

목 차

| | |
|------------------------------------|-----|
| 반기 보고서 | 1 |
| 【대표이사 등의 확인】 | 2 |
| I. 회사의 개요 | 3 |
| 1. 회사의 개요 | 3 |
| 2. 회사의 연혁 | 11 |
| 3. 자본금 변동사항 | 17 |
| 4. 주식의 총수 등 | 18 |
| 5. 정관에 관한 사항 | 19 |
| II. 사업의 내용 | 20 |
| 1. 사업의 개요 | 20 |
| 2. 주요 제품 및 서비스 | 22 |
| 3. 원재료 및 생산설비 | 23 |
| 4. 매출 및 수주상황 | 30 |
| 5. 위험관리 및 파생거래 | 35 |
| 6. 주요계약 및 연구개발활동 | 42 |
| 7. 기타 참고사항 | 48 |
| III. 재무에 관한 사항 | 68 |
| 1. 요약재무정보 | 68 |
| 2. 연결재무제표 | 71 |
| 3. 연결재무제표 주식 | 78 |
| 4. 재무제표 | 146 |
| 5. 재무제표 주식 | 152 |
| 6. 배당에 관한 사항 | 212 |
| 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 | 214 |
| 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 | 214 |
| 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 | 218 |
| 8. 기타 재무에 관한 사항 | 219 |
| IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 | 242 |
| V. 회계감사인의 감사의견 등 | 243 |
| 1. 외부감사에 관한 사항 | 243 |
| 2. 내부통제에 관한 사항 | 250 |
| VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 | 251 |
| 1. 이사회에 관한 사항 | 251 |
| 2. 감사제도에 관한 사항 | 265 |
| 3. 주주총회 등에 관한 사항 | 271 |
| VII. 주주에 관한 사항 | 274 |
| VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 | 284 |
| 1. 임원 및 직원 등의 현황 | 284 |
| 2. 임원의 보수 등 | 336 |
| IX. 계열회사 등에 관한 사항 | 345 |
| X. 대주주 등과의 거래내용 | 368 |
| XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 | 372 |
| 1. 공시내용 진행 및 변경사항 | 372 |
| 2. 우발부채 등에 관한 사항 | 372 |
| 3. 제재 등과 관련된 사항 | 375 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 | 384 |
| XII. 상세표 | 388 |
| 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 388 |
| 2. 계열회사 현황(상세) | 400 |
| 3. 타법인출자 현황(상세)..... | 417 |
| 4. 연구개발실적(상세) | 421 |
| 【전문가의 확인】 | 443 |
| 1. 전문가의 확인..... | 443 |
| 2. 전문가와의 이해관계 | 443 |

반기보고서

(제 55 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 06월 30일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2023년 8월 14일

제출대상법인 유형 :

주권상장법인

면제사유발생 :

해당사항 없음

회 사 명 :

삼성전자주식회사

대 표 이 사 :

한 종 희

본 점 소 재 지 :

경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)

(전 화) 031-200-1114

(홈페이지) <http://www.samsung.com/sec>

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재경팀장 (성 명) 김 동 욱

(전 화) 031-277-7218

【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당임원으로서
2023년 반기보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여
직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의
누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 반기보고서에 표시된
기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이
기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제8조의 규정에
따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.


2023. 8. 14

삼성전자 주식회사

대표이사: 한 종 회



신고업무 담당임원: 박 학 규



I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적·상업적 명칭

당사의 명칭은 삼성전자주식회사이고 영문명은 Samsung Electronics Co., Ltd.입니다.

나. 설립일자

당사는 1969년 1월 13일에 삼성전자공업주식회사로 설립되었으며, 1975년 6월 11일 기업공개를 실시하였습니다.

당사는 1984년 2월 28일 정기주주총회 결의에 의거하여 상호를 삼성전자공업주식회사에서 삼성전자주식회사로 변경하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)

전화번호: 031-200-1114

홈페이지: <https://www.samsung.com/sec>

라. 주요 사업의 내용

당사는 제품의 특성에 따라 DX(Device eXperience), DS(Device Solutions) 2개의 부문과 패널 사업을 영위하는 SDC(삼성디스플레이(주) 및 그 종속기업), 전장부품사업 등을 영위하는 Harman(Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업)으로 나누어 경영을 하고 있습니다.

당사는 본사를 거점으로 한국과 DX 부문 산하 해외 9개 지역총괄, DS 부문산하 해외 5개 지역총괄의 생산·판매법인 및 SDC, Harman 산하 종속기업 등 233개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

각 부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

| 부문 | 주요 제품 |
|--------|---|
| DX 부문 | TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등 |
| DS 부문 | DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등 |
| SDC | 스마트폰용 OLED 패널 등 |
| Harman | 디지털 콕핏(Digital Cockpit), 텔레매틱스(Telematics), 스피커 등 |

※ 당사는 2021년 12월 조직개편을 통해 CE 부문과 IM 부문을 DX 부문으로 통합하였으며, 내부 조직체계에 맞추어 SDC를 DS 부문과 별도로 구분하였습니다.

[DX 부문]

DX 부문은 TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 및 휴대폰, 태블릿, 웨어러블(Wearable) 제품 등을 생산·판매하는 사업을 영위하고 있습니다. Neo QLED 등 프리미엄 기술력을 바탕으로 한 프리미엄 TV, 경험을 중시하는 소비자들의 라이프스타일(Lifestyle)에 맞춰 출시한 Lifestyle TV, 그리고 소비자들의 다양한 Needs에 맞춘 비스포크(BESPOKE) 제품 등 차별화된 제품, 기술 및 디자인으로 글로벌 디지털 시장을 이끌고 있으며 특히 TV는 2022년까지 17년 연속으로 세계 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 또한 핵심제품인 스마트폰은 '갤럭시(GALAXY)' 브랜드를 통해 프리미엄부터 보급형까지 폭넓은 제품 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 당사는 앞으로도 프리미엄 TV와 Lifestyle TV 시장에서의 혁신 노력을 계속하고, 비스포크(BESPOKE) 제품의 글로벌 판매를 본격 강화하는 한편, Galaxy Ecosystem을 통해 고객들이 모바일 뿐 아니라 TV와 가전까지 편리하게 활용할 수 있는 최고의 Multi Device 경험을 제공해 나가겠습니다. 또한 소비자의 Needs와 Trend를 반영한 신제품을 지속적으로 출시하여 글로벌 브랜드로서의 위상 및 시장 지배력을 계속 강화해 나가고 단말, 칩셋으로 이어지는 End-to-End 솔루션과 5G 초기시장에서의 상용화 경험을 바탕으로 글로벌 5G 시장을 리드하겠습니다.

[DS 부문]

DS 부문은 DRAM, NAND Flash 등 제품을 생산·판매하는 메모리 반도체 사업과 모바일 AP, 카메라 센서칩 등을 설계·판매하는 System LSI 사업, 반도체 제조 위탁 생산을 하는 Foundry 사업 등으로 구성되어 있습니다.

메모리 반도체 사업은 DRAM, NAND Flash 제품 등에 선단 공정 기술을 적용하고, 고부가 솔루션 중심의 사업 포트폴리오 운영을 통해 제품을 차별화하고 원가 경쟁력을 제고하는 등 질적 성장에 주력하여 전 세계 메모리 시장에서 선두 자리를 지속적으로 유지하고 있습니다.

System LSI 사업은 모바일용 반도체 사업에서 차량용 반도체 사업으로 확장을 추진 중이며, 선형 공정 개발을 통한 AP, CIS 등 제품의 차별화 및 파운드리 공급처를 다변화하여 시장 수요에 대응하는 등 시장 지배력을 확대하고 있습니다.

Foundry 사업은 선단 공정에서 요소 기술과 신구조 도입을 통해 기술 경쟁력을 확보하고, 글로벌 반도체 수요 약세 상황에서도 공급역량을 확보하는 한편, 레거시 공정은 다양한 고객/응용처의 사업구조로 전환 추진하여 사업을 확장하고 있습니다.

[SDC]

SDC의 중소형 패널 사업은 차별화된 기술을 바탕으로 OLED 패널의 점유율을 확대하는 한편 폴더블·롤러블·전장 등 신규 응용처의 제품 출시를 통해 시장 영역을 넓혀 나가고 있습니다. 또한, 대형 패널 사업은 고화질, 초대형, 퀀텀닷(Quantum Dot) 등 프리미엄 제품 중심으로 사업을 특화하고, 기술 및 생산성 향상을 지속 추진하여 사업 경쟁력을 제고하고 있습니다.

[Harman]

Harman은 커넥티드카 제품 및 솔루션 등을 디자인하고 개발하는 전장부품 사업과 소비자 오디오 제품 및 프로페셔널 오디오 솔루션을 제공하는 라이프스타일 오디오 사업으로 구성되어 있습니다. Harman은 전장부품 시장의 선도업체로서 완성차 업체들에게 혁신 기술을 적용한 제품을 공급하는 한편, 오디오 시장에서도 기술혁신을 통해 일반 소비자들과 음악 애호가 사이에서 명성을 쌓아왔습니다. Harman은 시장 인지도가 높은 브랜드와 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 자체 개발 및 전략적 인수 등을 통해 각 사업 분야에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.

☞ 사업부문별 자세한 사항은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

마. 연결대상 종속회사 현황(요약)

기업회계기준서(K-IFRS) 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사(최상위)인 당사의 연결대상 종속기업은 2023년 반기말 현재 233개사입니다.
전년말 대비 4개 기업이 증가하고 3개 기업이 감소하였습니다.

(단위 : 사)

| 구분 | 연결대상회사수 | | | | 주요 종속회사수 |
|-----|---------|----|----|-----|-------------|
| | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |
| 상장 | - | - | - | - | - |
| 비상장 | 232 | 4 | 3 | 233 | 141 |
| 합계 | 232 | 4 | 3 | 233 | 141 |

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(당기 연결대상회사의 변동내용)

| 구분 | 자회사 | 사유 |
|----------|-----------------------------|----|
| 신규 연결 | SVIC 62호 신기술투자조합 | 설립 |
| | Samsung Federal, Inc. (SFI) | 설립 |
| | Emerald Intermediate, Inc. | 설립 |
| | Emerald Merger Sub, Inc. | 설립 |
| 연결 제외 | Dacor Holdings, Inc. | 합병 |
| | Dacor, Inc. | 합병 |
| | Red Bend Software Ltd. | 청산 |

바. 중소기업 해당 여부

당사는 「중소기업기본법」 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

| | |
|------------|-----|
| 중소기업 해당 여부 | 미해당 |
| 벤처기업 해당 여부 | 미해당 |
| 중견기업 해당 여부 | 미해당 |

사. 신용평가에 관한 사항

당사는 Moody's(미국) 및 S&P(미국)로부터 신용등급 평가를 받고 있습니다. 2023년 반기말 현재 Moody's의 당사 평가등급은 Aa2, 전망치는 안정적(Stable)이고, S&P의 당사 평가등급은 AA-, 전망치는 안정적(Stable)입니다.

| 평가대상 유가증권 | 평가일 | 평가대상 유가증권의 신용등급 | 평가회사 | 비고 |
|---|---------|--------------------|---------|------|
| 회사채 US\$ Bond ('97년 발행, '27년 만기) | 2021.07 | AA- | S&P | 정기평가 |
| | 2021.08 | Aa3 | Moody's | 정기평가 |
| | 2022.08 | AA- | S&P | 정기평가 |
| | 2022.09 | Aa2 | Moody's | 정기평가 |

※ 2023.7월 S&P(미국) 신용등급: AA-, 2023.8월 Moody's(미국) 신용등급: Aa2

※ 신용평가등급 범위: Moody's (Aaa~C), S&P (AAA~D)

| 구분 | Moody's | | S&P | |
|------------|--------------------|---|-------------------|---|
| | 등급 | 정의 | 등급 | 정의 |
| 투자적격 등급 | Aaa | 채무상환능력 최상, 신용위험 최소 | AAA | 채무상환능력이 극히 높음, 최고등급 |
| | Aa1/Aa2/Aa3 | 채무상환능력 높음, 신용위험 매우 낮음 | AA+/AA/AA- | 채무상환능력이 매우 높음 |
| | A1/A2/A3 | 채무상환능력 중상, 신용위험 낮음 | A+/A/A- | 채무상환능력은 충분하나 경제 상황 악화 및 변화에 다소 취약함 |
| | Baa1/Baa2/ Baa3 | 채무상환능력 중간, 신용위험 크지 않으나 투기적 요소가 있음 | BBB+/BBB/ BBB- | 채무상환능력은 충분하나 상위 등급에 비해 경제 상황 악화에 좀 더 취약함 |
| 투기 등급 | Ba1/Ba2/Ba3 | 투기적 성향, 신용위험 상당함 | BB+/BB/BB- | 가까운 장래에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 낮으나 경영, 재무, 경제 상황 악화에 대한 불확실성이 큼 |
| | B1/B2/B3 | 투기적 성향, 신용위험 높음 | B+/B/B- | 경영, 재무, 경제 상황 악화에 좀 더 취약하나 현재로서는 채무상환능력이 있음 |
| | Caa | 투기적 성향 높음, 신용위험 매우 높음 | CCC | 현재 채무불이행 가능성이 있으며 채무상환은 경영, 재무, 경제 상황이 호의적일 경우에만 가능함 |
| | Ca | 투기적 성향 매우 높음, 가까운 시일 내 부도발생 가능, 원리금 상환가능성 존재 | CC | 채무불이행 가능성이 높음, 부도 상태는 아니지만 사실상 부도가 예상됨 |
| | C | 부도 상태, 원리금 상환가능성 낮음 | C | 현재 채무불이행 가능성이 매우 높으며 최종 회수율은 상위등급 채무보다 낮게 추정됨 |
| | | | D | 금융채무불이행 상태 혹은 묵시적 계약 (imputed promises) 파 기, 또는 파산 신청 혹은 이와 유사한 상태 |

☞ 당사의 종속기업이 발행한 회사채 및 기업어음 등에 대한 신용등급 평가결과는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

아. 주권상장(또는 등록·지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

당사는 1975년 6월 11일 유가증권시장에 기업공개를 실시하였습니다.

| 주권상장 (또는 등록·지정)여부 | 주권상장 (또는 등록·지정)일자 | 특례상장 등 여부 | 특례상장 등 적용법규 |
|----------------------|----------------------|--------------|----------------|
| 유가증권시장 | 1975년 06월 11일 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

| | |
|------------|---|
| 1969.01.13 | 삼성전자공업주식회사로 설립 |
| 1975.06.11 | 기업공개 |
| 1984.02.28 | 삼성전자주식회사로 상호 변경 |
| 1988.11.01 | 삼성반도체통신주식회사 흡수 합병 |
| 2012.04.01 | LCD사업부 분사(삼성디스플레이(주) 설립) |
| 2017.03.10 | 전장 기업 Harman International Industries, Inc. 지분(100%) 인수 |
| 2017.07.04 | 세계 최대 규모 평택 반도체 라인 가동 |
| 2019.04.03 | '갤럭시 S10 5G' 5G 스마트폰 출시 |
| 2019.06.04 | 소비자 라이프스타일 맞춤형 냉장고 '비스포크(BESPOKE)' 출시 |
| 2019.09.04 | '엑시노스 980' 5G 모바일 프로세서 공개 |
| 2019.09.06 | '갤럭시 폴드' 새로운 폼팩터 폴더블폰 공개 |
| 2020.01.29 | '그랑데 AI' 인공지능 기반 세탁기·건조기 출시 |
| 2020.02.04 | AI·차세대 슈퍼컴퓨터용 초고속 DRAM 출시 |
| 2020.02.11 | '갤럭시 Z 플립' 폴더블폰 공개 |
| 2020.08.30 | 세계 최대 규모 평택 반도체 2라인 가동 |
| 2021.01.07 | 'Neo QLED TV' 공개 |
| 2021.05.11 | '비스포크 홈' 글로벌 시장 확대 선언 |
| 2021.06.03 | 전세계 반도체 업체 최초 전 사업장 '탄소/물/폐기물 저감' 인증 |
| 2021.08.11 | '갤럭시 Z 폴드3', '갤럭시 Z 플립3' 공개 |
| 2021.10.12 | 업계 최선단 14나노 EUV DDR5 D램 양산 |
| 2021.11.09 | 업계 최초 LPDDR5X D램 개발 |
| 2021.11.24 | 미국 테일러시에 신규 파운드리 라인 투자 발표 |
| 2022.02.10 | '갤럭시 S22' 시리즈 공개 |
| 2022.02.17 | 비스포크 인피니트 라인 공개 |
| 2022.06.30 | 세계 최초 3나노 GAA 파운드리 양산 |
| 2022.08.10 | '갤럭시 Z 폴드4', '갤럭시 Z 플립4' 공개 |
| 2022.08.19 | 차세대 반도체 R&D단지 기공식 |
| 2022.09.15 | '신환경경영전략' 선언 |
| 2022.11.07 | 1Tb 8세대 V낸드 양산 |
| 2022.12.21 | 업계 최선단 12나노급 16Gb DDR5 D램 개발 |
| 2023.01.17 | 초고화소 기술 집약된 2억 화소 이미지센서 '아이소셀 HP2' 출시 |
| 2023.02.01 | '갤럭시 S23' 시리즈 공개 |
| 2023.05.12 | 업계 최초 'CXL 2.0 D램' 개발 |
| 2023.05.18 | 업계 최선단 12나노급 D램 양산 |
| 2023.06.29 | 체험형 플래그십 스토어 '삼성 강남' 오픈 |

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본점소재지는 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)입니다.
최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경 사항은 없습니다.

다. 경영진의 중요한 변동

2023년 반기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(한종희, 경계현, 노태문, 박학규, 이정배)과 사외이사 6인(김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희) 등 총 11인의 이사로 구성되어 있습니다.

| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | | 임기만료 또는 해임 |
|------------|------|--|--|--|
| | | 신규 | 재선임 | |
| 2019.03.20 | 정기주총 | 사외이사 김한조 사외이사 안규리 | 사외이사 박재완 | 사외이사 이인호 사외이사 송광수 |
| 2019.10.26 | - | - | - | 사내이사 이재용 |
| 2020.02.14 | - | - | - | 사내이사 이상훈(사임) |
| 2020.03.18 | 정기주총 | 사내이사 한종희 사내이사 최윤희 | - | - |
| 2021.03.17 | 정기주총 | - | 사내이사 김기남 사내이사 김현석 사내이사 고동진 사외이사 박병국 사외이사 김종훈 사외이사 김선욱 | - |
| 2021.03.17 | - | - | 대표이사 김기남 대표이사 김현석 대표이사 고동진 | - |
| 2021.12.31 | - | - | - | 사내이사 최윤희(사임) |
| 2022.02.15 | - | 대표이사 한종희 | - | 대표이사 김기남(사임) 대표이사 김현석(사임) 대표이사 고동진(사임) |
| 2022.03.16 | 정기주총 | 사내이사 경계현 사내이사 노태문 사내이사 박학규 사내이사 이정배 사외이사 한화진 사외이사 김준성 | 사외이사 김한조 | - |
| 2022.03.16 | - | - | - | 사내이사 김기남(사임) 사내이사 김현석(사임) 사내이사 고동진(사임) |
| 2022.03.16 | - | 대표이사 경계현 | - | - |
| 2022.03.19 | - | - | - | 사외이사 박재완 사외이사 안규리 |

| | | | | |
|------------|------|----------------------|----------|--------------|
| 2022.04.20 | - | - | - | 사외이사 한화진(사임) |
| 2022.05.17 | - | - | - | 사외이사 박병국(퇴임) |
| 2022.11.03 | 임시주총 | 사외이사 허은녕 사외이사 유명희 | - | - |
| 2023.03.15 | 정기주총 | - | 사내이사 한종희 | - |
| 2023.03.15 | - | - | 대표이사 한종희 | - |

- ※ 2021년 3월 17일 이사회에서 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.
- ※ 2021년 12월 31일 최윤호 사내이사가 사임하였습니다.
- ※ 2022년 2월 15일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 대표이사직에서 사임하였으며, 동일 개최한 이사회에서 한종희 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.
- ※ 2022년 3월 16일 주주총회를 통해 경계현, 노태문, 박학규, 이정배 사내이사와 한화진, 김준성 사외이사가 신규 선임되었고, 김한조 사외이사가 재선임되었습니다.
- ※ 2022년 3월 16일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 사임하였습니다.
- ※ 2022년 3월 16일 이사회를 통해 경계현 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.
- ※ 2022년 3월 19일 박재완, 안규리 사외이사의 임기가 만료되었습니다.
- ※ 2022년 4월 20일 한화진 사외이사가 사임하였습니다.
- ※ 2022년 5월 17일 박병국 사외이사가 퇴임하였습니다.
- ※ 2022년 11월 3일 주주총회를 통해 허은녕, 유명희 사외이사가 신규 선임되었습니다.
- ※ 2023년 3월 15일 이사회를 통해 한종희 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

라. 최대주주의 변동

2021년 4월 29일에 기존 최대주주가 소유하던 당사 주식의 상속으로 인해 최대주주가 삼성생명보험(주)으로 변동되었습니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 주, %)

| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비고 |
|------------|-----------|---------------|--------|---------------|----|
| 2021.04.29 | 삼성생명보험(주) | 1,263,050,053 | 21.16% | 변동전 최대주주의 피상속 | - |

※ 소유주식수 및 지분율은 최대주주 및 그 특수관계인의 합산 내역이며, 의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다.

☞ 최대주주 관련 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

마. 상호의 변경

2019년 중에는 종속기업 Samsung Electronics Greece S.A. (SEGR) 사명이 Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)로 변경되었습니다.

2021년 중에는 종속기업 Samsung Electronics Portuguesa S.A. (SEP) 사명이 Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)로 변경되었습니다.

☞ 당사(지배기업) 및 주요 종속기업 기준으로 작성하였습니다.
주요 종속기업에 대한 사항은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참조하시기 바랍니다.

바. 합병 등에 관한 사항

2019년 중 종속기업 Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)은 Corephotonics Ltd. 지분을 인수하였으며, 당사는 관계기업인 삼성전기(주)의 PLP(Panel Level Package) 사업을 양수하였습니다. 또한, 종속기업 Duran Audio B.V.가 종속기업 HarmanBecker Automotive Systems Manufacturing Kft에 합병되었으며, 종속기업 Samsung Electronics (Beijing) Service Company Limited (SBSC)가 종속기업 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)에 합병되었습니다.

2021년 중 종속기업 Viv Labs, Inc.는 종속기업 Samsung Research America, Inc (SRA)에 합병되었습니다. 또한, 종속기업 Prismview, LLC는 종속기업 Samsung Electronics America, Inc. (SEA)에 합병되었습니다.

☞ 당사(지배기업) 및 주요 종속기업 기준으로 작성하였습니다.

주요 종속기업에 대한 사항은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참조하시기 바랍니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다.

아. 그 밖에 경영 활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

당사는 2021년 12월 중 기존의 CE 부문과 IM 부문을 DX 부문으로 통합하였으며, 무선사업부의 명칭을 MX(Mobile eXperience)사업부로 변경하였습니다. 또한 내부 조직 체계에 맞추어 SDC를 DS 부문과 별도로 구분하였습니다.

[2021년 12월]

| | 변경전 | 변경후 |
|----------|--|---|
| 사업 조직 | CE 부문 (영상디스플레이, 생활가전, 의료기기) | DX 부문 (영상디스플레이, 생활가전, 의료기기, Mobile eXperience, 네트워크) |
| | IM 부문 (무선, 네트워크) | |
| | DS 부문 (메모리, System LSI, Foundry, DP) | DS 부문 (메모리, System LSI, Foundry) |
| | | SDC (DP) |
| | Harman 부문 | Harman |
| 지역 총괄 | 한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카 | 한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카 |
| | 미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS) | 미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS) |

3. 자본금 변동사항

자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

2023년 반기말 현재 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하 "보통주") 및 무의결권 기명식 우선주식(이하 "우선주")의 수는 각각 7,780,466,850주와 1,194,671,350주입니다. 당사는 2023년 반기말 현재까지 보통주 1,810,684,300주와 우선주 371,784,650주를 이사회 결의에 의거 이익으로 소각한 바 있습니다. 2023년 반기말 현재 유통주식수는 보통주 5,969,782,550주, 우선주 822,886,700주입니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 주)

| 구 분 | 주식의 종류 | | | 비고 |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|-------|
| | 보통주 | 우선주 | 합계 | |
| I. 발행할 주식의 총수 | 20,000,000,000 | 5,000,000,000 | 25,000,000,000 | - |
| II. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 7,780,466,850 | 1,194,671,350 | 8,975,138,200 | - |
| III. 현재까지 감소한 주식의 총수 | 1,810,684,300 | 371,784,650 | 2,182,468,950 | - |
| 1. 감자 | - | - | - | - |
| 2. 이익소각 | 1,810,684,300 | 371,784,650 | 2,182,468,950 | 자사주소각 |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - |
| 4. 기타 | - | - | - | - |
| IV. 발행주식의 총수 (II-III) | 5,969,782,550 | 822,886,700 | 6,792,669,250 | - |
| V. 자기주식수 | - | - | - | - |
| VI. 유통주식수 (IV-V) | 5,969,782,550 | 822,886,700 | 6,792,669,250 | - |

5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2018년 3월 23일이며, 최근 3사업연도 및 작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변경된 정관 이력은 없습니다.

[사업목적 현황]

| 구분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|----|--|---------|
| 1 | 전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업 | 영위 |
| 2 | 통신기기기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업 | 영위 |
| 3 | 의료기기의 제작 및 판매업 | 영위 |
| 4 | 광디스크 및 광원응용기계기구와 그 부품의 제작, 판매, 서비스업 | 영위 |
| 5 | 광섬유, 케이블 및 관련 기기의 제조, 판매, 임대, 서비스업 | 영위 |
| 6 | 전자계산조직 및 동 관련 제품의 제조, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업 | 영위 |
| 7 | 저작물, 컴퓨터 프로그램 등의 제작, 판매, 임대업 | 영위 |
| 8 | 노우하우, 기술의 판매, 임대업 | 영위 |
| 9 | 정보통신 시스템에 관련된 구성 및 운영과 역무의 제공 | 영위 |
| 10 | 자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 서비스업 | 영위 |
| 11 | 공작기계 및 부품의 제작, 판매, 임대, 서비스업 | 영위 |
| 12 | 반도체 및 관련 제품의 제조, 판매업 | 영위 |
| 13 | 반도체 제조 장치의 제조, 판매업 | 영위 |
| 14 | 반도체 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업 | 영위 |
| 15 | 기타기계기구의 제작 및 판매업 | 영위 |
| 16 | 합성수지의 제조, 가공 및 판매업 | 영위 |
| 17 | 금을 제외한 금속의 제련가공 및 판매업 | 영위 |
| 18 | 수출입업 및 동 대행업 | 영위 |
| 19 | 경제성 식물의 재배 및 판매업 | 미영위 |
| 20 | 부동산업 | 영위 |
| 21 | 물품 매도 확약서 발행업 | 영위 |
| 22 | 계량기, 측정기 등의 교정 검사업 및 제작, 판매업 | 영위 |
| 23 | 전 각항의 기술용역, 정보통신 공사업 및 전기공사업 | 영위 |
| 24 | 주택사업 임대 및 분양 | 영위 |
| 25 | 운동, 경기 및 기타 관련사업 | 영위 |
| 26 | 전동기, 발전기 및 전기변환장치 제조업 | 영위 |
| 27 | 전기공급 및 제어장치 제조업 | 영위 |
| 28 | 교육 서비스업 및 사업 관련 서비스업 | 영위 |
| 29 | 각 항에 관련된 부대사업 및 투자 | 영위 |

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 본사를 거점으로 한국과 DX 부문 산하 해외 9개 지역총괄 및 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산·판매법인, SDC 및 Harman 산하 종속기업 등 233개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

사업별로 보면, Set 사업은 DX(Device eXperience) 부문이 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP(스마트폰 등), 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산·판매하며, 부품 사업은 DS(Device Solutions) 부문에서 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산·판매하고, SDC가 중소형 OLED 등의 디스플레이 패널(DP)을 생산·판매하고 있습니다. 또한, 2017년에 인수한 Harman에서는 디지털 콕핏(Digital Cockpit), 텔레매틱스(Telematics), 스피커 등을 생산·판매하고 있습니다.

당사는 2021년 12월 조직개편을 통해 기존의 CE 부문과 IM 부문을 DX 부문으로 통합하였으며, 무선사업부의 명칭을 MX(Mobile eXperience) 사업부로 변경하였습니다. 또한 내부 조직체계에 맞추어 SDC를 DS 부문과 별도로 구분하였습니다.

☞ 부문별 사업에 관한 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '다. 사업부문별 현황'과 '라. 사업부문별 요약 재무 현황' 항목을 참고하시기 바랍니다.

지역별로 보면, 국내에서는 DX 부문 및 DS 부문 등을 총괄하는 본사와 34개의 종속기업이 사업을 운영하고 있습니다. 본사는 수원, 구미, 광주, 기흥, 화성, 평택사업장 등으로 구성되어 있으며, 국내 종속기업은 디스플레이 패널을 생산하는 삼성디스플레이(주)와 국내 대리점 판매를 전담하는 삼성전자판매(주), 제품 수리 서비스를 담당하는 삼성전자서비스(주), 제품 운송을 담당하는 삼성전자로지텍(주) 등 비상장 종속기업들로 구성되어 있습니다.

해외(미주, 유럽·CIS, 중동·아프리카, 아시아 등지)에서는 생산, 판매, 연구활동 등을 담당하는 199개의 비상장 중속기업이 운영되고 있습니다.

미주에는 TV, HHP 등 Set 제품의 미국 판매를 담당하는 SEA(New Jersey, USA), TV 생산을 담당하는 SII(California, USA), 반도체·DP 판매를 담당하는 SSI(California, USA), 반도체 생산을 담당하는 SAS(Texas, USA), Set 제품 복합 생산법인 SEDA(Brazil), 전장부품 사업 등을 담당하는 Harman(Connecticut, USA) 등을 포함하여 총 46개의 판매·생산 등을 담당하는 법인이 있습니다.

유럽·CIS에는 SEUK(UK), SEG(Germany), SEF(France), SEI(Italy), SERC(Russia) 등 Set 제품 판매법인과 SEH(Hungary), SERK(Russia) 등 TV 생산법인, 가전제품 생산법인 SEPM(Poland) 등을 포함하여 총 71개의 법인이 운영되고 있습니다.

중동·아프리카에는 SGE(UAE), SSA(South Africa) 등 Set 제품 판매법인과 SEEG(Egypt), SSAP(South Africa) 등 TV 생산법인을 포함한 총 20개 법인이 운영되고 있습니다.

아시아(중국 제외)에는 SESP(Singapore), SEAU(Australia), SEPCO(Philippines), SME(Malaysia) 등 판매법인과, HHP 등 생산법인 SEV·SEVT(Vietnam), TV 등 생산법인 SEHC(Vietnam), DP 생산법인 SDV(Vietnam), 복합 생산법인 SIEL(India) 등을 포함한 총 32개의 법인이 운영되고 있습니다.

중국에는 SCIC(Beijing), SEHK(Hong Kong) 등 Set 제품 판매법인과 SSS(Shanghai), SSCX(Xian) 등 반도체·DP 판매법인, SSEC(Suzhou) 등 Set 제품 생산법인, SCS(Xian) 등 반도체 생산법인을 포함하여 총 30개의 법인이 운영되고 있습니다.

2023년 반기 당사의 매출은 123조 7,509억원으로 전년 동기 대비 20.2% 감소하였으며, 주요 매출처로는 Apple, Best Buy, Deutsche Telekom, Qualcomm, Verizon 등(알파벳순)이 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 매출

당사는 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP 등 완제품과 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등 반도체 부품 및 디스플레이 패널 등을 생산·판매하고 있습니다. 아울러 Harman을 통해 디지털 콕핏, 텔레매틱스 등을 생산·판매하고 있습니다.

2023년 반기 매출은 DX 부문이 86조 4,287억원(69.8%), DS 부문이 28조 4,637억원(23.0%)이며, SDC가 13조 972억원(10.6%), Harman은 6조 6,616억원(5.4%)입니다.

(단위 : 억원, %)

| 부 문 | 주요 제품 | 매출액 | 비중 |
|--------|---|-----------|--------|
| DX 부문 | TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등 | 864,287 | 69.8% |
| DS 부문 | DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등 | 284,637 | 23.0% |
| SDC | 스마트폰용 OLED패널 등 | 130,972 | 10.6% |
| Harman | 디지털 콕핏, 텔레매틱스, 스피커 등 | 66,616 | 5.4% |
| 기타 | 부문간 내부거래 제거 등 | △109,003 | △8.8% |
| 총 계 | | 1,237,509 | 100.0% |

※ 각 부문별 매출액은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 세부 제품별 매출은 '4. 매출 및 수주상황' 항목을 참고하시기 바랍니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황

2023년 반기 TV의 평균 판매가격은 전년 대비 약 2% 하락하였으며, HHP는 전년 대비 약 12% 상승하였습니다. 그리고 메모리 평균 판매가격은 전년 대비 약 50% 하락하였으며, 디스플레이 패널(스마트폰용 OLED 패널)은 약 1% 상승하였습니다. 반면 디지털 콕핏의 평균 판매가격은 전년도와 유사한 수준입니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 현황

당사의 주요 원재료로 DX 부문은 모바일AP 솔루션, Camera Module 등을 Qualcomm, 삼성전기(주) 등에서 공급받고 있으며, TV·모니터용 디스플레이 패널 등을 CSOT 등으로부터 공급받고 있습니다. DS 부문은 Chemical, Wafer 등을 솔브레인(주), SK실트론(주) 등으로부터, SDC는 FPCA, Window 등을 (주)비에이치, Apple 등으로부터 공급받고 있습니다. Harman은 SOC(System-On-Chip) 등을 NVIDIA 등에서 공급받고 있습니다.

(단위 : 억원, %)

| 부 문 | 매입유형 | 품 목 | 구체적 용도 | 매입액 | 비중 | 주요 매입처 |
|--------|------|---------------------|---------------|---------|--------|-----------------------|
| DX 부문 | 원재료 | 모바일AP 솔루션 | CPU | 57,457 | 17.7% | Qualcomm, MediaTek 등 |
| | 원재료 | Camera Module | HHP 카메라 | 27,460 | 8.5% | 삼성전기(주), 파워로직스 등 |
| | 원재료 | 디스플레이 패널 | TV·모니터용 화상신호기 | 19,521 | 6.0% | CSOT, AUO, BOE 등 |
| | 원재료 | 기타 | - | 220,408 | 67.8% | |
| | 소 계 | | | 324,846 | 100.0% | |
| DS 부문 | 원재료 | Chemical | 원판 가공 | 13,656 | 16.3% | 솔브레인(주), 동우화인켐(주) 등 |
| | 원재료 | Wafer | 반도체 원판 | 12,324 | 14.7% | SK실트론(주), Siltronic 등 |
| | 원재료 | 기타 | - | 57,658 | 69.0% | |
| | 소 계 | | | 83,638 | 100.0% | |
| SDC | 원재료 | FPCA | 구동회로 | 9,295 | 20.7% | (주)비에이치, 영풍전자 등 |
| | 원재료 | Window | 강화유리 | 6,680 | 14.9% | Apple, Biel 등 |
| | 원재료 | 기타 | - | 28,926 | 64.4% | |
| | 소 계 | | | 44,901 | 100.0% | |
| Harman | 원재료 | SOC(System-On-Chip) | 자동차용 제품 | 3,903 | 15.8% | NVIDIA, Intel 등 |
| | 원재료 | 기타 | - | 20,844 | 84.2% | |
| | 소 계 | | | 24,747 | 100.0% | |
| 기타 | 원재료 | - | - | 194 | - | |
| 총 계 | | | | 478,326 | - | |

※ 매입액은 부문 등 간의 내부거래를 포함하고 있지 않습니다.

※ 비중은 각 부문의 원재료 총매입액 대비 각 품목의 매입액 비중입니다.

※ 주요 매입처 중 삼성전기(주)는 계열회사입니다.

※ AP와 그 주변부품의 높은 연관성을 감안하여, 2023년 반기부터 기존 모바일AP에서 모바일AP 솔루션(AP와 AP전용 IC류 자재 포함) 가격으로, DX부문 주요 원재료 현황을 작성하였습니다.

(단위 : 억원)

| 매입액 | 2023년 1분기 | 2022년 | 2021년 |
|-----------|-----------|---------|--------|
| 모바일AP 솔루션 | 31,450 | 113,790 | 76,295 |

나. 주요 원재료 가격 변동 추이

DX 부문의 주요 원재료인 모바일AP 솔루션 가격은 전년 대비 약 30% 상승하였고, CameraModule 가격은 전년 대비 약 14% 상승하였으며, TV·모니터용 디스플레이 패널 가격은 약 4% 하락하였습니다. DS 부문의 주요 원재료 중 반도체 Wafer 가격은 전년 대비 약 1% 상승하였으며, SDC의 FPCA 가격은 약 5% 하락, 강화유리용 Window 가격은 약 9% 하락하였습니다. Harman의 원재료 중 SOC(System-On-Chip)가격은 전년 대비 약 10% 상승하였으며, 자동차용 메모리는 약 7% 상승하였습니다.

※ AP와 그 주변부품의 높은 연관성을 감안하여, 2023년 반기부터 기존 모바일AP에서 모바일AP 솔루션(AP와 AP전용 IC류 자재 포함) 가격으로, DX부문 주요 원재료 가격 변동 추이를 작성하였습니다.

| 가격변동추이 | 2023년 1분기 | 2022년 | 2021년 |
|-----------|--------------|--------------|------------|
| 모바일AP 솔루션 | 전년 대비 37% 상승 | 전년 대비 46% 상승 | 전년과 유사한 수준 |

다. 생산능력, 생산실적, 가동률

(생산능력)

(단위 : 천대, 천개)

| 부 문 | 품 목 | 제55기 반기 | 제54기 | 제53기 |
|--------|--------|-------------|---------------|---------------|
| DX 부문 | 영상기기 | 26,816 | 55,747 | 54,235 |
| | HHP | 147,750 | 332,170 | 319,550 |
| DS 부문 | 메모리 | 940,540,300 | 1,905,731,836 | 1,756,009,941 |
| SDC | DP | 1,142 | 2,700 | 3,604 |
| Harman | 디지털 콕핏 | 5,649 | 11,257 | 9,066 |

※ 생산능력은 주요 제품의 연결 기준입니다.

DX 부문의 주요 품목별 생산능력은 '평균 라인 수'×'시간당 평균 생산실적'×'일 평균 가동시간'×'표준 가동일수'로 산출하였으며, DS 부문의 메모리 생산능력은 1Gb환산 기준으로 환산 생산실적(패키지OUT 기준)을 가동률로 나눠서 생산능력을 산출하고 있습니다. SDC의 경우 라인별 생산 가능한 제품의 총 면적을 8세대 Glass (2,200×2,500mm)로 환산하고 있으며, Harman의 디지털 콕핏 생산능력은 '각 거래처·제품별 생산셀(조립, 테스트) 수'×'각 생산셀별 시간당 생산능력'×'1일 표준 생산시간'×'표준생산일수'로 산출하였습니다.

(생산실적)

2023년(제55기) 반기 DX 부문의 영상기기 생산실적은 19,268천대이며 멕시코, 베트남, 브라질, 헝가리 등 세계 각 지역에서 생산되고 있으며, HHP 생산실적은 95,354천대이며 한국(구미), 베트남, 인도, 브라질 등 지역에서 생산되고 있습니다. DS 부문의 메모리 생산실적은 940,540백만개(1Gb 환산 기준)이며 한국(화성, 평택 등), 중국에서 생산하고 있습니다. SDC의 DP 생산실적은 639천개이며 한국(천안, 아산) 등에서 생산 중입니다. Harman의 디지털 콕핏 생산실적은 4,108천개입니다.

(단위 : 천대, 천개)

| 부 문 | 품 목 | 제55기 반기 | 제54기 | 제53기 |
|--------|--------|-------------|---------------|---------------|
| DX 부문 | 영상기기 | 19,268 | 41,802 | 44,133 |
| | HHP | 95,354 | 229,180 | 260,501 |
| DS 부문 | 메모리 | 940,540,300 | 1,905,731,836 | 1,756,009,941 |
| SDC | DP | 639 | 2,008 | 2,849 |
| Harman | 디지털 콕핏 | 4,108 | 8,334 | 6,928 |

※ 생산실적은 주요 제품의 연결 기준입니다.

(가동률)

당사 DX 부문의 2023년(제55기) 반기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, 영상기기 71.9%, HHP 64.5%입니다.

(단위 : 천대)

| 부 문 | 품 목 | 제55기 반기 | | |
|-------|------|---------|----------|-------|
| | | 생산능력 대수 | 실제 생산 대수 | 가동률 |
| DX 부문 | 영상기기 | 26,816 | 19,268 | 71.9% |
| | HHP | 147,750 | 95,354 | 64.5% |

DS 부문의 메모리 사업과 SDC의 DP 사업은 24시간 3교대 작업을 실시하고 있으며, 2023년(제55기) 반기 누적 가동일은 휴일을 포함하여 총 181일입니다. 가동률은 가동 가능시간 (가동일 × 생산라인 수 × 24시간) 대비 실제 가동 시간으로 산출하였습니다.

(단위 : 시간)

| 부 문 | 품 목 | 제55기 반기 | | |
|-------|-----|----------|----------|------|
| | | 가동 가능 시간 | 실제 가동 시간 | 가동률 |
| DS 부문 | 메모리 | 43,440 | 43,440 | 100% |
| SDC | DP | 21,720 | 21,720 | 100% |

Harman의 2023년 반기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며 72.7%입니다.

(단위 : 천개)

| 부 문 | 품 목 | 제55기 반기 | | |
|--------|--------|---------|----------|-------|
| | | 생산능력 개수 | 실제 생산 개수 | 가동률 |
| Harman | 디지털 콕핏 | 5,649 | 4,108 | 72.7% |

라. 생산설비 및 투자 현황 등

(생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등)

당사는 수원사업장을 비롯하여 구미, 광주, 화성, 평택, 아산 등 국내사업장 및 북미, 구주(유럽), 중국 등 해외 DX 부문 산하 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 5개 지역총괄, SDC 및 Harman 산하 중속기업 등에서 주요 제품의 생산, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업 활동을 수행하고 있습니다.

[주요 사업장 현황]

| 지역 | 사업장 | 소재지 |
|---|---------|---|
| 국내 (DX 부문, DS 부문, SDC 산하 12개 사업장) | 수원사업장 | 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동) |
| | 서초사업장 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동) |
| | 우면사업장 | 서울특별시 서초구 성촌길 33(우면동) |
| | 기흥사업장 | 경기도 용인시 기흥구 삼성로 1(농서동) |
| | 화성사업장 | 경기도 화성시 삼성전자로 1(반월동) |
| | 평택사업장 | 경기도 평택시 고덕면 삼성로 114 |
| | 천안사업장 | 충청남도 천안시 서북구 번영로 465 (성성동) |
| | 온양사업장 | 충청남도 아산시 배방읍 배방로 158 (복수리) |
| | 아산사업장 | 충청남도 아산시 탕정면 삼성로 181 (명암리) |
| | 구미1사업장 | 경상북도 구미시 1공단로 244(공단동) |
| | 구미2사업장 | 경상북도 구미시 3공단3로 302(임수동) |
| | 광주사업장 | 광주광역시 광산구 하남산단6번로 107(오선동) |
| 해외 (DX 부문 산하 9개 지역총괄) | 북미 총괄 | 85 Challenger Rd., Ridgefield Park, New Jersey, USA |
| | 구주 총괄 | 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK |
| | 중국 총괄 | No.31, Jinghui Street, Chaoyang, Beijing, China |
| | 동남아 총괄 | 30 Pasir Panjang Rd., Mapletree Business City, Singapore |
| | 서남아 총괄 | Two Horizon Centre, Golf Course RD, Gurgaon, Haryana, India |
| | CIS 총괄 | 31 Novinsky Boulevard, Moscow, Russia |
| | 중동 총괄 | Butterfly Building A, Dubai Media City, Dubai, UAE |
| | 아프리카 총괄 | 2929 William Nicol Drive, Bryanston, Johannesburg, South Africa |
| | 중남미 총괄 | Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240 Diamond Tower, Sao Paulo, Brazil |
| 해외 (DS 부문 산하 5개 지역총괄) | 미주 총괄 | 3655 N. 1st St. San Jose, California, USA |
| | 구주 총괄 | Koelner Str. 12, Eschborn, Germany |
| | 중국 총괄 | 3F, No.458, Fute North Rd., Shanghai, China |
| | 동남아 총괄 | 3 Church Street, #26-01 Samsung Hub, Singapore |
| | 일본 총괄 | Shinagawa Grand Central Tower, Konan, Minato, Tokyo, Japan |
| Harman | 미국 HQ | 400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA |

* Harman의 Automotive 사업은 미국(Novi), 독일(Garching) 등에서, Lifestyle 사업은 미국(Northridge) 등에서 영위하고 있습니다.

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2023년 반기말 현재 장부금액은 177조 8,699억원으로 전년말 대비 9조 8,245억원 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

| 구 분 | | 토지 | 건물및구축물 | 기계장치 | 건설중인자산 | 기타유형자산 | 계 |
|--------|------------------|---------|----------|------------|---------|---------|------------|
| 기 초 | 기초장부금액 | 98,922 | 407,069 | 797,146 | 336,076 | 41,241 | 1,680,454 |
| | - 취득원가 | 100,246 | 677,138 | 3,030,006 | 336,076 | 132,485 | 4,275,951 |
| | - 감가상각누계액(손상 포함) | △1,324 | △270,069 | △2,232,860 | - | △91,244 | △2,595,497 |
| 증 감 | 일반취득 및 자본적지출 | 1,491 | 15,478 | 97,754 | 141,789 | 6,481 | 262,993 |
| | 감가상각 | △247 | △18,757 | △148,591 | - | △8,091 | △175,686 |
| | 처분·폐기·손상 | △77 | △1,592 | △271 | - | △159 | △2,099 |
| | 기타 | 192 | 5,556 | 1,724 | 5,038 | 527 | 13,037 |
| 기 말 | 기말장부금액 | 100,281 | 407,754 | 747,762 | 482,903 | 39,999 | 1,778,699 |
| | - 취득원가 | 101,759 | 695,590 | 3,109,764 | 482,903 | 136,694 | 4,526,710 |
| | - 감가상각누계액(손상 포함) | △1,478 | △287,836 | △2,362,002 | - | △96,695 | △2,748,011 |

※ 토지의 감가상각은 기업회계기준서 제1116호 '리스'에 따른 사용권자산의 감가상각비입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 기타는 환율변동에 의한 증감액 및 관련 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 시가 판단이 어려워 기재를 생략했습니다.

(시설투자 현황)

2023년 반기 중 DS 부문 및 SDC 등의 첨단공정 증설·전환과 인프라 투자를 중심으로 25.3조원의 시설투자가 이루어졌습니다. 당사는 2023년 글로벌 시황 악화에도 불구하고 미래 경쟁력 강화 및 중장기 수요대비를 위한 투자를 지속적으로 추진 중이며, 내실 강화를 위한 투자 효율성 제고 활동도 병행할 계획입니다.

(단위 : 억원)

| 구 분 | 내 용 | 투자기간 | 대상자산 | 투자액 |
|-------|------------|-----------------|---------|---------|
| DS 부문 | 신·증설, 보완 등 | 2023.01~2023.06 | 건물·설비 등 | 232,473 |
| SDC | 신·증설, 보완 등 | 2023.01~2023.06 | 건물·설비 등 | 8,882 |
| 기 타 | 신·증설, 보완 등 | 2023.01~2023.06 | 건물·설비 등 | 11,238 |
| 합 계 | | | | 252,593 |

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

2023년 반기 매출은 123조 7,509억원으로 전년 동기 대비 20.2% 감소하였습니다. 부문별로 보면 전년 동기 대비 DX 부문이 6.6%, DS 부문이 48.6%, SDC는 16.5% 감소하였으며, Harman은 17.9% 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

| 부 문 | 매출유형 | 품 목 | 제55기 반기 | 제54기 | 제53기 |
|--------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| DX 부문 | 제·상품, 용역 및 기타매출 | TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등 | 864,287 | 1,824,897 | 1,662,594 |
| DS 부문 | 제·상품, 용역 및 기타매출 | DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등 | 284,637 | 984,553 | 953,872 |
| SDC | 제·상품, 용역 및 기타매출 | 스마트폰용 OLED 패널 등 | 130,972 | 343,826 | 317,125 |
| Harman | 제·상품, 용역 및 기타매출 | 디지털 콕핏, 텔레매틱스, 스피커 등 | 66,616 | 132,137 | 100,399 |
| 기 타 | 부문간 내부거래 제거 등 | | △109,003 | △263,099 | △237,942 |
| 합 계 | | | 1,237,509 | 3,022,314 | 2,796,048 |

※ 각 부문별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 제53기는 2021년 12월의 조직변경을 반영하여 재작성하였습니다.

(1) 주요 제품별 매출실적

(단위 : 억원)

| 구 분 | 제55기 반기 | 제54기 | 제53기 |
|------|---------|-----------|-----------|
| 영상기기 | 146,807 | 332,795 | 314,974 |
| 무선 | 553,532 | 1,154,254 | 1,046,806 |
| 메모리 | 178,844 | 685,349 | 726,022 |
| DP | 130,972 | 343,826 | 317,125 |

※ 각 제품별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

(2) 매출유형별 매출실적

(단위 : 억원)

| 구 분 | 제55기 반기 | 제54기 | 제53기 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 제·상품 | 1,161,192 | 2,903,461 | 2,658,785 |
| 용역 및 기타매출 | 76,317 | 118,853 | 137,263 |
| 계 | 1,237,509 | 3,022,314 | 2,796,048 |

※ 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다.

(3) 주요 지역별 매출 현황

(단위 : 억원)

| 구 분 | | 제55기 반기 | 제54기 | 제53기 |
|-----|----------|---------|-----------|-----------|
| 내수 | 국내 | 106,840 | 221,799 | 221,497 |
| | 미주 | 254,781 | 659,617 | 583,805 |
| 수출 | 유럽 | 114,392 | 265,147 | 258,227 |
| | 아시아·아프리카 | 164,885 | 425,114 | 336,671 |
| | 중국 | 178,080 | 546,998 | 597,247 |
| 계 | | 818,978 | 2,118,675 | 1,997,447 |

※ 별도 기준의 내수·수출 매출 현황입니다.

나. 판매경로 등

(1) 국내

| 판매자 | 판매 경로 | 소비자 |
|------------|------------------------------------|-----|
| 생산 및 매입 | 전속 대리점 | 소비자 |
| | 유통업체(양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등) | |
| | 통신사업자(SK텔레콤(주), (주)케이티, (주)LG유플러스) | |
| | 직접판매(B2B 및 온라인) | |

(2) 해외

| 판매자 | 판매 경로 | | | 소비자 | |
|-------------|-------|-----------------------|----------|----------|----------|
| 생산법인 | 판매법인 | Retailer | | 소비자 | |
| | | Dealer | Retailer | | |
| | | Distributor | Dealer | | Retailer |
| | | 통신사업자, Automotive OEM | | | |
| | | 직접판매(B2B 및 온라인) | | | |
| | 물류법인 | 판매법인 | Retailer | | |
| | | | Dealer | | Retailer |
| Distributor | | | Dealer | Retailer | |

(3) 판매경로별 매출액 비중

| 경로 | 도매 | 소매 | 특직판 | 기타 |
|----|-----|-----|-----|----|
| 비중 | 20% | 31% | 43% | 6% |

다. 판매방법 및 조건

(1) 국내

| 구 분 | 판매경로 | 대금회수조건 | 부대비용 비용분담 |
|-----------|-----------------------------|--------|------------------------------|
| 전속 | 대리점 | 약정여신조건 | 사안별 상호 협의하에 일부 분담 |
| 유통업체 | 양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등 | 개별계약조건 | 사안별 상호 협의하에 일부 분담 |
| 통신사업자 | SK텔레콤(주), (주)케이티, (주)LG유플러스 | 개별계약조건 | 사안별 상호 협의하에 일부 분담 (공동마케팅) |
| B2B 및 온라인 | 일반기업체 등 | 개별계약조건 | 없 음 |

(2) 해외

| 구 분 | 판매경로 | 대금회수조건 | 부대비용 비용분담 |
|-------------|---------------|--------|-------------------|
| Retailer | 소매점 | 개별계약조건 | 사안별 상호 협의하에 일부 분담 |
| Dealer | 양판점, 할인점, 백화점 | 개별계약조건 | 사안별 상호 협의하에 일부 분담 |
| Distributor | 현지 거래처 직판 영업 | 개별계약조건 | 사안별 상호 협의하에 일부 분담 |
| B2B 및 온라인 | 일반기업체 등 | 개별계약조건 | 없 음 |

라. 판매전략

- 프리미엄 제품을 중심으로 한 시장 우위 강화
- 브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공
- 고객 · 시장 중심의 수요 촉발 마케팅 강화

마. 주요 매출처

2023년 반기 당사의 주요 매출처로는 Apple, Best Buy, Deutsche Telekom, Qualcomm, Verizon 등(알파벳순)이 있습니다. 당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 14% 수준입니다.

바. 수주상황

2023년 반기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리정책

당사의 재무위험관리는 영업 활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책과 프로그램을 운영하고 있습니다. 위험을 회피하기 위한 파생상품의 이용도 이 프로그램에 포함되어 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 글로벌 재무위험관리정책을 수립한 후 주기적으로 재무위험 측정, 헷지 및 평가 등을 실행하고 있습니다.

한편 해외 주요 권역별로 지역 금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역 내 자금을 통합운용하여 유동성위험을 관리하고 있습니다.

당사 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다

나. 주요 재무위험관리

(1) 시장위험

(환율변동위험)

당사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR, INR 등이 있습니다.

당사는 환율변동과는 무관하게 통화별 자산과 부채 규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융 거래 발생 시 현지 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다.

또한, 당사는 효과적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

(이자율변동위험)

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무 활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.

(주가변동위험)

당사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

2023년 반기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 81,526백만원(전반기: 90,393백만원)이며, 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 4,309백만원(전반기: 3,413백만원)입니다.

(2) 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재경팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독하에 이루어지고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

(3) 유동성위험

대규모 투자가 많은 당사 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금 수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다.

당사는 주기적으로 미래 현금 흐름을 예측하여 유동성위험을 사전 관리하고 있습니다. 권역별로 Cash Pooling을 구축·활용하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 내부 자금을 활용하여 유동성위험을 효율적으로 관리하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사 간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성위험을 최소화하는 한편 자금운용부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 당사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

또한, 만약의 대규모 유동성 필요에 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있습니다.

(4) 자본위험

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

2023년 반기말 현재 당사는 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 Aa2 평가등급을 받고 있으며, 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 제55기 반기말 | 제54기말 |
|------|-------------|-------------|
| 부 채 | 89,024,926 | 93,674,903 |
| 자 본 | 358,975,626 | 354,749,604 |
| 부채비율 | 24.8% | 26.4% |

다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 환율변동 위험관리 목적상 장부 통화가 아닌 외화 포지션에 대하여 통화선도 (Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지하고 있습니다. 통화선도 상품은 매매목적 및 위험회피목적으로 은행을 통하여 매수 또는 매도하고 있습니다.

2023년 반기말 현재 당사는 USD, EUR, JPY 등 총 36개 통화에 대하여 2,662건의 통화선도 거래를 체결하고 있으며, 관련 자산·부채 장부금액 및 평가손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 자산 | 부채 | 평가이익 | 평가손실 |
|------|---------|---------|---------|---------|
| 통화선도 | 108,161 | 100,053 | 397,730 | 597,822 |

그리고 당사는 레인보우로보틱스(주) 및 그 최대주주 등과 체결한 주주간 계약에 따라, 일정 기간 동안 최대주주 등에게 최대주주 등이 보유하는 주식의 전부 또는 일부를 당사 또는 당사가 지정한 제3자에게 매도할 것을 청구할 권리를 보유하고 있습니다. 또한 레인보우로보틱스(주)의 최대주주 등은 일정한 사유가 발생할 경우, 당사가 보유한 레인보우로보틱스(주) 지분의 전부 또는 일부를 최대주주 등에게 매도할 것을 청구할 권리를 보유하고 있습니다. 2023년 반기말 현재 해당 콜옵션의 공정가치는 안진회계법인이 평가하였습니다.

또한, 종속회사인 삼성디스플레이(주)는 Corning Incorporated와 2021년 4월 8일 실행된 주식매매계약에 따라, 보유 중인 Corning 지분증권 일부를 Corning에게 매각할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다.

삼성디스플레이(주)는 TCL Technology Group Corporation (TCL) 및 TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)와 2021년 4월 1일 실행된 주주간 계약에 따라 CSOT가 상장기한 내 비상장 시, 삼성디스플레이(주)가 보유 중인 CSOT 지분증권 전부 또는 일부를 TCL에게 매각할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다. 2023년 반기말 현재 해당 풋옵션의 공정가치는 한영회계법인이 평가하였습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약 등

| 계약 상대방 | 항 목 | 내 용 |
|-----------------|-----------|---|
| Cisco | 계약 유형 | 상호 특허 사용 계약 |
| | 체결시기 | 2014.01.23 |
| | 목적 및 내용 | 상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소 |
| Google | 계약 유형 | 상호 특허 사용 계약 |
| | 체결시기 및 기간 | 2014.01.25 (영구) |
| | 목적 및 내용 | 상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소 |
| | 기타 주요내용 | 영구 라이선스 계약 (향후 10년간 출원될 특허까지 포함) |
| GlobalFoundries | 계약 유형 | 공정 기술 라이선스 계약 |
| | 체결시기 | 2014.02.28 |
| | 목적 및 내용 | 14nm 공정의 고객기반 확대 |
| InterDigital | 계약 유형 | 특허 사용 계약 |
| | 체결시기 | 2014.06.03 |
| | 목적 및 내용 | 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소 |
| Qualcomm | 계약 유형 | 상호 특허 사용 계약 |
| | 체결기간 | 2022.07.06 |
| | 목적 및 내용 | 상호 특허 라이선스 · 부제소를 통한 사업자유도 확보 |
| Apple | 계약 유형 | 소취하 계약 |
| | 체결시기 | 2018.06.26 |
| | 목적 및 내용 | 양사 간 미국에서 진행 중인 모든 소송 취하 |
| Nokia | 계약 유형 | 특허 사용 계약 |
| | 체결시기 | 2023.01.19 |
| | 목적 및 내용 | 특허 라이선스 체결을 통한 사업자유도 확보 |
| Microsoft | 계약 유형 | 상호 특허 사용 계약 |
| | 체결시기 | 2019.02.11 |
| | 목적 및 내용 | 상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소 |
| Google | 계약 유형 | EMADA |
| | 체결시기 및 기간 | 2023.01.01~2023.12.31(연장) |
| | 목적 및 내용 | 유럽 31개국(EEA) 대상으로 Play Store, YouTube 등 구글 앱 사용에 대한 라이선스 계약 |
| Huawei | 계약 유형 | 상호 특허 사용 계약 |
| | 체결시기 | 2022.07.13 |
| | 목적 및 내용 | 상호 특허 라이선스 확보로 사업 자유도 확보 |
| AMD | 계약 유형 | 기술 라이선스 계약 |
| | 체결시기 | 2019.05.30 |
| | 목적 및 내용 | 모바일 및 기타 응용 제품에 활용할 수 있는 그래픽 설계자산 확보 |
| Sharp | 계약 유형 | 상호 특허 사용 계약 |

| | | |
|----------|---------|--------------------------------------|
| | 체결시기 | 2019.07.30 |
| | 목적 및 내용 | 상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소 |
| Ericsson | 계약 유형 | 상호 특허 사용 계약 |
| | 체결시기 | 2021.05.07 |
| | 목적 및 내용 | 상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소 |

※ 계약 체결 금액 등 기타 분쟁에 참고가 될 사항은 기재하지 않았습니다.

나. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용

당사는 고객의 요구를 먼저 파악하고 발상의 전환을 통해 창조적이고 혁신적인 제품, 미래를 선도하는 기술을 지속적으로 창출하여 세계 시장을 선도해 나가고 있습니다. 또한, 세계 IT업계에서의 위상을 더욱 굳건히 하기 위해 차세대 기술과 원천기술을 확보하여 세계 산업 기술을 이끄는 진정한 선도 기업(Leading Company)이 되도록 최선을 다하고 있습니다.

2023년(제55기) 반기 당사의 연구개발비용은 13조 7,779억원이며, 이 중 정부보조금으로 차감되거나 자산화된 연구개발비를 제외하고 13조 7,773억원을 당기비용으로 회계처리하였습니다.

[연구개발비용]

(단위 : 백만원, %)

| 과 목 | | 제55기 반기 | 제54기 | 제53기 |
|---|---------------|------------|------------|------------|
| 연구개발비용 총계 | | 13,777,881 | 24,929,171 | 22,596,487 |
| (정부보조금) | | △592 | △9,973 | △1,053 |
| 연구개발비용 계 | | 13,777,289 | 24,919,198 | 22,595,434 |
| 회계 처리 | 개발비 자산화(무형자산) | - | - | △193,708 |
| | 연구개발비(비용) | 13,777,289 | 24,919,198 | 22,401,726 |
| 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 총계 ÷ 당기매출액 × 100] | | 11.1% | 8.2% | 8.1% |

※ 연결 누계기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다.

다. 연구개발 조직 및 운영

(국내)

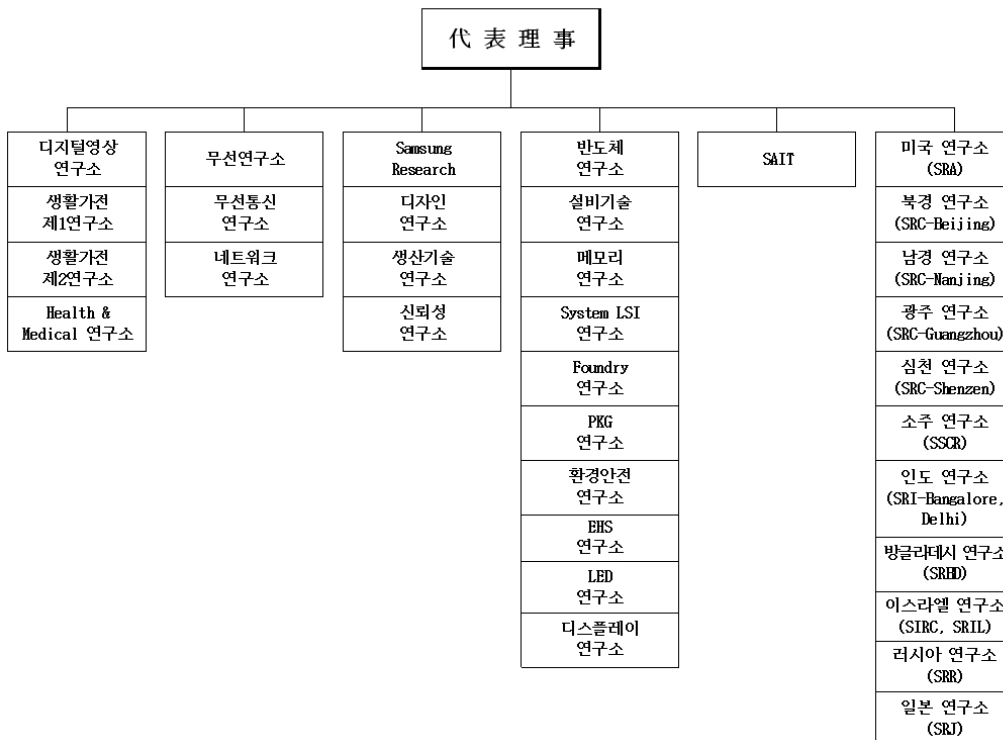
당사는 3계층의 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 1~2년 내에 시장에 선보일 상품화 기술을 개발하는 각 부문 산하 사업부 개발팀, 3~5년 후의 미래 유망 중장기 기술을 개발하는 각 부문 연구소, 그리고 미래 성장엔진에 필요한 핵심 요소 기술을 선행 개발하는 종합기술원 등으로 연구 개발 구조를 체계화하여 운영하고 있습니다.

종합기술원은 미래를 주도할 최첨단 기술의 산실로서 설립된 삼성전자의 중앙연구소로 미래 성장엔진 가시화와 주력사업의 기술 경쟁력 강화 등 전사 차원에서 유망 성장 분야에 대한 연구개발 방향 제시와 창의적 R&D 체제를 구축하고 있습니다.

(해외)

미국(SRA), 중국(SSCR, SRC-Beijing, SRC-Nanjing, SRC-Guangzhou, SRC-Shenzen), 인도(SRI-Bangalore, SRI-Delhi), 방글라데시(SRBD), 이스라엘(SRIL, SIRC), 러시아(SRR), 일본(SRJ) 등의 지역에 연구개발 조직을 운영하고 있으며 제품 개발 및 기초 기술 연구 등의 연구 활동을 수행 중입니다.

또한, 영국 캠브리지, 러시아 모스크바, 캐나다 토론토·몬트리올, 미국 뉴욕에 AI센터를 설립하여 세계적인 전문가와 한국·미국 등의 AI 연구인력이 함께 AI 분야 기술력을 강화하고 있습니다.



※ 연구개발조직도는 2023년 반기말 기준입니다.

☞ 상세한 해외 연구개발 조직(법인) 현황은 'XII. 상세표'의
'1. 연결대상 종속회사 현황(상세)'을 참고하시기 바랍니다.

라. 연구개발실적

2023년 반기 중 당사의 각 부문별 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

| 부문 | 연구과제 등 | 연구결과 및 기대효과 등 |
|-------|----------|--|
| DX 부문 | 청소기 | · 세계최고 성능(흡입력/사용시간) 스틱 청소기 BESPOKE 제트AI 280W 출시 |
| | 갤럭시 S23 | · Galaxy S23 · S23+ · S23 Ultra 출시 |
| | 갤럭시 A | · Galaxy A54 5G 출시 · Galaxy A34 5G 출시 · Galaxy A24 LTE 출시 · Galaxy A14 LTE · 5G 출시 |
| | 갤럭시북 | · Galaxy Book3 Ultra 출시 · Galaxy Book3 Pro 360 출시 · Galaxy Book3 Pro 출시 · Galaxy Book3 360 출시 |
| | 기지국 | · 최초 상용 Strand Smallcell(전선 설치형 소형 기지국) 개발 |
| DS 부문 | 서버용 DRAM | · 업계 최선단 12나노급 D램 양산 |
| | SSD | · 5나노 기반 컨트롤러 탑재한 PC용 고성능 SSD 'PM9C1a' 양산 |
| | 엑시노스 | · 5G 기반 위성통신용 모뎀 국제 표준기술 확보(NTN: Non Terrestrial Network) · 근거리 무선통신용 반도체 '엑시노스 커넥트 U100' 출시 |
| | 이미지센서 | · 초고화소 2억화소 이미지센서 출시(HP2, 0.6um/200Mp) |
| SDC | OLED | · 초고해상도 VR용 OLED 개발 · 노트북용 14/16" OLED 개발 |

※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(상세)' 참조

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 관련

당사는 R&D 활동의 지적재산화에도 집중하여 1984년 최초로 미국에 특허를 등록한 이래 현재 세계적으로 총 234,156건의 특허를 보유하고 있으며, 특히 미국에서의 분쟁에 효과적으로 대응하고자 미국에서 가장 많은 특허를 보유하고 있습니다.

[국가별 등록 건수(2023년 반기말 현재, 연결 기준)] (단위 : 건)

| 구분 | 한국 | 미국 | 유럽 | 중국 | 일본 | 기타국가 | 계 |
|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 등록건수 | 55,039 | 90,482 | 43,139 | 21,730 | 8,931 | 14,835 | 234,156 |

2023년 반기 중 총 13.8조원의 R&D투자를 통해 국내 특허 4,357건, 미국 특허 4,276건 등을 등록하였습니다.

[주요 국가 연도별 특허등록 건수] (단위 : 건)

| 구분 | 2023년 반기 | 2022년 | 2021년 |
|----|----------|-------|-------|
| 한국 | 4,357 | 9,136 | 8,437 |
| 미국 | 4,276 | 8,490 | 8,565 |

이 지적재산권은 대부분 스마트폰, 스마트 TV, 메모리, System LSI 등에 관한 특허로써 당사 전략사업 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정이며, 사업 보호의 역할뿐만 아니라 유사 기술·특허가 난립하는 상황에서 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한, 미래 신기술 관련 선형 특허 확보를 통하여 향후 신규 사업 진출 시 사업 보호의 역할이 기대되고 있습니다. 당사는 Cisco(2014.01.체결), Google(2014.01.), Qualcomm(2022.07.), Nokia(2023.01.), Microsoft(2019.02.), Sharp(2019.07.), Ericsson(2021.05.) 등과의 특허 라이선스 체결을 통하여, 모바일, 반도체 등 당사 주력사업 및 신사업 분야에서 광범위한 특허 보호망을 확보하고 있습니다.

당사는 상기 특허뿐만 아니라 스마트폰, 스마트 TV 등에 적용된 당사 고유 디자인을보호하고자 디자인특허 확보도 강화하여, 2023년 반기 중 미국에서 211건의 디자인특허(Design Patent)를 취득하였습니다.

나. 환경 관련 규제사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저히 준수하고 있습니다. 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서요구하는 사업장에서 발생하는 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 신고하고지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다.

(제품 환경규제 준수)

전자제품은 일반적으로 소비자가 직접 휴대하거나, 가정에 설치하여 사용하고 있어 사용자 건강과 안전에 직·간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 관련 환경규제가 강화되고 있습니다. 이에 대해 당사는 부품 및 제품의 개발단계부터 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전 과정(Life Cycle)에 걸쳐 환경영향을 최소화하기 위한 활동을 하고있습니다. 유해물질을 제거한 부품 공급을 위해 협력회사 에코파트너 인증 제도를 운영하고 개발단계에서 제품의 친환경 요소(자원 사용 절감, 에너지 절약, 유해 물질 저감, 친환경소재 적용 등)를 제품에 반영하기 위해 에코디자인 평가 제도를 운영하며, 제품 사용 후 발생하는 폐전자제품을 회수하여 재활용하는 폐제품 회수·재활용시스템을 유럽, 북미, 한국, 인도 등 각국에서 운영하고 있습니다. 이러한 활동은 전기·전자 제품 관련 국내외 환경 법규를 준수할 뿐만 아니라 회사와 제품의 차별화 요소로 기여하고 있습니다.

각국 관련 법률은 다음과 같습니다.

1. 폐제품 회수·재활용법 (예: EU WEEE Directive)
2. 유해물질 사용 제한 (예: EU RoHS Directive, REACH Regulation)
3. 제품 에너지 소비효율 규정 (예: EU ErP Directive)

(사업장관리 환경규제 준수)

제품생산과정에서 발생하는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기오염방지시설, 수질 오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지 시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 하고 있습니다. 이러한 사업장의 환경관리는 관련 부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국내 및 글로벌 전 생산 사업장은 국제 환경안전보건 경영시스템 인증 (ISO 14001, ISO 45001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

국내외 주요한 관련 법률은 다음과 같습니다.

1. 환경오염물질 배출 규제: 「물환경보전법」 「대기환경보전법」 「폐기물관리법」 「소음·진동관리법」 「환경영향평가법」 등
2. 온실가스 배출 관리: 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 「저탄소 녹색성장 기본법」 등
3. 기타 사업장환경관리법: 「화학물질관리법」 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 「악취방지법」 「토양환경보전법」 등

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제42조(기후변화대응 및 에너지의 목표관리) 제6항에 따른 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제44조(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 등의 보고)와 당국의 지침에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자에게 공개하고 있습니다

정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

(단위 : tCO₂-eq, TJ)

| 구 분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| 온실가스(tCO ₂ -eq) | 19,289,286 | 19,267,835 | 17,234,522 |
| 에너지(TJ) | 290,011 | 274,298 | 255,990 |

- ※ 연결 기준입니다.
- ※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등입니다.
- ※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.
- ※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 2015년부터 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제8조(할당대상업체의 지정 및 지정취소)에 따라 온실가스 배출권 할당 대상업체에 해당합니다.

다. 사업부문별 현황

[DX 부문]

(산업의 특성 등)

1) TV산업

DX 부문의 주요 제품인 TV 산업은 1926년 흑백 TV 개발, 1954년 RCA사가 Color TV(21") 양산·판매를 시작한 이래로 트리니트론 브라운관(1967년), 완전평면 브라운관(1996년) 개발 등 기술적인 발전을 거듭해 왔으나, 주요 국가 보급률이 90%를 넘어서면서 브라운관 TV 산업의 성장은 정체되었습니다. 그러나 Flat Panel TV(LCD, PDP) 출시, 디지털 방송의 확산 등을 통해 TV 시장은 성장 모멘텀을 되찾았으며, Flat Panel TV는 화질, 디자인 등 제품의 성능 향상과 가격 경쟁력 있는 제품 출시를 통해 성장을 지속하며 기존의 브라운관 TV 시장을 빠르게 대체하였습니다.

2010년에는 입체감을 느낄 수 있는 3D TV가 출시되었고, 2011년부터 2012년에 걸쳐 인터넷 동영상 서비스 업체의 부상과 스마트기기에 대한 사용자의 관심 확대로 스마트TV 시장이 태동하였습니다. 이후 2017년에 화질 및 해상도가 혁신적으로 높아진 퀀텀닷 소재를 사용한 QLED TV가 출시되고, 8K와 MICRO LED TV가 상용화되는 등 TV 시장은 끊임없이 진화하고 있습니다.

2) 휴대폰 산업

휴대폰 산업은 1980년대 초 음성통화만 가능했던 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 음성 및 문자 메시지 전송이 가능한 CDMA와 GSM의 2세대 디지털 방식을 거쳐, 음성 데이터뿐만 아니라, 사진, 동영상과 같은 멀티미디어 데이터까지 전송 가능한 WCDMA 등의 3세대 이동통신으로 발전하였습니다. 이후 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 전 세계로 확산되어 2022년에 판매된 휴대폰의 82%가 LTE를 지원하고 있습니다(출처: TechInsights 2023.06).

또한, 2019년 초 4차 산업 혁명을 포함하여 미래 변화를 주도할 5세대 이동통신 5G 서비스는 한국과 미국을 시작으로 글로벌 상용화되었으며, 5G 스마트폰은 2020년 2.7억대에서 2022년 6.8억대로 판매가 확대되는 등, 융합 서비스 및 기반 산업의 생태계 조성을 가속화하고 있습니다(출처: TechInsights 2023.06).

스마트폰 시장은 2007년 이후 큰 폭으로 성장하여 2022년 전체 휴대폰 판매량 중 스마트폰의 비중은 82% 수준, 피쳐폰의 비중은 일부 신흥 시장에서의 수요로 인해 18% 수준입니다(출처: TechInsights 2023.06). 또한 스마트폰 보급률은 2022년 52%에서 2023년 53%로 소폭 증가할 것으로 전망됩니다(출처: TechInsights 2023.07).

스마트폰 시장이 성숙함에 따라 고성능 AP, 대화면 AMOLED Display, 폴더블 폼팩터, 멀티 카메라, 센서, 방수·방진, 생체 인식 등과 같은 하드웨어뿐만 아니라 플랫폼기반의 Application, UX, Game, Media, Digital Wallet, AI, 보안 등 전반적인 소프트웨어 기반 경험 경쟁력의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

1) TV산업

2022년 TV 전체 시장 수요는 러시아-우크라이나 전쟁 및 원자재·에너지 공급 불안정, 글로벌 인플레이션 확대에 따른 가계 실질 소득 감소 영향 등으로 전년비 역성장하여 약 2억 328만대 수준이었습니다. 그러나 2023년은 아시아 및 중동/아프리카 등성장 시장 중심으로 소폭 성장하여 약 2억 500만대로 전망하고 있습니다.(출처: Omdia 2023.06).

< TV 시장점유율 추이 >

| 제 품 | 2023년 반기 | 2022년 | 2021년 |
|-----|----------|-------|-------|
| TV | 31.1% | 29.7% | 29.5% |

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장 점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.
(2023년 반기 시장점유율은 당사 추정치입니다.)

2) 휴대폰 산업

스마트폰 시장은 지정학적 불안 지속, 인플레이션 등 불확실성으로 인해 2022년 12.0억대에서 2023년 11.6억대 수준으로 감소할 것으로 예상됩니다(출처: TechInsights 2023.06). 그동안 교체 수요의 감소 등으로 역성장을 지속했던 태블릿 시장은 코로나 19(COVID-19)의 영향 등에 따른 비대면 수요 증가로 2021년 1.8억대로 성장한 후, 2022년에는 1.6억대 수준으로 감소하였으며, 2023년에도 1.5억대 수준으로 감소할 것으로 전망됩니다(출처: TechInsights 2023.06).

< 스마트폰 시장점유율 추이 >

| 제 품 | 2023년 반기 | 2022년 | 2021년 |
|------|----------|-------|-------|
| 스마트폰 | 21.2% | 21.7% | 20.0% |

※ 시장점유율은 외부조사기관인 TechInsights의 세계시장점유율 자료(수량 기준)를 활용하였습니다.

※ TechInsights는 기존 외부조사기관인 Strategy Analytics를 인수하였습니다.

(영업의 개황 등)

1) TV산업

당사는 2006년 이후 2022년까지 17년 연속으로 TV 판매 1위를 달성하였습니다.

2018년 당사는 세계 최초로 8K TV를 글로벌 시장에 공개하여 다시 한번 TV 산업의프리미엄 제품 리더십을 주도하였습니다. QLED 라인업은 중형에서 초대형까지 다양한 사이즈를 구비하여 소비자에게 폭넓은 선택을 할 수 있는 기회를 제공하였고, 화질도 한층 더 개선되었다는 전문가와 소비자의 평가를 받았습니다. 당사는 QLED뿐만 아니라 UHD 라인업에서도 초대형 사이즈를 구비해서 견조한 실적을 기록하였습니다.

2020년 당사는 코로나19(COVID-19)로 인한 전 세계 경제위기 상황에서도 QLED 4K·8K TV와 Lifestyle TV 신제품(The Terrace, The Premiere, The Sero 등)을 통해 시장 리더십과 지배력을 확대하였습니다.

2021년에는 명암비와 화질을 획기적으로 개선한 Neo QLED TV를 출시하여 프리미엄 제품군을 확대하였습니다. 또한 Lifestyle 제품과 Sound Bar 제품의 판매 비중도 상승하였으며, TV 플러스, 홈 트레이닝, 게임 등 다양한 스마트 생태계에 참여하는 업체들도 확대되었습니다. 특히, 당사는 2021년부터 제품 재질부터 패키징(Packaging)에 이르기까지 친환경 사업에 앞장서는 한편, 접근성을 발전시켜서 시각·청각 장애인도 불편없이 제품을 사용할 수 있도록 지원하고 있습니다.

2022년에는 Neo QLED 8K 혁신 기술들을 중심으로 75" 이상 초대형 프리미엄 시장 점유율을 확대해가는 한편, 더 프리스타일 제품을 도입하여 라이프스타일 라인업을 더욱 보강하였습니다.

2023년에는 당사의 주력 제품인 Neo QLED와 초대형 등 프리미엄 제품에 집중해 시장 점유율을 확대해 나가는 한편 라이프스타일 쪽에서도 라인업 확대와 제품 성능 개선 등을 통해 소비자 맞춤형 제품들을 지속적으로 제공할 것입니다. 또한, 전사 차원의 친환경 경영전략에 맞춰 재생 플라스틱을 활용한 소재를 친환경 리모컨에 추가 확대 적용하고 초전력 기술을 적용한 TV 신제품들도 선보일 예정입니다.

2) 휴대폰 산업

당사는 주력 사업인 휴대폰 시장에서 글로벌 1위의 위상을 유지하고 있으며, 특히 스마트폰은 2011년 이후 12년 연속 글로벌 1위의 입지를 확고히 하고 있습니다. 또한, 스마트폰 뿐만 아니라 전체 모바일 시장에서의 사업 위상을 강화하기 위해 태블릿과 웨어러블, 액세서리 등의 제품과 함께 Digital Health, Digital Wallet 등 콘텐츠와 서비스 부문에서도 사업 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

당사는 프리미엄에서 보급형까지 다양하고 경쟁력 있는 스마트폰 라인업을 활용하여 지역별 시장 상황과 경쟁 환경에 최적화된 제품 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 특히 프리미엄 스마트폰은 대화면 Infinity Display에 더해 Dynamic AMOLED 2X(120Hz) 지원, UWB(Ultra Wideband)를 활용한 디지털키 및 콘텐츠 공유, 방수·방진, 고속 유·무선 충전, 초음파 방식의 온스크린 지문 인식, AI 기술을 활용한 고화질 사진 및 고배율·야간 촬영, 8K 동영상 등 고객의 Needs에 기반한 차별화된 기능을 지속해서 선보이고 있습니다.

2019년에는 세계 최초 5G 스마트폰 출시로 5G 시장 리더십을 선점하고 폴더블 디스플레이를 탑재한 '갤럭시 폴드'로 신규 시장을 개척한 데 이어, 2020년에는 상하로 접히는 '갤럭시 Z 플립'과 한층 더 진화된 '갤럭시 Z 폴드2'를, 2021년에는 독보적인 장인정신을 기반으로 내구성을 대폭 강화한 3세대 Z 시리즈를 출시하며 폴더블 시장을 리딩해 왔습니다.

2022년 출시한 '갤럭시 Z 폴드4'와 '갤럭시 Z 플립4'는 사용자 관점에서 각 제품의 핵심 경험인 멀티태스킹과 Flex Mode 경험의 완성도를 더욱 높여 시장의 호응을 얻었습니다. 당사는 새로운 폴더블 시리즈의 진정한 대중화로 기존 노트 시리즈 신제품이상의 판매량을 달성할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다.

또한, 2023년 출시한 갤럭시 S23 시리즈는 소비자가 일상에서 체감할 수 있는 제품 경험을 한 단계 높여 당사의 기술 리더십을 공고히 하고자 노력하였습니다. 특히 갤럭시 S23 Ultra는 2억 화소 이미지 센서를 기반으로 더욱 개선된 야간 촬영 및 Zoom기능을 제공하고, 고용량 메모리 및 친환경 소재 적용을 확대하여 좋은 반응을 이끌어 내었습니다.

더불어, 빠르게 변화하는 시장과 고객 Needs에 민첩하게 대응하기 위해 중저가 스마트폰에도 5G, 쿼드 카메라, 대화면 Infinity Display, 고용량 배터리 등을 적극적으로 채택하여 제품 경쟁력을 높이고 있습니다.

스마트폰 외에도 대화면 디스플레이와 S Pen으로 노트 필기와 영상회의, 멀티태스킹 등 생산적인 경험을 제공하는 태블릿, 혁신적인 생체 센서 기술을 적용하여 더욱 고도화된 피트니스 및 웰니스 기능을 제공하는 스마트 워치와 풍부하고 뛰어난 사운드 경험을 제공하는 무선 이어폰이 포함된 웨어러블 제품 등 다양한 Galaxy Eco 제품군을 통해 당사 스마트폰을 사용하는 고객에게 더욱 풍부한 모바일 경험을 제공하고 있습니다.

당사는 제품과 더불어 그동안 Samsung Pay, Samsung Health, SmartThings 등의 실용적이고 가치 있는 서비스를 제공해 왔으며, 스마트폰 외에도 TV, 냉장고, 에어컨 등 다양한 제품군에 Bixby를 적용하여 고객이 어느 기기를 사용하더라도 일관되고 끊김 없는 경험을 할 수 있는 Multi Device Experience를 제공하고 있습니다.

또한, Ecosystem 확장을 위한 전략적 파트너십도 강화하고 있으며, SmartThings, Bixby, Cloud를 활용하고 Service Biz를 강화하여 Digital Health, Digital Wallet 등 미래 성장에 대비한 투자를 지속하여 새롭고 혁신적인 기술을 확보하고 있습니다.

뿐만 아니라 제품에 재활용 소재 적용을 확대하는 등, 친환경 기술 혁신도 지속하고 있습니다. 대표적으로 플라스틱 폐기물 중 하나인 폐어망을 재활용해 만든 소재를 갤럭시 S22 및 S23 시리즈, 갤럭시 Z 폴드4 등 주요 제품에 적용하였습니다.

당사는 앞으로도 업계 최고 수준의 R&D 역량을 바탕으로 철저한 미래 준비를 통해 고객에게 새로운 가치를 끊임없이 제공할 것입니다.

[DS 부문]

(산업의 특성 등)

반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다.

메모리 반도체는 읽고 쓸 수 있는 램(RAM, Random Access Memory) 제품과 읽기만 할 수 있는 롬(ROM, Read Only Memory) 제품으로 구분됩니다. 램(RAM)은 전원이 꺼지면 기억된 내용은 지워져 휘발성 메모리(Volatile Memory)라고 하며, 컴퓨터의 주기억 장치, 응용 프로그램의 일시적 로딩>Loading), 데이터의 일시적 저장 등에 사용됩니다. 롬(ROM)은 전원이 꺼져도 Data가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로, 대표적으로 입출력 시스템이나 IC카드 등에 사용됩니다.

System LSI 제품은 응용처에 따라 종류가 다양하며, 중앙처리 장치인 CPU(Central Processing Unit), 그래픽 처리 장치인 GPU(Graphics Processing Unit), ISP(Image Signal Processor), Modem(Modulator-Demodulator) 등을 내장한 모바일 기기용 SOC(System-On-Chip)가 가장 대표적인 제품입니다. 당사는 스마트폰, 태블릿 등 모바일용 SOC 제품과 이미지 센서, OLED용 DDI(Display Driver IC) 등을 공급하고 있습니다.

Foundry 사업은 다른 업체가 설계한 반도체를 위탁 생산해서 공급해 주는 사업으로, 일반 제조업의 OEM 공급과 비슷한 개념의 '수탁 반도체 제조 사업'입니다. 반도체 공정 기술의 고도화와 투자 부담의 증가로 생산 시설을 보유하지 않은 팹리스(Fabless) 업체가 증가하고 있으며, 이러한 팹리스 업체 제품의 위탁생산을 담당하고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

메모리 시장은 서버 고객사들의 재고 조정이 지속되었으나, 주요 데이터센터의 AI향 투자 확대로 고용량/고사양DRAM 제품의 수요가 강세를 보였습니다. 반면 서버 고객사들의 CAPEX는 유지되는 가운데 AI향 위주로 투자가 집중됨에 따라 스토리지 수요는 상대적으로 부진하였습니다. 당사는 AI향 DDR5 및 HBM DRAM 수요 증가에 적극 대응하였고, 선단 공정 비중 확대를 통한 NAND 원가경쟁력 강화를 지속하며 고용량 및 신규 Interface 수요 대응에 집중하였습니다.

Foundry 시장은 2022년 하반기부터 이어진 글로벌 경기 불황 장기화로 인해 Set 시장 회복이 지연됨에 따라 수요 약세가 지속되고 있습니다. 다만, AI관련 고성능 컴퓨팅 수요, 응용처 확대 및 스마트폰 수요 증가 등의 수요 진작과 공급망 정상화에 따라 3분기부터는 점진적 회복을 기대하고 있습니다. 한편, 중장기적으로는 지속적인 모바일 수요 및 전장향 고성능 SoC(자율 주행) 수요 증가 등으로 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

< DRAM 시장점유율 추이 >

| 제 품 | 2023년 반기 | 2022년 | 2021년 |
|------|----------|-------|-------|
| DRAM | 41.9% | 43.1% | 43.0% |

※ 시장점유율은 외부조사기관인 DRAMeXchange의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.

(2023년 반기 시장점유율은 당사 추정치입니다.)

(영업의 개황 등)

메모리는 하반기에 고객사 재고 조정이 마무리되며 구매 수요는 점차 회복될 것으로 전망됩니다. 하반기 스마트폰 신제품 출시와 PC 프로모션으로 상반기 대비 개선이 기대되고, AI 수요 증가와 High-core CPU 전환 확대로 DDR5 중심 서버 탑재량 성장이 예상됩니다. 이에, DRAM은 High-core CPU 전환 확대에 따른 수요에 적극 대응하는 가운데, 고성능 서버/모바일 High-end 세그먼트에서의 리더십 강화를 위해 DDR5, LPDDR5x 및 HBM3 등 선단 제품 비중 확대를 가속화 할 계획입니다. NAND는 V7/V8 등 선단 공정 비중 확대를 통해 원가 경쟁력 강화하고, UFS4.0 등 고객이 필요로 하는 제품이 적기 공급될 수 있도록 대응해 나갈 것입니다.

System LSI는 글로벌 경기 침체 및 중국 Mobile 시장 정체 지속으로 주요 고객들의 재고 조정이 심화될 것으로 전망되나, 고객과의 협력 강화, 차세대 신제품 적기 개발, 원가 경쟁력 강화 등을 통해 극복해 나가고 있습니다. SOC는 모바일 5G SOC와 선단공정 적용 제품 개발 외 모바일 Custom SOC 및 자동차용 SOC 등으로 제품 라인업을 확대하는 한편, 모바일 위성 통신 서비스 등 차세대 기술 개발도 고객과 협력을 통해 강화하고 있습니다.

Foundry는 지속 이어지고 있는 침체된 시황을 극복하고, 성장 국면으로 전환될 시장 상황을 대비하기 위해 사업 전 영역에서 대응 준비를 하고 있습니다. Advanced 노드의 3나노 GAA(Gate All Around) 1세대 공정은 안정적인 수율 기반 양산 중이며, 이후 2세대 공정은 1세대 공정의 Lesson Learn을 반영하여 계획한 일정에 맞춰 차질없이 개발 중에 있습니다. 4나노 2세대 제품 또한 안정적인 수율을 기반으로 양산 중이며, 3세대 제품은 4분기 양산을 앞두고 목표 달성이 전망됩니다. Advanced 노드의 지속적인 기술경쟁력 강화를 통해, 미래 먹거리 확보에 집중하겠습니다. 더불어 평택·테일러 등 신규 FAB을 구축하여 적기 Capa를 확보, Ramp-up 및 공급능력을 향상하여 증가할 것으로 전망되는 고객 수요에 대응할 준비를 하고 있습니다. Matured 노드는 신규 고객 발굴, 기존 고객 확대 판매 및 공정 포트폴리오 강화 등을 통해 시황 극복 및 특정 고객에 편중되어 있는 사업 구조를 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 공정 기술 개선 및 고수익 제품 확대를 통해 원가 경쟁력을 지속 개선하고, 고성능 컴퓨팅/전장용 반도체/5G/IOT 등 다양한 응용처별 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다.

[SDC]

(산업의 특성 등)

디스플레이(Display)는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시 소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, OLED(Organic Light Emitting Diode)와 QD-OLED(Quantum Dot-Organic Light Emitting Diode), TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display) 등이 이에 해당합니다.

OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색 일치율이 높고 색 재현 범위가 넓으며 응답 속도가 빠르다는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 OLED 디스플레이는 멀티미디어 콘텐츠, 인터넷 사용 등 디스플레이의 성능이 중시되는 스마트폰 시장에서 채용이 빠르게 증가하고 있습니다. 과거에는 OLED로 고해상도의 장수명 패널을 구현하는 것에 대해 시장의 큰 우려가 있었으나, 당사는 기술적 한계를 극복하여 시장을 발전시켜 왔습니다. OLED는 LCD의 단점을 극복할 뿐만 아니라, 앞으로 폴더블, 롤러블, 전장 등 다른 응용처로 확대 적용이 가능하며 앞으로 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. QD-OLED는 수 나노 미터의반도체 결정인 퀀텀닷(Quantum Dot)을 패널에 내재화해 색재현력과 시야각을 극대화한 자발광 디스플레이로, 향후 프리미엄급 TV 및 모니터 시장을 주도할 차세대 디스플레이로 주목받고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

스마트폰용 디스플레이 패널 시장은 2022년 13.8억대에서 2023년 14.0억대로 소폭 상승할 것으로 전망됩니다. 반면 스마트폰용 OLED 디스플레이 패널의 경우 2022년 5.7억대에서 2023년 5.9억대로 확대될 것으로 전망되며, 전체 스마트폰 디스플레이 패널에서 차지하는 비중은 2022년 42%에서 2023년 42%로 동등한 수준으로 유지될 것으로 전망됩니다.(출처: Omdia 2023.07).

대형 디스플레이 패널 시장은 2022년 9.0억대였으며, 2023년은 8.7억대로 소폭 감소할 것으로 전망됩니다(출처: Omdia 2023.06).

< 스마트폰 패널 시장점유율 추이 >

| 제 품 | 2023년 반기 | 2022년 | 2021년 |
|---------|----------|-------|-------|
| 스마트폰 패널 | 48.8% | 56.7% | 51.4% |

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.
(2023년 반기 시장점유율은 외부조사기관의 예측치입니다.)

(영업의 개황 등)

당사는 2007년 세계 최초로 OLED 제품의 상용화에 성공한 이후 현재까지 중소형 OLED 시장에서 독보적인 점유율을 유지하고 있습니다. 또한 스마트폰 외에도 폴더블, 태블릿, 워치, 노트북, 전장 등으로 제품군을 다각화하여 명실상부한 OLED 디스플레이의 선도 기업으로 자리매김하였습니다.

당사는 Flexible OLED와 Rigid OLED 패널을 통해 프리미엄부터 보급형 제품까지 최적의 제품 포트폴리오를 구축하여 소비자의 고도화되는 Needs에 적극 대응하고 있습니다. 또한 차별화된 기능과 디자인의 폴더블·OLED IT 제품을 지속적으로 출시하여 시장으로부터 업계 최고의 기술력을 인정받고 있습니다.

2023년은 글로벌 경기 침체 영향으로 수요 회복이 지연될 것으로 예상됩니다. 당사는 폴더블 성능 향상을 통해 Mainstream 제품에 진입하고, 고객사 Needs에 발맞춰 고휘도, 저전력 등 신기술 적용을 확대하는 한편, 원가 경쟁력을 강화하여 스마트폰 제품에서의 OLED 패널 채용률을 지속적으로 높여가기 위해 노력하겠습니다.

또한, 8.6G IT OLED라인 투자를 본격화 하는 등 스마트폰에 편중된 중소형 패널 사업을 다각화하여 IT, Gaming, Automotive 제품 등으로 제품 포트폴리오를 확대하고 사업 리더십을 더욱 견고히 할 계획입니다.

한편, 대형 디스플레이 사업은 QD-OLED 제품의 라인업 확대 및 판매처 다변화를 통해 프리미엄 시장에서의 점유율을 지속적으로 높여갈 계획입니다.

[Harman]

(산업의 특성 등)

Harman은 전장부품(Automotive)과 라이프스타일 오디오(Lifestyle Audio) 산업에서 경쟁하고 있습니다. 이중 전장부품이 Harman 사업의 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 디지털 콕핏, 텔레매틱스, 카 오디오 등 분야에 진출해 있습니다.

소비자들이 지속적으로 커넥티비티 및 엔터테인먼트 관련하여 가장 최신 기술을 요구함에 따라, 자동차 제조사들은 Harman의 전장부품(디지털 콕핏, 텔레매틱스, 카 오디오 등) 솔루션을 활용하여 이러한 소비자들의 수요를 충족시키고 있습니다. 특히 최근 진행되고 있는 차량공유 및 자율주행 기술의 혁신은 이러한 자동차 제조사들의 요구조건에 계속 영향을 주고 있습니다. 이로 인해 전장산업의 커넥티비티(Connectivity) 및 엔터테인먼트 솔루션 시장에서 주요 업체(Alpine, Aptiv, Continental, Mitsubishi, Panasonic 등)간 경쟁이 매우 치열합니다. Harman은 카 오디오(Car Audio) 분야에서 시스템 솔루션뿐만 아니라 오디오 컴포넌트(스피커, 앰프 등)도 제공하고 있으며, 주요 업체(Bose, Pioneer, Panasonic 등) 간 경쟁이 매우 치열합니다. 이 분야는 지속적인 기술 발전이 예상되며, 여러 카 오디오 업체가 다양한 음향관리 솔루션 개발 등으로 차별화해 나갈 것으로 전망됩니다. 따라서 향후 지속해서 업체 간 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다.

라이프스타일 오디오 산업은 소비자 오디오와 프로페셔널(Professional) 오디오 솔루션으로 구분됩니다. 소비자 오디오(포터블 스피커, 헤드폰, 커넥티드 오디오 솔루션 등) 산업은 상대적으로 시장점유율 집중도가 낮으며 소수의 선도 업체(Amazon, Beats, Bose, Ultimate Ears 등)가 있습니다. 특히 커넥티드 홈(Connected Home)과 스마트 스피커 제품이 시장을 계속 포화 상태로 만들고 있기 때문에 다른 산업에서 진입하는 새로운 업체와 기존 업체 간 경쟁 상황이 지속될 것으로 전망됩니다. 특히 휴대폰 제조사가 절대적인 시장점유율을 차지하고 있는 True Wireless 헤드폰 분야는 폭발적인 성장이 예상됩니다.

프로페셔널 오디오 솔루션(상업용·대규모 공연장 등에서의 오디오, 특수조명, 영상컨트롤 솔루션 등) 산업은 제품 종류에 따라 세분화되어 있고 제품의 응용 방식에 따라 다양한 업체가 진출한 상태입니다. QSC와 Yamaha가 현재 산업 내에서 널리 알려진 선도 업체입니다.

(국내외 시장여건 등)

러시아-우크라이나 전쟁 영향 등으로 지정학적 리스크가 상존하는 가운데, 반도체 및 원자재 공급망의 어려움이 지속되고, 세계 각국 중앙은행이 인플레이션에 대응하기 위해 추가적인 긴축 정책을 시행하는 등 거시경제의 불확실성이 지속될 것으로 예상됩니다.

이러한 요인들을 감안하였을때 2023년 전세계 자동차 생산은 2022년 대비 4% 수준 증가에 그칠 것으로 예상됩니다(출처: S&P Global Light Vehicle Production Forecast 2023.06).

< 디지털 콕핏 시장점유율 추이 >

| 제 품 | 2023년 반기 | 2022년 | 2021년 |
|--------|----------|-------|-------|
| 디지털 콕핏 | 21.2% | 24.7% | 25.3% |

※ 디지털 콕핏(Digital Cockpit)은 인포테인먼트 시스템 등을 통해 안전한 운전 환경을 제공하는 디지털 전장부품입니다.

※ 시장점유율은 외부조사기관인 I.H.S 와 LMC의 자료(수량 기준)를 활용한 당사 추정치입니다.

(영업의 개황 등)

Harman은 전장부품 시장에서 선도 기업의 위상을 유지하고 있습니다. 당사는 이러한 Harman 브랜드에 부합되는 품질을 유지하는 한편, 대중적인 시장부터 고급 모델에 이르기 까지 다양한 브랜드를 활용할 계획입니다. 더불어, Harman은 하드웨어와 소프트웨어 솔루션 모두에서 끊임없는 혁신을 추구함으로써 소비자들의 차량 외부에서의 디지털화된 일상생활이 차량내에서도 이어지도록 하여 소비자들의 차량내 경험을 강화할 것입니다.

자동차 시장에서의 여러 성공 요인은 소비자 오디오 및 프로페셔널 오디오 솔루션 시장에서도 유사하게 적용될 것입니다. 그래미상 3회, 아카데미상 2회 등을 수상한 바와 같이 여러 Harman 브랜드는 일상적인 소비자와 음악 애호가 사이에서 명성을 쌓아왔습니다. 무선 스마트 스피커와 같은 전도 유망한 분야에서 신제품을 제공하는 것은 신규 고객을 Harman으로 유인함과 동시에 브랜드 평판을 더욱 강화하는데 지속적으로 도움이 될 것입니다.

또한 Harman은 DTS(Digital Transformation Solutions) 사업을 지속적으로 개발하고 있습니다. DTS는 자동차 제조사들이 소비자들에게 UX, 클라우드, 빅데이터, 이동성, 사물 인터넷 등이 하나로 통합된 서비스를 제공할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.

글로벌 지정학적 불안정 속 거시경제환경 악화 등 어려운 경영환경이 예상되지만, Harman은 고객사와의 협업을 통해 위험을 최소화할 수 있도록 하겠습니다.

라. 사업부문별 요약 재무 현황

2023년(제55기) 반기 매출은 DX 부문이 86조 4,287억원(69.8%), DS 부문이 28조 4,637억원(23.0%)이며, SDC가 13조 972억원(10.6%), Harman은 6조 6,616억원(5.4%)입니다.

2023년(제55기) 반기 영업이익은 DX 부문이 8조 381억원, DS 부문이 △8조 9,437억원, SDC가 1조 6,191억원, 그리고 Harman은 3,803억원입니다.

(단위 : 억원, %)

| 부문 | 구 분 | 제55기 반기 | | 제54기 | | 제53기 | |
|--------|------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 |
| DX 부문 | 매출액 | 864,287 | 69.8% | 1,824,897 | 60.4% | 1,662,594 | 59.5% |
| | 영업이익 | 80,381 | 614.2% | 127,461 | 29.4% | 173,866 | 33.7% |
| | 총자산 | 2,323,385 | 38.2% | 2,279,669 | 38.6% | 2,479,832 | 42.0% |
| DS 부문 | 매출액 | 284,637 | 23.0% | 984,553 | 32.6% | 953,872 | 34.1% |
| | 영업이익 | △89,437 | △683.4% | 238,158 | 54.9% | 291,920 | 56.5% |
| | 총자산 | 2,745,329 | 45.1% | 2,620,558 | 44.3% | 2,258,223 | 38.3% |
| SDC | 매출액 | 130,972 | 10.6% | 343,826 | 11.4% | 317,125 | 11.3% |
| | 영업이익 | 16,191 | 123.7% | 59,530 | 13.7% | 44,574 | 8.6% |
| | 총자산 | 734,446 | 12.1% | 737,798 | 12.5% | 668,836 | 11.3% |
| Harman | 매출액 | 66,616 | 5.4% | 132,137 | 4.4% | 100,399 | 3.6% |
| | 영업이익 | 3,803 | 29.1% | 8,805 | 2.0% | 5,991 | 1.2% |
| | 총자산 | 176,281 | 2.9% | 171,023 | 2.9% | 158,874 | 2.7% |

※ 각 사업부문별 요약 재무 현황은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

※ 제53기는 2021년 12월의 조직변경을 반영하여 재작성하였습니다.

(공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부 기준 적용)

- 공통 판매비와 관리비의 경우 각 제품·모델별 귀속이 확실한 직접비용(위임성 경비)은 각 제품·모델부문에 직접 귀속시키고 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부 기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다.
- 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당 부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부 기준(매출액비, 세전이익비 등)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

| 구분 | 제55기 반기 2023년 6월말 | 제54기 2022년 12월말 | 제53기 2021년 12월말 |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| [유동자산] | 203,975,373 | 218,470,581 | 218,163,185 |
| · 현금및현금성자산 | 79,919,775 | 49,680,710 | 39,031,415 |
| · 단기금융상품 | 17,180,130 | 65,102,886 | 81,708,986 |
| · 기타유동금융자산 | 25,310 | 443,690 | 3,409,791 |
| · 매출채권 | 36,104,142 | 35,721,563 | 40,713,415 |
| · 재고자산 | 55,504,798 | 52,187,866 | 41,384,404 |
| · 기타 | 15,241,218 | 15,333,866 | 11,915,174 |
| [비유동자산] | 244,025,179 | 229,953,926 | 208,457,973 |
| · 기타비유동금융자산 | 11,881,582 | 12,802,480 | 15,491,183 |
| · 관계기업 및 공동기업 투자 | 11,334,699 | 10,893,869 | 8,932,251 |
| · 유형자산 | 177,869,942 | 168,045,388 | 149,928,539 |
| · 무형자산 | 23,430,234 | 20,217,754 | 20,236,244 |
| · 기타 | 19,508,722 | 17,994,435 | 13,869,756 |
| 자산총계 | 448,000,552 | 448,424,507 | 426,621,158 |
| [유동부채] | 70,780,638 | 78,344,852 | 88,117,133 |
| [비유동부채] | 18,244,288 | 15,330,051 | 33,604,094 |
| 부채총계 | 89,024,926 | 93,674,903 | 121,721,227 |
| [지배기업 소유주지분] | 349,042,413 | 345,186,142 | 296,237,697 |
| · 자본금 | 897,514 | 897,514 | 897,514 |
| · 주식발행초과금 | 4,403,893 | 4,403,893 | 4,403,893 |
| · 이익잉여금 | 338,310,655 | 337,946,407 | 293,064,763 |
| · 기타 | 5,430,351 | 1,938,328 | △2,128,473 |
| [비지배지분] | 9,933,213 | 9,563,462 | 8,662,234 |
| 자본총계 | 358,975,626 | 354,749,604 | 304,899,931 |
| | 2023년 1월~6월 | 2022년 1월~12월 | 2021년 1월~12월 |
| 매출액 | 123,750,904 | 302,231,360 | 279,604,799 |
| 영업이익 | 1,308,725 | 43,376,630 | 51,633,856 |
| 연결총당기순이익 | 3,298,171 | 55,654,077 | 39,907,450 |
| · 지배기업 소유주지분 | 2,948,270 | 54,730,018 | 39,243,791 |
| · 비지배지분 | 349,901 | 924,059 | 663,659 |
| 기본주당순이익(단위 : 원) | 434 | 8,057 | 5,777 |
| 희석주당순이익(단위 : 원) | 434 | 8,057 | 5,777 |
| 연결에 포함된 회사수 | 234개 | 233개 | 229개 |

* 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제53기~제54기 연결감사보고서 및 제55기 반기 연결검토보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 요약별도재무정보

(단위 : 백만원)

| 구분 | 제55기 반기 | 제54기 | 제53기 |
|------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | 2023년 6월말 | 2022년 12월말 | 2021년 12월말 |
| [유동자산] | 73,472,493 | 59,062,658 | 73,553,416 |
| · 현금및현금성자산 | 12,892,470 | 3,921,593 | 3,918,872 |
| · 단기금융상품 | 1,403 | 137 | 15,000,576 |
| · 매출채권 | 22,140,988 | 20,503,223 | 33,088,247 |
| · 재고자산 | 32,589,559 | 27,990,007 | 15,973,053 |
| · 기타 | 5,848,073 | 6,647,698 | 5,572,668 |
| [비유동자산] | 212,555,100 | 201,021,092 | 177,558,768 |
| · 기타비유동금융자산 | 1,731,047 | 1,364,608 | 1,664,667 |
| · 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 | 57,359,028 | 57,397,249 | 56,225,599 |
| · 유형자산 | 132,603,414 | 123,266,986 | 103,667,025 |
| · 무형자산 | 11,168,723 | 8,561,424 | 8,657,456 |
| · 기타 | 9,692,888 | 10,430,825 | 7,344,021 |
| 자산총계 | 286,027,593 | 260,083,750 | 251,112,184 |
| [유동부채] | 38,302,556 | 46,086,047 | 53,067,303 |
| [비유동부채] | 29,536,245 | 4,581,512 | 4,851,149 |
| 부채총계 | 67,838,801 | 50,667,559 | 57,918,452 |
| [자본금] | 897,514 | 897,514 | 897,514 |
| [주식발행초과금] | 4,403,893 | 4,403,893 | 4,403,893 |
| [이익잉여금] | 213,225,614 | 204,388,016 | 188,774,335 |
| [기타] | △338,229 | △273,232 | △882,010 |
| 자본총계 | 218,188,792 | 209,416,191 | 193,193,732 |
| 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| | 2023년 1월~6월 | 2022년 1월~12월 | 2021년 1월~12월 |
| 매출액 | 81,897,767 | 211,867,483 | 199,744,705 |
| 영업이익 | △7,606,864 | 25,319,329 | 31,993,162 |
| 당기순이익 | 13,742,728 | 25,418,778 | 30,970,954 |
| 기본주당순이익(단위 : 원) | 2,023 | 3,742 | 4,559 |
| 희석주당순이익(단위 : 원) | 2,023 | 3,742 | 4,559 |

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제53기~제54기 감사보고서 및 제55기 반기 검토보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다.

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 55 기 반기말 2023.06.30 현재

제 54 기말 2022.12.31 현재

(단위 : 백만원)

| | 제 55 기 반기말 | 제 54 기말 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 자산 | | |
| 유동자산 | 203,975,373 | 218,470,581 |
| 현금및현금성자산 | 79,919,775 | 49,680,710 |
| 단기금융상품 | 17,180,130 | 65,102,886 |
| 단기상각후원가금융자산 | | 414,610 |
| 단기당기손익-공정가치금융자산 | 25,310 | 29,080 |
| 매출채권 | 36,104,142 | 35,721,563 |
| 미수금 | 5,822,772 | 6,149,209 |
| 선급비용 | 3,214,408 | 2,867,823 |
| 재고자산 | 55,504,798 | 52,187,866 |
| 기타유동자산 | 6,204,038 | 6,316,834 |
| 비유동자산 | 244,025,179 | 229,953,926 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 10,308,125 | 11,397,012 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,573,457 | 1,405,468 |
| 관계기업 및 공동기업 투자 | 11,334,699 | 10,893,869 |
| 유형자산 | 177,869,942 | 168,045,388 |
| 무형자산 | 23,430,234 | 20,217,754 |
| 순확정급여자산 | 5,143,048 | 5,851,972 |
| 이연법인세자산 | 5,527,377 | 5,101,318 |
| 기타비유동자산 | 8,838,297 | 7,041,145 |
| 자산총계 | 448,000,552 | 448,424,507 |
| 부채 | | |
| 유동부채 | 70,780,638 | 78,344,852 |
| 매입채무 | 11,744,005 | 10,644,686 |
| 단기차입금 | 3,557,360 | 5,147,315 |
| 미지급금 | 15,020,336 | 17,592,366 |
| 선수금 | 1,165,583 | 1,314,934 |
| 예수금 | 756,934 | 1,298,244 |
| 미지급비용 | 25,402,072 | 29,211,487 |
| 당기법인세부채 | 2,601,584 | 4,250,397 |
| 유동성장기부채 | 1,263,841 | 1,089,162 |
| 총당부채 | 6,861,551 | 5,844,907 |

| | | |
|------------|-------------|-------------|
| 기타유동부채 | 2,407,372 | 1,951,354 |
| 비유동부채 | 18,244,288 | 15,330,051 |
| 사채 | 554,625 | 536,093 |
| 장기차입금 | 3,763,250 | 3,560,672 |
| 장기미지급금 | 5,358,916 | 2,753,305 |
| 순확정급여부채 | 429,242 | 268,370 |
| 이연법인세부채 | 3,485,352 | 5,111,332 |
| 장기충당부채 | 2,271,470 | 1,928,518 |
| 기타비유동부채 | 2,381,433 | 1,171,761 |
| 부채총계 | 89,024,926 | 93,674,903 |
| 자본 | | |
| 지배기업 소유주지분 | 349,042,413 | 345,186,142 |
| 자본금 | 897,514 | 897,514 |
| 우선주자본금 | 119,467 | 119,467 |
| 보통주자본금 | 778,047 | 778,047 |
| 주식발행초과금 | 4,403,893 | 4,403,893 |
| 이익잉여금(결손금) | 338,310,655 | 337,946,407 |
| 기타자본항목 | 5,430,351 | 1,938,328 |
| 비지배지분 | 9,933,213 | 9,563,462 |
| 자본총계 | 358,975,626 | 354,749,604 |
| 부채와자본총계 | 448,000,552 | 448,424,507 |

연결 손익계산서

제 55 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

제 54 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

(단위 : 백만원)

| | 제 55 기 반기 | | 제 54 기 반기 | |
|----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 수익(매출액) | 60,005,533 | 123,750,904 | 77,203,607 | 154,985,105 |
| 매출원가 | 41,647,190 | 87,654,283 | 46,269,748 | 93,341,805 |
| 매출총이익 | 18,358,343 | 36,096,621 | 30,933,859 | 61,643,300 |
| 판매비와관리비 | 17,689,796 | 34,787,896 | 16,836,814 | 33,424,846 |
| 영업이익 | 668,547 | 1,308,725 | 14,097,045 | 28,218,454 |
| 기타수익 | 201,176 | 705,471 | 463,971 | 1,164,164 |
| 기타비용 | 169,057 | 373,039 | 600,393 | 1,053,503 |
| 지분법이익 | 199,941 | 413,782 | 259,229 | 491,706 |
| 금융수익 | 4,056,928 | 8,684,977 | 5,371,885 | 8,874,074 |
| 금융비용 | 3,244,540 | 7,200,541 | 5,130,979 | 8,164,297 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 1,712,995 | 3,539,375 | 14,460,758 | 29,530,598 |
| 법인세비용 | (10,576) | 241,204 | 3,361,953 | 7,107,165 |
| 계속영업이익(손실) | 1,723,571 | 3,298,171 | 11,098,805 | 22,423,433 |
| 당기순이익(손실) | 1,723,571 | 3,298,171 | 11,098,805 | 22,423,433 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | | | | |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 1,547,018 | 2,948,270 | 10,954,515 | 22,083,609 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 176,553 | 349,901 | 144,290 | 339,824 |
| 주당이익 | | | | |
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 228 | 434 | 1,613 | 3,251 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 228 | 434 | 1,613 | 3,251 |

연결 포괄손익계산서

제 55 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

제 54 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

(단위 : 백만원)

| | 제 55 기 반기 | | 제 54 기 반기 | |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 당기순이익(손실) | 1,723,571 | 3,298,171 | 11,098,805 | 22,423,433 |
| 기타포괄손익 | (83,744) | 5,895,756 | 3,970,338 | 5,489,814 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 364,891 | 1,143,636 | (1,245,872) | (1,909,188) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | 475,009 | 1,471,490 | (1,195,764) | (1,799,944) |
| 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | (7,191) | 22,697 | (15,627) | (11,875) |
| 순확정급여부채(자산) 재측정요소 | (102,927) | (350,551) | (34,481) | (97,369) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | (448,635) | 4,752,120 | 5,216,210 | 7,399,002 |
| 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | (50,332) | 85,428 | 295,429 | 34,846 |
| 해외사업장환산외환차이 | (403,003) | 4,653,884 | 4,919,214 | 7,356,247 |
| 현금흐름위험회피파생상품평가손익 | 4,700 | 12,808 | 1,567 | 7,909 |
| 총포괄손익 | 1,639,827 | 9,193,927 | 15,069,143 | 27,913,247 |
| 포괄손익의 귀속 | | | | |
| 지배기업 소유주지분 | 1,474,638 | 8,761,401 | 14,890,896 | 27,498,046 |
| 비지배지분 | 165,189 | 432,526 | 178,247 | 415,201 |

연결 자본변동표

제 55 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

제 54 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

(단위 : 백만원)

| | 자본 | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| | 지배기업 소유주지분 | | | | | 비지배지분 | 자본 합계 |
| | 자본금 | 주식발행초과금 | 이익잉여금 | 기타자본항목 | 지배기업 소유주지분 합계 | | |
| 2022.01.01 (기초자본) | 897,514 | 4,403,893 | 293,064,763 | (2,128,473) | 296,237,697 | 8,662,234 | 304,899,931 |
| 당기순이익(손실) | | | 22,083,609 | | 22,083,609 | 339,824 | 22,423,433 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | | | (26,456) | (1,756,494) | (1,782,950) | (16,994) | (1,799,944) |
| 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | | | (26,456) | 22,729 | 22,729 | 242 | 22,971 |
| 해외사업장환산외환차이 | | | | 7,264,141 | 7,264,141 | 92,106 | 7,356,247 |
| 순확정급여부채(자산) 재측정요소 | | | | (97,392) | (97,392) | 23 | (97,369) |
| 현금흐름위험회피파생상품평가손익 | | | | 7,909 | 7,909 | | 7,909 |
| 배당 | | | (4,905,131) | | (4,905,131) | (1,457) | (4,906,588) |
| 연결실체내 자본거래 등 | | | | | | (404) | (404) |
| 기타 | | | | | | 478 | 478 |
| 2022.06.30 (기말자본) | 897,514 | 4,403,893 | 310,216,785 | 3,312,420 | 318,830,612 | 9,076,052 | 327,906,664 |
| 2023.01.01 (기초자본) | 897,514 | 4,403,893 | 337,946,407 | 1,938,328 | 345,186,142 | 9,563,462 | 354,749,604 |
| 당기순이익(손실) | | | 2,948,270 | | 2,948,270 | 349,901 | 3,298,171 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | | | 2,321,108 | (897,106) | 1,424,002 | 47,488 | 1,471,490 |
| 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | | | | 104,471 | 104,471 | 3,654 | 108,125 |
| 해외사업장환산외환차이 | | | | 4,622,266 | 4,622,266 | 31,618 | 4,653,884 |
| 순확정급여부채(자산) 재측정요소 | | | | (350,415) | (350,415) | (136) | (350,551) |
| 현금흐름위험회피파생상품평가손익 | | | | 12,807 | 12,807 | 1 | 12,808 |
| 배당 | | | (4,905,130) | | (4,905,130) | (61,116) | (4,966,246) |
| 연결실체내 자본거래 등 | | | | | | (825) | (825) |
| 기타 | | | | | | (834) | (834) |
| 2023.06.30 (기말자본) | 897,514 | 4,403,893 | 338,310,655 | 5,430,351 | 349,042,413 | 9,933,213 | 358,975,626 |

연결 현금흐름표

제 55 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

제 54 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

(단위 : 백만원)

| | 제 55 기 반기 | 제 54 기 반기 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 영업활동 현금흐름 | 14,461,689 | 24,589,135 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 16,982,831 | 31,054,031 |
| 당기순이익 | 3,298,171 | 22,423,433 |
| 조정 | 21,958,025 | 28,057,798 |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (8,273,365) | (19,427,200) |
| 이자의 수취 | 2,429,443 | 706,755 |
| 이자의 지급 | (441,850) | (264,834) |
| 배당금 수입 | 52,618 | 229,806 |
| 법인세 납부액 | (4,561,353) | (7,136,623) |
| 투자활동 현금흐름 | 21,022,564 | (19,929,267) |
| 단기금융상품의 순감소(증가) | 43,879,546 | (906,942) |
| 단기상각후원가금융자산의 순감소(증가) | 416,095 | 2,198,246 |
| 단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가) | 3,770 | (14,748) |
| 장기금융상품의 처분 | 4,491,705 | 5,343,921 |
| 장기금융상품의 취득 | (534) | (4,326,888) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 | 3,750,752 | 484,094 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 | (20,013) | (15,385) |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 38,818 | 157,878 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (69,368) | (76,726) |
| 관계기업 및 공동기업 투자의 처분 | 17,839 | 6,933 |
| 관계기업 및 공동기업 투자의 취득 | (65,182) | (903,758) |
| 유형자산의 처분 | 67,844 | 105,839 |
| 유형자산의 취득 | (29,373,990) | (20,157,775) |
| 무형자산의 처분 | 11,253 | 19,036 |
| 무형자산의 취득 | (1,620,300) | (1,576,361) |
| 사업결합으로 인한 현금유출액 | | (31,383) |
| 기타투자활동으로 인한 현금유출입액 | (505,671) | (235,248) |
| 재무활동 현금흐름 | (6,760,720) | (6,457,643) |
| 단기차입금의 순증가(감소) | (1,503,980) | (668,224) |
| 장기차입금의 차입 | 193,279 | 73,224 |
| 사채 및 장기차입금의 상환 | (543,400) | (955,802) |
| 배당금의 지급 | (4,905,792) | (4,906,518) |
| 비지배지분의 증감 | (827) | (323) |
| 외화환산으로 인한 현금의 변동 | 1,515,532 | 2,349,501 |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 30,239,065 | 551,726 |
| 기초의 현금및현금성자산 | 49,680,710 | 39,031,415 |

| | | |
|--------------|------------|------------|
| 기말의 현금및현금성자산 | 79,919,775 | 39,583,141 |
|--------------|------------|------------|

3. 연결재무제표 주석

제 55 기 반기 : 2023년 6월 30일 현재

제 54 기 : 2022년 12월 31일 현재

삼성전자주식회사와 그 종속기업

1. 일반적 사항:

가. 연결회사의 개요

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사 및 종속기업(이하 삼성전자주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 사업은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman으로 구성되어 있습니다. DX(Device eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 휴대폰, 통신시스템 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry, System LSI 등으로 구성되어 있습니다. SDC는 디스플레이 패널 사업을 영위하며, Harman은 전장부품사업 등을 영위하고 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 회사는 삼성디스플레이(주) 및 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 233개의 종속기업을 연결대상으로 하고, 삼성전기(주) 등 38개 관계기업과 공동기업을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

나. 종속기업 현황

당반기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

| 지역 | 기업명 | 업종 | 지분율 (%)(*) |
|--------------------------|---|-----------------|---------------|
| 미주 | Samsung Electronics America, Inc. (SEA) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung International, Inc. (SII) | 전자제품 생산 | 100.0 |
| | Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX) | 전자제품 생산 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA) | 가전제품 생산 | 100.0 |
| | Samsung Research America, Inc (SRA) | R&D | 100.0 |
| | SAMSUNG NEXT LLC (SNX) | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF) | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 100.0 |
| | NeuroLogica Corp. | 의료기기 생산 및 판매 | 100.0 |
| | Samsung HVAC America, LLC | 에어컨공조 판매 | 100.0 |
| | Joyent, Inc. | 클라우드서비스 | 100.0 |
| | SmartThings, Inc. | 스마트홈 플랫폼 | 100.0 |
| | TeleWorld Solutions, Inc. (TWS) | 네트워크장비 설치 및 최적화 | 100.0 |
| | Samsung Semiconductor, Inc. (SSI) | 반도체 · DP 판매 | 100.0 |
| | Samsung Federal, Inc. (SFI) | R&D | 100.0 |
| | Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS) | 반도체 생산 | 100.0 |
| | Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI) | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | SEMES America, Inc. | 반도체 장비 서비스 | 100.0 |
| | Emerald Intermediate, Inc. | 해외자회사관리 | 100.0 |
| | Emerald Merger Sub, Inc. | 해외자회사관리 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| AdGear Technologies Inc. | 디지털광고 플랫폼 | 100.0 | |

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

| 지역 | 기업명 | 업종 | 지분율 (%)(*) |
|---|--|----------------------------|---------------|
| 미주 | Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA) | 전자제품 생산 및 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM) | 가전제품 생산 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA) | 마케팅 및 서비스 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Chile Limitada (SECH) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN) | 마케팅 및 서비스 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA) | 컨설팅 | 100.0 |
| | Harman International Industries, Inc. | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Harman Becker Automotive Systems, Inc. | 오디오제품 생산, 판매, R&D | 100.0 |
| | Harman Connected Services, Inc. | Connected Service Provider | 100.0 |
| | Harman Connected Services Engineering Corp. | Connected Service Provider | 100.0 |
| | Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda. | 오디오제품 생산, 판매 | 100.0 |
| | Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V. | 오디오제품 생산 | 100.0 |
| | Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda. | 오디오제품 판매, R&D | 100.0 |
| | Harman Financial Group LLC | Management Company | 100.0 |
| | Harman International Industries Canada Ltd. | 오디오제품 판매 | 100.0 |
| | Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V. | 오디오제품 판매 | 100.0 |
| | Harman KG Holding, LLC | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Harman Professional, Inc. | 오디오제품 판매, R&D | 100.0 |
| Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P | 벤처기업 투자 | 61.4 | |
| China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership | 벤처기업 투자 | 99.0 | |

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

| 지역 | 기업명 | 업종 | 지분율 (%)(*) |
|--|--|---------------------|---------------|
| 유럽· CIS | Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Ltd. (SEL) | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL) | 반도체·DP 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics GmbH (SEG) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG) | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG) | 반도체·DP 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics France S.A.S (SEF) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH) | 전자제품 생산 및 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS) | 물류 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH) | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK) | TV·모니터 생산 | 100.0 |
| | Samsung Display Slovakia, s.r.o., v likvidacii (SDSK) | DP 임가공 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM) | 가전제품 생산 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Romania LLC (SEROM) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Baltics SIA (SEB) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE) | 에어컨공조 판매 | 100.0 |
| | Samsung Nanoradio Design Center (SNDC) | R&D | 100.0 |
| | Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC) | R&D | 100.0 |
| | Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC) | R&D | 100.0 |
| | SAMSUNG Zhilabs, S.L. | 네트워크Solution 개발, 판매 | 100.0 |
| | FOODIENT LTD. | R&D | 100.0 |
| | Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK) | TV 생산 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR) | R&D | 100.0 | |
| Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE) | 전자제품 판매 | 100.0 | |
| Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO) | 전자제품 판매 | 100.0 | |
| Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR) | R&D | 100.0 | |
| Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC) | 마케팅 | 100.0 | |
| Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ) | 전자제품 판매 | 100.0 | |

| 지역 | 기업명 | 업종 | 지분율 (%)(*) |
|--------------------|--|----------------------------|---------------|
| 유럽· CIS | AKG Acoustics Gmbh | 오디오제품 생산, 판매 | 100.0 |
| | Apostera UA, LLC | Connected Service Provider | 100.0 |
| | Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada | 오디오제품 판매 | 100.0 |
| | Harman Automotive UK Limited | 오디오제품 생산 | 100.0 |
| | Harman Becker Automotive Systems GmbH | 오디오제품 생산, 판매, R&D | 100.0 |
| | Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L. | 오디오제품 판매 | 100.0 |
| | Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft | 오디오제품 생산, R&D | 100.0 |
| | Harman Belgium SA | 오디오제품 판매 | 100.0 |
| | Harman Connected Services AB. | Connected Service Provider | 100.0 |
| | Harman Finland Oy | Connected Service Provider | 100.0 |
| | Harman Connected Services GmbH | Connected Service Provider | 100.0 |
| | Harman Connected Services Poland Sp.zoo | Connected Service Provider | 100.0 |
| | Harman Connected Services UK Ltd. | Connected Service Provider | 100.0 |
| | Harman Consumer Nederland B.V. | 오디오제품 판매 | 100.0 |
| | Harman Deutschland GmbH | 오디오제품 판매 | 100.0 |
| | Harman Finance International GP S.a.r.l | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Harman France SNC | 오디오제품 판매 | 100.0 |
| | Harman Holding Gmbh & Co. KG | Management Company | 100.0 |
| | Harman Hungary Financing Ltd. | Financing Company | 100.0 |
| | Harman Inc. & Co. KG | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Harman International Estonia OU | R&D | 100.0 |
| | Harman International Industries Limited | 오디오제품 판매, R&D | 100.0 |
| | Harman International Romania SRL | R&D | 100.0 |
| | Harman Finance International, SCA | Financing Company | 100.0 |
| | Harman Management Gmbh | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Harman Professional Kft | 오디오제품 생산, R&D | 100.0 |
| | Harman Professional Denmark ApS | 오디오제품 판매, R&D | 100.0 |
| | Red Bend Software SAS | 소프트웨어 디자인 | 100.0 |
| | Studer Professional Audio GmbH | 오디오제품 판매, R&D | 100.0 |
| | Harman Connected Services OOO | Connected Service Provider | 100.0 |
| Harman RUS CIS LLC | 오디오제품 판매 | 100.0 | |

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

| 지역 | 기업명 | 업종 | 지분율 (%)(*) |
|--------------|---|----------------------------|---------------|
| 중동 · 아프리카 | Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Turkiye (SETK) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P) | 전자제품 생산 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. (SELV) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG) | 전자제품 생산 및 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL) | 마케팅 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN) | 마케팅 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK) | 마케팅 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC) | R&D | 100.0 |
| | Corephotonics Ltd. | R&D | 100.0 |
| | Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP) | TV · 모니터 생산 | 100.0 |
| | Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA) | 마케팅 | 100.0 |
| | Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA) | 마케팅 | 100.0 |
| | Global Symphony Technology Group Private Ltd. | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Harman Connected Services Morocco | Connected Service Provider | 100.0 |
| | Harman Industries Holdings Mauritius Ltd. | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Red Bend Ltd. | 오디오제품 생산 | 100.0 |

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

| 지역 | 기업명 | 업종 | 지분율 (%)(*) |
|-------------------|---|----------------------------|---------------|
| 아시아 (중국 제외) | Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL) | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA) | 전자제품 생산 | 100.0 |
| | Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA) | 가전제품 생산 | 100.0 |
| | Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV) | 전자제품 생산 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT) | 통신제품 생산 | 100.0 |
| | Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC) | 전자제품 생산 및 판매 | 100.0 |
| | Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV) | DP 생산 | 100.0 |
| | DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED | DP 부품 생산 | 100.0 |
| | PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN) | 전자제품 생산 및 판매 | 100.0 |
| | PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN) | 전자제품 판매 및 서비스 | 100.0 |
| | Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE) | 전자제품 생산 및 판매 | 91.8 |
| | Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE) | 마케팅 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL) | 전자제품 생산 및 판매 | 100.0 |
| | Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd. | 마케팅 | 100.0 |
| | Samsung Display Noida Private Limited (SDN) | DP 생산 | 100.0 |
| | Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore) | R&D | 100.0 |
| | Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD) | R&D | 100.0 |
| | Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL) | 서비스 | 100.0 |
| | Samsung Japan Corporation (SJC) | 반도체 · DP 판매 | 100.0 |
| | Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ) | R&D | 100.0 |
| | Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd. | Connected Service Provider | 100.0 |
| | Harman International (India) Private Limited | 오디오제품 판매, R&D | 100.0 |
| | Harman International Industries PTY Ltd. | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Harman International Japan Co., Ltd. | 오디오제품 판매, R&D | 100.0 |
| | Harman Singapore Pte. Ltd. | 오디오제품 판매 | 100.0 |

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

| 지역 | 기업명 | 업종 | 지분율 (%) (*) |
|----|---|----------------------------|-------------|
| 중국 | Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. (TSEC) | TV · 모니터 생산 | 91.2 |
| | Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC) | 가전제품 생산 | 88.3 |
| | Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E) | 가전제품 생산 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC) | R&D | 100.0 |
| | Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC) | 통신제품 생산 | 90.0 |
| | Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing) | R&D | 100.0 |
| | Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing) | R&D | 100.0 |
| | Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou) | R&D | 100.0 |
| | Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen) | R&D | 100.0 |
| | Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS) | 반도체 · DP 판매 | 100.0 |
| | Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS) | 반도체 생산 | 100.0 |
| | Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX) | 반도체 · DP 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS) | 반도체 임가공 | 100.0 |
| | Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED) | LED 생산 | 100.0 |
| | Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR) | R&D | 100.0 |
| | Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD) | DP 생산 | 100.0 |
| | Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT) | DP 생산 | 95.0 |
| | SEMES (XIAN) Co., Ltd. | 반도체 장비 서비스 | 100.0 |
| | Samsung Semiconductor Investment L.P. I | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | Harman (China) Technologies Co., Ltd. | 오디오제품 생산 | 100.0 |
| | Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd. | 오디오제품 판매 | 100.0 |
| | Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd. | 오디오제품 생산, R&D | 100.0 |
| | Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd. | 오디오제품 판매 | 100.0 |
| | Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd. | Connected Service Provider | 100.0 |
| | Harman Holding Limited | 오디오제품 판매 | 100.0 |
| | Harman International (China) Holdings Co., Ltd. | 오디오제품 판매, R&D | 100.0 |
| | Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | 오디오제품 판매, R&D | 100.0 |

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

| 지역 | 기업명 | 업종 | 지분율 (%) |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 국내 | 삼성디스플레이(주) | DP 생산 및 판매 | 84.8 |
| | 에스유머티리얼스(주) | DP 부품 생산 | 50.0 |
| | 스테코(주) | 반도체 부품 생산 | 70.0 |
| | 세메스(주) | 반도체 · FPD 장비 생산, 판매 | 91.5 |
| | 삼성전자서비스(주) | 전자제품 수리 서비스 | 99.3 |
| | 삼성전자서비스씨에스(주) | 고객상담서비스 | 100.0 |
| | 삼성전자판매(주) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | 삼성전자로지텍(주) | 종합물류대행 | 100.0 |
| | 삼성메디슨(주) | 의료기기 생산 및 판매 | 68.5 |
| | (주)희망별숲 | 식품 제조 가공 | 100.0 |
| | (주)미래로시스템 | 반도체 소프트웨어 개발 및 공급 | 99.9 |
| | (주)도우인시스 | DP 부품 생산 | 69.0 |
| | 지에프(주) | DP 부품 생산 | 100.0 |
| | (주)하만인터내셔널코리아 | 소프트웨어 개발 및 공급 | 100.0 |
| | SVIC 21호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 22호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 26호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 28호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 29호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 32호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 33호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 37호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 40호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 42호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 43호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 45호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 48호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 52호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 55호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 56호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 57호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 62호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | 반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁 | 반도체산업 투자 | 66.7 |
| 시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁 | 반도체산업 투자 | 62.5 | |

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

다. 당반기 및 전기의 주요 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(1) 당반기

(단위 : 백만원)

| 기업명(*1) | 당반기말 | | 당반기 | | | |
|--|------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|
| | 자산 | 부채 | 3개월 | | 누적 | |
| | | | 매출액 | 분기순이익 | 매출액 | 반기순이익 |
| 삼성디스플레이㈜ | 59,206,888 | 6,470,299 | 5,444,771 | 871,621 | 11,035,413 | 2,404,779 |
| Samsung Electronics America, Inc. (SEA) | 38,938,571 | 12,063,696 | 9,157,280 | 79,508 | 19,977,552 | 294,772 |
| Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL) | 23,579,581 | 1,186,112 | - | 333,661 | - | 6,966,849 |
| Harman과 그 종속기업(*2) | 17,628,070 | 6,154,046 | 3,488,999 | 205,076 | 6,651,475 | 285,899 |
| Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS) | 15,957,741 | 1,346,950 | 2,440,992 | 203,913 | 5,011,167 | 530,735 |
| Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT) | 14,327,372 | 2,734,691 | 6,729,383 | 870,408 | 15,346,957 | 1,166,442 |
| Samsung Semiconductor, Inc. (SSI) | 11,686,283 | 5,001,617 | 5,113,436 | 55,475 | 10,076,971 | 182,461 |
| Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS) | 11,545,027 | 2,512,400 | 1,136,235 | 148,327 | 2,091,445 | 252,445 |
| Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC) | 9,821,955 | 8,407,678 | 702,653 | 12,754 | 1,574,264 | 177,969 |
| Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH) | 9,693,632 | 4,624,422 | - | 23,610 | - | 32,085 |
| Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV) | 9,526,085 | 1,890,857 | 4,337,615 | 447,372 | 10,033,911 | 910,213 |
| Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL) | 7,396,505 | 3,478,642 | 3,499,445 | 235,083 | 7,313,363 | 568,363 |
| Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV) | 7,237,305 | 1,889,058 | 5,025,494 | 120,439 | 10,213,581 | 570,535 |
| Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA) | 5,290,815 | 1,439,082 | 1,738,745 | 32,413 | 3,654,447 | 164,645 |
| Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC) | 4,029,275 | 821,791 | 1,598,461 | 153,715 | 3,095,852 | 352,241 |
| Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS) | 3,785,339 | 3,202,972 | 3,669,230 | 50,856 | 6,589,203 | 114,934 |
| Samsung International, Inc. (SII) | 2,981,785 | 830,750 | 1,912,341 | 403,181 | 3,668,330 | 768,771 |
| Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE) | 2,918,991 | 534,692 | 1,183,524 | 96,887 | 2,402,275 | 185,939 |
| Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK) | 2,552,143 | 1,722,261 | 1,323,540 | 14 | 2,850,876 | 72,364 |
| Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS) | 2,438,051 | 2,019,758 | 3,802,880 | 42,336 | 8,045,329 | 226,763 |
| Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM) | 2,251,383 | 1,193,458 | 909,620 | 23,765 | 1,752,163 | 83,052 |
| 세메스㈜ | 2,147,494 | 603,152 | 683,383 | 58,675 | 1,409,736 | 82,958 |
| Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD) | 2,117,019 | 191,384 | 348,339 | 33,691 | 757,767 | 62,505 |
| Samsung Electronics GmbH (SEG) | 2,013,641 | 1,891,158 | 1,407,255 | (5,306) | 3,049,199 | 54,982 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN) | 1,782,683 | 635,257 | 630,333 | 26,455 | 1,462,038 | 132,672 |

(*1) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

| 기업명(*1) | 전기말 | | 전반기 | | | |
|--|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 자산 | 부채 | 3개월 | | 누 적 | |
| | | | 매출액 | 분기순이익 | 매출액 | 반기순이익 |
| 삼성디스플레이(주) | 57,302,567 | 7,282,718 | 6,845,875 | 791,204 | 13,946,851 | 1,817,837 |
| Samsung Electronics America, Inc. (SEA) | 37,883,156 | 12,258,315 | 12,333,476 | 316,721 | 23,673,944 | 271,086 |
| Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL) | 26,894,611 | 2,678,285 | - | 2,505,351 | - | 2,516,913 |
| Harman과 그 종속기업(*2) | 17,102,324 | 6,380,456 | 2,986,052 | 36,184 | 5,648,793 | 126,028 |
| Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS) | 17,095,000 | 2,970,835 | 2,453,729 | 165,104 | 4,869,323 | 321,642 |
| Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT) | 15,718,299 | 2,358,140 | 9,983,377 | 971,650 | 20,552,811 | 1,934,576 |
| Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC) | 13,830,988 | 9,764,636 | 528,784 | (43,273) | 1,361,932 | 63,608 |
| Samsung Semiconductor, Inc. (SSI) | 12,199,102 | 5,930,369 | 12,742,094 | 33,503 | 23,653,098 | 75,744 |
| Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV) | 10,931,037 | 1,408,387 | 5,919,010 | 499,274 | 11,739,681 | 928,374 |
| Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH) | 10,841,515 | 6,272,800 | - | 21,517 | - | 28,482 |
| Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS) | 9,301,017 | 828,494 | 836,674 | (12,167) | 1,625,295 | (14,589) |
| Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV) | 7,471,680 | 1,608,448 | 5,142,739 | 56,185 | 10,814,792 | 187,691 |
| Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL) | 6,772,537 | 3,571,863 | 3,488,909 | 114,899 | 7,688,929 | 317,183 |
| Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS) | 5,067,891 | 2,858,382 | 6,504,147 | 62,530 | 13,054,783 | 138,258 |
| Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA) | 4,600,508 | 1,342,517 | 1,971,171 | (45,838) | 3,890,800 | 68,690 |
| Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC) | 3,732,057 | 980,448 | 1,602,862 | 125,102 | 3,554,895 | 327,308 |
| Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE) | 3,263,473 | 486,820 | 1,297,116 | 22,286 | 2,711,163 | 5,686 |
| Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK) | 2,819,792 | 1,708,064 | 1,349,597 | (24,169) | 2,881,511 | (5,105) |
| Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN) | 2,377,730 | 597,044 | 612,857 | (13,563) | 1,420,327 | (6,661) |
| Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH) | 2,374,317 | 452,628 | 881,554 | 42,573 | 2,205,901 | 123,503 |
| Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS) | 2,194,975 | 2,021,491 | 3,663,321 | 60,139 | 8,262,182 | 300,226 |
| Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD) | 2,135,132 | 265,835 | 788,603 | 33,918 | 1,595,752 | 83,548 |
| 세메스(주) | 2,065,558 | 602,323 | 740,885 | 54,932 | 1,466,317 | 128,901 |
| Samsung Electronics GmbH (SEG) | 1,968,273 | 1,907,132 | 1,485,197 | (75,712) | 3,186,298 | (133,174) |
| Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM) | 1,816,895 | 996,002 | 880,155 | 17,403 | 1,556,318 | 52,569 |

(*1) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

라. 연결대상범위의 변동

당반기 중 연결재무제표 작성대상범위의 변동 내용은 다음과 같습니다.

| 구분 | 지역 | 기업명 | 사유 |
|------|--------|-----------------------------|----|
| 신규연결 | 국내 | SVIC 62호 신기술투자조합 | 설립 |
| | 미주 | Samsung Federal, Inc. (SFI) | 설립 |
| | | Emerald Intermediate, Inc. | 설립 |
| | | Emerald Merger Sub, Inc. | 설립 |
| 연결제외 | 미주 | Dacor Holdings, Inc. | 합병 |
| | | Dacor, Inc. | 합병 |
| | 유럽·CIS | Red Bend Software Ltd. | 청산 |

2. 중요한 회계처리방침:

2.1. 재무제표 작성기준

연결회사의 2023년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 반기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 반기연결재무제표는 보고기간종료일인 2023년 6월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

가. 연결회사가 채택한 제·개정 기준서

연결회사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

공시 대상 회계정책 정보를 '유의적인' 회계정책에서 '중요한(material)' 회계정책으로 대체하고 그 의미를 명확히 하였습니다. 또한, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서2 '중요성에 대한 판단'을 개정하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래당시 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

나. 연결회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서

제정 또는 공표됐으나 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 연결회사가 조기 적용하지 않은 주요 제·개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.

2.2. 회계정책

반기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.3. 중요한 회계추정 및 가정

반기연결재무제표 작성시 연결회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산·부채의 장부금액 및 이익·비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

반기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 범주별 금융상품:

보고기간종료일 현재 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당반기말

(단위 : 백만원)

| 금융자산 | 상각후원가 측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타금융자산(*) | 계 |
|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------|-------------|
| 현금및현금성자산 | 79,919,775 | - | - | - | 79,919,775 |
| 단기금융상품 | 17,180,130 | - | - | - | 17,180,130 |
| 단기상각후원가금융자산 | - | - | - | - | - |
| 단기당기손익-공정가치금융자산 | - | - | 25,310 | - | 25,310 |
| 매출채권 | 36,104,142 | - | - | - | 36,104,142 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | 10,308,125 | - | - | 10,308,125 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | - | 1,573,457 | - | 1,573,457 |
| 기타 | 10,472,509 | - | 448,027 | 76,182 | 10,996,718 |
| 계 | 143,676,556 | 10,308,125 | 2,046,794 | 76,182 | 156,107,657 |

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

| 금융부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 기타금융부채(*) | 계 |
|---------|------------------|----------------------|-----------|------------|
| 매입채무 | 11,744,005 | - | - | 11,744,005 |
| 단기차입금 | 473,326 | - | 3,084,034 | 3,557,360 |
| 미지급금 | 13,443,741 | - | - | 13,443,741 |
| 유동성장기부채 | 299,158 | - | 964,683 | 1,263,841 |
| 사채 | 554,625 | - | - | 554,625 |
| 장기차입금 | 33,756 | - | 3,729,494 | 3,763,250 |
| 장기미지급금 | 4,890,945 | - | - | 4,890,945 |
| 기타 | 10,421,841 | 297,833 | 24,105 | 10,743,779 |
| 계 | 41,861,397 | 297,833 | 7,802,316 | 49,961,546 |

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

| 금융자산 | 상각후원가 측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타금융자산(*) | 계 |
|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------|-------------|
| 현금및현금성자산 | 49,680,710 | - | - | - | 49,680,710 |
| 단기금융상품 | 65,102,886 | - | - | - | 65,102,886 |
| 단기상각후원가금융자산 | 414,610 | - | - | - | 414,610 |
| 단기당기손익-공정가치금융자산 | - | - | 29,080 | - | 29,080 |
| 매출채권 | 35,721,563 | - | - | - | 35,721,563 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | 11,397,012 | - | - | 11,397,012 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | - | 1,405,468 | - | 1,405,468 |
| 기타 | 9,945,209 | - | 334,263 | 61,404 | 10,340,876 |
| 계 | 160,864,978 | 11,397,012 | 1,768,811 | 61,404 | 174,092,205 |

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

| 금융부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 기타금융부채(*) | 계 |
|---------|------------------|----------------------|-----------|------------|
| 매입채무 | 10,644,686 | - | - | 10,644,686 |
| 단기차입금 | 1,577,958 | - | 3,569,357 | 5,147,315 |
| 미지급금 | 16,328,237 | - | - | 16,328,237 |
| 유동성장기부채 | 215,143 | - | 874,019 | 1,089,162 |
| 사채 | 536,093 | - | - | 536,093 |
| 장기차입금 | 33,846 | - | 3,526,826 | 3,560,672 |
| 장기미지급금 | 2,289,236 | - | - | 2,289,236 |
| 기타 | 12,047,761 | 334,415 | 27,353 | 12,409,529 |
| 계 | 43,672,960 | 334,415 | 7,997,555 | 52,004,930 |

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

4. 공정가치금융자산:

가. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기타포괄손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|--------|------------|------------|
| 비유동항목: | | |
| 지분상품 | 10,308,125 | 11,397,012 |

(2) 당기손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|--------|-----------|-----------|
| 유동항목: | | |
| 채무상품 | 25,310 | 29,080 |
| 비유동항목: | | |
| 지분상품 | 904,192 | 773,063 |
| 채무상품 | 669,265 | 632,405 |
| 소 계 | 1,573,457 | 1,405,468 |
| 계 | 1,598,767 | 1,434,548 |

나. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, %, 백만원)

| 기업명 | 당반기말 | | | | 전기말 |
|----------------------|--------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| | 보유주식수 (주) | 지분율 (%)(*) | 취득원가 | 장부금액 (시장가치) | 장부금액 (시장가치) |
| 삼성중공업(주) | 134,027,281 | 15.2 | 932,158 | 893,962 | 684,879 |
| (주)호텔신라 | 2,004,717 | 5.1 | 13,957 | 147,146 | 166,592 |
| (주)아이마켓코리아 | 647,320 | 1.9 | 324 | 6,402 | 6,538 |
| (주)에스에프에이 | 2,100,000 | 5.8 | 22,050 | 75,600 | 132,642 |
| (주)원익홀딩스 | 3,518,342 | 4.6 | 30,821 | 13,352 | 11,945 |
| (주)원익아이피에스 | 3,701,872 | 7.5 | 32,428 | 121,421 | 91,621 |
| ASML Holding N.V. | 2,750,072 | 0.7 | 158,517 | 2,601,025 | 4,287,121 |
| Wacom Co., Ltd. | 8,398,400 | 5.3 | 62,013 | 44,789 | 46,750 |
| Corning Incorporated | 80,000,000 | 9.4 | 3,980,636 | 3,680,041 | 3,238,205 |
| 기타 | | | 594,391 | 999,767 | 855,452 |
| 계 | | | 5,827,295 | 8,583,505 | 9,521,745 |

(*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

5. 재고자산:

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기말 | | | 전기말 | | |
|-----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 평가전금액 | 평가총당금 | 장부금액 | 평가전금액 | 평가총당금 | 장부금액 |
| 제품 및 상품 | 16,909,611 | (1,823,192) | 15,086,419 | 17,526,178 | (1,493,952) | 16,032,226 |
| 반제품 및 재공품 | 27,960,258 | (3,784,518) | 24,175,740 | 21,612,965 | (1,535,446) | 20,077,519 |
| 원재료 및 저장품 | 16,304,014 | (1,324,533) | 14,979,481 | 16,268,974 | (1,289,694) | 14,979,280 |
| 미착품 | 1,263,158 | - | 1,263,158 | 1,098,841 | - | 1,098,841 |
| 계 | 62,437,041 | (6,932,243) | 55,504,798 | 56,506,958 | (4,319,092) | 52,187,866 |

6. 관계기업 및 공동기업 투자:

가. 당반기 및 전반기 중 관계기업 및 공동기업 투자의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|------------|------------|------------|
| 기초 | 10,893,869 | 8,932,251 |
| 취득 | 65,182 | 1,002,798 |
| 처분 | (18,357) | (6,913) |
| 이익 중 지분해당액 | 413,782 | 491,706 |
| 기타(*) | (19,777) | (36,904) |
| 반기말 | 11,334,699 | 10,382,938 |

(*) 기타는 배당, 손상, 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 및 공동기업 투자 현황은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

| 기업명 | 관계의 성격 | 지분율(%)(*1) | 주사업장 | 결산월 |
|--------------|--|------------|------|-----|
| 삼성전기(주) | 수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급 | 23.7 | 한국 | 12월 |
| 삼성에스디에스(주) | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합·관리 등 IT 서비스 및 물류서비스 제공 | 22.6 | 한국 | 12월 |
| 삼성바이오로직스(주) | 신사업 투자 | 31.2 | 한국 | 12월 |
| 삼성SDI(주)(*2) | 2차전지 등 전자부품의 생산 및 공급 | 19.6 | 한국 | 12월 |
| (주)제일기획 | 광고 대행업 | 25.2 | 한국 | 12월 |

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

(2) 공동기업 투자

| 기업명 | 관계의 성격 | 지분율(%)(*1) | 주사업장 | 결산월 |
|-----------------|---------------------|------------|------|-----|
| 삼성코닝어드밴스드글라스(유) | 기타 산업용 유리제품 생산 및 공급 | 50.0 | 한국 | 12월 |

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

다. 보고기간종료일 현재 관계기업 및 공동기업 투자 내역은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

(단위 : 백만원)

| 기업명 | 당반기말 | | | 전기말 | | |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | 취득원가 | 순자산가액(*) | 장부금액 | 취득원가 | 순자산가액(*) | 장부금액 |
| 삼성전기(주) | 359,237 | 1,789,744 | 1,789,544 | 359,237 | 1,765,507 | 1,764,249 |
| 삼성에스디에스(주) | 147,963 | 1,905,359 | 1,918,426 | 147,963 | 1,857,481 | 1,870,338 |
| 삼성바이오로직스(주) | 1,424,358 | 2,906,481 | 2,911,314 | 1,424,358 | 2,804,547 | 2,808,673 |
| 삼성SDI(주) | 1,242,605 | 3,540,877 | 2,816,234 | 1,242,605 | 3,318,875 | 2,691,223 |
| (주)제일기획 | 506,162 | 349,678 | 650,157 | 506,162 | 347,510 | 649,161 |
| 기타 | 693,839 | 795,017 | 1,042,491 | 645,255 | 718,801 | 907,333 |
| 계 | 4,374,164 | 11,287,156 | 11,128,166 | 4,325,580 | 10,812,721 | 10,690,977 |

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

(2) 공동기업 투자

(단위 : 백만원)

| 기업명 | 당반기말 | | | 전기말 | | |
|-----------------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | 취득원가 | 순자산가액(*) | 장부금액 | 취득원가 | 순자산가액(*) | 장부금액 |
| 삼성코닝어드밴스드글라스(유) | 215,000 | 136,279 | 136,297 | 215,000 | 137,727 | 137,745 |
| 기타 | 259,994 | 71,044 | 70,236 | 259,994 | 67,632 | 65,147 |
| 계 | 474,994 | 207,323 | 206,533 | 474,994 | 205,359 | 202,892 |

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

라. 당반기 및 전반기 중 지분법평가 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당반기

(단위 : 백만원)

| 기업명 | 기초 | 지분법평가 내역 | | | 반기말 |
|-----------------|------------|----------|---------|----------|------------|
| | | 지분법손익 | 지분법자본변동 | 기타증감액(*) | |
| 삼성전기(주) | 1,764,249 | 56,192 | 6,258 | (37,155) | 1,789,544 |
| 삼성에스디에스(주) | 1,870,338 | 84,939 | 19,059 | (55,910) | 1,918,426 |
| 삼성바이오로직스(주) | 2,808,673 | 102,673 | (32) | - | 2,911,314 |
| 삼성SDI(주) | 2,691,223 | 101,539 | 37,340 | (13,868) | 2,816,234 |
| (주)제일기획 | 649,161 | 29,823 | 4,567 | (33,394) | 650,157 |
| 삼성코닝어드밴스드글라스(유) | 137,745 | (1,448) | - | - | 136,297 |
| 기타 | 972,480 | 40,064 | 40,933 | 59,250 | 1,112,727 |
| 계 | 10,893,869 | 413,782 | 108,125 | (81,077) | 11,334,699 |

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당, 손상 및 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 전반기

(단위 : 백만원)

| 기업명 | 기초 | 지분법평가 내역 | | | 반기말 |
|-----------------|-----------|----------|----------|----------|------------|
| | | 지분법손익 | 지분법자본변동 | 기타증감액(*) | |
| 삼성전기(주) | 1,556,386 | 143,913 | 24,503 | (37,156) | 1,687,646 |
| 삼성에스디에스(주) | 1,652,155 | 100,037 | 26,499 | (41,933) | 1,736,758 |
| 삼성바이오로직스(주) | 1,577,664 | 93,678 | (1,888) | 981,164 | 2,650,618 |
| 삼성SDI(주) | 2,529,650 | 91,076 | 20,729 | (13,462) | 2,627,993 |
| (주)제일기획 | 621,292 | 30,141 | 7,828 | (28,747) | 630,514 |
| 삼성코닝어드밴스드글라스(유) | 135,580 | 3,277 | - | - | 138,857 |
| 기타 | 859,524 | 29,584 | (54,700) | 76,144 | 910,552 |
| 계 | 8,932,251 | 491,706 | 22,971 | 936,010 | 10,382,938 |

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당, 손상 및 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

마. 주요 관계기업 및 공동기업 투자의 요약 재무정보 등은 다음과 같습니다.

(1) 주요 관계기업

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | | | | |
|-----------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| | 삼성전기(주) | 삼성에스디에스(주) | 삼성바이오로직스(주) | 삼성SDI(주) | (주)제일기획 |
| I. 요약 재무정보(연결재무제표 기준) | | | | | |
| 요약 재무상태표: | | | | | |
| 유동자산 | 4,989,963 | 7,873,234 | 5,222,084 | 10,437,387 | 1,979,357 |
| 비유동자산 | 6,196,663 | 4,078,928 | 10,479,717 | 22,465,431 | 564,032 |
| 유동부채 | 2,643,685 | 2,210,196 | 3,590,808 | 9,489,196 | 1,110,927 |
| 비유동부채 | 736,124 | 996,079 | 2,799,969 | 4,961,003 | 201,884 |
| 비지배지분 | 164,835 | 310,735 | - | 864,153 | 10,974 |
| 요약 포괄손익계산서: | | | | | |
| 매출 | 4,242,517 | 6,691,688 | 1,587,107 | 11,195,427 | 1,913,000 |
| 반기순손익(*) | 237,527 | 375,102 | 326,641 | 899,767 | 104,081 |
| 기타포괄손익(*) | 36,158 | 84,377 | (91) | 271,927 | 19,952 |
| 총포괄손익(*) | 273,685 | 459,479 | 326,550 | 1,171,694 | 124,033 |
| II. 배당 | | | | | |
| 배당 | 37,155 | 55,911 | - | 13,867 | 33,394 |

(*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 전기 | | | | |
|-----------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| | 삼성전기(주) | 삼성에스디에스(주) | 삼성바이오로직스(주) | 삼성SDI(주) | 주제일기획 |
| I. 요약 재무정보(연결재무제표 기준) | | | | | |
| 요약 재무상태표(전기말): | | | | | |
| 유동자산 | 4,888,319 | 8,005,764 | 6,457,657 | 9,651,702 | 2,193,979 |
| 비유동자산 | 6,108,852 | 3,946,660 | 10,124,394 | 20,605,823 | 557,466 |
| 유동부채 | 2,525,123 | 2,493,323 | 4,181,542 | 8,006,939 | 1,335,643 |
| 비유동부채 | 778,563 | 992,132 | 3,416,034 | 5,033,084 | 194,373 |
| 비지배지분 | 154,991 | 243,777 | - | 731,779 | 9,388 |
| 요약 포괄손익계산서(전반기): | | | | | |
| 매출 | 5,089,065 | 8,786,676 | 1,162,727 | 8,790,200 | 1,922,981 |
| 반기순손익(*) | 604,625 | 464,770 | 298,983 | 747,915 | 105,224 |
| 기타포괄손익(*) | 106,251 | 110,958 | 1,476 | 148,171 | 28,644 |
| 총포괄손익(*) | 710,876 | 575,728 | 300,459 | 896,086 | 133,868 |
| II. 배당(전반기) | | | | | |
| 배당 | 37,155 | 41,933 | - | 13,463 | 28,748 |

(*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(2) 주요 공동기업

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 삼성코닝어드밴스드글라스(유) | |
|----------------|-----------------|---------|
| | 당반기 | 전기 |
| I. 요약 재무정보 | | |
| 요약 재무상태표: | | |
| 유동자산 | 108,663 | 170,103 |
| 비유동자산 | 186,867 | 125,507 |
| 유동부채 | 21,507 | 19,794 |
| 비유동부채 | 1,466 | 363 |
| 요약 포괄손익계산서(*): | | |
| 매출 | 50,320 | 75,043 |
| 반기순손익 | (2,896) | 6,553 |
| 기타포괄손익 | - | - |
| 총포괄손익 | (2,896) | 6,553 |
| II. 배당 | | |
| 배당 | - | - |

(*) 반기 6개월 기준 금액입니다.

(3) 개별적으로 중요하지 않은 관계기업과 공동기업의 손익 중 연결회사의 지분 해당액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | | 전반기 | |
|--------|--------|-------|----------|---------|
| | 관계기업 | 공동기업 | 관계기업 | 공동기업 |
| 반기순손익 | 38,861 | 1,203 | 28,633 | 951 |
| 기타포괄손익 | 40,789 | 144 | (51,498) | (3,202) |
| 총포괄손익 | 79,650 | 1,347 | (22,865) | (2,251) |

바. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 주요 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

| 기 업 명 | 당반기말 | | 전기말 |
|-------------|------------|------------|------------|
| | 주식수(주) | 시장가치 | 시장가치 |
| 삼성전기(주) | 17,693,084 | 2,556,651 | 2,308,947 |
| 삼성에스디에스(주) | 17,472,110 | 2,147,322 | 2,149,070 |
| 삼성바이오로직스(주) | 22,217,309 | 16,529,678 | 18,240,411 |
| 삼성SDI(주) | 13,462,673 | 9,006,528 | 7,956,440 |
| (주)제일기획 | 29,038,075 | 526,460 | 669,328 |

사. 기타사항

증권선물위원회는 연결회사의 관계기업인 삼성바이오로직스(주)가 Biogen Therapeutics Inc.와 합작 투자한 삼성바이오에피스(주) 지분에 대한 회계처리와 관련하여, 합작계약 약정사항의 재무제표 주식 미기재를 이유로 담당임원 해임권고, 검찰 고발, 감사인 지정 등의 조치(이하 "1차 처분")를 2018년 7월 12일에 의결하였으며, 연결대상 범위 회계처리 오류 등 회계기준 위반을 이유로 과징금 80억원 부과, 대표이사 해임권고, 재무제표 재작성, 검찰 고발 등의 조치(이하 "2차 처분")를 2018년 11월 14일 의결하였습니다.

이에 대하여 삼성바이오로직스(주)는 회계처리의 정당성을 입증하기 위하여 위 처분의 취소를 구하는 소송(이하 "본안 소송")을 서울행정법원에 제기하였고, 현재 소송을 진행 중입니다. 1차 처분의 취소를 구하는 소송과 관련하여, 서울행정법원은 2020년 9월 24일 증권선물위원회가 부과한 행정 처분을 취소한다고 판결하고, 항소심 판결 선고 시까지 위 처분의 효력을 정지하는 결정을 하였습니다. 이에 증권선물위원회는 2020년 10월 16일 항소하여 현재 서울고등법원에서 소송을 진행 중입니다. 또한, 삼성바이오로직스(주)는 위 처분에 대한 효력정지신청서를 서울행정법원에 제출하였으며, 법원은 2019년 1월 22일(2차 처분)과 2019년 2월 19일(1차 처분)에 본안 소송의 판결 시까지 처분의 효력을 정지하는 결정을 선고하였습니다. 이에 증권선물위원회는 위 집행정지 결정에 대하여 즉시항고하였으며, 서울고등법원은 2019년 5월 13일(2차 처분), 2019년 5월 24일(1차 처분) 항고를 기각하였습니다. 이에 증권선물위원회는 2019년 5월 23일(2차 처분), 2019년 6월 10일(1차 처분) 재항고하였으며, 대법원은 2019년 9월 6일(2차 처분), 2019년 10월 11일(1차 처분) 재항고를 기각하여 효력정지 결정이 확정되었습니다.

향후 행정소송의 결과를 예측하기 어려우나 소송 결과에 따라 삼성바이오로직스(주)가 삼성바이오에피스(주) 지분에 관한 과거 회계처리를 수정하여 재무제표를 재작성하게 될 경우, 이로 인해 연결회사의 2015년과 그 이후 기간 지분법평가손익, 관계기업투자주식, 이익잉여금과 2016년 일부 지분 처분이익 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 현재로서는 삼성바이오로직스(주)와 증권선물위원회 간의 행정소송에 대한 종결 시기와 그 결과를 예측할 수 없으므로, 연결회사의 당반기 재무제표에 이를 반영하기 어렵습니다.

7. 유형자산:

가. 당반기 및 전반기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|--------------|--------------|--------------|
| 기초장부금액 | 168,045,388 | 149,928,539 |
| 일반취득 및 자본적지출 | 26,299,312 | 20,754,405 |
| 감가상각 | (17,568,639) | (18,077,845) |
| 처분·폐기·손상 | (209,921) | (164,773) |
| 기타(*) | 1,303,802 | 1,814,250 |
| 반기말장부금액 | 177,869,942 | 154,254,576 |

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액, 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

나. 당반기 및 전반기 중 계정과목별 유형자산 상각 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|-----------|------------|------------|
| 매출원가 | 15,643,321 | 16,292,066 |
| 판매비와관리비 등 | 1,925,318 | 1,785,779 |
| 계 | 17,568,639 | 18,077,845 |

다. 당반기말 현재 유형자산에 포함된 사용권자산은 5,479,379백만원(전기말: 4,917,609백만원)입니다. 또한, 당반기 중 신규 발생한 사용권자산은 1,040,012백만원(전반기: 502,506백만원)이며, 사용권자산의 감가상각비는 589,402백만원(전반기:469,474백만원)입니다.

8. 무형자산:

가. 당반기 및 전반기 중 무형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|----------|-------------|-------------|
| 기초장부금액 | 20,217,754 | 20,236,244 |
| 개별 취득 | 4,324,670 | 859,818 |
| 상각 | (1,576,451) | (1,543,029) |
| 처분·폐기·손상 | (25,652) | (27,801) |
| 기타(*) | 489,913 | 571,694 |
| 반기말장부금액 | 23,430,234 | 20,096,926 |

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액, 사업결합으로 인한 취득 등을 포함하고 있습니다.

나. 당반기 및 전반기 중 계정과목별 무형자산 상각 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|-----------|-----------|-----------|
| 매출원가 | 1,109,423 | 1,070,464 |
| 판매비와관리비 등 | 467,028 | 472,565 |
| 계 | 1,576,451 | 1,543,029 |

9. 차입금:

보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : %, 백만원)

| 구 분 | 차입처 | 연이자율(%) | 금 액 | |
|------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | | 당반기말 | 당반기말 | 전기말 |
| 단기차입금: | | | | |
| 담보부차입금(*1) | 우리은행 등 | 0.1~17.7 | 3,084,034 | 3,569,357 |
| 무담보차입금 | 씨티은행 등 | 0.1~62.2 | 473,326 | 1,577,958 |
| 계 | | | 3,557,360 | 5,147,315 |
| 유동성장기차입금: | | | | |
| 은행차입금 | BNP 등 | 36.7~61.5 | 292,688 | 208,915 |
| 리스부채(*2) | CSSD 등 | 4.1 | 964,683 | 874,019 |
| 계 | | | 1,257,371 | 1,082,934 |
| 장기차입금: | | | | |
| 은행차입금 | 기업은행 등 | 2.5~6.7 | 33,756 | 33,846 |
| 리스부채(*2) | CSSD 등 | 4.1 | 3,729,494 | 3,526,826 |
| 계 | | | 3,763,250 | 3,560,672 |

(*1) 담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.

(*2) 리스부채의 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며 당반기 중 발생한 이자비용은 94,075백만원(전반기: 61,932백만원)입니다. 또한, 채무불이행이 발생할 경우에 대비하여 리스제공자에게 사용권자산에 대한 권리를 담보로 제공하였습니다.

10. 사채:

보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : %, 백만원)

| 구 분 | 발행일 | 만기상환일 | 연이자율(%) | 금 액 | |
|--|------------|------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 당반기말 | 당반기말 | 전기말 |
| US\$ denominated Straight Bonds(*1) | 1997.10.02 | 2027.10.01 | 7.7 | 32,820 (US\$ 25,000천) | 31,683 (US\$ 25,000천) |
| US\$ denominated Debenture Bonds(*2) | 2015.05.11 | 2025.05.15 | 4.2 | 525,120 (US\$ 400,000천) | 506,920 (US\$ 400,000천) |
| 소 계 | | | | 557,940 | 538,603 |
| 사채할인발행차금 | | | | (467) | (543) |
| 사채할증발행차금 | | | | 3,622 | 4,261 |
| 계 | | | | 561,095 | 542,321 |
| 차감: 유동성사채 | | | | (6,470) | (6,228) |
| 비유동성사채 | | | | 554,625 | 536,093 |

(*1) 10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

(*2) 종속기업 Harman International Industries, Inc.에서 발행하였고, 10년 만기 일시상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

11. 순확정급여부채(자산):

가. 보고기간종료일 현재 순확정급여부채(자산)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 | 14,408,258 | 13,639,460 |
| 기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치 | 277,253 | 370,848 |
| 소 계 | 14,685,511 | 14,010,308 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (19,399,317) | (19,593,910) |
| 순확정급여부채(자산) 계 | (4,713,806) | (5,583,602) |

나. 당반기 및 전반기 중 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|-----------|-----------|----------|
| 당기근무원가 | 634,643 | 684,929 |
| 순이자원가(수익) | (176,734) | (49,382) |
| 과거근무원가 | (581) | 56 |
| 기타 | 15,865 | 3,417 |
| 계 | 473,193 | 639,020 |

다. 당반기 및 전반기 중 확정급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|-----------|---------|---------|
| 매출원가 | 189,349 | 273,388 |
| 판매비와관리비 등 | 283,844 | 365,632 |
| 계 | 473,193 | 639,020 |

12. 총당부채:

당반기 중 총당부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 판매보증 (가) | 기술사용료 (나) | 장기성과급 (다) | 기타 (라),(마) | 계 |
|---------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 기초 | 2,309,726 | 1,546,606 | 783,263 | 3,133,830 | 7,773,425 |
| 순전입(환입) | 1,237,011 | 344,251 | 140,071 | 1,464,674 | 3,186,007 |
| 사용 | (1,131,980) | (188,844) | (44,421) | (597,610) | (1,962,855) |
| 기타(*) | 66,854 | 39,497 | 5,490 | 24,603 | 136,444 |
| 당반기말 | 2,481,611 | 1,741,510 | 884,403 | 4,025,497 | 9,133,021 |

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

가. 연결회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 총당부채로 설정하고 있습니다.

나. 연결회사는 협상 진행 중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 연결회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과 기간 해당분을 총당부채로 계상하고 있습니다.

라. 연결회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용 등을 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다.

마. 연결회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

(1) 당반기말 현재 당기 이행연도에 대한 무상할당 배출권과 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 만톤(tCO₂-eq))

| 구 분 | 당반기말 |
|----------|-------|
| 무상할당 배출권 | 1,710 |
| 배출량 추정치 | 1,903 |

(2) 당반기 및 전반기 중 배출권 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|-----|--------|--------|
| 기초 | 19,567 | 46,074 |
| 증가 | 1,272 | 1,871 |
| 사용 | (225) | - |
| 반기말 | 20,614 | 47,945 |

(3) 당반기 및 전반기 중 배출부채 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---------|--------|--------|
| 기초 | 32,838 | 45,049 |
| 순전입(환입) | - | 23,365 |
| 사용 | (14) | - |
| 반기말 | 32,824 | 68,414 |

13. 우발부채와 약정사항:

가. 소송 등

당반기말 현재 연결회사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 연결회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

나. 기타 약정사항

당반기말 현재 발생하지 않은 유·무형자산의 취득을 위한 약정액은 17,119,756백만원입니다.

14. 계약부채:

보고기간종료일 현재 계약부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---------|------------|------------|
| 계약부채(*) | 12,787,097 | 13,255,682 |

(*) 계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

15. 자본금:

보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250억주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사가 발행한 보통주 및 우선주의 수(소각 주식수 제외)는 각각 5,969,782,550주와 822,886,700주입니다. 보고기간종료일 현재 유통주식수는 상기 발행주식의 수와 동일하며, 당반기 및 전기 중 변동사항은 없습니다. 한편, 발행주식의 액면총액은 679,267백만원(보통주 596,978백만원, 우선주 82,289백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다.

16. 연결이익잉여금:

가. 보고기간종료일 현재 연결이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|------------|-------------|-------------|
| 임의적립금 등 | 208,019,306 | 192,294,496 |
| 연결미처분이익잉여금 | 130,291,349 | 145,651,911 |
| 계 | 338,310,655 | 337,946,407 |

나. 당반기 및 전반기 중 배당금 산정 내역은 다음과 같습니다.

(1) 분기배당 (배당기준일: 2023년과 2022년 3월 31일, 6월 30일)

(단위 : 주, %, 백만원)

| 구 분 | | 당반기 | 전반기 | |
|-----|-------------|---------|----------------|----------------|
| 1분기 | 배당받을 주식 | 보통주 | 5,969,782,550주 | 5,969,782,550주 |
| | | 우선주 | 822,886,700주 | 822,886,700주 |
| | 배당률(액면가 기준) | 보통주·우선주 | 361% | 361% |
| | 배당금액 | 보통주 | 2,155,092 | 2,155,092 |
| | | 우선주 | 297,062 | 297,062 |
| | | 계 | 2,452,154 | 2,452,154 |
| 2분기 | 배당받을 주식 | 보통주 | 5,969,782,550주 | 5,969,782,550주 |
| | | 우선주 | 822,886,700주 | 822,886,700주 |
| | 배당률(액면가 기준) | 보통주·우선주 | 361% | 361% |
| | 배당금액 | 보통주 | 2,155,092 | 2,155,092 |
| | | 우선주 | 297,062 | 297,062 |
| | | 계 | 2,452,154 | 2,452,154 |

17. 기타자본항목:

보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | 1,852,003 | 2,749,109 |
| 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익누계액에 대한 지분 | 219,458 | 114,987 |
| 해외사업장환산외환차이 | 5,661,463 | 1,039,197 |
| 순확정급여부채(자산) 재측정요소 | (2,402,025) | (2,051,610) |
| 기타 | 99,452 | 86,645 |
| 계 | 5,430,351 | 1,938,328 |

18. 비용의 성격별 분류:

당반기 및 전반기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | | 전반기 | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 3 개 월 | 누 적 | 3 개 월 | 누 적 |
| 제품 및 재공품 등의 변동 | (935,654) | (3,152,414) | (4,439,969) | (6,998,972) |
| 원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등 | 21,190,339 | 48,387,259 | 28,865,165 | 56,931,407 |
| 급여 | 8,090,473 | 15,991,639 | 7,528,038 | 15,260,987 |
| 퇴직급여 | 273,221 | 551,510 | 341,528 | 692,424 |
| 감가상각비 | 8,767,744 | 17,568,639 | 9,068,814 | 18,077,845 |
| 무형자산상각비 | 790,853 | 1,576,451 | 772,552 | 1,543,029 |
| 복리후생비 | 1,740,173 | 3,281,449 | 1,738,929 | 3,140,865 |
| 유틸리티비 | 1,771,378 | 3,632,488 | 1,383,458 | 2,782,026 |
| 외주용역비 | 1,729,937 | 3,410,856 | 1,652,475 | 3,135,008 |
| 광고선전비 | 1,073,439 | 2,218,782 | 1,397,480 | 2,865,181 |
| 판매촉진비 | 1,568,835 | 3,241,787 | 1,536,956 | 3,360,354 |
| 기타비용 | 13,276,248 | 25,733,733 | 13,261,136 | 25,976,497 |
| 계(*) | 59,336,986 | 122,442,179 | 63,106,562 | 126,766,651 |

(*) 연결손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

19. 판매비와관리비:

당반기 및 전반기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | | 전반기 | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 3 개 월 | 누 적 | 3 개 월 | 누 적 |
| (1) 판매비와관리비: | | | | |
| 급여 | 2,102,067 | 4,174,476 | 1,884,465 | 3,879,818 |
| 퇴직급여 | 70,645 | 140,157 | 72,706 | 150,000 |
| 지급수수료 | 2,070,654 | 4,174,578 | 1,806,907 | 3,537,298 |
| 감가상각비 | 419,353 | 822,999 | 382,702 | 761,443 |
| 무형자산상각비 | 172,647 | 341,586 | 163,203 | 331,697 |
| 광고선전비 | 1,073,439 | 2,218,782 | 1,397,480 | 2,865,181 |
| 판매촉진비 | 1,568,835 | 3,241,787 | 1,536,956 | 3,360,354 |
| 운반비 | 420,198 | 834,603 | 984,085 | 1,841,718 |
| 서비스비 | 1,088,395 | 2,110,131 | 837,018 | 1,730,562 |
| 기타판매비와관리비 | 1,505,008 | 2,951,508 | 1,516,418 | 2,789,669 |
| 소 계 | 10,491,241 | 21,010,607 | 10,581,940 | 21,247,740 |
| (2) 경상연구개발비: | | | | |
| 연구개발 총지출액 | 7,198,555 | 13,777,289 | 6,254,874 | 12,177,106 |
| 계 | 17,689,796 | 34,787,896 | 16,836,814 | 33,424,846 |

20. 기타수익 및 기타비용:

당반기 및 전반기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | | 전반기 | |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| | 3 개 월 | 누 적 | 3 개 월 | 누 적 |
| (1) 기타수익: | | | | |
| 배당금수익 | 48,894 | 96,788 | 62,400 | 330,909 |
| 임대료수익 | 36,963 | 74,905 | 34,914 | 69,498 |
| 유형자산처분이익 | 20,598 | 55,047 | 63,780 | 114,200 |
| 기타 | 94,721 | 478,731 | 302,877 | 649,557 |
| 계 | 201,176 | 705,471 | 463,971 | 1,164,164 |
| (2) 기타비용: | | | | |
| 유형자산처분손실 | 10,611 | 20,003 | 19,911 | 24,107 |
| 기부금 | 29,710 | 102,793 | 85,866 | 175,426 |
| 기타 | 128,736 | 250,243 | 494,616 | 853,970 |
| 계 | 169,057 | 373,039 | 600,393 | 1,053,503 |

21. 금융수익 및 금융비용:

당반기 및 전반기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | | 전반기 | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 3 개 월 | 누 적 | 3 개 월 | 누 적 |
| (1) 금융수익: | | | | |
| 이자수익 | 1,152,273 | 2,212,719 | 487,194 | 856,226 |
| - 상각후원가 측정 금융자산 | 1,152,212 | 2,212,592 | 487,130 | 856,097 |
| - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 61 | 127 | 64 | 129 |
| 외환차이 | 2,758,603 | 5,878,615 | 4,490,804 | 7,099,407 |
| 파생상품관련이익 | 146,052 | 593,643 | 393,887 | 918,441 |
| 계 | 4,056,928 | 8,684,977 | 5,371,885 | 8,874,074 |
| (2) 금융비용: | | | | |
| 이자비용 | 286,893 | 578,570 | 123,064 | 272,295 |
| - 상각후원가 측정 금융부채 | 176,050 | 327,906 | 31,904 | 106,567 |
| - 기타금융부채 | 110,843 | 250,664 | 91,160 | 165,728 |
| 외환차이 | 2,556,359 | 5,932,237 | 4,675,575 | 7,136,257 |
| 파생상품관련손실 | 401,288 | 689,734 | 332,340 | 755,745 |
| 계 | 3,244,540 | 7,200,541 | 5,130,979 | 8,164,297 |

연결회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

22. 법인세비용:

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당반기말 현재 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 6.8%입니다.

23. 주당이익:

가. 기본주당이익

당반기 및 전반기의 기본주당이익 산정 내역은 다음과 같습니다.

(1) 보통주

(단위 : 백만원, 천주, 원)

| 구 분 | 당반기 | | 전반기 | |
|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | 3 개 월 | 누 적 | 3 개 월 | 누 적 |
| 지배회사지분 반기순이익 | 1,547,018 | 2,948,270 | 10,954,515 | 22,083,609 |
| 반기순이익 중 보통주 해당분 | 1,359,607 | 2,591,107 | 9,627,448 | 19,408,327 |
| ÷ 가중평균유통보통주식수(천주) | 5,969,783 | 5,969,783 | 5,969,783 | 5,969,783 |
| 기본 보통주 주당이익(원) | 228 | 434 | 1,613 | 3,251 |

(2) 우선주

(단위 : 백만원, 천주, 원)

| 구 분 | 당반기 | | 전반기 | |
|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | 3 개 월 | 누 적 | 3 개 월 | 누 적 |
| 지배회사지분 반기순이익 | 1,547,018 | 2,948,270 | 10,954,515 | 22,083,609 |
| 반기순이익 중 우선주 해당분 | 187,411 | 357,163 | 1,327,067 | 2,675,282 |
| ÷ 가중평균유통우선주식수(천주) | 822,887 | 822,887 | 822,887 | 822,887 |
| 기본 우선주 주당이익(원) | 228 | 434 | 1,613 | 3,251 |

나. 희석주당이익

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당반기 및 전반기의 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

24. 현금흐름표:

가. 연결회사는 영업활동 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다. 당반기 및 전반기 중 영업활동 현금흐름 관련 조정 내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

(1) 조정 내역

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|----------------|-------------|-------------|
| 법인세비용 | 241,205 | 7,107,165 |
| 금융수익 | (3,619,551) | (3,033,105) |
| 금융비용 | 2,601,229 | 2,516,133 |
| 퇴직급여 | 551,510 | 692,424 |
| 감가상각비 | 17,568,639 | 18,077,845 |
| 무형자산상각비 | 1,576,451 | 1,543,029 |
| 대손상각비(환입) | 76,054 | 24,421 |
| 배당금수익 | (96,788) | (330,909) |
| 지분법이익 | (413,782) | (491,706) |
| 유형자산처분이익 | (55,047) | (114,200) |
| 유형자산처분손실 | 20,003 | 24,107 |
| 재고자산평가손실(환입) 등 | 3,569,456 | 1,934,530 |
| 기타 | (61,354) | 108,064 |
| 계 | 21,958,025 | 28,057,798 |

(2) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|-----------------|-------------|--------------|
| 매출채권의 감소(증가) | 727,124 | 383,614 |
| 미수금의 감소(증가) | 990,666 | (656,444) |
| 장단기선급비용의 감소(증가) | (449,776) | (323,801) |
| 재고자산의 감소(증가) | (5,846,100) | (10,473,730) |
| 매입채무의 증가(감소) | 635,101 | (3,479,374) |
| 장단기미지급금의 증가(감소) | 589,905 | (2,076,950) |
| 선수금의 증가(감소) | (181,346) | 13,502 |
| 예수금의 증가(감소) | (562,980) | (563,671) |
| 미지급비용의 증가(감소) | (4,485,803) | (1,705,600) |
| 장단기충당부채의 증가(감소) | 1,223,152 | 326,635 |
| 퇴직금의 지급 | (323,060) | (295,378) |
| 기타 | (590,248) | (576,003) |
| 계 | (8,273,365) | (19,427,200) |

나. 당반기 및 전반기 중 리스부채와 관련하여 발생한 원금 상환에 따른 현금유출액(재무활동)은 538,783백만원 및 485,458백만원, 이자비용 현금유출액(영업활동)은 94,075백만원 및 61,932백만원입니다.

25. 재무위험관리:

연결회사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험등을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책과 프로그램을 운영하고 있습니다. 위험을 회피하기 위한 파생상품의 이용도 이 프로그램에 포함되어 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 글로벌 재무위험 관리정책을 수립한 후 주기적으로 재무위험 측정, 헷지 및 평가 등을 실행하고 있습니다.

한편, 해외 주요 권역별로 지역 금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역 내 자금을 통합운용하여 유동성위험을 관리하고 있습니다.

재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

연결회사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요통화로는 USD, EUR, INR 등이 있습니다.

연결회사는 환율변동과는 무관하게 통화별 자산과 부채 규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융 거래 발생 시 현지 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 또한, 연결회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

(2) 이자율변동위험

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.

(3) 주가변동위험

연결회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

당반기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영전)에 미치는 영향은 81,526백만원(전반기: 90,393백만원)이며, 당기손익(법인세효과 반영전)에 미치는 영향은 4,309백만원(전반기: 3,413백만원)입니다.

나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재경팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독하에 이루어지고 있습니다. 연결회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

보고기간종료일 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

다. 유동성위험

대규모 투자가 많은 연결회사 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 연결회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금 수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다.

연결회사는 주기적으로 미래 현금 흐름을 예측하여 유동성위험을 사전 관리하고 있습니다. 권역별로 Cash Pooling을 구축·활용하여 권역 내 자금 부족의 경우에도 내부 자금을 활용하여 유동성위험을 효율적으로 관리하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사 간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성위험을 최소화하는 한편 자금운용 부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 연결회사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

또한, 만약의 대규모 유동성 필요에 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있습니다.

라. 자본위험

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

당반기말 현재 연결회사는 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 Aa2 평가등급을 받고 있으며, 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|------|-------------|-------------|
| 부 채 | 89,024,926 | 93,674,903 |
| 자 본 | 358,975,626 | 354,749,604 |
| 부채비율 | 24.8% | 26.4% |

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구분 | 당반기말 | | 전기말 | |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 |
| 금융자산: | | | | |
| 현금및현금성자산 | 79,919,775 | (*1) | 49,680,710 | (*1) |
| 단기금융상품 | 17,180,130 | (*1) | 65,102,886 | (*1) |
| 단기상각후원가금융자산 | - | (*1) | 414,610 | (*1) |
| 단기당기손익-공정가치금융자산 | 25,310 | 25,310 | 29,080 | 29,080 |
| 매출채권 | 36,104,142 | (*1) | 35,721,563 | (*1) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 10,308,125 | 10,308,125 | 11,397,012 | 11,397,012 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,573,457 | 1,573,457 | 1,405,468 | 1,405,468 |
| 기타(*2) | 10,996,718 | 524,209 | 10,340,876 | 395,667 |
| 계 | 156,107,657 | | 174,092,205 | |
| 금융부채: | | | | |
| 매입채무 | 11,744,005 | (*1) | 10,644,686 | (*1) |
| 단기차입금 | 3,557,360 | (*1) | 5,147,315 | (*1) |
| 미지급금 | 13,443,741 | (*1) | 16,328,237 | (*1) |
| 유동성장기부채 | 1,263,841 | 6,995 | 1,089,162 | 6,580 |
| - 유동성장기차입금 | 1,257,371 | (*1)(*3) | 1,082,934 | (*1)(*3) |
| - 유동성사채 | 6,470 | 6,995 | 6,228 | 6,580 |
| 사채 | 554,625 | 537,772 | 536,093 | 521,129 |
| 장기차입금 | 3,763,250 | (*1)(*3) | 3,560,672 | (*1)(*3) |
| 장기미지급금 | 4,890,945 | (*1) | 2,289,236 | (*1) |
| 기타(*2) | 10,743,779 | 321,938 | 12,409,529 | 361,768 |
| 계 | 49,961,546 | | 52,004,930 | |

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융자산 10,472,509백만원(전기말: 9,945,209백만원)

및 금융부채 10,421,841백만원(전기말: 12,047,761백만원)은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*3) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기말 | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|------------|
| | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 계 |
| 금융자산: | | | | |
| 단기당기손익-공정가치금융자산 | - | 25,310 | - | 25,310 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 8,152,616 | - | 2,155,509 | 10,308,125 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 430,889 | - | 1,142,568 | 1,573,457 |
| 기타 | - | 329,602 | 194,607 | 524,209 |
| 금융부채: | | | | |
| 유동성사채 | - | 6,995 | - | 6,995 |
| 사채 | - | 537,772 | - | 537,772 |
| 기타 | - | 314,534 | 7,404 | 321,938 |

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 전기말 | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|------------|
| | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 계 |
| 금융자산: | | | | |
| 단기당기손익-공정가치금융자산 | - | 29,080 | - | 29,080 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 9,207,295 | - | 2,189,717 | 11,397,012 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 314,449 | - | 1,091,019 | 1,405,468 |
| 기타 | - | 373,176 | 22,491 | 395,667 |
| 금융부채: | | | | |
| 유동성사채 | - | 6,580 | - | 6,580 |
| 사채 | - | 521,129 | - | 521,129 |
| 기타 | - | 354,364 | 7,404 | 361,768 |

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- '수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- '수준 2': 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)
- '수준 3': 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

연결회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(3) 가치평가기법 및 투입변수

연결회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

당반기말 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 공정가치 | 가치평가기법 | '수준 3' 투입변수 | 투입변수 범위 |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| 기타포괄손익-공정가치금융자산: | | | | |
| 삼성벤처투자(주) | 32,236 | 현금흐름할인법 | 영구성장률 | 1.0% |
| | | | 가중평균자본비용 | 18.1% |
| (주)미코세라믹스 | 30,714 | 현금흐름할인법 등 | 영구성장률 | 0.0% |
| | | | 가중평균자본비용 | 14.3% |
| TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT) | 1,221,371 | 현금흐름할인법 | 영구성장률 | 0.0% |
| | | | 가중평균자본비용 | 11.3% |
| China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Ltd (CSOSDT) | 204,245 | 현금흐름할인법 | 영구성장률 | 0.0% |
| | | | 가중평균자본비용 | 11.3% |
| 기타: | | | | |
| 지분 콜옵션 | 169,957 | 이항모형 | 무위험 이자율 | 3.7% |
| | | | 가격 변동성 | 55.0% |
| 지분 풋옵션 | 24,650 | 이항모형 | 무위험 이자율 | 4.2%~5.4%, 2.2% |
| | | | 가격 변동성 | 25.1%, 28.8% |

(4) '수준 3'에 해당하는 금융상품의 변동 내역

(단위 : 백만원)

| 금융자산 | 당반기 | 전반기 |
|-----------------|-------------|-----------|
| 기초 | 3,303,227 | 3,430,214 |
| 매입 | 120,995 | 108,009 |
| 매도 | (3,216,022) | (160,465) |
| 당기손익으로 인식된 손익 | 248,191 | 91,008 |
| 기타포괄손익으로 인식된 손익 | 3,124,848 | 183,532 |
| 기타 | (88,555) | 1,180 |
| 반기말 | 3,492,684 | 3,653,478 |

(단위 : 백만원)

| 금융부채 | 당반기 | 전반기 |
|------|-------|-------|
| 기초 | 7,404 | 5,438 |
| 기타 | - | - |
| 반기말 | 7,404 | 5,438 |

(5) '수준 3'으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

당반기말 현재 '수준 3'으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(자본은 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 유리한 변동 | | 불리한 변동 | |
|---------------------|--------|---------|----------|----------|
| | 당기손익 | 자본 | 당기손익 | 자본 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산(*1) | - | 113,344 | - | (81,509) |
| 기타(*2) | 60,223 | - | (51,595) | - |

(*1) 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1.0%~1.0%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

(*2) 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산 가격(20%) 및 가격 변동성(5% 또는 10%)을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

26. 부문별 보고:

가. 부문별 정보

연결회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 연결회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman 등으로 구성되어 있습니다.

당반기와 전반기의 보고부문의 부문별 정보는 감가상각비, 무형자산상각비, 영업이익의 내부 거래조정이 배분된 후로 작성되었으며, 보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

(1) 당분기(3개월)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | DX 부문 | DS 부문 | SDC | Harman | 내부거래 조정 등 | 계(*) |
|---------|------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 매출액 | 40,206,174 | 14,729,264 | 6,483,066 | 3,495,745 | (4,908,716) | 60,005,533 |
| 감가상각비 | 640,513 | 7,188,749 | 804,766 | 83,040 | - | 8,767,744 |
| 무형자산상각비 | 433,138 | 192,575 | 55,624 | 50,578 | - | 790,853 |
| 영업이익 | 3,829,380 | (4,361,844) | 843,069 | 251,381 | - | 668,547 |

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

당분기(3개월) 주요 제품별 매출은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 영상기기 | 무선 | 메모리 | DP | 계(*) |
|-----|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 매출액 | 7,245,758 | 24,608,693 | 8,967,359 | 6,483,066 | 60,005,533 |

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(2) 당반기(누적)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | DX 부문 | DS 부문 | SDC | Harman | 내부거래 조정 등 | 계(*) |
|---------|------------|-------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 매출액 | 86,428,687 | 28,463,739 | 13,097,217 | 6,661,642 | (10,900,381) | 123,750,904 |
| 감가상각비 | 1,255,917 | 14,411,510 | 1,637,600 | 163,068 | - | 17,568,639 |
| 무형자산상각비 | 850,496 | 399,184 | 110,647 | 99,681 | - | 1,576,451 |
| 영업이익 | 8,038,140 | (8,943,698) | 1,619,085 | 380,330 | - | 1,308,725 |

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

당반기(누적) 주요 제품별 매출은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 영상기기 | 무선 | 메모리 | DP | 계(*) |
|-----|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 매출액 | 14,680,693 | 55,353,244 | 17,884,356 | 13,097,217 | 123,750,904 |

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(3) 전분기(3개월)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | DX 부문 | DS 부문 | SDC | Harman | 내부거래 조정 등 | 계(*) |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 매출액 | 44,455,371 | 28,497,568 | 7,710,680 | 2,982,834 | (6,442,846) | 77,203,607 |
| 감가상각비 | 610,308 | 7,051,507 | 1,284,450 | 80,322 | - | 9,068,814 |
| 무형자산상각비 | 403,013 | 204,895 | 59,793 | 50,151 | - | 772,552 |
| 영업이익 | 3,021,697 | 9,981,053 | 1,057,643 | 101,642 | - | 14,097,045 |

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

전분기(3개월) 주요 제품별 매출은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 영상기기 | 무선 | 메모리 | DP | 계(*) |
|-----|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 매출액 | 7,537,814 | 28,000,484 | 21,075,357 | 7,710,680 | 77,203,607 |

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(4) 전반기(누적)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | DX 부문 | DS 부문 | SDC | Harman | 내부거래 조정 등 | 계(*) |
|---------|------------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 매출액 | 92,524,038 | 55,364,982 | 15,681,171 | 5,649,180 | (14,234,266) | 154,985,105 |
| 감가상각비 | 1,215,157 | 13,935,829 | 2,684,014 | 158,693 | - | 18,077,845 |
| 무형자산상각비 | 796,775 | 412,182 | 119,181 | 107,677 | - | 1,543,029 |
| 영업이익 | 7,577,158 | 18,431,184 | 2,150,507 | 203,202 | - | 28,218,454 |

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

전반기 주요 제품별 매출은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 영상기기 | 무선 | 메모리 | DP | 계(*) |
|-----|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 매출액 | 16,255,835 | 59,228,241 | 41,166,821 | 15,681,171 | 154,985,105 |

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

나. 지역별 정보

당반기와 전반기의 지역별 영업현황(소채지 기준)은 다음과 같습니다.

(1) 당분기(3개월)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 국내 | 미주 | 유럽 | 아시아 및 아프리카 | 중국 | 연결실체 내 내부거래조정 | 계 |
|----------|-------------|------------|------------|---------------|------------|------------------|-------------|
| 매출액 | 10,269,812 | 21,321,961 | 11,064,655 | 11,012,989 | 6,336,116 | - | 60,005,533 |
| 비유동자산(*) | 156,560,136 | 16,470,864 | 6,132,379 | 9,199,292 | 13,857,391 | (919,886) | 201,300,176 |

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

(2) 당반기(누적)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 국내 | 미주 | 유럽 | 아시아 및 아프리카 | 중국 | 연결실체 내 내부거래조정 | 계 |
|----------|-------------|------------|------------|---------------|------------|------------------|-------------|
| 매출액 | 21,570,240 | 44,084,412 | 23,647,578 | 22,547,328 | 11,901,346 | - | 123,750,904 |
| 비유동자산(*) | 156,560,136 | 16,470,864 | 6,132,379 | 9,199,292 | 13,857,391 | (919,886) | 201,300,176 |

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

(3) 전분기(3개월)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 국내 | 미주 | 유럽 | 아시아 및 아프리카 | 중국 | 연결실체 내 내부거래조정 | 계 |
|----------|-------------|------------|------------|---------------|------------|------------------|-------------|
| 매출액 | 11,262,111 | 32,479,799 | 11,100,501 | 12,010,024 | 10,351,172 | - | 77,203,607 |
| 비유동자산(*) | 130,507,765 | 11,857,401 | 5,873,791 | 9,396,020 | 17,570,719 | (854,194) | 174,351,502 |

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

(4) 전반기(누적)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 국내 | 미주 | 유럽 | 아시아 및 아프리카 | 중국 | 연결실체 내 내부거래조정 | 계 |
|----------|-------------|------------|------------|---------------|------------|------------------|-------------|
| 매출액 | 23,335,805 | 61,573,772 | 24,344,402 | 24,913,418 | 20,817,708 | - | 154,985,105 |
| 비유동자산(*) | 130,507,765 | 11,857,401 | 5,873,791 | 9,396,020 | 17,570,719 | (854,194) | 174,351,502 |

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

27. 특수관계자와의 거래:

가. 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 매출·매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당반기

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 기업명(*1) | 매출 등 | 비유동자산 처분 | 매입 등 | 비유동자산 매입 |
|----------------|---------------|---------|----------|-----------|-----------|
| 관계기업 및 공동기업 | 삼성에스디에스(주) | 101,310 | - | 970,023 | 152,478 |
| | 삼성전기(주) | 51,439 | - | 610,203 | 60 |
| | 삼성SDI(주) | 69,556 | - | 363,305 | 16,983 |
| | (주)제일기획 | 36,039 | - | 440,390 | 76 |
| | 기타 | 466,197 | - | 6,373,995 | 51,275 |
| | 관계기업 및 공동기업 계 | 724,541 | - | 8,757,916 | 220,872 |
| 그 밖의 특수관계자 | 삼성물산(주) | 27,964 | 70 | 133,436 | 1,994,302 |
| | 기타 | 262,577 | - | 951,690 | 1,548,223 |
| | 그 밖의 특수관계자 계 | 290,541 | 70 | 1,085,126 | 3,542,524 |
| 기타(*2) | 삼성엔지니어링(주) | 761 | - | 15,319 | 1,400,444 |
| | (주)에스원 | 5,381 | - | 261,314 | 23,155 |
| | 기타 | 96,497 | - | 387,511 | 196,225 |
| | 기타 계 | 102,639 | - | 664,144 | 1,619,824 |

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전반기

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 기업명(*1) | 매출 등 | 비유동자산 처분 | 매입 등 | 비유동자산 매입 |
|----------------|---------------|---------|----------|------------|-----------|
| 관계기업 및 공동기업 | 삼성에스디에스(주) | 129,044 | - | 889,262 | 185,302 |
| | 삼성전기(주) | 48,221 | - | 769,412 | - |
| | 삼성SDI(주) | 43,494 | - | 392,753 | 7,252 |
| | (주)제일기획 | 30,204 | - | 456,042 | - |
| | 기타 | 685,854 | - | 7,752,693 | 55,766 |
| | 관계기업 및 공동기업 계 | 936,817 | - | 10,260,162 | 248,320 |
| 그 밖의 특수관계자 | 삼성물산(주) | 28,750 | - | 240,033 | 2,832,163 |
| | 기타 | 189,235 | - | 834,358 | 149,510 |
| | 그 밖의 특수관계자 계 | 217,985 | - | 1,074,391 | 2,981,673 |
| 기타(*2) | 삼성엔지니어링(주) | 970 | - | 14,328 | 1,068,938 |
| | (주)에스원 | 4,871 | - | 246,721 | 14,330 |
| | 기타 | 83,692 | - | 133,566 | 145,829 |
| | 기타 계 | 89,533 | - | 394,615 | 1,229,097 |

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

나. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 등 잔액은 다음과 같습니다.

(1) 당반기말

(단위 : 백만원)

| 구분 | 기업명(*1) | 채권 등 | 채무 등(*2) |
|----------------|---------------|---------|-----------|
| 관계기업 및 공동기업 | 삼성에스디에스(주) | 24,819 | 522,578 |
| | 삼성전기(주) | 2,740 | 130,774 |
| | 삼성SDI(주) | 134,584 | 77,919 |
| | (주)제일기획 | 664 | 313,162 |
| | 기타 | 231,369 | 1,095,322 |
| | 관계기업 및 공동기업 계 | 394,176 | 2,139,755 |
| 그 밖의 특수관계자 | 삼성물산(주) | 213,512 | 750,085 |
| | 기타 | 20,218 | 307,132 |
| | 그 밖의 특수관계자 계 | 233,730 | 1,057,217 |
| 기타(*3) | 삼성엔지니어링(주) | 385 | 897,538 |
| | (주)에스원 | 1,193 | 50,029 |
| | 기타 | 14,653 | 207,452 |
| | 기타 계 | 16,231 | 1,155,019 |

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

| 구분 | 기업명(*1) | 채권 등 | 채무 등(*2) |
|----------------|---------------|---------|-----------|
| 관계기업 및 공동기업 | 삼성에스디에스(주) | 49,792 | 512,022 |
| | 삼성전기(주) | 385 | 133,952 |
| | 삼성SDI(주) | 121,605 | 92,452 |
| | (주)제일기획 | 223 | 453,545 |
| | 기타 | 371,575 | 1,236,016 |
| | 관계기업 및 공동기업 계 | 543,580 | 2,427,987 |
| 그 밖의 특수관계자 | 삼성물산(주) | 217,818 | 2,783,240 |
| | 기타 | 20,830 | 250,103 |
| | 그 밖의 특수관계자 계 | 238,648 | 3,033,343 |
| 기타(*3) | 삼성엔지니어링(주) | 331 | 1,251,039 |
| | (주)에스원 | 3,839 | 73,102 |
| | 기타 | 15,647 | 545,684 |
| | 기타 계 | 19,817 | 1,869,825 |

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

다. 연결회사는 당반기 및 전반기 중 관계기업 및 공동기업에 65,182백만원 및 903,758백만원을 출자하였습니다. 또한, 당반기 및 전반기 중 관계기업 및 공동기업으로부터 17,839백만원 및 6,787백만원의 출자원금을 회수하였습니다.

라. 연결회사가 당반기 및 전반기 중 특수관계자에게 지급 결의한 배당금은 825,850백만원 및 835,814백만원입니다. 또한, 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에게 당반기 및 전반기 중 지급 결의한 배당금은 64,116백만원 및 64,116백만원입니다. 당반기말 및 전기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 존재하지않습니다

마. 연결회사가 당반기 중 특수관계자와 체결한 리스 이용계약은 1,762백만원이며, 전반기 중 특수관계자와 체결한 리스 이용 계약은 없습니다. 당반기와 전반기 중 특수관계자에게 지급한 리스료는 10,259백만원 및 12,493백만원입니다.

바. 연결회사가 당반기 및 전반기 중 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---------|-------|-------|
| 단기급여 | 5,154 | 4,694 |
| 퇴직급여 | 279 | 289 |
| 기타 장기급여 | 3,917 | 3,873 |

4. 재무제표

재무상태표

제 55 기 반기말 2023.06.30 현재

제 54 기말 2022.12.31 현재

(단위 : 백만원)

| | 제 55 기 반기말 | 제 54 기말 |
|----------------------|-------------|-------------|
| 자산 | | |
| 유동자산 | 73,472,493 | 59,062,658 |
| 현금및현금성자산 | 12,892,470 | 3,921,593 |
| 단기금융상품 | 1,403 | 137 |
| 매출채권 | 22,140,988 | 20,503,223 |
| 미수금 | 2,041,832 | 2,925,006 |
| 선급비용 | 1,055,116 | 1,047,900 |
| 재고자산 | 32,589,559 | 27,990,007 |
| 기타유동자산 | 2,751,125 | 2,674,792 |
| 비유동자산 | 212,555,100 | 201,021,092 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 1,730,986 | 1,364,325 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 61 | 283 |
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 | 57,359,028 | 57,397,249 |
| 유형자산 | 132,603,414 | 123,266,986 |
| 무형자산 | 11,168,723 | 8,561,424 |
| 순확정급여자산 | 3,661,528 | 4,410,223 |
| 이연법인세자산 | 1,957,367 | 2,142,512 |
| 기타비유동자산 | 4,073,993 | 3,878,090 |
| 자산총계 | 286,027,593 | 260,083,750 |
| 부채 | | |
| 유동부채 | 38,302,556 | 46,086,047 |
| 매입채무 | 9,474,012 | 8,729,315 |
| 단기차입금 | 2,668,838 | 2,381,512 |
| 미지급금 | 12,840,656 | 18,554,543 |
| 선수금 | 238,297 | 320,689 |
| 예수금 | 416,178 | 523,354 |
| 미지급비용 | 6,990,048 | 8,359,296 |
| 당기법인세부채 | | 2,533,481 |
| 유동성장기부채 | 201,192 | 135,753 |
| 총당부채 | 4,850,096 | 4,059,491 |
| 기타유동부채 | 623,239 | 488,613 |
| 비유동부채 | 29,536,245 | 4,581,512 |
| 사채 | 25,883 | 24,912 |
| 장기차입금 | 22,826,584 | 654,979 |

| | | |
|------------|-------------|-------------|
| 장기미지급금 | 4,772,353 | 2,439,232 |
| 장기총당부채 | 1,857,914 | 1,423,165 |
| 기타비유동부채 | 53,511 | 39,224 |
| 부채총계 | 67,838,801 | 50,667,559 |
| 자본 | | |
| 자본금 | 897,514 | 897,514 |
| 우선주자본금 | 119,467 | 119,467 |
| 보통주자본금 | 778,047 | 778,047 |
| 주식발행초과금 | 4,403,893 | 4,403,893 |
| 이익잉여금(결손금) | 213,225,614 | 204,388,016 |
| 기타자본항목 | (338,229) | (273,232) |
| 자본총계 | 218,188,792 | 209,416,191 |
| 부채와자본총계 | 286,027,593 | 260,083,750 |

손익계산서

제 55 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

제 54 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

(단위 : 백만원)

| | 제 55 기 반기 | | 제 54 기 반기 | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 수익(매출액) | 39,729,088 | 81,897,767 | 58,641,288 | 115,365,546 |
| 매출원가 | 33,808,570 | 70,922,059 | 39,964,268 | 79,149,180 |
| 매출총이익 | 5,920,518 | 10,975,708 | 18,677,020 | 36,216,366 |
| 판매비와관리비 | 9,618,621 | 18,582,572 | 8,518,142 | 16,905,657 |
| 영업이익 | (3,698,103) | (7,606,864) | 10,158,878 | 19,310,709 |
| 기타수익 | 13,533,358 | 22,103,342 | 144,397 | 427,668 |
| 기타비용 | 39,191 | 131,431 | 99,176 | 153,785 |
| 금융수익 | 1,829,316 | 3,982,674 | 2,489,143 | 4,229,038 |
| 금융비용 | 2,156,852 | 4,477,000 | 2,433,137 | 3,875,505 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 9,468,528 | 13,870,721 | 10,260,105 | 19,938,125 |
| 법인세비용 | (116,105) | 127,993 | 2,068,797 | 4,094,874 |
| 계속영업이익(손실) | 9,584,633 | 13,742,728 | 8,191,308 | 15,843,251 |
| 당기순이익(손실) | 9,584,633 | 13,742,728 | 8,191,308 | 15,843,251 |
| 주당이익 | | | | |
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 1,411 | 2,023 | 1,206 | 2,332 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 1,411 | 2,023 | 1,206 | 2,332 |

포괄손익계산서

제 55 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

제 54 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

(단위 : 백만원)

| | 제 55 기 반기 | | 제 54 기 반기 | |
|----------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| 당기순이익(손실) | 9,584,633 | 13,742,728 | 8,191,308 | 15,843,251 |
| 기타포괄손익 | 87,808 | (64,997) | (100,478) | (217,406) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 87,808 | (64,997) | (100,478) | (217,406) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | 182,793 | 270,112 | (61,732) | (115,633) |
| 순확정급여부채(자산) 재측정요소 | (94,985) | (335,109) | (38,746) | (101,773) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | | | | |
| 총포괄손익 | 9,672,441 | 13,677,731 | 8,090,830 | 15,625,845 |

자본변동표

제 55 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

제 54 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

(단위 : 백만원)

| | 자본 | | | | |
|---------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | 자본금 | 주식발행초과금 | 이익잉여금 | 기타자본항목 | 자본 합계 |
| 2022.01.01 (기초자본) | 897,514 | 4,403,893 | 188,774,335 | (882,010) | 193,193,732 |
| 당기순이익(손실) | | | 15,843,251 | | 15,843,251 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | | | | (115,633) | (115,633) |
| 순확정급여부채(자산) 재측정요소 | | | | (101,773) | (101,773) |
| 배당 | | | (4,905,130) | | (4,905,130) |
| 2022.06.30 (기말자본) | 897,514 | 4,403,893 | 199,712,456 | (1,099,416) | 203,914,447 |
| 2023.01.01 (기초자본) | 897,514 | 4,403,893 | 204,388,016 | (273,232) | 209,416,191 |
| 당기순이익(손실) | | | 13,742,728 | | 13,742,728 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | | | | 270,112 | 270,112 |
| 순확정급여부채(자산) 재측정요소 | | | | (335,109) | (335,109) |
| 배당 | | | (4,905,130) | | (4,905,130) |
| 2023.06.30 (기말자본) | 897,514 | 4,403,893 | 213,225,614 | (338,229) | 218,188,792 |

현금흐름표

제 55 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

제 54 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

(단위 : 백만원)

| | 제 55 기 반기 | 제 54 기 반기 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 영업활동 현금흐름 | 17,642,788 | 21,221,889 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (2,004,178) | 26,374,703 |
| 당기순이익 | 13,742,728 | 15,843,251 |
| 조정 | (3,908,556) | 18,238,275 |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (11,838,350) | (7,706,823) |
| 이자의 수취 | 124,568 | 161,320 |
| 이자의 지급 | (184,726) | (117,383) |
| 배당금 수입 | 22,160,138 | 137,839 |
| 법인세 납부액 | (2,453,014) | (5,334,590) |
| 투자활동 현금흐름 | (25,934,522) | (16,415,626) |
| 단기금융상품의 순감소(증가) | (1,266) | 1,896,376 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 | 22 | |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 222 | 150 |
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분 | 107,710 | 75,028 |
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득 | (69,514) | (940,489) |
| 유형자산의 처분 | 97,006 | 239,039 |
| 유형자산의 취득 | (24,524,605) | (16,286,602) |
| 무형자산의 처분 | 11,380 | 197 |
| 무형자산의 취득 | (1,499,642) | (1,335,396) |
| 기타투자활동으로 인한 현금유출입액 | (55,835) | (63,929) |
| 재무활동 현금흐름 | 17,272,858 | (5,646,940) |
| 단기차입금의 순증가(감소) | 268,775 | (669,755) |
| 사채 및 장기차입금의 차입 | 21,990,000 | |
| 사채 및 장기차입금의 상환 | (80,125) | (72,124) |
| 배당금의 지급 | (4,905,792) | (4,905,061) |
| 외화환산으로 인한 현금의 변동 | (10,247) | 923 |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 8,970,877 | (839,754) |
| 기초의 현금및현금성자산 | 3,921,593 | 3,918,872 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 12,892,470 | 3,079,118 |

5. 재무제표 주석

제 55 기 반기 : 2023년 6월 30일 현재

제 54 기 : 2022년 12월 31일 현재

삼성전자주식회사

1. 일반적 사항:

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사의 사업은 DX 부문, DS 부문으로 구성되어 있습니다. DX(Device eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 휴대폰, 통신시스템 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry, System LSI 등으로 구성되어 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다.

2. 중요한 회계처리방침:

2.1. 재무제표 작성기준

회사의 2023년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 반기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 반기재무제표는 보고기간종료일인 2023년 6월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

가. 회사가 채택한 제·개정 기준서

회사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

공시 대상 회계정책 정보를 '유의적인' 회계정책에서 '중요한(material)' 회계정책으로 대체하고 그 의미를 명확히 하였습니다. 또한, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '중요성에 대한 판단'을 개정하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래당시 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

나. 회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서

제정 또는 공표됐으나 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 회사가 조기 적용하지 않은 주요 제·개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.

2.2. 회계정책

반기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주식 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.3. 중요한 회계추정 및 가정

반기재무제표 작성시 회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산·부채의 장부금액 및 이익·비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

반기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 범주별 금융상품:

보고기간종료일 현재 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당반기말

(단위 : 백만원)

| 금융자산 | 상각후원가 측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 계 |
|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| 현금및현금성자산 | 12,892,470 | - | - | 12,892,470 |
| 단기금융상품 | 1,403 | - | - | 1,403 |
| 매출채권 | 22,140,988 | - | - | 22,140,988 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | 1,730,986 | - | 1,730,986 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | - | 61 | 61 |
| 기타 | 4,856,121 | - | 169,957 | 5,026,078 |
| 계 | 39,890,982 | 1,730,986 | 170,018 | 41,791,986 |

(단위 : 백만원)

| 금융부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 기타금융부채(*) | 계 |
|---------|------------------|-----------|------------|
| 매입채무 | 9,474,012 | - | 9,474,012 |
| 단기차입금 | - | 2,668,838 | 2,668,838 |
| 미지급금 | 12,579,242 | - | 12,579,242 |
| 유동성장기부채 | 6,470 | 194,722 | 201,192 |
| 사채 | 25,883 | - | 25,883 |
| 장기차입금 | 21,990,000 | 836,584 | 22,826,584 |
| 장기미지급금 | 4,414,940 | - | 4,414,940 |
| 기타 | 3,541,169 | - | 3,541,169 |
| 계 | 52,031,716 | 3,700,144 | 55,731,860 |

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

| 금융자산 | 상각후원가 측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 계 |
|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| 현금및현금성자산 | 3,921,593 | - | - | 3,921,593 |
| 단기금융상품 | 137 | - | - | 137 |
| 매출채권 | 20,503,223 | - | - | 20,503,223 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | 1,364,325 | - | 1,364,325 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | - | 283 | 283 |
| 기타 | 5,470,355 | - | - | 5,470,355 |
| 계 | 29,895,308 | 1,364,325 | 283 | 31,259,916 |

(단위 : 백만원)

| 금융부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 기타금융부채(*) | 계 |
|---------|------------------|-----------|------------|
| 매입채무 | 8,729,315 | - | 8,729,315 |
| 단기차입금 | - | 2,381,512 | 2,381,512 |
| 미지급금 | 18,324,604 | - | 18,324,604 |
| 유동성장기부채 | 6,228 | 129,525 | 135,753 |
| 사채 | 24,912 | - | 24,912 |
| 장기차입금 | - | 654,979 | 654,979 |
| 장기미지급금 | 2,083,790 | - | 2,083,790 |
| 기타 | 3,145,473 | - | 3,145,473 |
| 계 | 32,314,322 | 3,166,016 | 35,480,338 |

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

4. 공정가치금융자산:

가. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기타포괄손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|------|-----------|-----------|
| 지분상품 | 1,730,986 | 1,364,325 |

(2) 당기손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|------|------|-----|
| 채무상품 | 61 | 283 |

나. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 기업명 | 당반기말 | | | | 전기말 |
|---------------------|--------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| | 보유주식수 (주) | 지분율 (%)(*) | 취득원가 | 장부금액 (시장가치) | 장부금액 (시장가치) |
| 삼성중공업(주) | 134,027,281 | 15.2 | 932,158 | 893,962 | 684,879 |
| (주)호텔신라 | 2,004,717 | 5.1 | 13,957 | 147,146 | 166,592 |
| (주)아이마켓코리아 | 647,320 | 1.9 | 324 | 6,402 | 6,538 |
| (주)케이티스카이라이프 | 240,000 | 0.5 | 3,344 | 1,541 | 1,954 |
| (주)용평리조트 | 400,000 | 0.8 | 1,869 | 1,228 | 1,412 |
| (주)에이테크솔루션 | 1,592,000 | 15.9 | 26,348 | 19,454 | 12,879 |
| (주)원익홀딩스 | 1,759,171 | 2.3 | 15,410 | 6,676 | 5,972 |
| (주)원익아이피에스 | 1,850,936 | 3.8 | 16,214 | 60,711 | 45,811 |
| (주)동진세미켐 | 2,467,894 | 4.8 | 48,277 | 103,898 | 73,913 |
| 솔브레인홀딩스(주) | 461,741 | 2.2 | 30,752 | 12,859 | 10,989 |
| 솔브레인(주) | 373,368 | 4.8 | 24,866 | 93,715 | 81,357 |
| (주)에스앤에스텍 | 1,716,116 | 8.0 | 65,933 | 95,073 | 45,220 |
| 와이아이케이(주) | 9,601,617 | 11.7 | 47,336 | 42,727 | 26,933 |
| (주)케이씨텍 | 1,022,216 | 4.9 | 20,720 | 21,722 | 15,129 |
| (주)엘오티베콤 | 1,267,668 | 7.1 | 18,990 | 21,868 | 14,326 |
| (주)뉴파워프라즈마 | 2,140,939 | 4.9 | 12,739 | 13,402 | 7,579 |
| (주)에프에스티 | 1,522,975 | 7.0 | 43,009 | 33,201 | 23,758 |
| (주)디엔에프 | 810,030 | 7.0 | 20,964 | 14,840 | 10,692 |
| Marvell | 173,187 | 0.0 | 11,705 | 13,592 | 8,129 |
| SoundHound AI, Inc. | 1,702,957 | 0.9 | 13,719 | 10,172 | 3,820 |
| 계 | | | 1,368,634 | 1,614,189 | 1,247,882 |

(*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

5. 재고자산:

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기말 | | | 전기말 | | |
|-----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 평가전금액 | 평가총당금 | 장부금액 | 평가전금액 | 평가총당금 | 장부금액 |
| 제품 및 상품 | 9,340,283 | (1,427,682) | 7,912,601 | 8,589,879 | (956,427) | 7,633,452 |
| 반제품 및 재공품 | 23,037,774 | (3,336,610) | 19,701,164 | 16,738,121 | (1,216,059) | 15,522,062 |
| 원재료 및 저장품 | 5,095,882 | (611,681) | 4,484,201 | 4,891,951 | (492,006) | 4,399,945 |
| 미착품 | 491,593 | - | 491,593 | 434,548 | - | 434,548 |
| 계 | 37,965,532 | (5,375,973) | 32,589,559 | 30,654,499 | (2,664,492) | 27,990,007 |

6. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자:

가. 당반기 및 전반기 중 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|-----|------------|------------|
| 기초 | 57,397,249 | 56,225,599 |
| 취득 | 69,514 | 1,211,063 |
| 처분 | (107,735) | (74,448) |
| 반기말 | 57,359,028 | 57,362,214 |

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 투자 현황은 다음과 같습니다.
(종속기업 현황은 주석 27 참조)

| 기업명 | 관계의 성격 | 지분율(%)(*1) | 주사업장 | 결산월 |
|--------------|--|------------|------|-----|
| 삼성전기(주) | 수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급 | 23.7 | 한국 | 12월 |
| 삼성에스디에스(주) | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합·관리 등 IT 서비스 및 물류서비스 제공 | 22.6 | 한국 | 12월 |
| 삼성바이오로직스(주) | 신사업 투자 | 31.2 | 한국 | 12월 |
| 삼성SDI(주)(*2) | 2차전지 등 전자부품의 생산 및 공급 | 19.6 | 한국 | 12월 |
| (주)제일기획 | 광고 대행업 | 25.2 | 한국 | 12월 |

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

다. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

| 구 분 | 당반기말 | | | 전기말 | |
|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 주식수 | 시장가치 | 장부금액 | 시장가치 | 장부금액 |
| 삼성전기(주) | 17,693,084 | 2,556,651 | 445,244 | 2,308,947 | 445,244 |
| 삼성에스디에스(주) | 17,472,110 | 2,147,322 | 560,827 | 2,149,070 | 560,827 |
| 삼성바이오로직스(주) | 22,217,309 | 16,529,678 | 1,595,892 | 18,240,411 | 1,595,892 |
| 삼성SDI(주) | 13,462,673 | 9,006,528 | 1,242,605 | 7,956,440 | 1,242,605 |
| (주)제일기획 | 29,038,075 | 526,460 | 491,599 | 669,328 | 491,599 |

7. 유형자산:

가. 당반기 및 전반기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|--------------|--------------|--------------|
| 기초장부금액 | 123,266,986 | 103,667,025 |
| 일반취득 및 자본적지출 | 21,892,460 | 16,792,529 |
| 감가상각 | (12,502,893) | (12,020,188) |
| 처분·폐기·손상 | (51,823) | (157,453) |
| 기타 | (1,316) | 100,063 |
| 반기말장부금액 | 132,603,414 | 108,381,976 |

나. 당반기 및 전반기의 계정과목별 유형자산 상각 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|-----------|------------|------------|
| 매출원가 | 11,513,134 | 11,133,349 |
| 판매비와관리비 등 | 989,759 | 886,839 |
| 계 | 12,502,893 | 12,020,188 |

다. 당반기말 현재 유형자산에 포함된 사용권자산은 1,774,639백만원(전기말: 1,236,013백만원)입니다. 또한, 당반기 중 신규 발생한 사용권자산은 665,017백만원(전반기: 31,866백만원)이며, 사용권자산의 감가상각비는 107,382백만원(전반기: 79,028백만원)입니다.

8. 무형자산:

가. 당반기 및 전반기 중 무형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|----------|-------------|-------------|
| 기초장부금액 | 8,561,424 | 8,657,456 |
| 개별 취득 | 3,930,568 | 800,515 |
| 상각 | (1,317,524) | (1,265,858) |
| 처분·폐기·손상 | (25,042) | (16,893) |
| 기타 | 19,297 | 6,314 |
| 반기말장부금액 | 11,168,723 | 8,181,534 |

나. 당반기 및 전반기의 계정과목별 무형자산 상각 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|-----------|-----------|-----------|
| 매출원가 | 1,018,232 | 967,462 |
| 판매비와관리비 등 | 299,292 | 298,396 |
| 계 | 1,317,524 | 1,265,858 |

9. 차입금:

보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 차입처 | 만기일 | 연이자율(%) | 금 액 | |
|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|
| | | | 당반기말 | 당반기말 | 전기말 |
| 단기차입금: | | | | | |
| 담보부차입금(*1) | 우리은행 등 | - | 0.1~17.7 | 2,668,838 | 2,381,512 |
| 유동성장기차입금: | | | | | |
| 리스부채(*2) | - | - | 2.5 | 194,722 | 129,525 |
| 장기차입금: | | | | | |
| 리스부채(*2) | - | - | 2.5 | 836,584 | 654,979 |
| 무담보차입금 | 삼성디스플레이(주) | 2025.08.16 | 4.6 | 21,990,000 | - |
| 계 | | | | 22,826,584 | 654,979 |

(*1) 담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.

(*2) 리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며, 당반기 중 발생한 이자비용은 11,552백만원(전반기: 4,571백만원)입니다.

10. 사채:

보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 발행일 | 만기상환일 | 연이자율(%) | 금 액 | |
|---------------------------------------|------------|------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 당반기말 | 당반기말 | 전기말 |
| US\$ denominated Straight Bonds(*) | 1997.10.02 | 2027.10.01 | 7.7 | 32,820 (US\$ 25,000천) | 31,683 (US\$ 25,000천) |
| 사채할인발행차금 | | | | (467) | (543) |
| 계 | | | | 32,353 | 31,140 |
| 차감: 유동성사채 | | | | (6,470) | (6,228) |
| 비유동성사채 | | | | 25,883 | 24,912 |

(*) 10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

11. 순확정급여부채(자산):

가. 보고기간종료일 현재 순확정급여부채(자산)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 | 11,318,275 | 10,729,126 |
| 기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치 | 31,169 | 29,546 |
| 소 계 | 11,349,444 | 10,758,672 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (15,010,972) | (15,168,895) |
| 순확정급여부채(자산) 계 | (3,661,528) | (4,410,223) |

나. 당반기 및 전반기 중 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|-----------|-----------|----------|
| 당기근무원가 | 481,183 | 515,017 |
| 순이자원가(수익) | (137,623) | (45,950) |
| 계 | 343,560 | 469,067 |

다. 당반기 및 전반기 중 확정급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|-----------|---------|---------|
| 매출원가 | 137,491 | 186,374 |
| 판매비와관리비 등 | 206,069 | 282,693 |
| 계 | 343,560 | 469,067 |

12. 충당부채:

당반기 중 충당부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 판매보증 (가) | 기술사용료 (나) | 장기성과급 (다) | 기타 (라),(마) | 계 |
|---------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 기초 | 587,665 | 1,546,606 | 549,181 | 2,799,204 | 5,482,656 |
| 순전입(환입) | 441,625 | 333,232 | 96,287 | 1,425,663 | 2,296,807 |
| 사용 | (352,272) | (188,844) | - | (591,191) | (1,132,307) |
| 기타 | - | 39,496 | - | 21,358 | 60,854 |
| 당반기말 | 677,018 | 1,730,490 | 645,468 | 3,655,034 | 6,708,010 |

가. 회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다.

나. 회사는 협상 진행 중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과 기간 해당분을 충당부채로 계상하고 있습니다.

라. 회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용 등을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

다. 회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

(1) 당반기말 현재 당기 이행연도에 대한 무상할당 배출권과 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 만톤(tCO₂-eq))

| 구 분 | 당반기말 |
|----------|-------|
| 무상할당 배출권 | 1,123 |
| 배출량 추정치 | 1,467 |

(2) 당반기 및 전반기 중 배출권 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|-----|--------|--------|
| 기초 | 19,567 | 46,073 |
| 증가 | 1,265 | 1,872 |
| 사용 | (217) | - |
| 반기말 | 20,615 | 47,945 |

(3) 당반기 및 전반기 중 배출부채 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|-----|--------|--------|
| 기초 | 32,825 | 45,049 |
| 순전입 | - | 23,351 |
| 사용 | - | - |
| 반기말 | 32,825 | 68,400 |

13. 우발부채와 약정사항:

가. 지급보증한 내역

(1) 당반기말 현재 회사가 해외종속기업의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 채무보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 해외종속기업 | 보증처 | 보증종료일 | 당반기말 | |
|--------|-------|------------|----------------------------|---------------------------------|
| | | | 관련 차입금 | 채무보증한도 |
| SETK | BNP 외 | 2024-06-13 | 347,142 | 1,020,046 |
| SETK-P | BNP 외 | 2023-12-16 | 17,647 | 170,664 |
| 기타 | 기타 | - | - | 9,473,145 |
| 계 | | | 364,789 (US\$ 277,890천) | 10,663,855 (US\$ 8,122,985천) |

(2) 당반기말 현재 회사가 해외종속기업의 계약이행을 위하여 제공하고 있는 지급보증 한도액은 483,137백만원입니다.

(3) 당반기말 현재 회사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.

나. 소송 등

당반기말 현재 회사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제 기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

다. 분할과 관련된 연대책무

회사와 삼성디스플레이(주) 등은 분할된 삼성디스플레이(주) 등의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

라. 기타 약정사항

당반기말 현재 발생하지 않은 유·무형자산의 취득을 위한 약정액은 12,505,566백만원입니다.

14. 계약부채 :

보고기간종료일 현재 계약부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---------|-----------|-----------|
| 계약부채(*) | 1,471,578 | 1,133,426 |

(*) 계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

15. 자본금:

보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250억주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사가 발행한 보통주 및 우선주의 수(소각 주식수 제외)는 각각 5,969,782,550주와 822,886,700주입니다. 보고기간종료일 현재 유통주식수는 상기 발행주식의 수와 동일하며, 당반기 및 전기 중 변동사항은 없습니다. 한편, 발행주식의 액면총액은 679,267백만원(보통주 596,978백만원, 우선주 82,289백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다.

16. 이익잉여금:

가. 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---------|-------------|-------------|
| 법정적립금 | 450,789 | 450,789 |
| 임의적립금 등 | 212,774,825 | 203,937,227 |
| 계 | 213,225,614 | 204,388,016 |

나. 당반기 및 전반기 중 배당금 산정 내역은 다음과 같습니다.

(1) 분기배당(배당기준일: 2023년과 2022년 3월 31일, 6월 30일)

(단위 : 주, %, 백만원)

| 구 분 | | 당반기 | 전반기 | |
|-----|-------------|---------|----------------|----------------|
| 1분기 | 배당받을 주식 | 보통주 | 5,969,782,550주 | 5,969,782,550주 |
| | | 우선주 | 822,886,700주 | 822,886,700주 |
| | 배당률(액면가 기준) | 보통주·우선주 | 361% | 361% |
| | 배당금액 | 보통주 | 2,155,092 | 2,155,092 |
| | | 우선주 | 297,062 | 297,062 |
| | | 계 | 2,452,154 | 2,452,154 |
| 2분기 | 배당받을 주식 | 보통주 | 5,969,782,550주 | 5,969,782,550주 |
| | | 우선주 | 822,886,700주 | 822,886,700주 |
| | 배당률(액면가 기준) | 보통주·우선주 | 361% | 361% |
| | 배당금액 | 보통주 | 2,155,092 | 2,155,092 |
| | | 우선주 | 297,062 | 297,062 |
| | | 계 | 2,452,154 | 2,452,154 |

17. 기타자본항목:

보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---------------------|-------------|-------------|
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | 147,468 | (122,644) |
| 순확정급여부채(자산) 재측정요소 | (2,246,105) | (1,910,996) |
| 기타 | 1,760,408 | 1,760,408 |
| 계 | (338,229) | (273,232) |

18. 비용의 성격별 분류:

당반기 및 전반기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | | 전반기 | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 3 개 월 | 누 적 | 3 개 월 | 누 적 |
| 제품 및 재공품 등의 변동 | (1,921,558) | (4,458,251) | (2,057,842) | (4,147,431) |
| 원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등 | 21,586,066 | 47,300,307 | 28,305,000 | 55,942,597 |
| 급여 | 3,973,830 | 8,056,082 | 3,820,721 | 8,060,769 |
| 퇴직급여 | 174,390 | 348,059 | 236,313 | 472,649 |
| 감가상각비 | 6,224,767 | 12,502,893 | 6,092,718 | 12,020,188 |
| 무형자산상각비 | 660,403 | 1,317,524 | 637,341 | 1,265,858 |
| 복리후생비 | 902,204 | 1,666,756 | 1,005,792 | 1,686,083 |
| 유틸리티비 | 1,183,576 | 2,411,748 | 835,588 | 1,668,263 |
| 외주용역비 | 927,790 | 1,859,249 | 944,007 | 1,747,749 |
| 광고선전비 | 382,376 | 655,398 | 435,815 | 788,863 |
| 판매촉진비 | 320,547 | 612,671 | 254,948 | 660,344 |
| 기타비용 | 9,012,800 | 17,232,195 | 7,972,009 | 15,888,905 |
| 계(*) | 43,427,191 | 89,504,631 | 48,482,410 | 96,054,837 |

(*) 손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

19. 판매비와관리비:

당반기 및 전반기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | | 전반기 | |
|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 3 개 월 | 누 적 | 3 개 월 | 누 적 |
| (1) 판매비와관리비: | | | | |
| 급여 | 648,380 | 1,384,662 | 563,646 | 1,292,305 |
| 퇴직급여 | 31,629 | 62,604 | 40,861 | 82,316 |
| 지급수수료 | 814,025 | 1,715,912 | 681,356 | 1,342,168 |
| 감가상각비 | 115,774 | 228,549 | 100,601 | 199,384 |
| 무형자산상각비 | 97,537 | 193,249 | 90,610 | 179,405 |
| 광고선전비 | 382,376 | 655,398 | 435,815 | 788,863 |
| 판매촉진비 | 320,547 | 612,671 | 254,948 | 660,344 |
| 운반비 | 135,377 | 271,208 | 298,887 | 560,372 |
| 서비스비 | 377,408 | 651,168 | 226,239 | 501,542 |
| 기타판매비와관리비 | 582,925 | 1,079,247 | 606,931 | 1,046,927 |
| 소 계 | 3,505,978 | 6,854,668 | 3,299,894 | 6,653,626 |
| (2) 경상연구개발비: | | | | |
| 연구개발 총지출액 | 6,112,643 | 11,727,904 | 5,218,248 | 10,252,031 |
| 계 | 9,618,621 | 18,582,572 | 8,518,142 | 16,905,657 |

20. 기타수익 및 기타비용:

당반기 및 전반기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | | 전반기 | |
|------------------|------------|------------|---------|---------|
| | 3 개 월 | 누 적 | 3 개 월 | 누 적 |
| (1) 기타수익: | | | | |
| 배당금수익 | 13,405,935 | 21,845,780 | 10,331 | 137,839 |
| 임대료수익 | 44,502 | 90,399 | 42,472 | 85,710 |
| 유형자산처분이익 | 37,373 | 69,275 | 40,594 | 88,692 |
| 기타 | 45,548 | 97,888 | 51,000 | 115,427 |
| 계 | 13,533,358 | 22,103,342 | 144,397 | 427,668 |
| (2) 기타비용: | | | | |
| 유형자산처분손실 | 2,172 | 5,338 | 3,185 | 4,119 |
| 기부금 | 20,292 | 77,639 | 76,946 | 129,403 |
| 기타 | 16,727 | 48,454 | 19,045 | 20,263 |
| 계 | 39,191 | 131,431 | 99,176 | 153,785 |

21. 금융수익 및 금융비용:

당반기 및 전반기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | | 전반기 | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 3 개 월 | 누 적 | 3 개 월 | 누 적 |
| (1) 금융수익: | | | | |
| 이자수익 | 88,806 | 150,581 | 85,462 | 168,920 |
| - 상각후원가 측정 금융자산 | 88,806 | 150,581 | 85,462 | 168,920 |
| 외환차이 | 1,740,510 | 3,596,340 | 2,392,638 | 3,789,545 |
| 파생상품관련이익 | - | 235,753 | 11,043 | 270,573 |
| 계 | 1,829,316 | 3,982,674 | 2,489,143 | 4,229,038 |
| (2) 금융비용: | | | | |
| 이자비용 | 316,475 | 477,978 | 65,175 | 119,096 |
| - 상각후원가 측정 금융부채 | 254,760 | 333,472 | 12,109 | 23,926 |
| - 기타금융부채 | 61,715 | 144,506 | 53,066 | 95,170 |
| 외환차이 | 1,746,798 | 3,905,443 | 2,367,962 | 3,756,409 |
| 파생상품관련손실 | 93,579 | 93,579 | - | - |
| 계 | 2,156,852 | 4,477,000 | 2,433,137 | 3,875,505 |

회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

22. 법인세비용:

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당반기 현재 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 0.9%입니다.

23. 주당이익:

가. 기본주당이익

당반기 및 전반기의 기본주당이익 산정 내역은 다음과 같습니다.

(1) 보통주

(단위 : 백만원, 천주, 원)

| 구 분 | 당반기 | | 전반기 | |
|-------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 3 개 월 | 누 적 | 3 개 월 | 누 적 |
| 반기순이익 | 9,584,633 | 13,742,728 | 8,191,308 | 15,843,251 |
| 반기순이익 중 보통주 해당분 | 8,423,518 | 12,077,888 | 7,198,986 | 13,923,947 |
| ÷ 가중평균유통보통주식수(천주) | 5,969,783 | 5,969,783 | 5,969,783 | 5,969,783 |
| 기본 보통주 주당이익(원) | 1,411 | 2,023 | 1,206 | 2,332 |

(2) 우선주

(단위 : 백만원, 천주, 원)

| 구 분 | 당반기 | | 전반기 | |
|-------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 3 개 월 | 누 적 | 3 개 월 | 누 적 |
| 반기순이익 | 9,584,633 | 13,742,728 | 8,191,308 | 15,843,251 |
| 반기순이익 중 우선주 해당분 | 1,161,115 | 1,664,840 | 992,322 | 1,919,304 |
| ÷ 가중평균유통우선주식수(천주) | 822,887 | 822,887 | 822,887 | 822,887 |
| 기본 우선주 주당이익(원) | 1,411 | 2,023 | 1,206 | 2,332 |

나. 희석주당이익

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당반기 및 전반기의 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

24. 현금흐름표:

가. 회사는 영업활동 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다. 당반기 및 전반기 중 영업활동 현금흐름 관련 조정 내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

(1) 조정 내역

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|----------------|--------------|-------------|
| 법인세비용 | 127,993 | 4,094,874 |
| 금융수익 | (712,113) | (1,111,466) |
| 금융비용 | 1,504,324 | 1,031,223 |
| 퇴직급여 | 348,059 | 472,649 |
| 감가상각비 | 12,502,893 | 12,020,188 |
| 무형자산상각비 | 1,317,524 | 1,265,858 |
| 대손상각비(환입) | 7,777 | 6,180 |
| 배당금수익 | (21,845,780) | (137,839) |
| 유형자산처분이익 | (69,275) | (88,692) |
| 유형자산처분손실 | 5,338 | 4,119 |
| 재고자산평가손실(환입) 등 | 2,890,936 | 662,791 |
| 기타 | 13,768 | 18,390 |
| 계 | (3,908,556) | 18,238,275 |

(2) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|-----------------|--------------|-------------|
| 매출채권의 감소(증가) | (1,433,395) | 1,214,372 |
| 미수금의 감소(증가) | 575,435 | 286,145 |
| 장단기선급비용의 감소(증가) | (173,745) | (182,769) |
| 재고자산의 감소(증가) | (7,416,523) | (5,988,520) |
| 매입채무의 증가(감소) | 707,640 | 462,580 |
| 장단기미지급금의 증가(감소) | (2,880,364) | (1,720,329) |
| 선수금의 증가(감소) | (82,392) | (45,620) |
| 예수금의 증가(감소) | (107,177) | (228,396) |
| 미지급비용의 증가(감소) | (1,635,068) | (971,137) |
| 장단기충당부채의 증가(감소) | 1,164,499 | 423,398 |
| 퇴직금의 지급 | (202,846) | (179,735) |
| 기타 | (354,414) | (776,812) |
| 계 | (11,838,350) | (7,706,823) |

나. 당반기 및 전반기 중 리스부채와 관련하여 발생한 원금 상환에 따른 현금유출액(재무활동)은 80,125백만원 및 72,124백만원, 이자비용 현금유출액(영업활동)은 11,552백만원 및 4,571백만원입니다.

25. 재무위험관리:

회사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책과 프로그램을 운영하고 있습니다. 위험을 회피하기 위한 파생상품의 이용도 이 프로그램에 포함되어 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 글로벌 재무위험 관리정책을 수립한 후 주기적으로 재무위험 측정, 헷지 및 평가 등을 실행하고 있습니다.

한편, 해외 주요 권역별로 지역 금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역 내 자금을 통합운용하여 유동성위험을 관리하고 있습니다.

재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

회사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR, INR 등이 있습니다.

회사는 환율변동과는 무관하게 통화별 자산과 부채 규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융 거래 발생 시 현지 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 또한, 회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

(2) 이자율변동위험

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 회사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.

(3) 주가변동위험

회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

당반기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영전)에 미치는 영향은 16,142백만원(전반기: 13,857백만원)입니다.

나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재정팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독하에 이루어지고 있습니다. 회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

보고기간종료일 현재 회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용 위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

다. 유동성위험

대규모 투자가 많은 회사 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금 수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다.

회사는 주기적으로 미래 현금 흐름을 예측하여 유동성위험을 사전 관리하고 있습니다. 권역별로 Cash Pooling을 구축·활용하여 권역 내 자금 부족의 경우에도 내부 자금을 활용하여 유동성위험을 효율적으로 관리하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사 간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성위험을 최소화하는 한편 자금운용부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 회사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

또한, 만약의 대규모 유동성 필요에 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있습니다.

라. 자본위험

회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

당반기말 현재 회사는 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 Aa2 평가등급을 받고 있으며, 보고 기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|------|-------------|-------------|
| 부 채 | 67,838,801 | 50,667,559 |
| 자 본 | 218,188,792 | 209,416,191 |
| 부채비율 | 31.1% | 24.2% |

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기말 | | 전기말 | |
|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 |
| 금융자산: | | | | |
| 현금및현금성자산 | 12,892,470 | (*1) | 3,921,593 | (*1) |
| 단기금융상품 | 1,403 | (*1) | 137 | (*1) |
| 매출채권 | 22,140,988 | (*1) | 20,503,223 | (*1) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 1,730,986 | 1,730,986 | 1,364,325 | 1,364,325 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 61 | 61 | 283 | 283 |
| 기타(*2) | 5,026,078 | 169,957 | 5,470,355 | (*1) |
| 계 | 41,791,986 | | 31,259,916 | |
| 금융부채: | | | | |
| 매입채무 | 9,474,012 | (*1) | 8,729,315 | (*1) |
| 단기차입금 | 2,668,838 | (*1) | 2,381,512 | (*1) |
| 미지급금 | 12,579,242 | (*1) | 18,324,604 | (*1) |
| 유동성장기부채 | 201,192 | 6,995 | 135,753 | 6,580 |
| - 유동성장기차입금 | 194,722 | (*3) | 129,525 | (*3) |
| - 유동성사채 | 6,470 | 6,995 | 6,228 | 6,580 |
| 사채 | 25,883 | 30,086 | 24,912 | 27,845 |
| 장기차입금 | 22,826,584 | (*1)(*3) | 654,979 | (*3) |
| 장기미지급금 | 4,414,940 | (*1) | 2,083,790 | (*1) |
| 기타 | 3,541,169 | (*1) | 3,145,473 | (*1) |
| 계 | 55,731,860 | | 35,480,338 | |

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 금융자산 4,856,121백만원은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*3) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기말 | | | |
|-----------------|-----------|--------|---------|-----------|
| | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 계 |
| 금융자산: | | | | |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 1,614,189 | - | 116,797 | 1,730,986 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | - | 61 | 61 |
| 기타 | - | - | 169,957 | 169,957 |
| 금융부채: | | | | |
| 유동성사채 | - | 6,995 | - | 6,995 |
| 사채 | - | 30,086 | - | 30,086 |

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 전기말 | | | |
|-----------------|-----------|--------|---------|-----------|
| | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 계 |
| 금융자산: | | | | |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 1,247,882 | - | 116,443 | 1,364,325 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | - | 283 | 283 |
| 금융부채: | | | | |
| 유동성사채 | - | 6,580 | - | 6,580 |
| 사채 | - | 27,845 | - | 27,845 |

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- '수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- '수준 2': 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)
- '수준 3': 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(3) 가치평가기법 및 투입변수

회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

당반기말 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 공정가치 | 가치평가기법 | '수준 3' 투입변수 | 투입변수 범위 |
|------------------|---------|-----------|-------------|---------|
| 기타포괄손익-공정가치금융자산: | | | | |
| 삼성벤처투자(주) | 32,236 | 현금흐름할인법 | 영구성장률 | 1.0% |
| | | | 가중평균자본비용 | 18.1% |
| (주)미코세라믹스 | 30,714 | 현금흐름할인법 등 | 영구성장률 | 0.0% |
| | | | 가중평균자본비용 | 14.3% |
| 기타: | | | | |
| 지분 콜옵션 | 169,957 | 이항모형 | 무위험 이자율 | 3.7% |
| | | | 가격 변동성 | 55.0% |

(4) '수준 3'에 해당하는 금융상품의 변동 내역

(단위 : 백만원)

| 금융자산 | 당반기 | 전반기 |
|-----------------|---------|----------|
| 기초 | 116,726 | 120,347 |
| 매입 | 27,784 | - |
| 매도 | (283) | (150) |
| 당기손익으로 인식된 손익 | 141,062 | - |
| 기타포괄손익으로 인식된 손익 | 1,526 | 12,822 |
| 기타 | - | (13,828) |
| 반기말 | 286,815 | 119,191 |

(5) '수준 3'으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

당반기말 현재 '수준 3'으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(자본은 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 유리한 변동 | | 불리한 변동 | |
|---------------------|--------|-------|----------|---------|
| | 당기손익 | 자본 | 당기손익 | 자본 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산(*1) | - | 3,113 | - | (2,543) |
| 기타(*2) | 57,071 | - | (46,533) | - |

(*1) 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1.0%~1.0%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

(*2) 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산 가격(20%) 및 가격 변동성(10%)을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

26. 부문별 보고:

회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문 등으로 구성되어 있습니다.

보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

(1) 당분기(3개월)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | DX 부문 | DS 부문 | 계(*) |
|---------|------------|-------------|-------------|
| 매출액 | 25,539,424 | 14,511,343 | 39,729,088 |
| 감가상각비 | 134,701 | 6,039,304 | 6,224,767 |
| 무형자산상각비 | 423,127 | 178,340 | 660,403 |
| 영업이익 | 1,035,370 | (4,885,030) | (3,698,103) |

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(2) 당반기(누적)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | DX 부문 | DS 부문 | 계(*) |
|---------|------------|-------------|-------------|
| 매출액 | 54,775,598 | 27,855,964 | 81,897,767 |
| 감가상각비 | 270,034 | 12,132,145 | 12,502,893 |
| 무형자산상각비 | 830,016 | 371,066 | 1,317,524 |
| 영업이익 | 2,257,012 | (9,867,407) | (7,606,864) |

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(3) 전분기(3개월)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | DX 부문 | DS 부문 | 계(*) |
|---------|------------|------------|------------|
| 매출액 | 30,994,646 | 28,327,697 | 58,641,288 |
| 감가상각비 | 135,790 | 5,914,663 | 6,092,718 |
| 무형자산상각비 | 391,409 | 191,232 | 637,341 |
| 영업이익 | 545,002 | 9,611,354 | 10,158,878 |

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(4) 전반기(누적)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | DX 부문 | DS 부문 | 계(*) |
|---------|------------|------------|-------------|
| 매출액 | 62,111,009 | 54,703,997 | 115,365,546 |
| 감가상각비 | 271,910 | 11,664,052 | 12,020,188 |
| 무형자산상각비 | 773,610 | 385,034 | 1,265,858 |
| 영업이익 | 1,740,202 | 17,564,175 | 19,310,709 |

(*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

27. 특수관계자와의 거래:

가. 당반기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

| 지역 | 기업명 | 업종 | 지분율 (%) |
|--------------------------|---|-----------------|---------|
| 미주 | Samsung Electronics America, Inc. (SEA) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung International, Inc. (SII) | 전자제품 생산 | 100.0 |
| | Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX) | 전자제품 생산 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA) | 가전제품 생산 | 100.0 |
| | Samsung Research America, Inc (SRA) | R&D | 100.0 |
| | SAMSUNG NEXT LLC (SNX) | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF) | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 100.0 |
| | NeuroLogica Corp. | 의료기기 생산 및 판매 | 100.0 |
| | Samsung HVAC America, LLC | 에어컨공조 판매 | 100.0 |
| | Joyent, Inc. | 클라우드서비스 | 100.0 |
| | SmartThings, Inc. | 스마트홈 플랫폼 | 100.0 |
| | TeleWorld Solutions, Inc. (TWS) | 네트워크장비 설치 및 최적화 | 100.0 |
| | Samsung Semiconductor, Inc. (SSI) | 반도체 · DP 판매 | 100.0 |
| | Samsung Federal, Inc. (SFI) | R&D | 100.0 |
| | Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS) | 반도체 생산 | 100.0 |
| | Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI) | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | SEMES America, Inc. | 반도체 장비 서비스 | 100.0 |
| | Emerald Intermediate, Inc. | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Emerald Merger Sub, Inc. | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| AdGear Technologies Inc. | 디지털광고 플랫폼 | 100.0 | |

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

| 지역 | 기업명 | 업종 | 지분율 (%)(*) |
|---|--|----------------------------|---------------|
| 미주 | Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA) | 전자제품 생산 및 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM) | 가전제품 생산 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA) | 마케팅 및 서비스 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Chile Limitada (SECH) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN) | 마케팅 및 서비스 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA) | 컨설팅 | 100.0 |
| | Harman International Industries, Inc. | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Harman Becker Automotive Systems, Inc. | 오디오제품 생산, 판매, R&D | 100.0 |
| | Harman Connected Services, Inc. | Connected Service Provider | 100.0 |
| | Harman Connected Services Engineering Corp. | Connected Service Provider | 100.0 |
| | Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda. | 오디오제품 생산, 판매 | 100.0 |
| | Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V. | 오디오제품 생산 | 100.0 |
| | Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda. | 오디오제품 판매, R&D | 100.0 |
| | Harman Financial Group LLC | Management Company | 100.0 |
| | Harman International Industries Canada Ltd. | 오디오제품 판매 | 100.0 |
| | Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V. | 오디오제품 판매 | 100.0 |
| | Harman KG Holding, LLC | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Harman Professional, Inc. | 오디오제품 판매, R&D | 100.0 |
| Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P | 벤처기업 투자 | 61.4 | |
| China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership | 벤처기업 투자 | 99.0 | |

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

| 지역 | 기업명 | 업종 | 지분율 (%)(*) |
|--|--|---------------------|---------------|
| 유럽· CIS | Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Ltd. (SEL) | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL) | 반도체·DP 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics GmbH (SEG) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG) | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG) | 반도체·DP 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics France S.A.S (SEF) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH) | 전자제품 생산 및 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS) | 물류 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH) | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK) | TV·모니터 생산 | 100.0 |
| | Samsung Display Slovakia, s.r.o., v likvidacii (SDSK) | DP 임가공 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM) | 가전제품 생산 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Romania LLC (SEROM) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE) | 에어컨공조 판매 | 100.0 |
| | Samsung Nanoradio Design Center (SNDC) | R&D | 100.0 |
| | Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC) | R&D | 100.0 |
| | Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC) | R&D | 100.0 |
| | SAMSUNG Zhilabs, S.L. | 네트워크Solution 개발, 판매 | 100.0 |
| | FOODIENT LTD. | R&D | 100.0 |
| | Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK) | TV 생산 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR) | R&D | 100.0 | |
| Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE) | 전자제품 판매 | 100.0 | |
| Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO) | 전자제품 판매 | 100.0 | |
| Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR) | R&D | 100.0 | |
| Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC) | 마케팅 | 100.0 | |
| Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ) | 마케팅 | 100.0 | |

| 지역 | 기업명 | 업종 | 지분율 (%)(*) |
|--------------------|--|----------------------------|---------------|
| 유럽· CIS | AKG Acoustics Gmbh | 오디오제품 생산, 판매 | 100.0 |
| | Apostera UA, LLC | Connected Service Provider | 100.0 |
| | Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada | 오디오제품 판매 | 100.0 |
| | Harman Automotive UK Limited | 오디오제품 생산 | 100.0 |
| | Harman Becker Automotive Systems GmbH | 오디오제품 생산, 판매, R&D | 100.0 |
| | Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L. | 오디오제품 판매 | 100.0 |
| | Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft | 오디오제품 생산, R&D | 100.0 |
| | Harman Belgium SA | 오디오제품 판매 | 100.0 |
| | Harman Connected Services AB. | Connected Service Provider | 100.0 |
| | Harman Finland Oy | Connected Service Provider | 100.0 |
| | Harman Connected Services GmbH | Connected Service Provider | 100.0 |
| | Harman Connected Services Poland Sp.zoo | Connected Service Provider | 100.0 |
| | Harman Connected Services UK Ltd. | Connected Service Provider | 100.0 |
| | Harman Consumer Nederland B.V. | 오디오제품 판매 | 100.0 |
| | Harman Deutschland GmbH | 오디오제품 판매 | 100.0 |
| | Harman Finance International GP S.a.r.l | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Harman France SNC | 오디오제품 판매 | 100.0 |
| | Harman Holding Gmbh & Co. KG | Management Company | 100.0 |
| | Harman Hungary Financing Ltd. | Financing Company | 100.0 |
| | Harman Inc. & Co. KG | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Harman International Estonia OU | R&D | 100.0 |
| | Harman International Industries Limited | 오디오제품 판매, R&D | 100.0 |
| | Harman International Romania SRL | R&D | 100.0 |
| | Harman Finance International, SCA | Financing Company | 100.0 |
| | Harman Management Gmbh | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Harman Professional Kft | 오디오제품 생산, R&D | 100.0 |
| | Harman Professional Denmark ApS | 오디오제품 판매, R&D | 100.0 |
| | Red Bend Software SAS | 소프트웨어 디자인 | 100.0 |
| | Studer Professional Audio GmbH | 오디오제품 판매, R&D | 100.0 |
| | Harman Connected Services OOO | Connected Service Provider | 100.0 |
| Harman RUS CIS LLC | 오디오제품 판매 | 100.0 | |

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

| 지역 | 기업명 | 업종 | 지분율 (%)(*) |
|--------------|---|----------------------------|---------------|
| 중동 · 아프리카 | Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Turkiye (SETK) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P) | 전자제품 생산 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. (SELV) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG) | 전자제품 생산 및 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL) | 마케팅 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN) | 마케팅 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK) | 마케팅 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC) | R&D | 100.0 |
| | Corephotonics Ltd. | R&D | 100.0 |
| | Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP) | TV · 모니터 생산 | 100.0 |
| | Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA) | 마케팅 | 100.0 |
| | Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA) | 마케팅 | 100.0 |
| | Global Symphony Technology Group Private Ltd. | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Harman Connected Services Morocco | Connected Service Provider | 100.0 |
| | Harman Industries Holdings Mauritius Ltd. | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Red Bend Ltd. | 오디오제품 생산 | 100.0 |

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

| 지역 | 기업명 | 업종 | 지분율 (%) |
|----------------|---|----------------------------|---------|
| 아시아 (중국 제외) | Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL) | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA) | 전자제품 생산 | 100.0 |
| | Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA) | 가전제품 생산 | 100.0 |
| | Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV) | 전자제품 생산 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT) | 통신제품 생산 | 100.0 |
| | Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC) | 전자제품 생산 및 판매 | 100.0 |
| | Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV) | DP 생산 | 100.0 |
| | DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED | DP 부품 생산 | 100.0 |
| | PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN) | 전자제품 생산 및 판매 | 100.0 |
| | PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN) | 전자제품 판매 및 서비스 | 100.0 |
| | Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE) | 전자제품 생산 및 판매 | 91.8 |
| | Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE) | 마케팅 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL) | 전자제품 생산 및 판매 | 100.0 |
| | Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd. | 마케팅 | 100.0 |
| | Samsung Display Noida Private Limited (SDN) | DP 생산 | 100.0 |
| | Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore) | R&D | 100.0 |
| | Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD) | R&D | 100.0 |
| | Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL) | 서비스 | 100.0 |
| | Samsung Japan Corporation (SJC) | 반도체 · DP 판매 | 100.0 |
| | Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ) | R&D | 100.0 |
| | Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd. | Connected Service Provider | 100.0 |
| | Harman International (India) Private Limited | 오디오제품 판매, R&D | 100.0 |
| | Harman International Industries PTY Ltd. | 해외자회사 관리 | 100.0 |
| | Harman International Japan Co., Ltd. | 오디오제품 판매, R&D | 100.0 |
| | Harman Singapore Pte. Ltd. | 오디오제품 판매 | 100.0 |

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

| 지역 | 기업명 | 업종 | 지분율 (%) (*) |
|----|---|----------------------------|-------------|
| 중국 | Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. (TSEC) | TV · 모니터 생산 | 91.2 |
| | Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC) | 가전제품 생산 | 88.3 |
| | Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E) | 가전제품 생산 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC) | R&D | 100.0 |
| | Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC) | 통신제품 생산 | 90.0 |
| | Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing) | R&D | 100.0 |
| | Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing) | R&D | 100.0 |
| | Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou) | R&D | 100.0 |
| | Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen) | R&D | 100.0 |
| | Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS) | 반도체 · DP 판매 | 100.0 |
| | Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS) | 반도체 생산 | 100.0 |
| | Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX) | 반도체 · DP 판매 | 100.0 |
| | Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS) | 반도체 임가공 | 100.0 |
| | Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED) | LED 생산 | 100.0 |
| | Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR) | R&D | 100.0 |
| | Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD) | DP 생산 | 100.0 |
| | Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT) | DP 생산 | 95.0 |
| | SEMES (XIAN) Co., Ltd. | 반도체 · FPD 장비 서비스 | 100.0 |
| | Samsung Semiconductor Investment L.P. I | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | Harman (China) Technologies Co., Ltd. | 오디오제품 생산 | 100.0 |
| | Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd. | 오디오제품 판매 | 100.0 |
| | Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd. | 오디오제품 생산, R&D | 100.0 |
| | Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd. | 오디오제품 판매 | 100.0 |
| | Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd. | Connected Service Provider | 100.0 |
| | Harman Holding Limited | 오디오제품 판매 | 100.0 |
| | Harman International (China) Holdings Co., Ltd. | 오디오제품 판매, R&D | 100.0 |
| | Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | 오디오제품 판매, R&D | 100.0 |

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

| 지역 | 기업명 | 업종 | 지분율 (%) |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 국내 | 삼성디스플레이(주) | DP 생산 및 판매 | 84.8 |
| | 에스유머티리얼스(주) | DP 부품 생산 | 50.0 |
| | 스테코(주) | 반도체 부품 생산 | 70.0 |
| | 세메스(주) | 반도체 · FPD 장비 생산, 판매 | 91.5 |
| | 삼성전자서비스(주) | 전자제품 수리 서비스 | 99.3 |
| | 삼성전자서비스씨에스(주) | 고객상담서비스 | 100.0 |
| | 삼성전자판매(주) | 전자제품 판매 | 100.0 |
| | 삼성전자로지텍(주) | 종합물류대행 | 100.0 |
| | 삼성메디슨(주) | 의료기기 생산 및 판매 | 68.5 |
| | (주)희망별숲 | 식품 제조 가공 | 100.0 |
| | (주)미래로시스템 | 반도체 소프트웨어 개발 및 공급 | 99.9 |
| | (주)도우인시스 | DP 부품 생산 | 69.0 |
| | 지에프(주) | DP 부품 생산 | 100.0 |
| | (주)하만인터내셔널코리아 | 소프트웨어 개발 및 공급 | 100.0 |
| | SVIC 21호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 22호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 26호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 28호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 29호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 32호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 33호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 37호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 40호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 42호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 43호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 45호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 48호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 52호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 55호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 56호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 57호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | SVIC 62호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 99.0 |
| | 반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁 | 반도체산업 투자 | 66.7 |
| 시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁 | 반도체산업 투자 | 62.5 | |

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

나. 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 매출·매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당반기

(단위 : 백만원)

| 구분 | 기업명(*1) | 매출 등 | 비유동자산 처분 | 매입 등 | 비유동자산 매입 |
|------|--|------------|-------------|------------|-------------|
| 종속기업 | 삼성디스플레이(주) | 137,144 | - | 738,877 | - |
| | Samsung Electronics America, Inc. (SEA) | 14,863,612 | - | 105,379 | - |
| | Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL) | 37 | - | 14,289 | - |
| | Harman과 그 종속기업(*2) | - | - | 30,015 | - |
| | Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS) | 51,078 | 30,686 | 5,008,994 | 10,575 |
| | Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT) | 1,947,849 | 196 | 10,352,523 | 263 |
| | Samsung Semiconductor, Inc. (SSI) | 9,097,034 | - | 331,874 | - |
| | Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS) | 1,135 | - | 2,091,445 | 1,058 |
| | Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC) | 3,861,951 | - | 5,270 | - |
| | Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH) | - | - | - | - |
| | Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV) | 1,200,221 | - | 6,675,894 | 767 |
| | Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL) | 1,569,624 | 118 | 2,195,873 | - |
| | Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV) | 631,355 | - | - | - |
| | Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA) | 676,922 | - | 12,630 | - |
| | Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC) | 265,417 | 965 | 2,617,708 | - |
| | Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS) | 5,606,090 | - | - | - |
| | Samsung International, Inc. (SII) | 123,097 | 51 | 3,575,194 | - |
| | Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE) | 1,413,307 | - | 1,226,275 | - |
| | Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK) | 1,114,666 | - | 56,462 | - |
| | Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS) | 2,494,493 | - | 4,298 | - |
| | Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM) | 1,297,667 | - | 3,041 | - |
| | 세메스(주) | 4,380 | - | 1,243,475 | - |
| | Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD) | 58,882 | - | - | - |
| | Samsung Electronics GmbH (SEG) | 1,680,581 | - | 3,457 | - |
| | Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN) | 1,164,819 | - | 685 | - |
| | 기타 | 27,765,854 | 2,717 | 6,705,608 | 1,964 |
| | 종속기업 계 | 77,027,215 | 34,733 | 42,999,266 | 14,627 |

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.

(단위 : 백만원)

| 구분 | 기업명(*1) | 매출 등 | 비유동자산 처분 | 매입 등 | 비유동자산 매입 |
|----------------|---------------|---------|----------|-----------|-----------|
| 관계기업 및 공동기업 | 삼성에스디에스㈜ | 100,607 | - | 871,968 | 148,503 |
| | 삼성전기㈜ | 49,539 | - | 441,319 | - |
| | 삼성SDI㈜ | 41,079 | - | 198,085 | 16,901 |
| | ㈜제일기획 | 34,644 | - | 419,220 | 76 |
| | 기타 | 278,091 | - | 425,725 | 3,003 |
| | 관계기업 및 공동기업 계 | 503,960 | - | 2,356,317 | 168,483 |
| 그 밖의 특수관계자 | 삼성물산㈜ | 13,016 | 70 | 24,997 | 1,874,820 |
| | 기타 | 207,882 | - | 449,283 | 118,060 |
| | 그 밖의 특수관계자 계 | 220,898 | 70 | 474,280 | 1,992,880 |
| 기타(*2) | 삼성엔지니어링㈜ | 680 | - | 15,188 | 1,359,554 |
| | ㈜에스원 | 2,606 | - | 222,138 | 7,432 |
| | 기타 | 77,658 | - | 101,852 | 147,800 |
| | 기타 계 | 80,944 | - | 339,178 | 1,514,786 |

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전반기

(단위 : 백만원)

| 구분 | 기업명(*1) | 매출 등 | 비유동자산 처분 | 매입 등 | 비유동자산 매입 |
|------|---|-------------|-------------|------------|-------------|
| 종속기업 | 삼성디스플레이㈜ | 116,235 | - | 374,350 | - |
| | Samsung Electronics America, Inc. (SEA) | 18,774,290 | - | 99,204 | - |
| | Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL) | 25 | - | 15,071 | - |
| | Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT) | 4,503,346 | - | 15,027,178 | 59 |
| | Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS) | 113,310 | 5,135 | 4,869,112 | 1,608 |
| | Harman과 그 종속기업(*2) | - | - | 43,916 | - |
| | Samsung Semiconductor, Inc. (SSI) | 22,720,846 | - | 244,899 | - |
| | Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC) | 871,795 | - | 4,008 | - |
| | Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV) | 3,073,882 | 6 | 8,133,380 | - |
| | Samsung Austin Semiconductor LLC (SAS) | 28 | - | 1,625,294 | 1,430 |
| | Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL) | 3,062,570 | - | 2,585,609 | - |
| | Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS) | 10,266,046 | - | 47 | - |
| | Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV) | 836,339 | - | - | - |
| | Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA) | 633,873 | - | 10,335 | - |
| | Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC) | 354,262 | 2,775 | 2,858,565 | 355 |
| | Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK) | 845,212 | - | 48,687 | - |
| | Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE) | 916,293 | - | 1,536,606 | - |
| | Samsung International, Inc. (SII) | 185,607 | 216 | 4,529,493 | - |
| | Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS) | 2,651,208 | - | 1,719 | - |
| | Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN) | 416,273 | - | 1,214 | - |
| | Samsung Electronics Hungarian Private Co., Ltd. (SEH) | 233,426 | 141 | 1,513 | - |
| | Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD) | 154,618 | - | - | - |
| | Samsung Electronics GmbH (SEG) | 1,991,533 | - | 3,567 | - |
| | 세메스㈜ | 4,709 | - | 1,123,457 | - |
| 기타 | 30,989,327 | 3,644 | 7,046,249 | 2,011 | |
| | 종속기업 계 | 103,715,053 | 11,917 | 50,183,473 | 5,463 |

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.

(단위 : 백만원)

| 구분 | 기업명(*1) | 매출 등 | 비유동자산 처분 | 매입 등 | 비유동자산 매입 |
|----------------|---------------|---------|----------|-----------|-----------|
| 관계기업 및 공동기업 | 삼성에스디에스㈜ | 128,256 | - | 792,366 | 172,753 |
| | 삼성전기㈜ | 47,427 | - | 486,789 | - |
| | 삼성SDI㈜ | 36,570 | - | 207,099 | 7,252 |
| | ㈜제일기획 | 29,923 | - | 441,732 | - |
| | 기타 | 248,805 | - | 400,521 | 2,404 |
| | 관계기업 및 공동기업 계 | 490,981 | - | 2,328,507 | 182,409 |
| 그 밖의 특수관계자 | 삼성물산㈜ | 25,175 | - | 35,202 | 2,595,379 |
| | 기타 | 158,280 | - | 303,463 | 37,825 |
| | 그 밖의 특수관계자 계 | 183,455 | - | 338,665 | 2,633,204 |
| 기타(*2) | 삼성엔지니어링㈜ | 875 | - | 12,995 | 1,030,441 |
| | ㈜에스원 | 2,117 | - | 208,373 | 11,040 |
| | 기타 | 69,002 | - | 76,038 | 66,110 |
| | 기타 계 | 71,994 | - | 297,406 | 1,107,591 |

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

다. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 등 잔액은 다음과 같습니다.

(1) 당반기말

(단위 : 백만원)

| 구분 | 기업명(*1) | 채권 등(*2) | 채무 등(*3) |
|------|--|------------|-----------|
| 종속기업 | 삼성디스플레이(주) | 14,686 | 49,590 |
| | Samsung Electronics America, Inc. (SEA) | 1,187,456 | 392,797 |
| | Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL) | 1,624 | 1,490 |
| | Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS) | 59,044 | 916,679 |
| | Harman과 그 종속기업(*4) | - | 7,753 |
| | Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT) | 625,911 | 2,636,407 |
| | Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC) | 89,730 | 943 |
| | Samsung Semiconductor, Inc. (SSI) | 3,887,532 | 376,972 |
| | Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS) | 4,933 | 418,948 |
| | Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH) | 411 | - |
| | Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV) | 326,389 | 1,534,787 |
| | Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL) | 1,080,694 | 354,918 |
| | Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV) | 112,611 | - |
| | Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA) | 213,218 | 3,879 |
| | Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS) | 2,595,113 | 22,553 |
| | Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC) | 143,848 | 406,402 |
| | Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE) | 102,719 | 200,015 |
| | Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK) | 95,644 | 39,104 |
| | Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS) | 382,101 | 749 |
| | Samsung International, Inc. (SII) | 91,221 | 296,012 |
| | Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM) | 402,146 | 242 |
| | Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD) | 10,164 | - |
| | Samsung Electronics GmbH (SEG) | 89,519 | 2,642 |
| | 세메스(주) | 47,821 | 780,695 |
| | Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN) | 35,992 | 1,916 |
| | 기타 | 7,423,977 | 1,553,132 |
| | 종속기업 계(*3) | 19,024,504 | 9,998,625 |

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다.

(*3) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(*4) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.

(단위 : 백만원)

| 구분 | 기업명(*1) | 채권 등 | 채무 등(*2) |
|----------------|---------------|---------|-----------|
| 관계기업 및 공동기업 | 삼성에스디에스주 | 24,604 | 480,778 |
| | 삼성전기주 | 1,716 | 87,444 |
| | 삼성SDI주 | 117,507 | 44,271 |
| | 주제일기획 | 14 | 302,171 |
| | 기타 | 87,493 | 112,288 |
| | 관계기업 및 공동기업 계 | 231,334 | 1,026,952 |
| 그 밖의 특수관계자 | 삼성물산주 | 189,932 | 733,038 |
| | 기타 | 14,013 | 201,169 |
| | 그 밖의 특수관계자 계 | 203,945 | 934,208 |
| 기타(*3) | 삼성엔지니어링주 | 340 | 877,530 |
| | 주에스원 | 689 | 26,747 |
| | 기타 | 4,702 | 170,253 |
| | 기타 계 | 5,731 | 1,074,530 |

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른

동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

| 구분 | 기업명(*1) | 채권 등(*2) | 채무 등(*3) |
|------|--|------------|------------|
| 종속기업 | 삼성디스플레이(주) | 32,521 | 108,011 |
| | Samsung Electronics America, Inc. (SEA) | 868,937 | 983,709 |
| | Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL) | 1,604 | 1,812 |
| | Harman과 그 종속기업(*4) | - | 6,537 |
| | Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS) | 57,423 | 751,693 |
| | Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT) | 606,030 | 2,396,411 |
| | Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC) | 131,285 | 283,459 |
| | Samsung Semiconductor, Inc. (SSI) | 4,700,427 | 263,757 |
| | Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV) | 369,380 | 1,748,670 |
| | Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH) | 693 | - |
| | Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS) | 21,309 | 386,640 |
| | Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV) | 196,643 | 7 |
| | Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL) | 1,219,298 | 312,243 |
| | Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS) | 1,623,968 | 77 |
| | Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA) | 227,180 | 3,037 |
| | Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC) | 234,870 | 358,082 |
| | Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE) | 115,103 | 379,098 |
| | Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK) | 76,264 | - |
| | Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN) | 18,403 | - |
| | Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH) | 11,449 | - |
| | Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS) | 273,816 | 506,872 |
| | Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD) | 20,177 | 11 |
| | 세메스(주) | 54,327 | 561,368 |
| | Samsung Electronics GmbH (SEG) | 10,607 | - |
| | Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM) | 230,508 | 1,093 |
| | 기타 | 6,565,258 | 2,226,116 |
| | 계 | 17,667,480 | 11,278,703 |

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다.

(*3) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(*4) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 기업명(*1) | 채권 등 | 채무 등(*2) |
|----------------|---------------|---------|-----------|
| 관계기업 및 공동기업 | 삼성에스디에스(주) | 24,604 | 480,778 |
| | 삼성전기(주) | 1,716 | 87,444 |
| | 삼성SDI(주) | 117,507 | 44,271 |
| | (주)제일기획 | 14 | 302,171 |
| | 기타 | 87,493 | 112,288 |
| | 관계기업 및 공동기업 계 | 231,334 | 1,026,952 |
| 그 밖의 특수관계자 | 삼성물산(주) | 189,932 | 733,038 |
| | 기타 | 14,013 | 201,170 |
| | 그 밖의 특수관계자 계 | 203,945 | 934,208 |
| 기타(*3) | 삼성엔지니어링(주) | 340 | 877,530 |
| | (주)에스원 | 689 | 26,747 |
| | 기타 | 4,702 | 170,253 |
| | 기타 계 | 5,731 | 1,074,530 |

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른

동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

라. 회사는 당반기 및 전반기 중 종속기업에 대여한 내역은 없으며, 당반기 중 종속기업으로부터 21,990,000백만원을 차입하였습니다(전반기: 차입 내역 없음). 또한, 당반기 및 전반기 중 관계기업 및 공동기업에게 대여 및 차입한 내역은 없습니다.

마. 회사는 당반기 및 전반기 중 종속기업에 10,532백만원 및 58,364백만원을 출자하였으며, 당반기 및 전반기 중 종속기업으로부터 출자원금 107,217백만원 및 74,448백만원을 회수하였습니다. 또한, 당반기 및 전반기 중 관계기업 및 공동기업에 58,982백만원 및 882,125백만원을 출자하였으며, 당반기 중 관계기업 및 공동기업으로부터 518백만원을 회수하였습니다(전반기: 회수 내역 없음).

바. 회사가 당반기 및 전반기 중 특수관계자에게 지급 결의한 배당금은 825,850백만원 및 835,814백만원입니다. 또한, 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에게 당반기 및 전반기 중 지급 결의한 배당금은 64,116백만원 및 64,116백만원입니다. 당반기말 및 전반기말 현재 동 배당과 관련한 미지급금은 존재하지 않습니다.

사. 회사가 당반기 중 특수관계자와 체결한 신규 리스 이용 계약은 없으며(전반기: 20백만원), 당반기 및 전반기 중 특수관계자에게 지급한 리스료는 9,963백만원 및 23,515백만원입니다.

아. 회사는 보고기간종료일 현재 특수관계자의 채무에 대하여 채무보증을 제공하고 있습니다(주석 13 참조).

자. 회사가 당반기 및 전반기 중 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상을 위해 비용으로반영한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---------|-------|-------|
| 단기급여 | 5,154 | 4,694 |
| 퇴직급여 | 279 | 289 |
| 기타 장기급여 | 3,917 | 3,873 |

6. 배당에 관한 사항

당사는 제품 및 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 2018~2020년의 주주환원 정책에 따라 3년간 잉여 현금흐름(Free Cash Flow)의 50%를 주주환원 재원으로 활용하여, 매년 연간 총 9.6조원 수준의 정규 배당을 실시하고 잔여 재원 10.7조원을 특별 배당금 성격으로 2020년 기말 정규 배당에 더해 지급하였습니다. 또한, 당사는 2021~2023년의 주주환원 정책을 2021년 1월에 발표하였습니다. 이에 따라 향후 3년의 사업연도에도 잉여현금흐름의 50%를 재원으로 활용하되 정규 배당을 연간 총 9.8조원 수준으로 확대하고 잔여 재원이 발생하는 경우에는 추가로 환원할 계획입니다.

[주요 배당지표]

(단위 : 원, 백만원, %, 주)

| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|----------------|--------|------------|------------|------------|
| | | 제55기 반기 | 제54기 | 제53기 |
| 주당액면가액(원) | | 100 | 100 | 100 |
| (연결)당기순이익(백만원) | | 2,948,270 | 54,730,018 | 39,243,791 |
| (별도)당기순이익(백만원) | | 13,742,728 | 25,418,778 | 30,970,954 |
| (연결)주당순이익(원) | | 434 | 8,057 | 5,777 |
| 현금배당금총액(백만원) | | 4,904,308 | 9,809,438 | 9,809,438 |
| 주식배당금총액(백만원) | | - | - | - |
| (연결)현금배당성향(%) | | 166.3 | 17.9 | 25.0 |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | 1.0 | 2.5 | 1.8 |
| | 우선주 | 1.2 | 2.7 | 2.0 |
| 주식배당수익률(%) | 보통주 | - | - | - |
| | 우선주 | - | - | - |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | 722 | 1,444 | 1,444 |
| | 우선주 | 722 | 1,445 | 1,445 |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - | - |
| | 우선주 | - | - | - |

※ (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.

※ (연결)주당순이익은 보통주 기본주당이익입니다. 기본주당이익 산출근거는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주식' 중 '주당이익' 항목을 참고하시기 바랍니다.

※ 현금배당금총액의 자세한 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주식' 중 '연결이익잉여금' 항목을 참고하시기 바랍니다. 분기 배당금은 제 55기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원)이며

제54기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원), 3분기 2,452,154백만원(주당 361원)이며,

제53기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원), 3분기 2,452,154백만원(주당 361원)입니다.

[배당 이력]

(단위: 회, %)

| 연속 배당횟수 | | 평균 배당수익률 | |
|----------|------|----------|--------|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| 38 | 42 | 2.7 | 2.9 |

- ※ 연속 배당횟수는 당기 분기배당 및 최근사업연도 결산배당을 포함하고 있습니다.
- ※ 중간배당은 1999년(제31기)부터 연속 배당 시작하였고, 분기배당은 2017년(제49기)부터 연속 배당중이며, 결산배당은 1981년(제13기)부터 연속 배당 중입니다.
- ※ 평균 배당수익률은 보통주 배당수익률입니다. 우선주에 대한 최근 3년간 평균 배당수익률은 3.0%, 최근 5년간 평균 배당수익률은 3.3%입니다.
- ※ 최근 3년간은 2020년(제52기)부터 2022년(제54기)까지 기간이며, 최근 5년간은 2018년(제50기)부터 2022년(제54기)까지 기간입니다. 2023년(제55기) 반기 배당수익률은 상기 '주요 배당지표'를 참고하시기 바랍니다(보통주 1.0%, 우선주 1.2%).

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 공시대상기간 중 지분증권의 발행 실적이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 백만원, %)

| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급 (평가기관) | 만기일 | 상환 여부 | 주관회사 |
|--|--------|------|------------|------------|------|-----------------------------|------------|----------|--------------------|
| 삼성전자(주) | 회사채 | 공모 | 1997.10.02 | 131,280 | 7.7% | Aa2 (Moody's), AA- (S&P) | 2027.10.01 | 일부상환 | Goldman Sachs 등 |
| Harman International Industries, Inc | 회사채 | 공모 | 2015.05.11 | 525,120 | 4.2% | Baa1 (Moody's), A- (S&P) | 2025.05.15 | 미상환 | J.P. Morgan 등 |
| ㈜도우인시스 | 회사채 | 사모 | 2020.02.28 | 23,000 | 0.5% | - | 2025.02.28 | 미상환 | - |
| ㈜도우인시스 | 회사채 | 사모 | 2022.12.08 | 42,000 | 0.5% | - | 2027.12.08 | 미상환 | - |
| 세메스(주) | 기업어음증권 | 사모 | 2023.01.30 | 30,000 | 4.1% | A1 | 2023.02.28 | 상환 | - |
| 세메스(주) | 기업어음증권 | 사모 | 2023.01.30 | 50,000 | 4.0% | A1 | 2023.02.28 | 상환 | - |
| 세메스(주) | 기업어음증권 | 사모 | 2023.02.10 | 70,000 | 3.9% | A1 | 2023.03.10 | 상환 | - |
| 세메스(주) | 기업어음증권 | 사모 | 2023.02.28 | 1,000 | 4.0% | A1 | 2023.03.28 | 상환 | - |
| 세메스(주) | 기업어음증권 | 사모 | 2023.02.28 | 9,000 | 4.0% | A1 | 2023.03.28 | 상환 | - |
| 세메스(주) | 기업어음증권 | 사모 | 2023.03.10 | 70,000 | 4.1% | A1 | 2023.04.10 | 상환 | - |
| 세메스(주) | 기업어음증권 | 사모 | 2023.03.28 | 45,000 | 4.0% | A1 | 2023.04.28 | 상환 | - |
| 세메스(주) | 기업어음증권 | 사모 | 2023.04.10 | 70,000 | 4.0% | A1 | 2023.05.10 | 상환 | - |
| 세메스(주) | 기업어음증권 | 사모 | 2023.05.10 | 70,000 | 4.0% | A1 | 2023.06.12 | 상환 | - |
| 세메스(주) | 기업어음증권 | 사모 | 2023.06.12 | 50,000 | 4.1% | A1 | 2023.07.12 | 미상환 | - |
| 합 계 | - | - | - | 1,186,400 | - | - | - | - | - |

※ 기업어음증권의 평가기관은 나이스신용평가(주), 한국기업평가(주)입니다.

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
|-----------|----|--------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-------|--------|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 사모 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| | 합계 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | 50,000 |

다. 전자단기사채 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
|-----------|----|--------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----|-------|-------|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - |

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
|-----------|----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|---------|
| 미상환 잔액 | 공모 | 6,564 | 531,684 | 6,564 | 6,564 | 6,564 | - | - | 557,940 |
| | 사모 | - | 23,000 | - | - | 42,000 | - | - | 65,000 |
| | 합계 | 6,564 | 554,684 | 6,564 | 6,564 | 6,564 | - | - | 622,940 |

- 삼성전자주

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
|-----------|----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|--------|
| 미상환 잔액 | 공모 | 6,564 | 6,564 | 6,564 | 6,564 | 6,564 | - | - | 32,820 |
| | 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 합계 | 6,564 | 6,564 | 6,564 | 6,564 | 6,564 | - | - | 32,820 |

- Harman International Industries, Inc.와 그 종속기업

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
|-----------|----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|---------|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | 525,120 | - | - | - | - | - | 525,120 |
| | 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 합계 | - | 525,120 | - | - | - | - | - | 525,120 |

※ 미상환잔액은 기준일 환율을 적용하였습니다.

- (주)도우인시스

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
|-----------|----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|--------|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 사모 | - | 23,000 | - | - | 42,000 | - | - | 65,000 |
| | 합계 | - | 23,000 | - | - | 42,000 | - | - | 65,000 |

※ (주)도우인시스의 사모 회사채는 연결 내 내부거래 상계대상입니다.

마. 신종자본증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 15년이하 | 15년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
|-----------|----|-------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - |

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
|-----------|----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-------|-----|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(삼성전자)

(작성기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 백만원, %)

| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리 계약체결일 | 사채관리회사 |
|------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|---|
| US\$ 100,000,000 7.7% Debenture | 1997.10.02 | 2027.10.01 | 131,280 | 1997.10.02 | The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. |

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일)

| | | |
|--------------|------|--|
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 해당사항 없음 |
| | 이행현황 | 해당사항 없음 |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 순유형자산의 10% 미만 |
| | 이행현황 | 계약내용 이행 중 (해당 자산에 대해 담보권 설정 없음) |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | (보증인이) 자산의 전부 또는 대부분을 처분하려면 본채권에 대한 의무사항 승계 등 조건을 충족시켜야 함 |
| | 이행현황 | 계약내용 이행 중 (2023년 반기 중 처분 자산은 전체의 0.1%) |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | 해당사항 없음 |
| | 이행현황 | 해당사항 없음 |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 해당사항 없음 |

※ 발행액은 기준일 환율을 적용하였습니다.

※ 사채관리계약 체결일은 Fiscal Agency Agreement 체결일로서, The Bank of New York Mellon Trust Company,

N.A.는 Fiscal Agent의 지위에 있습니다.

※ 담보권설정 제한자산인 순유형자산은 생산설비 및 본사 보유주식입니다.

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근 재무제표의 작성기준일입니다.

※ 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일입니다.

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공시대상기간 중 공시대상인 자금조달 실적이 없습니다.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 재무제표 재작성

해당사항 없습니다.

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

(SSL, SSM 법인 매각)

중속기업 삼성디스플레이(주)는 2020년 8월 28일자 이사회 결의에 의거 2021년 4월 1일자로 수익성 악화에 따른 LCD 사업 축소를 위하여 Samsung Suzhou Module Co.,Ltd. (SSM) 지분 100%와 Samsung Suzhou LCD Co., Ltd. (SSL) 지분 60%를 TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)에게 매각하였습니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

(자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리)

해당사항 없습니다.

(중요한 소송사건)

당사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(채무보증 내역)

1) 국내채무보증

해당사항 없습니다.

2) 해외채무보증

(단위 : 천US\$, %)

| 법인명 (채무자) | 관계 | 채권자 | 내용 | 목적 | 보증시작일 | 보증종료일 | 채무보증한도 | | 채무금액 | | | 이자율 |
|--------------|------|-------------------|------|------|------------|------------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-------|
| | | | | | | | 기초 | 기말 | 기초 | 증감 | 기말 | |
| SEA | 계열회사 | BOA 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 1,278,000 | 1,278,000 | - | - | - | |
| SEM | 계열회사 | BBVA 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 715,000 | 715,000 | - | - | - | |
| SAMCOL | 계열회사 | Citibank 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 210,000 | 210,000 | - | - | - | |
| SEDA | 계열회사 | BRADESCO 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.10.01 | 2023.12.16 | 409,000 | 409,000 | - | - | - | |
| SECH | 계열회사 | Citibank 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2024.06.13 | 62,000 | 62,000 | - | - | - | |
| SEPR | 계열회사 | BBVA 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2024.06.13 | 150,000 | 150,000 | - | - | - | |
| SSA | 계열회사 | SCB 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 318,000 | 318,000 | - | - | - | |
| SEMAG | 계열회사 | SocGen 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.12.16 | 110,000 | 110,000 | - | - | - | |
| SETK | 계열회사 | BNP 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 777,000 | 777,000 | 239,395 | 25,052 | 264,447 | 48.2% |
| SETK-P | 계열회사 | BNP 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.12.16 | 130,000 | 130,000 | 25,649 | △12,206 | 13,443 | 29.6% |
| SECE | 계열회사 | Citibank | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2023.12.16 | 60,000 | 100,000 | - | - | - | |
| SEEG | 계열회사 | HSBC | 지급보증 | 운영자금 | 2023.06.14 | 2024.06.13 | 85,000 | 85,000 | - | - | - | |
| SEIN | 계열회사 | BNP 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 70,000 | 70,000 | - | - | - | |
| SJC | 계열회사 | Mizuho Bank 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.04.30 | 832,572 | 808,985 | - | - | - | |
| SEUC | 계열회사 | Credit Agricole 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 150,000 | 125,000 | - | - | - | |
| SEDAM | 계열회사 | Citibank 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 537,000 | 537,000 | 155,768 | △155,768 | - | |
| SECA | 계열회사 | BoA | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.11.08 | 70,000 | 70,000 | - | - | - | |
| SELA | 계열회사 | Citibank | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2023.12.16 | 60,000 | 60,000 | - | - | - | |
| SEEH | 계열회사 | HSBC 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.01 | 2024.06.13 | 888,400 | 888,400 | - | - | - | |
| SERK | 계열회사 | SMBC | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 45,000 | 20,000 | - | - | - | |
| SELV | 계열회사 | Citibank | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2023.12.16 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | |
| SEIL | 계열회사 | Citibank | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2023.12.16 | 15,600 | 15,600 | 9,664 | △9,664 | - | |
| SAPL | 계열회사 | BOA 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 404,000 | 404,000 | - | - | - | |
| SAVINA | 계열회사 | HSBC | 지급보증 | 운영자금 | 2023.06.14 | 2024.06.13 | 51,000 | 51,000 | - | - | - | |
| SCIC | 계열회사 | HSBC 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 300,000 | 300,000 | - | - | - | |
| SME | 계열회사 | SCB | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.11.08 | 110,000 | 110,000 | - | - | - | |
| SAMEX | 계열회사 | Citibank | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2023.12.16 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | |
| SEASA | 계열회사 | Citibank | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2023.12.16 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | |
| SSAP | 계열회사 | SCB | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.11.08 | 35,000 | 35,000 | - | - | - | |
| SEPM | 계열회사 | HSBC | 지급보증 | 운영자금 | 2023.06.14 | 2024.06.13 | 35,000 | 35,000 | - | - | - | |
| SESAR | 계열회사 | HSBC | 지급보증 | 운영자금 | 2023.06.14 | 2024.06.13 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | |
| SEUZ | 계열회사 | Citibank | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2023.12.16 | - | 10,000 | - | - | - | |

| 법인명 (채무자) | 관계 | 채권자 | 내용 | 목적 | 보증시작일 | 보증종료일 | 채무보증한도 | | 채무금액 | | | 이자 율 |
|---|------|-----------|------|--------|------------|------------|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------|
| | | | | | | | 기초 | 기말 | 기초 | 증감 | 기말 | |
| AdGear Technologies Inc. | 계열회사 | BOA | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.11.08 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | |
| Harman International Industries, Inc. | 계열회사 | JP Morgan | 지급보증 | 운영자금 | 2023.06.14 | 2024.06.13 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | |
| Harman International Japan Co., Ltd. | 계열회사 | MUFG | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.11.08 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | |
| Harman Holding Limited | 계열회사 | HSBC | 지급보증 | 운영자금 | 2023.06.14 | 2024.06.13 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | |
| Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda. | 계열회사 | SocGen | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.11.08 | 15,000 | 15,000 | - | - | - | |
| Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda. | 계열회사 | | | | | | | | | | | |
| Harman International Industries Limited | 계열회사 | HSBC | 지급보증 | 운영자금 | 2023.06.14 | 2024.06.13 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | |
| SDN | 계열회사 | SIEL | 지급보증 | 운영자금 등 | 2021.11.24 | 2026.02.19 | 603,960 | 609,199 | 513,366 | 4,453 | 517,819 | 8.1% |
| SAS | 계열회사 | Epcor | 지급보증 | 운영자금 등 | 2022.04.26 | 채무소멸시 | 340,000 | 340,000 | - | - | - | |
| DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED | 계열회사 | ANZ | 지급보증 | 시설자금 | 2022.11.10 | 2025.11.09 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 | 7.0% |
| 합 계 | | | | | | | 9,110,532 | 9,092,184 | 963,842 | △148,133 | 815,709 | |

※ 연결 기준입니다. SDN 건은 삼성디스플레이(주), SAS 건은 SEA, DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED 건은
 (주)도우인시스가 각각 채무보증인입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

또한 종속기업인 삼성디스플레이(주)의 경우 건별 채무보증금액이 100억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 상기 채무보증에 대하여 당사가 보증하는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을
 감안하여 수수료를 수취하고 있습니다. 당사는 2022년 중 US\$547천의 수수료를 청구하였으며, 2023년 중 수취하였습니다.
 한편, 삼성디스플레이(주)는 SDN에게 2022년 중 US\$3,080천 수수료를 청구하였으며, 2023년 중 수취하였습니다.

☞ 우발채무 등에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결채무제표 주석'을
 참조하시기 바랍니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

(감사보고서상 강조사항과 핵심감사사항)

| 구분 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---------|---------|--|
| 제55기 반기 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 제54기 | 해당사항 없음 | (연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 |
| 제53기 | 해당사항 없음 | (연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 |

나. 대손충당금(손실충당금) 설정 현황

(1) 계정과목별 대손충당금(손실충당금) 설정내역

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 계정과목 | 채권 금액 | 대손충당금 (손실충당금) | 대손충당 설정률 |
|--------------|--------|------------|------------------|----------|
| 제55기말 반기말 | 매출채권 | 36,493,987 | 389,845 | 1.1% |
| | 단기대여금 | 28,309 | 205 | 0.7% |
| | 미수금 | 5,908,097 | 85,325 | 1.4% |
| | 선급금 | 1,806,631 | 4,337 | 0.2% |
| | 장기매출채권 | 92,950 | - | 0.0% |
| | 장기미수금 | 1,328,612 | 527 | 0.0% |
| | 장기선급금 | 3,352,214 | 10,279 | 0.3% |
| | 장기대여금 | 242,488 | 1,265 | 0.5% |
| | 합 계 | 49,253,288 | 491,783 | 1.0% |
| 제54기말 | 매출채권 | 36,033,784 | 312,221 | 0.9% |
| | 단기대여금 | 22,403 | 215 | 1.0% |
| | 미수금 | 6,227,068 | 77,859 | 1.3% |
| | 선급금 | 1,741,031 | 3,965 | 0.2% |
| | 장기매출채권 | 204,248 | - | 0.0% |
| | 장기미수금 | 824,468 | 242 | 0.0% |
| | 장기선급금 | 2,382,711 | 10,969 | 0.5% |
| | 장기대여금 | 225,983 | 1,206 | 0.5% |
| | 합 계 | 47,661,696 | 406,677 | 0.9% |
| 제53기말 | 매출채권 | 41,024,295 | 310,880 | 0.8% |
| | 단기대여금 | 17,895 | 73 | 0.4% |
| | 미수금 | 4,569,772 | 72,515 | 1.6% |
| | 선급금 | 1,122,660 | 3,847 | 0.3% |
| | 장기매출채권 | 225,739 | - | 0.0% |
| | 장기미수금 | 1,002,404 | 290 | 0.0% |
| | 장기선급금 | 1,770,999 | 9,003 | 0.5% |
| | 장기대여금 | 199,577 | 917 | 0.5% |
| | 합 계 | 49,933,341 | 397,525 | 0.8% |

※ 연결 기준입니다.

※ 채권 금액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.

(2) 대손충당금(손실충당금) 변동 현황

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 제55기 반기 | 제54기 | 제53기 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 기초 대손충당금(손실충당금) | 406,677 | 397,525 | 388,943 |
| 순대손처리액(① - ② + ③) | △9,944 | 16,658 | 25,926 |
| ① 대손처리액(상각채권액) 등 | 11,150 | 9,711 | 22,400 |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | △21,094 | 6,947 | 3,526 |
| 대손상각비 계상(환입)액 | 75,162 | 25,810 | 34,508 |
| 기말 대손충당금(손실충당금) | 491,783 | 406,677 | 397,525 |

※ 연결 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

(3) 매출채권 관련 대손충당금(손실충당금) 설정 방침

(설정방침)

- 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 고려하는 기대신용손실모형을 적용하여 대손충당금(손실충당금) 설정

(대손경험률 및 대손예상액 산정근거)

- 대손경험률: 과거 3개년 평균 채권잔액에 대한 신용손실 경험 등을 근거로 연령별 대손경험률을 산정하여 설정
- 대손예상액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등과 채무자의 신용정보 및 미래 전망을 고려하여 합리적인 대손예상액 설정

[대손 설정 기준]

| 상 황 | 설정률 |
|------|-------|
| 분 쟁 | 25 % |
| 수금의뢰 | 50 % |
| 소 송 | 75 % |
| 부 도 | 100 % |

(대손 처리 기준)

매출채권 등에 대해 다음과 같은 사유 발생 시 실대손처리

- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수 불능이 객관적으로 입증된 경우
- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우
- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우
- 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우
- 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우

(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과 1년 이하 | 1년 초과 3년 이하 | 3년 초과 | 계 |
|------|------------|----------------|----------------|---------|------------|
| 금 액 | 36,424,023 | 38,095 | 11,103 | 113,716 | 36,586,937 |
| 구성비율 | 99.6% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 100.0% |

※ 연결 기준입니다.

※ 매출채권 잔액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.

다. 재고자산 현황

(1) 사업부문별 재고자산의 보유 현황

(단위 : 백만원, %, 회)

| 부문 | 계정과목 | 제55기 반기말 | 제54기말 | 제53기말 |
|---|-----------|------------|------------|------------|
| DX 부문 | 제품 및 상품 | 6,782,945 | 7,712,885 | 8,894,766 |
| | 반제품 및 재공품 | 827,801 | 1,013,606 | 799,218 |
| | 원재료 및 저장품 | 10,486,278 | 10,520,293 | 11,384,887 |
| | 미착품 | 1,082,985 | 943,322 | 1,299,624 |
| | 소 계 | 19,180,009 | 20,190,106 | 22,378,495 |
| DS 부문 | 제품 및 상품 | 7,086,418 | 6,601,087 | 2,490,097 |
| | 반제품 및 재공품 | 22,817,806 | 18,756,104 | 11,809,911 |
| | 원재료 및 저장품 | 3,721,497 | 3,639,061 | 2,118,424 |
| | 미착품 | 63,911 | 61,352 | 36,685 |
| | 소 계 | 33,689,632 | 29,057,604 | 16,455,117 |
| SDC | 제품 및 상품 | 269,909 | 811,518 | 294,777 |
| | 반제품 및 재공품 | 579,484 | 542,473 | 874,229 |
| | 원재료 및 저장품 | 782,353 | 788,521 | 810,325 |
| | 미착품 | 18,204 | 23,626 | 48,253 |
| | 소 계 | 1,649,950 | 2,166,138 | 2,027,584 |
| Harman | 제품 및 상품 | 834,063 | 799,919 | 533,008 |
| | 반제품 및 재공품 | 114,404 | 119,890 | 105,271 |
| | 원재료 및 저장품 | 858,119 | 913,085 | 736,109 |
| | 미착품 | 358,022 | 269,715 | 321,128 |
| | 소 계 | 2,164,608 | 2,102,609 | 1,695,516 |
| 총 계 | 제품 및 상품 | 15,086,419 | 16,032,226 | 12,280,579 |
| | 반제품 및 재공품 | 24,175,740 | 20,077,519 | 13,473,618 |
| | 원재료 및 저장품 | 14,979,482 | 14,979,280 | 14,184,841 |
| | 미착품 | 1,263,157 | 1,098,841 | 1,445,366 |
| | 소 계 | 55,504,798 | 52,187,866 | 41,384,404 |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] | | 12.0% | 11.6% | 9.7% |
| 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고 + 기말재고)÷2}] | | 3.3회 | 4.1회 | 4.5회 |

※ 당사 연결 기준입니다.

※ 제53기는 2021년 12월의 조직변경을 반영하여 재작성하였습니다.

(2) 재고자산의 실사내역 등

(실사내역)

- 5월말 및 11월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시
- 재고조사 시점과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당 기간 전체 재고의 입출고 내역을 확인하여 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인

(실사방법)

- 사내보관재고: 폐창식 전수조사 실시
 - ※ 반도체 및 DP 라인 재고 및 자동화창고보관 SVC자재는 표본조사
- 사외보관재고: 제3자 보관재고, 운송 중인 재고는 전수로 물품보유확인서 또는 장치보관확인서 징구 및 표본조사 병행
- 외부감사인은 당사의 기말 재고실사에 입회·확인하고 일부 항목은 표본 추출하여 그 실재성 및 완전성 확인

※ 당사는 2023년 5월 29일부터 6월 5일까지 상반기 재고실사를 실시하였으며, 종속기업들도 동일 기준(5월말)으로 상반기 재고실사를 진행하였습니다.

(장기체화재고 등 내역)

재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우 저가법 등을 사용하여 재고자산의 장부금액을 결정하고 있으며, 2023년 반기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

| 계정과목 | 취득원가 | 보유금액 | 평가충당금 | 기말잔액 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 제품 및 상품 | 16,909,611 | 16,909,611 | △1,823,192 | 15,086,419 |
| 반제품 및 재공품 | 27,960,258 | 27,960,258 | △3,784,518 | 24,175,740 |
| 원재료 및 저장품 | 16,304,014 | 16,304,014 | △1,324,533 | 14,979,481 |
| 미착품 | 1,263,158 | 1,263,158 | - | 1,263,158 |
| 합 계 | 62,437,041 | 62,437,041 | △6,932,243 | 55,504,798 |

※ 당사 연결 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

라. 수주계약 현황

2023년 반기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

마. 공정가치평가 내역

(1) 금융상품의 공정가치평가 방법

[금융자산]

(분류)

당사는 금융자산을 공정가치 측정 금융자산 (기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식), 상각후원가 측정 금융자산으로 분류합니다.

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 분류합니다.

공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 당사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.

단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

(측정)

당사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.

내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

1) 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거합니다. 당사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.

① 상각후원가 측정 금융자산

사업모형이 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 경우, 금융자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.

② 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

사업모형이 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 모두를 위해 보유하는 것이고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 경우, 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 표시하고 손상차손은 '기타비용'으로 표시합니다.

③ 당기손익-공정가치 측정 금융자산

상기 상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

2) 지분상품

당사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로, 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않고 제거되는 시점에 자본에 누적된 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익을 이익잉여금으로 대체합니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 당사가 배당을 받을 권리가 확정된 때에 손익계산서에 '기타수익'으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

(손상)

당사는 미래전망정보에 근거하여, 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 당사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

(인식과 제거)

금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금 흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다. 당사가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 당사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다. 해당 금융부채는 재무상태표에 '차입금'으로 분류하고 있습니다.

(금융상품의 상계)

금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다.

[금융부채]

(분류 및 측정)

모든 금융부채는 다음을 제외하고는 후속적으로 상각후원가로 측정되도록 분류합니다.

- 1) 당기손익-공정가치 측정 금융부채
과생상품부채를 포함한 이러한 부채는 후속적으로 공정가치로 측정합니다.
- 2) 금융자산의 양도가 제거 조건을 충족하지 못하거나 지속적 관여 접근법이 적용되는 경우에 생기는 금융부채
이러한 금융부채는 상기 금융자산의 내용을 적용하여 측정합니다.
- 3) 금융보증계약
최초 인식 시 공정가치로 측정되며, 이후에 이러한 계약의 발행자는 해당 계약을 후속적으로 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
 - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
 - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
- 4) 시장이자율보다 낮은 이자율로 대출하기로 한 약정
최초 인식 후에 이러한 약정의 발행자는 후속적으로 해당 약정을 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
 - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
 - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
- 5) 기준서 제1103호를 적용하는 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가
이러한 조건부 대가는 후속적으로 당기손익-공정가치로 측정합니다.

(제거)

금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다. 소멸하거나 제3자에게 양도한 금융부채의 장부금액과 지급한 대가(양도한 비현금자산이나 부담한 부채를 포함)의 차액은 당기손익으로 인식합니다.

[파생상품]

당사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피와 해외사업장에 대한 순투자에 대한 위험회피금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

당사는 재고자산의 가격 변동 위험 등을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 현금흐름위험회피 대상으로 지정되어 적용요건을 충족하는 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 인식하고, 비효과적인 부분은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 인식하고 있습니다.

(2) 범주별 금융상품 내역

1) 제55기 반기말

(단위 : 백만원)

| 금융자산 | 상각후원가 측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타금융자산(*) | 계 |
|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------|-------------|
| 현금및현금성자산 | 79,919,775 | - | - | - | 79,919,775 |
| 단기금융상품 | 17,180,130 | - | - | - | 17,180,130 |
| 단기상각후원가금융자산 | - | - | - | - | - |
| 단기당기손익-공정가치금융자산 | - | - | 25,310 | - | 25,310 |
| 매출채권 | 36,104,142 | - | - | - | 36,104,142 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | 10,308,125 | - | - | 10,308,125 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | - | 1,573,457 | - | 1,573,457 |
| 기타 | 10,472,509 | - | 448,027 | 76,182 | 10,996,718 |
| 계 | 143,676,556 | 10,308,125 | 2,046,794 | 76,182 | 156,107,657 |

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

| 금융부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 기타금융부채(*) | 계 |
|---------|------------------|----------------------|-----------|------------|
| 매입채무 | 11,744,005 | - | - | 11,744,005 |
| 단기차입금 | 473,326 | - | 3,084,034 | 3,557,360 |
| 미지급금 | 13,443,741 | - | - | 13,443,741 |
| 유동성장기부채 | 299,158 | - | 964,683 | 1,263,841 |
| 사채 | 554,625 | - | - | 554,625 |
| 장기차입금 | 33,756 | - | 3,729,494 | 3,763,250 |
| 장기미지급금 | 4,890,945 | - | - | 4,890,945 |
| 기타 | 10,421,841 | 297,833 | 24,105 | 10,743,779 |
| 계 | 41,861,397 | 297,833 | 7,802,316 | 49,961,546 |

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

2) 제54기말

(단위 : 백만원)

| 금융자산 | 상각후원가 측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타금융자산(*) | 계 |
|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------|-------------|
| 현금및현금성자산 | 49,680,710 | - | - | - | 49,680,710 |
| 단기금융상품 | 65,102,886 | - | - | - | 65,102,886 |
| 단기상각후원가금융자산 | 414,610 | - | - | - | 414,610 |
| 단기당기손익-공정가치금융자산 | - | - | 29,080 | - | 29,080 |
| 매출채권 | 35,721,563 | - | - | - | 35,721,563 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | 11,397,012 | - | - | 11,397,012 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | - | 1,405,468 | - | 1,405,468 |
| 기타 | 9,945,209 | - | 334,263 | 61,404 | 10,340,876 |
| 계 | 160,864,978 | 11,397,012 | 1,768,811 | 61,404 | 174,092,205 |

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

| 금융부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 기타금융부채(*) | 계 |
|---------|------------------|----------------------|-----------|------------|
| 매입채무 | 10,644,686 | - | - | 10,644,686 |
| 단기차입금 | 1,577,958 | - | 3,569,357 | 5,147,315 |
| 미지급금 | 16,328,237 | - | - | 16,328,237 |
| 유동성장기부채 | 215,143 | - | 874,019 | 1,089,162 |
| 사채 | 536,093 | - | - | 536,093 |
| 장기차입금 | 33,846 | - | 3,526,826 | 3,560,672 |
| 장기미지급금 | 2,289,236 | - | - | 2,289,236 |
| 기타 | 12,047,761 | 334,415 | 27,353 | 12,409,529 |
| 계 | 43,672,960 | 334,415 | 7,997,555 | 52,004,930 |

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(3) 금융상품의 공정가치 측정내역

(금융상품의 장부금액과 공정가치)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 제55기 반기말 | | 제54기말 | |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 |
| 금융자산: | | | | |
| 현금및현금성자산 | 79,919,775 | (*1) | 49,680,710 | (*1) |
| 단기금융상품 | 17,180,130 | (*1) | 65,102,886 | (*1) |
| 단기상각후원가금융자산 | - | (*1) | 414,610 | (*1) |
| 단기당기손익-공정가치금융자산 | 25,310 | 25,310 | 29,080 | 29,080 |
| 매출채권 | 36,104,142 | (*1) | 35,721,563 | (*1) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 10,308,125 | 10,308,125 | 11,397,012 | 11,397,012 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,573,457 | 1,573,457 | 1,405,468 | 1,405,468 |
| 기타(*2) | 10,996,718 | 524,209 | 10,340,876 | 395,667 |
| 계 | 156,107,657 | | 174,092,205 | |
| 금융부채: | | | | |
| 매입채무 | 11,744,005 | (*1) | 10,644,686 | (*1) |
| 단기차입금 | 3,557,360 | (*1) | 5,147,315 | (*1) |
| 미지급금 | 13,443,741 | (*1) | 16,328,237 | (*1) |
| 유동성장기부채 | 1,263,841 | 6,995 | 1,089,162 | 6,580 |
| - 유동성장기차입금 | 1,257,371 | (*1)(*3) | 1,082,934 | (*1)(*3) |
| - 유동성사채 | 6,470 | 6,995 | 6,228 | 6,580 |
| 사채 | 554,625 | 537,772 | 536,093 | 521,129 |
| 장기차입금 | 3,763,250 | (*1)(*3) | 3,560,672 | (*1)(*3) |
| 장기미지급금 | 4,890,945 | (*1) | 2,289,236 | (*1) |
| 기타(*2) | 10,743,779 | 321,938 | 12,409,529 | 361,768 |
| 계 | 49,961,546 | | 52,004,930 | |

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융자산 10,472,509백만원(전기말: 9,945,209백만원)

및 금융부채 10,421,841백만원(전기말: 12,047,761백만원)은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*3) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 제55기 반기말 | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|------------|
| | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 계 |
| 금융자산: | | | | |
| 단기당기손익-공정가치금융자산 | - | 25,310 | - | 25,310 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 8,152,616 | - | 2,155,509 | 10,308,125 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 430,889 | - | 1,142,568 | 1,573,457 |
| 기타 | - | 329,602 | 194,607 | 524,209 |
| 금융부채: | | | | |
| 유동성사채 | - | 6,995 | - | 6,995 |
| 사채 | - | 537,772 | - | 537,772 |
| 기타 | - | 314,534 | 7,404 | 321,938 |

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 제54기말 | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|------------|
| | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 계 |
| 금융자산: | | | | |
| 단기당기손익-공정가치금융자산 | - | 29,080 | - | 29,080 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 9,207,295 | - | 2,189,717 | 11,397,012 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 314,449 | - | 1,091,019 | 1,405,468 |
| 기타 | - | 373,176 | 22,491 | 395,667 |
| 금융부채: | | | | |
| 유동성사채 | - | 6,580 | - | 6,580 |
| 사채 | - | 521,129 | - | 521,129 |
| 기타 | - | 354,364 | 7,404 | 361,768 |

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- '수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- '수준 2': 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)
- '수준 3': 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

당사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(가치평가기법 및 투입변수)

당사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

2023년 반기말 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 공정가치 | 가치평가기법 | '수준 3' 투입변수 | 투입변수 범위 |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| 기타포괄손익-공정가치금융자산: | | | | |
| 삼성벤처투자(주) | 32,236 | 현금흐름할인법 | 영구성장률 | 1.0% |
| | | | 가중평균자본비용 | 18.1% |
| (주)미코세라믹스 | 30,714 | 현금흐름할인법 등 | 영구성장률 | 0.0% |
| | | | 가중평균자본비용 | 14.3% |
| TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT) | 1,221,371 | 현금흐름할인법 | 영구성장률 | 0.0% |
| | | | 가중평균자본비용 | 11.3% |
| China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Ltd (CSOSDT) | 204,245 | 현금흐름할인법 | 영구성장률 | 0.0% |
| | | | 가중평균자본비용 | 11.3% |
| 기타: | | | | |
| 지분 콜옵션 | 169,957 | 이항모형 | 무위험 이자율 | 3.7% |
| | | | 가격 변동성 | 55.0% |
| 지분 풋옵션 | 24,650 | 이항모형 | 무위험 이자율 | 4.2%~5.4%, 2.2% |
| | | | 가격 변동성 | 25.1%, 28.8% |

[△는 부(-)의 값임]

(수준 3'에 해당하는 금융상품의 변동내역)

(단위 : 백만원)

| 금융자산 | 제55기 반기 | 제54기 반기 |
|-----------------|------------|-----------|
| 기초 | 3,303,227 | 3,430,214 |
| 매입 | 120,995 | 108,009 |
| 매도 | △3,216,022 | △160,465 |
| 당기손익으로 인식된 손익 | 248,191 | 91,008 |
| 기타포괄손익으로 인식된 손익 | 3,124,848 | 183,532 |
| 기타 | △88,555 | 1,180 |
| 반기말 | 3,492,684 | 3,653,478 |

[△는 부(-)의 값임]

(단위 : 백만원)

| 금융부채 | 제55기 반기 | 제54기 반기 |
|---------------|---------|---------|
| 기초 | 7,404 | 5,438 |
| 당기손익으로 인식된 손익 | - | - |
| 기타 | - | - |
| 반기말 | 7,404 | 5,438 |

[△는 부(-)의 값임]

(‘수준 3’으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석)

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

2023년 반기말 현재 ‘수준 3’으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(자본은 법인세효과 반영전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 유리한 변동 효과 | | 불리한 변동 효과 | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 당기손익 | 자본 | 당기손익 | 자본 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | 113,344 | - | △81,509 |
| 기타 | 60,223 | - | △51,595 | - |

- ※ 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(△1.0%~1.0%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다. [△는 부(-)의 값임]
- ※ 기타는 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산 가격(20%) 및 가격 변동성(5% 또는 10%)을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

(4) 유형자산 재평가내역

당사는 공시대상기간 중 유형자산 재평가내역이 없습니다.

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 감사의견 등

삼정회계법인은 당사의 제55기 반기 검토를 수행하였으며, 검토 결과 재무제표에 한국채택 국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.

안진회계법인은 당사의 제53기, 제54기 감사를 수행하였으며, 감사의견은 모두 적정입니다.

한편, 당사의 감사 대상 종속기업은 공시대상기간 중 모두 적정의견을 받았습니다.

| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---------------------|--------|---------|---------|--|
| 제55기 반기 (당반기) | 삼정회계법인 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 제54기 (전기) | 안진회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 | (연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 |
| 제53기 (전전기) | 안진회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 | (연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 |

※ 감사의견은 별도·연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

[감사용역 체결 현황]

(단위 : 백만원, 시간)

| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
|---------------------|--------|--|--------|--------|--------|--------|
| | | | 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| 제55기 반기 (당반기) | 삼정회계법인 | 분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 별도 및 연결 내부회계관리제도 감사 | 7,800 | 85,700 | 3,119 | 34,264 |
| 제54기 (전기) | 안진회계법인 | 분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 감사 | 8,424 | 78,000 | 8,424 | 78,146 |
| 제53기 (전전기) | 안진회계법인 | 분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 감사 | 7,900 | 76,741 | 7,900 | 76,999 |

(제55기 반기 일정)

| 구 분 | | 일 정 |
|----------|------|-------------------------|
| 제55기 1분기 | 사전검토 | 2023.03.06 ~ 2023.03.29 |
| | 본검토 | 2023.04.07 ~ 2023.05.12 |
| 제55기 2분기 | 사전검토 | 2023.06.05 ~ 2023.06.30 |
| | 본검토 | 2023.07.07 ~ 2023.08.11 |

※ 별도·연결 재무제표 검토에 대한 일정입니다.

[비감사용역 체결 현황]

(단위 : 백만원)

| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|------------------|---------|------------------|-----------------|------|--------|
| 제55기 반기 (당반기) | 2017.02 | 세무자문업무(해외중속기업) | 2023.01~2023.06 | 33 | 삼정회계법인 |
| | 2018.09 | 세무자문업무(해외중속기업) | 2023.01~2023.06 | 27 | |
| | 2019.05 | 세무자문업무(해외중속기업) | 2023.01~2023.06 | - | |
| | 2023.05 | ESG인증업무(국내중속기업) | 2023.05~2023.06 | 25 | |
| 제54기 (전기) | - | - | - | - | - |
| 제53기 (전전기) | 2017.06 | E-Discovery 자문업무 | 2021.01~2021.12 | 394 | 안진회계법인 |

[내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과]

| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|----|------------|--|------|---|
| 1 | 2023.01.27 | <ul style="list-style-type: none"> 감사위원회: 위원 3명 회사: 감사팀장 감사인: 업무수행이사 외 4명 | 대면회의 | <ul style="list-style-type: none"> 핵심감사사항 등 중점 감사사항 내부회계관리제도 감사 진행 상황 기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항 |
| 2 | 2023.04.25 | <ul style="list-style-type: none"> 감사위원회: 위원 3명 회사: 감사팀장 감사인: 업무수행이사 외 5명 | 대면회의 | <ul style="list-style-type: none"> 분기 검토 경과 보고 연간 회계감사 계획 기타 감사계획단계 필수 커뮤니케이션 사항 |
| 3 | 2023.07.25 | <ul style="list-style-type: none"> 감사위원회: 위원 3명 회사: 감사팀장 감사인: 업무수행이사 외 5명 | 대면회의 | <ul style="list-style-type: none"> 연간 회계감사 진행 상황 핵심 감사사항 선정 계획 내부회계관리제도 감사 진행 상황 분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항 |

[조정협의내용 및 재무제표 불일치정보]

해당사항 없습니다.

나. 회계감사인의 변경

당사는 지정감사인이었던 안진회계법인(Deloitte)과의 계약이 2022년말 기간 만료로 종료됨에 따라 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조 제1항 및 제3항, 제4항에 의거하여 감사위원회가 선정한 삼정회계법인(KPMG)을 2023년부터 2025년까지 3개년의 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 이에 따라 당분기부터 당사 회계감사인은 안진회계법인(Deloitte)에서 삼정회계법인(KPMG)으로 변경되었습니다.

제55기 반기말(당반기말) 현재 당사의 종속기업은 233개이며, 당반기 중 국내 종속기업 가운데 삼성디스플레이(주) 등 8개는 안진회계법인(Deloitte)에서 삼정회계법인(KPMG)로, 에스유머티리얼스(주)는 한영회계법인(E&Y)에서 삼정회계법인(KPMG)로 회계감사인을 변경하였습니다. 또한, 해외 종속기업 중 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 30개사는 Deloitte에서 KPMG로, Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS) 등 65개사는 PwC에서 KPMG로, Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN) 등 6개사는 E&Y에서 KPMG로, Laos Samsung Electronics Sole Co.,Ltd (LSE)는 KPP Co., Ltd에서 KPMG로 회계감사인을 변경하였습니다. 또한 전기 중 설립된 종속기업 Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ), DOWOOLINSYSVINA COMPANY LIMITED가 KPMG를, 당반기 중 설립된 SVIC 62호 신기술투자조합이 삼정회계법인(KPMG)를 회계감사인으로 신규 선임하였습니다.

해당 종속기업들은 당사(지배회사)의 회계감사인 변경에 따라 연결감사 업무 효율화 등을 위해 회계감사인을 변경 및 신규 선임하였으며, 종속기업의 회계감사인 변경 및 신규 선임은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

[제55기 종속기업의 회계감사인 변경 현황]

| 종속기업명 | 변경전 회계감사인 | 변경후 회계감사인 |
|---|------------------|--------------|
| 삼성디스플레이(주) | 안진회계법인(Deloitte) | 삼정회계법인(KPMG) |
| 삼성전자서비스(주) | 안진회계법인(Deloitte) | 삼정회계법인(KPMG) |
| 삼성전자서비스씨에스(주) | 안진회계법인(Deloitte) | 삼정회계법인(KPMG) |
| 삼성전자판매(주) | 안진회계법인(Deloitte) | 삼정회계법인(KPMG) |
| 삼성전자로지텍(주) | 안진회계법인(Deloitte) | 삼정회계법인(KPMG) |
| (주)도우인시스 | 안진회계법인(Deloitte) | 삼정회계법인(KPMG) |
| 지에프(주) | 안진회계법인(Deloitte) | 삼정회계법인(KPMG) |
| (주)미래로시스템 | 안진회계법인(Deloitte) | 삼정회계법인(KPMG) |
| 에스유머티리얼스(주) | 한영회계법인(E&Y) | 삼정회계법인(KPMG) |
| Samsung Electronics America, Inc. (SEA) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Semiconductor, Inc. (SSI) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX) | Deloitte | KPMG |
| Samsung International, Inc. (SII) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG) | Deloitte | KPMG |

| | | |
|--|----------|------|
| Samsung Electronics GmbH (SEG) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU) | Deloitte | KPMG |
| Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV) | Deloitte | KPMG |
| Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC) | Deloitte | KPMG |
| Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET) | Deloitte | KPMG |
| Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Electronics Turkiye (SETK) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA) | Deloitte | KPMG |
| Samsung Japan Corporation (SJC) | PwC | KPMG |
| Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ) | PwC | KPMG |
| Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA) | PwC | KPMG |
| Samsung Research America, Inc (SRA) | PwC | KPMG |
| SAMSUNG NEXT LLC (SNX) | PwC | KPMG |
| SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics France S.A.S (SEF) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Romania LLC (SEROM) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG) | PwC | KPMG |
| SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB) | PwC | KPMG |

| | | |
|---|-----|------|
| Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR) | PwC | KPMG |
| Samsung Nanoradio Design Center (SNDC) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE) | PwC | KPMG |
| Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC) | PwC | KPMG |
| Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC) | PwC | KPMG |
| Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ) | PwC | KPMG |
| PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN) | PwC | KPMG |
| PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN) | PwC | KPMG |
| Samsung Display Noida Private Limited (SDN) | PwC | KPMG |
| Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD) | PwC | KPMG |
| Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK) | PwC | KPMG |
| Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC) | PwC | KPMG |
| Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E) | PwC | KPMG |
| Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou) | PwC | KPMG |
| Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS) | PwC | KPMG |
| SEMES (XIAN) Co., Ltd. | PwC | KPMG |
| Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC) | PwC | KPMG |
| Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing) | PwC | KPMG |
| Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS) | PwC | KPMG |
| Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP) | PwC | KPMG |
| Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Chile Limitada (SECH) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC) | PwC | KPMG |
| Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE) | PwC | KPMG |
| Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA) | E&Y | KPMG |

| | | |
|--|--------------|------|
| Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN) | E&Y | KPMG |
| Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP) | E&Y | KPMG |
| Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO) | E&Y | KPMG |
| Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. (SELV) | E&Y | KPMG |
| Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC) | E&Y | KPMG |
| Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE) | KPP Co., Ltd | KPMG |

제54기말(전기) 현재 당사의 종속기업은 232개이며, 종속기업 Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)이 PwC를, SVIC 52호 신기술투자조합과 SVIC 55호 신기술투자조합, SVIC 56호 신기술투자조합, SVIC 57호 신기술투자조합은 삼정회계법인(KPMG)을 회계감사인으로 신규 선임하였습니다.

또한, 제53기말(전전기) 현재 당사의 종속기업은 228개이며, 종속기업 Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)와 Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd.(SETK-P)가 Deloitte를, 지에프(주)가 안진회계법인(Deloitte)을 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 또한 종속기업 Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)이 Deloitte에서 E&Y로 감사인을 변경하였으며, 도우인시스(주)가 삼덕회계법인에서 안진회계법인(Deloitte)으로 변경하였습니다. 종속기업의 회계감사인 신규 선임및 변경은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

2. 내부통제에 관한 사항

[회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견]

| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 지적사항 |
|------------------|--------|--|---------|
| 제55기 반기 (당반기) | 삼정회계법인 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 제54기 (전기) | 안진회계법인 | 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. | 해당사항 없음 |
| 제53기 (전전기) | 안진회계법인 | 회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. | 해당사항 없음 |

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 사내이사 5인(한중희, 경계현, 노태문, 박학규, 이정배)과 사외이사 6인(김한조, 김선욱, 김중훈, 김준성, 허은녕, 유명희), 총 11인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 김한조 사외이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사 후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 지속가능경영위원회 등 6개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일)

| 구분 | 구성 | 소속 이사명 | 의장·위원장 | 주요 역할 |
|-----------------|---------------------|--|---------------|---|
| 이사회 | 사내이사 5명, 사외이사 6명 | 한중희, 경계현, 노태문, 박학규, 이정배, 김한조, 김선욱, 김중훈, 김준성, 허은녕, 유명희 | 김한조 (사외이사) | · 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 · 경영진의 업무집행 감독 |
| 경영위원회 | 사내이사 5명 | 한중희, 경계현, 노태문, 박학규, 이정배 | 한중희 (사내이사) | · 경영 일반, 재무 관련 사항 및 이사회가 위임한 사안을 심의·결의 |
| 감사위원회 | 사외이사 3명 | 김한조, 김선욱, 김중훈 | 김한조 (사외이사) | · 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사 |
| 사외이사 후보추천위원회 | 사외이사 3명 | 김선욱, 허은녕, 유명희 | - | · 사외이사 후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천 |
| 내부거래위원회 | 사외이사 3명 | 김선욱, 김한조, 김중훈 | 김선욱 (사외이사) | · 자율적인 공정거래 준수를 통해 회사 경영의 투명성을 제고 |
| 보상위원회 | 사외이사 3명 | 김중훈, 김한조, 김준성 | 김중훈 (사외이사) | · 이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보 |
| 지속가능경영위원회 | 사외이사 6명 | 김한조, 김선욱, 김중훈, 김준성, 허은녕, 유명희 | 김한조 (사외이사) | · 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 영역에서 지속가능경영을 추진하고 주주가치를 제고 |

※ 2023년 1월 27일 김중훈 사외이사가 보상위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2023년 3월 15일 주주총회를 통해 한중희 사내이사가 재선임되었습니다.

※ 2023년 3월 15일 이사회를 통해 허은녕, 유명희 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.

※ 사외이사 후보추천위원회 위원장은 차기 위원회 개최시 선임 예정입니다.

※ 2023년 4월 27일 한중희 사내이사가 경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.

(사외이사 및 그 변동 현황)

(단위 : 명)

| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
|-------|--------|-----------|----|------|
| | | 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| 11 | 6 | - | - | - |

나. 중요의결사항 등

| 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 이사의 성명 | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 사내이사 | | | | | 사외이사 | | | | | |
| | | | 한중희 (출석률 :100%) | 경계현 (출석률 :50%) | 노태문 (출석률 :75%) | 박학규 (출석률 :100%) | 이정배 (출석률 :100%) | 김한조 (출석률 :100%) | 김선욱 (출석률 :100%) | 김중훈 (출석률 :100%) | 김준성 (출석률 :100%) | 허은녕 (출석률 :100%) | 유명희 (출석률 :100%) |
| | | | 찬 반 여부 | | | | | | | | | | |
| '23.01.31 (1차) | 1. 2022년(제54기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 삼성디스플레이(주)와 임차계약 체결의 건 * 보고사항 ① 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 ② 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| '23.02.14 (2차) | 1. 삼성디스플레이(주)와 자금 거래의 건 2. 제54기 정기주주총회 소집결정의 건 3. 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 □ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 특수관계인과의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 제1호: 제54기(2022.1.1~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 □ 제2호: 사내이사 한중희 선임의 건 □ 제3호: 이사 보수한도 승인의 건 4. 2023년 사회공헌 매칭기금 운영계획 승인의 건 5. 학교법인 충남성성학원 후원금 출연의 건 6. 생산물 배상책임보험 가입의 건 7. 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| '23.03.15 (3차) | 1. 대표이사 선정의 건 2. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 3. 이사 보수 책정의 건 4. 삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| '23.04.27 (4차) | 1. 2023년 1분기 보고서 및 분기배당 승인의 건 2. 스마트공장 지원사업 추진의 건 3. DS부문 우수협력사 인센티브 기금 출연의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |

* 2023년 3월 15일 주주총회를 통해 한중희 사내이사가 재선임되었습니다.

다. 이사회내의 위원회

(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일)

| 위원회명 | 구성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|-----------|---------|--------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 경영위원회 | 사내이사 5명 | 한종희(위원장), 경계현, 노태문, 박학규, 이정배 | 하단 기재내용 참조 | · 한종희 사내이사 위원장 선임('23.04.27) |
| 내부거래위원회 | 사외이사 3명 | 김선욱(위원장), 김한조, 김종훈 | 하단 기재내용 참조 | · 김선욱 사외이사 위원장 선임('21.04.27) |
| 보상위원회 | 사외이사 3명 | 김종훈(위원장), 김한조, 김준성 | 하단 기재내용 참조 | · 김종훈 사외이사 위원장 선임('23.01.27) |
| 지속가능경영위원회 | 사외이사 6명 | 김한조(위원장), 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희 | 하단 기재내용 참조 | · 김한조 사외이사 위원장 선임('22.04.28) |

※ 감사위원회와 사외이사 후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

※ 2023년 1월 27일 김종훈 사외이사가 보상위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2023년 4월 27일 한종희 사내이사가 경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.

(경영위원회)

- 설치목적: 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행해야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사항에 관하여 심의하고 결의한다.
경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.
- 권한사항: 경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함

1. 경영일반에 관한 사항

- 1) 회사의 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략
- 2) 주요 경영전략
- 3) 사업계획·사업구조 조정 추진
- 4) 해외 지점·법인의 설치, 이전 및 철수
- 5) 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진
- 6) 국내외 주요 자회사 매입 또는 매각(자기자본 0.1% 이상인 경우에 한함)
- 7) 기타 주요 경영현황
- 8) 지점, 사업장의 설치 및 이전, 폐지
- 9) 지배인의 선임 또는 해임
- 10) 최근사업연도 생산액의 5%이상 생산중단, 폐업
- 11) 자기자본 0.5%이상 기술도입계약 체결 및 기술이전, 제휴
- 12) 자기자본 0.5%이상 신물질, 신기술 관련 특허권 취득, 양수, 양도계약
- 13) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 제품수거, 파기
- 14) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일계약 체결
- 15) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일판매 대행 또는 공급계약 체결 또는 해지
- 16) 조직의 운영에 관한 기본원칙
- 17) 급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙의 결정 및 변경
- 18) 명의개서 대리인의 선임, 해임 및 변경
- 19) 주주명부폐쇄 및 기준일 설정에 관한 사항
- 20) 업무추진 및 경영상 필요한 세칙의 제정

2. 재무 등에 관한 사항

- 1) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 타법인 출자, 처분
- 2) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 해외 직접투자
- 3) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 신규 담보제공 또는 신규 채무보증(기간 연장은 제외함)
 - 담보: 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함
 - 채무보증: 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외
- 4) 자기자본 0.1%이상 5%미만 상당 신규 차입계약 체결 (기간 연장은 제외함)
- 5) 내부거래의 승인
내부거래라 함은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 30억원 이상 50억원 미만 상당의 자금(가지급금, 대여금 등), 유가증권(주식, 회사채 등) 또는 자산(부동산, 무체재산권 등)을 제공하거나 거래하는 행위(기존 계약을 중대한 변경 없이 갱신하는 경우는 제외함)
- 6) 사채발행
- 7) 자기자본 0.1% 이상의 부동산 취득 및 처분. 단, 제3자와의 거래로 인한 경우에 한함
- 8) 주요 시설투자 등 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

3. 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회의 권한에 속하는 사항 중 이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과 다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항

(내부거래위원회)

- 설치목적: 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함
- 권한사항
 - 내부거래 보고 청취권: 계열사와의 내부거래 현황에 대해 보고받을 수 있음
 - ※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 50억원 이상 대규모 내부거래는 사전 심의하고 그 이외의 거래에 있어서도 중요한 거래라고 판단하는 거래는 심의 및 의결할 수 있음
 - 내부거래 직권조사 명령권
 - 내부거래 시정조치 건의권

(보상위원회)

- 설치목적: 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함
- 권한사항
 - 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도
 - 등기이사에 대한 보상체계
 - 기타 이사회에서 위임한 사항

(지속가능경영위원회)

- 설치목적: 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 영역에서 지속가능경영을 추진하고 주주가치를 제고하기 위함
- 권한사항
 - 회사의 지속가능경영과 관련된 사항
 - 1) 주요 지속가능경영 전략 및 정책
 - 2) 환경, 사회, 지배구조 등 지속가능경영 관련 주요 활동 보고
 - 3) 지속가능경영보고서 발간 계획
 - 주주가치 제고와 관련된 사항
 - 1) 주주환원 정책 사전 심의
 - 2) 주주권익 관련 주요 사안 보고
 - 기타 지속가능경영 및 주주가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항으로 위원회가 부의가 필요하다고 판단한 사항
 - 위원회 산하 연구회, 협의회 등 조직의 설치, 구성, 운영과 관련된 사항
 - 기타 이사회에서 위임한 사항

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

(경영위원회)

| 위원회명 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 이사의 성명 | | | | |
|-----------|-----------------|---------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 한종희 (출석률: 100%) | 경계현 (출석률: 100%) | 노대문 (출석률: 67%) | 박학규 (출석률: 100%) | 이정배 (출석률: 100%) |
| | | | | 찬 반 여 부 | | | | |
| 경영위원회 | '23.01.19 | 1. 라이선스 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 2. 임원 성과 인센티브 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| | '23.04.27 | 1. 경영위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 2. 해외법인 설립의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 3. 해외법인(중국) 청산의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 4. 해외법인(유럽) 청산의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| '23.05.15 | 1. 메모리 투자의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| | 2. 해외법인 지분인수의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |

(내부거래위원회)

| 위원회명 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 이사의 성명 | | |
|-------------|-------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 김선욱 (출석률: 100%) | 김한조 (출석률: 100%) | 김종훈 (출석률: 100%) |
| | | | | 찬 반 여 부 | | |
| 내부거래 위원회 | '23.01.27 | 1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 ① 삼성디스플레이(주)와 임차계약 체결의 건 | - | - | - | - |
| | | 2. 2022년 4분기 내부거래 현황 보고 | - | - | - | - |
| | '23.02.10 | 1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 ① 생산물 배상책임 보험 가입의 건 ② 삼성디스플레이(주)와 자금 거래의 건 | - | - | - | - |
| '23.04.25 | 1. 2023년 1분기 내부거래 현황 보고 | - | - | - | - | |

(보상위원회)

| 위원회명 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 이사의 성명 | | |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 김종훈 (출석률: 100%) | 김한조 (출석률: 100%) | 김준성 (출석률: 100%) |
| | | | | 찬 반 여 부 | | |
| 보상 위원회 | '23.01.27 | 1. 보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 2. 2023년 사내이사 개별 고정연봉 심의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 3. 2023년 이사보수 한도 심의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |

※ 2023년 1월 27일 김종훈 사외이사가 보상위원회 위원장으로 선임되었습니다.

(지속가능경영위원회)

| 위원회명 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 이사의 성명 | | | | | |
|---------------|-----------|--|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 김한조 (출석률 :100%) | 김선욱 (출석률 :100%) | 김종훈 (출석률 :100%) | 김준성 (출석률 :100%) | 허은녕 (출석률 :100%) | 유명희 (출석률 :100%) |
| | | | | 찬 반 여부 | | | | | |
| 지속가능 경영위원회 | '23.01.31 | 1. IR 동향 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - |
| | '23.04.27 | 1. IR 동향 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2. ESG 정보공개 요구 현황 및 대응(안) 3. EU 공급망실사지침 대응 현황 | - | - | - | - | - | - | - |

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사 후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 전자 산업에 대한 이해와 재무, 법률, IT, ESG, 금융, 투자, 환경, 에너지, 국제통상 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령·정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.

각 이사의 주요경력에는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일)

| 직명 | 성명 | 임기 (연임여부/횟수) | 선임배경 | 추천인 | 활동분야 (담당업무) | 회사와의 거래 | 최대주주 또는 주요주주와의 관 계 |
|----------------|-----|----------------------------|---|-----------------|-------------------|------------|--------------------------|
| 사내이사 (대표이사) | 한종희 | '20.03~'26.03 (1회) | 디스플레이 제품 분야의 최고 개발 전문가로서 당사가 글로벌 TV 1위를 지속 달성하는데 주도적인 역할을 하였으며, DX부문장으로서 탁월한 경영역량을 발휘하여 경쟁이 심화되고 있는 시장을 주도하여 리더십을 더욱 공고히 하는데 기여할 것으로 판단 | 이사회 | DX부문 경영전반 총괄 | 해당사항 없음 | 특수관계인 |
| 사내이사 (대표이사) | 경계현 | '22.03~'25.03 (해당사항 없음) | DS부문장으로서, DRAM, Flash, Solution 메모리 3대 제품을 모두 섭렵한 기술력을 보유하고 있으며, 소통과 공감을 통해 조직의 근본적인 체질을 개선하고 세계 반도체시장 1위 지위를 굳건히 강화 하는데 가장 적임자로 판단 | 이사회 | DS부문 경영전반 총괄 | 해당사항 없음 | 특수관계인 |
| 사내이사 | 노태문 | '22.03~'25.03 (해당사항 없음) | MX사업부의 주요 핵심보직을 두루 경험하였고, '21년에는 갤럭시 S21, 폴더블 등을 통해 매출 104조원을 달성하여 '14년 이후 최고 실적을 창출 하였음. 또한, 사업운영 개선을 통해 수익성을 강화 하고 사업체질을 공고화하는 등 기업체질 변화에 크게 기여할 것으로 판단 | 이사회 | MX사업부 경영전반 총괄 | 해당사항 없음 | 특수관계인 |
| 사내이사 | 박학규 | '22.03~'25.03 (해당사항 없음) | 주요 사업부들의 경영관리 보직들을 거치며 경영 리스크 관리역량을 입증하였고, 폭넓은 안목으로 사업 혁신을 성공적으로 이끌었음. 현재는 DX부문 경영 지원실장으로서, 사업 성과창출을 위해 핵심 스텝 기 능과 진단 및 감사역할까지 담당하고 있으며 전사 경영 이슈를 조율하는데 크게 기여 | 이사회 | 전사 경영전반에 대한 업무 | 해당사항 없음 | 특수관계인 |
| 사내이사 | 이정배 | '22.03~'25.03 (해당사항 없음) | 메모리사업부의 개발, 품질, 전략 등 주요 보직들을 두루 경험한 전문가로 제품 경쟁력 확보를 통해 DRAM 30년 연속 매출 1위를 달성하였고, '21년에는 세계 반도 체 매출 1위를 재탈환하는 등 DS부문 사업에 대한 풍부한 경험과 뛰어난 역량을 보유한 것으로 판단 | 이사회 | 메모리사업부 경영전반 총괄 | 해당사항 없음 | 특수관계인 |
| 사외이사 | 김한조 | '19.03~'25.03 (1회) | 은행장을 역임한 재무전문가이자 전문 경영인이며 현재 사회공헌 재단을 맡고 있어 경영 전반에 대한 조언 외에 재무 전문성 및 상생·나눔경영 역량을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단 | 사외이사 후보추천위원회 | 전사 경영전반에 대한 업무 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 사외이사 | 김선욱 | '18.03~'24.03 (1회) | 법학전문대학원 교수와 법제처장을 역임한 법률전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단 과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단 | 사외이사 후보추천위원회 | 전사 경영전반에 대한 업무 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

| | | | | | | | |
|------|-----|----------------------------|---|-----------------|-------------------|------------|---------|
| 사외이사 | 김종훈 | '18.03~'24.03 (1회) | IT 분야의 통신 전문가이자 경영인으로서 다양한 경험을 바탕으로 경영을 감독할 수 있는 역량과 함께 IT산업에 대한 통찰력과 광범위한 네트워크를 통한 글로벌 경영 감각으로 이사회에 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단 | 사외이사 후보추천위원회 | 전사 경영전반에 대한 업무 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 사외이사 | 김준성 | '22.03~'25.03 (해당사항 없음) | 글로벌 선진 금융시장에서 주식시장 분석과 투자 경험을 쌓은 국제경제 및 투자 전문가로서, 해외시장과 외국 투자자들의 입장을 잘 대변하고, 글로벌 네트워킹을 활용하여 트렌디한 투자 전략 수립에 큰 기여를 할 것으로 판단 | 사외이사 후보추천위원회 | 전사 경영전반에 대한 업무 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 사외이사 | 허은영 | '22.11~'25.11 (해당사항 없음) | 에너지·자원·환경 관련 경제 및 정책 분야 전문가이자 세계적으로도 손꼽히는 석학으로 당사 해당 분야의 경영 강화에 기여하는 한편, 이사회에 실질적인 조언을 해줄 것으로 판단 | 사외이사 후보추천위원회 | 전사 경영전반에 대한 업무 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 사외이사 | 유명희 | '22.11~'25.11 (해당사항 없음) | 통상교섭본부장을 역임한 국제 통상전문가로 외교적 소통 노하우, 글로벌 인적 네트워크를 바탕으로 회사의 주요 투자자 및 이해 관계자들과 긴밀히 소통할 수 있을 것으로 판단 | 사외이사 후보추천위원회 | 전사 경영전반에 대한 업무 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는 「상법」 제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

※ 2023년 3월 15일 주주총회를 통해 한중희 사내이사가 재선임되었습니다.

※ 2023년 3월 15일 이사회를 통해 한중희 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

(2) 사외이사 후보추천위원회

주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사 후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 작성기준일(2023년 6월 30일) 현재 위원회는 사외이사 3인(김선욱, 허은녕, 유명희)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다(「상법」 제542조의 8 제4항의 규정 충족).

| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 이사의 성명 | | |
|-----------------|------|------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 김선욱 (출석률: -) | 허은녕 (출석률: -) | 유명희 (출석률: -) |
| | | | | 찬반여부 | | |
| 사외이사 후보추천위원회 | - | - | - | - | - | - |

※ 2023년 3월 15일 이사회를 통해 허은녕, 유명희 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.

(3) 사외이사의 전문성

1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일)

| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수 / 지원업무 담당기간) | 주요 활동내역 |
|------------|--------|---|---|
| 이사회 사무국 | 4 | <ul style="list-style-type: none"> 상무 1명(18년 5개월 / 7개월), 직원(Principal Professional) 2명 (평균 18년 5개월 / 평균 5년 2개월) 직원(Professional) 1명 (6년 5개월 / 4개월) | <ul style="list-style-type: none"> 주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원 사외이사 교육 및 직무수행 지원 이사 후보에 대한 데이터베이스 구축 각 이사에게 안건에 관련된 정보 제공 회의 진행을 위한 실무 지원 이사회 및 위원회의 회의내용 기록 |

2) 경영이해도 제고를 위한 사외이사 내부교육 실시 현황

① 국내외 경영현장 점검

| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 사외이사 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|
| 2022.04.28 | MX사업부 | 김한조, 김선욱, 박병국, 김종훈, 김준성 | 해당사항 없음 | · 사업부 경영현황 파악 및 현장 답사 |
| 2022.07.28 | Memory 사업부 | 김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성 | 해당사항 없음 | · 사업부 경영현황 파악 및 현장 답사 |
| 2022.11.30 | Foundry 사업부 | 김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희 | 해당사항 없음 | · 사업부 경영현황 파악 및 현장 답사 |
| 2023.01.31 | Samsung Research, 디자인경영센터 | 김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희 | 해당사항 없음 | · 사업조직 현황 파악 및 현장 답사 |
| 2023.04.27 | 생활가전 사업부 | 김한조, 김선욱, 김종훈, 허은녕, 유명희 | 업무 출장 | · 사업부 경영현황 파악 및 현장 답사 |

② 신임 사외이사 오리엔테이션

| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 사외이사 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
|------------|--------|----------|---------|-------------------------|
| 2022.04.27 | 경영지원실 | 김준성 | 해당사항 없음 | · 이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항 |
| 2022.11.28 | 경영지원실 | 허은녕, 유명희 | 해당사항 없음 | · 이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항 |

※ 교육 참석 대상은 신임 사외이사입니다.

③ 사외이사 공통 교육

| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 사외이사 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
|------------|---------------------|---------------------------------|---------|---|
| 2023.03.15 | 인력개발원 | 김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희 | 해당사항 없음 | · 회사 역사, 경영철학 등 회사경영 관련 주요사항 |
| 2023.04.25 | 글로벌마케팅실 글로벌EHS센터 | 김한조, 김선욱, 김종훈, 허은녕, 유명희 | 업무 출장 | · 마케팅 활동의 이해 · EHS 관리 현황 및 환경 경영의 이해 |

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 2023년 반기말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 동 위원회 위원 중 재무전문가는 김한조 위원이며, 관련 법령의 경력 요건을 충족하고 있습니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일)

| 성명 | 사외이사 여부 | 경력 | 회계·재무전문가 관련 | | |
|-----|------------|---|-------------|-------------------------------------|--|
| | | | 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 |
| 김한조 | 예 | <ul style="list-style-type: none"> · 하나금융나눔재단 이사장('22~현재) · 하나금융공익재단 이사장('19~'21) · 하나금융나눔재단 이사장('15~'19) · (주)하나금융지주 부회장('15~'16) · (주)한국외환은행 은행장('14~'15) · 외환캐피탈(주) 사장('13~'14) | 예 | 4호 유형 (금융기관·정부· 증권유관기관 등 경력자) | <ul style="list-style-type: none"> · (주)하나금융지주 부회장('15~'16) · (주)한국외환은행 은행장('14~'15) · 외환캐피탈(주) 사장('13~'14) · (주)한국외환은행 - 기업사업그룹장('12~'13) - 지점장('99~'02, '04~'05) |
| 김선욱 | 예 | <ul style="list-style-type: none"> · 이화여대 법학전문대학원 명예교수('18~현재) · 이화여대 법학과(법학전문대학원) 교수('95~'18) · 이화여대 총장('10~'14) · 법제처 처장('05~'07) | - | - | - |
| 김종훈 | 예 | <ul style="list-style-type: none"> · Kiswe Mobile 공동 창업자 및 회장('13~현재) · Alcatel-Lucent 최고전략책임자(CSO)('11~'13) · Alcatel-Lucent Bell 연구소 사장('05~'13) · University of Maryland 전기 및 컴퓨터공학과 교수 겸 기계공학과 교수('02~'13) · Lucent Technologies 사장('98~'01) · Yurie Systems 창업자, 회장 및 CEO('92~'98) | - | - | - |

※ 전문가 유형은 기업공시서식 작성기준 및 「상법 시행령」 제37조 제2항에 따른 회계·재무전문가 유형입니다.

· 4호 유형: 금융기관·정부·증권유관기관 등에서 회계·재무 관련 업무 또는 이에 대한 감독업무를 수행한 경력이 모두 5년 이상인지 여부

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회 위원 전원은 이사회의 추천을 받아 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성되어 있으며, 재무전문가(김한조 위원)와 법률전문가(김선욱 위원)를 선임하고 있습니다. 동 위원회 위원은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요 주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한, 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련 법령의 요건을 충족하고 있습니다.

| 선출기준의 주요내용 | 선출기준의 충족 여부 | 관련 법령 등 |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 3명의 이사로 구성 | 충족(3명) | 「상법」 제415조의2 제2항, 당사 감사위원회 규정 제2조 |
| 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 | 충족(전원 사외이사) | |
| 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 | 충족(김한조 위원) | 「상법」 제542조의11 제2항, 당사 감사위원회 규정 제3조 |
| 감사위원회의 대표는 사외이사 | 충족(김한조 위원) | |
| 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) | 충족(해당사항 없음) | 「상법」 제542조의11 제3항 |

(기준일 : 2023년 06월 30일)

| 성명 | 임기 (연임여부/횟수) | 선임배경 | 추천인 | 회사와의 관계 | 최대주주 또는 주요주주와의 관계 | 타회사 경력 현황 |
|-----|-----------------------|---|-----------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| 김한조 | '19.03~'25.03 (1회) | 재무전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단 | 사외이사 후보추천위원회 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | - |
| 김선욱 | '18.03~'24.03 (1회) | 법률전문가로서 전문성과 행정, 재무, 대외협력 등 조직 운영에 대한 경험을 바탕으로 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단 | 사외이사 후보추천위원회 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | - |
| 김중훈 | '18.03~'24.03 (1회) | 글로벌 경영인으로서 여러 기업을 투명하고 공정하게 운영한 경험을 바탕으로 독립적이고 객관적인 시각에서 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단 | 사외이사 후보추천위원회 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | Kiswe Mobile 회장 (13년~현재) |

※ 회사와의 관계, 최대주주 또는 주요주주와의 관계는 「상법」 제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

감사위원회는 회계감사를 위해서 재무제표 등 회계 관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계 정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한, 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사회부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용합니다.

다. 감사위원회 주요 활동 내역

| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 이사의 성명 | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 김한조 (출석률: 100%) | 김선욱 (출석률: 100%) | 김종훈 (출석률: 100%) |
| | | | | 찬 반 여부 | | |
| 감사 위원회 | '23.01.27 | 1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - |
| | | 2. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | - | - | - | - |
| | | 3. 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션 | - | - | - | - |
| | | 4. 2022년(제54기) 재무제표 및 영업보고서 보고의 건 | - | - | - | - |
| | | 5. 2022년 4분기 비감사업무 수행 검토 보고의 건 | - | - | - | - |
| | | 6. 2022년 4분기 대외후원금 현황 보고의 건 | - | - | - | - |
| | | 7. 2022년 감사실적 보고의 건 | - | - | - | - |
| | '23.02.10 | 1. 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 심의의 건 | - | - | - | - |
| | | 2. 2022년 내부감시장치 가동현황 보고의 건 | - | - | - | - |
| | '23.04.25 | 1. 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션 | - | - | - | - |
| | | 2. 2022년 외부감사 이행 평가 보고의 건 | - | - | - | - |
| | | 3. 2023년 1분기 보고서 보고의 건 | - | - | - | - |
| | | 4. 2023년 1분기 비감사업무 수행 검토 보고의 건 | - | - | - | - |
| | | 5. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고의 건 | - | - | - | - |
| 6. 2023년 1분기 대외 후원금 현황 보고의 건 | | - | - | - | - | |
| 7. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가계획 보고의 건 | | - | - | - | - | |

라. 감사위원회 교육 실시 계획

당사는 내부회계관리제도 업무지침에 따라 연 1회 이상 감사위원의 전문성 확보 등을 위해 외부전문가, 재경팀 및 감사팀이 주체가 되어 내부통제 변화사항, 내부회계관리제도 등에 대하여 별도의 교육을 실시하고 있습니다.

마. 감사위원회 교육 실시 현황

| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 감사위원 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
|------------|---------------|-------------------|---------|------------|
| 2021.07.27 | 외부전문가 | 박재완 김선욱 김한조 | 해당사항 없음 | · 내부회계관리제도 |
| 2022.05.25 | 재경팀, 외부전문가 | 김종훈 | 해당사항 없음 | · 입문교육 |
| 2022.07.26 | 외부전문가 | 김한조 김선욱 김종훈 | 해당사항 없음 | · 내부회계관리제도 |

바. 감사위원회 지원조직 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일)

| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|----------------|--------|--|--------------------------|
| 감사팀 | 4 | 부사장 1명(3년 6개월), 직원(Principal Professional) 1명(5년 6개월), 직원(Senior Professional) 2명(평균 2년 11개월) | · 감사위원회 지원 |
| 내부회계 평가지원그룹 | 5 | 상무 1명(4년 6개월), 변호사 1명(2년 3개월) 직원(Principal Professional) 1명(1개월), 직원(Senior Professional) 2명(평균 1년 6개월) | · 내부회계관리제도 운영실태 평가 지원 |

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.

사. 준법지원인에 관한 사항

(기준일 : 2023년 06월 30일)

| 구 분 | 내 용 | |
|-------------------|------------------------------------|---|
| 1. 인적사항 및 주요경력 | 성명 | 박정호 |
| | 출생연월 | 1971.09 |
| | 성별 | 남 |
| | 담당업무 | 삼성전자(주) Compliance팀장('22.12~현재) |
| | 주요경력 | '04.05 : 삼성전자(주) 경영지원실 인사팀 변호사 '14.12 : 삼성전자(주) 법무실 법무팀 상무대우 '18.03 : 삼성전자(주) DS부문 법무지원팀 상무대우 '20.01 : 삼성전자(주) Compliance팀 상무대우 '22.12 : 삼성전자(주) Compliance팀장 부사장대우 |
| 학력 | 서울대 법학(학사) 미시간주립대 대학원 노사관계학(석사) | |
| 2. 이사회 결의일 | 2022.12.20 | |
| 3. 결격요건 | 해당사항 없음 | |
| 4. 기타 | 해당사항 없음 | |

※ 준법지원인은 관련 법령 「상법」 제542조의13 제5항의 요건(변호사 자격)을 충족하고 있습니다.

아. 준법지원인 등의 주요 활동 내역 및 그 처리 결과

당사는 국내외 사업장에서 정기·비정기적으로 준법 점검 활동을 수행하고 있으며, 점검 결과를 바탕으로 개선이 필요한 사안은 경영 활동에 반영하여 회사 및 임직원이제반 법규를 준수할 수 있도록 효과적인 준법 지원 활동을 하고 있습니다.

| 점검일시 | 점검 내용 | 점검 분야 | 점검 및 처리 결과 | |
|---------|---------|----------------------|---|-------------------|
| '23.1분기 | '23.01 | 국내 품질조직 준법 점검 | · 전반적으로 양호하며, 일부 개선 필요사항은 사내 정책 등에 따라 보완함 | |
| | '23.03 | 국내외 제3자 생산 거래선 준법 점검 | | 영업비밀, 기술유출 등 |
| '23.2분기 | '23.05. | 해외법인 자율 준법 점검 | | 기술유출, 제조물책임 등 |
| | | 고객사 영업비밀 침해 리스크 점검 | | 컴플라이언스 프로그램 운영 현황 |
| | '23.06. | 해외 판매법인 준법 점검 | | 영업비밀 |
| | | 국내외 제3자 생산 거래선 준법 점검 | | 공정거래, 영업비밀 등 |
| | | | 기술유출, 제조물책임 등 | |

※ 점검시기는 각 분기별 종료월 기준입니다.

※ 각 점검은 일부 점검대상 조직을 선정하여 실시하였습니다.

자. 준법지원인 지원 조직 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일)

| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---------------|--------|--|------------------|
| Compliance팀 등 | 66 | 상무 2명 (평균 7년 7개월), 직원(Principal Professional/Engineer) 17명(평균 8년 5개월), 변호사 12명(평균 5년 3개월), 직원(Senior Professional) 33명(평균 5년), 직원(Professional) 2명(평균 1년 10개월) | · 준법지원인 주요 활동 지원 |

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 2023년 반기말 현재 집중투표제와 서면투표제를 도입하지 않았으며, 2023년 3월 15일 제54기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다. 당사 이사회는 2020년 1월 30일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 「상법」 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 당사는 2020년 3월 18일에 개최한 제51기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다. 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일)

| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---------|-------|-------|-----------------------|
| 도입여부 | 배제 | 미도입 | 도입 |
| 실시여부 | - | - | 제54기('22년도) 정기주주총회 |

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 의결권 현황

2023년 반기말 현재 당사의 발행주식총수는 보통주 5,969,782,550주, 우선주 822,886,700주입니다. 이 중 우선주는 의결권이 없으며, 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식(597,454,635주)을 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 5,372,327,915주입니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 주)

| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|--|--------|---------------|--|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 5,969,782,550 | - |
| | 우선주 | 822,886,700 | - |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | - | - |
| | 우선주 | - | - |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
| | 우선주 | 822,886,700 | - |
| 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) | 보통주 | 596,959,200 | 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 제한 (삼성생명보험주) 508,157,148주, 삼성화재해상보험주 88,802,052주) |
| | 보통주 | 495,435 | 「보험업법」에 의한 제한 (삼성생명보험주) 특별계정 일부) |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
| | 우선주 | - | - |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 5,372,327,915 | - |
| | 우선주 | - | - |

※ 단, '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에서, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의해 제한된 주식(596,959,200주) 중 일부는 임원의 선임 또는 해임 및 정관변경 등과 관련하여 의결권 행사가 가능합니다.

다. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2023년 06월 30일)

| 주총일자 | 안 건 | 결의내용 |
|--------------------------------|--|--|
| 제54기 정기주주총회 (2023.03.15) | 1. 제54기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 2. 사내이사 한종희 선임의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 가결 가결 |
| 제54기 임시주주총회 (2022.11.03) | 1. 사외이사 선임의 건 1-1호: 사외이사 허은녕 선임의 건 1-2호: 사외이사 유명희 선임의 건 | 가결 가결 |
| 제53기 정기주주총회 (2022.03.16) | 1. 제53기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 2-1호: 사외이사 선임의 건 2-1-1호: 사외이사 김한조 선임의 건 2-1-2호: 사외이사 한화진 선임의 건 2-1-3호: 사외이사 김준성 선임의 건 2-2호: 사내이사 선임의 건 2-2-1호: 사내이사 경계현 선임의 건 2-2-2호: 사내이사 노태문 선임의 건 2-2-3호: 사내이사 박학규 선임의 건 2-2-4호: 사내이사 이정배 선임의 건 2-3호: 감사위원회 위원 선임의 건 2-3-1호: 감사위원회 위원 김한조 선임의 건 2-3-2호: 감사위원회 위원 김종훈 선임의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 |
| 제52기 정기주주총회 (2021.03.17) | 1. 제52기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 2-1호: 사외이사 선임의 건 2-1-1호: 사외이사 박병국 선임의 건 2-1-2호: 사외이사 김종훈 선임의 건 2-2호: 사내이사 선임의 건 2-2-1호: 사내이사 김기남 선임의 건 2-2-2호: 사내이사 김현석 선임의 건 2-2-3호: 사내이사 고동진 선임의 건 3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김선욱 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 |

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 주, %)

| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
|-----------------|-------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|------|
| | | | 기 초 | | 기 말 | | |
| | | | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |
| 삼성생명보험(주) | 최대주주 본인 | 보통주 | 508,157,148 | 8.51 | 508,157,148 | 8.51 | - |
| 삼성생명보험(주) | 최대주주 본인 | 우선주 | 43,950 | 0.01 | 43,950 | 0.01 | - |
| 삼성생명보험(주)(특별계정) | 최대주주 본인 | 보통주 | 10,246,942 | 0.17 | 9,561,743 | 0.17 | 장내매매 |
| 삼성생명보험(주)(특별계정) | 최대주주 본인 | 우선주 | 403,278 | 0.05 | 514,646 | 0.06 | 장내매매 |
| 삼성물산(주) | 계열회사 | 보통주 | 298,818,100 | 5.01 | 298,818,100 | 5.01 | - |
| 삼성화재해상보험(주) | 계열회사 | 보통주 | 88,802,052 | 1.49 | 88,802,052 | 1.49 | - |
| 삼성복지재단 | 출연 재단 | 보통주 | 4,484,150 | 0.08 | 4,484,150 | 0.08 | - |
| 삼성문화재단 | 출연 재단 | 보통주 | 1,880,750 | 0.03 | 1,880,750 | 0.03 | - |
| 홍라희 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 117,302,806 | 1.96 | 117,302,806 | 1.96 | - |
| 홍라희 | 최대주주의 특수관계인 | 우선주 | 206,633 | 0.03 | 206,633 | 0.03 | - |
| 이재용 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 97,414,196 | 1.63 | 97,414,196 | 1.63 | - |
| 이재용 | 최대주주의 특수관계인 | 우선주 | 137,757 | 0.02 | 137,757 | 0.02 | - |
| 이부진 | 계열회사 임원 | 보통주 | 55,394,044 | 0.93 | 55,394,044 | 0.93 | - |
| 이부진 | 계열회사 임원 | 우선주 | 137,755 | 0.02 | 137,755 | 0.02 | - |
| 이서현 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 55,394,044 | 0.93 | 55,394,044 | 0.93 | - |
| 이서현 | 최대주주의 특수관계인 | 우선주 | 137,755 | 0.02 | 137,755 | 0.02 | - |
| 한중희 | 계열회사 임원 | 보통주 | 15,000 | 0.00 | 15,000 | 0.00 | - |
| 경계현 | 계열회사 임원 | 보통주 | 18,050 | 0.00 | 21,050 | 0.00 | 장내매매 |
| 노태문 | 계열회사 임원 | 보통주 | 13,000 | 0.00 | 13,000 | 0.00 | - |
| 박학규 | 계열회사 임원 | 보통주 | 22,500 | 0.00 | 22,500 | 0.00 | - |
| 이정배 | 계열회사 임원 | 보통주 | 15,000 | 0.00 | 15,000 | 0.00 | - |
| 김한조 | 계열회사 임원 | 보통주 | 3,655 | 0.00 | 3,655 | 0.00 | - |
| 계 | | 보통주 | 1,237,981,437 | 20.74 | 1,237,299,238 | 20.73 | - |
| | | 우선주 | 1,067,128 | 0.13 | 1,178,496 | 0.14 | - |

※ 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다. (단, 보통주 일부는 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한되어 있습니다.)

※ 2023년 6월 30일 기준입니다. 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)의 '임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참고하십시오.

2. 최대주주 관련 사항

가. 최대주주의 개요

(1) 최대주주(삼성생명보험주)의 기본정보

1) 법적·상업적 명칭: 삼성생명보험주 (Samsung Life Insurance Co., Ltd.)

2) 설립일자: 1957년 4월 24일

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)

전화번호: 1588-3114

홈페이지: www.samsunglife.com

4) 최대주주(삼성생명보험주)의 대표이사·업무집행자·최대주주

(단위 : 명, %)

| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | | 업무집행자 (업무집행조합원) | | 최대주주 (최대출자자) | |
|---------|-------------|-----------------|-------|--------------------|-------|-----------------|-------|
| | | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| 삼성생명보험주 | 96,766 | 전영목 | 0.00 | - | - | 삼성물산주 | 19.34 |
| | | - | - | - | - | - | - |

※ 2023년 06월 30일 보통주 기준입니다.

5) 최대주주(삼성생명보험주)의 대표이사·업무집행자·최대주주의 변동내역

(단위 : %)

| 변동일 | 대표이사 (대표조합원) | | 업무집행자 (업무집행조합원) | | 최대주주 (최대출자자) | |
|------------|-----------------|-------|--------------------|-------|-----------------|-------|
| | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| 2021.03.16 | 전영목 | 0.00 | - | - | - | - |
| 2021.04.29 | - | - | - | - | 이건희 | - |
| 2021.04.29 | - | - | - | - | 삼성물산주 | 19.34 |

※ 2021년 4월 29일 최대주주(2020년 10월 25일 별세)가 소유하던 주식에 대한 상속으로 인하여 최대주주가 삼성물산주로 변경되었습니다.

(2) 최대주주(삼성생명보험주)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

| 구 분 | |
|--------------|-------------|
| 법인 또는 단체의 명칭 | 삼성생명보험주 |
| 자산총계 | 300,600,003 |
| 부채총계 | 257,035,867 |
| 자본총계 | 43,564,136 |
| 매출액 | 16,273,105 |
| 영업이익 | 1,200,113 |
| 당기순이익 | 1,038,875 |

※ 재무현황은 2023년 06월 30일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

(3) 최대주주(삼성생명보험주)의 사업현황 등

삼성생명보험주(주)은 인보험 및 그와 관련된 재보험계약 등을 주요 영업목적으로 하는 생명보험회사로, 보험업법 및 기타 법령 등에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

또한, 주요 종속기업인 삼성카드(주)는 여신전문금융업(신용카드업·시설대여업·할부금융업 등)을 영위하는 여신전문금융회사로, 여신전문금융업법 및 기타 관계법령에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

☞ 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 삼성생명보험주(주)의 사업(분·반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래

해당사항 없습니다.

다. 최대주주의 최대주주의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 기본정보

1) 법적·상업적 명칭: 삼성물산주 (Samsung C&T Corporation)

2) 설립일자 및 존속기간

1963년 12월 23일에 동화부동산주식회사로 시작하여, 2014년 7월 제일모직주식회사로 사명을 변경하였습니다. 또한 1938년 3월 1일 설립된 삼성상회를 모태로 1951년 1월에 설립된 삼성물산주식회사와의 합병을 통하여 2015년 9월 2일(합병등기일) 삼성물산주식회사로 사명을 변경하였습니다.

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)

전화번호: 02-2145-5114

홈페이지: www.samsungcnt.com

4) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 대표이사·업무집행자·최대주주

| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조함원) | | 업무집행자 (업무집행조함원) | | 최대주주 (최대출자자) | |
|-------|-------------|-----------------|-------|--------------------|-------|-----------------|-------|
| | | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| 삼성물산주 | 177,363 | 고정석 | 0.00 | - | - | 이재용 | 18.26 |
| | | 오세철 | 0.00 | - | - | - | - |
| | | 정해린 | 0.00 | - | - | - | - |

※ 2023년 06월 30일, 보통주 기준입니다.

5) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 대표이사·업무집행자·최대주주의 변동내역

(단위 : %)

| 변동일 | 대표이사 (대표조합원) | | 업무집행자 (업무집행조합원) | | 최대주주 (최대출자자) | |
|------------|-----------------|-------|--------------------|-------|-----------------|-------|
| | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| 2021.03.19 | 고정석 | 0.00 | - | - | - | - |
| 2021.03.19 | 오세철 | 0.00 | - | - | - | - |
| 2021.04.29 | - | - | - | - | 이재용 | 18.26 |
| 2023.03.17 | 한승환 | - | - | - | - | - |
| 2023.03.17 | 정해린 | 0.00 | - | - | - | - |

※ 2021년 3월 19일 이영호, 정금용 대표이사가 사임하고, 오세철, 한승환 사내이사가 대표이사로 선임되었으며,

고정석 대표이사가 재선임되었습니다.

※ 2021년 4월 29일 상속(상속인: 이재용 외 3명)으로 인하여 최대주주의 지분율(보통주)이 변동(17.48%→18.26%)되었습니다.

※ 2023년 3월 17일 한승환 대표이사가 사임하고, 정해린 대표이사가 선임되었습니다.

(2) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

| 구 분 | |
|--------------|------------|
| 법인 또는 단체의 명칭 | 삼성물산주 |
| 자산총계 | 62,832,693 |
| 부채총계 | 25,896,057 |
| 자본총계 | 36,936,636 |
| 매출액 | 20,824,745 |
| 영업이익 | 1,412,836 |
| 당기순이익 | 1,446,607 |

※ 재무현황은 2023년 06월 30일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

(3) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 사업현황 등

삼성물산주는 국내외의 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하고 있는 건설부문과 자원개발, 철강, 화학, 산업소재, 섬유 등 다양한 방면에서 국제무역을 하고 있는 상사부문, 의류제품 제조, 판매사업과 모제품(직물)가공, 판매사업을 하는 패션부문, 조경사업과 에버랜드(드라이파크), 캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식, 식자재유통사업(삼성웰스토리)을 영위 운영하는 리조트부문, 바이오의약품 위탁생산사업 및 바이오시밀러 사업으로 구성되어 있습니다.

☞ 최대주주의 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 삼성물산주의 사업(분·반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 최대주주 변동현황

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 주, %)

| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비고 |
|------------|-----------|---------------|-------|---------------|----|
| 2021.04.29 | 삼성생명보험(주) | 1,263,050,053 | 21.16 | 변동전 최대주주의 피상속 | - |

※ 소유주식수 및 지분율은 최대주주 및 그 특수관계인의 합산 내역이며, 의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다.

4. 주식의 분포 현황

가. 주식 소유 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 주)

| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|----------|-------------------------|-------------|--------|-----------------|
| 5% 이상 주주 | 삼성생명보험(주) | 517,718,891 | 8.68 | 특별계정 포함 |
| | 국민연금공단 | 439,039,024 | 7.35 | - |
| | BlackRock Fund Advisors | 300,391,061 | 5.03 | 2019년 1월 28일 기준 |
| | 삼성물산(주) | 298,818,100 | 5.01 | - |
| 우리사주조합 | | - | - | - |

※ 5% 이상 주주는 의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다.

자세한 현황은 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항' 중 '3. 주주총회 등에 관한 사항'의 '라. 의결권 현황'을 참고하시기 바랍니다.

※ BlackRock Fund Advisors의 소유주식수 및 지분율은 2019년 2월 7일 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 '주식등의 대량보유상황보고서' 기준입니다.

나. 소액주주 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 주)

| 구분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비고 |
|------|-----------|-----------|--------|---------------|---------------|--------|----|
| | 소액 주주수 | 전체 주주수 | 비율 (%) | 소액 주식수 | 총발행 주식수 | 비율 (%) | |
| 소액주주 | 5,668,319 | 5,668,455 | 99.99 | 4,005,369,716 | 5,969,782,550 | 67.09 | - |

※ 소유주식은 의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다.

※ 소액주주는 총발행주식수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주 기준입니다.

5. 주가 및 주식거래실적

가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

| 종 류 | | '23.01월 | '23.02월 | '23.03월 | '23.04월 | '23.05월 | '23.06월 | |
|-----|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 보통주 | 주가 | 최 고 | 64,600 | 63,800 | 64,000 | 66,100 | 72,300 | 72,700 |
| | | 최 저 | 55,400 | 60,500 | 59,000 | 62,300 | 64,100 | 70,500 |
| | | 평 균 | 60,540 | 62,320 | 61,145 | 64,855 | 66,900 | 71,676 |
| | 거래량 | 최고(일) | 29,746,731 | 23,285,983 | 18,278,602 | 27,476,120 | 27,476,897 | 19,165,568 |
| | | 최저(일) | 9,646,327 | 7,665,046 | 8,318,514 | 9,176,149 | 8,172,021 | 8,783,093 |
| | | 월 간 | 304,721,328 | 259,275,907 | 273,644,150 | 291,035,766 | 269,419,265 | 265,070,208 |
| 우선주 | 주가 | 최 고 | 58,200 | 57,100 | 54,700 | 55,800 | 60,400 | 61,200 |
| | | 최 저 | 50,500 | 53,400 | 52,000 | 53,100 | 54,400 | 59,100 |
| | | 평 균 | 54,830 | 55,720 | 53,141 | 54,850 | 56,575 | 60,148 |
| | 거래량 | 최고(일) | 1,949,266 | 1,287,426 | 2,624,397 | 2,309,225 | 3,822,138 | 2,092,560 |
| | | 최저(일) | 388,253 | 432,218 | 699,742 | 830,959 | 417,228 | 444,802 |
| | | 월 간 | 17,897,148 | 15,693,926 | 28,775,173 | 26,024,392 | 23,281,506 | 23,729,722 |

※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.

나. 해외증권시장

[증권거래소명 : 런던 증권거래소(보통주)]

(단위 : US\$, 원, DR)

| 종류 | | | '23.01월 | '23.02월 | '23.03월 | '23.04월 | '23.05월 | '23.06월 | |
|-----|-----|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 보통주 | 주가 | 최고 | US\$ | 1,314.50 | 1,301.00 | 1,228.50 | 1,267.00 | 1,372.00 | 1,414.00 |
| | | | ₩환산 | 1,618,675 | 1,602,051 | 1,601,718 | 1,677,761 | 1,818,723 | 1,825,615 |
| | | 최저 | US\$ | 1,076.50 | 1,148.00 | 1,112.50 | 1,181.00 | 1,190.00 | 1,353.00 |
| | | | ₩환산 | 1,365,971 | 1,512,375 | 1,451,701 | 1,573,919 | 1,575,798 | 1,788,125 |
| | | 평균 | US\$ | 1,226.90 | 1,219.00 | 1,171.76 | 1,224.67 | 1,257.90 | 1,383.05 |
| | | | ₩환산 | 1,529,630 | 1,547,529 | 1,530,932 | 1,617,217 | 1,671,688 | 1,795,027 |
| | 거래량 | 최고(일) | | 21,049 | 14,900 | 14,375 | 13,275 | 19,105 | 14,553 |
| | | 최저(일) | | 7,270 | 3,469 | 4,916 | 4,355 | 4,793 | 5,690 |
| | | 월 간 | | 274,301 | 193,873 | 196,049 | 165,207 | 209,478 | 197,373 |

※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.

※ 최고·최저 주가의 원화 환산은 해당 일자의 종가 원/달러 환율 기준이며, 평균 주가의 원화 환산은 월평균 원/달러 환율 기준입니다.

※ DR 1주당 원주 25주입니다.

[증권거래소명 : 룩셈부르크 증권거래소(우선주)]

(단위 : US\$, 원, DR)

| 종류 | | | '23.01월 | '23.02월 | '23.03월 | '23.04월 | '23.05월 | '23.06월 | |
|-----|-----|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 우선주 | 주가 | 최고 | US\$ | 1,184.00 | 1,152.00 | 1,046.00 | 1,064.00 | 1,142.00 | 1,204.00 |
| | | | ₩환산 | 1,457,978 | 1,418,573 | 1,364,821 | 1,408,949 | 1,513,835 | 1,554,484 |
| | | 최저 | US\$ | 980.00 | 1,018.00 | 967.00 | 1,000.00 | 1,016.00 | 1,118.00 |
| | | | ₩환산 | 1,243,522 | 1,341,113 | 1,261,838 | 1,332,700 | 1,341,425 | 1,477,549 |
| | | 평균 | US\$ | 1,108.38 | 1,085.50 | 1,014.87 | 1,032.00 | 1,061.40 | 1,154.82 |
| | | | ₩환산 | 1,381,861 | 1,378,050 | 1,325,950 | 1,362,794 | 1,410,549 | 1,498,815 |
| | 거래량 | 최고(일) | | 3,165 | 7,375 | 4,057 | 1,687 | 6,009 | 2,298 |
| | | 최저(일) | | 394 | 170 | 264 | 247 | 275 | 324 |
| | | 월 간 | | 25,182 | 27,610 | 26,068 | 13,367 | 28,086 | 19,269 |

※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.

※ 최고·최저 주가의 원화 환산은 해당 일자의 종가 원/달러 환율 기준이며, 평균 주가의 원화 환산은 월평균 원/달러 환율 기준입니다.

※ DR 1주당 원주 25주입니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 등기임원

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 주)

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기 임원 여부 | 상근 여부 | 담당 업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주 와의 관계 | 재직기 간 | 임기 만료일 |
|-----|----|---------|-----|----------------|----------|--|--|------------------|------------------|------------------|----------|------------|
| | | | | | | | | 의결권 있는 주 식 | 의결권 없는 주 식 | | | |
| 한중희 | 남 | 1962.03 | 부회장 | 사내 이사 | 상근 | · 대표이사 (DX 부문 경영전반 총괄) | · 인하대 전자공학 학사 · 삼성전자 DX부문장 | 15,000 | - | 계열회사 임원 | 40개월 | 2026.03.17 |
| 경계현 | 남 | 1963.03 | 사장 | 사내 이사 | 상근 | · 대표이사 (DS 부문 경영전반 총괄) | · 서울대 제어계측공학 박사 · 삼성전자 DS부문장 | 21,050 | - | 계열회사 임원 | 16개월 | 2025.03.15 |
| 노태문 | 남 | 1968.09 | 사장 | 사내 이사 | 상근 | · MX사업부장 | · 포항공대 전자전기공학 박사 · 삼성전자 MX사업부장 | 13,000 | - | 계열회사 임원 | 16개월 | 2025.03.15 |
| 박학규 | 남 | 1964.11 | 사장 | 사내 이사 | 상근 | · CFO | · KAIST 경영학 석사 · 삼성전자 경영지원실장 | 22,500 | - | 계열회사 임원 | 16개월 | 2025.03.15 |
| 이정배 | 남 | 1967.02 | 사장 | 사내 이사 | 상근 | · 메모리사업부장 | · 서울대 전자공학 박사 · 삼성전자 메모리사업부장 | 15,000 | - | 계열회사 임원 | 16개월 | 2025.03.15 |
| 김한조 | 남 | 1956.07 | 이사 | 사외 이사 | 비상근 | · 이사회 의장 · 감사위원회 위원장 · 내부거래위원회 위원 · 보상위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원장 | · 연세대 불어불문학 학사 · 하나금융나눔재단 이사장 | 3,655 | - | 계열회사 임원 | 52개월 | 2025.03.19 |
| 김선옥 | 여 | 1952.12 | 이사 | 사외 이사 | 비상근 | · 감사위원회 위원 · 내부거래위원회 위원장 · 사외이사후보추천위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원 | · Konstanz대 법학 박사 · 이화여대 명예교수 | - | - | 계열회사 임원 | 64개월 | 2024.03.22 |
| 김중훈 | 남 | 1960.08 | 이사 | 사외 이사 | 비상근 | · 감사위원회 위원 · 내부거래위원회 위원 · 보상위원회 위원장 · 지속가능경영위원회 위원 | · Maryland대 신뢰성공학 박사 · Kiswe Mobile 회장 | - | - | 계열회사 임원 | 64개월 | 2024.03.22 |
| 김준성 | 남 | 1967.10 | 이사 | 사외 이사 | 비상근 | · 보상위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원 | · Carnegie Mellon대 경제학/산업공학 학사 · 싱가포르투자청 토달리턴그룹 이사 | - | - | 계열회사 임원 | 16개월 | 2025.03.15 |
| 허은녕 | 남 | 1964.08 | 이사 | 사외 이사 | 비상근 | · 사외이사후보추천위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원 | · Pennsylvania State대 자원경제학 박사 · 서울대 공과대학 교수 | - | - | 계열회사 임원 | 8개월 | 2025.11.02 |
| 유명희 | 여 | 1967.06 | 이사 | 사외 이사 | 비상근 | · 사외이사후보추천위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원 | · Vanderbilt대 법학 박사 · 서울대 국제대학원 객원교수 | - | - | 계열회사 임원 | 8개월 | 2025.11.02 |

※ 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 등기임원 소유주식수는 작성기준일 현재 기준이며, 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)의 '임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참고하십시오.

※ 2022년 2월 15일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 대표이사직에서 사임하였으며, 동일 개최한 이사회에서 한종희 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

※ 2022년 3월 16일 주주총회를 통해 경계현, 노태문, 박학규, 이정배 사내이사와 한화진, 김준성 사외이사가 신규 선임되었고, 김한조 사외이사가 재선임되었습니다.

※ 2022년 3월 16일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 사임하였습니다.

※ 2022년 3월 16일 이사회를 통해 경계현 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

※ 2022년 3월 19일 박재완, 안규리 사외이사의 임기가 만료되었습니다.

※ 2022년 4월 20일 한화진 사외이사가 사임하였습니다.

※ 2022년 5월 17일 박병국 사외이사가 퇴임하였습니다.

※ 2022년 11월 3일 주주총회를 통해 허은영, 유명희 사외이사가 신규 선임되었습니다.

※ 2023년 3월 15일 주주총회를 통해 한종희 사내이사가 재선임되었습니다.

나. 등기임원의 타회사 임원겸직 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일)

| 겸 직 자 | | 겸 직 회 사 | | |
|-------|------|--------------|------|----------|
| 성 명 | 직 위 | 기 업 명 | 직 위 | 재 임 기 간 |
| 김종훈 | 사외이사 | Kiswe Mobile | 회장 | 2013년~현재 |
| 유명희 | 사외이사 | HD현대건설기계 | 사외이사 | 2022년~현재 |

다. 미등기임원 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 개월)

| 성명 | 성별 | 출생 연월 | 직위 | 상근 여부 | 담당업무 | 주요경력 | 학력 | 최대주주 와의 관계 | 재직 기간 |
|-----|----|----------|-----|----------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|----------|
| 김기남 | 남 | 1958.04 | 회장 | 상근 | SAIT 회장 | DS부문장 | Univ. of California, LA(박사) | 계열회사 임원 | |
| 이재용 | 남 | 1968.06 | 회장 | 상근 | 회장 | COO | Harvard Univ.(박사수료) | 최대주주 의 특수관 계인 | |
| 정현호 | 남 | 1960.03 | 부회장 | 상근 | 사업지원T/F장 | 디지털이미징사업부장 | Harvard Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 강인엽 | 남 | 1963.07 | 사장 | 상근 | 미주담당 사장 | System LSI사업부장 | Univ. of California, LA(박사) | 계열회사 임원 | |
| 김수목 | 남 | 1964.05 | 사장 | 상근 | 법무실장 | 법무실 송무팀장 | 서울대(학사) | 계열회사 임원 | 34 |
| 김우준 | 남 | 1968.05 | 사장 | 상근 | 네트워크사업부장 | 네트워크 전략마케팅팀 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 남석우 | 남 | 1966.03 | 사장 | 상근 | 제조담당 | 글로벌인프라총괄 | 연세대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 박승희 | 남 | 1964.08 | 사장 | 상근 | Corporate Relations담당 | 삼성물산 건설부문 커뮤니케이션팀장 | 건국대(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 박용인 | 남 | 1964.04 | 사장 | 상근 | System LSI사업부장 | System LSI 전략마케팅실장 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-----|----|------------------------------------|-------------------------------------|---|------------|----|
| 백수현 | 남 | 1963.01 | 사장 | 상근 | 커뮤니케이션팀장 | 커뮤니케이션 담당임원 | 서울대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 송재혁 | 남 | 1967.08 | 사장 | 상근 | DS부문 CTO, 반도체연구소장 | 메모리 Flash개발실장 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 승현준 | 남 | 1966.06 | 사장 | 상근 | Samsung Research 글로벌 R&D협력담당 | Samsung Research 담당임원 | Harvard Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 양걸 | 남 | 1962.10 | 사장 | 상근 | 중국전략협력실장 | DS부문 중국총괄 | 서강대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이영희 | 여 | 1964.11 | 사장 | 상근 | 글로벌마케팅실장 | 무선 마케팅팀장 | Northwestern Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이원진 | 남 | 1967.08 | 사장 | 상근 | Mobile eXperience 서비스 Biz팀장 | 영상디스플레이 Service Business팀장 | Purdue Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 전경훈 | 남 | 1962.12 | 사장 | 상근 | DX부문 CTO | 네트워크사업부장 | Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사) | 계열회사 임원 | |
| 진교영 | 남 | 1962.08 | 사장 | 상근 | SAIT 원장 | 메모리사업부장 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 최경식 | 남 | 1962.03 | 사장 | 상근 | 복미총괄 | 무선 전략마케팅실장 | 한양대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 최시영 | 남 | 1964.01 | 사장 | 상근 | Foundry사업부장 | 글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터장 | The Ohio State Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 한승환 | 남 | 1964.07 | 사장 | 상근 | 의료사업일류화추진단장 | 삼성물산 리조트부문 대표이사 | 서울대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 강문수 | 남 | 1969.08 | 부사장 | 상근 | AVP사업팀장 | Foundry Corporate Planning실 담당임원 | Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(박사) | 계열회사 임원 | 48 |
| 강봉구 | 남 | 1962.02 | 부사장 | 상근 | 한국총괄 | 생활가전 전략마케팅팀장 | 홍익대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 강성철 | 남 | 1967.08 | 부사장 | 상근 | Samsung Research Robot센 터장 | 무선 개발실 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 51 |
| 강신봉 | 남 | 1970.01 | 부사장 | 상근 | 글로벌마케팅실 D2C센터장 | 위대한상상, CEO | Duke Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 6 |
| 계종욱 | 남 | 1966.10 | 부사장 | 상근 | Foundry Design Platform개발 실장 | Foundry Design Platform개발 실 담당임원 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 고대곤 | 남 | 1965.03 | 부사장 | 상근 | SEPM법인장 | SIEL-P(C)법인장 | 아주대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 고봉준 | 남 | 1972.01 | 부사장 | 상근 | 영상디스플레이 개발팀 담당임 원 | Stanford Univ., Research Fellow | Columbia Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 40 |
| 고승환 | 남 | 1962.09 | 부사장 | 상근 | 영상디스플레이 구매팀장 | 생활가전 구매팀장 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 고재운 | 남 | 1973.01 | 부사장 | 상근 | 지원팀 담당임원 | 경영혁신팀 담당임원 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 고재필 | 남 | 1970.03 | 부사장 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | 메모리 인사팀장 | Purdue Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 고형중 | 남 | 1970.11 | 부사장 | 상근 | 메모리 Design Platform개발실 장 | 메모리 Design Platform개발실 담당임원 | Univ. of Florida(박사) | 계열회사 임원 | |
| 곽성웅 | 남 | 1965.05 | 부사장 | 상근 | System LSI Design Platform개 발팀장 | System LSI Security&Power제 품개발팀장 | Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 곽연봉 | 남 | 1967.03 | 부사장 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 인프라기술 센터 담당임원 | 광운대(학사) | 계열회사 임원 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-----|----|--|------------------------------------|---|------------|----|
| 구본영 | 남 | 1967.05 | 부사장 | 상근 | SAS법인장 | 글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 구자흥 | 남 | 1968.01 | 부사장 | 상근 | Foundry 기술개발실 담당임원 | 글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원 | North Carolina State Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 권상덕 | 남 | 1967.03 | 부사장 | 상근 | 반도체연구소 Logic TD실장 | 반도체연구소 Logic TD실 담당 임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 권오상 | 남 | 1967.04 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | 무선 개발2실 담당임원 | Univ. of Texas, Austin(박 사) | 계열회사 임원 | |
| 권태훈 | 남 | 1968.02 | 부사장 | 상근 | 재경팀 담당임원 | DS부문 일본총괄 담당임원 | Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사) | 계열회사 임원 | |
| 권환준 | 남 | 1971.09 | 부사장 | 상근 | Samsung Research 차세대통 신연구센터 담당임원 | Qualcomm, Sr. Director | Univ. of California, San Diego(박사) | 계열회사 임원 | 16 |
| 김강태 | 남 | 1972.10 | 부사장 | 상근 | Samsung Research 기술전략 팀장 | Samsung Research SE팀장 | 중앙대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 김경진 | 남 | 1963.11 | 부사장 | 상근 | DX부문 CSO, Global EHS센터 장 | 영상디스플레이 Global제조팀 장 | 숭실대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김경환 | 남 | 1970.06 | 부사장 | 상근 | 법무실 법무팀장 | 법무실 담당임원 | 서울대(학사) | 계열회사 임원 | 44 |
| 김경희 | 여 | 1969.07 | 부사장 | 상근 | 글로벌마케팅실 D2C센터 담 당임원 | Moda Operandi, CMO | Yale Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 58 |
| 김기훈 | 남 | 1968.05 | 부사장 | 상근 | 지원팀 담당임원 | 구주총괄 지원팀장 | Univ. of Baltimore(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김대주 | 남 | 1969.10 | 부사장 | 상근 | 영상디스플레이 지원팀 담 당임원 | 서남아총괄 지원팀장 | Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김대현 | 남 | 1974.06 | 부사장 | 상근 | Samsung Research SoC Architecture팀장 | Samsung Research Platform팀 담당임원 | Cornell Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 김도현 | 남 | 1975.03 | 부사장 | 상근 | DS부문 법무지원팀장 | DS부문 법무지원팀 담당임원 | 서울대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김동관 | 남 | 1969.10 | 부사장 | 상근 | DS부문 정보보호센터장 | 삼성SDS 정보보호센터장 | 한양대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김동욱 | 남 | 1968.10 | 부사장 | 상근 | 재경팀장 | 재경팀 담당임원 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김두일 | 남 | 1971.07 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | Samsung Research Platform팀장 | 경북대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김만영 | 남 | 1969.07 | 부사장 | 상근 | SEG법인장 | 무선 전략마케팅실 담당임원 | Boston Univ.(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김명철 | 남 | 1968.09 | 부사장 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | 반도체연구소 공정개발실 담 당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |
| 김민구 | 남 | 1964.08 | 부사장 | 상근 | System LSI CP개발실장 | System LSI SOC개발실 담 당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 김병도 | 남 | 1967.03 | 부사장 | 상근 | 글로벌마케팅실 D2C센터 담 당임원 | 글로벌마케팅센터 담당임원 | 서강대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김보현 | 남 | 1973.02 | 부사장 | 상근 | 메모리 People팀장 | Samsung Research 인사팀장 | 서강대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김사필 | 남 | 1965.04 | 부사장 | 상근 | 상생협력센터 담당임원 | 상생협력센터 담당임원 | 경찰대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김선식 | 남 | 1964.06 | 부사장 | 상근 | DS부문 People팀 담당임원 | 메모리 인사팀장 | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-----|----|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|----|
| 김성욱 | 남 | 1968.06 | 부사장 | 상근 | 한국총괄 D2C팀장 | 인사팀 담당임원 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김성윤 | 남 | 1966.10 | 부사장 | 상근 | 법무실 IP센터 담당임원 | IP센터 책임변호사 | Harvard Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김세윤 | 남 | 1973.06 | 부사장 | 상근 | 생활가전 전략마케팅팀 담당임원 | 감사팀 담당임원 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김세호 | 남 | 1967.10 | 부사장 | 상근 | SEI법인장 | 영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원 | 동국대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김수진 | 여 | 1969.08 | 부사장 | 상근 | 지속가능경영추진센터장 | Global Public Affairs팀 담당임원 | Univ. of Pennsylvania(박사) | 계열회사 임원 | |
| 김연성 | 남 | 1966.05 | 부사장 | 상근 | 생활가전 지원팀장 | 한국총괄 지원팀장 | MIT(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김영집 | 남 | 1971.03 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원 | 무선 Global Mobile B2B팀 담당임원 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김영호 | 남 | 1964.12 | 부사장 | 상근 | 수원지원센터장 | 생활가전 지원팀 담당임원 | Tulane Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김용관 | 남 | 1963.12 | 부사장 | 상근 | 의료기기사업부장 | 의료기기 전략지원담당 | Thunderbird(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김용국 | 남 | 1968.01 | 부사장 | 상근 | 사업지원T/F 담당임원 | 삼성바이오에피스 생산본부 담당임원 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 24 |
| 김용재 | 남 | 1972.03 | 부사장 | 상근 | 영상디스플레이 개발팀 담당임원 | 영상디스플레이 개발팀 담당임원 | 서강대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김용주 | 남 | 1970.08 | 부사장 | 상근 | Foundry 지원팀장 | 삼성SDI 중대형사업부 지원팀장 | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김우평 | 남 | 1970.05 | 부사장 | 상근 | DSRA-AVP 연구소장 | TSP총괄 담당임원 | Georgia Inst. of Tech.(박사) | 계열회사 임원 | 12 |
| 김원경 | 남 | 1967.08 | 부사장 | 상근 | Global Public Affairs팀장 | 북미총괄 대외협력팀장 | The Johns Hopkins Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김유석 | 남 | 1965.04 | 부사장 | 상근 | 법무실 IP센터장 | 법무실 IP센터 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 김은중 | 남 | 1965.06 | 부사장 | 상근 | AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원 | TSP총괄 GPO팀장 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김이수 | 남 | 1973.03 | 부사장 | 상근 | SIEL-P(N)공장장 | Mobile eXperience Global제조센터 담당임원 | 아주대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김이태 | 남 | 1966.02 | 부사장 | 상근 | 상생협력센터 담당임원 | 커뮤니케이션팀 담당임원 | Univ. of Missouri, Columbia(박사) | 계열회사 임원 | |
| 김인식 | 남 | 1967.09 | 부사장 | 상근 | 재경팀 담당임원 | 삼성SDS 전략기획담당 담당임원 | Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김장경 | 남 | 1973.05 | 부사장 | 상근 | 사업지원T/F 담당임원 | 영상디스플레이 지원팀 담당임원 | 홍익대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김재묵 | 남 | 1965.05 | 부사장 | 상근 | 생활가전 구매팀 담당임원 | 상생협력센터 상생협력팀장 | 국민대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김재열 | 남 | 1965.07 | 부사장 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원 | 중앙대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김재윤 | 남 | 1963.03 | 부사장 | 상근 | 기획팀장 | 삼성경제연구소 산업전략1실장 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 김재준 | 남 | 1968.01 | 부사장 | 상근 | 메모리 전략마케팅실장 | DS부문 미주총괄 담당임원 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---------|-----|----|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------|----|
| 김재훈 | 남 | 1967.01 | 부사장 | 상근 | 영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원 | SELA법인장 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김정식 | 남 | 1970.08 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담당임원 | 무선 서비스사업실 담당임원 | 한양대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김정현 | 남 | 1975.06 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience CX실 담당임원 | 무선 기획팀 담당임원 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김종현 | 남 | 1966.08 | 부사장 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 People팀장 | Foundry 인사팀장 | 육사(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김주년 | 남 | 1969.12 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 품질혁신센터장 | Mobile eXperience 개발실 담당임원 | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김준석 | 남 | 1969.04 | 부사장 | 상근 | System LSI CP개발실 담당임원 | System LSI SOC개발실 담당임원 | Stanford Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 김진수 | 남 | 1971.10 | 부사장 | 상근 | 디자인경영센터 담당임원 | 무선 디자인팀 담당임원 | 국민대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김찬우 | 남 | 1976.04 | 부사장 | 상근 | Samsung Research Global AI센터 담당임원 | Samsung Research AI센터 담당임원 | Carnegie Mellon Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 김창업 | 남 | 1969.08 | 부사장 | 상근 | SEDA-S판매부문장 | Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원 | 한양대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김철기 | 남 | 1968.03 | 부사장 | 상근 | 영상디스플레이 영상전략마케팅팀장 | Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원 | 경북대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김태훈 | 남 | 1969.04 | 부사장 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 김학상 | 남 | 1966.09 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담당임원 | 무선 개발2실 담당임원 | Univ. of Massachusetts, Lowell(박사) | 계열회사 임원 | |
| 김한석 | 남 | 1968.07 | 부사장 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김현도 | 남 | 1966.04 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 구미지원센터장 | 생활가전 광주지원센터장 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김현우 | 남 | 1970.02 | 부사장 | 상근 | 반도체연구소 기술기획팀장 | 반도체연구소 공정개발실 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |
| 김형섭 | 남 | 1966.01 | 부사장 | 상근 | DS부문 CTO 담당임원 | 반도체연구소장 | Univ. of Texas, Austin(박사) | 계열회사 임원 | |
| 김홍경 | 남 | 1965.11 | 부사장 | 상근 | DS부문 경영지원실장 | DS부문 경영지원실 담당임원 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김홍식 | 남 | 1969.09 | 부사장 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | 글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 나기홍 | 남 | 1966.03 | 부사장 | 상근 | People팀장 | 인사팀 담당임원 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 노원일 | 남 | 1967.08 | 부사장 | 상근 | SRA연구소장 | 네트워크 상품전략팀장 | Stanford Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 다니엘오 | 남 | 1974.03 | 부사장 | 상근 | IR팀 담당임원 | Morrow Sodali, Managing Director | The Johns Hopkins Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 17 |
| 더못라이언 | 남 | 1962.09 | 부사장 | 상근 | DS부문 DSE총괄 | DS부문 구조총괄 담당임원 | Limerick Regional Technical Coll.(학사) | 계열회사 임원 | |
| 데이브다스 | 남 | 1975.06 | 부사장 | 상근 | SEIB법인장 | Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원 | Northwestern Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 데이빗리 | 남 | 1969.07 | 부사장 | 상근 | Samsung NEXT장 | Refactor Capital, Co-founder | New York Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 29 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---------|-----|----|---|--------------------------------------|---|---------|----|
| 도현호 | 남 | 1967.10 | 부사장 | 상근 | 설비기술연구소 설비개발실 담당임원 | Applied Materials, Managing Director | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 16 |
| 디페이 | 남 | 1969.06 | 부사장 | 상근 | SRI-Bangalore연구소장 | SRI-Bangalore 副연구소장 | Indian Inst. of Management, Bangalore(석사) | 계열회사 임원 | |
| 린준청 | 남 | 1970.07 | 부사장 | 상근 | AVP사업팀 AVP개발실 담당임원 | Skytech, CEO | NTUST(박사) | 계열회사 임원 | 6 |
| 마크리퍼트 | 남 | 1973.02 | 부사장 | 상근 | 북미총괄 대외협력팀장 | YouTube, APAC 대외협력총괄 | Stanford Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 16 |
| 메노 | 남 | 1968.06 | 부사장 | 상근 | SEF법인장 | SEBN법인장 | Haarlem Business School(학사) | 계열회사 임원 | |
| 명호석 | 남 | 1967.04 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원 | SEA 담당임원 | 중앙대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 문성우 | 남 | 1971.12 | 부사장 | 상근 | 경영혁신센터장 | 경영혁신센터 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |
| 문성훈 | 남 | 1974.09 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담당임원 | 무선 개발실 담당부장 | 경북대(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 문승도 | 남 | 1968.10 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담당임원 | 무선 개발1실 담당임원 | Univ. of Southern California(박사) | 계열회사 임원 | |
| 문종승 | 남 | 1971.08 | 부사장 | 상근 | 생산기술연구소장 | SEDA-P(M) 공장장 | Georgia Inst. of Tech.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 문준 | 남 | 1974.06 | 부사장 | 상근 | 네트워크 개발팀장 | 네트워크 개발팀 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 문창록 | 남 | 1971.01 | 부사장 | 상근 | 반도체연구소 CIS TD팀장 | System LSI Sensor사업팀 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 문희동 | 남 | 1971.07 | 부사장 | 상근 | 사업지원T/F 담당임원 | 종합기술원 인사팀장 | 한양대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 민종술 | 남 | 1968.03 | 부사장 | 상근 | 영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원 | 영상디스플레이 개발팀 담당임원 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 바우만 | 남 | 1966.05 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원 | SEUK법인장 | Univ. of Bath(석사) | 계열회사 임원 | |
| 박건대 | 남 | 1969.09 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 구매팀 담당임원 | 감사팀 담당부장 | Univ. of Colorado, Boulder(석사) | 계열회사 임원 | |
| 박길재 | 남 | 1966.04 | 부사장 | 상근 | Global CS센터장 | Mobile eXperience 품질혁신센터장 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 박문호 | 남 | 1965.01 | 부사장 | 상근 | People팀 담당임원 | 경영진단팀 담당임원 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 박성선 | 남 | 1965.08 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담당임원 | 무선 개발2실 담당임원 | 충남대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 박성욱 | 남 | 1972.04 | 부사장 | 상근 | SCS법인장 | 글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 박성준 | 남 | 1971.01 | 부사장 | 상근 | 반도체연구소 공정개발실 담당임원 | 종합기술원 Material연구센터 담당임원 | Stanford Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 박성호 | 남 | 1968.09 | 부사장 | 상근 | SEVT법인장 | SIEL-P(N)공장장 | 경북대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 박수남 | 남 | 1970.10 | 부사장 | 상근 | 설비기술연구소 설비개발실 담당임원 | 생산기술연구소 설비개발실 담당임원 | Univ. of Minnesota, Minneapolis(박사) | 계열회사 임원 | 54 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-----|----|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|----|
| 박순철 | 남 | 1966.07 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 지원팀장 | 사업지원T/F 담당임원 | 연세대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 박정민 | 남 | 1972.03 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원 | Virginia Tech, 교수 | Purdue Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 30 |
| 박정호 | 남 | 1971.09 | 부사장 | 상근 | Compliance팀장 | Compliance팀 담당임원 | Michigan State Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 박정훈 | 남 | 1969.10 | 부사장 | 상근 | Samsung Research Visual Technology팀장 | Samsung Research Media Research팀장 | 한양대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 박제민 | 남 | 1971.12 | 부사장 | 상근 | 반도체연구소 DRAM TD실장 | 글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 담당임원 | Univ. of California, Berkeley(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 박종범 | 남 | 1969.02 | 부사장 | 상근 | 서남아총괄 | SIEL-S 담당임원 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 박지선 | 남 | 1974.09 | 부사장 | 상근 | SRA 담당임원 | 무선 개발실 담당임원 | Univ. of Texas, Austin(박 사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 박진영 | 여 | 1971.11 | 부사장 | 상근 | DS부문 구매팀장 | DS부문 구매팀 담당임원 | 서울대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 박찬우 | 남 | 1973.05 | 부사장 | 상근 | 생활가전 담당임원 | 생활가전 전략마케팅팀 담당임 원 | Stanford Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 박찬익 | 남 | 1972.04 | 부사장 | 상근 | DS부문 DSA 담당임원 | 메모리 기획팀장 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 박찬훈 | 남 | 1962.04 | 부사장 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | 글로벌 제조&인프라총괄 담당 임원 | 電氣通信大學(박사) | 계열회사 임원 | |
| 박철우 | 남 | 1971.10 | 부사장 | 상근 | 영상디스플레이 Customer Marketing팀장 | Mattel, SVP | Harvard Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 47 |
| 박현정 | 남 | 1969.12 | 부사장 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 박형원 | 남 | 1966.09 | 부사장 | 상근 | System LSI Global Operation실장 | System LSI 품질팀장 | 한양대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 박훈중 | 남 | 1967.08 | 부사장 | 상근 | 한국총괄 MX팀 담당임원 | 한국총괄 모바일영업팀 담당임 원 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 반효동 | 남 | 1967.06 | 부사장 | 상근 | 메모리 DRAM개발실 담당임원 | 글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 배광진 | 남 | 1968.02 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | 무선 개발2실 담당임원 | 금오공대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 배상우 | 남 | 1970.10 | 부사장 | 상근 | 메모리 품질실장 | 메모리 품질보증실 담당임원 | Purdue Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 배용철 | 남 | 1970.05 | 부사장 | 상근 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | DS부문 중국총괄 담당임원 | Harvard Univ.(박사수료) | 계열회사 임원 | |
| 서병훈 | 남 | 1963.07 | 부사장 | 상근 | IR팀장 | IR팀 담당임원 | Carnegie Mellon Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 서한석 | 남 | 1968.02 | 부사장 | 상근 | SEA 담당임원 | SEDA-S판매부문장 | George Washington Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 서행룡 | 남 | 1967.09 | 부사장 | 상근 | 혁신센터 담당임원 | DIT센터 담당임원 | 부산대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 서형석 | 남 | 1968.02 | 부사장 | 상근 | DS부문 DSC총괄 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 성일경 | 남 | 1964.01 | 부사장 | 상근 | 구주총괄 | 영상디스플레이 영상전략마케 팅팀장 | 연세대(학사) | 계열회사 임원 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-----|----|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|----|
| 손성원 | 남 | 1969.02 | 부사장 | 상근 | 북미총괄 지원팀장 | 무선 지원팀 담당임원 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 손영수 | 남 | 1974.02 | 부사장 | 상근 | 메모리 DRAM개발실 담당임원 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | 포항공대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 송기환 | 남 | 1970.07 | 부사장 | 상근 | 메모리 Flash개발실 담당임원 | 메모리 Flash개발실 수석 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 송두근 | 남 | 1968.07 | 부사장 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터장 | 글로벌 제조&인프라총괄 글로벌 환경안전/인프라센터장 | 아주대(박사수료) | 계열회사 임원 | |
| 송명주 | 여 | 1970.02 | 부사장 | 상근 | TSE-S법인장 | 생활가전 전략마케팅팀 담당임 원 | 서강대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 송병무 | 남 | 1973.08 | 부사장 | 상근 | Foundry 기술개발실 담당임원 | Intel, Yield Group Manager | Cornell Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 송승엽 | 남 | 1968.08 | 부사장 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 TP센 터장 | TSP총괄 TP센터 담당임원 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 송용호 | 남 | 1967.04 | 부사장 | 상근 | 메모리 Solution개발실장 | 메모리 Solution개발실 담당임 원 | Univ. of Southern California(박사) | 계열회사 임원 | 51 |
| 송원득 | 남 | 1964.01 | 부사장 | 상근 | DS부문 IP팀장 | 법무실 IP센터 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |
| 송철섭 | 남 | 1967.12 | 부사장 | 상근 | Foundry Corporate Planning실 담당임원 | DS부문 중국총괄 담당임원 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 송호건 | 남 | 1966.01 | 부사장 | 상근 | TSP총괄 Package개발실장 | TSP총괄 TP센터 담당임원 | Univ. of California, Berkeley(박사) | 계열회사 임원 | |
| 신경섭 | 남 | 1968.09 | 부사장 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 반도체연구소 공정개발실 담당 임원 | Univ. of California, Berkeley(박사) | 계열회사 임원 | |
| 신명훈 | 남 | 1965.01 | 부사장 | 상근 | 법무실 담당임원 | 법무팀 담당임원 | Columbia Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 신승원 | 남 | 1974.09 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | KAIST, 교수 | Texas A&M Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 30 |
| 신승철 | 남 | 1973.04 | 부사장 | 상근 | DS부문 DSSEA총괄 | Foundry Corporate Planning실 담당임원 | 연세대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 신승혁 | 남 | 1968.01 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | Samsung Research IP출원팀 장 | Polytechnic Univ. of NY(박 사) | 계열회사 임원 | |
| 신영주 | 남 | 1969.09 | 부사장 | 상근 | DS부문 구매팀 담당임원 | 메모리제조기술센터 담당임원 | Purdue Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 신유균 | 남 | 1965.02 | 부사장 | 상근 | 반도체연구소 차세대연구실장 | 반도체연구소 공정개발실장 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |
| 신종신 | 남 | 1973.12 | 부사장 | 상근 | Foundry Design Platform개발 실 담당임원 | Foundry 기술개발실 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 신현진 | 남 | 1971.01 | 부사장 | 상근 | 영상디스플레이 People팀장 | 영상디스플레이 인사팀장 | 경북대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 심상필 | 남 | 1965.05 | 부사장 | 상근 | Foundry Corporate Planning실 장 | Foundry 전략마케팅실장 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |
| 심은수 | 남 | 1966.10 | 부사장 | 상근 | SAIT System Research Center장 | DIT센터장 | Columbia Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 안길준 | 남 | 1969.01 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 담당임원 | 무선 개발실 담당임원 | George Mason Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 안상호 | 남 | 1965.03 | 부사장 | 상근 | SESS법인장 | TSP총괄 TP센터 담당임원 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-----|----|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|----|
| 안수진 | 여 | 1969.12 | 부사장 | 상근 | 메모리 Flash개발실 담당임원 | 반도체연구소 메모리TD실 담당 임원 | 포항공대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 안용일 | 남 | 1971.02 | 부사장 | 상근 | 글로벌마케팅실 CX·MDE센터 담당임원 | 디자인경영센터 담당임원 | 서강대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 안장혁 | 남 | 1967.12 | 부사장 | 상근 | 네트워크 지원팀장 | SEVT 담당임원 | 육사(학사) | 계열회사 임원 | |
| 안재용 | 남 | 1968.08 | 부사장 | 상근 | DS부문 감사팀 담당임원 | DS부문 상생협력센터 담당임원 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 안정착 | 남 | 1970.12 | 부사장 | 상근 | System LSI Sensor사업팀 담당 임원 | 반도체연구소 담당임원 | 포항공대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 양세영 | 남 | 1975.08 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | Apple, Engineering Manager | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |
| 양장규 | 남 | 1963.09 | 부사장 | 상근 | 설비기술연구소장 | 생산기술연구소장 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |
| 양준호 | 남 | 1971.02 | 부사장 | 상근 | 생활가전 디자인팀장 | Mobile eXperience CX실 담당 임원 | 세종대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 양혜순 | 여 | 1968.02 | 부사장 | 상근 | 생활가전 Global CS팀장 | 생활가전 상품전략팀장 | Michigan State Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 염대현 | 남 | 1966.03 | 부사장 | 상근 | 법무실 송무팀장 | 법무실 담당임원 | 한양대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 염재훈 | 남 | 1966.06 | 부사장 | 상근 | DS부문 DS대외협력팀장 | DS부문 상생협력센터 담당임원 | 서강대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 여명구 | 남 | 1970.10 | 부사장 | 상근 | DS부문 People팀 담당임원 | 조직문화개선T/F 담당임원 | 아주대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 여형민 | 남 | 1971.06 | 부사장 | 상근 | 사업지원T/F 담당임원 | 삼성SDS 담당임원 | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 오문욱 | 남 | 1974.02 | 부사장 | 상근 | 메모리 Solution개발실 담당임 원 | 메모리 Solution개발실 수석 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 오정석 | 남 | 1970.03 | 부사장 | 상근 | TSP총괄 지원팀장 | System LSI 지원팀장 | 淸華大(석사) | 계열회사 임원 | |
| 오중훈 | 남 | 1969.10 | 부사장 | 상근 | 메모리 지원팀장 | DS부문 미주총괄 담당임원 | Purdue Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 오치오 | 남 | 1967.01 | 부사장 | 상근 | 한국총괄 B2B팀장 | 한국총괄 B2B영업팀 담당임원 | 건국대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 오태영 | 남 | 1974.10 | 부사장 | 상근 | 메모리 DRAM개발실 담당임원 | 메모리 DRAM개발실 담당임원 | Stanford Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 오화석 | 남 | 1972.02 | 부사장 | 상근 | 메모리 Solution개발실 담당임 원 | 메모리 Solution개발실 담당임 원 | 서강대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 왕통 | 남 | 1962.06 | 부사장 | 상근 | 중국전략협력실 담당임원 | SCIC 담당임원 | 北京郵電大(학사) | 계열회사 임원 | |
| 용석우 | 남 | 1970.09 | 부사장 | 상근 | 영상디스플레이 담당임원 | 영상디스플레이 개발팀장 | Polytechnic Univ. of NY(석 사) | 계열회사 임원 | |
| 우영돈 | 남 | 1974.01 | 부사장 | 상근 | 법무실 담당임원 | 무선 지원팀 담당임원 | 한양대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 원성근 | 남 | 1968.05 | 부사장 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 평택사업장 담당임원 | 경북대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 원순재 | 남 | 1972.01 | 부사장 | 상근 | 메모리 Solution개발실 담당임 원 | 메모리 Solution개발실 수석 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-----|----|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|----|
| 원종현 | 남 | 1967.05 | 부사장 | 상근 | 영상디스플레이 지원팀장 | 영상디스플레이 지원팀 담당임원 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 위훈 | 남 | 1970.04 | 부사장 | 상근 | 생활가전 선행개발팀장 | 생활가전 개발팀 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 유규태 | 남 | 1975.02 | 부사장 | 상근 | 의료기기 전략마케팅팀장 | 삼성메디슨 전략마케팅팀장 | Cornell Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 유미영 | 여 | 1968.07 | 부사장 | 상근 | 생활가전 S/W개발팀장 | 영상디스플레이 개발팀 담당임원 | 포항공대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 유병길 | 남 | 1970.09 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원 | Mobile eXperience 전략기획팀장 | Univ. of Virginia(석사) | 계열회사 임원 | |
| 유승호 | 남 | 1968.06 | 부사장 | 상근 | 지원팀 담당임원 | 생활가전 지원팀 담당임원 | 연세대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 유창식 | 남 | 1969.12 | 부사장 | 상근 | 메모리 DRAM개발실 담당임원 | 한양대, 교수 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 32 |
| 윤석민 | 남 | 1971.02 | 부사장 | 상근 | 설비기술연구소 설비개발실 담당임원 | LAM Research, Sr. Director | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 15 |
| 윤세승 | 남 | 1965.12 | 부사장 | 상근 | Foundry Design Platform개발실 담당임원 | Qualcomm, Senior Director | 연세대(학사) | 계열회사 임원 | 14 |
| 윤인수 | 남 | 1974.11 | 부사장 | 상근 | 법무실 담당임원 | 법무팀 담당임원 | Georgetown Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 윤장현 | 남 | 1968.12 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담당임원 | 무선 서비스사업실 담당임원 | Georgia Inst. of Tech.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 윤종덕 | 남 | 1969.04 | 부사장 | 상근 | 커뮤니케이션팀 담당임원 | 커뮤니케이션팀 담당부장 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 윤종식 | 남 | 1961.09 | 부사장 | 상근 | Foundry CTO | Foundry 기술개발실장 | Univ. of California, LA(박사) | 계열회사 임원 | |
| 윤준오 | 남 | 1967.06 | 부사장 | 상근 | 기획팀 담당임원 | 네트워크 기획팀장 | 건국대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 윤철운 | 남 | 1962.11 | 부사장 | 상근 | SEHC법인장 | 영상디스플레이 Global운영팀장 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | |
| 윤태양 | 남 | 1968.12 | 부사장 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 | 글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터장 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이경우 | 남 | 1969.04 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담당임원 | 무선 개발2실 수석 | 한양대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 이계성 | 남 | 1967.11 | 부사장 | 상근 | 법무실 해외법무팀장 | 구주총괄 대외협력팀장 | St. Louis Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이광렬 | 남 | 1969.02 | 부사장 | 상근 | 영상디스플레이 Global CS팀장 | Global CS센터 담당임원 | 한양대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이광현 | 남 | 1971.06 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience People팀장 | 인사팀 담당임원 | 연세대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이규열 | 남 | 1966.05 | 부사장 | 상근 | TSP총괄 | TSP총괄 TP센터장 | 항공대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이규필 | 남 | 1961.05 | 부사장 | 상근 | DS부문 People팀 담당임원 | 반도체연구소 메모리TD실장 | Univ. of Florida(박사) | 계열회사 임원 | |
| 이규호 | 남 | 1969.06 | 부사장 | 상근 | People팀 담당임원 | 영상디스플레이 인사팀장 | 서강대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이근호 | 남 | 1970.02 | 부사장 | 상근 | 혁신센터 담당임원 | DIT센터 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-----|----|-----------------------------------|---------------------------------|--|------------|----|
| 이금주 | 여 | 1971.09 | 부사장 | 상근 | 반도체연구소 공정개발실 담당 임원 | 반도체연구소 메모리 TD실 담 당임원 | 중앙대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이동근 | 남 | 1971.08 | 부사장 | 상근 | 네트워크 개발팀 담당임원 | 네트워크 개발팀 수석 | 한양대(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 이동기 | 남 | 1969.05 | 부사장 | 상근 | DS부문 People팀 담당임원 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | Univ. of California, San Diego(박사) | 계열회사 임원 | |
| 이동우 | 남 | 1967.06 | 부사장 | 상근 | 사업지원T/F 담당임원 | 메모리 지원팀장 | 경북대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이우형 | 남 | 1970.02 | 부사장 | 상근 | 생활가전 개발팀장 | 생활가전 개발팀 담당임원 | Purdue Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 이병국 | 남 | 1965.11 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience Global제조 센터장 | SEVT법인장 | 부산대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이상도 | 남 | 1969.03 | 부사장 | 상근 | SEA 담당임원 | 영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원 | City Univ. of New York(석 사) | 계열회사 임원 | |
| 이상우 | 남 | 1972.11 | 부사장 | 상근 | 법무실 담당임원 | 법무팀 담당임원 | 연세대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이상원 | 남 | 1971.07 | 부사장 | 상근 | 서남아총괄 지원팀장 | 영상디스플레이 지원팀 담당임 원 | Georgetown Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이상재 | 남 | 1965.12 | 부사장 | 상근 | TSP총괄 품질팀장 | TSP총괄 TP센터 담당임원 | 홍익대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이상주 | 남 | 1970.09 | 부사장 | 상근 | 구주총괄 대외협력팀장 | 법무실 담당임원 | Harvard Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이상현 | 남 | 1966.05 | 부사장 | 상근 | Foundry사업부 담당임원 | Foundry Design Platform개발 실장 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 이상훈 | 남 | 1973.04 | 부사장 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | Intel, Sr. Principal Engineer | Univ. of California, Berkeley(박사) | 계열회사 임원 | 11 |
| 이석원 | 남 | 1970.07 | 부사장 | 상근 | 설비기술연구소 담당임원 | 생산기술연구소 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 이석준 | 남 | 1965.07 | 부사장 | 상근 | System LSI AP개발실장 | System LSI SOC개발실 담당임 원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |
| 이성수 | 남 | 1964.11 | 부사장 | 상근 | DS부문 감사팀장 | 메모리 품질보증실 담당임원 | 경희대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이성현 | 남 | 1966.07 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 전략마케 팅실 담당임원 | SGE법인장 | 홍익대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이승구 | 남 | 1969.08 | 부사장 | 상근 | People팀 담당임원 | SEG 담당임원 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이승욱 | 남 | 1967.02 | 부사장 | 상근 | 전장사업팀장 | 사업지원T/F 담당임원 | Univ. of Akron(박사) | 계열회사 임원 | |
| 이시영 | 남 | 1972.04 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | 무선 개발실 담당임원 | Univ. of Sussex(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이양우 | 남 | 1972.02 | 부사장 | 상근 | 영상디스플레이 담당임원 | KNOWCK, 공동대표 | Univ. of Colorado(석사) | 계열회사 임원 | 28 |
| 이영수 | 남 | 1972.01 | 부사장 | 상근 | SEVT 담당임원 | 글로벌기술센터 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 이영웅 | 남 | 1969.07 | 부사장 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 담당 임원 | Shell, General Manager | MIT(박사) | 계열회사 임원 | 3 |
| 이영호 | 남 | 1967.07 | 부사장 | 상근 | 중국사업혁신팀장 | 무선 전략마케팅실 담당임원 | Univ. of Maryland, College Park(석사) | 계열회사 임원 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-----|----|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|----|
| 이왕익 | 남 | 1963.07 | 부사장 | 상근 | 재경팀 담당임원 | 삼성생명 지원팀 담당임원 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이우섭 | 남 | 1966.05 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 구매팀장 | 무선 구매팀 담당임원 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이원준 | 남 | 1970.02 | 부사장 | 상근 | 재경팀 담당임원 | 중동총괄 지원팀장 | 연세대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이일환 | 남 | 1973.09 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience CX실 담당 임원 | Mercedez-Benz, CDO of China | Art Center College Of Design(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 이재범 | 남 | 1970.10 | 부사장 | 상근 | 영상디스플레이 기획팀장 | 영상디스플레이 지원팀 담당임 원 | 홍익대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이재열 | 남 | 1970.01 | 부사장 | 상근 | System LSI LSI개발실장 | System LSI LSI개발실 담당임 원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 이정원 | 남 | 1977.04 | 부사장 | 상근 | System LSI CP개발실 담당임 원 | System LSI SOC개발실 담당임 원 | Stanford Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 30 |
| 이정환 | 남 | 1971.05 | 부사장 | 상근 | DS부문 법무실장 | DS부문 법무지원팀장 | 서울대(학사) | 계열회사 임원 | 6 |
| 이제현 | 남 | 1970.04 | 부사장 | 상근 | 사업지원T/F 담당임원 | 삼성디스플레이 경영지원실 담 당임원 | 광운대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이종명 | 남 | 1970.03 | 부사장 | 상근 | 반도체연구소 공정개발실장 | 반도체연구소 공정개발실 담당 임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 이종민 | 남 | 1971.09 | 부사장 | 상근 | 디바이스플랫폼센터 담당임원 | 무선 기획팀 담당임원 | Illinois Inst. of Tech.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이종열 | 남 | 1970.02 | 부사장 | 상근 | 혁신센터장 | 메모리 Solution개발실 담당임 원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 이종철 | 남 | 1968.01 | 부사장 | 상근 | 법무실 담당임원 | Compliance팀 담당임원 | Univ. of Pennsylvania(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이주영 | 남 | 1966.07 | 부사장 | 상근 | 메모리 DRAM개발실장 | 반도체연구소 메모리TD실 담당 임원 | Univ. of California, LA(박 사) | 계열회사 임원 | |
| 이준현 | 남 | 1965.05 | 부사장 | 상근 | Samsung Research 차세대가 전연구팀장 | 생활가전 선행개발팀장 | Univ. of Cincinnati(박사) | 계열회사 임원 | |
| 이준화 | 남 | 1972.03 | 부사장 | 상근 | 생활가전 CX팀장 | 생활가전 개발팀 담당임원 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이준희 | 남 | 1969.03 | 부사장 | 상근 | 네트워크 전략마케팅팀장 | 네트워크 개발팀장 | MIT(박사) | 계열회사 임원 | |
| 이지별 | 남 | 1971.03 | 부사장 | 상근 | 글로벌마케팅실 글로벌브랜드 센터 담당임원 | Meta, Creative Director | Parsons School of Design(학사) | 계열회사 임원 | 11 |
| 이진엽 | 남 | 1970.02 | 부사장 | 상근 | 메모리 Flash개발실 담당임원 | 메모리 Flash개발실 수석 | 서강대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이창수 | 남 | 1971.07 | 부사장 | 상근 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | 메모리 전략마케팅 담당임원 | 경희대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이청용 | 남 | 1968.12 | 부사장 | 상근 | SAVINA-S법인장 | Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원 | MIT(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이충순 | 남 | 1967.09 | 부사장 | 상근 | CIS총괄 | 영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이태관 | 남 | 1971.12 | 부사장 | 상근 | 법무실 담당임원 | 삼성물산 법무팀 담당임원 | George Washington Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이학민 | 남 | 1972.04 | 부사장 | 상근 | 사업지원T/F 담당임원 | 네트워크 지원팀장 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-----|----|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|----|
| 이해창 | 남 | 1975.10 | 부사장 | 상근 | System LSI Sensor사업팀 담당 임원 | Google, Sensor Team Lead | Stanford Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 33 |
| 이현 | 남 | 1969.02 | 부사장 | 상근 | 영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원 | TSE-S법인장 | Syracuse Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이현 | 남 | 1971.01 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원 | SEF 담당임원 | Duke Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 임건 | 남 | 1970.03 | 부사장 | 상근 | 반도체연구소 Logic TD실 담당 임원 | Qualcomm, Sr. Director Engineer | Stanford Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 40 |
| 임근휘 | 남 | 1973.05 | 부사장 | 상근 | Big Data센터 담당임원 | Samsung Research AI센터 담 당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |
| 임병일 | 남 | 1970.01 | 부사장 | 상근 | 사업지원T/F 담당임원 | 삼성증권 기업금융1본부장 | Univ. of Chicago(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 임석환 | 남 | 1974.11 | 부사장 | 상근 | DSRA-S.LSI 연구소장 | System LSI 기반설계실 담당임 원 | Stanford Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 54 |
| 임성택 | 남 | 1966.06 | 부사장 | 상근 | 중동총괄 | SEI법인장 | 연세대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 임용식 | 남 | 1971.01 | 부사장 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 메모리 Flash개발실 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |
| 임준서 | 남 | 1968.08 | 부사장 | 상근 | System LSI Sensor사업팀장 | System LSI Sensor사업팀 담당 임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |
| 장상익 | 남 | 1968.07 | 부사장 | 상근 | 영상디스플레이 구매팀 담당임 원 | 영상디스플레이 구매팀 담당임 원 | 경북대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 장성대 | 남 | 1964.08 | 부사장 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터장 | 글로벌 제조&인프라총괄 환경 안전센터장 | 동국대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 장성재 | 남 | 1965.06 | 부사장 | 상근 | 생활가전 담당임원 | 사업지원T/F 담당임원 | 서강대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 장성진 | 남 | 1965.07 | 부사장 | 상근 | TSP총괄 담당임원 | TSP총괄 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | |
| 장세명 | 남 | 1968.01 | 부사장 | 상근 | 기획팀 담당임원 | 삼성글로벌리서치 Tech&Future본부장 | Case Western Reserve Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 장세연 | 남 | 1967.01 | 부사장 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원 | 광운대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 장우승 | 남 | 1970.02 | 부사장 | 상근 | Big Data센터장 | 무선 차세대플랫폼센터 담당임 원 | Univ. of California, Berkeley(박사) | 계열회사 임원 | 51 |
| 장재훈 | 남 | 1969.07 | 부사장 | 상근 | 반도체연구소 Flash TD실장 | 반도체연구소 메모리 TD실 담 당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |
| 장종산 | 남 | 1964.12 | 부사장 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 EHS연구소장 | 글로벌인프라총괄 환경안전연 구소장 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 39 |
| 장호영 | 남 | 1968.01 | 부사장 | 상근 | 네트워크 구매팀장 | 네트워크 Global운영팀 담당임 원 | 경북대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 장호진 | 남 | 1970.09 | 부사장 | 상근 | 법무실 IP센터 담당임원 | 법무실 IP센터 책임변호사 | Duke Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 전경빈 | 남 | 1966.12 | 부사장 | 상근 | 로봇사업팀장 | 로봇사업화T/F장 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |
| 전상욱 | 남 | 1971.01 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 전략기획팀 장 | 삼성글로벌리서치 글로벌전략 실 담당임원 | Washington, Seattle(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 정기봉 | 남 | 1970.01 | 부사장 | 상근 | Foundry Corporate Planning실 담당임원 | DS부문 IP팀 담당임원 | Stanford Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 31 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-----|----|--------------------------------------|--------------------------------------|--|------------|----|
| 정기태 | 남 | 1965.09 | 부사장 | 상근 | Foundry 기술개발실장 | Foundry 기술개발실 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 정상섭 | 남 | 1966.11 | 부사장 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 장 | SAS법인장 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |
| 정상태 | 남 | 1972.01 | 부사장 | 상근 | 생활가전 전략마케팅팀 담당임 원 | SEA 담당임원 | 중앙대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 정서형 | 남 | 1967.05 | 부사장 | 상근 | 네트워크 개발팀 담당임원 | 네트워크 개발2팀 담당임원 | Univ. of Wisconsin, Madison(석사) | 계열회사 임원 | |
| 정성택 | 남 | 1976.09 | 부사장 | 상근 | 신사업T/F장 | Goldman Sachs, SVP | Stanford Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 11 |
| 정완영 | 남 | 1965.05 | 부사장 | 상근 | DS부문 상생협력센터장 | DS부문 중국총괄 담당임원 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 정용준 | 남 | 1969.10 | 부사장 | 상근 | Foundry 품질팀장 | Foundry Corporate Planning실 담당임원 | 서강대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 정윤 | 남 | 1967.05 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 전략마케팅 실장 | SEA 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 정재연 | 여 | 1974.09 | 부사장 | 상근 | 디바이스플랫폼센터 담당임원 | Mobile eXperience 모바일플랫 폼센터 담당임원 | MIT(박사) | 계열회사 임원 | |
| 정재욱 | 남 | 1976.07 | 부사장 | 상근 | Samsung Research Global AI센터 담당임원 | Apple, Sr. Engineering Mgr | Univ. of Waterloo(박사) | 계열회사 임원 | 8 |
| 정재현 | 남 | 1962.09 | 부사장 | 상근 | DS부문 DSA 담당임원 | DS부문 미주총괄 | Univ. of Southern California(박사) | 계열회사 임원 | |
| 정진민 | 남 | 1972.12 | 부사장 | 상근 | Samsung Research S/W혁신 센터장 | Samsung Research Platform팀장 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |
| 정혁준 | 남 | 1972.05 | 부사장 | 상근 | System LSI AP개발실 담당임원 | System LSI SOC개발실 담당임 원 | Univ. of Southern California(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 정현준 | 남 | 1964.06 | 부사장 | 상근 | 생활가전 Global제조팀장 | 영상디스플레이 Micro LED팀장 | 한양대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 정호진 | 남 | 1971.05 | 부사장 | 상근 | 한국총괄 MX팀장 | 한국총괄 CE영업팀장 | Rutgers Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 정훈 | 남 | 1969.01 | 부사장 | 상근 | 영상디스플레이 Enterprise Business팀장 | 영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원 | 홍익대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 조기재 | 남 | 1967.01 | 부사장 | 상근 | DS부문 지원팀장 | 사업지원T/F 담당임원 | Babson College(석사) | 계열회사 임원 | |
| 조명호 | 남 | 1969.05 | 부사장 | 상근 | 영상디스플레이 개발팀 담당임 원 | 감사팀 담당임원 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 조상연 | 남 | 1971.12 | 부사장 | 상근 | 메모리 Solution개발실 담당임 원 | System LSI A-Project팀장 | Univ. of Minnesota, Twin Cities(박사) | 계열회사 임원 | |
| 조상호 | 남 | 1965.02 | 부사장 | 상근 | 동남아총괄 | 구주총괄 | 경희대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 조성대 | 남 | 1969.06 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | 무선 개발1실 담당임원 | RPI(박사) | 계열회사 임원 | |
| 조성혁 | 남 | 1970.05 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원 | 영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원 | Univ. of California, Berkeley(석사) | 계열회사 임원 | |
| 조시정 | 남 | 1969.11 | 부사장 | 상근 | People팀 담당임원 | Mobile eXperience 인사팀장 | 경희대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 조영준 | 남 | 1971.05 | 부사장 | 상근 | 북미총괄 People팀장 | 네트워크 인사팀장 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------|-----|----|--|--------------------------------|--|------------|----|
| 조용 | 남 | 1972.08 | 부사장 | 상근 | 법무실 담당임원 | SDI 법무팀장 | 한양대(학사) | 계열회사 임원 | 15 |
| 조인하 | 여 | 1974.02 | 부사장 | 상근 | SEUK법인장 | SENA법인장 | 서강대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 조필주 | 남 | 1971.07 | 부사장 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 지원 팀장 | 종합기술원 기획지원팀장 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 조홍상 | 남 | 1966.06 | 부사장 | 상근 | 중남미총괄 | SEF법인장 | 연세대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 주드버클 리 | 남 | 1970.05 | 부사장 | 상근 | SEA 담당임원 | SEA EVP | Queensland Univ.(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 주영수 | 남 | 1965.08 | 부사장 | 상근 | 성균관대(파견) | 삼성생명서비스 고객지원실 담 당임원 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 주은기 | 남 | 1962.01 | 부사장 | 상근 | 상생협력센터장 | 상생협력센터 담당임원 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | |
| 주창훈 | 남 | 1970.10 | 부사장 | 상근 | 사업지원T/F 담당임원 | 인사팀 담당임원 | 아주대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 주혁 | 남 | 1971.10 | 부사장 | 상근 | S.LSI 전략마케팅실 담당임원 | 종합기술원 Device연구센터 담 당임원 | Univ. of California, Berkeley(박사) | 계열회사 임원 | |
| 지현기 | 남 | 1968.01 | 부사장 | 상근 | 메모리 기획팀장 | SCS 담당임원 | Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(석사) | 계열회사 임원 | |
| 짐엘리엇 | 남 | 1970.11 | 부사장 | 상근 | DS부문 DSA 담당임원 | 미주총괄 VP | California Polytechnic State Univ.(학사) | 계열회사 임원 | |
| 차병석 | 남 | 1968.11 | 부사장 | 상근 | 커뮤니케이션팀 담당임원 | 삼성경제연구소 연구조정실 담 당임원 | Helsinki Sch. Of Economics & Business Administration(석사) | 계열회사 임원 | 22 |
| 채원철 | 남 | 1966.05 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience CX실 담 당임원 | 무선 상품전략팀장 | 광운대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 최강석 | 남 | 1965.12 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience Global Mobile B2B팀장 | 무선 Global Mobile B2B팀 담 당임원 | Univ of California, Irvine(학 사) | 계열회사 임원 | 44 |
| 최경세 | 남 | 1969.04 | 부사장 | 상근 | AVP사업팀 AVP개발실장 | TSP총괄 Package개발실장 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 최광보 | 남 | 1971.03 | 부사장 | 상근 | 사업지원T/F 담당임원 | 북미총괄 지원팀장 | 부산대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 최성현 | 남 | 1970.05 | 부사장 | 상근 | Samsung Research 차세대통 신연구센터장 | 서울대, 교수 | Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사) | 계열회사 임원 | 46 |
| 최승걸 | 남 | 1968.12 | 부사장 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 글로 벌EHS/인프라센터장 | 글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터장 | 서울시립대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 최승범 | 남 | 1964.12 | 부사장 | 상근 | 디바이스플랫폼센터장 | Samsung Research 기술전략 팀장 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | |
| 최승식 | 남 | 1966.01 | 부사장 | 상근 | 중국총괄 | 무선 전략마케팅실 담당임원 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 최승은 | 여 | 1969.07 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 마케팅팀장 | 무선 GDC센터 담당임원 | 서강대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 최승훈 | 남 | 1970.10 | 부사장 | 상근 | 상생협력센터 담당임원 | 생명 기획팀장 | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 최완우 | 남 | 1965.02 | 부사장 | 상근 | DS부문 People팀장 | 메모리 인사팀장 | 서강대(학사) | 계열회사 임원 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------|-----|----|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------|----|
| 최용원 | 남 | 1968.05 | 부사장 | 상근 | 설비기술연구소 설비개발실장 | 생산기술연구소 설비개발실장 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 최용훈 | 남 | 1969.07 | 부사장 | 상근 | 영상디스플레이 담당임원 | 영상디스플레이 Global운영팀 장 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 최원준 | 남 | 1970.09 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience 개발실장 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | Stanford Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 최윤준 | 남 | 1967.09 | 부사장 | 상근 | LED사업팀장 | LED사업팀 담당임원 | MIT(박사) | 계열회사 임원 | |
| 최익수 | 남 | 1967.05 | 부사장 | 상근 | 생활가전 전략마케팅팀장 | SESA법인장 | Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(석사) | 계열회사 임원 | |
| 최정준 | 남 | 1965.08 | 부사장 | 상근 | 지원팀장 | 지원팀 담당임원 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 최주호 | 남 | 1963.03 | 부사장 | 상근 | 베트남복합단지장 | 무선 인사팀장 | 아주대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 최진원 | 남 | 1966.09 | 부사장 | 상근 | 재경팀 담당임원 | 재경팀 담당부장 | 서울대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 최진한 | 남 | 1973.05 | 부사장 | 상근 | 설비기술연구소 설비개발실 담 당임원 | AMAT, Managing Director | Univ. Of Arizona(박사수료) | 계열회사 임원 | 8 |
| 최진혁 | 남 | 1967.02 | 부사장 | 상근 | DSRA-Memory 연구소장 | 메모리 Solution개발실장 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 최창규 | 남 | 1970.03 | 부사장 | 상근 | SAIT AI Research Center장 | 종합기술원 AI&SW연구센터장 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |
| 추종석 | 남 | 1962.09 | 부사장 | 상근 | 상생협력센터 담당임원 | 구주총괄 | Univ. of Missouri, Columbia(석사) | 계열회사 임원 | |
| 패트릭쇼 메 | 남 | 1964.05 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience CX실장 | 무선 서비스사업실 담당임원 | Institut d administration des entreprises(석사) | 계열회사 임원 | |
| 피재걸 | 남 | 1964.04 | 부사장 | 상근 | System LSI 전략마케팅실장 | System LSI 전략마케팅실 담 당임원 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 한상숙 | 여 | 1966.07 | 부사장 | 상근 | 영상디스플레이 Service Business팀 담당임원 | 영상디스플레이 Service Business팀 담당임원 | Northwestern Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 한인택 | 남 | 1966.10 | 부사장 | 상근 | SAIT Material Research Center장 | 종합기술원 Material연구센터 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 한지니 | 여 | 1969.04 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience Digital Wallet팀장 | Mobile eXperience Digital Life팀장 | Univ. of Southern California(박사) | 계열회사 임원 | 34 |
| 한진만 | 남 | 1966.10 | 부사장 | 상근 | DS부문 DSA총괄 | 메모리 전략마케팅실장 | 서울대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 허길영 | 남 | 1965.08 | 부사장 | 상근 | DS부문 재경팀장 | DS부문 재경팀 담당임원 | 아주대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 허석 | 남 | 1973.10 | 부사장 | 상근 | DS부문 기획팀장 | DS부문 기획팀 담당임원 | Stanford Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 허성희 | 남 | 1969.01 | 부사장 | 상근 | 메모리 Flash개발실장 | 메모리 Flash개발실 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |
| 홍기채 | 남 | 1969.06 | 부사장 | 상근 | 법무실 담당임원 | 법무법인 다전, 변호사 | 한양대(학사) | 계열회사 임원 | 24 |
| 홍두희 | 남 | 1964.02 | 부사장 | 상근 | 감사팀장 | 무선 지원팀장 | Wake Forest Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 홍범석 | 남 | 1968.06 | 부사장 | 상근 | 아프리카총괄 | Iran지점장 | 중앙대(학사) | 계열회사 임원 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-----|----|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|----|
| 홍석준 | 남 | 1970.07 | 부사장 | 상근 | DS부문 담당임원 | Fairchild, Principal Engineer | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 1 |
| 홍성민 | 남 | 1969.06 | 부사장 | 상근 | Foundry People팀장 | 글로벌인프라총괄 인사팀장 | Univ. of Texas, Austin(석사) | 계열회사 임원 | |
| 홍성희 | 남 | 1966.02 | 부사장 | 상근 | DS부문 구매팀 담당임원 | DS부문 일본총괄 담당임원 | 서강대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 홍승완 | 남 | 1971.06 | 부사장 | 상근 | 메모리 Flash개발실 담당임원 | 반도체연구소 메모리 TD실 담당임원 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 홍영기 | 남 | 1970.03 | 부사장 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | Foundry 기술개발실 담당임원 | Imperial College(박사) | 계열회사 임원 | |
| 홍유진 | 여 | 1972.05 | 부사장 | 상근 | Mobile eXperience CX실 담당임원 | 무선 Mobile UX센터 담당임원 | Univ. of California, LA(석사) | 계열회사 임원 | |
| 홍형선 | 남 | 1963.08 | 부사장 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 반도체연구소 메모리 TD실장 | 인하대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 황경순 | 남 | 1968.08 | 부사장 | 상근 | SAIT Air Science Research Center장 | UT Austin, 교수 | Caltech(박사) | 계열회사 임원 | 1 |
| 황기현 | 남 | 1967.06 | 부사장 | 상근 | 제조담당 제조시너지팀장 | 반도체연구소 공정개발실 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 황상준 | 남 | 1972.01 | 부사장 | 상근 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | 메모리 DRAM개발실 담당임원 | 고려대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 황태환 | 남 | 1968.04 | 부사장 | 상근 | 한국총괄 CE팀장 | 한국총괄 CE영업팀장 | 경희대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 황하섭 | 남 | 1964.03 | 부사장 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터장 | SCS법인장 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 강건혁 | 남 | 1978.11 | 상무 | 상근 | System LSI Design Platform개발팀 담당임원 | System LSI 기반설계실 담당임원 | Purdue Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 22 |
| 강도희 | 남 | 1974.12 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담당임원 | 무선 품질혁신센터 담당임원 | 경북대(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 강동구 | 남 | 1976.12 | 상무 | 상근 | 메모리 Flash개발실 담당임원 | 메모리 Flash개발실 수석 | Purdue Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 강동우 | 남 | 1971.04 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 AVP제조기술센터장 | TSP총괄 Package개발실 담당임원 | 한양대(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 강동훈 | 남 | 1970.12 | 상무 | 상근 | DS부문 법무지원팀 담당임원 | 법무실 담당임원 | Georgetown Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 강명진 | 남 | 1977.02 | 상무 | 상근 | Foundry 기술개발실 담당임원 | Foundry 기술개발실 수석 | 연세대(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 강민석 | 남 | 1976.10 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience CX실 담당임원 | 무선 CX실 담당부장 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 강병욱 | 남 | 1967.02 | 상무 | 상근 | 한국총괄 CE팀 담당임원 | 한국총괄 CE영업팀 담당부장 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 강보경 | 여 | 1976.12 | 상무 | 상근 | System LSI Design Platform개발팀 담당임원 | System LSI Design Platform개발팀 수석 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 강상용 | 남 | 1972.09 | 상무 | 상근 | 전장사업팀 담당임원 | SEG 담당임원 | Univ. of Pennsylvania(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 강석채 | 남 | 1971.06 | 상무 | 상근 | DS부문 DSA 담당임원 | Foundry 전략마케팅실 담당임원 | Georgia Inst. of Tech.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 강성욱 | 남 | 1971.05 | 상무 | 상근 | 지원팀 담당임원 | SEUK 담당부장 | Univ. of Southern California(석사) | 계열회사 임원 | 42 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---------|----|----|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------|----|
| 강신광 | 남 | 1968.08 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원 | 아주대(석사) | 계열회사 임원 | 27 |
| 강윤경 | 여 | 1968.12 | 상무 | 상근 | People팀 담당임원 | Samsung Research 창의개발센터 담당임원 | Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사) | 계열회사 임원 | |
| 강은경 | 여 | 1972.08 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 개발팀 담당임원 | 영상디스플레이 개발팀 수석 | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 강정대 | 남 | 1970.09 | 상무 | 상근 | 재경팀 담당임원 | 상생협력센터 담당부장 | 한국방송통신대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 강진선 | 남 | 1975.09 | 상무 | 상근 | 한국총괄 CE팀 담당임원 | 한국총괄 CE영업팀 담당부장 | 한국외국어대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 강태규 | 남 | 1972.01 | 상무 | 상근 | IR팀 담당임원 | IR그룹 담당임원 | Indiana Univ., Bloomington(석사) | 계열회사 임원 | |
| 강태우 | 남 | 1973.10 | 상무 | 상근 | 재경팀 담당임원 | 재경팀 담당부장 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 강혁 | 남 | 1984.10 | 상무 | 상근 | 생산기술연구소 담당임원 | 생산기술연구소 스마트팩토리팀 담당부장 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 강희성 | 남 | 1970.08 | 상무 | 상근 | Foundry 기술개발실 담당임원 | 글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원 | 포항공대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 고경민 | 남 | 1975.03 | 상무 | 상근 | System LSI Sensor사업팀 담당임원 | System LSI LSI개발실 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |
| 고광현 | 남 | 1968.08 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담당임원 | Intel, Senior Technical Staff | Stanford Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 고상원 | 남 | 1979.11 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 구매팀 담당임원 | Flex, Sr. Director | Stanford Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 고승범 | 남 | 1971.07 | 상무 | 상근 | 메모리 품질실 담당임원 | 메모리 Design Platform개발실 담당임원 | 아주대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 고알시드 | 남 | 1977.12 | 상무 | 상근 | 글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원 | Accenture, Mng. Director | Univ. of Sydney(석사) | 계열회사 임원 | 35 |
| 고영관 | 남 | 1972.06 | 상무 | 상근 | TSP총괄 Package개발실 담당임원 | 삼성전기 중앙연구소 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 49 |
| 고의중 | 남 | 1972.02 | 상무 | 상근 | 법무실 담당임원 | 법무실 수석변호사 | 서울대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 고정욱 | 남 | 1976.02 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원 | 한국총괄 IM영업팀 담당임원 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 고주현 | 남 | 1974.08 | 상무 | 상근 | System LSI Sensor사업팀 담당임원 | System LSI Sensor사업팀 수석 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 고택균 | 남 | 1971.05 | 상무 | 상근 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | DS부문 중국총괄 담당부장 | 서강대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 고형석 | 남 | 1972.09 | 상무 | 상근 | SEA 담당임원 | 무선 전략마케팅실 담당임원 | Case Western Reserve Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 공병진 | 남 | 1971.09 | 상무 | 상근 | SIEL-P(C)공장장 | 생활가전 Global운영팀 담당부장 | 항공대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 곽진환 | 남 | 1968.01 | 상무 | 상근 | SAIT 미래기술육성센터장 | SRIL연구소장 | Santa Clara Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 구관본 | 남 | 1975.01 | 상무 | 상근 | System LSI LSI개발실 담당임원 | On Semiconductor, Director | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 24 |
| 구봉진 | 여 | 1971.05 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 공정개발실 담당임원 | 반도체연구소 공정개발실 수석 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 31 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|------------------------------------|---|---|------------|----|
| 구윤본 | 남 | 1970.02 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 담당 임원 | 글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원 | 한양대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 구자천 | 남 | 1981.04 | 상무 | 상근 | 사업지원T/F 담당임원 | System LSI 기획팀장 | Northwestern Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 45 |
| 권기덕 | 남 | 1972.07 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | SCS 담당임원 | 경북대(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 권기덕 | 여 | 1974.10 | 상무 | 상근 | 기획팀 담당임원 | 기획팀 담당부장 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 권기덕 | 남 | 1977.10 | 상무 | 상근 | 법무실 담당임원 | DS부문 법무지원팀 수석변호사 | 서울대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 권상욱 | 남 | 1968.08 | 상무 | 상근 | Samsung Research 차세대가 전연구팀 담당임원 | SRUK연구소장 | Univ. of Southern California(박사) | 계열회사 임원 | |
| 권순범 | 남 | 1976.09 | 상무 | 상근 | 법무실 담당임원 | 법무실 수석변호사 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 권영재 | 남 | 1972.05 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | 무선 개발실 수석 | 한양대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 권영훈 | 남 | 1972.02 | 상무 | 상근 | 네트워크 개발팀 담당임원 | NXP, Technical Director | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 24 |
| 권오경 | 남 | 1977.08 | 상무 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 권욱 | 남 | 1978.07 | 상무 | 상근 | 글로벌마케팅실 D2C센터 담당 임원 | Lazada, CMO | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 13 |
| 권정현 | 남 | 1980.03 | 상무 | 상근 | Samsung Research Robot센 터 담당임원 | NVIDIA, Senior S/W Engineering Manager | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 5 |
| 권진현 | 남 | 1968.07 | 상무 | 상근 | System LSI Sensor사업팀 담당 임원 | System LSI Sensor사업팀 담당 부장 | Thunderbird(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 권춘기 | 남 | 1969.04 | 상무 | 상근 | 생활가전 Global제조팀 담당임 원 | SEEG-P법인장 | 포항공대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 권태훈 | 남 | 1971.02 | 상무 | 상근 | SEA 담당임원 | 경영혁신센터 담당임원 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 권혁만 | 남 | 1973.06 | 상무 | 상근 | System LSI 전략마케팅실 담당 임원 | System LSI 상품기획팀 담당임 원 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 권혁우 | 남 | 1973.07 | 상무 | 상근 | Global Public Affairs팀 담당임 원 | 산업통상자원부 과장 | The Johns Hopkins Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 12 |
| 권형석 | 남 | 1973.02 | 상무 | 상근 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | DS부문 동남아총괄 담당임원 | 서강대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 권호범 | 남 | 1975.12 | 상무 | 상근 | Samsung Research Platform팀장 | Samsung Research Platform팀 담당임원 | New York Univ., Tandon School of Engineering(석 사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 김강수 | 남 | 1966.09 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 인프라QA팀 장 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김건우 | 남 | 1976.01 | 상무 | 상근 | SEH-P 담당임원 | 영상디스플레이 지원팀 담당부 장 | MIT(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김경륜 | 남 | 1983.02 | 상무 | 상근 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | 메모리 DRAM개발실 수석 | Stanford Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김경준 | 남 | 1969.01 | 상무 | 상근 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | DS부문 미주총괄 담당임원 | 광운대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|---------------------------------------|---|---|------------|----|
| 김경태 | 남 | 1973.12 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원 | 부산대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 김경태 | 남 | 1973.07 | 상무 | 상근 | 한국총괄 마케팅팀 담당임원 | 한국총괄 IMC팀 담당부장 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 김광연 | 남 | 1965.07 | 상무 | 상근 | 생활가전 Global제조팀 담당임 원 | 영상디스플레이 개발팀 담당임 원 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김광익 | 남 | 1974.09 | 상무 | 상근 | DS부문 지원팀 담당임원 | 글로벌인프라총괄 펌웨어사업장 담당부장 | 한양대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김광훈 | 남 | 1975.02 | 상무 | 상근 | SEDA-P(C)공장장 | Mobile eXperience Global제조 센터 담당부장 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 김구영 | 남 | 1975.03 | 상무 | 상근 | AVP사업팀 AVP개발실 담당임 원 | TSP총괄 Package개발실 수석 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김기남 | 남 | 1964.08 | 상무 | 상근 | SAIT Material Research Center 담당임원 | DMC연구소 ECO Solution팀 담당임원 | Stevens Inst. of Tech.(박 사) | 계열회사 임원 | |
| 김기수 | 남 | 1970.02 | 상무 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김기수 | 남 | 1976.05 | 상무 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | 글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 수석 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 김기연 | 남 | 1972.06 | 상무 | 상근 | DS부문 DSC 담당임원 | DS부문 DSC 수석 | 한양대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 김기호 | 남 | 1966.03 | 상무 | 상근 | SRA 담당임원 | SRI-Delhi연구소장 | George Washington Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김기환 | 남 | 1975.03 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | NVIDIA, Principal Research Scientist | Georgia Inst. of Tech.(박 사) | 계열회사 임원 | 39 |
| 김대신 | 남 | 1970.03 | 상무 | 상근 | 혁신센터 담당임원 | DIT센터 담당임원 | Georgia Inst. of Tech.(박 사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 김대우 | 남 | 1970.03 | 상무 | 상근 | AVP사업팀 AVP개발실 담당임 원 | 반도체연구소 Package개발팀 담당임원 | 연세대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 김대현 | 남 | 1974.08 | 상무 | 상근 | SME법인장 | Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당부장 | 경북대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 김덕현 | 남 | 1975.06 | 상무 | 상근 | 상생협력센터 담당임원 | 메타볼라이트, Co-Founder | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | 41 |
| 김덕호 | 남 | 1970.11 | 상무 | 상근 | 생활가전 S/W개발팀 담당임원 | SRI-Delhi연구소장 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 김도기 | 남 | 1975.05 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 People팀장 | 인사팀 담당부장 | 숭실대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 김동근 | 남 | 1976.07 | 상무 | 상근 | System LSI AP개발실 담당임원 | System LSI SOC개발실 수석 | Univ. of Maryland, College Park(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김동수 | 남 | 1975.10 | 상무 | 상근 | DS부문 People팀 담당임원 | DS부문 인사팀 담당부장 | Univ. of Maryland, College Park(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김동욱 | 남 | 1969.06 | 상무 | 상근 | AVP사업팀 AVP개발실 담당임 원 | Test&Package센터 담당임원 | Univ. of California, Irvine(박사) | 계열회사 임원 | |
| 김동준 | 남 | 1973.05 | 상무 | 상근 | TSLED법인장 | 글로벌인프라총괄 LED기술센 터 담당임원 | 광주과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |
| 김래훈 | 남 | 1975.07 | 상무 | 상근 | System LSI AP개발실 담당임원 | System LSI 기반설계실 담당임 원 | Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(박사) | 계열회사 임원 | 27 |
| 김룡 | 남 | 1971.12 | 상무 | 상근 | People팀 담당임원 | 무선 인사팀 담당임원 | 중앙대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|----|
| 김명오 | 남 | 1972.09 | 상무 | 상근 | 메모리 DRAM개발실 담당임원 | 메모리 DRAM개발실 수석 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 김무성 | 남 | 1975.12 | 상무 | 상근 | 메모리 Flash개발실 담당임원 | 메모리 Flash개발실 수석 | 포항공대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김문수 | 남 | 1977.12 | 상무 | 상근 | SRI-Delhi연구소장 | 영상디스플레이 개발팀 담당임원 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 김민우 | 남 | 1978.06 | 상무 | 상근 | TSE-S 담당임원 | SESP법인장 | 한양대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 김범진 | 남 | 1975.02 | 상무 | 상근 | SEAU 담당임원 | SERC 담당임원 | Southern Illinois Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 김보성 | 남 | 1974.04 | 상무 | 상근 | Samsung Research 담당임원 | Awair, CDO | Royal Collge of Art(석사) | 계열회사 임원 | 16 |
| 김보창 | 남 | 1977.09 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 메모리 Flash개발실 수석 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 김봉수 | 남 | 1971.06 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원 | 반도체연구소 메모리 TD실 담당임원 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 김상윤 | 남 | 1972.01 | 상무 | 상근 | 생활가전 전략마케팅팀 담당임원 | SECE법인장 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 김상윤 | 남 | 1969.10 | 상무 | 상근 | Foundry Design Platform개발실 담당임원 | Synopsys, Technical Member | Univ. of Southern California(박사) | 계열회사 임원 | 41 |
| 김상호 | 남 | 1967.10 | 상무 | 상근 | SRA 담당임원 | 네트워크 지원팀 담당임원 | Duke Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김상훈 | 남 | 1968.02 | 상무 | 상근 | SEI 담당임원 | SENA 담당임원 | 건국대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김석희 | 남 | 1971.11 | 상무 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원 | 부산대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 김선길 | 남 | 1974.11 | 상무 | 상근 | 생활가전 Global CS팀 담당임원 | 생활가전 Global CS팀 담당부장 | 전남대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 김선정 | 남 | 1973.02 | 상무 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 수석 | National Univ. of Singapore(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김성권 | 남 | 1971.02 | 상무 | 상근 | 디자인경영센터 담당임원 | 디자인경영센터 수석 | 홍익대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 김성기 | 남 | 1968.11 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원 | 북미총괄 CS팀장 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김성민 | 남 | 1976.03 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 지원팀 담당임원 | SEA 담당부장 | Univ. of Southern California(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김성은 | 남 | 1968.11 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 구매팀 담당임원 | 무선 기술전략팀 담당임원 | 항공대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김성은 | 남 | 1970.05 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담당임원 | 무선 개발실 수석 | 경북대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 김성한 | 남 | 1970.05 | 상무 | 상근 | Foundry Corporate Planning실 담당임원 | Foundry 전략마케팅실 담당임원 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김세진 | 여 | 1973.07 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원 | Mobile eXperience 전략마케팅실 담당부장 | Duke Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 김세훈 | 남 | 1975.01 | 상무 | 상근 | 커뮤니케이션팀 담당임원 | 커뮤니케이션팀 담당부장 | 중앙대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 김수련 | 여 | 1967.04 | 상무 | 상근 | AVP사업팀 AVP개발실 담당임원 | 메모리제조기술센터 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|-------------------------------------|-----------------------------------|---|------------|----|
| 김수형 | 남 | 1972.08 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원 | 영상디스플레이 개발팀 담당임 원 | MIT(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 김수홍 | 남 | 1972.11 | 상무 | 상근 | 설비기술연구소 설비개발실 담 당임원 | 생산기술연구소 설비개발실 담 당임원 | Stanford Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 김승연 | 여 | 1975.04 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원 | Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 김승일 | 남 | 1970.07 | 상무 | 상근 | 네트워크 전략마케팅 담당임 원 | 네트워크 전략마케팅 담당부 장 | 단국대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김시우 | 남 | 1972.10 | 상무 | 상근 | System LSI LSI개발실 담당임 원 | System LSI LSI개발실 수석 | 단국대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 김신 | 남 | 1971.12 | 상무 | 상근 | 생활가전 개발팀 담당임원 | 생활가전 개발팀 수석 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김연정 | 남 | 1975.12 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 구매팀 담 당임원 | 무선 상품전략팀 담당임원 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김영대 | 남 | 1968.10 | 상무 | 상근 | Foundry 기술개발실 담당임원 | Foundry 제품기술팀장 | 동국대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김영무 | 남 | 1976.09 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원 | 영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당부장 | The Johns Hopkins Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김영우 | 남 | 1972.12 | 상무 | 상근 | DS부문 기획팀 담당임원 | 삼성글로벌리서치, 담당임원 | Columbia Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 1 |
| 김영일 | 남 | 1974.12 | 상무 | 상근 | DS부문 DSA 담당임원 | DS부문 미주총괄 담당부장 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 김영정 | 남 | 1972.03 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 수석 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김영주 | 남 | 1973.07 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 평택사업장 수석 | 한양대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김영집 | 남 | 1979.05 | 상무 | 상근 | 네트워크 개발팀 담당임원 | 네트워크 개발팀 수석 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 김용관 | 남 | 1976.04 | 상무 | 상근 | DS부문 구매팀 담당임원 | Apple, Manager | Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(박사) | 계열회사 임원 | 41 |
| 김용상 | 남 | 1972.08 | 상무 | 상근 | Foundry Corporate Planning실 담당임원 | Foundry 전략마케팅실 담당임 원 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 김용성 | 남 | 1973.09 | 상무 | 상근 | SAIT Device Research Center장 | 종합기술원 Material연구센터 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 김용완 | 남 | 1970.04 | 상무 | 상근 | 메모리 Global운영팀장 | 메모리 Global운영팀 담당부장 | 연세대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 김용찬 | 남 | 1969.03 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원 | 경희대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 김용한 | 남 | 1976.02 | 상무 | 상근 | 생활가전 선행개발팀 담당임원 | 생활가전 선행개발팀 수석 | 고려대(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김용훈 | 남 | 1972.11 | 상무 | 상근 | 생활가전 전략마케팅팀 담당임 원 | 생활가전 전략마케팅팀 담당부 장 | 한양대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 김우년 | 남 | 1970.09 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | Qualcomm, Principal Engineer | 포항공대(박사) | 계열회사 임원 | 54 |
| 김원국 | 남 | 1975.11 | 상무 | 상근 | 네트워크 개발팀 담당임원 | 네트워크 개발팀 수석 | 경북대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김원우 | 남 | 1970.03 | 상무 | 상근 | SEDA-S 담당임원 | 영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|----|
| 김원희 | 남 | 1971.04 | 상무 | 상근 | SEAU법인장 | SEAU 담당임원 | Mcgill Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 김유나 | 여 | 1979.01 | 상무 | 상근 | SRPOL연구소장 | Samsung Research Platform팀 수석 | 포항공대(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김윤재 | 남 | 1973.02 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 공정개발실 담당 임원 | 반도체연구소 메모리 TD실 담 당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 김은경 | 여 | 1974.04 | 상무 | 상근 | 메모리 Flash개발실 담당임원 | 메모리 Flash개발실 수석 | 단국대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 김은용 | 남 | 1979.02 | 상무 | 상근 | 네트워크 개발팀 담당임원 | 네트워크 개발팀 수석 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 김은하 | 여 | 1971.05 | 상무 | 상근 | 법무실 IP센터 담당임원 | 법무실 IP센터 수석 | Univ. of Southern California(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 김이태 | 남 | 1971.01 | 상무 | 상근 | System LSI Sensor사업팀 담당 임원 | System LSI Sensor사업팀 수석 | 포항공대(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 김인범 | 남 | 1973.05 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원 | 영상디스플레이 개발팀 수석 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 김인형 | 남 | 1973.12 | 상무 | 상근 | System LSI CP개발실 담당임 원 | System LSI SOC개발실 담당임 원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 김일룡 | 남 | 1974.02 | 상무 | 상근 | System LSI Global Operation실 담당임원 | System LSI 기반설계실 담당임 원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 김장환 | 남 | 1975.08 | 상무 | 상근 | 설비기술연구소 설비개발실 담 당임원 | 생산기술연구소 설비개발실 담 당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 김재성 | 남 | 1972.04 | 상무 | 상근 | SEA 담당임원 | 영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 김재영 | 남 | 1971.11 | 상무 | 상근 | SECA 담당임원 | SIEL-S 담당임원 | 포항공대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 김재윤 | 남 | 1970.07 | 상무 | 상근 | 경영혁신센터 담당임원 | 전장사업팀 담당임원 | Georgetown Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 김재진 | 남 | 1969.11 | 상무 | 상근 | People팀 담당임원 | 인사팀 담당임원 | 항공대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 김재홍 | 남 | 1973.03 | 상무 | 상근 | 지원팀 담당임원 | 무선 지원팀 담당부장 | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 김재환 | 남 | 1969.07 | 상무 | 상근 | 법무실 IP센터 담당임원 | 법무실 IP센터 수석변호사 | The Ohio State Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 김재훈 | 남 | 1974.12 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | Facebook, S/W Engineer | Univ. of Southern California(박사) | 계열회사 임원 | 21 |
| 김정봉 | 남 | 1965.07 | 상무 | 상근 | 육상연맹(파견) | SSC 담당임원 | 부산대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김정현 | 남 | 1972.12 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원 | DL E&C, 전무 | 경희대(석사) | 계열회사 임원 | 8 |
| 김정호 | 남 | 1972.01 | 상무 | 상근 | 생활가전 지원팀 담당임원 | 기획팀 담당임원 | Georgetown Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 김종균 | 남 | 1966.08 | 상무 | 상근 | 경영혁신센터 담당임원 | 정보전략팀 담당부장 | 경상대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김종근 | 남 | 1967.06 | 상무 | 상근 | 생산기술연구소 담당임원 | 글로벌기술센터 담당임원 | 경북대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김종민 | 남 | 1968.03 | 상무 | 상근 | SSC 담당임원 | 전장사업팀 담당임원 | Univ. of Pennsylvania(석사) | 계열회사 임원 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|--|-------------------------------------|---|------------|----|
| 김중훈 | 남 | 1969.12 | 상무 | 상근 | 메모리 품질실 담당임원 | 메모리 DRAM개발실 담당임원 | 중앙대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김주연 | 남 | 1974.12 | 상무 | 상근 | Foundry 기술개발실 담당임원 | Foundry 기술개발실 수석 | 한양대(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 김준석 | 남 | 1972.10 | 상무 | 상근 | System LSI Project Management팀장 | System LSI SOC개발실 담당임 원 | 연세대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 김준성 | 남 | 1975.08 | 상무 | 상근 | Foundry Corporate Planning실 담당임원 | Foundry Corporate Planning실 담당부장 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 김준엽 | 남 | 1969.10 | 상무 | 상근 | SEHC 담당임원 | SESK 담당임원 | 경기대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김중정 | 남 | 1973.11 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원 | 東北大(박사) | 계열회사 임원 | |
| 김지영 | 남 | 1970.04 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 반도체연구소 메모리TD실 담당 임원 | Univ. of California, LA(박 사) | 계열회사 임원 | |
| 김지용 | 남 | 1975.06 | 상무 | 상근 | SEA 담당임원 | SEA 담당부장 | Syracuse Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 김지윤 | 여 | 1975.02 | 상무 | 상근 | People팀 담당임원 | 인사팀 담당임원 | Cornell Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 김지훈 | 남 | 1971.08 | 상무 | 상근 | 한국총괄 B2B팀 담당임원 | 한국총괄 B2B영업팀 담당임원 | 서강대(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김진교 | 남 | 1973.05 | 상무 | 상근 | 상생협력센터 담당임원 | 베트남복합단지 담당부장 | 경찰대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김진기 | 남 | 1972.01 | 상무 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 수석 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김진성 | 남 | 1971.02 | 상무 | 상근 | SEVT 담당임원 | 지원팀 담당임원 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 김진주 | 남 | 1969.05 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 평택사업장 담당임원 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김진호 | 남 | 1977.01 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 담당 임원 | 글로벌 제조&인프라총괄 수석 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 김찬호 | 남 | 1975.06 | 상무 | 상근 | SEIB 담당임원 | 영상디스플레이 지원팀 담당임 원 | Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 김창용 | 남 | 1973.04 | 상무 | 상근 | SAIT People팀장 | 종합기술원 담당부장 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김창태 | 남 | 1972.01 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | 무선 개발실 수석 | 금오공대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김철주 | 남 | 1976.07 | 상무 | 상근 | SRR연구소장 | SRR 수석 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 김태경 | 남 | 1971.03 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 Flash TD실 담당 임원 | Intel, Principal Engineer | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 2 |
| 김태균 | 남 | 1976.02 | 상무 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 수석 | RPI(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김태균 | 남 | 1969.01 | 상무 | 상근 | AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원 | DS부문 지원팀 담당임원 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김태수 | 남 | 1971.11 | 상무 | 상근 | 한국총괄 CE팀 담당임원 | 한국총괄 CE영업팀 담당임원 | 부산대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 김태수 | 남 | 1985.03 | 상무 | 상근 | Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원 | Samsung Research Security팀 담당임원 | MIT(박사) | 계열회사 임원 | 26 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|----|
| 김태우 | 남 | 1971.05 | 상무 | 상근 | 메모리 기획팀 담당임원 | DS부문 기획팀 담당임원 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 김태정 | 남 | 1972.12 | 상무 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원 | 충북대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 김태중 | 남 | 1971.05 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience CX실 담당 임원 | 무선 디자인팀 담당임원 | 한양대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김태진 | 남 | 1969.01 | 상무 | 상근 | 재경팀 담당임원 | 삼성경제연구소 사회인프라개 발실 담당부장 | George Washington Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김태훈 | 남 | 1970.10 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 김태훈 | 남 | 1973.01 | 상무 | 상근 | 상생협력센터 담당임원 | 감사팀 담당임원 | 단국대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 김평진 | 남 | 1973.12 | 상무 | 상근 | 법무실 담당임원 | 법무실 수석변호사 | 연세대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 김향희 | 여 | 1972.07 | 상무 | 상근 | SEROM법인장 | SEH-S법인장 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김현 | 남 | 1968.07 | 상무 | 상근 | 서남아총괄 대외협력팀장 | SEVT 담당임원 | 서강대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김현근 | 남 | 1973.07 | 상무 | 상근 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | 메모리 전략마케팅실 담당부장 | 경희대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김현기 | 남 | 1973.01 | 상무 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | 글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 수석 | 광운대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 김현덕 | 남 | 1981.06 | 상무 | 상근 | 혁신센터 담당임원 | Meta, Software Engineer | UIUC(박사) | 계열회사 임원 | 6 |
| 김현석 | 남 | 1976.10 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 Flash TD실 담당 임원 | 반도체연구소 메모리 TD실 담 당임원 | 고려대(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김현수 | 남 | 1970.09 | 상무 | 상근 | Samsung Research 기술전략 팀 담당임원 | DMC연구소 기술전략팀 담당임 원 | 성균관대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 김현조 | 남 | 1970.05 | 상무 | 상근 | Foundry 기술개발실 담당임원 | 반도체연구소 Logic TD실 담당 임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 김현중 | 남 | 1977.11 | 상무 | 상근 | 법무실 담당임원 | 법무실 수석변호사 | Columbia Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 김현중 | 남 | 1969.05 | 상무 | 상근 | 한국총괄 e-Commerce팀장 | 한국총괄 CE영업팀 담당임원 | Thunderbird(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 김현철 | 남 | 1969.05 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 CIS TD팀 담당임 원 | 반도체연구소 CIS TD팀 수석 | Texas A&M Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 김형로 | 남 | 1973.01 | 상무 | 상근 | People팀 담당임원 | 인사팀 담당임원 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김형섭 | 남 | 1970.12 | 상무 | 상근 | 상생협력센터 담당임원 | 상생협력센터 담당부장 | 중앙대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 김형재 | 남 | 1970.12 | 상무 | 상근 | SEM-S법인장 | 영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김형준 | 남 | 1972.05 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | 무선 개발실 수석 | 숭실대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 김호균 | 남 | 1968.12 | 상무 | 상근 | 중남미총괄 대외협력팀장 | Samsung Research 인사팀장 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김홍민 | 남 | 1971.10 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience CX실 담당 임원 | 무선 디자인팀 담당임원 | SAIC(석사) | 계열회사 임원 | 46 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|----|----|---|-------------------------------|--|---------|----|
| 김후성 | 남 | 1972.01 | 상무 | 상근 | System LSI Global Operation실 담당임원 | 메모리 품질보증실 담당임원 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 김희승 | 남 | 1970.09 | 상무 | 상근 | DS부문 People팀 담당임원 | SCS 담당임원 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 나현수 | 남 | 1971.06 | 상무 | 상근 | 중국총괄 지원팀장 | 한국총괄 지원팀 담당임원 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 남경인 | 남 | 1973.03 | 상무 | 상근 | SELS법인장 | 경영혁신센터 담당임원 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 남기돈 | 남 | 1972.09 | 상무 | 상근 | 재경팀 담당임원 | CIS총괄 지원팀장 | 중앙대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 남정만 | 남 | 1967.06 | 상무 | 상근 | 생활가전 Global제조팀 담당임원 | 생활가전 구매팀 담당임원 | 전남기계공고(고교) | 계열회사 임원 | |
| 노강호 | 남 | 1978.05 | 상무 | 상근 | 메모리 Solution개발실 담당임원 | 메모리 Solution개발실 수석 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 노경래 | 남 | 1976.12 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원 | SEM-S 담당임원 | 서강대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 노경윤 | 남 | 1972.09 | 상무 | 상근 | 메모리 Flash개발실 담당임원 | Intel, Director | MIT(박사) | 계열회사 임원 | 22 |
| 노미정 | 여 | 1971.04 | 상무 | 상근 | Foundry Corporate Planning실 담당임원 | Foundry Design Platform개발실 수석 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 노수혁 | 남 | 1970.04 | 상무 | 상근 | 생활가전 담당임원 | 생활가전 개발팀 담당임원 | 연세대(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 노승남 | 남 | 1973.04 | 상무 | 상근 | 메모리 지원팀 담당임원 | 사업지원T/F 담당부장 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 노승환 | 남 | 1974.08 | 상무 | 상근 | 생활가전 담당임원 | 생활가전 지원팀 담당임원 | Indiana Univ., Bloomington(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 노태현 | 남 | 1969.09 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원 | 무선 서비스사업실 담당임원 | George Washington Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 다니엘라 라우조 | 남 | 1981.08 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 전략기획팀 담당임원 | 사업지원T/F 담당부장 | Univ. Of Pennsylvania(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 드미트리 | 남 | 1972.07 | 상무 | 상근 | SERC 담당임원 | SERC VP | Moscow Institute of Physics and Technology(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 라병주 | 남 | 1972.05 | 상무 | 상근 | 전장사업팀 담당임원 | 전장사업팀 담당부장 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 류일근 | 남 | 1968.07 | 상무 | 상근 | SEVT 담당임원 | 인사팀 담당임원 | 경북대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 류효경 | 남 | 1980.10 | 상무 | 상근 | Foundry Design Platform개발실 담당임원 | Broadcom, Principal Engineer | Univ. of Michigan(박사) | 계열회사 임원 | 32 |
| 마피유 | 남 | 1981.10 | 상무 | 상근 | 기획팀 담당임원 | 사업지원T/F 담당부장 | MIT(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 명관주 | 남 | 1972.10 | 상무 | 상근 | 생활가전 Global CS팀 담당임원 | 생활가전 개발팀 수석 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 모한 | 남 | 1973.07 | 상무 | 상근 | SRI-Bangalore 담당임원 | SRI-Bangalore VP | Acharya Nagarjuna Univ.(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 목진호 | 남 | 1968.09 | 상무 | 상근 | 생산기술연구소 담당임원 | 글로벌기술센터 담당임원 | 연세대(박사) | 계열회사 임원 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|----|
| 문국열 | 남 | 1969.01 | 상무 | 상근 | SEVT 담당임원 | SVCC 담당임원 | 구미1대(전문대) | 계열회사 임원 | |
| 문진옥 | 남 | 1971.12 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원 | 한양대(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 문형준 | 남 | 1968.07 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 기술기획팀 담당 임원 | System LSI 기획팀장 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | |
| 민병기 | 남 | 1963.02 | 상무 | 상근 | 상생협력센터 담당임원 | 에스원 커뮤니케이션팀 담당임 원 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 민재호 | 남 | 1976.09 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 공정개발실 담당 임원 | 반도체연구소 공정개발실 수석 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 민현진 | 남 | 1974.06 | 상무 | 상근 | 설비기술연구소 설비개발실 담 당임원 | 설비기술연구소 설비개발실 수 석 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 박동욱 | 남 | 1974.01 | 상무 | 상근 | System LSI 기획팀장 | DS부문 기획팀 담당부장 | 한양대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 박두건 | 남 | 1981.01 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 모바일플랫 폼센터 담당임원 | Amazon, Applied Science Mgr | Stanford Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 8 |
| 박래순 | 남 | 1969.05 | 상무 | 상근 | 중국전략협력실 담당임원 | 삼성전기 인사지원 그룹장 | Peking Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 11 |
| 박민규 | 남 | 1976.09 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | 무선 개발실 수석 | 연세대(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 박민철 | 남 | 1972.09 | 상무 | 상근 | 메모리 Flash개발실 담당임원 | 반도체연구소 메모리TD실 담당 임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 박범주 | 남 | 1966.04 | 상무 | 상근 | 인재개발원 담당임원 | Samsung Research S/W혁신 센터 담당임원 | 성균관대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 박병률 | 남 | 1968.09 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 TP센 터 담당임원 | TSP총괄 TP센터 담당임원 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | 49 |
| 박병수 | 남 | 1972.12 | 상무 | 상근 | 한국총괄 B2B팀 담당임원 | 한국총괄 B2B팀 담당부장 | 한양대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 박봉일 | 남 | 1972.02 | 상무 | 상근 | System LSI AP개발실 담당임원 | System LSI Custom SOC사업 팀 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 박봉태 | 남 | 1974.10 | 상무 | 상근 | SCS 담당임원 | 메모리 Flash개발실 담당임원 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 박상교 | 남 | 1972.03 | 상무 | 상근 | 중국전략협력실 담당임원 | 중국본사 담당임원 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 박상권 | 남 | 1971.07 | 상무 | 상근 | DS부문 커뮤니케이션팀장 | 커뮤니케이션팀 담당임원 | 서울대(학사) | 계열회사 임원 | 28 |
| 박상도 | 남 | 1973.12 | 상무 | 상근 | 북미총괄 담당임원 | 북미총괄 담당부장 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 박상훈 | 남 | 1978.02 | 상무 | 상근 | Foundry Design Platform개발 실 담당임원 | Foundry Design Platform개발 실 수석 | 포항공대(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 박상훈 | 남 | 1969.09 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 지원팀 담 당임원 | 법무실 담당임원 | Syracuse Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 박석민 | 남 | 1970.12 | 상무 | 상근 | 생활가전 Global운영팀 담당임 원 | 생활가전 Global운영팀 담당임 원 | Univ. of Texas, Austin(박 사) | 계열회사 임원 | |
| 박성범 | 남 | 1984.10 | 상무 | 상근 | System LSI AP개발실 담당임원 | System LSI SOC개발실 수석 | Stanford Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 박성제 | 남 | 1971.05 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 Global CS팀 담당임원 | 영상디스플레이 담당임원 | 국민대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---------|----|----|---|-----------------------------------|--|------------|----|
| 박성철 | 남 | 1972.10 | 상무 | 상근 | 메모리 DRAM개발실 담당임원 | 메모리 DRAM개발실 수석 | Purdue Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 박세근 | 남 | 1974.01 | 상무 | 상근 | 메모리 DRAM개발실 담당임원 | 메모리 DRAM개발실 수석 | 성균관대(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 박장목 | 남 | 1967.02 | 상무 | 상근 | 재경팀 담당임원 | 재경팀 담당부장 | 계명대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 박장용 | 남 | 1979.01 | 상무 | 상근 | 법무실 담당임원 | 법무실 수석변호사 | 서울대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 박재범 | 남 | 1977.08 | 상무 | 상근 | DS부문 People팀 담당임원 | DS부문 인사팀 담당부장 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 박재성 | 남 | 1971.02 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원 | TSP총괄 TP센터 담당임원 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 박재식 | 남 | 1976.08 | 상무 | 상근 | 생활가전 구매팀 담당임원 | 생활가전 구매팀 담당부장 | 경희대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 박재현 | 남 | 1970.07 | 상무 | 상근 | 글로벌마케팅실 글로벌브랜드센터 담당임원 | 글로벌마케팅센터 담당임원 | 한양대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 박정대 | 남 | 1976.12 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 분석기술팀장 | 포항공대(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 박정미 | 여 | 1968.07 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원 | Mobile eXperience 전략마케팅팀 담당임원 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | |
| 박정재 | 남 | 1974.01 | 상무 | 상근 | DS부문 재경팀 담당임원 | DS부문 일본총괄 담당부장 | Univ. of Texas, Austin(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 박정호 | 남 | 1974.11 | 상무 | 상근 | 네트워크 개발팀 담당임원 | 네트워크 개발팀 수석 | 연세대(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 박제영 | 남 | 1969.09 | 상무 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 박제임스 | 남 | 1973.06 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원 | 무선 Global Mobile B2B팀 담당부장 | California Polytechnic State Univ.(학사) | 계열회사 임원 | |
| 박종규 | 남 | 1969.07 | 상무 | 상근 | 메모리 Solution개발실 담당임원 | 메모리 Solution개발실 수석 | 경북대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 박종만 | 남 | 1971.11 | 상무 | 상근 | 디바이스플랫폼센터 담당임원 | Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원 | 서강대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 박종우 | 남 | 1972.02 | 상무 | 상근 | 한국총괄 B2B팀 담당임원 | 한국총괄 B2B영업팀 담당임원 | 서울시립대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 박종욱 | 남 | 1968.11 | 상무 | 상근 | Global CS센터 담당임원 | 영상디스플레이 개발팀 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 박준수 | 남 | 1967.08 | 상무 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | 글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | 10 |
| 박준영 | 남 | 1974.10 | 상무 | 상근 | SEBN법인장 | SEA 담당임원 | Univ. of Paris 11(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 박준호 | 남 | 1972.05 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience CX실 담당임원 | 무선 전략마케팅실 담당임원 | 한양대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 박진수 | 남 | 1969.07 | 상무 | 상근 | DS부문 상생협력센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 펌웨어사업장 담당임원 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 박진표 | 남 | 1972.11 | 상무 | 상근 | DS부문 DSA 담당임원 | System LSI AP개발실 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 박찬형 | 남 | 1973.06 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원 | 영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당부장 | City Univ. of New York(석사) | 계열회사 임원 | 7 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|---------------------------------|----------------------------|---|---------|----|
| 박창서 | 남 | 1980.06 | 상무 | 상근 | 혁신센터 담당임원 | DIT센터 담당임원 | Univ. of California, Berkeley(박사) | 계열회사 임원 | 28 |
| 박창진 | 남 | 1967.01 | 상무 | 상근 | 네트워크 Global CS팀장 | 네트워크 개발팀 담당임원 | 경북대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 박철민 | 남 | 1971.01 | 상무 | 상근 | AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 41 |
| 박철범 | 남 | 1966.03 | 상무 | 상근 | 상생협력센터 담당임원 | 상생협력센터 담당임원 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 박철웅 | 남 | 1973.01 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 담당임원 | Mobile eXperience 개발실 담당임원 | 연세대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 박충신 | 남 | 1973.09 | 상무 | 상근 | 의료기기 People팀장 | 의료기기 인사팀장 | 경북대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 박대상 | 남 | 1975.01 | 상무 | 상근 | 생산기술연구소 담당임원 | 글로벌기술센터 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 박태호 | 남 | 1969.03 | 상무 | 상근 | 경영혁신센터 담당임원 | SEAG법인장 | Univ. of Pittsburgh(석사) | 계열회사 임원 | |
| 박태훈 | 남 | 1974.11 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 수석 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 박행철 | 남 | 1970.01 | 상무 | 상근 | 상생협력센터 담당임원 | 상생협력센터 담당부장 | 부산대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 박현근 | 남 | 1973.01 | 상무 | 상근 | Foundry 기획팀장 | DS부문 기획팀 담당임원 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 박현준 | 남 | 1978.01 | 상무 | 상근 | 구주총괄 People팀장 | 사업지원T/F 담당부장 | 한국외국어대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 박형민 | 남 | 1977.03 | 상무 | 상근 | SEA 담당임원 | SEAD법인장 | 서울대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 박호우 | 남 | 1971.03 | 상무 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | Foundry 기술개발실 수석 | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 박훈철 | 남 | 1974.05 | 상무 | 상근 | 생활가전 지원팀 담당임원 | 지원팀 담당부장 | 광운대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 박희걸 | 남 | 1972.08 | 상무 | 상근 | 네트워크 시스템솔루션팀 담당 임원 | 네트워크 개발팀 담당임원 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | 29 |
| 반수형 | 남 | 1972.06 | 상무 | 상근 | 생활가전 개발팀 담당임원 | 생활가전 개발팀 수석 | 아주대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 반일승 | 남 | 1974.11 | 상무 | 상근 | 네트워크 전략마케팅팀 담당 임원 | SEJ 담당부장 | 경희대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 발라지 | 남 | 1969.09 | 상무 | 상근 | SSIR연구소장 | SSIR VP | Birla Institute of Technology and Science, Pilani(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 방지훈 | 남 | 1973.11 | 상무 | 상근 | System LSI AP개발실 담당임원 | System LSI 기반설계실 담당 임원 | Carnegie Mellon Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 배범희 | 남 | 1985.09 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담당임원 | 생산기술연구소 수석 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 배상기 | 남 | 1974.04 | 상무 | 상근 | 메모리 지원팀 담당임원 | SAS 담당임원 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 배승준 | 남 | 1976.03 | 상무 | 상근 | 메모리 DRAM개발실 담당임원 | 메모리 Flash개발실 담당임원 | 포항공대(박사) | 계열회사 임원 | 55 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|----|
| 배일환 | 남 | 1970.07 | 상무 | 상근 | People팀 담당임원 | 인사팀 담당임원 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 배학범 | 남 | 1963.08 | 상무 | 상근 | SESK법인장 | SEHC 담당임원 | 경희대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 배희선 | 여 | 1974.02 | 상무 | 상근 | SCIC 담당임원 | 영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원 | 경북대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 백기열 | 남 | 1967.07 | 상무 | 상근 | 경영혁신센터 담당임원 | 삼성SDS 품질팀장 | 한국외국어대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 백아론 | 남 | 1979.10 | 상무 | 상근 | Samsung Research Robot센터 담당임원 | Samsung Research Robot센터 수석 | Stanford Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 백일섭 | 남 | 1968.08 | 상무 | 상근 | Global CS센터 담당임원 | Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원 | 광운대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 백종수 | 남 | 1971.01 | 상무 | 상근 | 지원팀 담당임원 | 전장사업팀 담당임원 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 백피터 | 남 | 1971.06 | 상무 | 상근 | DS부문 IP팀 담당임원 | 법무실 IP센터 책임변호사 | Univ. of Minnesota, Minneapolis(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 변준호 | 남 | 1972.07 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담당임원 | 무선 개발2실 담당임원 | Southern Illinois Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 부민혁 | 남 | 1973.06 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience사업부 CX실 담당임원 | 생활가전 디자인팀장 | 제주대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 부장원 | 남 | 1973.06 | 상무 | 상근 | Big Data센터 담당임원 | 글로벌마케팅센터 담당임원 | MIT(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 서경현 | 남 | 1970.05 | 상무 | 상근 | People팀 담당임원 | 인사팀 담당임원 | 광운대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 서보철 | 남 | 1972.01 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience Global운영팀장 | Mobile eXperience Global제조센터 담당임원 | 동국대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 서상원 | 남 | 1979.06 | 상무 | 상근 | System LSI CP개발실 담당임원 | Apple, Engineer/Manager | Michigan Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 8 |
| 서성기 | 남 | 1972.12 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원 | 건국대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 서영진 | 남 | 1969.05 | 상무 | 상근 | Global CS센터 담당임원 | CS환경센터 담당부장 | Insa De Lyon(박사) | 계열회사 임원 | |
| 서원주 | 남 | 1976.07 | 상무 | 상근 | DS부문 IP팀 담당임원 | DS부문 미주총괄 VP | Stanford Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 서정아 | 여 | 1971.05 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원 | Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원 | Columbia Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 서정혁 | 남 | 1972.07 | 상무 | 상근 | Samsung Research People팀장 | 네트워크 인사팀장 | 건국대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 서정현 | 남 | 1974.04 | 상무 | 상근 | SCS 담당임원 | DS부문 지원팀 담당임원 | Univ. of Wisconsin, Madison(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 서창우 | 남 | 1974.06 | 상무 | 상근 | SEF 담당임원 | SEBN 담당부장 | Manchester(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 서치영 | 남 | 1974.12 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원 | Airbnb, Director | Univ. of Southern California(박사) | 계열회사 임원 | 16 |
| 서현정 | 여 | 1978.02 | 상무 | 상근 | DS부문 경영지원실 담당임원 | ERM 코리아, 대표 | Univ. of Southern California(석사) | 계열회사 임원 | 20 |
| 석종욱 | 남 | 1969.06 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 LED제조기술팀장 | 글로벌인프라총괄 LED제조기술팀장 | 광운대(학사) | 계열회사 임원 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|----------------------------------|----------------------------|--|------------|----|
| 선동석 | 남 | 1974.04 | 상무 | 상근 | 혁신센터 담당임원 | DIT센터 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 설지윤 | 남 | 1974.12 | 상무 | 상근 | 네트워크 상품전략팀장 | 네트워크 개발팀 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 설훈 | 남 | 1970.03 | 상무 | 상근 | SEG 담당임원 | SEROM법인장 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 성낙희 | 남 | 1973.03 | 상무 | 상근 | System LSI AP개발실 담당임원 | System LSI SOC개발실 담당임원 | Georgia Inst. of Tech.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 성덕용 | 남 | 1973.09 | 상무 | 상근 | 설비기술연구소 담당임원 | 생산기술연구소 담당임원 | Carnegie Mellon Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 성백민 | 남 | 1971.05 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 인프라기술센터 수석 | 한양공고(고교) | 계열회사 임원 | 19 |
| 성한준 | 남 | 1971.02 | 상무 | 상근 | 생활가전 개발팀 담당임원 | 생활가전 개발팀 수석 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 소재민 | 남 | 1983.04 | 상무 | 상근 | 생산기술연구소 담당임원 | 영상디스플레이 개발팀 수석 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 손석준 | 남 | 1974.07 | 상무 | 상근 | 생활가전 개발팀 담당임원 | 생활가전 개발팀 수석 | 전남대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 손성민 | 남 | 1973.06 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 구매팀 담당임원 | SEV 담당부장 | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 손영아 | 여 | 1973.05 | 상무 | 상근 | 생활가전 전략마케팅팀 담당임원 | SELA 담당부장 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 손영웅 | 남 | 1970.10 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원 | 반도체연구소 메모리 TD실 담당임원 | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 손용우 | 남 | 1968.09 | 상무 | 상근 | 생활가전 지원팀 담당임원 | SEDA-P(M) 담당임원 | 경희대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 손용훈 | 남 | 1973.03 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 공정개발실 담당임원 | 반도체연구소 메모리 TD실 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 손준호 | 남 | 1976.08 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 지원팀 담당임원 | Mobile eXperience 지원팀 담당부장 | Emory Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 손종근 | 남 | 1970.09 | 상무 | 상근 | LED사업팀 담당임원 | LED사업팀 수석 | State Univ. of New York, Stony Brook(박사) | 계열회사 임원 | |
| 손태용 | 남 | 1972.08 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 Micro LED팀장 | 영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 손환구 | 남 | 1969.06 | 상무 | 상근 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | 메모리 전략마케팅팀 담당임원 | State Univ. of New York, Stony Brook(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 손현석 | 남 | 1976.03 | 상무 | 상근 | SEH-P법인장 | SEH-P 담당부장 | 홍익대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 손호민 | 남 | 1969.02 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원 | 한양대(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 손호성 | 남 | 1968.04 | 상무 | 상근 | 생활가전 개발팀 담당임원 | 무선 구매팀 담당임원 | 경북대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 송기재 | 남 | 1970.04 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원 | TSP총괄 TP센터 담당임원 | 광운대(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 송명숙 | 여 | 1972.11 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 Customer Marketing팀 담당임원 | 글로벌마케팅센터 담당임원 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 송방영 | 남 | 1974.10 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 지원팀 담당임원 | 지원팀 담당임원 | Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사) | 계열회사 임원 | 55 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---------|----|----|---------------------------------------|--|---|------------|----|
| 송보영 | 여 | 1976.10 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 수석 | 포항공대(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 송상철 | 남 | 1973.09 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원 | Verizon Media, Chief Architect | Univ. of Maryland, College Park(박사) | 계열회사 임원 | 28 |
| 송영근 | 남 | 1970.01 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 AVP제조기술센터 담당임원 | Intel, Principal Engineer | 건국대(학사) | 계열회사 임원 | 6 |
| 송우창 | 남 | 1968.01 | 상무 | 상근 | 한국총괄 B2B팀 담당임원 | 한국총괄 B2B영업팀 담당임원 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | |
| 송원준 | 남 | 1969.04 | 상무 | 상근 | 생활가전 전략마케팅팀 담당임 원 | 영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원 | Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(석사) | 계열회사 임원 | |
| 송원철 | 남 | 1976.01 | 상무 | 상근 | SAMEX 담당임원 | 지원팀 담당부장 | Georgetown Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 송윤종 | 남 | 1971.10 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 차세대연구실 담 당임원 | 반도체연구소 차세대TD팀장 | Virginia Tech(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 송인강 | 남 | 1971.07 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | 무선 기술전략팀 담당부장 | Vanderbilt Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 송정우 | 남 | 1977.12 | 상무 | 상근 | 메모리 DRAM개발실 담당임원 | 메모리 DRAM개발실 수석 | State Univ. Of New York, Buffalo(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 송태중 | 남 | 1971.04 | 상무 | 상근 | Foundry Corporate Planning실 담당임원 | Foundry Design Platform개발 실 담당임원 | Georgia Inst. of Tech.(박 사) | 계열회사 임원 | |
| 송호영 | 남 | 1972.12 | 상무 | 상근 | 메모리 DRAM개발실 담당임원 | 메모리 DRAM개발실 수석 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 셰인희비 | 남 | 1972.05 | 상무 | 상근 | SEA 담당임원 | SEA VP | Fairleigh Dickinson Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 신규범 | 남 | 1972.06 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 품질혁신센 터 담당임원 | 무선 Global CS팀 담당부장 | 부산대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 신대중 | 남 | 1971.11 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience Global제조 센터 담당임원 | SEDA-P(C)공장장 | 경북대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 신문선 | 남 | 1975.04 | 상무 | 상근 | 생활가전 개발팀 담당임원 | 생활가전 개발팀 수석 | 한국해양대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 신민호 | 남 | 1970.03 | 상무 | 상근 | System LSI CP개발실 담당임 원 | System LSI SOC개발실 수석 | 연세대(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 신상용 | 남 | 1973.05 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 수석 | 홍익대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 신승주 | 남 | 1972.04 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원 | SESA 담당임원 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 신용우 | 남 | 1974.12 | 상무 | 상근 | DS부문 기획팀 담당임원 | DS부문 기획팀 담당부장 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 신원화 | 남 | 1976.11 | 상무 | 상근 | 메모리 DRAM개발실 담당임원 | 메모리 DRAM개발실 수석 | 성균관대(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 신의창 | 남 | 1971.05 | 상무 | 상근 | People팀 담당임원 | 인사팀 담당부장 | 한국외국어대(학사) | 계열회사 임원 | 4 |
| 신인철 | 남 | 1974.06 | 상무 | 상근 | TSP총괄 People팀장 | DS부문 인사팀 담당임원 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 신현 | 남 | 1972.12 | 상무 | 상근 | 한국총괄 D2C팀 담당임원 | 한국총괄 온라인영업팀 담당부 장 | 경기대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 신현석 | 남 | 1969.05 | 상무 | 상근 | 신사업T/F 담당임원 | Samsung Research Intelligent Machine센터장 | 서강대(석사) | 계열회사 임원 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|----|
| 심승환 | 남 | 1974.04 | 상무 | 상근 | 글로벌마케팅실 D2C센터 담당 임원 | Apple, Sr. Development Manager | Stanford Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 1 |
| 심우철 | 남 | 1982.06 | 상무 | 상근 | Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원 | Samsung Research Security팀 수석 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 심재혁 | 남 | 1978.04 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원 | Dupont Korea, 상무 | 서강대(학사) | 계열회사 임원 | 9 |
| 심재현 | 남 | 1972.01 | 상무 | 상근 | 지원팀 담당임원 | Mobile eXperience 지원팀 담 당임원 | Georgetown Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 심호준 | 남 | 1977.12 | 상무 | 상근 | DS부문 DSC 담당임원 | 메모리 Solution개발실 담당임 원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 심황윤 | 남 | 1971.01 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | 무선 개발실 수석 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 아라이 | 남 | 1968.08 | 상무 | 상근 | DS부문 DSJ총괄 | DS부문 일본총괄 VP | 한국외국어대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 안대현 | 남 | 1972.02 | 상무 | 상근 | 한국총괄 CE팀 담당임원 | 한국총괄 CE영업팀 담당임원 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 안성준 | 남 | 1975.01 | 상무 | 상근 | System LSI S/W Engineering팀장 | System LSI S/W Architecture팀 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 안승환 | 남 | 1970.10 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원 | SEA 담당임원 | 연세대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 안신현 | 남 | 1972.09 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 펌웨어사업장 수석 | 한양대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 안용석 | 남 | 1974.11 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 DRAM TD실 담 당임원 | 반도체연구소 DRAM TD실 수 석 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 안재용 | 남 | 1977.02 | 상무 | 상근 | 감사팀 담당임원 | 감사팀 담당부장 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 안정희 | 남 | 1970.09 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원 | SEMAG법인장 | 경북대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 안주원 | 여 | 1977.03 | 상무 | 상근 | 생활가전 기획팀 담당임원 | 기획팀 담당부장 | 서강대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 안준 | 남 | 1978.02 | 상무 | 상근 | 네트워크 개발팀 담당임원 | AWS, S/W Engineer | Univ. of Southern California(박사) | 계열회사 임원 | 21 |
| 안진우 | 남 | 1969.11 | 상무 | 상근 | Compliance팀 담당임원 | 법무실 담당임원 | 동아대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 안치용 | 남 | 1975.12 | 상무 | 상근 | 메모리 품질실 담당임원 | 메모리 품질실 수석 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 안희영 | 여 | 1976.12 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 Service Business팀 담당임원 | 영상디스플레이 Service Business팀 담당부장 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 양병덕 | 남 | 1971.03 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | Apple, Principal Engineer | 연세대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 양시준 | 남 | 1974.01 | 상무 | 상근 | 네트워크 지원팀 담당임원 | 무선 지원팀 담당부장 | Univ. of Southern California(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 양익준 | 남 | 1969.11 | 상무 | 상근 | 경영혁신센터 담당임원 | 아프리카총괄 지원팀장 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 양종훈 | 남 | 1974.05 | 상무 | 상근 | DS부문 구매팀 담당임원 | DS부문 구매팀 담당부장 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 양준철 | 남 | 1972.06 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 구매팀 담당임 원 | 영상디스플레이 구매팀 담당부 장 | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | 42 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|----|
| 양진기 | 남 | 1971.05 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담당임원 | 무선 개발실 담당부장 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 양택진 | 남 | 1971.08 | 상무 | 상근 | Samsung Research 기술전략 팀 담당임원 | Samsung Research 기술전략 팀 담당부장 | 연세대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 양희철 | 남 | 1975.07 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience CX실 담당임원 | 무선 UX혁신팀 수석 | 포항공대(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 여태정 | 남 | 1970.06 | 상무 | 상근 | 전장사업팀 담당임원 | 전장사업팀 담당부장 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 연지현 | 여 | 1974.10 | 상무 | 상근 | System LSI 전략마케팅실 담당임원 | System LSI 전략마케팅실 담당부장 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 염강수 | 남 | 1972.08 | 상무 | 상근 | 커뮤니케이션팀 담당임원 | 커뮤니케이션팀 담당부장 | 서울대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 염부호 | 남 | 1972.04 | 상무 | 상근 | 글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원 | Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원 | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 염종범 | 남 | 1977.06 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience People팀 담당임원 | DS부문 중국총괄 담당부장 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 오름 | 여 | 1977.02 | 상무 | 상근 | 메모리 DRAM개발실 담당임원 | 메모리 DRAM개발실 수석 | 고려대(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 오상진 | 남 | 1977.11 | 상무 | 상근 | 사업지원T/F 담당임원 | Foundry 지원팀 담당임원 | MIT(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 오석민 | 여 | 1974.07 | 상무 | 상근 | 디자인경영센터 담당임원 | 디자인경영센터 수석 | New York Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 오승훈 | 남 | 1968.03 | 상무 | 상근 | 생활가전 Global CS팀 담당임원 | SRI-Noida연구소장 | Aachen Univ. of Tech.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 오영기 | 남 | 1973.01 | 상무 | 상근 | 인재개발원 담당임원 | 인재개발원 담당부장 | 충남대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 오용찬 | 남 | 1972.10 | 상무 | 상근 | SIEL-S 담당임원 | 생활가전 전략마케팅팀 담당부장 | 홍익대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 오재균 | 남 | 1972.02 | 상무 | 상근 | System LSI 지원팀장 | TSP총괄 지원팀장 | Univ. of Iowa(석사) | 계열회사 임원 | |
| 오정환 | 남 | 1973.12 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 공정개발실 담당임원 | 반도체연구소 공정개발실 수석 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 오준영 | 남 | 1969.02 | 상무 | 상근 | TSP총괄 Package개발실 담당임원 | 메모리 Solution개발실 수석 | The Ohio State Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 오창민 | 남 | 1965.02 | 상무 | 상근 | SEJ법인장 | 무선 전략마케팅실 담당임원 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 오창호 | 남 | 1971.03 | 상무 | 상근 | SEV 담당임원 | 무선 구매팀 담당임원 | 동아대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 오창환 | 남 | 1969.01 | 상무 | 상근 | DS부문 창의혁신센터장 | DS부문 경영지원실 담당임원 | George Washington Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 오혁상 | 남 | 1969.06 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원 | 부산대(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 오형석 | 남 | 1970.09 | 상무 | 상근 | TSP총괄 구매팀장 | TSP총괄 구매팀장 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 올라프 | 남 | 1971.01 | 상무 | 상근 | SEG 담당임원 | SEG VP | Johannes Gutenberg Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 왕지연 | 여 | 1977.09 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience CX실 담당임원 | Mobile eXperience CX실 수석 | 홍익대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|---|---------------------------------|---|------------|----|
| 우형동 | 남 | 1970.09 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 평택사업장 담당임원 | 경북대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 원석준 | 남 | 1970.02 | 상무 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 원찬식 | 남 | 1975.12 | 상무 | 상근 | 생산기술연구소 담당임원 | 글로벌기술센터 수석 | 서강대(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 유미경 | 여 | 1974.05 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | 무선 개발실 담당임원 | Stanford Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 22 |
| 유상민 | 남 | 1973.09 | 상무 | 상근 | System LSI CP개발실 담당임 원 | System LSI 기반설계실 담당임 원 | Univ. of Washington(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 유성종 | 남 | 1976.03 | 상무 | 상근 | System LSI LSI개발실 담당임 원 | System LSI LSI개발실 수석 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 유성호 | 남 | 1973.02 | 상무 | 상근 | System LSI 지원팀 담당임원 | System LSI 지원팀 담당부장 | Stanford Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 유송 | 남 | 1975.05 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원 | SEA 담당임원 | 연세대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 유종민 | 남 | 1974.04 | 상무 | 상근 | People팀 담당임원 | SSC 담당임원 | 경희대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 유한중 | 남 | 1973.10 | 상무 | 상근 | SEF 담당임원 | 재경팀 담당임원 | Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 유화열 | 남 | 1971.11 | 상무 | 상근 | System LSI LSI개발실 담당임 원 | System LSI LSI개발실 수석 | 인하대(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 육근성 | 남 | 1968.08 | 상무 | 상근 | 한국총괄 지원팀장 | 한국총괄 지원팀 담당임원 | Indiana Univ., Bloomington(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 윤가람 | 여 | 1983.08 | 상무 | 상근 | Samsung Research Visual Technology팀 담당임원 | Meta, Manager | Univ. of Arizona(박사) | 계열회사 임원 | 13 |
| 윤남호 | 남 | 1968.12 | 상무 | 상근 | 한국총괄 MX팀 담당임원 | 한국총괄 IM영업팀 담당임원 | Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 윤보영 | 여 | 1977.08 | 상무 | 상근 | 네트워크 개발팀 담당임원 | 네트워크 개발팀 수석 | 이화여대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 윤석진 | 남 | 1968.11 | 상무 | 상근 | 혁신센터 담당임원 | DIT센터 담당임원 | 연세대(박사) | 계열회사 임원 | 29 |
| 윤석호 | 남 | 1972.07 | 상무 | 상근 | LED사업팀 담당임원 | 글로벌인프라총괄 LED기술센 터 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 윤석호 | 남 | 1973.04 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원 | 한국기계연구원, 열에너지솔루 션실장 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 6 |
| 윤성욱 | 남 | 1974.06 | 상무 | 상근 | 구주총괄 담당임원 | 인사팀 담당부장 | 연세대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 윤성호 | 남 | 1974.01 | 상무 | 상근 | 생활가전 선행개발팀 담당임원 | GE, Staff Engineer | Cambridge Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 6 |
| 윤성환 | 남 | 1972.04 | 상무 | 상근 | 법무실 IP센터 담당임원 | 법무실 IP센터 수석 | State Univ. of New York, Buffalo(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 윤송호 | 남 | 1974.10 | 상무 | 상근 | 메모리 Solution개발실 담당임 원 | 메모리 Solution개발실 수석 | 광운대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 윤승욱 | 남 | 1970.01 | 상무 | 상근 | AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원 | TSP총괄 Package개발실 담당 임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 45 |
| 윤여환 | 남 | 1972.02 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 지원팀 담당임 원 | 영상디스플레이 지원팀 책임변 호사 | Syracuse Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 31 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|----|
| 윤영조 | 남 | 1975.02 | 상무 | 상근 | Global Public Affairs팀 담당임원 | IR팀 담당임원 | Georgetown Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 39 |
| 윤우근 | 남 | 1972.01 | 상무 | 상근 | 생산기술연구소 담당임원 | 글로벌기술센터 담당임원 | 東北大(박사) | 계열회사 임원 | 29 |
| 윤인철 | 남 | 1971.03 | 상무 | 상근 | 생활가전 개발팀 담당임원 | 생활가전 선행개발팀 담당임원 | 한양대(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 윤주환 | 남 | 1970.05 | 상무 | 상근 | 재경팀 담당임원 | 재경팀 담당부장 | Univ. of California, Berkeley(석사) | 계열회사 임원 | |
| 윤찬현 | 남 | 1971.10 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 구매팀 담당임원 | 무선 구매팀 담당부장 | 영남대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 윤철웅 | 남 | 1970.07 | 상무 | 상근 | SERC 담당임원 | 영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 윤하룡 | 남 | 1971.12 | 상무 | 상근 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | 메모리 전략마케팅팀 담당임원 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 윤호용 | 남 | 1969.12 | 상무 | 상근 | SEM-S 담당임원 | Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원 | Drexel Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 은성민 | 남 | 1977.01 | 상무 | 상근 | DS부문 DSA 담당임원 | 사업지원T/F 담당부장 | Wake Forest Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 이강규 | 남 | 1972.09 | 상무 | 상근 | Foundry Corporate Planning실 담당임원 | DS부문 미주총괄 담당임원 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 이강승 | 남 | 1977.07 | 상무 | 상근 | System LSI Global Operation실 담당임원 | System LSI Global운영팀장 | 포항공대(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 이경준 | 남 | 1976.06 | 상무 | 상근 | 생활가전 전략마케팅팀 담당임원 | 한국총괄 CE영업팀 담당임원 | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 이경호 | 남 | 1975.10 | 상무 | 상근 | System LSI Sensor사업팀 담당임원 | System LSI Sensor사업팀 수석 | 포항공대(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 이계복 | 남 | 1969.06 | 상무 | 상근 | SEM-P법인장 | SEHA법인장 | 홍익대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 이계원 | 남 | 1968.05 | 상무 | 상근 | 한국총괄 B2B팀 담당임원 | 한국총괄 B2B영업팀 담당임원 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이계훈 | 남 | 1980.02 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원 | 영상디스플레이 개발팀 담당임원 | 서울대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 이관수 | 남 | 1969.11 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 지원팀 담당임원 | SAMEX 담당임원 | 영남대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이광열 | 남 | 1974.11 | 상무 | 상근 | 아프리카총괄 지원팀장 | 사업지원T/F 담당부장 | Emory Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 이귀호 | 여 | 1975.05 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 Service Business팀 담당임원 | 영상디스플레이 Service Business팀 담당부장 | 이화여대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 이규영 | 남 | 1968.10 | 상무 | 상근 | LED사업팀 담당임원 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이규원 | 남 | 1974.03 | 상무 | 상근 | DS부문 DSJ 담당임원 | DS부문 일본총괄 담당부장 | Waseda Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 이근수 | 남 | 1970.12 | 상무 | 상근 | 상생협력센터 담당임원 | 상생협력센터 담당부장 | 세종대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 이기욱 | 남 | 1970.08 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원 | 무선 개발2실 수석 | 동아대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이기철 | 남 | 1972.11 | 상무 | 상근 | 네트워크 개발팀 담당임원 | 네트워크 Global Technology Service팀 담당임원 | 고려대(박사) | 계열회사 임원 | 42 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|----|
| 이남호 | 남 | 1972.02 | 상무 | 상근 | DS부문 재경팀 담당임원 | 두산, 부문장 | 성균관대(박사) | 계열회사 임원 | 30 |
| 이대성 | 남 | 1970.09 | 상무 | 상근 | SCIC 담당임원 | 무선 전략마케팅실 담당임원 | Thunderbird(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 이동진 | 남 | 1971.01 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 개발팀 담당임원 | 영상디스플레이 개발팀 수석 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 이동하 | 남 | 1968.07 | 상무 | 상근 | 혁신센터 담당임원 | DIT센터 담당임원 | 포항공대(박사) | 계열회사 임원 | 43 |
| 이동현 | 남 | 1972.09 | 상무 | 상근 | DS부문 법무지원팀 담당임원 | DS부문 법무지원팀 수석변호사 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이두희 | 남 | 1973.11 | 상무 | 상근 | SGE법인장 | SEMAG법인장 | 단국대(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 이민철 | 남 | 1970.04 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원 | 무선 PC사업팀 담당임원 | 서강대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이병섭 | 남 | 1972.10 | 상무 | 상근 | 메모리 DRAM개발실 담당임원 | 메모리 DRAM개발실 수석 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 이병일 | 남 | 1983.07 | 상무 | 상근 | 메모리 Flash개발실 담당임원 | 메모리 Flash개발실 수석 | Stanford Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 이병진 | 남 | 1970.09 | 상무 | 상근 | DS부문 법무지원팀 담당임원 | DS부문 법무지원팀 수석변호사 | Univ. Of Wisconsin, Madison(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 이병철 | 남 | 1972.11 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience People팀 담당임원 | Mobile eXperience 인사팀 담당임원 | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 이병환 | 남 | 1974.05 | 상무 | 상근 | 재경팀 담당임원 | 재경팀 담당부장 | Univ. Of Wisconsin, Madison(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 이병현 | 남 | 1974.11 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원 | Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원 | Manchester Business Sch.(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 이보나 | 여 | 1973.02 | 상무 | 상근 | 생활가전 담당임원 | 생활가전 CX팀 담당임원 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 이상수 | 남 | 1975.06 | 상무 | 상근 | 네트워크 개발팀 담당임원 | 무선 개발실 수석 | 아주대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 이상엽 | 남 | 1967.11 | 상무 | 상근 | 상생협력센터 담당임원 | 삼성물산 상생협력팀 담당부장 | 서울대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 이상용 | 남 | 1970.02 | 상무 | 상근 | 네트워크 전략마케팅팀 담당임원 | GCT Semiconductor, Senior Director | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 48 |
| 이상욱 | 남 | 1972.08 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담당임원 | 무선 품질혁신센터 담당임원 | 금오공대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이상육 | 남 | 1971.01 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원 | 무선 제품기술팀 담당임원 | 경북대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이상직 | 남 | 1970.06 | 상무 | 상근 | SELA법인장 | SEM-S법인장 | 한국외국어대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이상현 | 남 | 1970.09 | 상무 | 상근 | SRJ 담당임원 | SCS 담당임원 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이상호 | 남 | 1973.01 | 상무 | 상근 | SAMCOL법인장 | 영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당부장 | 한국외국어대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 이상희 | 남 | 1974.09 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 Mask개발팀장 | 반도체연구소 Mask개발팀 수석 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 이석림 | 남 | 1974.03 | 상무 | 상근 | SEAS법인장 | 생활가전 전략마케팅팀 담당임원 | Univ. of Southern California(석사) | 계열회사 임원 | 19 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|---|--------------------------------|---|------------|----|
| 이선화 | 여 | 1975.08 | 상무 | 상근 | 글로벌마케팅실 CX·MDE센터 담당임원 | CX·MDE센터 담당임원 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 이성원 | 남 | 1976.03 | 상무 | 상근 | 네트워크 개발팀 담당임원 | 네트워크 개발팀 수석 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 이성원 | 남 | 1978.10 | 상무 | 상근 | System LSI AP개발실 담당임원 | Qualcomm, Sr. Staff Engineer | Univ. of Southern California(박사) | 계열회사 임원 | 10 |
| 이성재 | 남 | 1974.12 | 상무 | 상근 | Foundry Design Platform개발 실 담당임원 | IBM, Principal Manager | Purdue Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 21 |
| 이성훈 | 남 | 1975.11 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 Flash TD실 담당 임원 | 반도체연구소 Flash TD실 수석 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 이수용 | 남 | 1968.03 | 상무 | 상근 | DS부문 구매팀 담당임원 | 반도체연구소 공정개발실 담당 Master | 한양대(석사) | 계열회사 임원 | 11 |
| 이승관 | 남 | 1973.10 | 상무 | 상근 | 커뮤니케이션팀 담당임원 | 연합뉴스, 기자 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | 41 |
| 이승목 | 남 | 1973.09 | 상무 | 상근 | System LSI People팀장 | 동남아총괄 인사팀장 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 이승엽 | 남 | 1968.08 | 상무 | 상근 | SEIN-S법인장 | 무선 전략마케팅실 담당임원 | 서울대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이승재 | 남 | 1974.08 | 상무 | 상근 | 메모리 Flash개발실 담당임원 | 메모리 Flash개발실 담당임원 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이승준 | 남 | 1974.04 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 Flash TD실 담당 임원 | 메모리 Flash개발실 수석 | 한양대(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 이승철 | 남 | 1975.12 | 상무 | 상근 | 경영혁신센터 담당임원 | 생활가전 지원팀 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 이승호 | 남 | 1973.11 | 상무 | 상근 | SEVT 담당임원 | SEIN-P법인장 | 서울사이버대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 이승환 | 남 | 1971.05 | 상무 | 상근 | LED사업팀 담당임원 | LED사업팀 수석 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 이승훈 | 남 | 1976.03 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 공정개발실 담당 임원 | 반도체연구소 공정개발실 수석 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 이신재 | 남 | 1972.11 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | 무선 개발실 담당부장 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 이애영 | 여 | 1968.12 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 모바일플랫 폼센터 담당임원 | 무선 차세대플랫폼센터 담당임 원 | 포항공대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이영직 | 남 | 1967.08 | 상무 | 상근 | SEHA법인장 | SEH-P법인장 | 아주대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이영학 | 남 | 1974.09 | 상무 | 상근 | 혁신센터 담당임원 | 혁신센터 수석 | 포항공대(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 이우용 | 남 | 1975.10 | 상무 | 상근 | SEDA-P(M) 담당임원 | Mobile eXperience 지원팀 담 당부장 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 이원용 | 남 | 1978.11 | 상무 | 상근 | SAIT 기획지원팀장 | SAIT 기획지원팀 수석 | Massachusetts Inst. Of Tech.(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 이윤경 | 여 | 1979.09 | 상무 | 상근 | Big Data센터 담당임원 | Samsung Research AI센터 수 석 | Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 이윤성 | 남 | 1971.09 | 상무 | 상근 | 메모리 품질실 담당임원 | 메모리 품질보증실 수석 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 이윤수 | 남 | 1975.11 | 상무 | 상근 | Samsung Research Data Intelligence팀장 | Samsung Research AI센터 수 석 | Univ. of Maryland(박사) | 계열회사 임원 | 31 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|----|
| 이의형 | 남 | 1975.09 | 상무 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | 글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당부장 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 이재영 | 남 | 1974.11 | 상무 | 상근 | 사업지원T/F 담당임원 | 구주총괄 인사팀장 | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 이재환 | 남 | 1970.09 | 상무 | 상근 | 생활가전 전략마케팅팀 담당임 원 | SEEG-S법인장 | 중앙대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이재훈 | 남 | 1974.01 | 상무 | 상근 | SERC 담당임원 | SEUC법인장 | 연세대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 이정노 | 남 | 1971.02 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 개발팀 담당임 원 | 영상디스플레이 담당임원 | 한양대(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 이정삼 | 남 | 1967.06 | 상무 | 상근 | TSP총괄 Global운영팀장 | TSP총괄 기획팀장 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이정숙 | 여 | 1972.12 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience CX실 담당 임원 | 무선 Mobile UX센터 담당임원 | Berlin Art Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 46 |
| 이정원 | 남 | 1971.07 | 상무 | 상근 | 네트워크 Global운영팀장 | 네트워크 Global운영팀 담당임 원 | 경북대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 이정자 | 여 | 1969.04 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 인프라기술 센터 담당임원 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이정호 | 남 | 1974.11 | 상무 | 상근 | 한국총괄 People팀장 | 한국총괄 인사팀장 | 경북대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 이종규 | 남 | 1970.02 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | 무선 개발1실 수석 | 한양대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이종민 | 남 | 1973.06 | 상무 | 상근 | DS부문 지원팀 담당임원 | 사업지원T/F 담당임원 | Univ. of Washington, Seattle(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 이종석 | 남 | 1973.02 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | Apple, CPU Micro Architect | 서강대(석사) | 계열회사 임원 | 8 |
| 이종우 | 남 | 1978.04 | 상무 | 상근 | System LSI 담당임원 | System LSI 기반설계실 수석 | Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 이종포 | 남 | 1974.10 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 개발팀 담당임 원 | 영상디스플레이 개발팀 수석 | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 이종필 | 남 | 1972.11 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | 무선 개발실 수석 | 경북대(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 이종필 | 남 | 1973.11 | 상무 | 상근 | System LSI Sensor사업팀 담당 임원 | System LSI SOC개발실 담당임 원 | 충남대(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 이종호 | 남 | 1968.01 | 상무 | 상근 | Foundry 기술개발실 담당임원 | 글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이종호 | 남 | 1976.02 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 TP센 터 담당임원 | TSP총괄 Package개발실 담당 임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 이주형 | 남 | 1972.08 | 상무 | 상근 | Samsung Research Global 시센터 담당임원 | Samsung Research 시센터 담 당임원 | Univ. of Texas, Austin(박 사) | 계열회사 임원 | 46 |
| 이준 | 남 | 1972.04 | 상무 | 상근 | 중동총괄 지원팀장 | SEF 담당임원 | Cornell Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 이준표 | 남 | 1971.06 | 상무 | 상근 | 생활가전 C&M사업팀장 | 생활가전 C&M사업팀 담당임원 | Univ. of Maryland(박사) | 계열회사 임원 | 20 |
| 이중원 | 남 | 1975.06 | 상무 | 상근 | 네트워크 개발팀 담당임원 | 네트워크 개발팀 수석 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 이지수 | 남 | 1976.02 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience CX실 담당 임원 | 무선 개발실 담당임원 | Georgia Inst. of Tech.(박 사) | 계열회사 임원 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|------------------------------------|---------------------------------|---|------------|----|
| 이지영 | 여 | 1976.08 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience CX실 담당 임원 | 무선 CX실 수석 | 제주대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 이지훈 | 남 | 1970.11 | 상무 | 상근 | SECA법인장 | SEA 담당임원 | State Univ. of New York, Stony Brook(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 이지훈 | 남 | 1976.02 | 상무 | 상근 | 구주총괄 지원팀장 | SEG 담당임원 | Northwestern Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 이진구 | 남 | 1973.02 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원 | 무선 서비스사업실 담당임원 | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이진우 | 남 | 1979.01 | 상무 | 상근 | 네트워크 시스템솔루션팀 담당 임원 | 네트워크 개발팀 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 이진욱 | 남 | 1972.01 | 상무 | 상근 | DS부문 DS대외협력팀 담당임 원 | DS부문 상생협력센터 담당임원 | 아주대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 이진원 | 남 | 1973.03 | 상무 | 상근 | 생활가전 Global CS팀 담당임 원 | 생활가전 Global CS팀 담당부 장 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 이창엽 | 남 | 1970.04 | 상무 | 상근 | DS부문 DSC 담당임원 | DS부문 중국총괄 담당부장 | 영남대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 이창원 | 남 | 1972.03 | 상무 | 상근 | 한국총괄 MX팀 담당임원 | 한국총괄 IM영업팀 담당임원 | Pennsylvania State Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 이치훈 | 남 | 1969.08 | 상무 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 이한관 | 남 | 1971.09 | 상무 | 상근 | SRA 담당임원 | DS부문 인사팀 담당임원 | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 이한용 | 남 | 1976.05 | 상무 | 상근 | 법무실 IP센터 담당임원 | 김앤장, Sr.Foreign Attorney | George Washington Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 16 |
| 이한형 | 남 | 1968.09 | 상무 | 상근 | 한국총괄 B2B팀 담당임원 | 한국총괄 CE영업팀 담당임원 | 경희대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이혁 | 남 | 1973.02 | 상무 | 상근 | Bloom T/F 담당임원 | 삼성카드, 상무 | Duke Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 1 |
| 이현동 | 남 | 1972.02 | 상무 | 상근 | SELV법인장 | Lebanon지점장 | 영남대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 이현우 | 남 | 1974.10 | 상무 | 상근 | People팀 담당임원 | 인사팀 담당임원 | 경북대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 이현정 | 여 | 1977.12 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 공정개발실 담당 임원 | 반도체연구소 공정개발실 수석 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 이현정 | 여 | 1971.11 | 상무 | 상근 | 한국총괄 마케팅팀 담당임원 | 한국총괄 Retail마케팅팀장 | 고려대(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 이형우 | 남 | 1970.03 | 상무 | 상근 | 북미총괄 담당임원 | Global Public Affairs팀 담당임 원 | Univ. of Texas, Austin(석 사) | 계열회사 임원 | |
| 이호 | 남 | 1972.07 | 상무 | 상근 | Foundry 기술개발실 담당임원 | Foundry 기술개발실 수석 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 이호신 | 남 | 1970.12 | 상무 | 상근 | 법무실 IP센터 담당임원 | 법무실 IP센터 책임변호사 | Georgetown Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 이흥빈 | 남 | 1964.04 | 상무 | 상근 | SSEC법인장 | 생활가전 Global제조팀 담당임 원 | 명지대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 이화성 | 남 | 1970.09 | 상무 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | Foundry 기술개발실 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 이훈신 | 남 | 1974.09 | 상무 | 상근 | Global EHS센터 담당임원 | Dupont, APAC EHS Head | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | 18 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|----|
| 이희운 | 남 | 1968.08 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원 | 부산수산대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 임백준 | 남 | 1968.07 | 상무 | 상근 | SRUK연구소장 | Samsung Research Global AI센터 담당임원 | Indiana Univ., Bloomington(석사) | 계열회사 임원 | |
| 임산 | 남 | 1973.03 | 상무 | 상근 | 메모리 기획팀 담당임원 | DS부문 감사팀 담당임원 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 임성수 | 남 | 1978.11 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원 | 메모리 DRAM개발실 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 임성택 | 남 | 1970.10 | 상무 | 상근 | 생활가전 개발팀 담당임원 | 생활가전 C&M사업팀장 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 임순규 | 남 | 1979.07 | 상무 | 상근 | 사업지원T/F 담당임원 | 삼성디스플레이 대형 지원팀장 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 임아영 | 여 | 1974.09 | 상무 | 상근 | 네트워크 전략마케팅팀 담당임원 | 네트워크 전략마케팅팀 담당부 장 | City Univ. of New York(석 사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 임영수 | 남 | 1969.06 | 상무 | 상근 | 한국총괄 B2B팀 담당임원 | 한국총괄 B2B영업팀 담당임원 | 영남대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 임재우 | 남 | 1973.04 | 상무 | 상근 | 메모리 Design Platform개발실 담당임원 | 메모리 Flash개발실 수석 | 한양대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 임전식 | 남 | 1969.08 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원 | 전북대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 임지훈 | 남 | 1972.12 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원 | Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원 | 서울대(학사) | 계열회사 임원 | 36 |
| 임휘용 | 남 | 1965.02 | 상무 | 상근 | 인재개발원 담당임원 | 네트워크 인사팀장 | 서강대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 장경훈 | 남 | 1970.02 | 상무 | 상근 | Samsung Research Robot센 터 담당임원 | Samsung Research Robot센 터 담당임원 | 고려대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 장세정 | 남 | 1974.04 | 상무 | 상근 | 메모리 품질실 담당임원 | 메모리 Solution개발실 수석 | 서울대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 장소연 | 여 | 1971.06 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원 | Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원 | 이화여대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 장순복 | 여 | 1977.04 | 상무 | 상근 | 메모리 Solution개발실 담당임 원 | 메모리 Solution개발실 수석 | 부산대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 장실완 | 남 | 1973.02 | 상무 | 상근 | 메모리 Solution개발실 담당임 원 | 메모리 Solution개발실 수석 | 서울대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 장용 | 남 | 1970.03 | 상무 | 상근 | 네트워크 전략마케팅팀 담당임 원 | 무선 Global Mobile B2B팀 담 당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 장우영 | 남 | 1973.02 | 상무 | 상근 | 의료기기 DR사업팀장 | 의료기기 Global CS팀장 | 서울대(박사수료) | 계열회사 임원 | 31 |
| 장욱 | 남 | 1973.11 | 상무 | 상근 | SEJ 담당임원 | Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당부장 | 한국외국어대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 장윤희 | 남 | 1974.09 | 상무 | 상근 | SIEL-P(N) 담당임원 | Mobile eXperience Global제조 센터 담당부장 | Emory Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 장인갑 | 남 | 1975.06 | 상무 | 상근 | 메모리 품질실 담당임원 | 메모리 품질보증실 수석 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 장정렬 | 남 | 1977.01 | 상무 | 상근 | SIEL-S 담당임원 | 네트워크 개발팀 수석 | 중앙대(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 장준희 | 남 | 1974.01 | 상무 | 상근 | SEASA법인장 | 무선 전략마케팅실 담당부장 | 한국외국어대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|----|----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|----|
| 장지호 | 남 | 1970.09 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담당임원 | GCT, VP | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 35 |
| 장흥민 | 남 | 1972.06 | 상무 | 상근 | 동남아총괄 CS팀장 | Global CS센터 담당부장 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 저메인클라우제 | 남 | 1982.08 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원 | 영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당부장 | Harvard Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 전대호 | 남 | 1971.01 | 상무 | 상근 | 제조담당 People팀장 | 반도체연구소 인사팀장 | 아주대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 전범준 | 남 | 1976.07 | 상무 | 상근 | Foundry 지원팀 담당임원 | Foundry 지원팀 담당부장 | Southern Methodist Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 전병권 | 남 | 1967.02 | 상무 | 상근 | SAMEX법인장 | 영상디스플레이 Global운영팀 담당임원 | 전북대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 전상욱 | 남 | 1980.08 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담당임원 | Mobile eXperience 개발실 수석 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 전성훈 | 남 | 1977.01 | 상무 | 상근 | 메모리 Solution개발실 담당임원 | 메모리 Solution개발실 수석 | 연세대(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 전소영 | 여 | 1974.05 | 상무 | 상근 | SEA 담당임원 | 무선 지원팀 담당부장 | Univ. of Texas, Dallas(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 전승수 | 남 | 1976.07 | 상무 | 상근 | 생활가전 담당임원 | 생활가전 전략마케팅팀 담당임원 | 고려대(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 전승훈 | 남 | 1971.08 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 모바일 플랫폼센터 담당임원 | 무선 차세대플랫폼센터 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 전지환 | 남 | 1977.10 | 상무 | 상근 | System LSI 전략마케팅실 담당임원 | System LSI 전략마케팅실 수석 | Univ. Of Texas, Austin(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 전진규 | 남 | 1974.05 | 상무 | 상근 | SENA 담당임원 | SEAG 담당부장 | 한양대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 전진원 | 남 | 1974.03 | 상무 | 상근 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | 메모리 전략마케팅실 담당부장 | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 전형준 | 남 | 1972.10 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원 | Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원 | Univ. of Southern California(석사) | 계열회사 임원 | 10 |
| 정강일 | 남 | 1974.10 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 CX팀 담당임원 | 영상디스플레이 CX팀 담당부장 | Illinois Inst. of Tech.(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 정광민 | 남 | 1971.07 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원 | SEPR법인장 | 부산대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 정광섭 | 남 | 1970.04 | 상무 | 상근 | 재경팀 담당임원 | 삼성물산 경영정보팀 수석 | 한양대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 정광희 | 남 | 1971.08 | 상무 | 상근 | DS부문 DSC 담당임원 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | Tsinghua Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 정기호 | 남 | 1973.08 | 상무 | 상근 | 생활가전 전략마케팅팀 담당임원 | 생활가전 CX팀 담당임원 | 한국해양대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 정다운 | 남 | 1980.09 | 상무 | 상근 | 혁신센터 담당임원 | 메모리 Solution개발실 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 정우경 | 남 | 1971.05 | 상무 | 상근 | Foundry Corporate Planning실 담당임원 | Foundry 전략마케팅실 담당임원 | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 정문일 | 남 | 1971.01 | 상무 | 상근 | 상생협력센터 담당임원 | 법무법인 지평, 전문위원 | 송실대(학사) | 계열회사 임원 | 21 |
| 정상일 | 남 | 1967.09 | 상무 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원 | 중앙대(학사) | 계열회사 임원 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|----|
| 정성원 | 남 | 1974.07 | 상무 | 상근 | 메모리 Global운영팀 담당임원 | 메모리 Global운영팀 담당부장 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 정성원 | 남 | 1971.12 | 상무 | 상근 | SCA법인장 | Senegal지점장 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 정승목 | 남 | 1969.05 | 상무 | 상근 | 중국전략협력실 담당임원 | 중국전략협력실 담당임원 | Thunderbird(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 정승일 | 남 | 1973.08 | 상무 | 상근 | 경영혁신센터 담당임원 | 경영혁신센터 담당부장 | Indiana Univ., Bloomington(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 정승진 | 남 | 1972.11 | 상무 | 상근 | 메모리 Solution개발실 담당임원 | 메모리 Solution개발실 수석 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 정신영 | 여 | 1973.03 | 상무 | 상근 | Foundry 품질팀 담당임원 | Foundry 제품기술팀 수석 | Univ. of Florida(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 정연일 | 남 | 1975.06 | 상무 | 상근 | DS부문 기획팀 담당임원 | DS부문 기획팀 담당부장 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 정영환 | 남 | 1971.08 | 상무 | 상근 | SCIC 담당임원 | SET법인장 | 복단대(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 정용덕 | 남 | 1976.09 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 정원석 | 남 | 1971.07 | 상무 | 상근 | 상생협력센터 담당임원 | 감사팀 담당임원 | 한양대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 정원철 | 남 | 1973.12 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 Logic TD실 담당 임원 | 반도체연구소 Logic TD실 담당 임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 정유진 | 여 | 1970.06 | 상무 | 상근 | SENA법인장 | 생활가전 전략마케팅팀 담당임 원 | 서강대(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 정윤찬 | 남 | 1968.09 | 상무 | 상근 | 베트남복합단지 담당임원 | 감사팀 담당임원 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 정의목 | 남 | 1968.07 | 상무 | 상근 | Foundry Corporate Planning실 담당임원 | Foundry Global운영팀장 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 정의철 | 남 | 1969.12 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 품질혁신센 터 담당임원 | 무선 제품기술팀 담당임원 | Seattle Pacific Univ.(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 정인호 | 남 | 1970.11 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 인프라기술 센터 담당임원 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 정인호 | 남 | 1975.02 | 상무 | 상근 | 사업지원T/F 담당임원 | DS부문 지원팀 담당임원 | MIT(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 정인희 | 여 | 1974.09 | 상무 | 상근 | 지속가능경영추진센터 담당임 원 | LG화학, Expert Advisor | Imperial College(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 정일규 | 남 | 1968.05 | 상무 | 상근 | DS부문 DSA 담당임원 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | 광운대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 정일룡 | 남 | 1970.10 | 상무 | 상근 | DS부문 재경팀 담당임원 | DS부문 재경팀 담당부장 | Georgetown Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 정재용 | 남 | 1973.09 | 상무 | 상근 | 메모리 Flash개발실 담당임원 | 메모리 Flash개발실 수석 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 정준수 | 남 | 1970.09 | 상무 | 상근 | SEEG-P법인장 | SERK법인장 | 영남대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 정지은 | 여 | 1974.05 | 상무 | 상근 | 생활가전 전략마케팅팀 담당임 원 | 생활가전 전략마케팅팀 담당부 장 | Northwestern Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 정진국 | 남 | 1975.10 | 상무 | 상근 | Samsung Research 차세대통 신연구센터 담당임원 | Samsung Research 차세대통 신연구센터 담당임원 | 서강대(박사) | 계열회사 임원 | 55 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|---------|----|----|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|----|
| 정한기 | 남 | 1976.05 | 상무 | 상근 | AVP사업팀 AVP개발실 담당임원 | TSP총괄 Package개발실 수석 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 정혁준 | 남 | 1974.09 | 상무 | 상근 | 생활가전 광주지원센터장 | 생활가전 광주지원센터 담당부 장 | 전남대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 정혜순 | 여 | 1975.12 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | 무선 개발1실 수석 | 부산대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 정희재 | 남 | 1971.04 | 상무 | 상근 | 생활가전 디자인팀 담당임원 | 생활가전 디자인팀 수석 | 서울시립대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 제이콥 | 남 | 1978.11 | 상무 | 상근 | DS부문 DSC 담당임원 | DS부문 중국총괄 VP | 中國科學技術大學(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 제임스휘 슬러 | 남 | 1972.10 | 상무 | 상근 | SEA 담당임원 | SEA SVP | Ward Melville High School(고교) | 계열회사 임원 | 19 |
| 제희원 | 남 | 1978.09 | 상무 | 상근 | System LSI CP개발실 담당임 원 | System LSI CP개발실 수석 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 조강욱 | 남 | 1977.08 | 상무 | 상근 | 동남아총괄 지원팀장 | 사업지원T/F 담당부장 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 조미선 | 여 | 1980.04 | 상무 | 상근 | 네트워크 전략마케팅팀 담당임 원 | Ericsson, VP | 한국외국어대(학사) | 계열회사 임원 | 6 |
| 조민정 | 여 | 1974.07 | 상무 | 상근 | 메모리 품질실 담당임원 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 조성일 | 남 | 1973.12 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 TP센 터 담당임원 | TSP총괄 TP센터 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 조성제 | 남 | 1977.04 | 상무 | 상근 | People팀 담당임원 | People팀 담당부장 | Michigan State Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 조성훈 | 남 | 1970.11 | 상무 | 상근 | 경영혁신센터 담당임원 | SELS법인장 | 건국대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 조성훈 | 남 | 1976.01 | 상무 | 상근 | 생활가전 People팀장 | 생활가전 인사팀장 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 조성희 | 남 | 1974.08 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 담당임원 | 영상디스플레이 개발팀 수석 | 서강대(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 조신형 | 남 | 1972.10 | 상무 | 상근 | DS부문 커뮤니케이션팀 담당임 원 | DS부문 커뮤니케이션팀 담당부 장 | 서강대(학사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 조영석 | 남 | 1976.11 | 상무 | 상근 | 재경팀 담당임원 | 재경팀 담당부장 | 고려대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 조영진 | 남 | 1979.06 | 상무 | 상근 | 메모리 Solution개발실 담당임 원 | 메모리 Solution개발실 수석 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 조용호 | 남 | 1970.03 | 상무 | 상근 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | DS부문 미주총괄 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |
| 조욱래 | 남 | 1972.03 | 상무 | 상근 | 제조담당 지원팀장 | DS부문 재경팀 담당임원 | Purdue Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 조유미 | 여 | 1971.09 | 상무 | 상근 | DS부문 글로벌마케팅팀장 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 조유성 | 남 | 1971.06 | 상무 | 상근 | Global EHS센터 담당임원 | Global EHS센터 담당부장 | 서울과학기술대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 조익현 | 남 | 1972.01 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | 무선 개발실 수석 | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 조종욱 | 남 | 1969.08 | 상무 | 상근 | 상생협력센터 담당임원 | 삼성바이오에피스 인사팀장 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------|----|----|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------------|----|
| 조지호 | 남 | 1972.04 | 상무 | 상근 | 메모리 Flash개발실 담당임원 | 메모리 Flash개발실 수석 | 부산대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 조철민 | 남 | 1971.03 | 상무 | 상근 | System LSI AP개발실 담당임원 | System LSI SOC개발실 수석 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 조철용 | 남 | 1975.08 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 디자인팀장 | 영상디스플레이 디자인팀 수석 | 홍익대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 조철형 | 남 | 1971.03 | 상무 | 상근 | SEDA-P(M)공장장 | 글로벌기술센터 담당임원 | 충북대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 조철호 | 남 | 1971.07 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원 | Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원 | Univ. of Southern California(석사) | 계열회사 임원 | |
| 조학주 | 남 | 1969.03 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 Logic TD실 담당 임원 | Foundry 기술개발실 담당임원 | Univ. of Texas, Austin(박 사) | 계열회사 임원 | |
| 조현덕 | 남 | 1974.05 | 상무 | 상근 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | 메모리 전략마케팅실 담당부장 | 경북대(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 조호근 | 남 | 1977.11 | 상무 | 상근 | 재경팀 담당임원 | 재경팀 담당부장 | Univ. Of California, LA(석 사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 조훈영 | 남 | 1973.08 | 상무 | 상근 | Samsing Research Global AI센터 담당임원 | NC Soft, Lab장 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 17 |
| 조희권 | 남 | 1976.06 | 상무 | 상근 | SEA 담당임원 | SEA 수석 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 존테일러 | 남 | 1968.04 | 상무 | 상근 | SAS 담당임원 | SAS VP | Univ. of New Hampshire(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 주명휘 | 남 | 1963.08 | 상무 | 상근 | DS부문 DSC 담당임원 | DS부문 중국총괄 VP | 上海大(석사) | 계열회사 임원 | |
| 주재원 | 남 | 1968.02 | 상무 | 상근 | 생활가전 개발팀 담당임원 | Global CS센터 담당임원 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 주현대 | 남 | 1972.12 | 상무 | 상근 | 생활가전 Global제조팀 담당임 원 | 생활가전 Global운영팀 담당임 원 | 울산대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 주형빈 | 남 | 1973.06 | 상무 | 상근 | SESAR법인장 | SEIL법인장 | 경희대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 지송하 | 여 | 1973.01 | 상무 | 상근 | 글로벌마케팅실 글로벌브랜드 센터 담당임원 | 영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원 | 이화여대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 지우정 | 남 | 1967.11 | 상무 | 상근 | SEEG-S법인장 | 생활가전 전략마케팅팀 담당임 원 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 지혜령 | 여 | 1972.04 | 상무 | 상근 | 커뮤니케이션팀 담당임원 | 커뮤니케이션팀 담당부장 | Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사) | 계열회사 임원 | |
| 진영두 | 남 | 1972.06 | 상무 | 상근 | 생활가전 S/W개발팀 담당임원 | Mobile eXperience사업부 개발 실 수석 | 동아대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 진인식 | 남 | 1971.03 | 상무 | 상근 | 혁신센터 담당임원 | DIT센터 담당임원 | 서강대(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 차경환 | 남 | 1972.04 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원 | SEAU법인장 | Univ. of California, Berkeley(석사) | 계열회사 임원 | |
| 차도현 | 남 | 1973.04 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | Mobile eXperience 담당임원 | Univ. of Southern California(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 차이위엔 천 | 남 | 1968.01 | 상무 | 상근 | Foundry 기술개발실 담당임원 | TEXAS INSTRUMENTS, Selection Manager | 국립대만대(석사) | 계열회사 임원 | 9 |
| 채동혁 | 남 | 1973.10 | 상무 | 상근 | 메모리 Flash개발실 담당임원 | 세미브레인, 팀장 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------|----|
| 천기철 | 남 | 1970.09 | 상무 | 상근 | DS부문 DSC 담당임원 | 메모리 품질보증실 담당임원 | Univ. Of Minnesota, Twin Cities(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 천상필 | 남 | 1969.05 | 상무 | 상근 | Global Public Affairs팀 담당임원 | 구주총괄 대외협력팀 담당임원 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 최경수 | 남 | 1971.12 | 상무 | 상근 | 감사팀 담당임원 | 상생협력센터 담당임원 | 경북대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 최기화 | 남 | 1969.03 | 상무 | 상근 | 네트워크 시스템솔루션팀 담당임원 | 네트워크 개발팀 담당임원 | Carnegie Mellon Univ.(박사) | 계열회사 임원 | |
| 최동준 | 남 | 1972.05 | 상무 | 상근 | 글로벌마케팅실 D2C센터 담당임원 | 글로벌마케팅센터 담당임원 | Univ. of Southern California(석사) | 계열회사 임원 | |
| 최병철 | 남 | 1971.06 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 Global운영팀장 | 영상디스플레이 지원팀 담당임원 | 성균관대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 최병희 | 남 | 1970.05 | 상무 | 상근 | SETK법인장 | SEB법인장 | 경북대(학사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 최상종 | 남 | 1973.03 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원 | 한양대(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 최서림 | 남 | 1972.02 | 상무 | 상근 | DS부문 감사팀 담당임원 | 설비기술연구소 기획지원팀장 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 최선일 | 남 | 1971.11 | 상무 | 상근 | System LSI AP개발실 담당임원 | System LSI 기반설계실 Master | Univ. of Southern California(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 최성욱 | 남 | 1969.02 | 상무 | 상근 | 생산기술연구소 담당임원 | 글로벌기술센터 담당임원 | 삼성전자공과대학(전문대) | 계열회사 임원 | |
| 최순 | 남 | 1970.10 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원 | SEA 담당임원 | Duke Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |
| 최승림 | 남 | 1972.02 | 상무 | 상근 | CIS총괄 지원팀장 | 재경팀 담당임원 | 서울대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 최영 | 남 | 1969.07 | 상무 | 상근 | 한국총괄 MX팀 담당임원 | 한국총괄 IM영업팀 담당임원 | 항공대(학사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 최영돈 | 남 | 1972.12 | 상무 | 상근 | 메모리 Design Platform개발실 담당임원 | 메모리 Design Platform개발실 수석 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 최영일 | 남 | 1973.08 | 상무 | 상근 | SAS 담당임원 | Foundry 지원팀 담당임원 | Georgetown Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 최영준 | 남 | 1967.09 | 상무 | 상근 | 생활가전 전략마케팅팀 담당임원 | LG전자, 자문역 | Univ. of Minnesota, Twin Cities(석사) | 계열회사 임원 | 35 |
| 최원경 | 여 | 1973.08 | 상무 | 상근 | AVP사업팀 AVP개발실 담당임원 | TSP총괄 Package개발실 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 최유종 | 남 | 1971.12 | 상무 | 상근 | 상생협력센터 담당임원 | 인사팀 담당임원 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | |
| 최유진 | 여 | 1979.06 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 UX팀장 | 영상디스플레이 UX팀 수석 | Illinois Inst. of Tech.(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 최윤석 | 남 | 1974.09 | 상무 | 상근 | TSP총괄 Package개발실 담당임원 | TSP총괄 Package개발실 수석 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 최인수 | 남 | 1973.02 | 상무 | 상근 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | 메모리 전략마케팅실 수석 | 연세대(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 최일환 | 남 | 1972.11 | 상무 | 상근 | Big Data센터 담당임원 | Big Data센터 수석 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 최장석 | 남 | 1973.06 | 상무 | 상근 | 메모리 전략마케팅실 담당임원 | 메모리 전략마케팅실 수석 | 충남대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|---------|----|----|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|----|
| 최재혁 | 남 | 1974.06 | 상무 | 상근 | 사업지원T/F 담당임원 | 생활가전 지원팀 담당부장 | Georgetown Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 최정연 | 남 | 1974.11 | 상무 | 상근 | 메모리 Design Platform개발실 담당임원 | Foundry Design Platform개발 실 담당임원 | 포항공대(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 최정화 | 남 | 1973.01 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 개발팀 담당임 원 | 영상디스플레이 개발팀 수석 | 한양대(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 최종무 | 남 | 1975.08 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | 무선 개발실 수석 | 아주대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 최진필 | 남 | 1973.04 | 상무 | 상근 | SCS 담당임원 | 글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원 | 연세대(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 최창훈 | 남 | 1973.08 | 상무 | 상근 | SIEL-S 담당임원 | 영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당부장 | 인하대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 최창훈 | 남 | 1972.02 | 상무 | 상근 | 제조담당 제조시너지팀 담당임 원 | 생산기술연구소 설비개발실 담 당임원 | 서울시립대(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 최철민 | 남 | 1973.09 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담 당임원 | 무선 개발2실 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | |
| 최철환 | 남 | 1974.04 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 수석 | 홍익대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 최청호 | 남 | 1976.11 | 상무 | 상근 | 법무실 담당임원 | 광장, 변호사 | 경북대(학사) | 계열회사 임원 | 6 |
| 최혁승 | 남 | 1976.04 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 모바일플랫 폼센터 담당임원 | Mobile eXperience 모바일플랫 폼센터 수석 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 최현호 | 남 | 1979.06 | 상무 | 상근 | SAIT Material Research Center 담당임원 | 종합기술원 Material연구센터 수석 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 최호규 | 남 | 1968.12 | 상무 | 상근 | 글로벌마케팅실 CX·MDE센터 담당임원 | CX·MDE센터 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 추민기 | 남 | 1975.10 | 상무 | 상근 | SECE법인장 | SEUZ법인장 | 서강대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 추민수 | 남 | 1973.10 | 상무 | 상근 | SEPCO법인장 | SENZ법인장 | Univ. of California, LA(석 사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 카리아타 카시 | 남 | 1969.02 | 상무 | 상근 | DS부문 DSRJ 담당임원 | TDK, 총괄부장 | Tohoku Univ.(박사) | 계열회사 임원 | 8 |
| 코너피어 스 | 남 | 1970.04 | 상무 | 상근 | SEPOL법인장 | SEUK 담당임원 | Univ. of Dublin(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 편정우 | 남 | 1970.10 | 상무 | 상근 | 메모리 품질실 담당임원 | 메모리 품질보증실 수석 | Univ. of Texas, Austin(박 사) | 계열회사 임원 | |
| 하경수 | 남 | 1979.04 | 상무 | 상근 | 메모리 DRAM개발실 담당임원 | 메모리 DRAM개발실 수석 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 하현재 | 남 | 1970.08 | 상무 | 상근 | DS부문 People팀 담당임원 | DS부문 People팀 담당부장 | 광운대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 한규희 | 남 | 1974.01 | 상무 | 상근 | 설비기술연구소 설비개발실 담 당임원 | 생산기술연구소 수석 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 한글라라 | 여 | 1976.02 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 구매팀 담당임 원 | 영상디스플레이 구매팀 담당부 장 | 경희대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 한상섭 | 남 | 1972.04 | 상무 | 상근 | Global CS센터 담당임원 | Global CS센터 담당부장 | 광운대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 한상연 | 남 | 1969.01 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 DRAM TD실 담 당임원 | 반도체연구소 메모리 TD실 담 당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---------|----|----|---------------------------------|---|--|---------|----|
| 한상욱 | 남 | 1974.02 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 개발실 담당임원 | Mobile eXperience 개발실 수석 | Univ. of Texas at Austin(박사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 한우섭 | 남 | 1967.01 | 상무 | 상근 | 생산기술연구소 담당임원 | 글로벌기술센터 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | |
| 한의택 | 남 | 1974.02 | 상무 | 상근 | SIEL-S 담당임원 | SME법인장 | State Univ. of New York, Stony Brook(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 한장수 | 남 | 1970.02 | 상무 | 상근 | 북미총괄 법무지원팀장 | 무선 지원팀 담당임원 | State Univ. of New York, Buffalo(박사) | 계열회사 임원 | |
| 한정남 | 남 | 1973.01 | 상무 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 한종호 | 남 | 1976.01 | 상무 | 상근 | SEG 담당임원 | SEI 담당임원 | Vanderbilt Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 한진규 | 남 | 1973.12 | 상무 | 상근 | Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원 | Samsung Research 수석 | 연세대(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 한진우 | 남 | 1980.07 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원 | NASA, Senior Scientist | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 14 |
| 함선규 | 남 | 1970.01 | 상무 | 상근 | 중남미총괄 지원팀장 | SRA 담당임원 | Washington Univ. in St. Louis(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 허욱 | 남 | 1972.05 | 상무 | 상근 | 네트워크 전략마케팅팀 담당임원 | 네트워크 전략마케팅팀 담당부장 | Waseda Univ.(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 허일정 | 남 | 1978.05 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 EHS연구소 담당임원 | 한국화학연구원 환경자원연구 센터장 | 포항공대(박사) | 계열회사 임원 | 8 |
| 허준 | 남 | 1972.08 | 상무 | 상근 | SEA 담당임원 | Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당부장 | 한양대(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 허준영 | 남 | 1977.02 | 상무 | 상근 | 네트워크 People팀장 | 구주총괄 인사팀장 | 연세대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 허준회 | 남 | 1979.03 | 상무 | 상근 | System LSI CP개발실 담당임원 | System LSI 기반설계실 담당임원 | Georgia Inst. of Tech.(박사) | 계열회사 임원 | 24 |
| 허지영 | 남 | 1970.09 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원 | 부산대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 허진욱 | 남 | 1971.09 | 상무 | 상근 | 북미총괄 CS팀장 | ECSO장 | 한양대(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 허태영 | 남 | 1970.11 | 상무 | 상근 | 글로벌마케팅실 CX·MDE센터 담당임원 | 영상디스플레이 CX팀장 | Univ. of California, LA(학사) | 계열회사 임원 | |
| 허훈 | 남 | 1974.08 | 상무 | 상근 | 네트워크 개발팀 담당임원 | 네트워크 개발팀 수석 | Univ. of Southern California(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 헨릭안손 | 남 | 1975.03 | 상무 | 상근 | 네트워크 담당임원 | Ericsson, VP | Chalmers Univ.(석사) | 계열회사 임원 | 6 |
| 현대은 | 남 | 1975.10 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 담당임원 | 영상디스플레이 개발팀 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 현상진 | 남 | 1972.02 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 공정개발실 담당임원 | 반도체연구소 메모리 TD실 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 현정혁 | 남 | 1977.09 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 수석 | 성균관대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 홍경선 | 남 | 1970.08 | 상무 | 상근 | 커뮤니케이션팀 담당임원 | 커뮤니케이션팀 담당부장 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 홍기준 | 남 | 1971.05 | 상무 | 상근 | System LSI AP설계실 담당임원 | System LSI SOC개발실 담당임원 | Columbia Univ.(석사) | 계열회사 임원 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------|----|
| 홍순상 | 남 | 1972.08 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원 | 무선 서비스Biz팀 담당부장 | 연세대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 홍연석 | 남 | 1972.01 | 상무 | 상근 | SEIN-P법인장 | 무선 Global제조센터 담당부장 | 경북대(석사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 홍영주 | 남 | 1977.08 | 상무 | 상근 | 네트워크 지원팀 담당임원 | 사업지원T/F 담당부장 | 서울대(학사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 홍유석 | 남 | 1972.12 | 상무 | 상근 | 법무실 담당임원 | 법무실 책임변호사 | Univ. of Notre Dame(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 홍정호 | 남 | 1969.02 | 상무 | 상근 | 의료기기 지원팀장 | 전장사업팀 담당임원 | Univ. of Washington, Seattle(석사) | 계열회사 임원 | |
| 홍주선 | 남 | 1971.10 | 상무 | 상근 | 생활가전 개발팀 담당임원 | 영상디스플레이 Global운영팀 담당임원 | 경희대(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 홍준식 | 남 | 1971.12 | 상무 | 상근 | 제조담당 메모리제조기술센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원 | 전북대(석사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 홍희일 | 남 | 1970.10 | 상무 | 상근 | 메모리 DRAM개발실 담당임원 | 메모리 DRAM개발실 수석 | 한양대(석사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 황근철 | 남 | 1973.03 | 상무 | 상근 | 네트워크 시스템솔루션팀장 | 네트워크 개발팀 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 황근하 | 남 | 1970.05 | 상무 | 상근 | 영상디스플레이 Global제조팀 장 | 영상디스플레이 Global제조팀 담당임원 | 아주대(학사) | 계열회사 임원 | |
| 황보용 | 남 | 1970.10 | 상무 | 상근 | 창의개발센터장 | 신사업T/F 담당임원 | 한국과학기술원(석사) | 계열회사 임원 | |
| 황성훈 | 남 | 1969.07 | 상무 | 상근 | Global CS센터 담당임원 | Global CS센터 담당부장 | 한양대(석사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 황영삼 | 남 | 1977.10 | 상무 | 상근 | 동남아총괄 People팀장 | People팀 담당부장 | 한양대(학사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 황완구 | 남 | 1972.02 | 상무 | 상근 | 제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원 | 삼성바이오로직스 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 19 |
| 황용호 | 남 | 1975.10 | 상무 | 상근 | Samsung Research Security & Privacy팀장 | Samsung Research Security팀 담당임원 | 포항공대(박사) | 계열회사 임원 | 42 |
| 황인철 | 남 | 1977.11 | 상무 | 상근 | Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원 | Samsung Research Global SI센터 담당임원 | 한국과학기술원(박사) | 계열회사 임원 | 55 |
| 황일권 | 남 | 1973.12 | 상무 | 상근 | 생산기술연구소 담당임원 | 생산기술연구소 담당부장 | 고려대(석사) | 계열회사 임원 | 7 |
| 황호승 | 남 | 1967.01 | 상무 | 상근 | 글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원 | 글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원 | Imperial College(박사) | 계열회사 임원 | 31 |
| 황희돈 | 남 | 1974.01 | 상무 | 상근 | 반도체연구소 공정개발실 담당임원 | 반도체연구소 메모리 TD실 담당임원 | 서울대(박사) | 계열회사 임원 | 42 |

※ 미등기임원 소유주식수는 작성기준일 현재 보통주(의결권 있는 주식) 98,156,000주(이재용 회장 97,414,196주 등),

우선주(의결권 없는 주식) 173,245주(이재용 회장 137,757주 등)이며, 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)의 '임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참조하십시오.

※ 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 재직기간은 기업공시서식 작성기준에 따라 미등기임원으로서 5년 이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 기재를 생략하였습니다.

라.미등기임원의 변동

작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변동된 미등기임원은 다음과 같습니다.

| 구분 (사유) | 성명 | 성별 | 출생연월 | 직위 | 담당업무 | 최대주주와의 관계 |
|------------|-----|----|---------|-----|-----------------|-----------|
| 임원선임 | 강연호 | 남 | 1979.11 | 상무 | 재경팀 담당임원 | 계열회사 임원 |
| | 남태호 | 남 | 1969.03 | 상무 | DS부문 경영지원실 담당임원 | 계열회사 임원 |
| | 이정주 | 남 | 1976.07 | 상무 | 생활가전 CX팀 담당임원 | 계열회사 임원 |
| | 이승철 | 남 | 1977.11 | 상무 | DS부문 담당임원 | 계열회사 임원 |
| 임원사임 | 장성재 | 남 | 1965.06 | 부사장 | 생활가전 담당임원 | 계열회사 임원 |
| | 노승환 | 남 | 1974.08 | 상무 | 생활가전 담당임원 | 계열회사 임원 |
| | 신현 | 남 | 1972.12 | 상무 | 한국총괄 D2C팀 담당임원 | 계열회사 임원 |

※ 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

마. 직원 등의 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외 근로자 | | | 비고 |
|------|----|-------------------|--------------|------------|--------------|---------|------------|------------|-------------|-------------|---|---|----|
| 사업부문 | 성별 | 직원 수 | | | | | 평균 근속연수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 남 | 여 | 계 | |
| | | 기간의 정함이 없는 근로자 | | 기간제 근로자 | | 합 계 | | | | | | | |
| | | 전체 | (단시간 근로자) | 전체 | (단시간 근로자) | | | | | | | | |
| DX | 남 | 38,047 | - | 302 | - | 38,349 | 16.3 | - | - | - | - | - | |
| DX | 여 | 12,090 | 222 | 87 | - | 12,177 | 13.0 | - | - | | | - | |
| DS | 남 | 52,932 | - | 141 | - | 53,073 | 10.5 | - | - | | | - | |
| DS | 여 | 20,444 | 180 | 27 | - | 20,471 | 10.8 | - | - | | | - | |
| 성별합계 | 남 | 90,979 | - | 443 | - | 91,422 | 12.9 | 4,899,585 | 55 | | | - | |
| 성별합계 | 여 | 32,534 | 402 | 114 | - | 32,648 | 11.6 | 1,264,675 | 42 | | | - | |
| 합 계 | | 123,513 | 402 | 557 | - | 124,070 | 12.6 | 6,164,260 | 51 | | | - | |

- ※ 본사 기준이며, 휴직자는 포함하고 등기임원 11명(사내이사 5명, 사외이사 6명)은 제외한 기준입니다.
- ※ 반기급여 총액 및 1인평균 급여액은 「소득세법」 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준(근로소득공제 반영전)입니다.
- ※ 1인 평균급여액은 평균 재직자 120,164명(남: 89,892명, 여: 30,273명) 기준으로 산출하였습니다.
- ※ 소속 외 근로자는 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)

바. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|-------|-----|---------|----------|----|
| 미등기임원 | 988 | 225,049 | 232 | - |

- ※ 인원수는 작성기준일 현재 책임 중인 임원을 기준으로 하였으며, '미등기임원 현황'의 임원 중 국내에서 근로소득이 발생하지 않은 인원은 제외하였습니다.
- ※ 반기급여 총액과 1인평균 급여액은 「소득세법」 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.
- ※ 반기급여 총액은 성과급 지급 실적을 포함하고 있으며, 성과급 지급 시점은 매년 상이합니다.
- ※ 1인 평균급여액은 평균 재직자 964명을 기준으로 산출하였습니다.

2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수

<이사·감사 전체의 보수현황>

(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

| 구분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|----------------|-----|-----------|----|
| 등기이사 | 5 | - | - |
| 사외이사 | 3 | - | - |
| 감사위원회 위원 또는 감사 | 3 | - | - |
| 계 | 11 | 48,000 | - |

※ 인원수는 주주총회 승인일 기준입니다.

※ 주주총회 승인금액은 「상법」 제388조와 당사 정관에 따라 2023년 3월 15일 주주총회 결의를 통해 승인받은

이사(퇴임이사 포함)의 보수 한도입니다.

2) 보수지급금액

(2-1) 이사·감사 전체

(단위 : 백만원)

| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|-----|-------|-----------|----|
| 11 | 5,154 | 469 | - |

※ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한

등기이사·사외이사·감사위원회 위원에게 지급된 금액 기준입니다.

※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사의 미등기임원 재임 시 보수 금액을 포함하여 산정하였으며, 「소득세법」 상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.

※ 주식매수선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

(2-2) 유형별

(단위 : 백만원)

| 구분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|-----------------------------|-----|-------|--------------|----|
| 등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 5 | 4,540 | 908 | - |
| 사외이사 (감사위원회 위원 제외) | 3 | 317 | 106 | - |
| 감사위원회 위원 | 3 | 296 | 99 | - |
| 감사 | - | - | - | - |

※ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한

등기이사·사외이사·감사위원회 위원에게 지급된 금액 기준입니다.

※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사의 미등기임원 재임 시 보수 금액을 포함하여 산정하였으며, 「소득세법」 상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.

※ 주식매수선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

(3) 보수지급기준

당사는 주주총회의 승인을 받은 이사보수 한도 금액 내에서 당사 임원처우규정 및 사외이사 처우규정에 따라 이사의 보수를 지급하고 있습니다.

| 구분 | 보수지급기준 |
|--------------------------------|--|
| 등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) | <ul style="list-style-type: none"> · 급여: 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무 수행 결과 등을 고려하여 보수를 결정 · 설·추석상여: 각 월급여 100% 지급 · 목표인센티브: 부서별 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 월급여의 0~200% 내에서 연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) · 성과인센티브: 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) · 장기성과인센티브: ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급 · 복리후생: 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원·건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공 |
| 사외이사 (감사위원회 위원 제외) | <ul style="list-style-type: none"> · 급여: 사외이사 처우규정에 따라 위임업무의 성격 등을 고려하여 보수를 결정 · 복리후생: 사외이사 처우규정에 따라 의료지원·건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공 |
| 감사위원회 위원 | <ul style="list-style-type: none"> · 급여: 사외이사 처우규정에 따라 위임업무의 성격 등을 고려하여 보수를 결정 · 복리후생: 사외이사 처우규정에 따라 의료지원·건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공 |

<보수지급금액 5억원 이상인 이사·감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|-----|------|-------|------------------|
| 한종희 | 대표이사 | 1,186 | - |
| 경계현 | 대표이사 | 954 | - |
| 노태문 | 이사 | 905 | - |
| 박학규 | 이사 | 697 | - |
| 이정배 | 이사 | 798 | - |

※ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임

또는 퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원 기준입니다.

※ 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사의 미등기임원 재임 시 보수 금액을 포함하여

산정하였으며, 「소득세법」 상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

| 이름 | 보수의 종류 | | 총액 | 산정기준 및 방법 |
|-------------|----------|-----------------|-----|--|
| 대표이사 한종희 | 근로 소득 | 급여 | 744 | · 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(부회장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 101백만원, 3월 181백만원, 4월부터 6월까지 매월 121백만원을 지급 |
| | | 상여 | 433 | · 설 상여 : 월급여 100% 지급 · 성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) (소급) ※ 전사 계량지표와 관련하여 2022년 DX 부문 매출액 182.5조원, 영업이익 12.7조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 전사 공통 플랫폼 고도화를 통한 DX 부문 제품 경쟁력 제고를 이끌었고, B2B 및 서비스 사업 강화로 미래경쟁력 제고에 기여한 점을 고려, 상여금 산정 |
| | | 주식매수선택권 행사이익 | - | - |
| | | 기타 근로소득 | 9 | · 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공 |
| | 퇴직소득 | - | - | - |
| | 기타소득 | - | - | - |

(단위 : 백만원)

| 이름 | 보수의 종류 | | 총액 | 산정기준 및 방법 |
|-------------|----------|-----------------|-----|--|
| 대표이사 경계현 | 근로 소득 | 급여 | 611 | · 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 83백만원, 3월 149백만원, 4월부터 6월까지 매월 99백만원을 지급 |
| | | 상여 | 330 | · 설 상여 : 월급여 100% 지급 · 성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) (소급) ※ 전사 계량지표와 관련하여 2022년 DS 부문 매출액 98.5조원, 영업이익 23.8조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 최선단 12나노급 DRAM 개발, 세계 최초 3나노 파운드리 양산, 업계 최초 2억화소 이미지센서 개발 등을 통해 반도체 사업 미래경쟁력 제고에 기여한 점을 고려, 상여금 산정 |
| | | 주식매수선택권 행사이익 | - | - |
| | | 기타 근로소득 | 14 | · 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공 |
| | 퇴직소득 | - | - | |
| | 기타소득 | - | - | |

(단위 : 백만원)

| 이름 | 보수의 종류 | | 총액 | 산정기준 및 방법 |
|-----------|----------|-----------------|-----|--|
| 이사 노태문 | 근로 소득 | 급여 | 632 | · 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 94백만원, 3월 132백만원, 4월부터 6월까지 매월 104백만원을 지급 |
| | | 상여 | 250 | · 설 상여 : 월급여 100% 지급 · 성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) (소급) ※ 전사 계량지표와 관련하여 2022년 MX 사업 매출액 115.4조원, 영업이익 10.5조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 모바일 분야 기술 혁신과 지역별 판매전략 강화를 통해 리더십 수성을 이끌었고, Risk 관리를 통한 브랜드 이미지 개선에 기여한 점을 고려, 상여금 산정 |
| | | 주식매수선택권 행사이익 | - | - |
| | | 기타 근로소득 | 24 | · 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공 |
| | 퇴직소득 | - | - | |
| | 기타소득 | - | - | |

(단위 : 백만원)

| 이름 | 보수의 종류 | | 총액 | 산정기준 및 방법 |
|-----------|----------|-----------------|-----|---|
| 이사 박학규 | 근로 소득 | 급여 | 518 | · 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 74백만원, 3월 118백만원, 4월부터 6월까지 매월 85백만원을 지급 |
| | | 상여 | 149 | · 설 상여 : 월급여 100% 지급 · 성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) (소급) ※ 전사 계량지표와 관련하여 2022년 DX부문 매출액 182.5조원, 영업이익 12.7조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 글로벌 경제 위기 상황에서도 사업리스크 선제적 관리, 자원 운영 고도화로 견실한 실적을 이끌었고, 중장기 투자 자원을 효과적으로 배분하여 미래 성장 동력 확보에 기여한 점을 고려, 상여금 산정 |
| | | 주식매수선택권 행사이익 | - | - |
| | | 기타 근로소득 | 30 | · 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공 |
| | 퇴직소득 | - | - | |
| | 기타소득 | - | - | |

(단위 : 백만원)

| 이름 | 보수의 종류 | | 총액 | 산정기준 및 방법 |
|-----------|----------|-----------------|-----|---|
| 이사 이정배 | 근로 소득 | 급여 | 510 | · 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 69백만원, 3월 124백만원, 4월부터 6월까지 매월 83백만원을 지급 |
| | | 상여 | 276 | · 설 상여 : 월급여 100% 지급 · 성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지급) (소급) ※ 전사 계량지표와 관련하여 2022년 메모리사업 매출액 68.5조원, 영업이익 20.8조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 DRAM/Flash 시장 리더십 수성과 최선단 12나노급 DRAM, 8세대 V-NAND 개발 등 메모리 제품 미래 경쟁력 제고에 기여한 점을 고려, 상여금 산정 |
| | | 주식매수선택권 행사이익 | - | - |
| | | 기타 근로소득 | 12 | · 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공 |
| | 퇴직소득 | - | - | |
| | 기타소득 | - | - | |

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|-----|-----|-------|------------------|
| 장우승 | 부사장 | 2,814 | - |
| 최강석 | 부사장 | 2,680 | - |
| 이해창 | 부사장 | 1,881 | - |
| 임근휘 | 부사장 | 1,575 | - |
| 한지니 | 부사장 | 1,363 | - |

※ 보수총액은 「소득세법」 상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

| 이름 | 보수의 종류 | | 총액 | 산정기준 및 방법 |
|-----|--------|--------------|-------|--|
| 장우승 | 근로소득 | 급여 | 249 | · 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(부사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 6월까지 매월 평균 41백만원을 지급 |
| | | 상여 | 2,487 | · 설상여 : 25백만원을 지급 · 성과인센티브 : 개인의 연간 업무목표(Big Data 인프라 강화 및 활용 확대, 온라인 사업 확대 지원 등) 달성도에 근거하여 대표이사가 결정한 지급률과 개별 기준금액에 따라 산정한 인센티브를 연 1회 지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2022년 DX 부문 매출액 182.5조원, 영업이익 12.7조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 Big Data 인프라 강화 및 활용 확대, 온라인 사업 확대 지원 등 미래경쟁력 제고에 기여한 점을 고려, 상여금 산정 |
| | | 주식매수선택권 행사이익 | - | - |
| | | 기타 근로소득 | 79 | · 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공 |
| | 퇴직소득 | - | - | - |
| | 기타소득 | - | - | - |

(단위 : 백만원)

| 이름 | 보수의 종류 | | 총액 | 산정기준 및 방법 |
|-----|--------|-----------------|-------|--|
| 최강석 | 근로소득 | 급여 | 587 | · 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(부사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 6월까지 매월 평균 98백만원을 지급 |
| | | 상여 | 2,064 | · 설상여 : 59백만원을 지급 · 성과인센티브 : 개인의 연간 업무목표(B2B 매출 확대 및 B2B 파트너십 강화) 달성도에 근거하여 대표이사가 결정한 지급률과 개별 기준금액에 따라 산정한 인센티브를 연 1회 지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2022년 MX 사업 매출액 115.4조원, 영업이익 10.5조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 B2B고객의 만족도 제고와 사업 확대의 기반을 마련한 점을 고려, 상여금 산정 |
| | | 주식매수선택권 행사이익 | - | - |
| | | 기타 근로소득 | 28 | · 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공 |
| | 퇴직소득 | - | - | - |
| | 기타소득 | - | - | - |

(단위 : 백만원)

| 이름 | 보수의 종류 | | 총액 | 산정기준 및 방법 |
|-----|--------|-----------------|-------|---|
| 이해창 | 근로소득 | 급여 | 256 | · 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(부사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 6월까지 매월 평균 43백만원을 지급 |
| | | 상여 | 1,600 | · 설상여 : 38백만원을 지급 · 성과인센티브 : 개인의 연간 업무목표(Automotive CIS제품 개발 및 사업화) 달성도에 근거하여 대표이사가 결정한 지급률과 개별 기준금액에 따라 산정한 인센티브를 연 1회 지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2022년 Automotive CIS 신사업 수주 목표액 5억불을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 신제품 성능 개선과 중국향 사업 확대의 기반을 마련한 점을 고려, 상여금 산정 |
| | | 주식매수선택권 행사이익 | - | - |
| | | 기타 근로소득 | 26 | · 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공 |
| | 퇴직소득 | - | - | - |
| | 기타소득 | - | - | - |

(단위 : 백만원)

| 이름 | 보수의 종류 | | 총액 | 산정기준 및 방법 |
|-----|--------|--------------|-------|--|
| 임근휘 | 근로소득 | 급여 | 164 | · 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(부사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 6월까지 매월 평균 27백만원을 지급 |
| | | 상여 | 1,343 | · 설상여 : 17백만원을 지급 · 성과인센티브 : 개인의 연간 업무목표(Big Data 인프라 강화 및 활용 확대, 온라인 사업 확대 지원 등) 달성도에 근거하여 대표이사가 결정한 지급률과 개별 기준금액에 따라 산정한 인센티브를 연 1회 지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2022년 DX 부문 매출액 182.5조원, 영업이익 12.7조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 Big Data 인프라 강화 및 활용 확대, 온라인 사업 확대 지원 등 미래경쟁력 제고에 기여한 점을 고려, 상여금 산정 |
| | | 주식매수선택권 행사이익 | - | - |
| | | 기타 근로소득 | 68 | · 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공 |
| | 퇴직소득 | - | - | |
| | 기타소득 | - | - | |

(단위 : 백만원)

| 이름 | 보수의 종류 | | 총액 | 산정기준 및 방법 |
|-----|--------|--------------|-----|--|
| 한지니 | 근로소득 | 급여 | 684 | · 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(부사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 6월까지 매월 평균 114백만원을 지급 |
| | | 상여 | 657 | · 설상여 : 69백만원을 지급 · 성과인센티브 : 개인의 연간 업무목표(Samsung Wallet, Digital Car Key 등 서비스 확대) 달성도에 근거하여 대표이사가 결정한 지급률과 개별 기준금액에 따라 산정한 인센티브를 연 1회 지급 ※ 전사 계량지표와 관련하여 2022년 DX 부문 매출액 182.5조원, 영업이익 12.7조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련하여 디지털 서비스 확대로 MX사업 경쟁력 확보에 기여한 점을 고려, 상여금 산정 |
| | | 주식매수선택권 행사이익 | - | - |
| | | 기타 근로소득 | 23 | · 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공 |
| | 퇴직소득 | - | - | |
| | 기타소득 | - | - | |

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황

2023년 반기말 현재 이사·감사·업무집행지시자 등에게 부여한 미행사 주식매수선택권(누적기준)은 없습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 인원수 | 주식매수선택권의 공정가치 총액 | 비고 |
|----------------|-------|------------------|----|
| 등기이사 | 5 | - | - |
| 사외이사 | 3 | - | - |
| 감사위원회 위원 또는 감사 | 3 | - | - |
| 업무집행지시자 | 1,151 | - | - |
| 계 | 1,162 | - | - |

※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단에 소속된 회사(요약)

당사는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 삼성그룹에 속한 계열회사로서, 2023년 반기말 현재 삼성그룹에는 전년말과 동일한 63개의 국내 계열회사가 있습니다. 이중 상장사는 당사를 포함하여 총 17개사이며 비상장사는 46개사입니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 사)

| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | | |
|----------|---------|-----|----|
| | 상장 | 비상장 | 계 |
| 삼성 | 17 | 46 | 63 |

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계열회사간 출자현황

[국내]

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : %)

| 피출자회사 출자회사 | 삼성물산 주 | 삼성바이오로직스 주 | 삼성생명 보험주 | 삼성에스 디아이주 | 삼성에스 디에스주 | 삼성에프 엔위탁관 리부동산 투자회사 (주) | 삼성엔지 니어링주 | 삼성전기 주 | 삼성전자 주 | 삼성중공 업주 | 삼성증권 주 | 삼성카드 주 | 삼성화재 해상보험 주 |
|--|-----------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 삼성물산주 | | 43.1 | 19.3 | | 17.1 | | 7.0 | 5.0 | 0.1 | | | | |
| 삼성바이오로직스주 | | | | | | | | | | | | | |
| 삼성생명보험주 | 0.1 | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 19.5 | 0.1 | 0.1 | 8.7 | 3.0 | 29.4 | 71.9 | 15.0 |
| 삼성에스디아이주 | | | | | | | 11.7 | | | 0.4 | | | |
| 삼성에스디에스주 | | | | | | | | | | | | | |
| 삼성전기주 | | | | | | | | | | 2.1 | | | |
| 삼성전자주 | | 31.2 | | 19.6 | 22.6 | | | 23.7 | | 15.2 | | | |
| 삼성중공업주 | | | | | | | | | | | | | |
| 삼성증권주 | | | | | | 2.9 | | | | | | | |
| 삼성카드주 | | | | | | | | | | | | | |
| 삼성화재해상보험주 | | | | | | 18.7 | 0.2 | 1.5 | | | | | |
| 주에스원 | | | | | | | | | | | | | |
| 주제일기획 | | | | | | | | | | 0.1 | | | |
| 주호텔신라 | | | | | | | | | | | | | |
| 삼성디스플레이주 | | | | | | | | | | | | | |
| 삼성자산운용주 | | | | | | | | | | | | | |
| 삼성전자서비스주 | | | | | | | | | | | | | |
| 주미라콤아이앤씨 | | | | | | | | | | | | | |
| 주삼성글로벌리서치 | | | | | | | | | | | | | |
| Harman International Industries, Inc. | | | | | | | | | | | | | |
| 계 | 0.1 | 74.3 | 19.3 | 19.7 | 39.8 | 41.2 | 19.0 | 23.8 | 15.2 | 20.9 | 29.4 | 71.9 | 15.0 |

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : %)

| 피출자회사 출자회사 | (주)멀티캠 퍼스 | ㈜에스원 | ㈜제일기 획 | ㈜호텔신 라 | 삼성디스 플레이㈜ | 삼성메디 슨㈜ | 삼성바이 오에피스 ㈜ | 삼성벤처 투자㈜ | 삼성생명 서비스손 해사정㈜ | 삼성선물 ㈜ | 삼성액티 브자산운 용㈜ | 삼성에스 알에이자 산운용㈜ | 삼성웰스 토리㈜ |
|--|--------------|------|-----------|-----------|--------------|------------|-------------------|-------------|----------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------|
| 삼성물산㈜ | | | | | | | | 16.7 | | | | | 100.0 |
| 삼성바이오로직스㈜ | | | | | | | 100.0 | | | | | | |
| 삼성생명보험㈜ | 0.0 | 5.4 | 0.3 | 7.4 | | | | | 99.8 | | | 100.0 | |
| 삼성에스디아이㈜ | | 11.0 | | 0.1 | 15.2 | | | 16.3 | | | | | |
| 삼성에스디에스㈜ | 47.2 | | | | | | | | | | | | |
| 삼성전기㈜ | | | | | | | | 17.0 | | | | | |
| 삼성전자㈜ | | | 25.2 | 5.1 | 84.8 | 68.5 | | 16.3 | | | | | |
| 삼성중공업㈜ | | | | | | | | 17.0 | | | | | |
| 삼성증권㈜ | | 1.3 | | 3.1 | | | | 16.7 | 100.0 | | | | |
| 삼성카드㈜ | | 1.9 | 3.0 | 1.3 | | | | | | | | | |
| 삼성화재해상보험㈜ | | 1.0 | | | | | | | | | | | |
| 에스원 | | | | | | | | | | | | | |
| 제일기획 | | | | | | | | | | | | | |
| 호텔신라 | | | | | | | | | | | | | |
| 삼성디스플레이㈜ | | | | | | | | | | | | | |
| 삼성자산운용㈜ | | | | | | | | | | | 100.0 | | |
| 삼성전자서비스㈜ | | | | | | | | | | | | | |
| ㈜미라콤아이앤씨 | | | | | | | | | | | | | |
| ㈜삼성글로벌리서치 | 15.2 | | | | | | | | | | | | |
| Harman International Industries, Inc. | | | | | | | | | | | | | |
| 계 | 62.4 | 20.7 | 28.6 | 17.0 | 100.0 | 68.5 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : %)

| 피출자회사 \\ 출자회사 | 삼성자산운 용주 | 삼성전자로 지택주 | 삼성전자서 비스주 | 삼성전자서 비스씨에스 주 | 삼성전자판 매주 | 삼성카드고 객서비스주 | 삼성코닝어 드밴스드글 라스(유) | 삼성해지자 산운용주 | 삼성화재서 비스손해사 정주 | 삼성화재애 니카손해사 정주 | 세메스주 | 수원삼성축 구단주 |
|--|-------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------|--------------|
| 삼성물산주 | | | | | | | | | | | | |
| 삼성바이오로직스주 | | | | | | | | | | | | |
| 삼성생명보험주 | 100.0 | | | | | | | | | | | |
| 삼성에스디아이주 | | | | | | | | | | | | |
| 삼성에스디에스주 | | | | | | | | | | | | |
| 삼성전기주 | | | | | | | | | | | | |
| 삼성전자주 | | 100.0 | 99.3 | | 100.0 | | | | | | 91.5 | |
| 삼성중공업주 | | | | | | | | | | | | |
| 삼성증권주 | | | | | | | | | | | | |
| 삼성카드주 | | | | | | 100.0 | | | | | | |
| 삼성화재해상보험주 | | | | | | | | | 100.0 | 100.0 | | |
| 주에스원 | | | | | | | | | | | | |
| 주제일기획 | | | | | | | | | | | | 100.0 |
| 주호텔신라 | | | | | | | | | | | | |
| 삼성디스플레이주 | | | | | | | 50.0 | | | | | |
| 삼성자산운용주 | | | | | | | | 100.0 | | | | |
| 삼성전자서비스주 | | | | 100.0 | | | | | | | | |
| 주미래콤아이앤씨 | | | | | | | | | | | | |
| 주삼성글로벌리서치 | | | | | | | | | | | | |
| Harman International Industries, Inc. | | | | | | | | | | | | |
| 계 | 100.0 | 100.0 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 91.5 | 100.0 |

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : %)

| 피출자회사 \ 출자회사 | 스테코(주) | 신라에이치 엠(주) | 에스디플렉 스(주) | 에스비티엠 (주) | 에스원씨알 엠(주) | 에스유머티 리얼스(주) | 에스코어(주) | 에스티엠(주) | 에이치디씨 신라면세점 (주) | 오픈핸즈(주) | 제일패션리 테일(주) | 주미라콤아 이앤씨 |
|--|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------|---------|-----------------------|---------|----------------|--------------|
| 삼성물산(주) | | | | | | | | | | | 100.0 | |
| 삼성바이오로직스(주) | | | | | | | | | | | | |
| 삼성생명보험(주) | | | | | | | | | | | | |
| 삼성에스디아이(주) | | | 50.0 | | | | | 100.0 | | | | |
| 삼성에스디에스(주) | | | | | | | 81.8 | | | 100.0 | | 83.6 |
| 삼성전기(주) | | | | | | | | | | | | |
| 삼성전자(주) | 70.0 | | | | | | | | | | | |
| 삼성중공업(주) | | | | | | | | | | | | |
| 삼성증권(주) | | | | | | | | | | | | |
| 삼성카드(주) | | | | | | | | | | | | |
| 삼성화재해상보험(주) | | | | | | | | | | | | |
| (주)에스원 | | | | | 100.0 | | 0.6 | | | | | 0.6 |
| (주)제일기획 | | | | | | | 5.2 | | | | | 5.4 |
| (주)호텔신라 | | 100.0 | | 100.0 | | | | | 50.0 | | | |
| 삼성디스플레이(주) | | | | | | 50.0 | | | | | | |
| 삼성자산운용(주) | | | | | | | | | | | | |
| 삼성전자서비스(주) | | | | | | | | | | | | |
| (주)미라콤아이앤씨 | | | | | | | 0.5 | | | | | |
| (주)삼성글로벌리서치 | | | | | | | | | | | | |
| Harman International Industries, Inc. | | | | | | | | | | | | |
| 계 | 70.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 88.1 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 89.6 |

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : %)

| 피출자회사 \ 출자회사 | ㈜삼성글 로벌리서 치 | ㈜삼성라 이온즈 | ㈜삼성생명 금융서비스 | ㈜삼성화재 금융서비스 보험대리점 | ㈜삼우종합 건축사사무 소 | ㈜서울레 이크사이 드 | ㈜시큐아이 | ㈜씨브이 네트 | ㈜에스에이 치피코퍼레 이션 | ㈜하만인 터내셔널 코리아 | ㈜휴먼티에 스에스 | ㈜희망별숲 |
|--|-------------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------|------------|----------------------|---------------------|--------------|-------|
| 삼성물산주 | 1.0 | | | | 100.0 | 100.0 | 8.7 | 40.1 | | | | |
| 삼성바이오로직스주 | | | | | | | | | | | | |
| 삼성생명보험주 | 14.8 | | 100.0 | | | | | | | | | |
| 삼성에스디아이주 | 29.6 | | | | | | | | | | | |
| 삼성에스디에스주 | | | | | | | 56.5 | 9.4 | | | | |
| 삼성전기주 | 23.8 | | | | | | | | | | | |
| 삼성전자주 | 29.8 | | | | | | | | | | | 100.0 |
| 삼성중공업주 | 1.0 | | | | | | | | | | | |
| 삼성증권주 | | | | | | | | | | | | |
| 삼성카드주 | | | | | | | | | | | | |
| 삼성화재해상보험주 | | | | 100.0 | | | | | | | | |
| ㈜에스원 | | | | | | | | | | | 100.0 | |
| ㈜제일기획 | | 67.5 | | | | | | | | | | |
| ㈜호텔신라 | | | | | | | | | 100.0 | | | |
| 삼성디스플레이주 | | | | | | | | | | | | |
| 삼성자산운용주 | | | | | | | | | | | | |
| 삼성전자서비스주 | | | | | | | | | | | | |
| ㈜미라콤아이앤씨 | | | | | | | | | | | | |
| ㈜삼성글로벌리서치 | | | | | | | | | | | | |
| Harman International Industries, Inc. | | | | | | | | | | 100.0 | | |
| 계 | 100.0 | 67.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 65.2 | 49.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

[해외]

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : %)

| 출자회사 | 피출자회사 | 지분율(%) |
|-------------------------------|--|--------|
| (주)삼우종합건축사사무소 | SAMOO AUSTIN INC | 100.0 |
| (주)삼우종합건축사사무소 | SAMOO HU Designer and Engineering Services Limited | 100.0 |
| (주)삼우종합건축사사무소 | SAMOO DESIGNERS & ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED | 100.0 |
| (주)삼우종합건축사사무소 | SAMOO (KL) SDN. BHD. | 100.0 |
| (주)삼우종합건축사사무소 | SAMOO Design Consulting Co.,Ltd | 100.0 |
| Samsung C&T America Inc. | Samsung Green repower, LLC | 100.0 |
| Samsung C&T America Inc. | Samsung Solar Construction Inc. | 100.0 |
| Samsung C&T America Inc. | QSSC, S.A. de C.V. | 20.0 |
| Samsung C&T America Inc. | Samsung Solar Energy LLC | 100.0 |
| Samsung C&T America Inc. | Equipment Trading Solutions Group, LLC | 70.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SP Armow Wind Ontario LP | 50.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE GRW EPC GP Inc. | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE GRW EPC LP | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE SKW EPC GP Inc. | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE SKW EPC LP | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE WIND PA GP INC. | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE WIND PA LP | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE GRS Holdings GP Inc. | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE GRS Holdings LP | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE K2 EPC GP Inc. | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE K2 EPC LP | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE KS HOLDINGS GP INC. | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE KS HOLDINGS LP | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SP Belle River Wind LP | 42.5 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE Armow EPC GP Inc. | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE Armow EPC LP | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | North Kent Wind 1 LP | 35.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE Wind GP Holding Inc. | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | South Kent Wind LP Inc. | 50.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | Grand Renewable Wind LP Inc. | 45.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE North Kent 2 LP Holdings LP | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE Solar Development GP Inc. | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE Solar Development LP | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE Windsor Holdings GP Inc. | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE Southgate Holdings GP Inc. | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE Solar Construction Management GP Inc. | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE Solar Construction Management LP | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE BRW EPC GP INC. | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE BRW EPC LP | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE North Kent 1 GP Holdings Inc | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE North Kent 2 GP Holdings Inc | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE Belle River GP Holdings Inc | 100.0 |

| | | |
|---|--|-------|
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE NK1 EPC GP Inc | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE NK1 EPC LP | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE Summerside Construction GP Inc. | 100.0 |
| Samsung Renewable Energy Inc. | SRE Summerside Construction LP | 100.0 |
| Samsung Green repower, LLC | Monument Power, LLC | 100.0 |
| SP Armow Wind Ontario GP Inc | SP Armow Wind Ontario LP | 0.0 |
| Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp. | PLL Holdings LLC | 83.6 |
| Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp. | PLL E&P LLC | 90.0 |
| SRE GRW EPC GP Inc. | SRE GRW EPC LP | 0.0 |
| SRE SKW EPC GP Inc. | SRE SKW EPC LP | 0.0 |
| PLL Holdings LLC | Parallel Petroleum LLC | 61.0 |
| SRE WIND PA GP INC. | SRE WIND PA LP | 0.0 |
| SRE GRS Holdings GP Inc. | Grand Renewable Solar GP Inc. | 50.0 |
| SRE GRS Holdings GP Inc. | SRE GRS Holdings LP | 0.0 |
| SRE K2 EPC GP Inc. | SRE K2 EPC LP | 0.0 |
| SRE KS HOLDINGS GP INC. | KINGSTON SOLAR GP INC. | 50.0 |
| SRE KS HOLDINGS GP INC. | SRE KS HOLDINGS LP | 0.0 |
| SP Belle River Wind GP Inc | SP Belle River Wind LP | 0.0 |
| SRE Armow EPC GP Inc. | SRE Armow EPC LP | 0.0 |
| SRE Wind GP Holding Inc. | SP Armow Wind Ontario GP Inc | 50.0 |
| SRE Wind GP Holding Inc. | South Kent Wind GP Inc. | 50.0 |
| SRE Wind GP Holding Inc. | Grand Renewable Wind GP Inc. | 50.0 |
| South Kent Wind GP Inc. | South Kent Wind LP Inc. | 0.0 |
| Grand Renewable Wind GP Inc. | Grand Renewable Wind LP Inc. | 0.0 |
| North Kent Wind 1 GP Inc | North Kent Wind 1 LP | 0.0 |
| SRE Solar Development GP Inc. | SRE Solar Development LP | 0.0 |
| SRE Solar Construction Management GP Inc. | SRE Solar Construction Management LP | 0.0 |
| SRE BRW EPC GP INC. | SRE BRW EPC LP | 0.0 |
| SRE North Kent 1 GP Holdings Inc | North Kent Wind 1 GP Inc | 50.0 |
| SRE North Kent 2 GP Holdings Inc | SRE North Kent 2 LP Holdings LP | 0.0 |
| SRE Belle River GP Holdings Inc | SP Belle River Wind GP Inc | 50.0 |
| SRE NK1 EPC GP Inc | SRE NK1 EPC LP | 0.0 |
| SRE Summerside Construction GP Inc. | SRE Summerside Construction LP | 0.0 |
| Samsung Solar Energy LLC | Samsung Solar Energy 1 LLC | 100.0 |
| Samsung Solar Energy LLC | Samsung Solar Energy 2 LLC | 100.0 |
| Samsung Solar Energy LLC | Samsung Solar Energy 3, LLC | 100.0 |
| Samsung Solar Energy 1 LLC | CS SOLAR LLC | 50.0 |
| Samsung Solar Energy 2 LLC | 5S ENERGY HOLDINGS, LLC | 50.0 |
| Samsung C&T Deutschland GmbH | SungEel Recycling Park Thuringen GmbH | 50.0 |
| Samsung C&T Deutschland GmbH | POSS-SLPC, S.R.O | 20.0 |
| Samsung C&T Deutschland GmbH | Solluce Romania 1 B.V. | 20.0 |
| Samsung C&T Deutschland GmbH | S.C. Otelinox S.A | 99.9 |
| Samsung C&T Malaysia SDN. BHD | WARIS GIGIH ENGINEERING AND TECHNOLOGY SDN. BHD. | 70.0 |
| Samsung C&T Singapore Pte., Ltd. | Samsung Chemtech Vina LLC | 48.3 |
| Samsung C&T Singapore Pte., Ltd. | Samsung C&T Thailand Co., Ltd | 0.2 |
| Samsung C&T Singapore Pte., Ltd. | Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd | 30.0 |

| | | |
|---|---|-------|
| Samsung C&T Singapore Pte., Ltd. | S&G Biofuel PTE.LTD | 12.6 |
| S&G Biofuel PTE.LTD | PT. Gandaerah Hendana | 95.0 |
| S&G Biofuel PTE.LTD | PT. Inecda | 95.0 |
| Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd. | VISTA CONTRACTING AND DEVELOPMENT BANGLADESH LTD. | 100.0 |
| Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd. | WELVISTA COMPANY LIMITED | 30.0 |
| CHEIL HOLDING INC. | SAMSUNG CONST. CO. PHILS. | 75.0 |
| Samsung C&T Hongkong Ltd. | Samsung C&T Thailand Co., Ltd | 6.8 |
| Samsung C&T Hongkong Ltd. | SAMSUNG TRADING (SHANGHAI) CO., LTD | 100.0 |
| Samsung C&T Hongkong Ltd. | Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd. | 45.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Japan Corporation | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics America, Inc. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Canada, Inc. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. | 63.6 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Ltd. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics (UK) Ltd. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Holding GmbH | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Iberia, S.A. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics France S.A.S | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Italia S.P.A. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Europe Logistics B.V. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Benelux B.V. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Overseas B.V. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Nordic Aktiebolag | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Austria GmbH | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Slovakia s.r.o | 55.7 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. | 75.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Vina Electronics Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Asia Pte. Ltd. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung India Electronics Private Ltd. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | PT Samsung Electronics Indonesia | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Thai Samsung Electronics Co., Ltd. | 91.8 |
| 삼성전자(주) | Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. | 69.1 |
| 삼성전자(주) | Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. | 48.2 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. | 100.0 |

| | | |
|-----------------------------------|--|-------|
| 삼성전자(주) | Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. | 90.0 |
| 삼성전자(주) | Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. | 73.7 |
| 삼성전자(주) | Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Egypt S.A.E | 0.1 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. | 87.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Argentina S.A. | 98.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Chile Limitada | 4.1 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Rus Company LLC | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Samsung Electronics Rus Kaluga LLC | 100.0 |
| 삼성전자(주) | Tianjin Samsung LED Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성바이오로직스(주) | Samsung Biologics America, Inc. | 100.0 |
| 삼성바이오에피스(주) | Samsung Bioepis United States Inc. | 100.0 |
| 삼성바이오에피스(주) | SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED | 100.0 |
| 삼성바이오에피스(주) | Samsung Bioepis NL B.V. | 100.0 |
| 삼성바이오에피스(주) | Samsung Bioepis CH GmbH | 100.0 |
| 삼성바이오에피스(주) | Samsung Bioepis PL Sp z o.o. | 100.0 |
| 삼성바이오에피스(주) | SAMSUNG BIOEPIS AU PTY LTD | 100.0 |
| 삼성바이오에피스(주) | SAMSUNG BIOEPIS NZ LIMITED | 100.0 |
| 삼성바이오에피스(주) | Samsung Bioepis TW Limited | 100.0 |
| 삼성바이오에피스(주) | Samsung Bioepis HK Limited | 100.0 |
| 삼성바이오에피스(주) | SAMSUNG BIOEPIS IL LTD | 100.0 |
| 삼성바이오에피스(주) | SAMSUNG BIOEPIS BR PHARMACEUTICAL LTDA | 100.0 |
| 삼성디스플레이(주) | Intellectual Keystone Technology LLC | 41.9 |
| 삼성디스플레이(주) | Emerald | 100.0 |
| 삼성디스플레이(주) | Samsung Display Slovakia, s.r.o., v likvidacii | 100.0 |
| 삼성디스플레이(주) | Samsung Display Vietnam Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성디스플레이(주) | Samsung Display Noida Private Limited | 100.0 |
| 삼성디스플레이(주) | Samsung Display Dongguan Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성디스플레이(주) | Samsung Display Tianjin Co., Ltd. | 95.0 |
| 삼성디스플레이(주) | Novald GmbH | 9.9 |
| 세메스(주) | SEMES America, Inc. | 100.0 |
| 세메스(주) | SEMES (XIAN) Co., Ltd. | 100.0 |
| Samsung Electronics America, Inc. | NeuroLogica Corp. | 100.0 |
| Samsung Electronics America, Inc. | Samsung HVAC America, LLC | 100.0 |
| Samsung Electronics America, Inc. | SmartThings, Inc. | 100.0 |
| Samsung Electronics America, Inc. | Samsung Oak Holdings, Inc. | 100.0 |
| Samsung Electronics America, Inc. | Joyent, Inc. | 100.0 |
| Samsung Electronics America, Inc. | TeleWorld Solutions, Inc. | 100.0 |
| Samsung Electronics America, Inc. | Samsung Semiconductor, Inc. | 100.0 |
| Samsung Electronics America, Inc. | Samsung Research America, Inc | 100.0 |

| | | |
|--|---|-------|
| Samsung Electronics America, Inc. | Samsung Electronics Home Appliances America, LLC | 100.0 |
| Samsung Electronics America, Inc. | Samsung International, Inc. | 100.0 |
| Samsung Electronics America, Inc. | Harman International Industries, Inc. | 100.0 |
| Samsung Semiconductor, Inc. | Samsung Federal, Inc. | 100.0 |
| Samsung Semiconductor, Inc. | Samsung Austin Semiconductor LLC. | 100.0 |
| Samsung Electronics Canada, Inc. | AdGear Technologies Inc. | 100.0 |
| Samsung Research America, Inc | SAMSUNG NEXT LLC | 100.0 |
| SAMSUNG NEXT LLC | SAMSUNG NEXT FUND LLC | 100.0 |
| Samsung International, Inc. | Samsung Mexicana S.A. de C.V | 100.0 |
| Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. | Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV | 100.0 |
| Emerald | Emerald Merger Sub, Inc. | 100.0 |
| Harman International Industries, Inc. | Harman International Japan Co., Ltd. | 100.0 |
| Harman International Industries, Inc. | Harman International Industries Canada Ltd. | 100.0 |
| Harman International Industries, Inc. | Harman Becker Automotive Systems, Inc. | 100.0 |
| Harman International Industries, Inc. | Harman Professional, Inc. | 100.0 |
| Harman International Industries, Inc. | Harman Connected Services, Inc. | 100.0 |
| Harman International Industries, Inc. | Harman Financial Group LLC | 100.0 |
| Harman International Industries, Inc. | Harman Belgium SA | 100.0 |
| Harman International Industries, Inc. | Harman France SNC | 100.0 |
| Harman International Industries, Inc. | Red Bend Software SAS | 100.0 |
| Harman International Industries, Inc. | Harman Inc. & Co. KG | 66.0 |
| Harman International Industries, Inc. | Harman KG Holding, LLC | 100.0 |
| Harman International Industries, Inc. | Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L. | 100.0 |
| Harman International Industries, Inc. | Harman Finance International, SCA | 100.0 |
| Harman International Industries, Inc. | Harman Finance International GP S.a.r.l | 100.0 |
| Harman International Industries, Inc. | Harman Industries Holdings Mauritius Ltd. | 100.0 |
| Harman International Industries, Inc. | Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V. | 99.9 |
| Harman Becker Automotive Systems, Inc. | Harman International Estonia OU | 100.0 |
| Harman Professional, Inc. | Harman Singapore Pte. Ltd. | 100.0 |
| Harman Professional, Inc. | Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda. | 0.0 |
| Harman Professional, Inc. | Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda. | 0.0 |
| Harman Connected Services, Inc. | Harman Connected Services Engineering Corp. | 100.0 |
| Harman Connected Services, Inc. | Harman Connected Services AB. | 100.0 |
| Harman Connected Services, Inc. | Harman Connected Services UK Ltd. | 100.0 |
| Harman Connected Services, Inc. | Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd. | 1.6 |
| Harman Connected Services, Inc. | Global Symphony Technology Group Private Ltd. | 100.0 |
| Harman Financial Group LLC | Harman International (India) Private Limited | 0.0 |
| Harman Financial Group LLC | Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V. | 0.1 |
| Harman Financial Group LLC | Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V. | 0.0 |
| Samsung Electronics (UK) Ltd. | Samsung Semiconductor Europe Limited | 100.0 |
| Samsung Electronics Holding GmbH | Samsung Semiconductor Europe GmbH | 100.0 |
| Samsung Electronics Holding GmbH | Samsung Electronics GmbH | 100.0 |
| Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. | Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. | 31.4 |
| Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. | Samsung Electronics Slovakia s.r.o | 44.3 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. | 36.4 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA | 100.0 |

| | | |
|--|--|-------|
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics West Africa Ltd. | 100.0 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics East Africa Ltd. | 100.0 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. | 100.0 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics Egypt S.A.E | 99.9 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics Israel Ltd. | 100.0 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L | 99.0 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. | 100.0 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. | 100.0 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics Turkiye | 100.0 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. | 100.0 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. | 100.0 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. | 100.0 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics Maghreb Arab | 100.0 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics Venezuela, C.A. | 100.0 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. | 13.0 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics Chile Limitada | 95.9 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics Peru S.A.C. | 100.0 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics Ukraine Company LLC | 100.0 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung R&D Institute Ukraine | 100.0 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung R&D Institute Rus LLC | 100.0 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics Central Eurasia LLP | 100.0 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd | 100.0 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. | 100.0 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. | Corephotonics Ltd. | 100.0 |
| Samsung Electronics Nordic Aktiebolag | Samsung Nanoradio Design Center | 100.0 |
| AKG Acoustics Gmbh | Harman Professional Denmark ApS | 100.0 |
| AKG Acoustics Gmbh | Studer Professional Audio GmbH | 100.0 |
| Harman Professional Denmark ApS | Martin Professional Japan Ltd. | 40.0 |
| Harman Becker Automotive Systems GmbH | Harman International Romania SRL | 0.0 |
| Harman Becker Automotive Systems GmbH | Apostera UA, LLC | 100.0 |
| Harman Holding Gmbh & Co. KG | Harman Becker Automotive Systems GmbH | 100.0 |
| Harman Holding Gmbh & Co. KG | Harman Deutschland GmbH | 100.0 |
| Harman Holding Gmbh & Co. KG | Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft | 100.0 |
| Harman Holding Gmbh & Co. KG | Harman RUS CIS LLC | 100.0 |
| Harman Inc. & Co. KG | Harman Holding Gmbh & Co. KG | 100.0 |
| Harman Inc. & Co. KG | Harman Management Gmbh | 100.0 |
| Harman Inc. & Co. KG | Harman Hungary Financing Ltd. | 100.0 |
| Harman Connected Services GmbH | Harman Connected Services OOO | 100.0 |
| Harman KG Holding, LLC | Harman Inc. & Co. KG | 34.0 |
| Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft | Harman Professional Kft | 100.0 |
| Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft | Harman Consumer Nederland B.V. | 100.0 |
| Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft | Harman International Romania SRL | 100.0 |

| | | |
|---|---|-------|
| Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft | Red Bend Ltd. | 100.0 |
| Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft | Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda. | 100.0 |
| Harman Hungary Financing Ltd. | Harman International Industries Limited | 100.0 |
| Harman Finance International GP S.a.r.l | Harman Finance International, SCA | 0.0 |
| Harman Consumer Nederland B.V. | AKG Acoustics Gmbh | 100.0 |
| Harman Consumer Nederland B.V. | Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada | 100.0 |
| Harman Consumer Nederland B.V. | Harman Holding Limited | 100.0 |
| Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada | Harman France SNC | 0.0 |
| Harman Connected Services AB. | Harman Finland Oy | 100.0 |
| Harman Connected Services AB. | Harman Connected Services GmbH | 100.0 |
| Harman Connected Services AB. | Harman Connected Services Poland Sp.zoo | 100.0 |
| Harman Connected Services AB. | Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd. | 100.0 |
| Harman International Industries Limited | Harman Automotive UK Limited | 100.0 |
| Harman International Industries Limited | Harman International Industries PTY Ltd. | 100.0 |
| Harman International Industries Limited | Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V. | 100.0 |
| Harman Connected Services UK Ltd. | Harman Connected Services Morocco | 100.0 |
| Samsung Electronics Austria GmbH | Samsung Electronics Switzerland GmbH | 100.0 |
| Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. | Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. | 68.6 |
| Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. | Samsung Electronics Romania LLC | 100.0 |
| Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. | SAMSUNG Zhilabs, S.L. | 100.0 |
| Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. | Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l. | 49.0 |
| Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. | Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o | 100.0 |
| Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. | Samsung Electronics Greece S.M.S.A | 100.0 |
| Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. | Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. | 100.0 |
| Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. | FOODIENT LTD. | 100.0 |
| Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. | Samsung Denmark Research Center ApS | 100.0 |
| Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. | Samsung Cambridge Solution Centre Limited | 100.0 |
| Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. | Novald GmbH | 40.0 |
| Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. | Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. | 25.0 |
| Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. | iMarket Asia Co., Ltd. | 11.4 |
| Samsung Asia Pte. Ltd. | Samsung Electronics Japan Co., Ltd. | 100.0 |
| Samsung Asia Pte. Ltd. | Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. | 100.0 |
| Samsung Asia Pte. Ltd. | Samsung Electronics New Zealand Limited | 100.0 |

| | | |
|---|---|-------|
| Samsung Asia Pte. Ltd. | Samsung Electronics Philippines Corporation | 100.0 |
| Samsung Asia Pte. Ltd. | Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited | 100.0 |
| Samsung Asia Pte. Ltd. | Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. | 100.0 |
| Samsung Asia Pte. Ltd. | Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. | 100.0 |
| Samsung Asia Pte. Ltd. | Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. | 100.0 |
| Samsung India Electronics Private Ltd. | Samsung Nepal Services Pvt, Ltd | 100.0 |
| Samsung India Electronics Private Ltd. | Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd. | 100.0 |
| PT Samsung Electronics Indonesia | PT Samsung Telecommunications Indonesia | 100.0 |
| Thai Samsung Electronics Co., Ltd. | Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd | 100.0 |
| Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. | iMarket Asia Co., Ltd. | 11.3 |
| Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. | Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. | 100.0 |
| Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. | Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. | 19.2 |
| Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. | Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou | 100.0 |
| Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. | Samsung R&D Institute China-Shenzhen | 100.0 |
| Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. | Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. | 43.1 |
| Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. | Beijing Samsung Telecom R&D Center | 100.0 |
| Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. | Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. | 26.3 |
| Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. | Samsung Electronics China R&D Center | 100.0 |
| Harman International (China) Holdings Co., Ltd. | Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd. | 100.0 |
| Harman International (China) Holdings Co., Ltd. | Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | 100.0 |
| Harman International (China) Holdings Co., Ltd. | Harman (China) Technologies Co., Ltd. | 100.0 |
| Harman Holding Limited | Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd. | 100.0 |
| Harman Holding Limited | Harman International (China) Holdings Co., Ltd. | 100.0 |
| Harman Holding Limited | Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd. | 100.0 |
| Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. | Samsung Electronics Egypt S.A.E | 0.1 |
| Samsung Electronics Maghreb Arab | Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L | 1.0 |
| Harman Industries Holdings Mauritius Ltd. | Harman International (India) Private Limited | 100.0 |
| Global Symphony Technology Group Private Ltd. | Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd. | 98.4 |
| Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. | Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. | 100.0 |
| Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. | Samsung Electronica Colombia S.A. | 100.0 |
| Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. | Samsung Electronics Panama. S.A. | 100.0 |
| Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. | Samsung Electronics Argentina S.A. | 2.0 |
| Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda. | Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda. | 100.0 |
| Samsung Electronics Central Eurasia LLP | Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd | 0.0 |
| 삼성에스디아이(주) | Intellectual Keystone Technology LLC | 41.0 |
| 삼성에스디아이(주) | Samsung SDI Japan Co., Ltd. | 89.2 |
| 삼성에스디아이(주) | Samsung SDI America, Inc. | 91.7 |
| 삼성에스디아이(주) | Samsung SDI Hungary., Zrt. | 100.0 |
| 삼성에스디아이(주) | Samsung SDI Europe GmbH | 100.0 |
| 삼성에스디아이(주) | Samsung SDI Battery Systems GmbH | 100.0 |
| 삼성에스디아이(주) | Samsung SDI Vietnam Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성에스디아이(주) | Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd. | 100.0 |

| | | |
|--|--|-------|
| 삼성에스디아이(주) | Samsung SDI India Private Limited | 100.0 |
| 삼성에스디아이(주) | Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. | 97.6 |
| 삼성에스디아이(주) | Samsung SDI China Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성에스디아이(주) | Samsung SDI-ARN (Xi'An) Power Battery Co., Ltd. | 65.0 |
| 삼성에스디아이(주) | Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd. | 80.0 |
| 삼성에스디아이(주) | STARPLUS ENERGY LLC. | 51.0 |
| 삼성에스디아이(주) | Novald GmbH | 50.1 |
| 삼성에스디아이(주) | SAMSUNG SDI WUXI CO.,LTD. | 100.0 |
| 삼성에스디아이(주) | iMarket Asia Co., Ltd. | 8.7 |
| Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. | Samsung SDI India Private Limited | 0.0 |
| Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. | Tianjin Samsung SDI Co., Ltd. | 80.0 |
| 삼성전기(주) | Samsung Electro-Mechanics Japan Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성전기(주) | Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | 100.0 |
| 삼성전기(주) | Samsung Electro-Mechanics GmbH | 100.0 |
| 삼성전기(주) | Samsung Electro-Mechanics Philippines, Corp. | 100.0 |
| 삼성전기(주) | Calamba Premier Realty Corporation | 39.8 |
| 삼성전기(주) | Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd. | 100.0 |
| 삼성전기(주) | Samsung Electro-Mechanics Vietnam Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성전기(주) | Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited | 99.9 |
| 삼성전기(주) | Dongguan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성전기(주) | Tianjin Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 81.8 |
| 삼성전기(주) | Samsung High-Tech Electro-Mechanics(Tianjin) Co., Ltd. | 95.0 |
| 삼성전기(주) | Samsung Electro-Mechanics (Shenzhen) Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성전기(주) | Kunshan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성전기(주) | iMarket Asia Co., Ltd. | 8.7 |
| Calamba Premier Realty Corporation | Batino Realty Corporation | 100.0 |
| Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd. | Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited | 0.1 |
| 삼성화재해상보험(주) | Samsung Fire & Marine Management Corporation | 100.0 |
| 삼성화재해상보험(주) | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD. | 100.0 |
| 삼성화재해상보험(주) | PT. Asuransi Samsung Tugu | 70.0 |
| 삼성화재해상보험(주) | SAMSUNG VINA INSURANCE COMPANY LIMITED | 75.0 |
| 삼성화재해상보험(주) | Samsung Reinsurance Pte. Ltd. | 100.0 |
| 삼성화재해상보험(주) | 삼성재산보험 (중국) 유한공사 | 37.0 |
| 삼성화재해상보험(주) | Samsung Fire & Marine Insurance Management Middle East Limited | 100.0 |
| 삼성중공업(주) | Camellia Consulting Corporation | 100.0 |
| 삼성중공업(주) | Samsung Heavy Industries India Pvt.Ltd. | 100.0 |
| 삼성중공업(주) | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (M) SDN.BHD | 100.0 |
| 삼성중공업(주) | 삼성중공업(영성)유한공사 | 100.0 |
| 삼성중공업(주) | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED | 100.0 |
| 삼성중공업(주) | Samsung Heavy Industries Mozambique LDA | 100.0 |
| 삼성중공업(주) | Samsung Heavy Industries Rus LLC | 100.0 |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED | SHI - MCI FZE | 70.0 |

| | | |
|---|--|-------|
| 삼성생명보험(주) | Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l. | 51.0 |
| 삼성생명보험(주) | Samsung Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd | 48.9 |
| 삼성생명보험(주) | Beijing Samsung Real Estate Co., Ltd | 90.0 |
| 삼성자산운용(주) | Samsung Asset Management (New York), Inc. | 100.0 |
| 삼성자산운용(주) | Samsung Global SME Private Equity Manager Fund Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성자산운용(주) | Samsung Asset Management U.S. Holdings, Inc. | 100.0 |
| 삼성자산운용(주) | Samsung Private Equity Fund 2022 GP, Ltd. | 100.0 |
| 삼성자산운용(주) | Samsung Co-Investment 2021 GP, Ltd. | 100.0 |
| 삼성자산운용(주) | Samsung Asset Management(London) Ltd. | 100.0 |
| 삼성자산운용(주) | Samsung Private Equity Manager I Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성자산운용(주) | Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd. | 100.0 |
| Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd. | Samsung Asset Management (Beijing) Ltd. | 100.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung C&T Japan Corporation | 100.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung C&T America Inc. | 100.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung E&C America, INC. | 100.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung Renewable Energy Inc. | 100.0 |
| 삼성물산(주) | QSSC, S.A. de C.V. | 80.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp. | 100.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung C&T Lima S.A.C. | 100.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung C&T Deutschland GmbH | 100.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung C&T U.K. Ltd. | 100.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung C&T ECUK Limited | 100.0 |
| 삼성물산(주) | Whessoe engineering Limited | 100.0 |
| 삼성물산(주) | POSS-SLPC, S.R.O | 50.0 |
| 삼성물산(주) | Solluce Romania 1 B.V. | 80.0 |
| 삼성물산(주) | SAM investment Manzanillo.B.V | 53.3 |
| 삼성물산(주) | Samsung C&T (KL) Sdn.,Bhd. | 100.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung C&T Malaysia SDN. BHD | 100.0 |
| 삼성물산(주) | Erdsam Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung Chemtech Vina LLC | 51.7 |
| 삼성물산(주) | Samsung C&T Thailand Co., Ltd | 93.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung C&T India Private Limited | 100.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung C&T Corporation India Private Limited | 100.0 |
| 삼성물산(주) | Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd | 70.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung C&T Singapore Pte., Ltd. | 100.0 |
| 삼성물산(주) | S&G Biofuel PTE.LTD | 50.5 |
| 삼성물산(주) | SAMSUNG C&T Mongolia LLC. | 70.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung C&T Eng.&Const. Mongolia LLC. | 100.0 |
| 삼성물산(주) | S&WOO CONSTRUCTION PHILIPPINES,INC. | 100.0 |
| 삼성물산(주) | VSSC STEEL CENTER LIMITED LIABILITY COMPANY | 70.0 |
| 삼성물산(주) | Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd. | 100.0 |
| 삼성물산(주) | SAMSUNG CONST. CO. PHILS. | 25.0 |
| 삼성물산(주) | CHEIL HOLDING INC. | 40.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung C&T Renewable Energy Australia Pty Ltd | 100.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung C&T Hongkong Ltd. | 100.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung C&T Taiwan Co., Ltd. | 100.0 |

| | | |
|---|---|-------|
| 삼성물산(주) | Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd. | 55.0 |
| 삼성물산(주) | SAMSUNG C&T (SHANGHAI) CO., LTD. | 100.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung C&T (Xi'an) Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성물산(주) | WARIS GIGIH ENGINEERING AND TECHNOLOGY SDN. BHD. | 30.0 |
| 삼성물산(주) | SAMSUNG C&T CORPORATION SAUDI ARABIA | 100.0 |
| 삼성물산(주) | SAM Gulf Investment Limited | 100.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung C&T Chile Copper SpA | 100.0 |
| 삼성물산(주) | SCNT Power Kelar Inversiones Limitada | 100.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung C&T Corporation Rus LLC | 100.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung SDI America, Inc. | 8.3 |
| 삼성물산(주) | Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. | 2.4 |
| 삼성물산(주) | Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd | 10.0 |
| 삼성물산(주) | CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL | 100.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung Fashion Trading Co. ,Ltd | 100.0 |
| 삼성물산(주) | SAMSUNG C&T CORPORATION VIETNAM CO., LTD | 100.0 |
| 삼성물산(주) | Samsung C&T Corporation UEM Construction JV Sdn Bhd | 60.0 |
| 삼성물산(주) | iMarket Asia Co., Ltd. | 19.3 |
| 삼성웰스토리(주) | WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED | 100.0 |
| 삼성웰스토리(주) | Shanghai Ever-Hongjun Business Mgt Service Co.,LTD | 85.0 |
| 삼성웰스토리(주) | Shanghai Welstory Food Company Limited | 81.6 |
| (주)멀티캠퍼스 | LANGUAGE TESTING INTERNATIONAL, INC. | 82.4 |
| WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED | WELVISTA COMPANY LIMITED | 70.0 |
| Pengtai Greater China Company Limited | PENGTAI CHINA CO.,LTD. | 100.0 |
| Pengtai Greater China Company Limited | PengTai Taiwan Co., Ltd. | 100.0 |
| PENGTAI CHINA CO.,LTD. | PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD | 100.0 |
| PENGTAI CHINA CO.,LTD. | PENGTAI MARKETING SERVICE CO.,LTD. | 100.0 |
| PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD | Medialytics Inc. | 100.0 |
| PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD | Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd. | 51.0 |
| iMarket Asia Co., Ltd. | iMarket China Co., Ltd. | 80.0 |
| 삼성증권(주) | Samsung Securities (America), Inc. | 100.0 |
| 삼성증권(주) | Samsung Securities (Europe) Limited. | 100.0 |
| 삼성증권(주) | Samsung Securities (Asia) Limited. | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | iMarket Asia Co., Ltd. | 40.6 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung SDS America, Inc. | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | SAMSUNG SDS GSCL Canada., Ltd. | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung SDS Europe, Ltd. | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung SDS Global SCL Hungary, Kft. | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung SDS Global SCL Slovakia, S.R.O. | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o. | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung GSCL Sweden AB | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung SDS Global SCL France SAS | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung SDS Global SCL Italy S.R.L. A Socio Unico | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Spain S.L.U | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A. | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung SDS Global SCL Germany GmbH | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung SDS Global SCL Romania S.R.L | 100.0 |

| | | |
|--|--|-------|
| 삼성에스디에스(주) | Samsung SDS Asia Pacific Pte, Ltd. | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung Data Systems India Private Limited | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung SDS Vietnam Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd.Inc. | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung SDS Global SCL Thailand Co.,Ltd | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung SDS Global SCL Malaysia SDN.BHD. | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | SAMSUNG SDS Global SCL Australia Pty.,Ltd. | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | SDS-ACUTECH CO., Ltd. | 50.0 |
| 삼성에스디에스(주) | ALS SDS Joint Stock Company | 51.0 |
| 삼성에스디에스(주) | SDS-MP Logistics Joint Stock Company | 51.0 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung SDS China Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung SDS Global SCL Hong Kong Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | SAMSUNG SDS Global SCL Egypt | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung SDS Global SCL South Africa (PTY) Ltd. | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung SDS Global SCL Nakliyat ve Lojistik Anonim Sirketi | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Middle East DWC-LLC | 100.0 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung SDS Latin America Tecnologia E Logistica LTDA. | 99.7 |
| 삼성에스디에스(주) | INTE-SDS Logistics S.A. de C.V. | 51.0 |
| 삼성에스디에스(주) | Samsung SDS Rus Limited Liability Company | 100.0 |
| Samsung SDS America, Inc. | Samsung SDS Mexico, S.A. DE C.V. | 99.0 |
| Samsung SDS America, Inc. | Samsung SDS Global SCL Panama S.A. | 100.0 |
| Samsung SDS America, Inc. | Samsung SDS Global SCL Chile Limitada | 100.0 |
| Samsung SDS America, Inc. | Samsung SDS Global SCL Peru S.A.C | 100.0 |
| Samsung SDS America, Inc. | Samsung SDS Global SCL Colombia S.A.S | 100.0 |
| Samsung SDS America, Inc. | Samsung SDS Latin America Solucoes Em Tecnologia Ltda. | 0.3 |
| Samsung SDS Europe, Ltd. | Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A. | 0.0 |
| Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A. | Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o. | 0.0 |
| Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A. | Samsung SDS Global SCL Romania S.R.L | 0.0 |
| Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A. | Samsung SDS Rus Limited Liability Company | 0.0 |
| 삼성엔지니어링(주) | Samsung Engineering America Inc. | 100.0 |
| 삼성엔지니어링(주) | Samsung Project Management Inc. | 100.0 |
| 삼성엔지니어링(주) | Samsung Engineering Hungary Ltd. | 100.0 |
| 삼성엔지니어링(주) | Samsung Engineering Italy S.R.L. | 100.0 |
| 삼성엔지니어링(주) | Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD. | 100.0 |
| 삼성엔지니어링(주) | PT Samsung Engineering Indonesia Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성엔지니어링(주) | Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd. | 81.0 |
| 삼성엔지니어링(주) | Samsung Engineering India Private Limited | 100.0 |
| 삼성엔지니어링(주) | Samsung Engineering Vietnam Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성엔지니어링(주) | Samsung Engineering Global Private Limited | 100.0 |
| 삼성엔지니어링(주) | Samsung Engineering Construction(Shanghai) Co., Ltd | 100.0 |
| 삼성엔지니어링(주) | Samsung Engineering Construction Xi' an Co., Ltd. | 100.0 |

| | | |
|---|---|-------|
| 삼성엔지니어링(주) | Samsung Saudi Arabia Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성엔지니어링(주) | Muharrag Wastewater Services Company W.L.L. | 99.8 |
| 삼성엔지니어링(주) | Muharrag STP Company B.S.C. | 6.6 |
| 삼성엔지니어링(주) | Muharrag Holding Company 1 Ltd. | 65.0 |
| 삼성엔지니어링(주) | Samsung Ingenieria Mexico Construccion Y Operacion S.A. De C.V. | 99.9 |
| 삼성엔지니어링(주) | Samsung Engineering Trinidad Co., Ltd. | 100.0 |
| 삼성엔지니어링(주) | Samsung Ingenieria Manzanillo, S.A. De C.V. | 99.9 |
| 삼성엔지니어링(주) | Grupo Samsung Ingenieria Mexico, S.A. De C.V. | 100.0 |
| 삼성엔지니어링(주) | Samsung Ingenieria Energia S.A. De C.V. | 100.0 |
| 삼성엔지니어링(주) | Samsung Engineering Bolivia S.A | 100.0 |
| 삼성엔지니어링(주) | Samsung Ingenieria DUBA S.A. de C.V. | 100.0 |
| 삼성엔지니어링(주) | Samsung Engineering Kazakhstan L.L.P. | 100.0 |
| Samsung Engineering America Inc. | SEA Construction, LLC | 100.0 |
| Samsung Engineering America Inc. | SEA Louisiana Construction, L.L.C. | 100.0 |
| Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD. | Muharrag Wastewater Services Company W.L.L. | 0.3 |
| Samsung Engineering India Private Limited | Samsung Engineering Global Private Limited | 0.0 |
| Samsung Engineering India Private Limited | Samsung Saudi Arabia Co., Ltd. | 0.0 |
| Samsung Saudi Arabia Co., Ltd. | Samsung EPC Company Ltd. | 75.0 |
| Muharrag Holding Company 1 Ltd. | Muharrag Holding Company 2 Ltd. | 100.0 |
| Muharrag Holding Company 2 Ltd. | Muharrag STP Company B.S.C. | 89.9 |
| Samsung Ingenieria DUBA S.A. de C.V. | Asociados Constructores DBNR, S.A. de C.V. | 49.0 |
| (주)에스원 | S-1 CORPORATION HUNGARY LLC | 100.0 |
| (주)에스원 | S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD | 100.0 |
| (주)에스원 | Samsung Beijing Security Systems | 100.0 |
| (주)제일기획 | Pengtai Greater China Company Limited | 98.8 |
| (주)제일기획 | PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD | 100.0 |
| (주)제일기획 | Cheil USA Inc. | 100.0 |
| (주)제일기획 | Cheil Central America Inc. | 100.0 |
| (주)제일기획 | Iris Worldwide Holdings Limited | 100.0 |
| (주)제일기획 | CHEIL EUROPE LIMITED | 100.0 |
| (주)제일기획 | Cheil Germany GmbH | 100.0 |
| (주)제일기획 | Cheil France SAS | 100.0 |
| (주)제일기획 | CHEIL SPAIN S.L | 100.0 |
| (주)제일기획 | Cheil Benelux B.V. | 100.0 |
| (주)제일기획 | Cheil Nordic AB | 100.0 |
| (주)제일기획 | Cheil India Private Limited | 100.0 |
| (주)제일기획 | Cheil (Thailand) Ltd. | 100.0 |
| (주)제일기획 | Cheil Singapore Pte. Ltd. | 100.0 |
| (주)제일기획 | CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED | 99.0 |
| (주)제일기획 | Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc. | 100.0 |
| (주)제일기획 | CHEIL MALAYSIA SDN. BHD. | 100.0 |
| (주)제일기획 | Cheil New Zealand Limited | 100.0 |
| (주)제일기획 | Cheil Worldwide Australia Pty Ltd | 100.0 |
| (주)제일기획 | CHEIL CHINA | 100.0 |
| (주)제일기획 | Cheil Hong Kong Ltd. | 100.0 |

| | | |
|---------------------------------|---|-------|
| (주)제일기획 | Caishu (Shanghai) Business Consulting Co., Ltd | 100.0 |
| (주)제일기획 | Cheil MEA FZ-LLC | 100.0 |
| (주)제일기획 | Cheil South Africa (Pty) Ltd | 100.0 |
| (주)제일기획 | CHEIL KENYA LIMITED | 99.0 |
| (주)제일기획 | Cheil Communications Nigeria Ltd. | 99.0 |
| (주)제일기획 | Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC. | 100.0 |
| (주)제일기획 | Cheil Ghana Limited | 100.0 |
| (주)제일기획 | Cheil Egypt LLC | 99.9 |
| (주)제일기획 | Cheil Maghreb LLC | 100.0 |
| (주)제일기획 | Cheil Brasil Comunicacoes Ltda. | 100.0 |
| (주)제일기획 | Cheil Mexico, S.A. de C.V. | 98.0 |
| (주)제일기획 | Cheil Chile SpA. | 100.0 |
| (주)제일기획 | Cheil Peru S.A.C. | 100.0 |
| (주)제일기획 | CHEIL ARGENTINA S.A. | 98.0 |
| (주)제일기획 | Cheil Rus LLC | 100.0 |
| (주)제일기획 | Cheil Ukraine LLC | 100.0 |
| (주)제일기획 | Cheil Kazakhstan LLC | 100.0 |
| (주)호텔신라 | Samsung Hospitality America Inc. | 100.0 |
| (주)호텔신라 | Shilla Travel Retail Pte. Ltd. | 100.0 |
| (주)호텔신라 | Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd. | 100.0 |
| (주)호텔신라 | Shilla Travel Retail Hong Kong Limited | 100.0 |
| 에이치디씨신라면세점(주) | HDC SHILLA (SHANGHAI) CO., LTD | 100.0 |
| 에스비티엠(주) | Samsung Hospitality U.K. Ltd. | 100.0 |
| 에스비티엠(주) | Samsung Hospitality Europe GmbH | 100.0 |
| 에스비티엠(주) | SAMSUNG HOSPITALITY ROMANIA SRL | 100.0 |
| 에스비티엠(주) | Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd. | 99.0 |
| 에스비티엠(주) | Samsung Hospitality Philippines Inc. | 100.0 |
| 에스비티엠(주) | Samsung Hospitality India Private Limited | 100.0 |
| 삼성벤처투자(주) | Samsung Venture Investment (Shanghai) Co., Ltd. | 100.0 |
| Iris Americas, Inc. | Iris (USA) Inc. | 100.0 |
| Iris Americas, Inc. | Iris Atlanta, Inc. | 100.0 |
| Iris Americas, Inc. | 89 Degrees, Inc. | 100.0 |
| Cheil USA Inc. | The Barbarian Group LLC | 100.0 |
| Cheil USA Inc. | McKinney Ventures LLC | 100.0 |
| Cheil USA Inc. | Cheil India Private Limited | 0.0 |
| Cheil USA Inc. | Cheil Mexico, S.A. de C.V. | 2.0 |
| Iris Worldwide Holdings Limited | Iris Nation Worldwide Limited | 100.0 |
| Iris Nation Worldwide Limited | Iris Americas, Inc. | 100.0 |
| Iris Nation Worldwide Limited | Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V. | 100.0 |
| Iris Nation Worldwide Limited | Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V. | 100.0 |
| Iris Nation Worldwide Limited | Pricing Solutions Ltd | 100.0 |
| Iris Nation Worldwide Limited | Iris London Limited | 100.0 |
| Iris Nation Worldwide Limited | Iris Promotional Marketing Ltd | 100.0 |
| Iris Nation Worldwide Limited | Iris Ventures 1 Limited | 100.0 |
| Iris Nation Worldwide Limited | Founded Partners Limited | 100.0 |
| Iris Nation Worldwide Limited | Iris Digital Limited | 100.0 |

| | | |
|---|---|-------|
| Iris Nation Worldwide Limited | Iris Amsterdam B.V. | 100.0 |
| Iris Nation Worldwide Limited | Iris Ventures (Worldwide) Limited | 100.0 |
| Iris Nation Worldwide Limited | Concise Consultants Limited | 100.0 |
| Iris Nation Worldwide Limited | WDMP Limited | 49.0 |
| Iris Nation Worldwide Limited | Iris Services Limited Dooel Skopje | 100.0 |
| Iris Nation Worldwide Limited | Irisnation Singapore Pte. Ltd. | 100.0 |
| Iris Nation Worldwide Limited | Iris Worldwide Integrated Marketing Private Limited | 100.0 |
| Iris Nation Worldwide Limited | Iris Sydney PTY Ltd | 100.0 |
| Iris Nation Worldwide Limited | Iris Worldwide (Thailand) Limited | 100.0 |
| Iris London Limited | Iris Partners LLP | 100.0 |
| Iris Promotional Marketing Ltd | Holdings BR185 Limited | 100.0 |
| Iris Ventures 1 Limited | Iris Germany GmbH | 100.0 |
| Founded Partners Limited | Founded, Inc. | 100.0 |
| Iris Germany GmbH | Pepper NA, Inc. | 100.0 |
| CHEIL EUROPE LIMITED | Beattie McGuinness Bungay Limited | 100.0 |
| CHEIL EUROPE LIMITED | Cheil Italia S.r.l | 100.0 |
| Cheil Germany GmbH | Cheil Austria GmbH | 100.0 |
| Cheil Germany GmbH | Centrade Integrated SRL | 100.0 |
| Centrade Integrated SRL | Centrade Cheil HU Kft. | 100.0 |
| Centrade Integrated SRL | Centrade Cheil Adriatic D.O.O. | 100.0 |
| Cheil India Private Limited | Experience Commerce Software Private Limited | 100.0 |
| Cheil Singapore Pte. Ltd. | PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA | 100.0 |
| Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc. | Cheil Philippines Inc. | 30.0 |
| Shilla Travel Retail Pte. Ltd. | Shilla Retail Plus Pte. Ltd. | 100.0 |
| Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd. | Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd | 100.0 |
| Shilla Travel Retail Hong Kong Limited | Shilla Retail Limited | 100.0 |
| Shilla Travel Retail Hong Kong Limited | BNY Trading Hong Kong Limited | 100.0 |
| Cheil MEA FZ-LLC | One Agency FZ-LLC | 100.0 |
| Cheil MEA FZ-LLC | One RX Project Management Design and Production Limited Company | 0.0 |
| Cheil MEA FZ-LLC | Cheil Egypt LLC | 0.1 |
| Cheil South Africa (Pty) Ltd | CHEIL KENYA LIMITED | 1.0 |
| Cheil South Africa (Pty) Ltd | Cheil Communications Nigeria Ltd. | 1.0 |
| One Agency FZ-LLC | Iris Korea Limited | 100.0 |
| One Agency FZ-LLC | One RX India Private Limited | 100.0 |
| One Agency FZ-LLC | One RX Project Management Design and Production Limited Company | 100.0 |
| One Agency FZ-LLC | ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C | 100.0 |
| One Agency FZ-LLC | ONE AGENCY PRINTING L.L.C | 100.0 |
| ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C | One RX India Private Limited | 0.0 |
| Holdings BR185 Limited | Brazil 185 Participacoes Ltda | 100.0 |
| Brazil 185 Participacoes Ltda | Iris Router Marketing Ltda | 100.0 |
| Cheil Brasil Comunicacoes Ltda. | CHEIL ARGENTINA S.A. | 2.0 |

다. 관련법령상의 규제내용 등

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 상호출자제한기업집단 등

① 지정시기: 2023년 5월 1일

② 규제내용 요약

- 상호출자의 금지
- 계열사 채무보증 금지
- 금융·보험사의 계열사 의결권 제한
- 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시
- 비상장사 중요사항 공시
- 기업집단 현황 등에 관한 공시

라. 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일)

| 겸직자 | | 계열회사 겸직현황 | | |
|-----|-----|-------------|---------|-------|
| 성명 | 직위 | 기업명 | 직위 | 상근 여부 |
| 김용관 | 부사장 | 삼성메디슨(주) | 대표이사 | 상근 |
| 육근성 | 상무 | 삼성전자판매(주) | 감사 | 비상근 |
| | | 삼성전자로지텍(주) | 감사 | 비상근 |
| | | 삼성전자서비스(주) | 감사 | 비상근 |
| 유승호 | 부사장 | 삼성메디슨(주) | 감사 | 비상근 |
| 유규태 | 부사장 | 삼성메디슨(주) | 사내이사 | 상근 |
| 최정준 | 부사장 | 삼성벤처투자(주) | 감사 | 비상근 |
| 유한종 | 상무 | (주)삼성글로벌리서치 | 감사 | 비상근 |
| 조기재 | 부사장 | 삼성디스플레이(주) | 감사 | 비상근 |
| 오종훈 | 부사장 | 세메스(주) | 감사 | 비상근 |
| 황희돈 | 상무 | 세메스(주) | 기타비상무이사 | 비상근 |
| 성덕용 | 상무 | 세메스(주) | 기타비상무이사 | 비상근 |
| 오재균 | 상무 | 스테코(주) | 감사 | 비상근 |
| 박동욱 | 상무 | 스테코(주) | 기타비상무이사 | 비상근 |

2. 타법인 출자 현황(요약)

2023년 반기말 현재 당사 타법인 출자 금액은 장부금액 기준 59조 901억원이며, 경영참여 등 목적으로 출자하였습니다.

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

| 출자 목적 | 출자회사수 | | | 총 출자금액 | | | |
|----------|-------|-----|-----|----------------|------------|----------|----------------|
| | 상장 | 비상장 | 계 | 기초 장부 가액 | 증가(감소) | | 기말 장부 가액 |
| | | | | | 취득 (처분) | 평가 손익 | |
| 경영참여 | 20 | 81 | 101 | 58,678,404 | -37,703 | 350,005 | 58,990,706 |
| 일반투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 단순투자 | 5 | 34 | 39 | 83,453 | -801 | 16,716 | 99,368 |
| 계 | 25 | 115 | 140 | 58,761,857 | -38,504 | 366,721 | 59,090,074 |

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

당사는 2023년 반기말 현재 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 계열회사의 자금조달 등을 위하여 채무보증을 제공하고 있습니다.

(단위 : 천US\$, %)

| 법인명 (채우자) | 관계 | 채권자 | 내용 | 목적 | 보증시작일 | 보증종료일 | 채무보증한도 | | 채무금액 | | | 이자율 |
|--------------|------|-------------------|------|------|------------|------------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-------|
| | | | | | | | 기초 | 기말 | 기초 | 증감 | 기말 | |
| SEA | 계열회사 | BOA 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 1,278,000 | 1,278,000 | - | - | - | |
| SEM | 계열회사 | BBVA 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 715,000 | 715,000 | - | - | - | |
| SAMCOL | 계열회사 | Citibank 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 210,000 | 210,000 | - | - | - | |
| SEDA | 계열회사 | BRADESCO 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.10.01 | 2023.12.16 | 409,000 | 409,000 | - | - | - | |
| SECH | 계열회사 | Citibank 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2024.06.13 | 62,000 | 62,000 | - | - | - | |
| SEPR | 계열회사 | BBVA 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2024.06.13 | 150,000 | 150,000 | - | - | - | |
| SSA | 계열회사 | SCB 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 318,000 | 318,000 | - | - | - | |
| SEMAG | 계열회사 | SocGen 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.12.16 | 110,000 | 110,000 | - | - | - | |
| SETK | 계열회사 | BNP 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 777,000 | 777,000 | 239,395 | 25,052 | 264,447 | 48.2% |
| SETK-P | 계열회사 | BNP 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.12.16 | 130,000 | 130,000 | 25,649 | △12,206 | 13,443 | 29.6% |
| SECE | 계열회사 | Citibank | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2023.12.16 | 60,000 | 100,000 | - | - | - | |
| SEEG | 계열회사 | HSBC | 지급보증 | 운영자금 | 2023.06.14 | 2024.06.13 | 85,000 | 85,000 | - | - | - | |
| SEIN | 계열회사 | BNP 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 70,000 | 70,000 | - | - | - | |
| SJC | 계열회사 | Mizuho Bank 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.04.30 | 832,572 | 808,985 | - | - | - | |
| SEUC | 계열회사 | Credit Agricole 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 150,000 | 125,000 | - | - | - | |
| SEDAM | 계열회사 | Citibank 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 537,000 | 537,000 | 155,768 | △155,768 | - | |
| SECA | 계열회사 | BoA | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.11.08 | 70,000 | 70,000 | - | - | - | |
| SELA | 계열회사 | Citibank | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2023.12.16 | 60,000 | 60,000 | - | - | - | |
| SEEH | 계열회사 | HSBC 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.01 | 2024.06.13 | 888,400 | 888,400 | - | - | - | |
| SERK | 계열회사 | SMBC | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 45,000 | 20,000 | - | - | - | |
| SELV | 계열회사 | Citibank | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2023.12.16 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | |
| SEIL | 계열회사 | Citibank | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2023.12.16 | 15,600 | 15,600 | 9,664 | △9,664 | - | |
| SAPL | 계열회사 | BOA 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 404,000 | 404,000 | - | - | - | |
| SAVINA | 계열회사 | HSBC | 지급보증 | 운영자금 | 2023.06.14 | 2024.06.13 | 51,000 | 51,000 | - | - | - | |
| SCIC | 계열회사 | HSBC 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 300,000 | 300,000 | - | - | - | |
| SME | 계열회사 | SCB | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.11.08 | 110,000 | 110,000 | - | - | - | |
| SAMEX | 계열회사 | Citibank | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2023.12.16 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | |
| SEASA | 계열회사 | Citibank | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2023.12.16 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | |
| SSAP | 계열회사 | SCB | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.11.08 | 35,000 | 35,000 | - | - | - | |
| SEPM | 계열회사 | HSBC | 지급보증 | 운영자금 | 2023.06.14 | 2024.06.13 | 35,000 | 35,000 | - | - | - | |
| SESAR | 계열회사 | HSBC | 지급보증 | 운영자금 | 2023.06.14 | 2024.06.13 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | |
| SEUZ | 계열회사 | Citibank | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2023.12.16 | - | 10,000 | - | - | - | |

| 법인명 (채무자) | 관계 | 채권자 | 내용 | 목적 | 보증시작일 | 보증종료일 | 채무보증한도 | | 채무금액 | | | 이자 율 |
|---|------|-----------|------|------|------------|------------|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------|
| | | | | | | | 기초 | 기말 | 기초 | 증감 | 기말 | |
| AdGear Technologies Inc. | 계열회사 | BOA | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.11.08 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | |
| Harman International Industries, Inc. | 계열회사 | JP Morgan | 지급보증 | 운영자금 | 2023.06.14 | 2024.06.13 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | |
| Harman International Japan Co., Ltd. | 계열회사 | MUFG | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.11.08 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | |
| Harman Holding Limited | 계열회사 | HSBC | 지급보증 | 운영자금 | 2023.06.14 | 2024.06.13 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | |
| Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda. | 계열회사 | SocGen | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.11.08 | 15,000 | 15,000 | - | - | - | |
| Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda. | 계열회사 | | | | | | | | | | | |
| Harman International Industries Limited | 계열회사 | HSBC | 지급보증 | 운영자금 | 2023.06.14 | 2024.06.13 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | |
| 합 계 | | | | | | | 8,146,572 | 8,122,985 | 430,476 | △152,586 | 277,890 | |

※ 별도 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 법인명은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참조하시기 바랍니다.

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 상기 채무보증에 대하여 당사가 보증하는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을

감안하여 수수료를 수취하고 있습니다. 당사는 2022년 중 US\$547천의 수수료를 청구하였으며, 2023년 중 수취하였습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 2023년 반기 중 법인의 생산설비 증설 등 목적으로 자산을 Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS) 등의 계열회사에 매각하였으며, 생산 효율화 등을 위해 자산을 계열회사로부터 매입하였습니다.

(단위 : 백만원)

| 법인명 | 관계 | 거래종류 | 거래일자 | 거래대상물 | 거래목적 | 거래금액 | 처분손익 |
|-------|------|---------|------------|--------|-----------------|--------|--------|
| SCS | 계열회사 | 자산매각/매입 | 2023.06.30 | 기계장치 등 | 생산설비 증설·생산효율화 등 | 41,262 | 23,688 |
| SESS | 계열회사 | 자산매각/매입 | 2023.06.12 | 기계장치 등 | 생산설비 증설·생산효율화 등 | 4,176 | 466 |
| SAS | 계열회사 | 자산매입 | 2023.06.28 | 기계장치 등 | 생산설비 증설·생산효율화 등 | 1,058 | - |
| SEHC | 계열회사 | 자산매각 | 2023.05.19 | 기계장치 등 | 생산설비 증설·생산효율화 등 | 965 | 93 |
| SEV | 계열회사 | 자산매입 | 2023.03.23 | 기계장치 등 | 생산설비 증설·생산효율화 등 | 767 | - |
| SEVT | 계열회사 | 자산매각/매입 | 2023.06.21 | 기계장치 등 | 생산설비 증설·생산효율화 등 | 459 | 148 |
| TSLED | 계열회사 | 자산매각 | 2023.03.19 | 기계장치 등 | 생산설비 증설·생산효율화 등 | 372 | 361 |
| SIEL | 계열회사 | 자산매각 | 2023.06.15 | 기계장치 등 | 생산설비 증설·생산효율화 등 | 118 | 13 |

※ 별도 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 법인명은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참조하시기 바랍니다.

※ 거래일자는 최근 거래일자 기준입니다.

※ 거래금액은 시장 및 가치평가 등을 거쳐 적절히 산정되었으며, 거래 다음달 15일·30일 이내 현금 지급조건 등 통상적인 조건으로 거래되었습니다.

※ 상기 자산양수도 거래는 이사회 결의 대상이 아닙니다.

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 거래금액이 1억원 미만인 경우에는 기재를 생략하였습니다.

3. 대주주와의 영업거래

2023년 반기 중 계열회사인 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등과 매출, 매입 등의 영업거래를 하였습니다

(단위 : 백만원)

| 법인명 | 관계 | 거래종류 | 거래기간 | 거래내용 | 거래금액 |
|------|------|-------|-----------------|------------------|------------|
| SEA | 계열회사 | 매출입 등 | 2023.01~2023.06 | HHP 및 가전제품 매출입 등 | 14,968,991 |
| SEVT | 계열회사 | 매출입 등 | 2023.01~2023.06 | HHP 매출입 등 | 12,300,373 |

※ 별도 기준입니다.

※ 법인명은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참조하시기 바랍니다.

※ 공시대상은 최근사업연도 매출액의 5% 이상 기준입니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 2023년 반기말 현재 제품경쟁력 제고, 상생경영을 위한 협력사 지원 및 종업원 복리후생 목적의 주택대부, 학자금 등으로 1,397억원의 대여금이 있습니다.

(단위 : 백만원)

| 성명 (법인명) | 관계 | 계정과목 | 대여금 변동 내역 | | |
|-------------|------------|-------|-----------|------|---------|
| | | | 기초 | 증감 | 기말 |
| (주)이랜텍 등 | 협력업체 및 종업원 | 단기대여금 | 47,161 | △923 | 46,238 |
| 범진아이엔디(주) 등 | 협력업체 및 종업원 | 장기대여금 | 92,898 | 608 | 93,506 |
| 합 계 | | | 140,059 | △315 | 139,744 |

※ 별도 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 대여금은 현재가치할인차금 차감후, 대손충당금(손실충당금) 차감전 기준입니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건등

당사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등을 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

당사(삼성전자(주), 삼성디스플레이(주) 등)는 분할된 삼성디스플레이(주) 등의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

그 밖의 우발부채 및 약정사항에 대해서는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.

나. 채무보증내역

(단위 : 천US\$, %)

| 법인명 (채무자) | 관계 | 채권자 | 내용 | 목적 | 보증시작일 | 보증종료일 | 채무보증한도 | | 채무금액 | | | 이자율 |
|--------------|------|-------------------|------|------|------------|------------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-------|
| | | | | | | | 기초 | 기말 | 기초 | 증감 | 기말 | |
| SEA | 계열회사 | BOA 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 1,278,000 | 1,278,000 | - | - | - | |
| SEM | 계열회사 | BBVA 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 715,000 | 715,000 | - | - | - | |
| SAMCOL | 계열회사 | Citibank 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 210,000 | 210,000 | - | - | - | |
| SEDA | 계열회사 | BRADESCO 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.10.01 | 2023.12.16 | 409,000 | 409,000 | - | - | - | |
| SECH | 계열회사 | Citibank 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2024.06.13 | 62,000 | 62,000 | - | - | - | |
| SEPR | 계열회사 | BBVA 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2024.06.13 | 150,000 | 150,000 | - | - | - | |
| SSA | 계열회사 | SCB 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 318,000 | 318,000 | - | - | - | |
| SEMAG | 계열회사 | SocGen 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.12.16 | 110,000 | 110,000 | - | - | - | |
| SETK | 계열회사 | BNP 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 777,000 | 777,000 | 239,395 | 25,052 | 264,447 | 48.2% |
| SETK-P | 계열회사 | BNP 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.12.16 | 130,000 | 130,000 | 25,649 | △12,206 | 13,443 | 29.6% |
| SECE | 계열회사 | Citibank | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2023.12.16 | 60,000 | 100,000 | - | - | - | |
| SEEG | 계열회사 | HSBC | 지급보증 | 운영자금 | 2023.06.14 | 2024.06.13 | 85,000 | 85,000 | - | - | - | |
| SEIN | 계열회사 | BNP 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 70,000 | 70,000 | - | - | - | |
| SJC | 계열회사 | Mizuho Bank 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.04.30 | 832,572 | 808,985 | - | - | - | |
| SEUC | 계열회사 | Credit Agricole 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 150,000 | 125,000 | - | - | - | |
| SEDAM | 계열회사 | Citibank 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 537,000 | 537,000 | 155,768 | △155,768 | - | |
| SECA | 계열회사 | BoA | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.11.08 | 70,000 | 70,000 | - | - | - | |
| SELA | 계열회사 | Citibank | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2023.12.16 | 60,000 | 60,000 | - | - | - | |
| SEEH | 계열회사 | HSBC 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.01 | 2024.06.13 | 888,400 | 888,400 | - | - | - | |
| SERK | 계열회사 | SMBC | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 45,000 | 20,000 | - | - | - | |
| SELV | 계열회사 | Citibank | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2023.12.16 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | |
| SEIL | 계열회사 | Citibank | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2023.12.16 | 15,600 | 15,600 | 9,664 | △9,664 | - | |
| SAPL | 계열회사 | BOA 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 404,000 | 404,000 | - | - | - | |
| SAVINA | 계열회사 | HSBC | 지급보증 | 운영자금 | 2023.06.14 | 2024.06.13 | 51,000 | 51,000 | - | - | - | |
| SCIC | 계열회사 | HSBC 등 | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2024.06.13 | 300,000 | 300,000 | - | - | - | |
| SME | 계열회사 | SCB | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.11.08 | 110,000 | 110,000 | - | - | - | |
| SAMEX | 계열회사 | Citibank | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2023.12.16 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | |
| SEASA | 계열회사 | Citibank | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2023.12.16 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | |
| SSAP | 계열회사 | SCB | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.11.08 | 35,000 | 35,000 | - | - | - | |
| SEPM | 계열회사 | HSBC | 지급보증 | 운영자금 | 2023.06.14 | 2024.06.13 | 35,000 | 35,000 | - | - | - | |
| SESAR | 계열회사 | HSBC | 지급보증 | 운영자금 | 2023.06.14 | 2024.06.13 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | |
| SEUZ | 계열회사 | Citibank | 지급보증 | 운영자금 | 2022.12.17 | 2023.12.16 | - | 10,000 | - | - | - | |

| 법인명 (채무자) | 관계 | 채권자 | 내용 | 목적 | 보증시작일 | 보증종료일 | 채무보증한도 | | 채무금액 | | | 이자 율 |
|---|------|-----------|------|--------|------------|------------|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------|
| | | | | | | | 기초 | 기말 | 기초 | 증감 | 기말 | |
| AdGear Technologies Inc. | 계열회사 | BOA | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.11.08 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | |
| Harman International Industries, Inc. | 계열회사 | JP Morgan | 지급보증 | 운영자금 | 2023.06.14 | 2024.06.13 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | |
| Harman International Japan Co., Ltd. | 계열회사 | MUFG | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.11.08 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | |
| Harman Holding Limited | 계열회사 | HSBC | 지급보증 | 운영자금 | 2023.06.14 | 2024.06.13 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | |
| Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda. | 계열회사 | SocGen | 지급보증 | 운영자금 | 2022.11.09 | 2023.11.08 | 15,000 | 15,000 | - | - | - | |
| Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda. | 계열회사 | | | | | | | | | | | |
| Harman International Industries Limited | 계열회사 | HSBC | 지급보증 | 운영자금 | 2023.06.14 | 2024.06.13 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | |
| SDN | 계열회사 | SIEL | 지급보증 | 운영자금 등 | 2021.11.24 | 2026.02.19 | 603,960 | 609,013 | 513,366 | 4,453 | 517,819 | 8.1% |
| SAS | 계열회사 | Epcor | 지급보증 | 운영자금 등 | 2022.04.26 | 채무소멸시 | 340,000 | 340,000 | - | - | - | |
| DOWOINSYS VINA COMPANY LIMITED | 계열회사 | ANZ | 지급보증 | 시설자금 | 2022.11.10 | 2025.11.09 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 | 7.0% |
| 합 계 | | | | | | | 9,110,532 | 9,092,184 | 963,842 | △148,133 | 815,079 | |

※ 연결 기준입니다. SDN 건은 삼성디스플레이㈜, SAS 건은 SEA, DOWOINSYS VINA COMPANY LIMITED 건은
 ㈜도우인시스가 각각 채무보증인입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 법인명은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참조하시기 바랍니다.

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.
 또한 종속기업인 삼성디스플레이㈜의 경우 건별 채무보증금액이 100억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 상기 채무보증에 대하여 당사가 보증하는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을
 감안하여 수수료를 수취하고 있습니다. 당사는 2022년 중 US\$547천의 수수료를 청구하였으며, 2023년 중 수취하였습니다.
 한편, 삼성디스플레이㈜는 SDN에게 2022년 중 US\$3,080천 수수료를 청구하였으며, 2023년 중 수취하였습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 수사·사법기관의 제재현황

[요약]

(단위 : 백만원)

| 일자 | 제재기관 | 대상자 | 처벌 또는 조치 내용 | 금전적 제재금액 | 징역·배임등 금액 | 근거 법령 |
|------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------|--------------|---|
| 2021.01.25 | 서울고등법원 (파기환송심) | 당사 임직원 | 징역 | - | 약 8,681 | 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 |
| 2021.02.04 | 대법원 | 당사 임직원 | 징역 | - | - | 「노동조합 및 노동관계조정법」 제90조, 제81조 등 |
| | | 자회사 및 임직원 (삼성전자서비스㈜) | 벌금, 징역 | 50 | - | 「노동조합 및 노동관계조정법」 제90조, 제81조 등, 「조세범처벌법」 제10조 |
| 2022.07.07 | 광주지방법원 | 당사 임직원 | 벌금 | 6 | - | 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제33조 7호, 제34조, 제18조 1항 등 |
| 2023.02.09 | 광주지방법원 | 당사 및 당사 임직원 | 벌금 | 25 | - | 「구.산업안전보건법」 제10조 제 1항, 「산업안전보건법」 제57조 제1항 등 |

대법원은 '박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건'에서 당사 임원 5명 (이재용 부회장, 최지성 前부회장, 장충기 前사장, 박상진 前사장, 황성수 前전무)의 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 위반(횡령) 등의 혐의와 관련하여, 2019년 8월 29일 고등법원의 원심판결 중 일부를 파기하고 서울고등법원에 환송하였습니다. 서울고등법원은 2021년 1월 18일 파기 환송심에서 이재용 부회장, 최지성 前부회장, 장충기 前사장에 대해 징역 2년 6개월, 박상진 前사장, 황성수 前전무에 대해 징역 2년 6개월(집행유예 4년)을 선고하였으며, 위 판결은 2021년 1월 25일 확정되었습니다. 당사는 재발 방지를 위하여 대외 후원금 집행 관련 프로세스를 강화하고 외부 독립 조직인 삼성 준법감시위원회를 신설하였습니다.

대법원이 2021년 2월 4일 당사 및 당사 임직원의 「노동조합 및 노동관계조정법」 제90조, 제81조 등 위반 혐의에 관해 상고기각 판결을 내림에 따라 서울고등법원이 2020년 8월 10일 선고한 당사 A부사장(근속연수 29년) 징역 1년 4개월, B前부사장 징역 1년 2개월(2년간 집행유예), C부사장(근속연수 34년) 징역 10개월(2년간 집행유예), D前부사장 징역 1년(2년간 집행유예), E전무(근속연수 32년) 징역 1년, F전무(근속연수 24년) 징역 1년 2개월(2년간 집행유예), G상무(근속연수 27년) 징역 10개월(2년간 집행유예), H상무(근속연수 18년) 징역 10개월(2년 집행유예)형이 확정되었고, 당사 및 당사의 前이사회 의장(근속연수 39년) 등은 무죄로 확정되었습니다. 또한 위 사건에서 자회사 삼성전자서비스(주) 및 임직원의 「노동조합 및 노동관계조정법」 제90조, 제81조 등 위반과 허위 세금 계산서 수수에 대한 「조세범처벌법」 제10조 위반(위반금액 약 1,678백만원) 혐의에 대해 삼성전자서비스(주) 벌금 50백만원(추징세액 약 97백만원), 삼성전자서비스(주) 前대표이사(근속연수 4년) 징역 1년 4개월, I전무(근속연수 11년) 징역 1년, J상무(근속연수 21년) 징역 10개월(2년간 집행유예)의 형이 확정되었습니다. 당사는 행동규범 등에 노동3권 보장을 명시하고 부당노동행위 예방 관련 전 임직원 교육을 실시하는 등 재발 방지를 위하여 노력하고 있습니다.

광주지방법원 순천지원은 2021년 1월 20일 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제18조 등 위반으로 당사 직원 A프로(근속연수 11년), B프로(근속연수 8년)에게 각 벌금(3백만원)을 선고하였고, 광주지방법원은 2022년 7월 7일 이 사건 항소심에서 항소 기각 판결을 선고하였습니다. 당사는 재발 방지를 위하여 주기적인 교차 측정 등을 실시하고 있습니다.

광주지방법원은 2023년 2월 9일 「구.산업안전보건법」 제10조 제1항, 「산업안전보건법」 제57조 제1항 등 위반으로 당사 및 당사 직원 5명에 대해 약식명령을 발령하였습니다. 당사 및 당사 직원 5명은 이에 대해 정식재판을 청구하지 않아 해당 약식명령은 확정되었고(당사 벌금 15백만원, 당사 직원 벌금 각 2백만원), 당사는 벌금 납부를 완료하였습니다. 당사는 재발 방지를 위하여 환경안전담당자 및 관리감독자 대상으로 특별 교육을 실시하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

나. 행정기관의 제재현황

(1) 공정거래위원회의 제재현황

[요약]

(단위 : 백만원)

| 일자 | 제재기관 | 대상자 | 처벌 또는 조치 내용 | 금전적 제재금액 | 사유 및 근거 법령 |
|-------------|---------|--------------------------|-------------|----------|---|
| 2021.06.22 | 공정거래위원회 | 당사 및 당사 임직원 | 검찰고발 | - | 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제7호 |
| 2021.08.27. | 공정거래위원회 | 당사 | 시정조치 과징금 | 101,217 | 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제7호 |
| | | 자회사 (삼성디스플레이㈜) | 시정조치 과징금 | 22,857 | 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제7호 |
| 2021.11.17 | 공정거래위원회 | 자회사 (삼성전자서비스 씨에스㈜) | 과태료 | 2.4 | 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제11조의4(기업집단현황 등에 관한 공시) |
| 2022.03.17 | 공정거래위원회 | 당사 임직원 | 경고 | - | 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조(상호출자제한기업집단 등의 지정 등) 제4항 |
| 2022.06.27 | 공정거래위원회 | 당사 | 과태료 | 10 | 「대리점거래의 공정화에 관한 법률」 제5조(대리점거래 계약서의 작성의무) 제1항 |

공정거래위원회는 2021년 6월 22일 삼성웰스토리(주)와의 단체급식 거래와 관련하여 검찰에 당사 및 퇴직 임원인 최지성 전 미래전략실장을 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제 23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제7호 위반 혐의로 고발하였습니다.

또한 당사와 삼성디스플레이(주)는 삼성웰스토리(주)와의 단체급식 거래와 관련하여 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제23조 제1항 제7호 위반 혐의로 공정거래위원회로부터 2021년 8월 27일 시정조치 및 과징금(당사: 1,012억 17백만원, 삼성디스플레이(주): 228억 5천 7백만원) 처분을 받았습니다. 동 처분에 대해 현재 행정소송이 진행 중이며, 시정 조치에 대해 2022년 1월 27일 집행정지 결정이 확정되었습니다.

공정거래위원회는 2021년 11월 5일 당사의 자회사인 삼성전자서비스씨에스(주)의 대규모 기업집단 현황 공시 자진 정정공시(이사회 구성원 누락) 관련하여 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제11조의4(기업집단현황 등에 관한 공시) 위반으로 과태료(2.4백만원)를 부과하였으며, 삼성전자서비스씨에스(주)는 2021년 11월 17일 이를 납부하였습니다. 삼성전자서비스씨에스(주)는 재발 방지를 위하여 담당자 추가 배치 등 내부관리 기준을 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

공정거래위원회는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제31조 제4항에 따른 2018년과 2019년 지정자료 제출시 삼성카드(주)의 사외이사가 지배하는 회사인 발백케이피엘코리아(주), 발백케이피엘파트너스(주), 발백케이피엘자산운용(주) 3개사를 상호출자제한기업집단 「삼성」의 소속회사에서 누락했다는 이유로 2022년 3월 17일 당사의 이재용 부회장에 대해 「경고」 처분 하였습니다.

당사는 2022년 6월 27일 공정거래위원회로부터 '대리점거래의 공정화에 관한 법률' 제5조 (대리점거래 계약서의 작성의무) 제1항 위반 혐의로 과태료 1천만원을 부과 받았으며, 이에 대하여 현재 이의신청 절차가 진행 중입니다.

당사는 공정거래법, 표시광고법, 대리점법 등 법률 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에게 대해 관련 예방교육을 시행하고 있습니다.

(2) 기타 행정·공공기관(금융감독·과세 당국 등 포함)의 제재현황

[요약]

(단위 : 백만원)

| 일자 | 제재기관 | 대상자 | 처벌 또는 조치 내용 | 금전적 제재금액 | 사유 및 근거 법령 |
|---------------------------|-------|---------------------------------|---------------------|----------|---|
| 2019.01.03 ~2022.02.23 | 고용노동부 | 당사 (평택, 온양, 천안, 기흥·화성사업장) | 과태료 | 14.7 | 「구.산업안전보건법」 제48조(유해·위험 방지 계획서의 제출 등) 제1항, 「산업안전보건법」 제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등 |
| 2021.03.02 | 환경부 | 당사 (광주사업장) | 녹색기업 지정취소 | - | 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제16조의3(녹색기업의 지정취소) 제1항 제1호 |
| 2021.08.10 | 법무부 | 당사 | 과태료 | 0.1 | 「출입국관리법」 제19조(외국인을 고용한 자 등의 신고의무) |
| 2021.04.01 | 고용노동부 | 자회사 (삼성전자서비스 씨에스㈜) | 과태료 | 1 | 「고용보험법」 제15조(피보험자격에 관한 신고 등) |
| 2021.09.29 | 고용노동부 | 자회사 (삼성전자서비스㈜) | 부분작업중지 명령 과태료 | 14 | 「산업안전보건법」 제16조(관리감독자) 제1항, 제41조(고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방조치 등) 제7항, 제53조(고용노동부장관의 시정조치 등) 제3항, 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육) 제3항 |
| 2021.11.23 | 고용노동부 | 자회사 (삼성디스플레이㈜) | 과태료 | 0.2 | 「산업안전보건법」 제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 |
| 2022.10.13 | 광주시청 | 당사 (광주사업장) | 과태료 | 3.2 | 「대기환경보전법」 제39조 제1항 |
| 2022.12.14 | 환경부 | 당사 (한국총괄) | 과태료 | 2.0 | 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제 17조 제2항 |
| 2022.12.22 | 환경부 | 당사 (광주사업장) | 과태료 | 1.6 | 「대기환경보전법」 제31조 1항의 4 |
| 2022.12.23 | 고용노동부 | 당사 (광주사업장) | 과태료 | 0.08 | 「산업안전보건법」 제37조 1항 |
| 2023.01.16 | 고용노동부 | 당사 (광주사업장) | 과태료 | 0.16 | 「산업안전보건법」 제37조 1항, 제115조 2항 |

당사는 2018년 9월 10일부터 9월 13일까지 진행된 평택사업장(P1-2)에 대한 고용노동부의 PSM 심사(2차)와 관련하여, 2019년 1월 3일 「구.산업안전보건법」 제48조(유해·위험 방지 계획서의 제출 등) 제1항 위반으로 과태료(10백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다.

2020년 2월 19일 온양사업장에 대한 고용노동부의 PSM 이행상태점검과 관련하여, 2020년 2월 25일 「산업안전보건법」 제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등 위반으로 과태료(20만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다.

2020년 5월 26일부터 5월 28일까지 진행된 천안사업장에 대한 고용노동부의 PSM 이행상태점검과 관련하여, 2020년 6월 29일 「산업안전보건법」 제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등 위반으로 과태료(90만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다.

2020년 11월 16일부터 11월 18일까지 진행된 평택사업장에 대한 고용노동부의 PSM 이행상태점검과 관련하여, 2020년 11월 26일 「산업안전보건법」 제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등 위반으로 과태료(2.1백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다.

2020년 12월 7일부터 12월 11일까지 진행된 기흥·화성사업장에 대한 고용노동부의 PSM 이행상태점검과 관련하여, 2020년 12월 14일 「산업안전보건법」 제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등 위반으로 과태료(90만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다.

2022년 2월 21일부터 2월 23일까지 진행된 은양사업장에 대한 고용노동부의 PSM 이행상태 정기평가와 관련하여 PSM 평가 등급은 한 단계 향상되었으나, 4월 21일 「산업안전보건법」 제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등 위반으로 과태료(60만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다.

당사는 위반사항에 대해서 조치 후 고용노동부에 개선 결과를 제출하였으며, PSM 혁신조직을 신설하여 인허가, 설계 반영, 12대 실천과제, 전문성 향상 활동을 통해 PSM 상시 운영체계를 구축하여 운영 중에 있으며, 현장 공정안전 전문가를 육성하고 공정안전 자체평가를 실시하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 2018년 녹색기업으로 지정된 광주사업장에 대해 2021년 3월 2일 환경부 영산강유역환경청으로부터 대기오염물질 측정값과 관련하여 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제16조의3(녹색기업의 지정취소) 제1항 제1호를 이유로 녹색기업 지정취소를 통보받았습니다. 당사는 측정값에 대한 신뢰도를 높이기 위하여 주기적인 교차 측정 등을 실시하고 있습니다.

당사는 2021년 8월 10일 「출입국관리법」 제19조 1항 (외국인을 고용한 자 등의 신고의무)에 따른 외국인 고용 변동사실 신고의무를 위반하여 수원출입국·외국인청으로부터 과태료(10만원)가 발생하였으며, 자진납부 완료하였습니다. 당사는 퇴직프로세스 개선을 통해 외국인 퇴직자의 고용변동 신고기한을 엄수하기 위해 노력하고 있습니다.

2022년 7월 7일 광주지방법원에서 당사 임직원 2명에게 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제18조 등 위반에 대한 선고가 완료 됨에 따라 2022년 10월 13일 광주시청으로부터 대기오염물질 자가측정결과 기록과 관련하여 「대기환경보전법」 제39조 (자가측정) 제1항 위반으로 과태료(3.2백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 측정값에 대한 신뢰도를 높이기 위하여 주기적인 교차 측정 등을 실시하고 있습니다.

당사는 2022년 11월 28일부터 29일까지 광주사업장에 대한 환경부의 대기방지시설 감독과 관련하여, 2022년 12월 22일 「대기환경보전법」 제31조 (배출시설과 방지시설의 운영) 제1항 위반으로 과태료(1.6백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 대기방지시설 점검을 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 환경부로부터 2022년 12월 14일 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제17조 (배출권 할당의 취소) 제2항 위반으로 과태료(2백만원)를 부과 받았으며, 납부 완료하였습니다. 당사는 온실가스 배출 사업장 현황 관리를 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 2022년 12월 19일부터 21일까지 광주사업장에 대한 고용노동부의 산업안전보건관리 감독과 관련하여, 2022년 12월 23일 「산업안전보건법」 제37조(안전보건표지의 설치·부착) 제1항 위반으로 과태료(8만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 또한, 2023년 1월 9일부터 11일까지 광주사업장에 대한 고용노동부의 산업안전보건관리 감독과 관련하여, 2023년 1월 16일 「산업안전보건법」 제115조(물질안전보건자료대상물질 용기 등의 경고 표시) 제2항, 제37조(안전보건표지의 설치·부착) 제1항 위반으로 과태료(16만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다.

당사는 안전표지판 설치 및 부착 점검을 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

삼성전자서비스씨에스(주)는 고용보험 취득신고를 지연 신고하여 고용노동부 중부지방고용노동청으로부터 2021년 4월 1일 「고용보험법」 제15조(피보험자격에 관한 신고 등) 위반으로 과태료(1백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 삼성전자서비스씨에스(주)는 재발 방지를 위하여 고용보험법 개정사항에 대해 주기적으로 검토하고 담당자 실무 교육을 실시하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

삼성전자서비스(주)는 2021년 9월 28일 세탁기 수리 중 발생한 작업자의 감전사와 관련하여, 2021년 9월 29일 고용노동부 서울지방고용노동청 서울남부지청으로부터 「산업안전보건법」 제53조(고용노동부장관의 시정조치 등)에 따른 부분작업중지 명령을 받았습니다. 이에 삼성전자서비스(주)는 전국 사업장에 대한 안전보건조치 개선 대책(안)을 제출하여 2021년 11월 10일부로 부분작업중지명령이 해제되었습니다. 또한 2021년 11월 15일 「산업안전보건법」 제16조(관리감독자) 제1항, 제41조(고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방조치 등) 제7항, 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육) 제3항 등 위반으로 과태료 14백만원이 발생하였으며, 2021년 12월 28일 과태료를 자진납부 완료하였습니다.

삼성디스플레이(주)는 2021년 11월 15일부터 11월 16일까지 진행된 기흥사업장에 대한 고용노동부의 PSM 이행상태점검과 관련하여 2021년 11월 23일 「산업안전보건법」 제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등 위반으로 과태료 16만원이 발생하였으며, 자진 납부 완료하였습니다.

다. 한국거래소 등으로부터 받은 제재현황

해당사항 없습니다

라. 단기매매차익 발생 및 반환에 관한 사항

해당사항 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

해당사항 없습니다.

나. 대외후원 현황

| 현황 | 금액 | 내용 | 비고 |
|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 삼성꿈장학재단 기부금 출연 | 11.2억원 | · 저소득층 고등학생 학습지원 | 2020.01.30 이사회 결의 |
| 2020년 사회공헌 매칭기금 운영계획 | 118.9억원 | · 당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금으로 구성되며, 2020년 회사매칭기금으로 118.9억원 운영 · 청소년 교육 관련 사회공헌 활동에 사용 | 2020.02.21 이사회 결의 |
| 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연 | 25.76억원 | · 지역 교육 환경 개선 도모 | |
| 코로나19 관련 긴급 구호지원 | 230억원 | · 코로나19 관련 피해자 및 지역사회 긴급 구호지원 | 2020.02.26 이사회 결의 |
| 삼성복지재단 등 기부금 출연 | 518억원 | · 저소득층 중학생 학습지원 프로그램인 드림클래스 운영 (삼성복지재단, 106억원) · 삼성서울병원 시설 및 연구 인프라 지원, 메르스 백신개발 연구 지원 (삼성생명공익재단, 265억원) · 교직원 법정부담금 지원 및 삼성장학금 운영 등(성균관대학, 147억원) | 2020.04.29 이사회 결의 |
| DS 부문 우수협력사 인센티브 | 약 620억원 | · 사업장내 안전사고 예방, 생산성 향상 및 협력사와의 동반성장 확산 · 대상: DS 부문 상주 1, 2차 협력회사 중 중소기업 | |
| 호암재단 기부금 출연 | 41억원 | · 학술, 예술 및 인류 복지 증진에 크게 공헌한 인물 시상 | 2020.05.27 이사회 결의 |
| 희망2021나눔캠페인 기부금 출연 | 338억원 | · 연말 이웃사랑 성금 보금 참여로 소외계층을 돕고 기업의 사회적 책임을 다하고자 사회복지공동모금회에 출연 | 2020.11.30 이사회 결의 |
| Samsung Global Goals 기부금 출연 | \$1,421,154 (약 15.7억원) | · UNDP(United Nations Development Programme)에 전달하여 각 국의 구호 활동 등에 활용 | |
| 2021년 사회공헌 매칭기금 운영계획 | 116.1억원 | · 당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금으로 구성되며, 2021년 회사매칭기금으로 116.1억원 운영 · 청소년 교육 관련 및 취약계층 관련 사회공헌 사업에 활용 | 2021.02.16 이사회 결의 |
| 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연 | 24.46억원 | · 지역 교육 환경 개선 도모 | |
| 삼성복지재단 등 기부금 출연 | 601억원 | · 저소득층 중학생 학습지원 프로그램인 드림클래스 운영 (삼성복지재단, 115억원) · 삼성서울병원 시설 및 연구 인프라 지원, 응급헬기 운영 지원 (삼성생명공익재단, 299억원) · 교직원 법정부담금 지원 및 삼성장학금 운영 등(성균관대학, 150억원) · 학술, 예술 및 인류 복지 증진에 크게 공헌한 인물 시상(호암재단, 37억원) | 2021.04.29 이사회 결의 |
| DS 부문 우수협력사 | 약 632억원 | · 사업장내 안전사고 예방, 생산성 향상 및 협력사와의 동반성장 확산 | |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|----------------------|
| 인센티브 | | · 대상: DS부문 상주 1,2차 협력회사 중 중소기업 | |
| 국제기능올림픽 후원 | 150만 유로 (약 20.9억원) | · 제46회 중국 상하이 국제기능올림픽대회 및 국제기능올림픽위원회(WorldSkills International) 후원 | |
| 공동투자형 기술개발 협약기금 출연 | 150억원 | · 중소벤처기업부 주관 공동투자형 기술개발사업 참여 · 중소벤처기업부와 협약기금을 조성, 협약기금은 중소기업이 제안한 로봇·AI / 바이오헬스 / 시스템 반도체, 소재부품장비 국산화 관련 과제 평가 후 최종 선정된 중소기업에 지급 | 2021.10.28 이사회 결의 |
| 희망2022 나눔캠페인 기부금 출연 | 256억원 | · 연말 이웃사랑 성금 보금 참여로 소외계층을 돕고 기업의 사회적 책임을 다하고자 사회 복지공동모금회에 출연 | 2021.11.30 |
| Samsung Global Goals 기부금 출연 | \$2,689,094 (약 32.0억원) | · United Nations Development Programme(UNDP)에 전달하여, 각 국의 구호활동 등에 활용 | 이사회 결의 |
| 2022년 사회공헌 매칭기금 운영계획 | 117.5억원 | · 당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금으로 구성되며, 2022년 회사매칭기금으로 117.5억원 운영 · 청소년 교육 관련 및 취약계층 관련 사회공헌 사업에 활용 | 2022.02.15 이사회 결의 |
| 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연 | 23.24억원 | · 지역 교육 환경 개선 도모 | |
| 삼성복지재단 등 기부금 출연 | 468억원 | · 저소득층 중학생 학습지원 프로그램인 드림클래스 운영 (삼성복지재단, 44억원) · 삼성서울병원 리모델링 공사비 지원(삼성생명공익재단, 232억원) · 교직원 법정부담금 지원 및 삼성장학금 운영 등(성균관대학, 150억원) · 학술, 예술 및 인류 복지 증진에 크게 공헌한 인물 시상(호암재단, 42억원) | 2022.04.28 이사회 결의 |
| DS부문 우수협력사 인센티브 | 약 740억원 | · 사업장내 안전사고 예방, 생산성 향상 및 협력사와의 동반성장 확산 · 대상: DS부문 상주 1,2차 협력회사 중 중소기업 | |
| 서울대 반도체공동연구소 운영비 기부금 출연 | 50억원 | · 서울대학교 반도체공동연구소의 교육 장비 인프라 및 연구 인력 채용을 위한 운영비 지원 | 2022.07.28 이사회 결의 |
| 이태원 사고 관련 지원 및 사회안전시스템 구축 성금 | 40억원 | · 이태원 사고 관련 지원 및 사회안전시스템 구축을 위해 총 40억원을 사단법인 전국재해구호협회에 현금 기부 | 2022.11.03 이사회 결의 |
| 희망2023 나눔캠페인 기부금 출연 | 188.7억원 | · 연말 이웃사랑 성금 보금 참여로 소외계층을 돕고 기업의 사회적 책임을 다하고자 사회 복지공동모금회에 출연 | |
| Samsung Global Goals 기부금 출연 | \$7,188,329 (약 95.7억원) | · United Nations Development Programme(UNDP)에 전달하여, 각 국의 구호활동 등에 활용 | 2022.11.30 이사회 결의 |
| 국제기능올림픽 후원 | 165만 유로 (약22.5억원) | · 제47회 프랑스 리옹 국제기능올림픽대회 및 국제기능올림픽위원회(WorldSkills International) 후원 | |
| 2023년 사회공헌 매칭기금 운영계획 | 123.4억원 | · 당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금으로 구성되며, 2023년 회사매칭기금으로 123.4억원 운영 · 청소년 교육 관련 및 취약계층 관련 사회공헌 사업에 활용 | 2023.02.14 이사회 결의 |
| 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연 | 23.78억원 | · 지역 교육 환경 개선 도모 | |
| 스마트공장 지원사업 추진 | 224억원 | · 스마트공장 지원을 통한 국내 제조경쟁력 강화 및 지역균형 발전에 기여 | 2023.04.27 |
| DS부문 우수협력사 인센티브 | 801억원 | · 사업장내 안전사고 예방, 생산성 향상 및 협력사와의 동반성장 확산 · 대상: DS부문 상주 1,2차 협력회사 중 중소기업 | 이사회 결의 |

* 대외후원 현황 및 금액은 이사회 결의 기준으로 기재하였습니다.

다. 녹색경영

당사는 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 '녹색기업 지정' 및 '녹색기술 인증'을 확대하고 있습니다. 특히 관련 법규에서 요구하는 사업장에서 발생하는 '온실가스배출량'과 '에너지 사용량'을 정부에 신고하고 지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다.

(녹색기업 지정)

당사는 오염물질 감소, 자원과 에너지의 절감, 제품의 환경성 개선, 녹색경영체제의 구축 등 친환경기업으로서의 책임을 다하고 있으며, 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제16조의2(녹색기업의 지정 등)에 따라 2023년 반기말 현재(별도 기준) 수원사업장, 구미사업장, 기흥·화성사업장, 평택사업장, 온양사업장이 녹색기업으로 지정되어 있습니다. 한편, 2021년 3월 광주사업장은 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제16조의3(녹색기업의 지정취소) 제1항 제1호에 따라 녹색기업 지정이 취소되었습니다.

(녹색기술 인증)

당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제32조(녹색기술·녹색산업의 표준화 및 인증 등) 2항에 따라 '녹색기술 인증'을 취득하고 있습니다. 당사의 녹색기술 개발은 사람과 자연을 존중하며 2050년까지 탄소 중립 실현을 목표로 하는 '신환경안전전략'을 발표하고 친환경 제품 개발과 보급 확대에 주력한 결과로, 인증 제도가 시작된 2010년 이래 2023년 반기말 현재 총 7건의 유효 녹색기술 인증을 확보하고 있습니다. 또한 당사는 인증 받은 녹색기술이 적용된 상용화 제품에 대해 부여하는 '녹색기술제품 확인' 인증을 총 183개 모델에 대해서 보유 중입니다.

2023년 반기말 현재 녹색기술 인증 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건)

| 부문 | 녹색기술인증 | 건수 |
|-------|---|----|
| DX 부문 | 고효율 전력 변환 기술을 활용한 노트북 대기전력 저감기술, 고효율 히트펌프와 열교환기를 적용한 의류건조기 에너지 효율 향상 기술, 모니터 대기전력 저감 기술 등 | 7 |

※ 별도 기준입니다.

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제42조(기후변화대응 및 에너지의 목표관리) 제6항에 따라 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제44조(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 등의 보고)와 당국의 지침에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자에게 공개하고 있습니다.

정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

(단위 : tCO₂-eq, TJ)

| 구 분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| 온실가스(tCO ₂ -eq) | 14,929,733 | 14,515,620 | 12,534,930 |
| 에너지(TJ) | 222,876 | 200,942 | 177,156 |

※ 별도 기준입니다.

※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등입니다.

※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.

※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 2015년부터 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제8조(할당대상업체의 지정 및 지정취소)에 따라 온실가스 배출권 할당대상업체에 해당합니다.

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

당사의 연결대상 종속기업은 2023년 반기말 현재 233개사입니다. 전년말 대비 4개 기업이 증가하고 3개 기업이 감소하였습니다.

☞ 본문 위치로 이동

(단위 : 백만원)

| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말 자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속 회사 여부 |
|--|----------|---|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|
| Samsung Electronics America, Inc. (SEA) | 1978. 07 | 85 Challenger Rd., Ridgefield Park, New Jersey, USA | 전자제품 판매 | 37,883,156 | 의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 1110호) | O |
| Samsung International, Inc. (SII) | 1983. 10 | 9335 Airway Rd. #105, San Diego, California, USA | 전자제품 생산 | 1,595,348 | 상동 | O |
| Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX) | 1988. 03 | Parque Ind., El Florido 1ra y 2da Secc., Tijuana, B.C., Mexico | 전자제품 생산 | 114,887 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA) | 2017. 08 | 284 Mawsons Way, Newberry, South Carolina, USA | 가전제품 생산 | 1,004,065 | 상동 | O |
| Samsung Research America, Inc (SRA) | 1988. 10 | 665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA | R&D | 824,812 | 상동 | O |
| SAMSUNG NEXT LLC (SNX) | 2016. 08 | 665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA | 해외자회사 관리 | 190,103 | 상동 | O |
| SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF) | 2016. 08 | 665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 305,097 | 상동 | O |
| NeuroLogica Corp. | 2004. 02 | 14 Electronics Ave., Danvers, Massachusetts, USA | 의료기기 생산 및 판매 | 236,677 | 상동 | O |
| Samsung HVAC America, LLC | 2001. 07 | 3001 Northern Cross Blvd. #361, Fort Worth, Texas, USA | 에어컨공조 판매 | 62,570 | 상동 | X |
| Joyent, Inc. | 2005. 03 | 655 Montgomery St. #1600, San Francisco, California, USA | 클라우드서비스 | 190,791 | 상동 | O |
| SmartThings, Inc. | 2012. 04 | 665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA | 스마트홈 플랫폼 | 205,450 | 상동 | O |
| TeleWorld Solutions, Inc. (TWS) | 2002. 05 | 43130 Amberwood Plaza #210, Chantilly, Virginia, USA | 네트워크장비 설치 및 최적화 | 31,801 | 상동 | X |
| Samsung Semiconductor, Inc. (SSI) | 1983. 07 | 3655 N. 1st St., San Jose, California, USA | 반도체 · DP 판매 | 12,199,102 | 상동 | O |
| Samsung Federal, Inc. (SFI) | 2023. 05 | 3655 N. First St., San Jose CA 95134 | R&D | - | 상동 | X |
| Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS) | 1996. 02 | 12100 Samsung Blvd., Austin, Texas, USA | 반도체 생산 | 9,301,017 | 상동 | O |
| Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI) | 2016. 06 | 3655 N. 1st St., San Jose, California, USA | 해외자회사 관리 | 550,459 | 상동 | O |
| SEMES America, Inc. | 1998. 10 | 13400 Immanuel Rd., Pflugerville, Texas, USA | 반도체 장비 서비스 | 2,292 | 상동 | X |
| Emerald Intermediate, Inc. | 2023. 05 | 3655 N 1st St San Jose CA 95134 | 해외자회사 관리 | - | 상동 | X |
| Emerald Merger Sub, Inc. | 2023. 05 | 3655 N 1st St San Jose CA 95134 | 해외자회사 관리 | - | 상동 | X |
| Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA) | 1980. 07 | 2050 Derry Rd. West, Mississauga, Ontario, Canada | 전자제품 판매 | 1,652,195 | 상동 | O |

| | | | | | | |
|---|----------|---|-------------------------------|------------|----|---|
| AdGear Technologies Inc. | 2010. 08 | 481 Viger West #300, Montreal, Quebec, Canada | 디지털광고 플랫폼 | 125,162 | 상통 | O |
| Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA) | 1995. 01 | Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240 Diamond Tower, Sao Paulo, Brazil | 전자제품 생산 및 판매 | 4,600,508 | 상통 | O |
| Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM) | 1995. 07 | Col. Chapultepec Morales, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, Mexico | 전자제품 판매 | 1,816,895 | 상통 | O |
| Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM) | 2012. 12 | Av. Benito Juarez #119, Parque Industrial Gro. Sta. Rosa Jauregui C.P, Queretaro, Mexico | 가전제품 생산 | 1,257,964 | 상통 | O |
| Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA) | 1989. 04 | Calle 50 Edificio PH Credicorp Bank Piso 16, Panama City, Panama | 전자제품 판매 | 1,234,491 | 상통 | O |
| Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI) | 1995. 05 | 9800 NW 41st St. #200, Miami, Florida, USA | 전자제품 판매 | 395,124 | 상통 | O |
| Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL) | 1997. 03 | Carrera 7 #114-43 Oficina 606, Bogota, Colombia | 전자제품 판매 | 487,904 | 상통 | O |
| Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA) | 1996. 06 | Bouchard 710 Piso #8, Buenos Aires, Argentina | 마케팅 및 서비스 | 102,325 | 상통 | O |
| Samsung Electronics Chile Limitada (SECH) | 2002. 12 | Americo Vespucio Sur 100 Oficina 102, Las Condes, Chile | 전자제품 판매 | 646,185 | 상통 | O |
| Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR) | 2010. 04 | Av. Rivera Navarrete 501 Piso 6, San Isidro, Lima, Peru | 전자제품 판매 | 357,460 | 상통 | O |
| Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN) | 2010. 05 | Torre Kepler Piso 1, Av. Blandin Castellana, Municipio Chacao, Caracas, Venezuela | 마케팅 및 서비스 | 37 | 상통 | X |
| Samsung Electronics Panama, S.A. (SEPA) | 2012. 07 | Torre C Piso 23 Torre de Las Americas, Panama City, Panama | 컨설팅 | 5,636 | 상통 | X |
| Harman International Industries, Inc. | 1980. 01 | 400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA | 해외자회사 관리 | 15,627,849 | 상통 | O |
| Harman Becker Automotive Systems, Inc. | 1981. 06 | 30001 Cabot Drive, Novi, Michigan, USA | 오디오제품 생산, 판매, R&D | 2,930,229 | 상통 | O |
| Harman Connected Services, Inc. | 2002. 02 | 636 Ellis St., Mountain View, California, USA | Connected Service Provider | 2,249,385 | 상통 | O |
| Harman Connected Services Engineering Corp. | 2004. 09 | 636 Ellis St., Mountain View, California, USA | Connected Service Provider | 2,980 | 상통 | X |
| Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda. | 2005. 07 | Av. Cupiuba 401, Distrito Industrial, Manaus, Amazonas, Brazil | 오디오제품 생산, 판매 | 134,845 | 상통 | O |
| Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V. | 1997. 02 | 2290 Ave De Las Torres, Juarez, Chih, Mexico | 오디오제품 생산 | 180,271 | 상통 | O |
| Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda. | 1958. 11 | BR-386 KM 435, Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, Brazil | 오디오제품 판매, R&D | 273,861 | 상통 | O |
| Harman Financial Group LLC | 2004. 06 | 400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA | Management Company | 755 | 상통 | X |
| Harman International Industries Canada Ltd. | 2005. 05 | 2900-550 Burrard St., Vancouver, British Columbia, Canada | 오디오제품 판매 | 313 | 상통 | X |
| Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V. | 2014. 12 | 2290 Ave De Las Torres, Juarez, Chih, Mexico | 오디오제품 판매 | 31,954 | 상통 | X |
| Harman KG Holding, LLC | 2009. 03 | 400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA | 해외자회사 관리 | - | 상통 | X |
| Harman Professional, Inc. | 2006. 07 | 8500 Balboa Blvd., Northridge, California, USA | 오디오제품 판매, R&D | 892,007 | 상통 | O |
| Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P | 2014. 12 | 89 Nexus Way, Cayman Bay, Grand Cayman, Cayman Islands | 벤처기업 투자 | 13,443 | 상통 | X |
| China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership | 2017. 09 | 23 Lime Tree Bay Av., Grand Cayman, Cayman Islands | 벤처기업 투자 | 8,089 | 상통 | X |
| Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK) | 1995. 07 | 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK | 전자제품 판매 | 2,819,792 | 상통 | O |

| | | | | | | |
|--|----------|--|---------------------|------------|----|---|
| Samsung Electronics Ltd. (SEL) | 1999. 01 | 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK | 해외자회사 관리 | 6,711 | 상동 | X |
| Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL) | 1997. 04 | No.5 The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, UK | 반도체 · DP 판매 | 102,683 | 상동 | O |
| Samsung Electronics GmbH (SEG) | 1984. 12 | Am Kronberger Hang 6, Schwalbach/Ts., Germany | 전자제품 판매 | 1,968,273 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG) | 1982. 02 | Am Kronberger Hang 6, Schwalbach/Ts., Germany | 해외자회사 관리 | 651,158 | 상동 | O |
| Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG) | 1987. 12 | Koelner Str. 12, Eschborn, Germany | 반도체 · DP 판매 | 816,633 | 상동 | O |
| Samsung Electronics France S.A.S (SEF) | 1988. 01 | 1 Rue Fructidor, Saint-Ouen, France | 전자제품 판매 | 1,053,910 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI) | 1991. 04 | Via Mike Bongiorno 9, Milano, Italy | 전자제품 판매 | 959,801 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA) | 1989. 01 | Parque Empresarial Omega Edf. C Av. de Barajas 32, Alcobendas, Madrid, Spain | 전자제품 판매 | 1,098,852 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP) | 1982. 09 | Lagoas, Edifício 5B, Piso 0, Porto Salvo, Portugal | 전자제품 판매 | 273,915 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH) | 1989. 10 | Samsung ter 1, Jaszfenyszaru, Hungary | 전자제품 생산 및 판매 | 2,374,317 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS) | 1991. 05 | Olof Palmestraat 10, Delft, Netherlands | 물류 | 2,194,975 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN) | 1995. 07 | Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands | 전자제품 판매 | 2,377,730 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH) | 2008. 10 | Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands | 해외자회사 관리 | 10,841,515 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA) | 1992. 03 | Box 1235, 16428, Kista, Sweden | 전자제품 판매 | 697,034 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK) | 2002. 06 | Hviezdoslavova 807, Galanta, Slovakia | TV · 모니터 생산 | 1,585,901 | 상동 | O |
| Samsung Display Slovakia, s.r.o., v likvidácii(SDSK) | 2007. 03 | Voderady 401, Voderady, Slovakia | DP 임가공 | 28,179 | 상동 | X |
| Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL) | 1996. 04 | ul.Marynarska 15, Warszawa, Poland | 전자제품 판매 | 1,172,265 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM) | 2010. 02 | ul. Mickiewicza 52, Wronki, Poland | 가전제품 생산 | 808,474 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Romania LLC (SEROM) | 2007. 09 | Sos. Pipera-Tunari, nr. 1/VII, Nord City Tower, Voluntari, Romania | 전자제품 판매 | 371,708 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG) | 2002. 01 | Praterstraße 31, Vienna, Austria | 전자제품 판매 | 574,106 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG) | 2013. 05 | Binzallee 4, Zurich, Switzerland | 전자제품 판매 | 390,327 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ) | 2010. 01 | V Parku 14, Prague, Czech Republic | 전자제품 판매 | 344,331 | 상동 | O |
| SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB) | 2001. 10 | Duntes iela 6, Riga, Latvia | 전자제품 판매 | 146,994 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR) | 2010. 04 | 280 Kifissias Ave, Halandri 15232, Athens, Greece | 전자제품 판매 | 129,431 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE) | 2017. 04 | Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands | 에어컨공조 판매 | 286,316 | 상동 | O |
| Samsung Nanoradio Design Center (SNDK) | 2004. 02 | Torshamnsgatan 48, 16440, Kista, Sweden | R&D | 26,918 | 상동 | X |
| Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC) | 2012. 09 | c/o Novi Science park, Niels Jernes Vej 10, Aalborg Øst, Denmark | R&D | 24,563 | 상동 | X |
| Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC) | 2012. 09 | St. John's Houst, St. John's Innovation Park, Cowley Rd., Cambridge, UK | R&D | 170,489 | 상동 | O |
| SAMSUNG Zhilabs, S.L. | 2008. 11 | Numancia 69-73, 5F, Barcelona, Spain | 네트워크Solution 개발, 판매 | 9,812 | 상동 | X |

| | | | | | | |
|--|----------|---|----------------------------|-----------|----|---|
| FOODIENT LTD. | 2012. 03 | Cornwall House, 31 Lionel St., Birmingham, UK | R&D | 2,349 | 상동 | X |
| Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC) | 2006. 10 | 31 Novinsky Boulevard, Moscow, Russia | 전자제품 판매 | 876,346 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK) | 2007. 07 | 1 Vladenie, Perviy Severniy proezd St., Koryakovo, Borovsk, Kaluga, Russia | TV 생산 | 1,149,970 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC) | 2008. 09 | 75A, Zhylanska St., Kiev, Ukraine | 전자제품 판매 | 244,279 | 상동 | O |
| Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR) | 2022. 02 | 57 L'va Tolstogo St. Kyiv Ukraine | R&D | 8,119 | 상동 | X |
| Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE) | 2008. 09 | Naurizbay batyr st., Almaty, Republic of Kazakhstan | 전자제품 판매 | 606,726 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO) | 1997. 01 | Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands | 전자제품 판매 | 1,960 | 상동 | X |
| Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR) | 2011. 11 | 12, building 1, Dvintsev St., Moscow, Russia | R&D | 52,581 | 상동 | X |
| Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC) | 2014. 10 | 1065 Bridge Plaza Biz Centre 12F, 6 Bakikhanov St., Baku, Azerbaijan | 마케팅 | 2,500 | 상동 | X |
| Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ) | 2022. 03 | International Business Center, 107 B - Amir Temur str., Tashkent Uzbekistan | 마케팅 | 6,418 | 상동 | X |
| AKG Acoustics GmbH | 1947. 03 | 254, Laxenburger St., Vienna, Austria | 오디오제품 생산, 판매 | 350,440 | 상동 | O |
| Apostera UA, LLC | 2020. 10 | 3 Sumska St., Kyiv, Ukraine | Connected Service Provider | 631 | 상동 | X |
| Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada | 2012. 11 | C/ ERCILLA 17 3ºBILBAO48, Bizkaia, Spain | 오디오제품 판매 | 1,399 | 상동 | X |
| Harman Automotive UK Limited | 2012. 10 | Salisbury House, London Wall, London, UK | 오디오제품 생산 | - | 상동 | X |
| Harman Becker Automotive Systems GmbH | 1990. 07 | 16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany | 오디오제품 생산, 판매, R&D | 3,962,309 | 상동 | O |
| Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L. | 2005. 12 | 17, Viale Luigi Majno, Milano (MI), Italy | 오디오제품 판매 | 1,047 | 상동 | X |
| Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft | 1994. 08 | 19 Holland Fasar, Szekesfehervar, Hungary | 오디오제품 생산, R&D | 3,291,277 | 상동 | O |
| Harman Belgium SA | 1967. 04 | 4 Drukperstraat, Brussels, Belgium | 오디오제품 판매 | 2,944 | 상동 | X |
| Harman Connected Services AB. | 1984. 10 | 24 Nordenskioldsgatan, Malmo, Sweden | Connected Service Provider | 12,527 | 상동 | X |
| Harman Finland Oy | 1998. 07 | Hermiankatu 1 A, Tampere, Finland | Connected Service Provider | - | 상동 | X |
| Harman Connected Services GmbH | 2005. 12 | 45 Wittener Str., Bochum, Germany | Connected Service Provider | 51,968 | 상동 | X |
| Harman Connected Services Poland Sp.zoo | 2007. 06 | UL Kasprzaka 6, Lodz, Poland | Connected Service Provider | 10,015 | 상동 | X |
| Harman Connected Services UK Ltd. | 2008. 09 | Devonshire House, 60 Goswell Rd., London, UK | Connected Service Provider | 54,603 | 상동 | X |
| Harman Consumer Nederland B.V. | 1995. 12 | 16 Danzigerkade, 1013 AP, Amsterdam, Netherlands | 오디오제품 판매 | 489,585 | 상동 | O |
| Harman Deutschland GmbH | 1998. 03 | Parkring 3 B. Munich, Garching, Germany | 오디오제품 판매 | 13,547 | 상동 | X |
| Harman Finance International GP S.a.r.l | 2015. 04 | 6, rue Eugene Ruppert, Luxembourg | 해외회사 관리 | - | 상동 | X |
| Harman France SNC | 1995. 11 | 12 bis, rue des Colannes-du-Trone, Paris, France | 오디오제품 판매 | 167,450 | 상동 | O |
| Harman Holding GmbH & Co. KG | 2002. 06 | 16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany | Management Company | 5,700,548 | 상동 | O |

| | | | | | | |
|---|----------|---|----------------------------|-----------|----|---|
| Harman Hungary Financing Ltd. | 2012. 06 | Holland Faszor 19, Szekesfehervar, Hungary | Financing Company | 45,415 | 상동 | X |
| Harman Inc. & Co. KG | 2012. 06 | 16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany | 해외자회사 관리 | 4,540,799 | 상동 | O |
| Harman International Estonia OU | 2015. 05 | Parnu mnt 139a, Tallinna linn, Harju maakond, Estonia | R&D | 232 | 상동 | X |
| Harman International Industries Limited | 1980. 03 | Westside, Two London Rd, Apsley, Hemel Hempstead, Hertfordshire, UK | 오디오제품 판매, R&D | 79,014 | 상동 | O |
| Harman International Romania SRL | 2015. 02 | 5-7, Bdul. Dimitrie Pompeiu, Metrooffice, Cladirea A parter, et. 2 si et. 4, Sec. 2, Bucharest, Romania | R&D | 17,145 | 상동 | X |
| Harman Finance International, SCA | 2015. 04 | 6, rue Eugene Ruppert, Luxembourg | Financing Company | 10,320 | 상동 | X |
| Harman Management GmbH | 2002. 04 | Becker Goering St. 16, Karlsbad, Germany | 해외자회사 관리 | - | 상동 | X |
| Harman Professional Kft | 2014. 12 | Holland Faszor 19, Szekesfehervar, Hungary | 오디오제품 생산, R&D | 68,463 | 상동 | X |
| Harman Professional Denmark ApS | 1987. 07 | Olof Palmes Alle 18., Aarhus, Denmark | 오디오제품 판매, R&D | 55,117 | 상동 | X |
| Red Bend Software SAS | 2002. 10 | Immeuble 15 place Georges Pompidou, MontignyLe Bretonneux, France | 소프트웨어 디자인 | 7,259 | 상동 | X |
| Studer Professional Audio GmbH | 2003. 11 | Althardstrasse 30, Regensdorf, Switzerland | 오디오제품 판매, R&D | 4,586 | 상동 | X |
| Harman Connected Services OOO | 1998. 11 | 8 Kovalikhinskaya St., Nizhny Novgorod, Russia | Connected Service Provider | 37,721 | 상동 | X |
| Harman RUS CIS LLC | 2011. 08 | RS 12/1 Dvintsev street, Moscow, Russia | 오디오제품 판매 | 52,838 | 상동 | X |
| Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE) | 1995. 05 | Butterfly Building A, Dubai Media City, Dubai, UAE | 전자제품 판매 | 1,031,216 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Turkiye (SETK) | 1984. 12 | Flatofis Is Merkezi Otakcilar Caddesi No.78 Kat 3 No. B3 Eyup, Istanbul, Turkey | 전자제품 판매 | 693,954 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P) | 2021. 02 | Flatofis Is Merkezi Otakcilar Caddesi No.78 Kat 3 No. B3 Eyup, Istanbul, Turkey | 전자제품 생산 | 130,961 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. (SELV) | 2009. 07 | Building Nr.5, King Hussein Business Park, King Abdullah II St., Amman, Jordan | 전자제품 판매 | 262,165 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG) | 2009. 11 | Lot N°9 Mandarouna 300 Route Sidi Maarouf, Casablanca, Morocco | 전자제품 판매 | 291,185 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG) | 2012. 07 | 62815 Piece No. 98, Engineering Sector, Kom Abu Radi, Al Wasta, BeniSuef, Egypt | 전자제품 생산 및 판매 | 1,055,570 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL) | 2012. 09 | Holland Building 1F, Europark, Yakum, Israel | 마케팅 | 16,764 | 상동 | X |
| Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN) | 2012. 09 | 2eme etage Immeuble Adonis, rue du Lac D'annecy, Tunis, Tunisia | 마케팅 | 5,294 | 상동 | X |
| Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK) | 2012. 11 | No.4 1F Park Lane Tower 172 Turfail Rd., Cantt, Lahore, Pakistan | 마케팅 | 3,765 | 상동 | X |
| Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR) | 2019. 11 | Hamad Tower, Olaya District, Riyadh, Saudi Arabia | 전자제품 판매 | 469,588 | 상동 | O |
| Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC) | 2007. 10 | 10 Oholiav St., Ramat Gan, Israel | R&D | 153,328 | 상동 | O |
| Corephotonics Ltd. | 2012. 01 | 25 Habarzel St., Tel Aviv, Israel | R&D | 21,964 | 상동 | X |
| Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA) | 1994. 06 | 2929 William Nicol Drive, Bryanston, Johannesburg, South Africa | 전자제품 판매 | 573,688 | 상동 | O |

| | | | | | | |
|---|----------|---|----------------------------|------------|----|---|
| Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP) | 2014. 07 | 35 Umkhomazi Drive, La Mercy, Kwa-Zulu Natal, South Africa | TV · 모니터 생산 | 81,698 | 상통 | O |
| Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA) | 2010. 03 | Mulliner Tower, Alfred Rewane Rd., Ikoyi, Lagos, Nigeria | 마케팅 | 33,487 | 상통 | X |
| Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA) | 2011. 12 | Milford Suites 4F, Nairobi, Kenya | 마케팅 | 18,273 | 상통 | X |
| Global Symphony Technology Group Private Ltd. | 2002. 01 | International Financial Services Ltd, IFS Court, TwentyEight CyberCity, Ebene, Mauritius | 해외자회사 관리 | 61,038 | 상통 | X |
| Harman Connected Services Morocco | 2012. 04 | Technopark, Route Nouaceur, Rs 114 & CT1029, Casablanca, Morocco | Connected Service Provider | 73 | 상통 | X |
| Harman Industries Holdings Mauritius Ltd. | 2009. 10 | IFS Court Twenty Eight Cybercity, Ebene, Mauritius | 해외자회사 관리 | 93,636 | 상통 | O |
| Red Bend Ltd. | 1998. 02 | 4 HaCharash St., Neve Ne'emman Industrial Park, Hod Ha'Sharon, Israel | 오디오제품 생산 | 129,006 | 상통 | O |
| Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL) | 2006. 07 | 30 Pasir Panjang Rd., Mapletree Business City, Singapore | 해외자회사 관리 | 26,894,611 | 상통 | O |
| Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP) | 2020. 10 | 30 Pasir Panjang Rd., Mapletree Business City, Singapore | 전자제품 판매 | 625,194 | 상통 | O |
| Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME) | 2003. 05 | #E-09-01, Level 9, East Wing, No.1 Jalan 1/68F, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia | 전자제품 판매 | 541,255 | 상통 | O |
| Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA) | 1995. 03 | Tuanku Jaafar Industrial Park, Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia | 전자제품 생산 | 24,689 | 상통 | X |
| Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA) | 1989. 09 | North Klang Straits, Area 21 Industrial Park, Port Klang, Selangor, Malaysia | 가전제품 생산 | 278,943 | 상통 | O |
| Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA) | 1995. 01 | 938 1A Highway, Linh Trung ward, Thu Duc Dist, Ho Chi Minh, Vietnam | 전자제품 판매 | 129,160 | 상통 | O |
| Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV) | 2008. 03 | YenTrung Commune, Yenphong Dist, Bacninh, Vietnam | 전자제품 생산 | 10,931,037 | 상통 | O |
| Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT) | 2013. 03 | Yen Binh 1, Industrial Park, Pho Yen district, Thai Nguyen, Vietnam | 통신제품 생산 | 15,718,299 | 상통 | O |
| Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC) | 2015. 02 | Lot I-11, D2 Road, Saigon HI-Tech Park, District 9, Ho Chi Minh, Vietnam | 전자제품 생산 및 판매 | 3,732,057 | 상통 | O |
| Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV) | 2014. 07 | Yenphong I I.P, YenTrung Commune, Yenphong Dist, Bacninh, Vietnam | DP 생산 | 7,471,680 | 상통 | O |
| DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED | 2022. 06 | Lot CN9, Song Cong II Industrial Zone, Tan Quang, SongCong, Thai Nguyen, Vietnam | DP 부품 생산 | 58,171 | 상통 | X |
| PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN) | 1991. 08 | Cikarang Industrial Estate, JL. Jababeka Raya Blok F29-33, Cikarang, Bekasi, West Java, Indonesia | 전자제품 생산 및 판매 | 883,023 | 상통 | O |
| PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN) | 2003. 03 | Prudential Tower 23F Jl. Jend. Sudirman Kav 79, Jakarta, Indonesia | 전자제품 판매 및 서비스 | 58,012 | 상통 | X |
| Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE) | 1988. 10 | 313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd, Sriracha Industry Park, T.Bung A.Sriracha Chonburi, Thailand | 전자제품 생산 및 판매 | 3,263,473 | 상통 | O |
| Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE) | 2016. 09 | 3F Kolao Tower 2, 23 Singha Rd., Vientiane, Laos | 마케팅 | 1,099 | 상통 | X |
| Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO) | 1996. 03 | 8F HanjinPhil Building 1128 University Parkway, North Bonifacio, Global City, Taguig, Philippines | 전자제품 판매 | 353,596 | 상통 | O |

| | | | | | | |
|--|----------|---|-------------------------------|------------|----|---|
| Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU) | 1987. 11 | Quad Samsung, 8 Parkview Drive, Homebush Bay 2127, Sydney, Australia | 전자제품 판매 | 593,991 | 상통 | O |
| Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ) | 2013. 09 | 24 The Warehouse Way, Northcote, Auckland, New Zealand | 전자제품 판매 | 178,053 | 상통 | O |
| Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL) | 1995. 08 | Two Horizon Centre, Golf Course RD, Gurgaon, Haryana, India | 전자제품 생산 및 판매 | 6,772,537 | 상통 | O |
| Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd. | 2012. 01 | 6th Floor, Salarpuria Sattva Magnificia, Old Madras Road, Bengaluru, Karnataka, India | 마케팅 | 2,082 | 상통 | X |
| Samsung Display Noida Private Limited (SDN) | 2019. 07 | B-1, Sector 81, Phase-II, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India | DP 생산 | 597,383 | 상통 | O |
| Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore) | 2005. 05 | Bagmane Tech. Park, Bangalore, Karnataka, India | R&D | 351,226 | 상통 | O |
| Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD) | 2010. 08 | Gualshan-1, Gulshan Ave., Dhaka, Bangladesh | R&D | 16,386 | 상통 | X |
| Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL) | 2017. 11 | Ward No 1, Durbar Marg, Kathmandu Municipality, Kathmandu, Nepal | 서비스 | 506 | 상통 | X |
| Samsung Japan Corporation (SJC) | 1975. 12 | Shinagawa Grand Central Tower, Konan, Minato, Tokyo, Japan | 반도체 · DP 판매 | 1,445,517 | 상통 | O |
| Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ) | 1992. 08 | 2-7, Sugawara-cho, Tsurumi-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan | R&D | 157,868 | 상통 | O |
| Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ) | 2008. 09 | Iidabashi Grand Bloom, 2-10-2, Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan | 전자제품 판매 | 906,235 | 상통 | O |
| Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd. | 2002. 04 | Survey No. 85 & 86, Sadarmangala Village, Krishnarajapuram Hobli, Bangalore, India | Connected Service Provider | 305,295 | 상통 | O |
| Harman International (India) Private Limited | 2009. 01 | Plot No. 9, Phase I, Doddenakkundi Industrial Area, K.R. Puram Hobli, Bangalore, India | 오디오제품 판매, R&D | 370,100 | 상통 | O |
| Harman International Industries PTY Ltd. | 2014. 12 | Warehouse 25 26-18, Roberna St., Moorabbin, Victoria, Australia | 해외회사 관리 | - | 상통 | X |
| Harman International Japan Co., Ltd. | 1991. 06 | 14F Sumitomo Fudosan Akihabara-ekimae, Kanda, Chiyoda, Tokyo, Japan | 오디오제품 판매, R&D | 77,535 | 상통 | O |
| Harman Singapore Pte. Ltd. | 2007. 08 | 108, Pasir Panjang Rd., #02-08 Golden Agri Plaza, Singapore | 오디오제품 판매 | 14,332 | 상통 | X |
| Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC) | 1996. 03 | Fortune Financial Center, No5, Dongsanhuan Zhong Rd., Chaoyang, Beijing, China | 전자제품 판매 | 13,830,988 | 상통 | O |
| Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK) | 1988. 09 | 33F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong | 전자제품 판매 | 1,366,841 | 상통 | O |
| Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET) | 1994. 11 | 10F, No.399, Rui Guang Rd., Nei Hu, Taipei, Taiwan | 전자제품 판매 | 1,364,801 | 상통 | O |
| Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. (TSEC) | 1993. 04 | #12, no 4 Big St., Dong Ting Rd., Teda, Tianjin, China | TV · 모니터 생산 | 392,205 | 상통 | O |
| Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC) | 1995. 04 | No.501, SuHong East Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China | 가전제품 생산 | 668,331 | 상통 | O |
| Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E) | 1995. 04 | No.501, SuHong East Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China | 가전제품 생산 | 504,994 | 상통 | O |

| | | | | | | |
|---|----------|--|-------------------------------|------------|----|---|
| Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC) | 2002. 09 | No.198, Fangzhou Rd., Suzhou Industrial park, Suzhou, China | R&D | 150,161 | 상동 | O |
| Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC) | 2001. 03 | No.9 WeiWu Rd. Micro Electronic Industrial Park, Xiqing, Tianjin, China | 통신제품 생산 | 643,732 | 상동 | O |
| Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing) | 2000. 09 | 12/F Zhongdian fazhan Building, No. 9, xiaguangli, Chaoyang, Beijing, China | R&D | 106,400 | 상동 | O |
| Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing) | 2004. 05 | 8/F, Huijie Plaza, 268 Zhongshan Rd., Nanjing, China | R&D | 25,344 | 상동 | X |
| Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou) | 2010. 01 | A3 Building, No.185 Kexue Ave., Science City, Luogang, Guangzhou, China | R&D | 109,198 | 상동 | O |
| Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen) | 2013. 03 | 22F, Building 2C, Shenzhen Software Industry Base, Nanshan District, Shenzhen, China | R&D | 38,911 | 상동 | X |
| Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS) | 2001. 10 | 3F, No.458, Fute North Rd., Shanghai, China | 반도체 · DP 판매 | 5,067,891 | 상동 | O |
| Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS) | 2012. 09 | No.1999, Xiaohe Rd., Changan, Xian, China | 반도체 생산 | 17,095,000 | 상동 | O |
| Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX) | 2016. 04 | 8F Customs Clearance Center, No.5 Tonghai First Rd., Changan, Xian, China | 반도체 · DP 판매 | 906,967 | 상동 | O |
| Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS) | 1994. 12 | No.15, JinJiHu Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China | 반도체 임가공 | 1,494,205 | 상동 | O |
| Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED) | 2009. 05 | No 1. Weisan Rd., Micro Electronic Industrial Park., Xiqing, Tianjin, China | LED 생산 | 509,355 | 상동 | O |
| Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR) | 2003. 04 | No.15, JinjiHu Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China | R&D | 76,826 | 상동 | O |
| Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD) | 2001. 11 | High Technology Industrial Zone, Houjie, Dongguan, China | DP 생산 | 2,135,132 | 상동 | O |
| Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT) | 2004. 06 | No.25, Mip Fourth Rd., Xiqing, Tianjin, China | DP 생산 | 1,446,605 | 상동 | O |
| SEMES (XIAN) Co., Ltd. | 2013. 07 | #A501, ZTE PLAZA, No.10 Tangyan South Rd., Gaoxin, Xian, China | 반도체 · FPD 장비 서비스 | 3,712 | 상동 | X |
| Samsung Semiconductor Investment L.P. I | 2021. 12 | #409, Building 2, No. 599, Wanzhen Road, ZhenxinXincun St., Jiading Dist., Shanghai, China | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 14,754 | 상동 | X |
| Harman (China) Technologies Co., Ltd. | 2011. 03 | No.68, First Yinquan Rd., Zhengxing, Dandong, China | 오디오제품 생산 | 181,150 | 상동 | O |
| Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd. | 2013. 03 | 20F, Modern Logistics No.88 Modern Ave., Suzhou, China | 오디오제품 판매 | 9,890 | 상동 | X |
| Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd. | 2006. 09 | No.125, Fangzhou Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China | 오디오제품 생산, R&D | 351,647 | 상동 | O |
| Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd. | 2010. 10 | Suite 2903B, Level 29, 288, West Nanjing Rd., Huangpu, Shanghai, China | 오디오제품 판매 | 347 | 상동 | X |
| Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd. | 2007. 08 | 14F, 15F, No 383 Jiaozhi Ave., High-tech, Chengdu, China | Connected Service Provider | 10,427 | 상동 | X |
| Harman Holding Limited | 2007. 05 | Flat/RM A 12F, Kiu Fu Commercial Building, 300 Lockhart Rd., Wan Chai, Hong Kong | 오디오제품 판매 | 765,662 | 상동 | O |

| | | | | | | |
|---|----------|--|-------------------|------------|----|---|
| Harman International (China) Holdings Co., Ltd. | 2009. 06 | 30F, No. 288, Nanjing Road West, Shanghai, China | 오디오제품 판매, R&D | 589,116 | 상통 | O |
| Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | 2004. 09 | 14F, China Merchants Bureau Port Building, Merchants St., Nanshan, Shenzhen, China | 오디오제품 판매, R&D | 48,247 | 상통 | X |
| 삼성디스플레이㈜ | 2012. 04 | 경기도 용인시 기흥구 삼성로 1(농서동) | DP 생산 및 판매 | 57,302,567 | 상통 | O |
| 에스유머티리얼스㈜ | 2011. 08 | 충청남도 아산시 탕정면 탕정로 380-2 | DP 부품 생산 | 36,204 | 상통 | X |
| 스테코㈜ | 1995. 06 | 충청남도 천안시 서북구 3공단1로 20(백석동) | 반도체 부품 생산 | 133,987 | 상통 | O |
| 세메스㈜ | 1993. 01 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 77 | 반도체·FPD 장비 생산, 판매 | 2,065,558 | 상통 | O |
| 삼성전자서비스㈜ | 1998. 10 | 경기도 수원시 영통구 삼성로 290(원천동) | 전자제품 수리 서비스 | 711,020 | 상통 | O |
| 삼성전자서비스씨에스㈜ | 2018. 10 | 경기도 수원시 영통구 종부대로 324(매탄동) | 고객상담서비스 | 15,593 | 상통 | X |
| 삼성전자판매㈜ | 1996. 07 | 경기도 성남시 분당구 백현로101번길 30 | 전자제품 판매 | 1,393,235 | 상통 | O |
| 삼성전자로지텍㈜ | 1998. 04 | 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동) | 종합물류대행 | 415,659 | 상통 | O |
| 삼성메디슨㈜ | 1985. 07 | 강원도 홍천군 남면 한서로 3366 | 의료기기 생산 및 판매 | 528,834 | 상통 | O |
| 주식회사 희망별숲 | 2022. 12 | 경기도 용인시 기흥구 서천로 201번길 14, 프리미엄원희캐슬 2층 | 식품 제조 가공 | 895 | 상통 | X |
| ㈜미레로시스템 | 1994. 01 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120(영덕동) | 반도체 소프트웨어 개발 및 공급 | 39,440 | 상통 | X |
| ㈜도우인시스 | 2010. 03 | 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 605-1(송절동) | DP 부품 생산 | 128,665 | 상통 | O |
| 지에프㈜ | 2015. 10 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 38 | DP 부품 생산 | 7,241 | 상통 | X |
| ㈜하만인터내셔널코리아 | 2005. 01 | 서울특별시 강남구 테헤란로 223(역삼동), 큰길타워 17층 | 소프트웨어 개발 및 공급 | 24,424 | 상통 | X |
| SVIC 21호 신기술투자조합 | 2011. 11 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 82,214 | 상통 | O |
| SVIC 22호 신기술투자조합 | 2011. 11 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 56,370 | 상통 | X |
| SVIC 26호 신기술투자조합 | 2014. 11 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 50,614 | 상통 | X |
| SVIC 28호 신기술투자조합 | 2015. 02 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 370,503 | 상통 | O |
| SVIC 29호 신기술투자조합 | 2015. 04 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 27,519 | 상통 | X |
| SVIC 32호 신기술투자조합 | 2016. 08 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 283,547 | 상통 | O |
| SVIC 33호 신기술투자조합 | 2016. 11 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 334,846 | 상통 | O |
| SVIC 37호 신기술투자조합 | 2017. 11 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 22,549 | 상통 | X |
| SVIC 40호 신기술투자조합 | 2018. 06 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 40,354 | 상통 | X |
| SVIC 42호 신기술투자조합 | 2018. 11 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 35,845 | 상통 | X |
| SVIC 43호 신기술투자조합 | 2018. 12 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 11,034 | 상통 | X |
| SVIC 45호 신기술투자조합 | 2019. 05 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 221,274 | 상통 | O |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|---------------------|---------|----|---|
| SWIC 48호 신기술투자조합 | 2019. 12 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 75,744 | 상통 | ○ |
| SWIC 52호 신기술투자조합 | 2021. 05 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 46,829 | 상통 | X |
| SWIC 55호 신기술투자조합 | 2021. 09 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 136,758 | 상통 | ○ |
| SWIC 56호 신기술투자조합 | 2021. 11 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩 29층 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 31,135 | 상통 | X |
| SWIC 57호 신기술투자조합 | 2022. 08 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성 전자빌딩 29층 | 신기술사업자, 벤 처기업 투자 | 18,681 | 상통 | X |
| SWIC 62호 신기술투자조합 | 2023. 03 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성 전자빌딩 29층 | 신기술사업자, 벤 처기업 투자 | - | 상통 | X |
| 반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁 | 2017. 03 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동), 한국거래소 별관 4층 | 반도체산업 투자 | 69,862 | 상통 | X |
| 시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁 | 2020. 04 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동), 한국거래소 별관 4층 | 반도체산업 투자 | 79,664 | 상통 | ○ |

※ 주요 사업에 대한 상세 내역은 'II.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

※ 주요 종속기업 여부 판단기준은 최근사업연도말 자산총액 750억원 이상입니다.

(종속기업의 변동)

(단위 : 개사)

| 구 분 | 미주 | 유럽 · CIS | 중동· 아프 리카 | 아시아 (중국 제외) | 중국 | 국내 | 합계 | 변 동 내 역 | |
|-------------------|----|----------------|-----------------|-------------------|----|----|-----|--|--|
| | | | | | | | | 증 가 | 감 소 |
| 제52기말 (2020년말) | 55 | 75 | 19 | 30 | 33 | 29 | 241 | - | - |
| 제53기 증감 | △9 | △4 | 1 | - | △3 | 2 | △13 | [중국: 1개사] · Samsung Semiconductor Investment L.P. I [중동·아프리카: 1개사] · Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P) [국내: 3개사] · SVIC 52호 신기술투자조합 · SVIC 55호 신기술투자조합 · SVIC 56호 신기술투자조합 | [미주: 9개사] · Viv Labs, Inc. · Stellus Technologies, Inc. · SigMast Communications Inc. · Prismview, LLC · Zhilabs, Inc. · TWS LATAM B, LLC · TWS LATAM S, LLC · SNB Technologies, Inc. Mexico, S.A. de C.V. RT SV CO-INVEST, LP [유럽·CIS: 4개사] · Arcam Limited · A&R Cambridge Limited · Harman Connected Services Limited · Martin Manufacturing (UK) Ltd. [중국: 4개사] · Samsung Suzhou Module Co., Ltd. (SSM) · Samsung Suzhou LCD Co., Ltd. (SSL) · Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd. (SEHZ) · Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication Co., Ltd.(SSET) [국내: 1개사] · SVIC 27호 신기술투자조합 |
| 제53기 (2021년말) | 46 | 71 | 20 | 30 | 30 | 31 | 228 | - | - |
| 제54기 증감 | △1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 | [유럽·CIS: 4개사] · Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR) · Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ) · Apostera GmbH · Apostera UA, LLC [아시아(중국 제외): 2개사] · DOWOINSYS VINA COMPANY LIMITED · Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd. [국내: 2개사] · SVIC 57호 신기술투자조합 · ㈜희망별숲 | [미주: 1개사] · Dacor Canada Co. [유럽·CIS: 3개사] · AMX UK Limited · Harman International s.r.o · Apostera GmbH |
| 제54기 (2022년말) | 45 | 72 | 20 | 32 | 30 | 33 | 232 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|---|---|
| 제55기 증감 | 1 | △1 | - | - | - | 1 | 1 | [미주: 3개사] · Samsung Federal, Inc. (SFI) · Emerald Intermediate, Inc. · Emerald Merger Sub, Inc. [국내: 1개사] · SVIC 62호 신기술투자조합 | [미주: 2개사] · Dacor Holdings, Inc. · Dacor, Inc. [유럽 · CIS: 1개사] · Red Bend Software Ltd. |
| 제55기 (2023년 반기말) | 46 | 71 | 20 | 32 | 30 | 34 | 233 | | |

2. 계열회사 현황(상세)

가. 국내 계열회사 현황

2023년 반기말 현재 삼성그룹에는 전년말과 동일한 63개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 17개사이며 비상장사는 46개사입니다.

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 사)

| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|------|-----|---------------------|---------------|
| 상장 | 17 | 삼성물산(주) | 1101110015762 |
| | | 삼성바이오로직스(주) | 1201110566317 |
| | | 삼성생명보험(주) | 1101110005953 |
| | | 삼성에스디아이(주) | 1101110394174 |
| | | 삼성에스디에스(주) | 1101110398556 |
| | | 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) | 1101118376893 |
| | | 삼성엔지니어링(주) | 1101110240509 |
| | | 삼성전기(주) | 1301110001626 |
| | | 삼성전자(주) | 1301110006246 |
| | | 삼성중공업(주) | 1101110168595 |
| | | 삼성증권(주) | 1101110335649 |
| | | 삼성카드(주) | 1101110346901 |
| | | 삼성화재해상보험(주) | 1101110005078 |
| | | (주)멀티캠퍼스 | 1101111960792 |
| | | (주)에스원 | 1101110221939 |
| | | (주)제일기획 | 1101110139017 |
| | | (주)호텔신라 | 1101110145519 |
| 비상장 | 46 | 삼성디스플레이(주) | 1345110187812 |
| | | 삼성메디슨(주) | 1346110001036 |
| | | 삼성바이오에피스(주) | 1201110601501 |
| | | 삼성벤처투자(주) | 1101111785538 |
| | | 삼성생명서비스손해사정(주) | 1101111855414 |
| | | 삼성선물(주) | 1101110894520 |
| | | 삼성액티브자산운용(주) | 1101116277382 |
| | | 삼성에스알에이자산운용(주) | 1101115004322 |
| | | 삼성웰스토리(주) | 1101115282077 |
| | | 삼성자산운용(주) | 1701110139833 |
| | | 삼성전자로지텍(주) | 1301110046797 |
| | | 삼성전자서비스(주) | 1301110049139 |
| | | 삼성전자서비스씨에스(주) | 1358110352541 |
| | | 삼성전자판매(주) | 1801110210300 |
| | | 삼성카드고객서비스(주) | 1101115291656 |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| | 삼성코닝어드밴스드글라스(유) | 1648140003466 |
| | 삼성헤지자산운용(주) | 1101116277390 |
| | 삼성화재서비스손해사정(주) | 1101111237703 |
| | 삼성화재애니카손해사정(주) | 1101111595680 |
| | 성균관대학교기술지주(주) | 1358110215426 |
| | 세메스(주) | 1615110011795 |
| | 수원삼성축구단(주) | 1358110160126 |
| | 스테코(주) | 1647110003490 |
| | 신라에이치엠(주) | 1101115433927 |
| | 에스디플렉스(주) | 1760110039005 |
| | 에스비티엠(주) | 1101116536556 |
| | 에스원씨알엠(주) | 1358110190199 |
| | 에스유머티리얼스(주) | 1648110061337 |
| | 에스코어(주) | 1101113681031 |
| | 에스티엠(주) | 2301110176840 |
| | 에이치디씨신라면세점(주) | 1101115722916 |
| | 오픈핸즈(주) | 1311110266146 |
| | 제일패션리테일(주) | 1101114736934 |
| | (주)미라콤아이앤씨 | 1101111617533 |
| | (주)삼성글로벌리서치 | 1101110766670 |
| | (주)삼성라이온즈 | 1701110015786 |
| | (주)삼성생명금융서비스 | 1101115714533 |
| | (주)삼성화재금융서비스보험대리점 | 1101116002424 |
| | (주)삼우종합건축사사무소 | 1101115494151 |
| | (주)서울레이크사이드 | 1101110504070 |
| | (주)시큐아이 | 1101111912503 |
| | (주)씨브이네트 | 1101111931686 |
| | (주)에스에이치피코퍼레이션 | 1101118151310 |
| | (주)하만인터내셔널코리아 | 1101113145673 |
| | (주)휴먼티에스에스 | 1101114272706 |
| | (주)희망별숲 | 1345110611259 |

※ 삼성코닝어드밴스드글라스는 2020년 10월 유한회사에서 주식회사로 변경하였다가, 2021년 2월 주식회사에서 유한회사로 재변경하였습니다.

나. 해외 계열회사 현황

(기준일 : 2023년 6월 30일)

(단위 : 사)

| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 소재국 |
|---|--------|--|----------|
| 비상장 | 566 | SAMOO AUSTIN INC | USA |
| | | SAMOO HU Designer and Engineering Services Limited | Hungary |
| | | SAMOO DESIGNERS & ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED | India |
| | | SAMOO (KL) SDN. BHD. | Malaysia |
| | | SAMOO Design Consulting Co.,Ltd | China |
| | | Samsung Green repower, LLC | USA |
| | | Samsung Solar Construction Inc. | USA |
| | | QSSC, S.A. de C.V. | Mexico |
| | | Samsung Solar Energy LLC | USA |
| | | Equipment Trading Solutions Group, LLC | USA |
| | | SP Armow Wind Ontario LP | Canada |
| | | SRE GRW EPC GP Inc. | Canada |
| | | SRE GRW EPC LP | Canada |
| | | SRE SKW EPC GP Inc. | Canada |
| | | SRE SKW EPC LP | Canada |
| | | SRE WIND PA GP INC. | Canada |
| | | SRE WIND PA LP | Canada |
| | | SRE GRS Holdings GP Inc. | Canada |
| | | SRE GRS Holdings LP | Canada |
| | | SRE K2 EPC GP Inc. | Canada |
| | | SRE K2 EPC LP | Canada |
| | | SRE KS HOLDINGS GP INC. | Canada |
| | | SRE KS HOLDINGS LP | Canada |
| | | SP Belle River Wind LP | Canada |
| | | SRE Armow EPC GP Inc. | Canada |
| | | SRE Armow EPC LP | Canada |
| | | North Kent Wind 1 LP | Canada |
| | | SRE Wind GP Holding Inc. | Canada |
| | | South Kent Wind LP Inc. | Canada |
| | | Grand Renewable Wind LP Inc. | Canada |
| | | SRE North Kent 2 LP Holdings LP | Canada |
| | | SRE Solar Development GP Inc. | Canada |
| SRE Solar Development LP | Canada | | |
| SRE Windsor Holdings GP Inc. | Canada | | |
| SRE Southgate Holdings GP Inc. | Canada | | |
| SRE Solar Construction Management GP Inc. | Canada | | |
| | | | |

| | | |
|--|---|-------------|
| | SRE Solar Construction Management LP | Canada |
| | SRE BRW EPC GP INC. | Canada |
| | SRE BRW EPC LP | Canada |
| | SRE North Kent 1 GP Holdings Inc | Canada |
| | SRE North Kent 2 GP Holdings Inc | Canada |
| | SRE Belle River GP Holdings Inc | Canada |
| | SRE NK1 EPC GP Inc | Canada |
| | SRE NK1 EPC LP | Canada |
| | SRE Summerside Construction GP Inc. | Canada |
| | SRE Summerside Construction LP | Canada |
| | Monument Power, LLC | USA |
| | PLL Holdings LLC | USA |
| | PLL E&P LLC | USA |
| | Parallel Petroleum LLC | USA |
| | Grand Renewable Solar GP Inc. | Canada |
| | KINGSTON SOLAR GP INC. | Canada |
| | SP Armow Wind Ontario GP Inc | Canada |
| | South Kent Wind GP Inc. | Canada |
| | Grand Renewable Wind GP Inc. | Canada |
| | North Kent Wind 1 GP Inc | Canada |
| | SP Belle River Wind GP Inc | Canada |
| | Samsung Solar Energy 1 LLC | USA |
| | Samsung Solar Energy 2 LLC | USA |
| | Samsung Solar Energy 3, LLC | USA |
| | CS SOLAR LLC | USA |
| | 5S ENERGY HOLDINGS, LLC | USA |
| | SungEel Recycling Park Thuringen GmbH | Germany |
| | POSS-SLPC, S.R.O | Slovakia |
| | Solluce Romania 1 B.V. | Romania |
| | S.C. Otelinox S.A | Romania |
| | WARIS GIGIH ENGINEERING AND TECHNOLOGY SDN. BHD. | Malaysia |
| | Samsung Chemtech Vina LLC | Vietnam |
| | Samsung C&T Thailand Co., Ltd | Thailand |
| | Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd | Malaysia |
| | S&G Biofuel PTE.LTD | Singapore |
| | PT. Gandaerah Hendana | Indonesia |
| | PT. Inecda | Indonesia |
| | VISTA CONTRACTING AND DEVELOPMENT BANGLADESH LTD. | Bangladesh |
| | WELVISTA COMPANY LIMITED | Vietnam |
| | SAMSUNG CONST. CO. PHILS. | Philippines |
| | SAMSUNG TRADING (SHANGHAI) CO., LTD | China |
| | | |

| | | |
|--|---|----------------|
| | Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd. | China |
| | Samsung Japan Corporation | Japan |
| | Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. | Japan |
| | Samsung Electronics America, Inc. | USA |
| | Samsung Electronics Canada, Inc. | Canada |
| | Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. | Mexico |
| | Samsung Electronics Ltd. | United Kingdom |
| | Samsung Electronics (UK) Ltd. | United Kingdom |
| | Samsung Electronics Holding GmbH | Germany |
| | Samsung Electronics Iberia, S.A. | Spain |
| | Samsung Electronics France S.A.S | France |
| | Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. | Hungary |
| | Samsung Electronics Italia S.P.A. | Italy |
| | Samsung Electronics Europe Logistics B.V. | Netherlands |
| | Samsung Electronics Benelux B.V. | Netherlands |
| | Samsung Electronics Overseas B.V. | Netherlands |
| | Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o | Poland |
| | Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. | Portugal |
| | Samsung Electronics Nordic Aktiebolag | Sweden |
| | Samsung Electronics Austria GmbH | Austria |
| | Samsung Electronics Slovakia s.r.o | Slovakia |
| | Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. | Netherlands |
| | Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. | Malaysia |
| | Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. | Malaysia |
| | Samsung Vina Electronics Co., Ltd. | Vietnam |
| | Samsung Asia Pte. Ltd. | Singapore |
| | Samsung India Electronics Private Ltd. | India |
| | Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited | India |
| | Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. | Australia |
| | PT Samsung Electronics Indonesia | Indonesia |
| | Thai Samsung Electronics Co., Ltd. | Thailand |
| | Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. | Malaysia |
| | Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. | Hong Kong |
| | Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. | China |
| | Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. | China |
| | Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. | China |
| | Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. | China |
| | Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. | Taiwan |
| | Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. | China |
| | Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. | China |
| | Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. | China |
| | | |

| | | |
|--|--|----------------|
| | Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. | China |
| | Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. | China |
| | Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. | China |
| | Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. | Utd.Arab Emir. |
| | Samsung Electronics Egypt S.A.E | Egypt |
| | Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. | South Africa |
| | Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. | Panama |
| | Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. | Brazil |
| | Samsung Electronics Argentina S.A. | Argentina |
| | Samsung Electronics Chile Limitada | Chile |
| | Samsung Electronics Rus Company LLC | Russian Fed. |
| | Samsung Electronics Rus Kaluga LLC | Russian Fed. |
| | Tianjin Samsung LED Co., Ltd. | China |
| | Samsung Biologics America, Inc. | USA |
| | Samsung Bioepis United States Inc. | USA |
| | SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED | United Kingdom |
| | Samsung Bioepis NL B.V. | Netherlands |
| | Samsung Bioepis CH GmbH | Switzerland |
| | Samsung Bioepis PL Sp z o.o. | Poland |
| | SAMSUNG BIOEPIS AU PTY LTD | Australia |
| | SAMSUNG BIOEPIS NZ LIMITED | New Zealand |
| | Samsung Bioepis TW Limited | Taiwan |
| | Samsung Bioepis HK Limited | Hong Kong |
| | SAMSUNG BIOEPIS IL LTD | Israel |
| | SAMSUNG BIOEPIS BR PHARMACEUTICAL LTDA | Brazil |
| | Intellectual Keystone Technology LLC | USA |
| | Emerald | USA |
| | Samsung Display Slovakia, s.r.o., v likvidacii | Slovakia |
| | Samsung Display Vietnam Co., Ltd. | Vietnam |
| | Samsung Display Noida Private Limited | India |
| | Samsung Display Dongguan Co., Ltd. | China |
| | Samsung Display Tianjin Co., Ltd. | China |
| | Novald GmbH | Germany |
| | SEMES America, Inc. | USA |
| | SEMES (XIAN) Co., Ltd. | China |
| | NeuroLogica Corp. | USA |
| | Samsung HVAC America, LLC | USA |
| | SmartThings, Inc. | USA |
| | Samsung Oak Holdings, Inc. | USA |
| | Joyent, Inc. | USA |
| | TeleWorld Solutions, Inc. | USA |
| | | |

| | | |
|--|---|----------------|
| | Samsung Semiconductor, Inc. | USA |
| | Samsung Research America, Inc | USA |
| | Samsung Electronics Home Appliances America, LLC | USA |
| | Samsung International, Inc. | USA |
| | Harman International Industries, Inc. | USA |
| | Samsung Federal, Inc. | USA |
| | Samsung Austin Semiconductor LLC. | USA |
| | AdGear Technologies Inc. | Canada |
| | SAMSUNG NEXT LLC | USA |
| | SAMSUNG NEXT FUND LLC | USA |
| | Samsung Mexicana S.A. de C.V | Mexico |
| | Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV | Mexico |
| | Emerald Merger Sub, Inc. | USA |
| | Harman International Japan Co., Ltd. | Japan |
| | Harman International Industries Canada Ltd. | Canada |
| | Harman Becker Automotive Systems, Inc. | USA |
| | Harman Professional, Inc. | USA |
| | Harman Connected Services, Inc. | USA |
| | Harman Financial Group LLC | USA |
| | Harman Belgium SA | Belgium |
| | Harman France SNC | France |
| | Red Bend Software SAS | France |
| | Harman Inc. & Co. KG | Germany |
| | Harman KG Holding, LLC | USA |
| | Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L. | Italy |
| | Harman Finance International, SCA | Luxembourg |
| | Harman Finance International GP S.a.r.l | Luxembourg |
| | Harman Industries Holdings Mauritius Ltd. | Mauritius |
| | Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V. | Mexico |
| | Harman International Estonia OU | Estonia |
| | Harman Singapore Pte. Ltd. | Singapore |
| | Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda. | Brazil |
| | Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda. | Brazil |
| | Harman Connected Services Engineering Corp. | USA |
| | Harman Connected Services AB. | Sweden |
| | Harman Connected Services UK Ltd. | United Kingdom |
| | Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd. | India |
| | Global Symphony Technology Group Private Ltd. | Mauritius |
| | Harman International (India) Private Limited | India |
| | Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V. | Mexico |
| | Samsung Semiconductor Europe Limited | United Kingdom |
| | | |

| | | |
|--|--|----------------|
| | Samsung Semiconductor Europe GmbH | Germany |
| | Samsung Electronics GmbH | Germany |
| | Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. | Czech Republic |
| | SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA | Latvia |
| | Samsung Electronics West Africa Ltd. | Nigeria |
| | Samsung Electronics East Africa Ltd. | Kenya |
| | Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. | Saudi Arabia |
| | Samsung Electronics Israel Ltd. | Israel |
| | Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L | Tunisia |
| | Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. | Pakistan |
| | Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. | South Africa |
| | Samsung Electronics Turkiye | Turkiye |
| | Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. | Turkiye |
| | Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. | Israel |
| | Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. | Jordan |
| | Samsung Electronics Maghreb Arab | Morocco |
| | Samsung Electronics Venezuela, C.A. | Venezuela |
| | Samsung Electronics Peru S.A.C. | Peru |
| | Samsung Electronics Ukraine Company LLC | Ukraine |
| | Samsung R&D Institute Ukraine | Ukraine |
| | Samsung R&D Institute Rus LLC | Russian Fed. |
| | Samsung Electronics Central Eurasia LLP | Kazakhstan |
| | Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd | Azerbaijan |
| | Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. | Uzbekistan |
| | Corephotonics Ltd. | Israel |
| | Samsung Nanoradio Design Center | Sweden |
| | Harman Professional Denmark ApS | Denmark |
| | Studer Professional Audio GmbH | Switzerland |
| | Martin Professional Japan Ltd. | Japan |
| | Harman International Romania SRL | Romania |
| | Apostera UA, LLC | Ukraine |
| | Harman Becker Automotive Systems GmbH | Germany |
| | Harman Deutschland GmbH | Germany |
| | Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft | Hungary |
| | Harman RUS CIS LLC | Russian Fed. |
| | Harman Holding GmbH & Co. KG | Germany |
| | Harman Management GmbH | Germany |
| | Harman Hungary Financing Ltd. | Hungary |
| | Harman Connected Services OOO | Russian Fed. |
| | Harman Professional Kft | Hungary |
| | Harman Consumer Nederland B.V. | Netherlands |
| | | |

| | | |
|--|--|----------------|
| | Red Bend Ltd. | Israel |
| | Harman International Industries Limited | United Kingdom |
| | AKG Acoustics Gmbh | Austria |
| | Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada | Spain |
| | Harman Holding Limited | Hong Kong |
| | Harman Finland Oy | Finland |
| | Harman Connected Services GmbH | Germany |
| | Harman Connected Services Poland Sp.zoo | Poland |
| | Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd. | China |
| | Harman Automotive UK Limited | United Kingdom |
| | Harman International Industries PTY Ltd. | Australia |
| | Harman Connected Services Morocco | Morocco |
| | Samsung Electronics Switzerland GmbH | Switzerland |
| | Samsung Electronics Romania LLC | Romania |
| | SAMSUNG Zhilabs, S.L. | Spain |
| | Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l. | Italy |
| | Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o | Poland |
| | Samsung Electronics Greece S.M.S.A | Greece |
| | Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. | Netherlands |
| | FOODIENT LTD. | United Kingdom |
| | Samsung Denmark Research Center ApS | Denmark |
| | Samsung Cambridge Solution Centre Limited | United Kingdom |
| | iMarket Asia Co., Ltd. | Hong Kong |
| | Samsung Electronics Japan Co., Ltd. | Japan |
| | Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. | Singapore |
| | Samsung Electronics New Zealand Limited | New Zealand |
| | Samsung Electronics Philippines Corporation | Philippines |
| | Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited | Bangladesh |
| | Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. | Vietnam |
| | Samsung Electronics Vietnam THANGUYEN Co., Ltd. | Vietnam |
| | Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. | Vietnam |
| | Samsung Nepal Services Pvt, Ltd | Nepal |
| | Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd. | India |
| | PT Samsung Telecommunications Indonesia | Indonesia |
| | Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd | Laos |
| | Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. | China |
| | Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou | China |
| | Samsung R&D Institute China-Shenzhen | China |
| | Beijing Samsung Telecom R&D Center | China |
| | Samsung Electronics China R&D Center | China |
| | Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd. | China |
| | | |

| | | |
|--|--|----------------|
| | Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | China |
| | Harman (China) Technologies Co., Ltd. | China |
| | Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd. | China |
| | Harman International (China) Holdings Co., Ltd. | China |
| | Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd. | China |
| | Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. | USA |
| | Samsung Electronica Colombia S.A. | Colombia |
| | Samsung Electronics Panama. S.A. | Panama |
| | Samsung SDI Japan Co., Ltd. | Japan |
| | Samsung SDI America, Inc. | USA |
| | Samsung SDI Hungary., Zrt. | Hungary |
| | Samsung SDI Europe GmbH | Germany |
| | Samsung SDI Battery Systems GmbH | Austria |
| | Samsung SDI Vietnam Co., Ltd. | Vietnam |
| | Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd. | Malaysia |
| | Samsung SDI India Private Limited | India |
| | Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. | Hong Kong |
| | Samsung SDI China Co., Ltd. | China |
| | Samsung SDI-ARN (Xi'An) Power Battery Co., Ltd. | China |
| | Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd. | China |
| | STARPLUS ENERGY LLC. | USA |
| | SAMSUNG SDI WUXI CO.,LTD. | China |
| | Tianjin Samsung SDI Co., Ltd. | China |
| | Samsung Electro-Mechanics Japan Co., Ltd. | Japan |
| | Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | USA |
| | Samsung Electro-Mechanics GmbH | Germany |
| | Samsung Electro-Mechanics Philippines, Corp. | Philippines |
| | Calamba Premier Realty Corporation | Philippines |
| | Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd. | Singapore |
| | Samsung Electro-Mechanics Vietnam Co., Ltd. | Vietnam |
| | Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited | India |
| | Dongguan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | China |
| | Tianjin Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | China |
| | Samsung High-Tech Electro-Mechanics(Tianjin) Co., Ltd. | China |
| | Samsung Electro-Mechanics (Shenzhen) Co., Ltd. | China |
| | Kunshan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | China |
| | Batino Realty Corporation | Philippines |
| | Samsung Fire & Marine Management Corporation | USA |
| | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD. | United Kingdom |
| | PT. Asuransi Samsung Tugu | Indonesia |

| | | |
|--|--|----------------|
| | SAMSUNG VINA INSURANCE COMPANY LIMITED | Vietnam |
| | Samsung Reinsurance Pte. Ltd. | Singapore |
| | 삼성재산보험 (중국) 유한공사 | China |
| | Samsung Fire & Marine Insurance Management Middle East Limited | Utd.Arab Emir. |
| | Camellia Consulting Corporation | USA |
| | Samsung Heavy Industries India Pvt.Ltd. | India |
| | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (M) SDN.BHD | Malaysia |
| | 삼성중공업(영성)유한공사 | China |
| | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED | Nigeria |
| | Samsung Heavy Industries Mozambique LDA | Mozambique |
| | Samsung Heavy Industries Rus LLC | Russian Fed. |
| | SHI – MCI FZE | Nigeria |
| | Samsung Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd | Thailand |
| | Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd | China |
| | Samsung Asset Management (New York), Inc. | USA |
| | Samsung Global SME Private Equity Manager Fund Co., Ltd. | Cayman Islands |
| | Samsung Asset Management U.S. Holdings, Inc. | USA |
| | Samsung Private Equity Fund 2022 GP, Ltd. | Cayman Islands |
| | Samsung Co-Investment 2021 GP, Ltd. | Cayman Islands |
| | Samsung Asset Management(London) Ltd. | United Kingdom |
| | Samsung Private Equity Manager I Co., Ltd. | Cayman Islands |
| | Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd. | Hong Kong |
| | Samsung Asset Management (Beijing) Ltd. | China |
| | Samsung C&T Japan Corporation | Japan |
| | Samsung C&T America Inc. | USA |
| | Samsung E&C America, INC. | USA |
| | Samsung Renewable Energy Inc. | Canada |
| | Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp. | USA |
| | Samsung C&T Lima S.A.C. | Peru |
| | Samsung C&T Deutschland GmbH | Germany |
| | Samsung C&T U.K. Ltd. | United Kingdom |
| | Samsung C&T ECUK Limited | United Kingdom |
| | Whesoe engineering Limited | United Kingdom |
| | SAM investment Manzanilo.B.V | Netherlands |
| | Samsung C&T (KL) Sdn.,Bhd. | Malaysia |
| | Samsung C&T Malaysia SDN. BHD | Malaysia |
| | Erdsam Co., Ltd. | Hong Kong |
| | Samsung C&T India Private Limited | India |
| | Samsung C&T Corporation India Private Limited | India |
| | Samsung C&T Singapore Pte., Ltd. | Singapore |
| | | |

| | | |
|--|---|----------------|
| | SAMSUNG C&T Mongolia LLC. | Mongolia |
| | Samsung C&T Eng.&Const. Mongolia LLC. | Mongolia |
| | S&WOO CONSTRUCTION PHILIPPINES,INC. | Philippines |
| | VSSC STEEL CENTER LIMITED LIABILITY COMPANY | Vietnam |
| | Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd. | Singapore |
| | CHEIL HOLDING INC. | Philippines |
| | Samsung C&T Renewable Energy Australia Pty Ltd | Australia |
| | Samsung C&T Hongkong Ltd. | Hong Kong |
| | Samsung C&T Taiwan Co., Ltd. | Taiwan |
| | SAMSUNG C&T (SHANGHAI) CO., LTD. | China |
| | Samsung C&T (Xi'an) Co., Ltd. | China |
| | SAMSUNG C&T CORPORATION SAUDI ARABIA | Saudi Arabia |
| | SAM Gulf Investment Limited | Utd.Arab Emir. |
| | Samsung C&T Chile Copper SpA | Chile |
| | SCNT Power Kelar Inversiones Limitada | Chile |
| | Samsung C&T Corporation Rus LLC | Russian Fed. |
| | CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL | Italy |
| | Samsung Fashion Trading Co. ,Ltd | China |
| | SAMSUNG C&T CORPORATION VIETNAM CO., LTD | Vietnam |
| | Samsung C&T Corporation UEM Construction JV Sdn Bhd | Malaysia |
| | WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED | Vietnam |
| | Shanghai Ever-Hongjun Business Mgt Service Co.,LTD | China |
| | Shanghai Welstory Food Company Limited | China |
| | LANGUAGE TESTING INTERNATIONAL, INC. | USA |
| | PENGTAI CHINA CO.,LTD. | China |
| | PengTai Taiwan Co., Ltd. | Taiwan |
| | PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD | China |
| | PENGTAI MARKETING SERVICE CO.,LTD. | China |
| | Medialytics Inc. | China |
| | Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd. | China |
| | iMarket China Co., Ltd. | China |
| | Samsung Securities (America), Inc. | USA |
| | Samsung Securities (Europe) Limited. | United Kingdom |
| | Samsung Securities (Asia) Limited. | Hong Kong |
| | Samsung SDS America, Inc. | USA |
| | SAMSUNG SDS GSCL Canada., Ltd. | Canada |
| | Samsung SDS Europe, Ltd. | United Kingdom |
| | Samsung SDS Global SCL Hungary, Kft. | Hungary |
| | Samsung SDS Global SCL Slovakia, S.R.O. | Slovakia |
| | Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o. | Poland |
| | Samsung GSCL Sweden AB | Sweden |
| | | |

| | | |
|--|---|----------------|
| | Samsung SDS Global SCL France SAS | France |
| | Samsung SDS Global SCL Italy S.R.L. A Socio Unico | Italy |
| | Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Spain S.L.U | Spain |
| | Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A. | Netherlands |
| | Samsung SDS Global SCL Germany GmbH | Germany |
| | Samsung SDS Global SCL Romania S.R.L | Romania |
| | Samsung SDS Asia Pacific Pte, Ltd. | Singapore |
| | Samsung Data Systems India Private Limited | India |
| | Samsung SDS Vietnam Co., Ltd. | Vietnam |
| | PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia | Indonesia |
| | Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd.Inc. | Philippines |
| | Samsung SDS Global SCL Thailand Co.,Ltd | Thailand |
| | Samsung SDS Global SCL Malaysia SDN.BHD. | Malaysia |
| | SAMSUNG SDS Global SCL Australia Pty.,Ltd. | Australia |
| | SDS-ACUTECH CO., Ltd. | Thailand |
| | ALS SDS Joint Stock Company | Vietnam |
| | SDS-MP Logistics Joint Stock Company | Vietnam |
| | Samsung SDS China Co., Ltd. | China |
| | Samsung SDS Global SCL Hong Kong Co., Ltd. | Hong Kong |
| | SAMSUNG SDS Global SCL Egypt | Egypt |
| | Samsung SDS Global SCL South Africa (PTY) Ltd. | South Africa |
| | Samsung SDS Global SCL Nakliyat ve Lojistik Anonim Sirketi | Turkiye |
| | Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Middle East DWC-LLC | Utd.Arab Emir. |
| | Samsung SDS Latin America Tecnologia E Logistica LTDA. | Brazil |
| | INTE-SDS Logistics S.A. de C.V. | Mexico |
| | Samsung SDS Rus Limited Liability Company | Russian Fed. |
| | Samsung SDS Mexico, S.A. DE C.V. | Mexico |
| | Samsung SDS Global SCL Panama S.A. | Panama |
| | Samsung SDS Global SCL Chile Limitada | Chile |
| | Samsung SDS Global SCL Peru S.A.C | Peru |
| | Samsung SDS Global SCL Colombia S.A.S | Colombia |
| | Samsung Engineering America Inc. | USA |
| | Samsung Project Management Inc. | Canada |
| | Samsung Engineering Hungary Ltd. | Hungary |
| | Samsung Engineering Italy S.R.L. | Italy |
| | Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD. | Malaysia |
| | PT Samsung Engineering Indonesia Co., Ltd. | Indonesia |
| | Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd. | Thailand |
| | Samsung Engineering India Private Limited | India |
| | Samsung Engineering Vietnam Co., Ltd. | Vietnam |
| | | |

| | | |
|--|---|-----------------|
| | Samsung Engineering Global Private Limited | India |
| | Samsung Engineering Construction(Shanghai) Co., Ltd | China |
| | Samsung Engineering Construction Xi' an Co., Ltd. | China |
| | Samsung Saudi Arabia Co., Ltd. | Saudi Arabia |
| | Muharrag Wastewater Services Company W.L.L. | Bahrain |
| | Muharrag STP Company B.S.C. | Bahrain |
| | Muharrag Holding Company 1 Ltd. | Utd.Arab Emir. |
| | Samsung Ingenieria Mexico Construccion Y Operacion S.A. De C.V. | Mexico |
| | Samsung Engineering Trinidad Co., Ltd. | Trinidad,Tobago |
| | Samsung Ingenieria Manzanillo, S.A. De C.V. | Mexico |
| | Grupo Samsung Ingenieria Mexico, S.A. De C.V. | Mexico |
| | Samsung Ingenieria Energia S.A. De C.V. | Mexico |
| | Samsung Engineering Bolivia S.A | Bolivia |
| | Samsung Ingenieria DUBA S.A. de C.V. | Mexico |
| | Samsung Engineering Kazakhstan L.L.P. | Kazakhstan |
| | SEA Construction, LLC | USA |
| | SEA Louisiana Construction, L.L.C. | USA |
| | Samsung EPC Company Ltd. | Saudi Arabia |
| | Muharrag Holding Company 2 Ltd. | Utd.Arab Emir. |
| | Asociados Constructores DBNR, S.A. de C.V. | Mexico |
| | S-1 CORPORATION HUNGARY LLC | Hungary |
| | S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD | Vietnam |
| | Samsung Beijing Security Systems | China |
| | Pengtai Greater China Company Limited | Hong Kong |
| | PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD | China |
| | Cheil USA Inc. | USA |
| | Cheil Central America Inc. | USA |
| | Iris Worldwide Holdings Limited | United Kingdom |
| | CHEIL EUROPE LIMITED | United Kingdom |
| | Cheil Germany GmbH | Germany |
| | Cheil France SAS | France |
| | CHEIL SPAIN S.L | Spain |
| | Cheil Benelux B.V. | Netherlands |
| | Cheil Nordic AB | Sweden |
| | Cheil India Private Limited | India |
| | Cheil (Thailand) Ltd. | Thailand |
| | Cheil Singapore Pte. Ltd. | Singapore |
| | CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED | Vietnam |
| | Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc. | Philippines |
| | CHEIL MALAYSIA SDN. BHD. | Malaysia |
| | | |

| | | |
|--|---|----------------|
| | Cheil New Zealand Limited | New Zealand |
| | Cheil Worldwide Australia Pty Ltd | Australia |
| | CHEIL CHINA | China |
| | Cheil Hong Kong Ltd. | Hong Kong |
| | Caishu (Shanghai) Business Consulting Co., Ltd | China |
| | Cheil MEA FZ-LLC | Utd.Arab Emir. |
| | Cheil South Africa (Pty) Ltd | South Africa |
| | CHEIL KENYA LIMITED | Kenya |
| | Cheil Communications Nigeria Ltd. | Nigeria |
| | Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC. | Jordan |
| | Cheil Ghana Limited | Ghana |
| | Cheil Egypt LLC | Egypt |
| | Cheil Maghreb LLC | Morocco |
| | Cheil Brasil Comunicacoes Ltda. | Brazil |
| | Cheil Mexico, S.A. de C.V. | Mexico |
| | Cheil Chile SpA. | Chile |
| | Cheil Peru S.A.C. | Peru |
| | CHEIL ARGENTINA S.A. | Argentina |
| | Cheil Rus LLC | Russian Fed. |
| | Cheil Ukraine LLC | Ukraine |
| | Cheil Kazakhstan LLC | Kazakhstan |
| | Samsung Hospitality America Inc. | USA |
| | Shilla Travel Retail Pte. Ltd. | Singapore |
| | Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd. | China |
| | Shilla Travel Retail Hong Kong Limited | Hong Kong |
| | HDC SHILLA (SHANGHAI) CO., LTD | China |
| | Samsung Hospitality U.K. Ltd. | United Kingdom |
| | Samsung Hospitality Europe GmbH | Germany |
| | SAMSUNG HOSPITALITY ROMANIA SRL | Romania |
| | Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd. | Vietnam |
| | Samsung Hospitality Philippines Inc. | Philippines |
| | Samsung Hospitality India Private Limited | India |
| | Samsung Venture Investment (Shanghai) Co., Ltd. | China |
| | Iris (USA) Inc. | USA |
| | Iris Atlanta, Inc. | USA |
| | 89 Degrees, Inc. | USA |
| | The Barbarian Group LLC | USA |
| | McKinney Ventures LLC | USA |
| | Iris Nation Worldwide Limited | United Kingdom |
| | Iris Americas, Inc. | USA |
| | Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V. | Mexico |
| | | |

| | | |
|--|---|-----------------|
| | Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V. | Mexico |
| | Pricing Solutions Ltd | Canada |
| | Iris London Limited | United Kingdom |
| | Iris Promotional Marketing Ltd | United Kingdom |
| | Iris Ventures 1 Limited | United Kingdom |
| | Founded Partners Limited | United Kingdom |
| | Iris Digital Limited | United Kingdom |
| | Iris Amsterdam B.V. | Netherlands |
| | Iris Ventures (Worldwide) Limited | United Kingdom |
| | Concise Consultants Limited | United Kingdom |
| | WDMP Limited | United Kingdom |
| | Iris Services Limited Dooel Skopje | Macedonia |
| | Irisnation Singapore Pte. Ltd. | Singapore |
| | Iris Worldwide Integrated Marketing Private Limited | India |
| | Iris Sydney PTY Ltd | Australia |
| | Iris Worldwide (Thailand) Limited | Thailand |
| | Iris Partners LLP | United Kingdom |
| | Holdings BR185 Limited | Brit.Virgin Is. |
| | Iris Germany GmbH | Germany |
| | Founded, Inc. | USA |
| | Pepper NA, Inc. | USA |
| | Beattie McGuinness Bungay Limited | United Kingdom |
| | Cheil Italia S.r.l | Italy |
| | Cheil Austria GmbH | Austria |
| | Centrade Integrated SRL | Romania |
| | Centrade Cheil HU Kft. | Hungary |
| | Centrade Cheil Adriatic D.O.O. | Serbia/Monten. |
| | Experience Commerce Software Private Limited | India |
| | PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA | Indonesia |
| | Cheil Philippines Inc. | Philippines |
| | Shilla Retail Plus Pte. Ltd. | Singapore |
| | Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd | China |
| | Shilla Retail Limited | Macau |
| | BNY Trading Hong Kong Limited | Hong Kong |
| | One Agency FZ-LLC | Utd.Arab Emir. |
| | One RX Project Management Design and Production Limited Company | Turkiye |
| | Iris Korea Limited | United Kingdom |
| | One RX India Private Limited | India |
| | ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C | Utd.Arab Emir. |
| | ONE AGENCY PRINTING L.L.C | Utd.Arab Emir. |
| | | |

| | | | |
|--|--|-------------------------------|--------|
| | | Brazil 185 Participacoes Ltda | Brazil |
| | | Iris Router Marketing Ltda | Brazil |

3. 타법인출자 현황(상세)

2023년 반기말 현재 당사 타법인 출자 금액은 장부금액 기준 59조 901억원이며, 경영참여 등 목적으로 출자하였습니다.

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2023년 06월 30일)

(단위 : 백만원, 천주, %)

| 법인명 | 상장 여부 | 최초취득일자 | 출자 목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도 재무현황 | |
|-----------------------------|-------|------------|-------|------------|-----------|-------|------------|--------|---------|---------|-----------|-------|------------|-------------|-----------|
| | | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 |
| | | | | | | | | 수량 | 금액 | | | | | | |
| 삼성전기주 | 상장 | 1977.01.01 | 경영참여 | 250 | 17,693 | 23.7 | 445,244 | - | - | - | 17,693 | 23.7 | 445,244 | 10,997,171 | 993,519 |
| 삼성SDI주 | 상장 | 1977.01.01 | 경영참여 | 304 | 13,463 | 19.6 | 1,242,605 | - | - | - | 13,463 | 19.6 | 1,242,605 | 30,257,525 | 2,039,361 |
| 삼성중공업주 | 상장 | 1977.09.01 | 경영참여 | 125 | 134,027 | 15.2 | 684,879 | - | - | 209,083 | 134,027 | 15.2 | 893,962 | 14,491,679 | -627,412 |
| ㈜호텔신라 | 상장 | 1979.12.01 | 경영참여 | 252 | 2,005 | 5.1 | 166,592 | - | - | -19,446 | 2,005 | 5.1 | 147,146 | 2,938,545 | -50,164 |
| ㈜재일기획 | 상장 | 1988.09.01 | 경영참여 | 185 | 29,038 | 25.2 | 491,599 | - | - | - | 29,038 | 25.2 | 491,599 | 2,751,445 | 195,834 |
| 삼성에스디에스주 | 상장 | 1992.07.01 | 경영참여 | 6,160 | 17,472 | 22.6 | 560,827 | - | - | - | 17,472 | 22.6 | 560,827 | 11,952,425 | 1,130,013 |
| 삼성바이오로직스주 | 상장 | 2011.04.21 | 경영참여 | 30,000 | 22,217 | 31.2 | 1,595,892 | - | - | - | 22,217 | 31.2 | 1,595,892 | 16,582,050 | 798,056 |
| 삼성디스플레이주 | 비상장 | 2012.04.01 | 경영참여 | 16,009,547 | 221,969 | 84.8 | 18,509,307 | - | - | - | 221,969 | 84.8 | 18,509,307 | 59,206,888 | 2,404,779 |
| 스태코주 | 비상장 | 1995.06.29 | 경영참여 | 24,000 | 2,590 | 70.0 | 35,861 | - | - | - | 2,590 | 70.0 | 35,861 | 127,863 | -798 |
| 세메스주 | 비상장 | 1992.12.31 | 경영참여 | 1,000 | 2,173 | 91.5 | 71,906 | - | - | - | 2,173 | 91.5 | 71,906 | 2,068,180 | 185,838 |
| 삼성전자서비스주 | 비상장 | 1998.01.01 | 경영참여 | 30,000 | 6,000 | 99.3 | 48,121 | - | - | - | 6,000 | 99.3 | 48,121 | 831,245 | 11,319 |
| 삼성전자판매주 | 비상장 | 2000.12.21 | 경영참여 | 3,100 | 1,767 | 100.0 | 247,523 | - | - | - | 1,767 | 100.0 | 247,523 | 1,379,276 | -15,688 |
| 삼성전자로지텍주 | 비상장 | 1999.04.01 | 경영참여 | 76 | 1,011 | 100.0 | 46,669 | - | - | - | 1,011 | 100.0 | 46,669 | 423,508 | 9,722 |
| 삼성메디슨주 | 비상장 | 2011.02.16 | 경영참여 | 286,384 | 87,350 | 68.5 | 433,026 | - | - | - | 87,350 | 68.5 | 433,026 | 599,406 | 43,365 |
| ㈜삼성글로벌리서치 | 비상장 | 1991.05.01 | 경영참여 | 320 | 3,576 | 29.8 | 24,942 | - | - | - | 3,576 | 29.8 | 24,942 | 179,120 | 287 |
| 삼성벤처투자주 | 비상장 | 1999.11.01 | 경영참여 | 4,900 | 980 | 16.3 | 32,073 | - | - | 163 | 980 | 16.3 | 32,236 | 204,289 | 11,683 |
| SVIC 21호 신기술투자조합 | 비상장 | 2011.11.02 | 경영참여 | 19,800 | 0 | 99.0 | 970 | - | - | - | 0 | 99.0 | 970 | 96,117 | 4,016 |
| SVIC 22호 신기술투자조합 | 비상장 | 2011.11.02 | 경영참여 | 19,800 | 0 | 99.0 | 49,520 | -0 | -34,650 | - | 0 | 99.0 | 14,870 | 54,415 | -14,289 |
| SVIC 26호 신기술투자조합 | 비상장 | 2014.11.07 | 경영참여 | 19,800 | 1 | 99.0 | 75,653 | -0 | -14,850 | - | 1 | 99.0 | 60,803 | 45,827 | -4,049 |
| SVIC 28호 신기술투자조합 | 비상장 | 2015.02.13 | 경영참여 | 7,425 | 0 | 99.0 | 35,486 | 0 | - | - | 0 | 99.0 | 35,486 | 395,545 | -19,969 |
| SVIC 32호 신기술투자조합 | 비상장 | 2016.08.09 | 경영참여 | 19,800 | 1 | 99.0 | 143,421 | -0 | -24,057 | - | 1 | 99.0 | 119,364 | 283,767 | 3,175 |
| SVIC 33호 신기술투자조합 | 비상장 | 2016.11.11 | 경영참여 | 4,950 | 1 | 99.0 | 122,622 | - | - | - | 1 | 99.0 | 122,622 | 334,846 | 9,875 |
| SVIC 42호 신기술투자조합 | 비상장 | 2018.11.30 | 경영참여 | 4,950 | 0 | 99.0 | 43,477 | 0 | 479 | - | 0 | 99.0 | 43,956 | 35,845 | -1,443 |
| SVIC 45호 신기술투자조합 | 비상장 | 2019.05.10 | 경영참여 | 19,800 | 2 | 99.0 | 191,323 | 0 | -32,577 | - | 2 | 99.0 | 158,746 | 221,522 | -3,064 |
| SVIC 52호 신기술투자조합 | 비상장 | 2021.05.17 | 경영참여 | 9,900 | 0 | 99.0 | 49,599 | - | - | - | 0 | 99.0 | 49,599 | 46,829 | -147 |
| SVIC 56호 신기술투자조합 | 비상장 | 2021.11.12 | 경영참여 | 22,084 | 0 | 99.0 | 32,380 | - | - | - | 0 | 99.0 | 32,380 | 31,984 | 651 |
| SVIC 57호 신기술투자조합 | 비상장 | 2022.08.10 | 경영참여 | 14,850 | 0 | 99.0 | 18,860 | 0 | 8,969 | - | 0 | 99.0 | 27,829 | 18,681 | -320 |
| 반도체성장 전문투자형 시 모 투자신탁 | 비상장 | 2017.03.03 | 경영참여 | 500 | 50,000.00 | 66.7 | 50,000 | - | - | - | 50,000.00 | 66.7 | 50,000 | 73,879 | 4,398 |
| 시스템반도체 상생 전문투 자형 시모 투자신탁 | 비상장 | 2020.04.27 | 경영참여 | 25,000 | 50,000.00 | 62.5 | 50,000 | - | - | - | 50,000.00 | 62.5 | 50,000 | 79,351 | 20 |
| ㈜희망별숲 | 비상장 | 2022.12.26 | 경영참여 | 900 | 180 | 100.0 | 900 | - | - | - | 180 | 100.0 | 900 | 895 | -5 |
| ㈜이마켓코리아 | 상장 | 2000.12.07 | 경영참여 | 1,900 | 647 | 1.9 | 6,538 | - | - | -136 | 647 | 1.9 | 6,402 | 1,224,955 | 29,103 |
| ㈜케이티스카이라이프 | 상장 | 2001.12.01 | 단순투자 | 3,344 | 240 | 0.5 | 1,954 | - | - | -413 | 240 | 0.5 | 1,541 | 1,361,298 | 23,086 |
| ㈜용평리조트 | 상장 | 2007.05.11 | 단순투자 | 1,869 | 400 | 0.8 | 1,412 | - | - | -184 | 400 | 0.8 | 1,228 | 868,286 | -12,121 |
| 에이테크솔루션주 | 상장 | 2009.11.26 | 단순투자 | 26,348 | 1,592 | 15.9 | 12,879 | - | - | 6,575 | 1,592 | 15.9 | 19,454 | 242,734 | 4,716 |
| ㈜원익홀딩스 | 상장 | 2013.12.18 | 경영참여 | 15,411 | 1,759 | 2.3 | 5,972 | - | - | 704 | 1,759 | 2.3 | 6,676 | 1,815,526 | 128,759 |
| ㈜원익아이피에스 | 상장 | 2016.04.01 | 경영참여 | 16,214 | 1,851 | 3.8 | 45,811 | - | - | 14,900 | 1,851 | 3.8 | 60,711 | 1,121,671 | 89,438 |
| ㈜동진세이빙 | 상장 | 2017.11.01 | 경영참여 | 48,277 | 2,468 | 4.8 | 73,913 | - | - | 29,985 | 2,468 | 4.8 | 103,898 | 1,374,304 | 156,195 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------------|------|--------|------------|-------|------------|-----|------|--------|------------|-------|------------|------------|----------|
| 솔브레인홀딩스㈜ | 상장 | 2017.11.01 | 경영참여 | 30,752 | 462 | 2.2 | 10,989 | - | - | 1,870 | 462 | 2.2 | 12,859 | 1,689,281 | 59,539 |
| 솔브레인㈜ | 상장 | 2020.07.01 | 경영참여 | 24,866 | 373 | 4.8 | 81,357 | - | - | 12,358 | 373 | 4.8 | 93,715 | 934,907 | 167,673 |
| ㈜에스앤에스텍 | 상장 | 2020.08.14 | 경영참여 | 65,933 | 1,716 | 8.0 | 45,220 | - | - | 49,853 | 1,716 | 8.0 | 95,073 | 226,750 | 17,464 |
| 와이어이케이㈜ | 상장 | 2020.08.14 | 경영참여 | 47,336 | 9,602 | 11.7 | 26,933 | - | - | 15,795 | 9,602 | 11.7 | 42,727 | 519,098 | 34,351 |
| ㈜케이씨텍 | 상장 | 2020.11.16 | 경영참여 | 20,720 | 1,022 | 4.9 | 15,129 | - | - | 6,593 | 1,022 | 4.9 | 21,722 | 483,313 | 55,386 |
| ㈜엘오티베콤 | 상장 | 2020.11.16 | 경영참여 | 18,990 | 1,268 | 7.1 | 14,325 | - | - | 7,543 | 1,268 | 7.1 | 21,867 | 323,674 | 20,575 |
| ㈜뉴파워프라즈마 | 상장 | 2020.11.16 | 경영참여 | 12,739 | 2,141 | 4.9 | 7,579 | - | - | 5,823 | 2,141 | 4.9 | 13,402 | 635,198 | 22,076 |
| ㈜에프에스티 | 상장 | 2021.03.16 | 경영참여 | 43,009 | 1,523 | 7.0 | 23,758 | - | - | 9,442 | 1,523 | 7.0 | 33,201 | 394,760 | 40,839 |
| ㈜디앤에프 | 상장 | 2021.08.11 | 경영참여 | 20,964 | 810 | 7.0 | 10,692 | - | - | 4,147 | 810 | 7.0 | 14,840 | 190,545 | 5,800 |
| Marvell | 상장 | 2021.10.05 | 단순투자 | 11,705 | 173 | 0.0 | 8,130 | - | - | 5,462 | 173 | 0.0 | 13,592 | 28,542,257 | -211,103 |
| 한국경제신문㈜ | 비상장 | 1987.05.01 | 단순투자 | 150 | 72 | 0.4 | 365 | - | - | 72 | 0.4 | 365 | 491,553 | 47,153 | |
| ㈜한국비즈니스금융대부 | 비상장 | 1995.01.01 | 단순투자 | 5,000 | 1,000 | 17.2 | 2,964 | - | - | - | 1,000 | 17.2 | 2,964 | 86,276 | 1,236 |
| ㈜씨이비뱅크 | 비상장 | 2000.12.30 | 단순투자 | 8,000 | 1,083 | 7.5 | 0 | - | - | - | 1,083 | 7.5 | 0 | - | - |
| 화인칩스㈜ | 비상장 | 2001.12.01 | 단순투자 | 10 | 2 | 3.3 | 10 | - | - | - | 2 | 3.3 | 10 | 15,919 | 3,878 |
| ㈜인켈 | 비상장 | 2006.11.01 | 단순투자 | 130 | 0 | 0.0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.0 | 0 | 53,047 | -8,636 |
| 인텔렉추얼디스커버리㈜ | 비상장 | 2011.05.13 | 단순투자 | 5,000 | 357 | 10.7 | 1,922 | - | - | - | 357 | 10.7 | 1,922 | 79,972 | 14,984 |
| ㈜말타니 | 비상장 | 2012.04.01 | 단순투자 | 16,544 | 45 | 15.0 | 7,431 | - | - | 34 | 45 | 15.0 | 7,465 | 72,421 | 2,891 |
| ㈜팩텍자산관리 | 비상장 | 2013.06.19 | 단순투자 | 53,000 | 53,000 | 10.0 | 0 | - | - | - | 53,000 | 10.0 | 0 | 8,114 | -36 |
| ㈜인공지능연구원 | 비상장 | 2016.07.28 | 단순투자 | 3,000 | 600 | 14.3 | 3,000 | - | - | - | 600 | 14.3 | 3,000 | 5,935 | 3,021 |
| ㈜미코세라믹스 | 비상장 | 2020.11.16 | 경영참여 | 21,667 | 747 | 13.7 | 29,385 | - | - | 1,329 | 747 | 13.7 | 30,714 | 180,809 | 20,984 |
| ㈜신성건설 | 비상장 | 2010.07.29 | 단순투자 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.0 | 0 | 147,706 | -12,265 |
| ㈜우방 | 비상장 | 2010.07.01 | 단순투자 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | - | - | 1 | 0.0 | 0 | 493,942 | 4,378 |
| ㈜삼보컴퓨터 | 비상장 | 2012.09.27 | 단순투자 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.0 | 0 | 55,884 | -2,453 |
| 대우산업개발㈜ | 비상장 | 2012.12.18 | 단순투자 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.0 | 0 | 321,513 | -3,342 |
| 대우송도개발㈜ | 비상장 | 2012.12.18 | 단순투자 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | - | - | - | 9 | 0.0 | 0 | 19,369 | -350 |
| 자일자동차판매㈜ | 비상장 | 2012.12.18 | 단순투자 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | - | - | 1 | 0.0 | 0 | 385,419 | -6,532 |
| 성원건설㈜ | 비상장 | 2014.04.30 | 단순투자 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | - | - | 1 | 0.0 | 0 | 27,744 | -627 |
| ㈜인희 | 비상장 | 2014.04.30 | 단순투자 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - | - | - | 0 | 0.1 | 0 | 2,753 | 211 |
| 포인트애니빌㈜ | 비상장 | 2019.12.26 | 단순투자 | 61 | 12 | 3.5 | 61 | -12 | -61 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| JNT(반도체펀드) | 비상장 | 2011.02.28 | 단순투자 | 1,800 | 0 | 24.0 | 1,758 | - | -518 | - | 0 | 24.0 | 1,240 | 2,174 | 19 |
| L&S(반도체펀드) | 비상장 | 2012.07.30 | 단순투자 | 848 | 0 | 7.5 | 1 | - | - | - | 0 | 7.5 | 1 | 3,241 | 171 |
| KTCNP-GC(반도체펀드) | 비상장 | 2013.12.01 | 단순투자 | 960 | 0 | 3.6 | 222 | - | -222 | - | 0 | 3.6 | 0 | 28,999 | -4,695 |
| 포스코사회적기업펀드 | 비상장 | 2013.12.01 | 단순투자 | 600 | 0 | 10.0 | 60 | - | - | - | 0 | 10.0 | 60 | 245 | -481 |
| 베어포트리조트 | 비상장 | 2022.04.18 | 단순투자 | - | 51 | 0.5 | 0 | - | 0 | - | 51 | 0.5 | 0 | 121,507 | 5,206 |
| SEA | 비상장 | 1978.07.01 | 경영참여 | 59,362 | 492 | 100.0 | 17,166,557 | - | - | - | 492 | 100.0 | 17,166,557 | 38,938,571 | 294,772 |
| SECA | 비상장 | 1992.08.13 | 경영참여 | 3,823 | 0 | 100.0 | 90,922 | - | - | - | 0 | 100.0 | 90,922 | 1,076,485 | -74,723 |
| SEDA | 비상장 | 1994.01.01 | 경영참여 | 13,224 | 77,205.709 | 87.0 | 647,620 | - | - | - | 77,205.709 | 87.0 | 647,620 | 5,290,815 | 164,645 |
| SEM | 비상장 | 1995.07.01 | 경영참여 | 3,032 | 3,837 | 63.6 | 165,638 | - | - | - | 3,837 | 63.6 | 165,638 | 2,251,383 | 83,052 |
| SELA | 비상장 | 1989.04.01 | 경영참여 | 319 | 40 | 100.0 | 86,962 | - | - | - | 40 | 100.0 | 86,962 | 728,002 | 33,867 |
| SEASA | 비상장 | 1996.06.01 | 경영참여 | 4,696 | 21,854 | 98.0 | 6,779 | - | - | - | 21,854 | 98.0 | 6,779 | 112,414 | 7,273 |
| SECH | 비상장 | 2002.12.19 | 경영참여 | 597 | 0 | 4.1 | 597 | - | - | - | 0 | 4.1 | 597 | 567,145 | 6,492 |
| SEUK | 비상장 | 1995.07.01 | 경영참여 | 33,908 | 109,546 | 100.0 | 433,202 | - | - | - | 109,546 | 100.0 | 433,202 | 2,552,143 | 72,364 |
| SEL | 비상장 | 1998.12.31 | 경영참여 | 8,280 | 4,393 | 100.0 | 0 | - | - | - | 4,393 | 100.0 | 0 | 7,030 | 0 |
| SEHG | 비상장 | 1982.02.01 | 경영참여 | 28,042 | 0 | 100.0 | 354,846 | - | - | - | 0 | 100.0 | 354,846 | 350,823 | -20,973 |
| SEF | 비상장 | 1991.08.21 | 경영참여 | 230 | 2,700 | 100.0 | 234,115 | - | - | - | 2,700 | 100.0 | 234,115 | 1,095,914 | -24,405 |
| SEI | 비상장 | 1993.05.24 | 경영참여 | 862 | 677 | 100.0 | 143,181 | - | - | - | 677 | 100.0 | 143,181 | 1,054,293 | -3,077 |
| SESA | 비상장 | 1989.01.01 | 경영참여 | 3,276 | 8,021 | 100.0 | 142,091 | - | - | - | 8,021 | 100.0 | 142,091 | 1,251,021 | 55,911 |
| SEP | 비상장 | 1982.09.01 | 경영참여 | 204 | 1,751 | 100.0 | 37,616 | - | - | - | 1,751 | 100.0 | 37,616 | 306,661 | 7,360 |
| SEH | 비상장 | 1991.05.31 | 경영참여 | 1,954 | 753 | 100.0 | 650,157 | - | - | - | 753 | 100.0 | 650,157 | 1,557,922 | 596,476 |
| SELS | 비상장 | 1991.05.01 | 경영참여 | 18,314 | 1,306 | 100.0 | 24,288 | - | - | - | 1,306 | 100.0 | 24,288 | 2,438,051 | 226,763 |
| SEBN | 비상장 | 1995.07.01 | 경영참여 | 236 | 539,138 | 100.0 | 914,751 | - | - | - | 539,138 | 100.0 | 914,751 | 1,782,683 | 132,672 |
| SEEH | 비상장 | 2008.01.01 | 경영참여 | 4,214 | 0 | 100.0 | 1,369,992 | - | - | - | 0 | 100.0 | 1,369,992 | 9,693,632 | 32,085 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|------------|------|---------|---------|-------|------------|-------|---------|---------|---------|-------|------------|------------|-----------|
| SENA | 비상장 | 1992.03.01 | 경영참여 | 392 | 1,000 | 100.0 | 69,372 | - | - | - | 1,000 | 100.0 | 69,372 | 565,956 | -50,055 |
| SESK | 비상장 | 2002.06.01 | 경영참여 | 8,976 | 0 | 55.7 | 263,767 | - | - | - | 0 | 55.7 | 263,767 | 884,500 | 68,197 |
| SEPOL | 비상장 | 1996.04.01 | 경영참여 | 5,462 | 106 | 100.0 | 78,267 | - | - | - | 106 | 100.0 | 78,267 | 1,324,541 | 71,659 |
| SEAG | 비상장 | 2002.01.01 | 경영참여 | 40 | 0 | 100.0 | 32,162 | - | - | - | 0 | 100.0 | 32,162 | 497,109 | 134,261 |
| SERC | 비상장 | 2006.01.01 | 경영참여 | 24,877 | 0 | 100.0 | 188,290 | - | - | - | 0 | 100.0 | 188,290 | 1,010,248 | 107,123 |
| SERK | 비상장 | 2007.07.19 | 경영참여 | 4,600 | 0 | 100.0 | 204,555 | - | - | - | 0 | 100.0 | 204,555 | 1,047,722 | 43,639 |
| SEO | 비상장 | 1997.01.01 | 경영참여 | 120 | 0 | 100.0 | -10,043 | - | - | - | 0 | 100.0 | -10,043 | 1,937 | 11 |
| SGE | 비상장 | 1995.05.25 | 경영참여 | 827 | 0 | 100.0 | 32,836 | - | - | - | 0 | 100.0 | 32,836 | 1,023,676 | 24,716 |
| SEEG | 비상장 | 2012.07.09 | 경영참여 | 23 | 0 | 0.1 | 39 | - | - | - | 0 | 0.1 | 39 | 1,349,945 | 66,642 |
| SSA | 비상장 | 1998.12.01 | 경영참여 | 263 | 2,000 | 100.0 | 32,622 | - | - | - | 2,000 | 100.0 | 32,622 | 458,345 | -34,536 |
| SAPL | 비상장 | 2006.07.01 | 경영참여 | 793 | 877,133 | 100.0 | 981,483 | - | - | - | 877,133 | 100.0 | 981,483 | 23,579,581 | 6,966,849 |
| SME | 비상장 | 2003.05.01 | 경영참여 | 4,796 | 17,100 | 100.0 | 7,644 | - | - | - | 17,100 | 100.0 | 7,644 | 557,750 | 14,243 |
| SDMA | 비상장 | 1995.03.01 | 경영참여 | 21,876 | 71,400 | 75.0 | 18,741 | - | - | - | 71,400 | 75.0 | 18,741 | 31,594 | -247 |
| SEMA | 비상장 | 1989.09.01 | 경영참여 | 4,378 | 16,247 | 100.0 | 103,402 | - | - | - | 16,247 | 100.0 | 103,402 | 326,332 | 44,203 |
| SAVINA | 비상장 | 1995.01.17 | 경영참여 | 5,839 | 0 | 100.0 | 28,365 | - | - | - | 0 | 100.0 | 28,365 | 106,618 | 9,169 |
| SEIN | 비상장 | 1991.08.28 | 경영참여 | 7,463 | 46 | 100.0 | 118,909 | - | - | - | 46 | 100.0 | 118,909 | 1,008,642 | 89,053 |
| TSE | 비상장 | 1988.01.01 | 경영참여 | 1,390 | 11,020 | 91.8 | 279,163 | - | - | - | 11,020 | 91.8 | 279,163 | 2,918,991 | 185,939 |
| SEAU | 비상장 | 1987.11.01 | 경영참여 | 392 | 53,200 | 100.0 | 111,964 | - | - | - | 53,200 | 100.0 | 111,964 | 465,246 | -107,979 |
| SIEL | 비상장 | 1995.08.01 | 경영참여 | 5,414 | 216,787 | 100.0 | 75,263 | - | - | - | 216,787 | 100.0 | 75,263 | 7,396,505 | 568,363 |
| SRI-Bangalore | 비상장 | 2005.05.30 | 경영참여 | 7,358 | 17 | 100.0 | 31,787 | - | - | - | 17 | 100.0 | 31,787 | 376,713 | 36,185 |
| SJC | 비상장 | 1975.12.01 | 경영참여 | 273 | 1,560 | 100.0 | 253,108 | - | - | - | 1,560 | 100.0 | 253,108 | 1,465,865 | -611 |
| SRJ | 비상장 | 1992.08.25 | 경영참여 | 3,120 | 122 | 100.0 | 117,257 | - | - | - | 122 | 100.0 | 117,257 | 132,868 | 1,000 |
| SCIC | 비상장 | 1996.03.01 | 경영참여 | 23,253 | 0 | 100.0 | 640,452 | - | - | - | 0 | 100.0 | 640,452 | 9,821,955 | 177,969 |
| SEHK | 비상장 | 1988.09.01 | 경영참여 | 349 | 274,250 | 100.0 | 79,033 | - | - | - | 274,250 | 100.0 | 79,033 | 1,006,894 | -7,243 |
| SET | 비상장 | 1994.11.01 | 경영참여 | 456 | 27,270 | 100.0 | 112,949 | - | - | - | 27,270 | 100.0 | 112,949 | 1,636,679 | 1,453 |
| TSEC | 비상장 | 1993.04.01 | 경영참여 | 15,064 | 0 | 48.2 | 103,134 | - | - | - | 0 | 48.2 | 103,134 | 380,062 | -2,589 |
| SSEC | 비상장 | 1995.04.01 | 경영참여 | 32,128 | 0 | 69.1 | 130,551 | - | - | - | 0 | 69.1 | 130,551 | 763,037 | 104,775 |
| SESC | 비상장 | 2002.09.01 | 경영참여 | 5,471 | 0 | 73.7 | 34,028 | - | - | - | 0 | 73.7 | 34,028 | 86,351 | 5,055 |
| TSTC | 비상장 | 2001.03.01 | 경영참여 | 10,813 | 0 | 90.0 | 260,092 | - | - | - | 0 | 90.0 | 260,092 | 644,935 | 2,678 |
| SSS | 비상장 | 2001.01.01 | 경영참여 | 1,200 | 0 | 100.0 | 19,189 | - | - | - | 0 | 100.0 | 19,189 | 3,785,339 | 114,934 |
| SCS | 비상장 | 2012.09.19 | 경영참여 | 111,770 | 0 | 100.0 | 5,275,760 | - | - | - | 0 | 100.0 | 5,275,760 | 15,957,741 | 530,735 |
| SSCX | 비상장 | 2016.04.25 | 경영참여 | 1,141 | 0 | 100.0 | 1,141 | - | - | - | 0 | 100.0 | 1,141 | 598,376 | 20,682 |
| SESS | 비상장 | 1994.12.30 | 경영참여 | 18,875 | 0 | 100.0 | 504,313 | - | - | - | 0 | 100.0 | 504,313 | 854,292 | 51,842 |
| TSLED | 비상장 | 2012.04.01 | 경영참여 | 119,519 | 0 | 100.0 | 119,519 | - | - | - | 0 | 100.0 | 119,519 | 253,668 | 16,619 |
| SSCR | 비상장 | 2006.09.01 | 경영참여 | 3,405 | 0 | 100.0 | 9,332 | - | - | - | 0 | 100.0 | 9,332 | 74,089 | 7,868 |
| TSST Japan | 비상장 | 2004.03.29 | 경영참여 | 1,639 | 30 | 49.0 | 0 | - | - | - | 30 | 49.0 | 0 | 159 | -21 |
| STE | 비상장 | 1996.01.01 | 경영참여 | 4,206 | 2 | 49.0 | 0 | - | - | - | 2 | 49.0 | 0 | 7,357 | 0 |
| Semiconductor Portal Inc. | 비상장 | 2002.12.01 | 단순투자 | 38 | 0 | 1.2 | 10 | - | - | - | 0 | 1.2 | 10 | 1,981 | 159 |
| Nanosys Inc. | 비상장 | 2010.08.13 | 단순투자 | 4,774 | 2,000 | 0.6 | 1,082 | - | - | - | 2,000 | 0.6 | 1,082 | 54 | -163 |
| One-Blue, LLC | 비상장 | 2011.07.14 | 경영참여 | 1,766 | 0 | 16.7 | 1,766 | - | - | - | 0 | 16.7 | 1,766 | 24,622 | 557 |
| TidalScale Inc. | 비상장 | 2013.08.12 | 단순투자 | 1,112 | 2,882 | 4.3 | 1,112 | - | - | -1,112 | 2,882 | 4.3 | 0 | 8,146 | -5,636 |
| Sentiance NV | 비상장 | 2012.12.01 | 단순투자 | 3,422 | 7 | 7.2 | 3,422 | - | - | - | 7 | 7.2 | 3,422 | 4,751 | -10,292 |
| Mantis Vision Ltd. | 비상장 | 2014.01.16 | 단순투자 | 1,594 | 355 | 2.1 | 1,980 | - | - | - | 355 | 2.1 | 1,980 | 19,901 | -27,332 |
| Leman Micro Devices SA | 비상장 | 2014.08.14 | 단순투자 | 1,019 | 17 | 3.4 | 1,019 | - | - | - | 17 | 3.4 | 1,019 | 1,680 | -2,891 |
| Sensifree LTD | 비상장 | 2016.01.01 | 단순투자 | 2,111 | 666 | 9.5 | 2,111 | - | - | - | 666 | 9.5 | 2,111 | 795 | -1,384 |
| Unispectral Ltd. | 비상장 | 2016.02.29 | 단순투자 | 1,112 | 2,308 | 7.9 | 2,130 | - | - | - | 2,308 | 7.9 | 2,130 | 3,270 | -3,578 |
| Quobyte, Inc. | 비상장 | 2016.04.28 | 단순투자 | 2,865 | 729 | 11.8 | 2,865 | - | - | - | 729 | 11.8 | 2,865 | 1,909 | -831 |
| Afero, Inc. | 비상장 | 2016.05.04 | 단순투자 | 5,685 | 723 | 5.5 | 5,685 | - | - | - | 723 | 5.5 | 5,685 | 46 | -14 |
| Graphcore Limited | 비상장 | 2016.06.30 | 단순투자 | 3,494 | 12,000 | 1.4 | 3,494 | - | - | - | 12,000 | 1.4 | 3,494 | 279,496 | -148,852 |
| SoundHound Inc. | 상장 | 2016.12.01 | 단순투자 | 7,059 | 1,703 | 0.9 | 3,820 | - | - | 6,352 | 1,703 | 0.9 | 10,172 | 48,475 | -148,964 |
| Fasetto, Inc. | 비상장 | 2019.01.29 | 단순투자 | 6,701 | 475 | 5.2 | 12,554 | - | - | - | 475 | 5.1 | 12,554 | 1,973 | -10,269 |
| (주)레인보우로보틱스 | 비상장 | 2023.01.11 | 경영참여 | - | 0 | - | 0 | 2,854 | 58,982 | - | 2,854 | 0.1 | 58,982 | 76,159 | 5,774 |
| 합계 | | | | - | - | - | 58,761,857 | 2,841 | -38,504 | 366,721 | - | - | 59,090,074 | - | - |

※ 별도재무제표 기준입니다.

※ 법인명은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참조하시기 바랍니다.

※ 최초취득일자의 날짜는 일부 과거 취득시 자료 확보가 현실적으로 곤란한 경우 일괄적으로 1일로 기재하였습니다.

※ 자본율은 보통주 기준입니다.

※ 당사는 기업회계기준에 따라 금융상품(지분상품)에 대해서는 공정가치로 측정하고 있으며, 종속기업 및 관계기업 투자주식에 대해서는

매년 손상(감액) 징후가 있는지 검토하고 징후가 있다면 해당 자산의 회수가능액을 추정하여 손상 회계처리를 하고 있습니다.

※ 최근사업연도 재무 현황은 일부 법인의 자료 확보가 현실적으로 곤란하여, 성원건설(주)은 2016년 12월 31일, 대우송도개발(주)는 2017년 12월 31일,

Mantis Vision은 2020년 12월 31일, Unispectral은 2021년 12월 31일, SensiFree는 2022년 11월 30일 현재의 재무 현황을 기재하였습니다.

4. 연구개발실적(상세)

☞ 본문 위치로 이동

| 부문 | 연구과제 등 | 연구결과 및 기대효과 등 |
|-------|---------|--|
| DX 부문 | 영상디스플레이 | <ul style="list-style-type: none"> □ Neo QLED 8K (2021.03. ~2023.03.) <ul style="list-style-type: none"> □ Mini LED 기반 초고화질 & 슬림 8K TV (65 · 75 · 85") <ul style="list-style-type: none"> - QN900 (65 · 75 · 85") / QN800 (65 · 75 · 85") / QN700 (55 · 65 · 75") - 세밀한 Mini LED의 향상된 명암비로 더욱 실재를 보는 듯한 QLED 8K 화질 - 'OTS Pro(Object Tracking Sound Pro)' 기능 추가 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> □ Neo QLED 4K (2021.03. ~2023.03.) <ul style="list-style-type: none"> □ Mini LED 기반 3개 시리즈, 7개 사이즈 (43 · 50 · 55 · 65 · 75 · 85 · 98") □ Mini LED 적용을 통한 Slim 구현 및 Bezel-less/Metal를 통한 디자인 프리미엄 Look <ul style="list-style-type: none"> - Quantum Nano-Layer Multi-Cell 구조를 적용하여 Slim하면서도 높은 광 효율과 광 Profile 조절이 가능한 New LED - 계조 표현력 4배 향상으로 밝고 어두운 영역을 더욱 자세하게 표현 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> □ QD-Display TV (~2023.03.) <ul style="list-style-type: none"> □ Quantum Dot 기반 self-emitting Display Flat 4K TV (55 · 65 · 77") <ul style="list-style-type: none"> - S95 (55 · 65 · 77") / S90 (55 · 65 · 77") - Quantum Dot 기반 self-emitting Display 고화질과 Sleek한 Blade Slim Design에 OTS 및 True Ch. ATMOS 까지 모두 적용된 진정한TV 가치를 제공하는 QD-Display TV |
| | | <ul style="list-style-type: none"> □ QLED TV (~2023.03.) <ul style="list-style-type: none"> □ Flat QLED 4K TV (43 · 50 · 55 · 60 · 65 · 70 · 75 · 82 · 85 · 98") <ul style="list-style-type: none"> - 4K 최고의 화질(AI/밝기/시야각) 및 음질(OTS)을 통한 시청 경험을 극대화한 Flagship QLED - 최고의 명암비, 시야각 Free, Life-like 컬러와 최적의 밝기로 몰입감을 극대화 - 음성인식 및 AI 기술 기반으로 외부 환경 및 사용자 Context를 인지하여 최적의 시청 경험 제공 - 고가의 전문 장비 없이 모바일로 손쉽게 TV 화질을 Calibration - Game Bar 3.0을 통한 캐주얼 게이머들을 위한 게임 경험 확대 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> □ UHD TV (~2023.03.) <ul style="list-style-type: none"> □ Flat UHD TV (43 · 50 · 55 · 58 · 60 · 65 · 70 · 75 · 82 · 85") <ul style="list-style-type: none"> - Slim한 Bezel-less 디자인과 실제 자연색에 가까운 Color를 제공하는 UHD 스마트 TV - Dynamic Crystal Color 및 Dual LED를 통해 원본 콘텐츠의 화질을 그대로 표현하는 UHD 화질 - Multi-media Screen 경험 제공, 풍부한 콘텐츠, Smart Home의 경험을 통해 완성된 Smart 경험 제공 - Game Home, IoT Hub, Watch/Chat together 기능 추가를 통한 Smart 경험 강화 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> □ Lifestyle TV (~2023.04.) <ul style="list-style-type: none"> □ The Sero (43") <ul style="list-style-type: none"> - Modern & Simple 한 세로형 Screen에 판상형 Speaker가 부착된 360도 Design - 다양한 거주공간 어디에도 쉽게 거치 가능, 이동 가능한 Floor 스탠드 제공 - 기울어진 폼팩터에도 외광/실내 조명 반사 없는 화질로 기존 제품의 VoC 대폭 개선 □ The Frame (32 · 43 · 50 · 55 · 65 · 75 · 85") <ul style="list-style-type: none"> - Real 액자 디자인 및 액자 설치 경험 완성 - 다양한 영화, 사진 등 감상 가능, 인테리어와 조화로운 Lifestyle 디자인 채용 - 초대형 Life Style 제품 Needs에 따른 85" 추가도입 - 외광/실내 조명 반사 없이 항상 종이와 같은 질감을 표현하는 화질로 Real Frame 경험 완성 □ The Serif (43 · 49 · 55 · 65") <ul style="list-style-type: none"> - 'I' 형태 Serif Font 디자인으로 확실한 차별화 및 인테리어 감성 극대화 - 대형 사이즈 제품 포지션 확대를 위한 65" 추가도입 - 외광/실내 조명 반사 없이 항상 매끈한 질감을 표현하는 화질로 가구와 같은 디자인 완성 □ The Terrace (55 · 65 · 75") <ul style="list-style-type: none"> - 옥외에서 휴식과 Entertainment를 동시에 즐기려는 Lifestyle 대응을 위한 차별화된 제품 □ The Premiere (100~130") <ul style="list-style-type: none"> - 초단초점 · 레이저 · 고화질 폼팩터에 업계 최고 Smart UX/OTT 경험 제공 - Blended 디자인으로 벽 근처에 쉽게 놓고 원하는 공간에 적합한 사이즈로 투영 - 당사 TV의 완성된 콘텐츠 경험과 차별화된 화질 · 음질을 제공하는 프로젝터 |

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| | | <input type="checkbox"/> The Freestyle (30~100") <ul style="list-style-type: none"> - 언제 어디서나 다양한 콘텐츠를 쉽게 감상할 수 있는 Movable Smart Screen - 다양한 공간에 쉽게 놓이며 각도/거리에 상관없이 최적 시청 경험 제공(Auto Focus/Auto Keystone) - 기본 Cradle로 다양한 공간에 거치 사용성이 추가되고 소켓을 통해 신규 설치 확장도 가능 |
| | Micro-LED TV (~2023.06.) | <input type="checkbox"/> The Wall 2.0 (110") <ul style="list-style-type: none"> - Tech. leadership 및 Micro-LED 시장 장악력 강화하기 위해 Micro-LED 완품형 출시 - 실제 세상을 화면에 재현하는 초대형 Home Screen - 해상도 제약없이, 실재를 보는 듯한 공간감 및 깊이감/입체감 있는 Micro-LED 화질 <input type="checkbox"/> Micro-LED Screen (89·101") <ul style="list-style-type: none"> - 프리미엄 고객 및 유통의 Needs를 만족 시켜 주는 차세대 Flagship 모델 - TFT Glass기반 12.7" 모듈(Pitch 0.51) Micro-LED Screen 완품형 출시 - MicroLED Processor : AI scaling + HDR enhancing 기반 선명한 입체 화질 구현 |
| | Sound Bar (~2022.03.) | <input type="checkbox"/> Sound Bar <ul style="list-style-type: none"> - TV와 조화로운 'Bar' 형태의 오디오 제품 - 음성 인식 AI Solution 채용 - 3D 서라운드 채용으로 현장감 극대화 및 공간을 채우는 사운드 구현 <input type="checkbox"/> Sound Bar Q990B <ul style="list-style-type: none"> - 업계 최초, TV에서 사운드바로 무선 ATMOS 전송(Wireless ATMOS) - TV와 Soundbar의 모든 채널을 활용하여 극장과 같은 최상의 Cinema True ATMOS 제공 - 사운드바 자체 공간 보정 기술 탑재 |
| | 모니터 (2021.01. ~2023.06.) | <input type="checkbox"/> 스페이스 모니터 <ul style="list-style-type: none"> - 모니터가 차지하는 공간을 최소화한 일체형 Arm Stand 적용 <input type="checkbox"/> Neo QLED 게이밍 모니터(49") <ul style="list-style-type: none"> - Neo QLED 적용하여 향상된 명암비를 기반으로 블랙 표현력 강화 - 세계 최고 곡률 1000R 적용하여 게이밍 몰입 강화 <input type="checkbox"/> 고해상도 QHD 모니터(34") <ul style="list-style-type: none"> - Intelligent Eye Care 솔루션 등으로 눈에 편안한 화질 솔루션 제공 <input type="checkbox"/> LCD 스마트 모니터: 스마트 TV 서비스 활용하여 PC 없이 VOD 시청 (Netflix, Youtube 등) |
| | | <input type="checkbox"/> 스마트 모니터 M80B (32") <ul style="list-style-type: none"> - 초슬림, Flat Back, Warm White 컬러 적용 Lifestyle 디자인 - Magnetic 방식의 전용 카메라 In-box 영상 커뮤니케이션 - 스마트 경험 강화(VOD 시청/모바일 연결/PC-less기능/IoT/Communication/Game) <input type="checkbox"/> 게이밍 모니터 G85NB (32") <ul style="list-style-type: none"> - 세계 최초 UHD 240Hz 1ms(GTG) 최고 게이밍 성능 모니터 (1000R Curved) - 새로운 수준 화질 경험을 제공하는 Odyssey Neo (Mini LED, Quantum HDR2000) <input type="checkbox"/> 세계 최초 1000R 대형 게임 스크린 G97NB (55") <ul style="list-style-type: none"> - 1000R, 16:9, 55" Big Curved Screen으로 근접 환경에서도 시야각 제약 없는 최대 사이즈 화면으로 최고의 몰입감 제공 - 세로로 회전하고 자유로운 각도 조정으로 우주선 조종석에 앉은 것 같은 새로운 몰입 경험 제공 - 4K 165Hz 입출력 및 반응속도 1ms까지 지원 가능한 게임 전용 패널 <input type="checkbox"/> QD-OLED 게이밍 모니터 (G85SB 34") <ul style="list-style-type: none"> - True RGB 자발광 Display와 Quantum Dot 기술의 조합으로 다양한 컬러를 정교하게 표현 - 0.1ms 최고 응답속도, 175Hz 주사율로 보다 깨끗한 화면으로 게임 플레이 가능 - Gaming Hub 적용으로 Cloud Game, 콘솔 등 All-In-One Game Discovery Platform 도입 <input type="checkbox"/> 5K 초고해상도 모니터 (S90PC 27") <ul style="list-style-type: none"> - 4K 대비 50% 이상 더 많은 픽셀로 더 많은 정보를 담는 5K(5120X2880) 해상도 - 모니터 후드 없이도 빛 반사를 줄여 화면 왜곡을 없애고 눈 보호하는 Matte Display |

| | | |
|------|-----------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - MAC/Windows 모두 만족하는 Thunderbolt 4 및 miniDP 제공 - 나의 작업/ 일상/ 공간에 맞춰 활용하는 '스마트스크린' |
| | <p>사이니지 (~2023.06.)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> LCD 기반의 B2B Smart Signage (LFD, Video Wall, Outdoor 등) (13 · 24 · 32 · 43 · 49 · 50 · 55 · 65 · 75 · 85 · 98") <input type="checkbox"/> LED 소자를 활용한 Indoor / Outdoor 사이니지 <input type="checkbox"/> 부가 장치 일체형 All-in-one Kiosk (24") <ul style="list-style-type: none"> - Tizen 결제모듈/주문 앱 개발 위한 결제 플랫폼, 항공 코팅 <input type="checkbox"/> FLIP-Edu (75 / 85") 교육용 인터랙티브 제품 |
| | <p>냉장고 (~2023.06.)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 북미/중남미 신규 TMF <ul style="list-style-type: none"> - 대용량, 전문보관, New Design으로 경쟁력 강화 및 제품 차별화(440L/480L) - Flex Zone(Fridge 1℃ / Chilled -1℃ / Soft Freezing) & Quick Chill Smart Alarm - Flat Door & Bespoke CMF, 용량 및 최적 사이즈로 경쟁력 강화(20L More) - Bi Volt(Free Voltage), Auto Ice Maker, Water Dispenser, Big Box, Hygiene <input type="checkbox"/> 1-Door Premium Kitchen Fit 냉장고 (냉동/냉장/김치/와인) <ul style="list-style-type: none"> - Premium Bespoke 디자인 및 신규 CMF 적용 - Auto Door Open - Water & Ice Solution 적용: Auto Fill Pitcher, Dual Auto Ice Maker(Cocktail Ice, Standard Ice) <input type="checkbox"/> 구주 177cm 1Door 빌트인 냉장고 신규 진입 <ul style="list-style-type: none"> - 빌트인 패키지 라인업 확대 - 신규격 기준 에너지 최고등급 구현 - 간냉식 용량 우위 확보 - 식품 신선보관(고습 냉장) 및 변온기능(냉동→냉장) 차별화 <input type="checkbox"/> 북미 48" 냉장고 빌트인 시장 교체 및 신규 수요 대응 <ul style="list-style-type: none"> - 빌트인 27.4cf 대용량 구현 - Ice & Water Solution 차별화(Auto Fill Water, Dual Auto Ice Maker) - Soft Closing 도어 적용으로 감성품질 고급화 <input type="checkbox"/> 한국향 초격차 에너지 모델 도입(초절전 1등급, 1등급-22%달성) <ul style="list-style-type: none"> - 세계 최고 효율 압축기 적용 (W1, EER 9.3) - Set 열부하 저감(VIP Coverage 증대) - 기계실 방열 증대(Comp 측 Side Cool 추가) |
| | <p>세탁기 (~2022.01.)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> BESPOKE 세탁기 & 건조기 <ul style="list-style-type: none"> - 당신의 공간에 딱 맞추는 비스포크 Flat 디자인 - 국내 최대 용량 올인원 컨트롤 UX 디자인 - 세탁부터 건조까지 AI 의류 케어(AI 맞춤세탁, 건조) - 99.9% 살균부터 세탁실 제습까지 위생관리 솔루션 <input type="checkbox"/> Agitator 세탁기 <ul style="list-style-type: none"> - 북미 Agitator 신규 시장 진입(Top Loader 시장 중 50% 점유) - ActiveWave™ Agitator 구현으로 소음, 진동 및 엉킴 줄이는 동시에 강력 세탁 가능 - 'Active Water Jet' 구현으로 애벌 세탁 가능 <input type="checkbox"/> 구주향 친환경 신냉매 건조기 <ul style="list-style-type: none"> - 친환경 냉매 : 온실가스감축을 위한 친환경 냉매(R290) 적용 - 에너지 A+++ : 구주 에너지 최고 등급 달성 - Sensor Dry : 건조행정 중 건조도 감지, 추가 건조부터 행정 종료까지 알아서 판단 - Simple UX : 제품 사용성 개선 (상세한 건조 정보 전달 및 맞춤형 패널 설정) - Hygiene Care : 유해 세균3종(녹농균, 대장균, 황색포도상구균) 99% 이상 살균 <input type="checkbox"/> 그랑데 AI 24kg 세탁기 <ul style="list-style-type: none"> - 24kg, Flat Design (Glass Type) |
| 생활가전 | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 핏케어 코스 적용(얼룩, 냄새, 알러젠 제거) - Auto open door 적용(세탁 종료 후 자동으로 문 열림) □ BESPOKE 그랑데 AI 20kg 건조기 <ul style="list-style-type: none"> - 국내최초 최대 용량 20kg, Flat Design - 핏케어 코스 적용(털제거 특화), - Auto open door 적용(건조 종료 후 자동으로 문 열림) - 온/습도 센서추가하여 세탁실 주변 습도 감지하여 제습 솔루션 제공 |
| | <p style="text-align: center;">에어컨 (~2023.05.)</p> | | <ul style="list-style-type: none"> □ 무풍 갤러리 스탠드 에어컨(56.9 · 62.6 · 75.5 · 81.8 · 92.5㎡) <ul style="list-style-type: none"> - 에너지 우위 확보가 가능한 최고 효율 Next 무풍 플랫폼 개발(56.9㎡ 싱글 에너지 2등급 달성) - 1.5배 넓어진 무풍 면적(패널)과 강력한 부스터풍 - 부스터 청정: 집진효율 99.95% 필터, 가구같이 편안한 갤러리 디자인 □ 무풍 벽걸이 와이드 에어컨(24.4 · 29.3 · 39.6 · 49.5㎡) <ul style="list-style-type: none"> - QMD 기반의 신규 통합 플랫폼 개발로 원가경쟁력 확보, 제품 경쟁력 강화 - 12% 더 커진 팬으로 빠르고 시원한 패스트 쿨링 - 전기료 부담을 최대 77% 덜어주는 무풍 미세 초절전 - 초미세먼지까지 제거하는 PM1.0 필터시스템의 무풍청정 □ BESPOKE 원도우핏 에어컨(17㎡, 그린/블루/핑크/베이지/그레이) <ul style="list-style-type: none"> - 실내외기 일체형으로 쉘프 간편 설치 - 2중 바람 날개로 냉기를 빠르게 순환하는 강력 회전 냉방 - 트윈 인버터 컴프레서로 도서관 수준의 37dB 저소음&저진동 - 저소음 모드 사용 시 소비전력 최대70% 절전 □ 구주 EHS 신형 플랫폼 적용 및 라인업 강화로 매출 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 저소음 규제 대응 : 독일을 중심으로 구주 국가별 소음 규제 확대 대응 - 저온 성능 강화 : -25℃외기에서 정격 난방 성능 100% 구현 - 고온 토출수 : Heat Pump 단일 사이클 최고 70℃ 토출수 구현 - 디자인 차별화 : 주거 환경에 조화를 이루는 Dark 색상 계열의 1FAN 실외기 □ BESPOKE 무풍에어컨 원도우핏 <ul style="list-style-type: none"> - 방안에서도 직바람 없이 시원한 무풍 냉방 - 진동과 소음을 줄여 숙면을 도와주는 32 dB 저소음 모드 - 상황에 맞춰 선택하는 고효율 에너지 맞춤 절전 - 더 강력한 냉방 성능과 더 커진 팬으로 골고루 시원하게 대용량 강력 냉방 - 빈틈없이 쉽고 안전하게 간편 안심 설치킷 □ Infinite Line 1Way BESPOKE 무풍 시스템에어컨 <ul style="list-style-type: none"> - 자연스럽게 공간의 무드를 만들어내는 은은한 간접조명 엷지 라이팅 - 고효율 에너지 맞춤절전 와이드 무풍 - 공기질부터 내부 관리까지 케어 8단계 - 상황에 맞춰 선택해 에너지를 절감하는 AI 절약모드 |
| | <p style="text-align: center;">청소기 (~2023.03.)</p> | | <ul style="list-style-type: none"> □ BESPOKE 제트 스틱 청소기(최고 흡입력 210W) <ul style="list-style-type: none"> - 일체형 자동 먼지배출기, 스마트한 정보전달(LCD Display) - 물분사 물걸레 브러시, 슬림 용 브러시 □ 제트봇 AI 로봇 청소기 <ul style="list-style-type: none"> - Active 3D 센서 개발 및 세계최초 적용하여 세계 최소(1cm²) 감지 실현으로 걸림 없는 주행 - 우리집 구조와 사물 종류까지 인식하는 AI 자율주행 - 제트 싸이클론과 디지털 인버터모터로 강력한 흡입력 - 충전과 동시에 자동 먼지비움 일체형 청정스테이션 - SmartThings로 더욱 편리해진 청소(AI 스마트컨트롤) □ BESPOKE 슬림 스틱 청소기 |

| | | |
|----|------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - 강력한 싸이클론과 디지털 인버터모터로 최대 150W 흡입력 - 셀프 스탠딩 및 허리 부담없이 간편 먼지 비움(POP & SHOOT) - 손목에 무리없이 가볍게 청소(인체공학 설계) <input type="checkbox"/> BESPOKE 제트 AI 청소기(최고 흡입력 280W) <ul style="list-style-type: none"> - 흡입력 및 원조 POD(청정 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 흡입력 구현으로 강력하고 깨끗한 청소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 |
| | 조리기기 (2021.03.) | <input type="checkbox"/> BESPOKE 큐커(Qooker) <ul style="list-style-type: none"> - 열원이나 온도/시간이 다른 식품을 한번에 맞춤 조리하는 "멀티룩" - Multi Cook: 하나 이상의 조리가 동시에 완료되어지는 모드 적용 - 식품사(8개 회사)와 연계 큐커 전용 알고리즘 적용 - SmartThings 연계 스캔 한번으로 쉽게 자동 조리 구현 - 열효율 및 고급감 STS 조리실: 법랑 → STS 적용 |
| | 렌지후드 (2022.02.) | <input type="checkbox"/> 자가 후드 프리미엄 라인업 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 제품과의 성능 차별화 - 트리플 센서를 탑재하여 상시배기 시스템으로 최적의 풍량 운전 - 업계 최고 흡입력 780CMH 구현, 업계 최저 소음 (29dB, Quiet Mark 인증) - 전기레인지와 연동 및 스테인리스 필터에 이지 클린 코팅 적용으로 사용편의성 개선 - 소비자의 다양한 니즈 반영한 디자인(비스포크 컬러) - Easy Install 및 설치 프로세스 도입으로 B2C 시장 진입 |
| | 정수기 (2021.03.) | <input type="checkbox"/> 가정용 Water Purifier <ul style="list-style-type: none"> - 소비자 라이프스타일에 따라 업그레이드하고 스스로 케어하는 모듈형 정수기 - 소비자 Needs에 따라 선택 가능한 모듈(정수/냉수/온수) - Smart AI 케어 및 직수형 최다항목 NSF 인증 필터 - 라이프 스타일과 공간 맞춤 『BESPOKE 정수기』 |
| | 의류관리기 (2021.05.) | <input type="checkbox"/> 슈드레서 <ul style="list-style-type: none"> - 에어워시와 UV 냄새분해필터로 강력 탈취 - 매일 신는 신발 기분 좋게 저온성세 건조 - 국내 가전 최초 제논 UVC 살균으로 99.9% 살균 - 제트슈트리로 다양한 신발 맞춤케어 관리 |
| | 인버터 제습기 (2022.05.) | <input type="checkbox"/> 에너지 소비효율 1등급 저소음 인버터 제습기 <ul style="list-style-type: none"> - 와이드 블레이드로 빠르고 강력하게 대용량 제습 - 욕실부터 드레스룸까지 공간을 쾌적하게 스마트 공간 케어 - 스윙 블레이드로 섬세한 의류도 골고루 와이드 의류 건조 - 어디에도 잘 어울리는 심플한 디자인과 컴팩트 사이즈 - 장시간 사용해도 조용한 저소음 모드 |
| | 식기세척기 (2022.06.) | <input type="checkbox"/> 구주/한국 시장 경쟁력있는 자체 기술 플랫폼 <ul style="list-style-type: none"> - 구주 시장 Tall Tub 대응 - 최고 수준 에너지/물/소음 사양 경쟁력 확보 - 한국 세제자동투입, Simple UX 등 차별화를 통한 프리미엄 강화 - Z-wash, Smart, Flexible Basket 사양 차별화 |
| | 가스오븐 (2023.04.) | <input type="checkbox"/> 북미 Dacor 48" Pro-Range <ul style="list-style-type: none"> - 48" all Gas Pro range 도입, 외관 Transitional(Chef) look 디자인 적용 - Air Fry, Air Sous-Vide 등 Healthier cooking POD 적용 - 7" Pop-up display 적용 |
| MX | 갤럭시 폴더블 (~2022.08.) | <input type="checkbox"/> Galaxy Z Fold3 5G (2021.08.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치: 메인 디스플레이 7.6", 커버 디스플레이 6.2" |

| | | |
|--|------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 158.2mm x 67.1mm x 14.4~16.0mm (펼쳤을 때) 158.2mm x 128.1mm x 6.4mm - Platform(H/W, S/W): 5나노 64비트 옥타코어 프로세서, Android 11, One UI 3.1.1 - 폴더블 스마트폰 최초 IPX8 등급지원 (1.5m 담수에서 최대 30분간 방수지원) - 알루미늄 소재인 'Armor Aluminum'과 'Corning Gorilla Glass Victus' 강화 유리 적용으로 내구성 강화 - 7.6" 인피니티 플렉스 디스플레이 탑재 및 언더 디스플레이 카메라 (Under Display Camera) 적용 - 에코스퀘어(Eco2) 기술로 디스플레이 화면 약 29% 밝기 향상 - 메인 / 커버 디스플레이 모두 120Hz 화면 주사율 지원 - 폴더블폰 최초로 S펜 적용 - 플렉스 모드패널(Flex Mode Panel)로 최적화 되지 않은 앱도 원하는 각도에서 상하단 표시 지원 - 최대 3개 앱까지 화면 분할해 사용하는 멀티 액티브 윈도우 (Multi-Active Windows) 지원 <hr/> <p>□ Galaxy Z Flip3 5G (2021.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치: 메인 디스플레이 6.7", 커버 디스플레이 1.9" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 72.2mm x 86.4mm x 15.9~17.1mm (펼쳤을 때) 72.2mm x 166mm x 6.9mm - Platform(H/W, S/W): 5나노 64비트 옥타코어 프로세서, Android 11, One UI 3.1.1 - 폴더블 스마트폰 최초 IPX8 등급지원 (1.5m 담수에서 최대 30분간 방수지원) - 알루미늄 소재인 'Armor Aluminum'과 'Corning Gorilla Glass Victus' 강화 유리 적용으로 내구성 강화 - 커버 디스플레이 사용성 강화 : 알림/메시지 8줄까지 확인가능, 날씨/걸음수 위젯 지원, 삼성페이 결제 지원 - 플렉스 모드 활용 강화: 촬영 인원에 따라 자동으로 구도를 조절하는 자동 프레임링(Auto Framing), 듀얼 프리뷰 (Dual Preview) 등 지원 - 메인 디스플레이 120Hz 화면 주사율 지원 <hr/> <p>□ Galaxy Z Fold4 (2022.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치: 메인 디스플레이 7.6", 커버 디스플레이 6.2" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 155.1mm x 67.1mm x 14.2~15.8mm (펼쳤을 때) 155.1mm x 130.1mm x 6.3mm - Platform(H/W, S/W): SM8475, Android 12.0, One UI 4.1.1 - Nightography 사진/비디오, 고해상도(50M/8K), 고배율줌(30X)로 카메라 사용 경험 완성도 제고 - Taskbar 제공으로 쉽고 빨라진 멀티 태스킹 - 다양한 진입점으로 편리하게 생성하는 멀티 윈도우 - 이미지에서 텍스트를 인식하여 AI 기반 Action 추천 기능 <hr/> <p>□ Galaxy Z Flip4 (2022.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치: 메인 디스플레이 6.7", 커버 디스플레이 1.9" - 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 71.9mm x 84.9mm x 15.9~17.1mm (펼쳤을 때) 71.9mm x 165.2mm x 6.9mm - Platform(H/W, S/W): SM8475, Android 12.0, One UI 4.1.1 - 25W 충전 지원 및 3700mAh 배터리 제공 - 다양한 각도로 사진/영상 촬영에 최적화된 플렉스 캠 지원 - 플렉스 모드에서 쉽고 빠른 앱 전환 및 조작 - 커버 스크린 기능 확대 (간편 답장, 삼성 월렛 플랫폼, 퀵세팅 확대 등) <hr/> <p>□ Galaxy S21 5G · S21+ 5G · S21 Ultra 5G (2021.01.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Design: Iconic and premium full metal camera housing, Bezel-less Design - 인치: S21 5G 6.2", S21+ 5G 6.7", S21 Ultra 5G 6.8" - 사이즈(W x H x D): S21 5G 71.2 x 151.7 x 7.9 mm, S21+ 5G 75.6 x 161.5 x 7.8 mm, S21 Ultra 5G 75.6 x 165.1 x 8.9 mm - Platform(H/W, S/W): Exynos2100, SDM888, Android 11.0, One UI 3.1 - 초고속 5G 이동통신 지원, Wi-Fi 6E 지원, 고화소 카메라 탑재 |
| | <p>갤럭시 S (~2023.02.)</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> · 카메라: S21 Ultra 1억 8백만 화소, S21 · S21+ 6,400만 화소, Multi Camera Recording 기능 · 최대 120Hz 가변 주사율 Dynamic AMOLED 2X Infinity-O 디스플레이 탑재 · SmartTag와 연동한 쉬운 사물 등록 · 찾기 기능 지원 · Digital Car Key 서비스 지원(S21+ 5G · S21 Ultra 5G only) · S Pen 지원(S21 Ultra 5G only) <hr/> <p>□ Galaxy S22 · S22+ · S22 Ultra (2022.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Design: Enhance Galaxy Design attractiveness with geometric bold design and integrity on quality - 인치 : S22 6.1", S22+ 6.6", S22 Ultra 6.8" - 사이즈(W x H x D) : S22 70.6 x 146.0 x 7.6 mm, S22+ 75.8 x 157.4 x 7.6 mm, S22 Ultra 77.9 x 163.3 x 8.9 mm - Platform(H/W, S/W): SM8450 Exynos2200, Android 12.0, One UI 4.1 - 카메라 동영상 촬영 및 저조도 성능 강화 <ul style="list-style-type: none"> · 동영상 : HDR, OIS+AI Stabilizer 성능 개선으로 풍부한 컬러 지원 및 흔들림/지터링 최소화 · 저조도 성능 강화 : Big Pixel 센서 및 On-device AI 알고리즘 적용 - S Pen 내장을 통한 Ultra/Note 통합 * Latency 최적화 : 5.6ms(S21 Ultra) → 2.8ms(S22 Ultra) - Display 야외 시인성 개선 * Peak 휘도: 1,500nit(S21 Ultra) → 1,750nit(S22 Ultra) - All day 사용 가능한 배터리와 초고속 45W 충전 속도 (S22 Ultra/S22+) - 내구성 강화 : 10% 개선된 Amor AL, Victus+ Glass 적용 - Galaxy Foundation 경험 완성도 제고 <ul style="list-style-type: none"> · One UI 4.1: 감성적 Interaction 경험과 사용자 개인 경험 고도화 · Galaxy Eco : End-to-End 완성도 제고 및 체감 편의 경험 강화 <hr/> <p>□ Galaxy S23 · S23+ · S23 Ultra (2023.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Design: Ultimate Premium Experience designed for today and beyond <ul style="list-style-type: none"> * Unrivaled Camera, Ultimate Gaming, Eco-conscious Design - 인치 : S23 6.1", S23+ 6.6", S23 Ultra 6.8" - 사이즈(W x H x D) : S23 70.9 x 146.3 x 7.6 mm, 168g, S23+ 76.2 x 157.8 x 7.6 mm, 195g S23 Ultra 78.1 x 163.4 x 8.9 mm, 233g - Platform(H/W, S/W): SM8550 Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1 - 강화된 AI 기반 저조도 및 동영상 경험 완성도 제고 <ul style="list-style-type: none"> · AI Scene 분석 기반 컬러 솔루션 개선으로 야간에도 정확한 인물 색감/톤 표현 가능 · OIS 보정각 확대로 동영상 손떨림 보정 강화 (S22 Ultra 1.5° → S23 Ultra 3°) - 고화소의 섬세한 디테일 구현 및 고해상도 사진 촬영 경험 제공 <ul style="list-style-type: none"> · S23 Ultra, 200MP 초고화소 센서 적용 · 조도 구간별 픽셀 크기 자동 조정으로 최적 화질 제공 - 발열, 낙하 내구성 등 기본 성능 개선 <ul style="list-style-type: none"> · 소모전류 개선 및 방열 구조 획기적 개선 등 발열 성능 향상을 통한 부드러운 게이밍 경험 제공 · 단품 강도 21% 개선된 Victus 2 Glass 적용으로 낙하 내구성 강화 - S23 Ultra, 내장된 S-Pen으로 더욱 완벽한 Productivity 경험 제공 <ul style="list-style-type: none"> · 이미지 / 동영상에서 텍스트를 인식하여 AI 기반 맞춤 Action 제안 - 멀티기기 연동 사용 경험 강화 (폰-PC) <ul style="list-style-type: none"> · 폰에서 브라우징 하던 웹페이지를 PC에서 이어서 사용 가능 - 컬러부터 소재까지 전반에 걸친 친환경 소재 적용으로 친환경 스토리 구성 <ul style="list-style-type: none"> · 패키징 박스 100% 재생용지 사용 · 재활용 메탈접합 PBT레진 적용(10%), 재활용 메탈 소재 적용(30%) 사이드키 등 · 전/후면 글라스 재생유리 적용(25%), 메탈 가공시 천연염료 사용, 재활용 PET 필름 사용 등 - Privacy와 Security 강화 <ul style="list-style-type: none"> · 보안 상태 시각화/ 이미지 공유시 민감 정보 알림/ 제품 수리시 개인 정보 접근 제한 |
|--|--|--|

| | | |
|------------------------|--|--|
| | | <p>□ Galaxy Tab S7 FE (2021.06.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치: 12.4" WQXGA (2560 x 1600) - 사이즈(W x H x D) & 무게: 284.8mmx 185mm x 6.3mm, 608g(LTE 기준) - 12.4" 대화면 Display와 slim 베젤로 몰입감 있는 디스플레이 - 긴 배터리 사용시간 (10,090mAh, Up to 13 hours video play) - Dolby Atmos 적용으로 풍성한 사운드 - Samsung Note 사용성 강화 <ul style="list-style-type: none"> · 간편하게 손글씨를 TEXT로 변환 · 입력창에 직접 S Pen으로 입력 - PENUP Drawing 기능 강화 <ul style="list-style-type: none"> · Layer 구조 적용 및 컬러링 & 라이브 드로잉 제공 - 경량화 키보드 커버 (330g) - 3Mic를 통한 주변 Noise 50%감소로 깨끗한 보이스 전달 - Device 연결성 강화 <ul style="list-style-type: none"> · Second Screen: Tablet을 PC의 보조 모니터로 사용 · Hand off: Phone에서 사용하던 걸 Tablet에서 바로 이어서 사용 (Internet, Samsung Notes) · Copy & Paste: Phone과 Tablet 간 Text 및 이미지를 복사 & 붙이기 · Auto Switching: 자동으로 Phone/Tablet 간 버즈 스위칭 <hr/> <p>□ Galaxy Tab A8 (2021.12.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치: 10.5" WUXGA (1920 x 1200) - 사이즈(W x H x D) & 무게: 246.8mm x 161.9mm x 6.9mm, 508 g - Platform(H/W, S/W): UniSOC T618(12nm) 프로세서, Android 11, One UI 3 - Memory : 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 4GB + 128GB, microSD 최대 1TB 전작 대비 RAM 4GB 및 ROM 128GB 옵션 신규 제공 - 당사 Tablet Design ID 확립 및 적용 (Samsung Logo, Camera 형상 및 위치, 측면 전후면 대칭), Tab S8 Flagship Family 와 동일 컬러 적용 (Gray, Silver, Pink Gold) - 당사 태블릿 표준 Display 비율 16:10 적용, 10.5"대화면 및 Slim Bezel로 몰입감 있는 멀티미디어 경험 제공 - Dolby Atmos 지원 및 Quad Speaker 탑재, Samsung TV Plus 등 콘텐츠 특화 앱 프리로드 (무료 Live Streaming 및 VOD 제공) - Multi-Active Window 로 2 Split Windows 및 Pop-up 창 지원, Fold3 적용된 Drag & Split 태블릿 최초 지원으로 멀티태스킹 경험 강화 - Tab A 시리즈 최초 Screen Recorder 지원으로 온라인 클래스 활용도 강화 - One UI 3.1.1 Galaxy Experience 확산 지원 (Copy&Paste, Auto Sync, Auto Switch) <hr/> <p>□ Galaxy Tab S8 · S8+ · S8 Ultra (2022.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : Tab S8 11" WQXGA+ (2560 x 1600) Tab S8+ 12.4" WQXGA+ (2800 x 1752) Tab S8 Ultra 14.6" WQXGA+ (2960 x 1848) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : Tab S8 253.8mm x 165.3mm x 6.3mm, 503g Tab S8+ 285.0mm x 185.0mm x 5.7mm, 567g Tab S8 Ultra 326.4mm x 208.6mm x 5.5mm, 726g - Platform(H/W, S/W): SM8450 프로세서, Android 12, One UI 4.1 - Memory : 8GB+128GB / 8GB+256GB / 12GB+256GB / 16G+512G, microSD up to 1TB - 화상 통화 경험 향상 [Tab S8 Ultra] Dual 전면 카메라(12M 80도, 12M 120도) 및 Auto Framing 기능 제공 [Tab S8+ / Tab S8] 12M 120도 전면 카메라 및 Auto Framing 기능 제공 |
| 전자공시시스템 dart.fss.or.kr | | Page 428 |

| | | |
|--|----------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - AP 방열 설계 강화를 통한 AP Sustain 성능 개선(전작비 GPU 70%, CPU 25%↑), 게임 성능 향상 - S Pen Latency 개선 (5.6ms → 2.65ms) 및 Prediction Algorithm 최적화 <li style="padding-left: 20px;">Writing & Drawing 시 Real Pen과 같이 끊김 없고 정밀한 필기 경험 제공, 밀착감 개선 - 3 MIC Noise Cancellation 성능 강화 (3종 잡음 제거 모드)로 화상 회의 오디오 경험 향상 - 태블릿 최초로 WiFi 6E 기능을 탑재하여 Device 간 대용량 데이터 전송 시간 개선 - D2D 15W 충전 기능 탑재하여 전작 대비 Phone Power Share 충전 시간 절반으로 단축 |
| | | <input type="checkbox"/> Galaxy A52 LTE · 5G (2021.03.) <ul style="list-style-type: none"> - 핵심 사양 강화를 통한 소비자 경험 제공 및 경쟁력 강화 - 인치 : 6.5" FHD+ sAMOLED HD (2,400 x 1,080) - 사이즈(W x H x D) : 75.1mm x 159.9mm x 8.4mm - Platform(H/W, S/W) : SDM750G(5G) / SDM720G(LTE), Android 11, One UI 3.1 - Supreme smooth UX/Dynamic refresh rate and Brightest (6.5" sAMOLED with 120Hz(5G)/90Hz(LTE), 800nit) - High-resolution 64MP Quad Camera (64M OIS/12M UW/5M Depth/5M Macro) - Powerful AP with High Capacity Battery (4,500mAh) |
| | | <input type="checkbox"/> Galaxy A72 (2021.03.) <ul style="list-style-type: none"> - 핵심 사양 강화를 통한 소비자 경험 제공 및 경쟁력 강화 - 인치 : 6.7" FHD+ sAMOLED HD (2,400 x 1,080) - 사이즈(W x H x D) : 77.4mm x 165.0mm x 8.4mm - Platform(H/W, S/W) : SDM720G, Android 11, One UI 3.1 - High refresh Rate Brightest Display (6.7" FHD+ sAMOLED with 90Hz, 800nit) - Advanced High-res/Multi Camera, More detail with blur-less (64M OIS/12M UW/8M Tele/5M Macro) - Long-lasting Battery with bigger capacity (5,000mAh) |
| | 갤럭시 A (~2023.05.) | <input type="checkbox"/> Galaxy A32 LTE · 5G (LTE: 2021.03., 5G: 2021.01.) <ul style="list-style-type: none"> - 핵심 사양 강화를 통한 소비자 경험 제공 및 경쟁력 강화 - 인치 : LTE 6.4" FHD+ sAMOLED (2,400 x 1,080) / 5G 6.5" HD+ TFT (1,600 x 720) - 사이즈(W x H x D) : LTE 73.6mm x 158.9mm x 8.4mm / 5G 76.1mm x 164.2mm x 9.1mm - Platform(H/W, S/W) : LTE MT6769T / 5G MT6853V, Android 11, One UI 3.1 - LTE <ul style="list-style-type: none"> · Brightest Display: 800nit Super AMOLED · High Resolution Camera: 64MP Quad (64M W/8M UW/5M Macro/5M Depth) · High Capacity Battery: 5,000mAh - 5G <ul style="list-style-type: none"> · Rich Camera Experience of 48MP Quad(48M W/8M UW/5M Macro/2M Depth) · High Capacity Battery: 5000mAh |
| | | <input type="checkbox"/> Galaxy Quantum2 A82 (2021.04.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.7" QHD+ (3200 x 1440) - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 161.9mm x 73.8mm x 8.1mm, 176g - Platform(H/W, S/W) : SDM855+, Android 11, One UI 3.1 - QRNG 보안칩셋 적용 - 시원한 대화면과 부드러운 화면전환 120Hz지원 - 전문가급 사진 촬영이 가능한 강력한 카메라 (초광각 12MP, 메인 64MP, 접사 5MP) |
| | | <input type="checkbox"/> Galaxy A03-Core (2021.12.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.5" HD+(1480 x 720) TFT 60Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 164.2mm x 75.9mm x 9.1mm, 211g - Platform(H/W, S/W) : 28나노 옥타코어 프로세서, Android 11(Android GO) · 전작 A01-Core(28나노 쿼드코어 프로세서) 대비 CPU 성능 향상 |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Entry 시장 대응을 위한 대화면/대용량 배터리 적용 초저가 제품 · 전작A01-Core 대비 디스플레이(5.3"→6.5" HD+), 배터리(3,000→5,000mAh) 강화 |
| | | <input type="checkbox"/> Galaxy A23 (2022.03.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ (2408 x 1080) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.9mm x 165.4mm x 8.4mm, 195g - Platform(H/W, S/W) : SDM680, Android 12, One UI 4.1 - 6.6" FHD+ 디스플레이, 90Hz 주사율 지원 (전작 A22 6.4" HD+ 90Hz) - 고화소 50MP OIS 카메라 적용으로 어두운 곳에서 흔들림 없는 선명한 사진 촬영 가능 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용 및 25W 초고속 충전 지원 |
| | | <input type="checkbox"/> Galaxy A13 5G (2022.01.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.5" HD+ (1600 x 720) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.5mm x 164.5mm x 8.8mm, 195g - 6.5" HD+ 디스플레이, 90Hz 주사율 지원 (전작 A12 6.5" HD+ 60Hz) - LTE 사용자 Migration 및 5G 시장 확산을 위한 초저가 5G 모델 - Entry 시장 대응을 위한 AP(5G) AP(MT6765 → MT6833v) 강화 - 50MP 카메라 적용으로 전작(A12 16MP)비 고화소 사진 촬영 가능 |
| | | <input type="checkbox"/> Galaxy A13 LTE (2022.03.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ (2400 x 1080) 60Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.4mm x 165.1mm x 8.8mm, 195g - Platform(H/W, S/W) : 8나노 옥타코어 프로세서, Android 12, One UI Core 4.1 - 6.6" FHD+ 디스플레이 적용하여 전작(A12 6.5" HD+)비 향상된 대화면 경험 제공 - 50MP 카메라 적용하여 전작(A12 48MP)비 고화소 사진 촬영 가능 - 5,000mAh 고용량 배터리 및 AI Power mode 적용하여 1회 충전으로 2 Days 사용 가능 |
| | | <input type="checkbox"/> Galaxy A73 5G (2022.04.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.7" FHD+ Super AMOLED+ (1080 x 2400) 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.1mm x 163.7mm x 7.6mm, 181g - Platform(H/W, S/W) : SDM778G, Android 12, One UI 4.1 - 108MP 고해상도 화질 및 OIS 지원으로 선명하면서도 어두운 곳에서 흔들림 없는 사진 촬영 가능 - 120Hz 고주사율과 sAMOLED display 적용으로 부드럽고 선명한 화면 경험 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용(2 days battery) 및 25W 초고속 충전 지원 - Gorilla Glass 5 및 IP67등급 적용으로 강력한 내구성 제공 - One UI 4.1 지원으로 최신 Flagship 경험 제공 |
| | | <input type="checkbox"/> Galaxy A53 5G (2022.04.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.5" FHD+ Super AMOLED (1080 x 2400) 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 74.8mm x 159.6mm x 8.1mm, 189g - Platform(H/W, S/W) : Exynos1280, Android 12, One UI 4.1 - 8.1t 슬림 디자인 및 5,000mAh 대용량 배터리 적용 (전작비 0.3t↓, 500mAh↑) - 120Hz 고주사율과 빠른 반응속도의 sAMOLED 조합이 제공하는 부드럽고 선명한 화면 경험 - Gorilla Glass 5 적용으로 Glass 내구성 향상 - One UI 4.1 지원으로 최신 Flagship 경험 제공 |
| | | <input type="checkbox"/> Galaxy A33 5G (2022.04.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.4" FHD+ Super AMOLED (1080 x 2400) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 74.0mm x 159.7mm x 8.1mm, 186g - Platform(H/W, S/W) : Exynos1280, Android 12, One UI 4.1 - 6.4" FHD+ 디스플레이, 90Hz 지원으로 향상된 화면 경험 제공 (전작 A32-5G HD+ TFT 60Hz) - 48MP OIS 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능 - Gorilla Glass 5 적용, IP67 등급의 방수&방진 지원으로 내구성 향상 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - 5,000mAh 대용량 배터리 적용(2 days battery) 및 25W 초고속 충전 지원 |
| | | <input type="checkbox"/> Galaxy A23 5G (2022.09.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ TFT LCD (1080 x 2400) 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.9mm x 165.4mm x 8.4mm, 197g - Platform(H/W, S/W) : SDM695, Android 12, One UI 4.1 - SDM695 적용하여 전작(A22-5G MT6833V) 대비 AP 성능 강화 - 50MP OIS 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능 (NA 권역 OIS 미지원) - 6.6" FHD+ 적용하여 전작(A22-5G 6.6" HD+ 90Hz) 대비 향상된 대화면 경험 제공 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용(2 days battery) 및 25W 고속충전 지원 |
| | | <input type="checkbox"/> Galaxy A14 5G (2023.01.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ TFT LCD (2408 x 1080) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 78.0 x 167.7 x 9.1mm, 205g - Platform(H/W, S/W) : MT6833V/Exynos1330, Android 13, One UI core 5.1 - 전작 (A13-5G) 대비 고사양 Front camera 적용으로 고화소 사진촬영 가능 (5MP → 13MP) - 6.6" FHD+ 대화면 디스플레이 적용으로 전작(A13-5G 6.5" HD+) 대비 향상된 화면 경험 제공 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용 |
| | | <input type="checkbox"/> Galaxy A54 5G (2023.03.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.4" FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 19.5:9 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.7 x 158.2 x 8.2mm, 202g - Platform(H/W, S/W) : Exynos1380, Android 13, One UI 5.1 - AP 화질 개선 기능, 조도별 튜닝 세분화 및 1000nit 적용을 통한 시인성 향상 - 120Hz 최적의 주사율 제공을 통한 성능 및 배터리 효율 극대화 - Linear 모터의 정교한 진동 조절을 통한 풍부한 Haptic 경험 제공 - Balanced Design 및 Premium CMF 강화 (6.4", 19.5:9 적용) - One UI 5.1 지원으로 최신 Flagship 경험 제공 |
| | | <input type="checkbox"/> Galaxy A34 5G (2023.03.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 120Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 78.1 x 161.3 x 8.2mm, 199g - Platform(H/W, S/W) : MT6877V, Android 13, One UI 5.1 - 6.6" FHD+, 1,000nit 휘도, 120Hz 주사율 지원으로 향상된 화면 경험 제공 - 48MP OIS 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능 - Linear Motor 탑재하여 플래그십 수준의 햅틱 경험 제공 |
| | | <input type="checkbox"/> Galaxy A14 (2023.03.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.6" FHD+ TFT LCD (2408 x 1080) 60Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 78.0 x 167.7 x 9.1mm, 201g - Platform(H/W, S/W) : Exynos850/MT6769V, Android 13, One UI core 5.1 - 전작 (A13) 대비 고사양 Front camera 적용으로 향상된 Selfie 경험 제공 (8MP → 13MP) - 5,000mAh 대용량 배터리 적용 |
| | | <input type="checkbox"/> Galaxy A24 (2023.05.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 6.5" FHD+ sAMOLED U-Cut (1080 x 2340) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 77.6mm x 162.1mm x 8.3mm, 195g - Platform(H/W, S/W) : MT6789V, Android 13, One UI core 5.1 - 전작(A23) 대비 고사양 Front camera 적용으로 향상된 Selfie 경험 제공 (8MP → 13MP) - 신규VDIS 적용으로 OIS와 함께 진보된 흔들림 없는 비디오 제공 - 전작(A23) 대비 야외 시인성 향상, 넓어진 색대역 등으로 밝고 편리한 화면 경험 제공 |
| | 갤럭시북 (~2023.02.) | <input type="checkbox"/> Galaxy Book Go (2021.04.) <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 14" FHD (1920 x 1080) |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 323.9mm x 224.8mm x 14.9mm, 1,380 g - Platform : 2세대 스텡드래곤 7C, Windows 10 - 언제 어디서나 인터넷이 가능한 LTE 지원 - 휴대에 최적화된 슬림 디자인 (14.9mm 두께) - Dolby Atmos 적용으로 풍성한 사운드 - 긴 배터리 사용시간 (up to 18 hours battery life) - Tablet, Phone 연결성 강화 <ul style="list-style-type: none"> • Quick Share : Phone, Tablet의 파일을 손쉽게 공유 • Second Screen : Tablet을 PC의 보조 모니터로 사용 • Galaxy Book Smart Switch : 기존 노트북의 데이터를 간편하게 전송 • SmartThings : 스마트 기기 연동 <hr/> <p>☐ Galaxy Book2 Pro 360 (2022.04.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 15.6" FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120% 13.3" FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120% - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 15.6" 354.85 x 227.97 x 11.9mm, 1.41kg 13.3" 302.5 x 202 x 11.5 mm, 1.04kg - Platform, OS : Intel 12세대 CPU (EVO Verified by Intel), Windows 11 - sAMOLED : Default 370nit/HDR 500nit, Color volume 120% - S Pen & Touchscreen support - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing 지원) - SSD : Gen4 SSD , Expendable SSD (M.2 2230) - WiFi 6E 지원 - Battery : 15.6" 68Wh (21hrs), 13.3" 63Wh (21hrs) - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control 등 <ul style="list-style-type: none"> • QR Sign-in : 폰에 사용중인 계정과 연동된 QR 인식으로 갤럭시북에 로그인 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원 <hr/> <p>☐ Galaxy Book2 Pro (2022.04.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 15.6" FHD AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120% 13.3" FHD AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120% - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 15.6" 355.4 x 225.8 x 11.7mm, 1.11kg 13.3" 304.4 x 199.8 x 11.2mm, 0.87kg - Platform, OS : Intel 12세대 CPU (EVO Verified by Intel), Windows 11 - AMOLED : Default 400nit/HDR 500nit, Color volume 120% - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing 지원) - SSD : Gen4 SSD, Expendable SSD (15.6" Only, M.2 2280) - WiFi 6E, 5G Sub6 (15.6" Only) 지원 - Battery : 15.6" 68Wh (21hrs), 13.3" 63Wh (21hrs) - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control 등 <ul style="list-style-type: none"> • QR Sign-in : 폰에 사용중인 계정과 연동된 QR 인식으로 갤럭시북에 로그인 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원 <hr/> <p>☐ Galaxy Book2 Go 5G (2022.12.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 14" IPS (1920 x 1080) - 사이즈(W x H x D) : 323.6mm x 224.8mm x 15.5mm - Platform : WoA 7C+ Gen3, Window 11 - 7C+ Gen3 적용 Mass WoA 제품 개발 (7C Gen2 대비 CPU 63%↑, GPU 102%↑) - Display 화질개선 (TN → IPS) - WiFi 6E, 5G Sub6 지원 |
|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 보급형ENDC/eSIM지원 5G 모델 도입 - 45W 충전 지원 - MIL-STD-810H 8개 항목 보증 <ul style="list-style-type: none"> · Shock, High/Low Temperature, Thermal Shock, Dust, Vibration, Low pressure, Humidity <hr/> <p><input type="checkbox"/> Galaxy Book2 Pro 360(2023) (2022.12.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 13.3" FHD AMOLED (16:9), Touch Screen, Color Volume(DCI-P3) 100%, S Pen - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 13.3" 302.5 x 202.0 x 11.5mm, 1.04kg - Platform, OS : Qualcomm Snapdragon 8cx Gen3, Windows 11 Home - AMOLED : 13.3" FHD Super AMOLED (16:9), Color Volume(DCI-P3) 100%, up to 370nit, S Pen - Speakers : Stereo 2 x 4W (Smart AMP), AKG, Dolby Atmos - SSD : eUFS on board, 256GB - WiFi 6E (802.11ax) - Battery : 63Wh (Video Play 35hrs↑) - Galaxy ecosystem : Smart Switch, Samsung Account, Samsung Apps, <ul style="list-style-type: none"> Keyboard & Touch Pad Sharing between Galaxy devices - Security : 지문 인식, Secured Core PC (Level 3, H/W & F/W Protection) - AI : Noise Reduction, Video Call with Neural Engine <hr/> <p><input type="checkbox"/> Galaxy Book3 Ultra (2023.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16.0" OLED 120Hz, 370nit/500nit, 16:10 (2880 x 1800, 3K) - 사이즈(W x D x H) : 355.4 x 250.5 x 16.5mm, 1.79kg, - 인텔 RPL-H i7/i9, Win 11, LPDDR5, nVidia RTX 4050/4070, 76W Battery, FHD MIPI Camera, A/C/D AI, B Glass, TA 100W - 13세대 Intel® Core™ H-프로세서와 차세대 NVIDIA® GeForce RTX™ 40 시리즈 그래픽 적용 - WQXGA+를 적용한 3K 고해상도 디스플레이, 컬러 볼륨 120% - 39% 더 넓어진 터치 패드 (갤럭시 북2 Pro 33.7 cm / 39.6cm 대비) - 100W 고속 충전, 30분 충전 시 55% 충전 가능 - Quad Speaker : AKG와 Dolby Atmos 적용 - Galaxy Ecosystem 적용 <ul style="list-style-type: none"> · Multi Control : 키보드와 마우스를 스마트폰, 탭에서도 사용할 수 있고, 기기 간 파일을 옮기거나, 문서/이미지의 복사, 붙여넣기도 가능 · Second Screen : Galaxy Tab을 듀얼 모니터처럼 활용, PC 화면 확장 또는 복제 가능 · Quick Share : 폰/태블릿 등 갤럭시 기기 간 무선 파일 공유 <hr/> <p><input type="checkbox"/> Galaxy Book3 Pro 360 (2023.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16.0" WQXGA+ AMOLED (16:10) 2880 x 1800, Touch Screen, DCI-P3 100%, S Pen - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 16.0" 355.4 x 252.2 x 12.8mm, 1.69kg - Platform, OS : Intel 13세대 CPU (EVO Verified by Intel), Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120% - S Pen & Touchscreen support - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing지원) - Quad SPK(AKG/Dolby, Max_5Wx2, 2Wx2), Studio Gade Dual Mic - SSD : Gen4 SSD - WiFi 6E 지원 - Battery : 76Wh - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control, Samsung Pass등 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원 <hr/> <p><input type="checkbox"/> Galaxy Book3 Pro (2023.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 16" WQXGA+ AMOLED (16:10), up to 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120% |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--------------------|---|
| | | | <p>14"WQXGA+ AMOLED (16:10), up to 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120%</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 16"355.4 x 250.4 x 12.5mm, 1.56kg <li style="padding-left: 40px;">14"313.3 x 223.8 x 11.3mm, 1.17kg - Platform, OS : Intel 13세대 CPU (EVO Verified by Intel), Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880 x 1800), 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120% - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing지원) - Quad SPK(AKG/Dolby, Max_5Wx2, 2Wx2), Studio Grade Dual Mic - SSD : Gen4 SSD, Expendable SSD (M.2 2280) - WiFi 6E 지원 - Battery : 16"76Wh, 14"63Wh - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control, Samsung Pass등 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원 <hr/> <p><input type="checkbox"/> Galaxy Book3 360 (2023.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : 15.6"FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), DCI-P3 120% <li style="padding-left: 40px;">13.3"FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), DCI-P3 120% - 사이즈(W x H x D) & 무게 : 15.6"355.4 x 228.0 x 13.7mm, 1.46kg <li style="padding-left: 40px;">13.3"304.4 x 202.0 x 12.9 mm, 1.16kg - Platform, OS : Intel 13세대 CPU (EVO Verified by Intel), Windows 11 - sAMOLED: 1080p FHD, 500nit(HDR), 60Hz, DCI-P3 120% - S Pen & Touchscreen support - 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing지원) - Stereo SPK(Dolby, 2Wx2), Studio Grade Dual Mic - SSD : Gen4 Dramless SSD, Expendable SSD (15.6") - WiFi 6E 지원 - Battery : 15.6"68Wh, 13.3"61.1Wh - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control, Samsung Pass등 - Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원 <hr/> <p><input type="checkbox"/> Galaxy Watch4 & Galaxy Watch4 Classic(2021.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치: Watch4 : (44mm) 1.4" (450 x 450), (40mm) 1.2"(396 x 396) <li style="padding-left: 40px;">Watch4 Classic : (46mm) 1.4" (450 x 450), (42mm) 1.2"(396 x 396) - 사이즈(W x H x D) : Watch4 : (44mm) 44.4 x 43.3 x 9.8mm, (40mm) 40.4 x 39.3 x 9.8mm <li style="padding-left: 40px;">Watch4 Classic : (46mm) 45.5 x 45.5 x 11.0mm, (42mm) 41.5 x 41.5 x 11.2mm - Platform(H/W, S/W) : AP Exynos W920(5나노 64비트 Dual-Core), <li style="padding-left: 40px;">Wear OS Powered By Samsung, One UI Watch 버전 3.0 - Memory : 1.5GB RAM + 16GB ROM 탑재하여 성능 개선 및 사용자 가용량 확대 제공 - 330 ppi Display 적용을 통한 가독성 개선 - 체성분 측정 기능 최초 탑재 및 Health 사용성 강화로 차별화 추진 - 산소포화도, 코골이 등 수면 상태 모니터링 강화 - Wear OS 기반 App Eco 확장 및 Phone 연동 경험 강화 <li style="padding-left: 20px;">· Play store/구글맵/YT Music 등 구글 주요 서비스 제공 <li style="padding-left: 20px;">· 최적화된 Fitness 전용 앱 및 다양한 서비스 앱 지원 <hr/> <p><input type="checkbox"/> Galaxy Watch5 & Galaxy Watch5 Pro(2022.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인치 : Watch5 Pro (46mm) : 34.6mm AMOLED (450 x 450) 330PPI <li style="padding-left: 40px;">Watch5 (44mm) : 34.6mm AMOLED (450 x 450) 330PPI <li style="padding-left: 40px;">Watch5 (40mm) : 30.4mm AMOLED (396 x 396) 330PPI - 사이즈(W x H x D) & 무게 : Watch5 Pro (46mm) : 45.4 x 45.4 x 10.5 mm, 46.5g <li style="padding-left: 40px;">Watch5 (44mm) : 44.4 x 43.3 x 9.8 mm, 33.5g |
| | | 갤럭시 워치 (~2022.08.) | |

| | | | |
|--|--|-----------------------|---|
| | | | <p>Watch5 (40mm) : 40.4 x 39.3 x 9.8 mm, 28.7g</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W) : Exynos W920, Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 3.5) - 사파이어 크리스탈 디스플레이 적용한 시그니처 원형 디자인 - 진화된 바이오액티브 센서 탑재로 더 강력해진 통합 건강 관리 기능 <ul style="list-style-type: none"> · 체성분, 심박, 혈압, 심전도 정확도 개선 및 수면 관리 기능 강화 - Wear OS 기반의 'One UI Watch 4.5' 탑재하여 다양한 구글 모바일 서비스와 앱 활용 - 프리미엄 소재 티타늄 바디, 향상된 GPS 성능으로 아웃도어 스포츠에 최적화 (Watch5 Pro) <ul style="list-style-type: none"> · 기능 향상과 내구성 제고하여 하이킹/사이클링과 같은 아웃도어 스포츠 활용도 제고 · 마그네틱 D-버클 스포츠 밴드 제공하여 내구성, 편의성 및 스타일리시한 모습 연출 · 경로운동(Route Workout) 및 GPX(GPS Exchange Format) 파일 이용한 운동경로 저장 및 공유 · 트랙백(Track back) 기능 통해 지나왔던 길찾기 제공 · 큰 용량 배터리(590mAh) 적용으로 장시간 아웃도어 활동 가능 |
| | | 갤럭시 버즈 (~2022.08.) | <p>☐ Galaxy Buds Pro (2021.01.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Design : Intelligent ANC 기능을 갖춘 커널 타입 Premium TWS - 사이즈(W x H x D) : (Earbuds) 20.5 x 19.5 x 20.8mm, (Cradle) 50.0 x 50.2 x 27.8mm - Platform(H/W, S/W) : BCM43015, RTOS - 2Way(Woofers + Tweeter) 11mm 스피커 탑재를 통한 사운드 품질 향상 <ul style="list-style-type: none"> · 3개의 마이크와 가속도 센서 (보이스 픽업 유닛) 탑재로 우수한 통화품질 제공 · 커널 타입 및 Intelligent ANC 기능 탑재 및 대화감지를 통해 주변소리 듣기로 자동 전환 · 영화관에 온 듯한 공간감을 느낄 수 있는 3D Audio 기능 제공 - IPx7 등급 방수 지원 |
| | | | <p>☐ Galaxy Buds 2 (2021.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기본기능 강화와 ANC기능 추가로 Buds Mass모델의 경쟁력 강화 - 사이즈(W x H x D) : (Earbuds) 17.0 x 20.9 x 21.1 mm (Cradle) 50.0 x 50.2 x 27.8 mm - BES2500 ZP-83 (BT + Codec + Flash) 저전력 신규 솔루션 <ul style="list-style-type: none"> · ANC 기능 제공 · 음악 재생 총 사용시간 29시간 확보 (Streaming, ANC OFF 기준) - Touch + BT Antenna FPCB 일체형 적용하여 RF 방사 성능 최적화 - Canal형 무선 이어폰 Audio 성능 고도화 <ul style="list-style-type: none"> · DNN 활용 통화 잡음 제거 성능 극대화 알고리즘 적용(DNN + 3-Mic +VPU) * DNN : Deep Neural Network , VPU : Voice Pickup Unit · 자연스러운 주변소리듣기 모드 전환 지연 속도 개선(3.2ms→0.65ms) · Woofer 진동판 신소재 적용을 통한 저역 강화 · 무결점 Mic 단품 도입으로 Mic 노이즈 차단 강화 · 통기홀 밀도 변경 및 FeedBack Mic 관로 개선을 통한 ANC 성능 및 음질 개선 · Mic 챔버 공간 극대화 및 위치 최적화를 통한 Wind Noise 개선 |
| | | | <p>☐ Galaxy Buds 2 Pro (2022.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24bit 고품질 Hi-Fi 사운드와 편안한 착용감을 제공하는 커널 타입Premium TWS - 사이즈(W x H x D) : (Earbuds) 21.6mm x 19.9mm x 18.7mm (Cradle) 50.2mm x 50.1mm x 27.7mm - Platform(H/W, S/W) : BES2700YP 1Chip솔루션, RTOS <ul style="list-style-type: none"> · 당사 Buds 최초24bit/48kHz Hi-Fi기술 적용하여 원본 음질 손실을 최소화한 고품질 사운드 경험All High-SNR MIC, 소음 제거 솔루션과 대화 감지 기술을 적용한 Intelligence ANC · 멀티 채널 오디오와 향상된 헤드 트래킹 기술을 통해 현장감 있는360 Audio 청취 경험 강화 · 개선된VPU와 개인화Beamforming 기술을 통해 또렷하고 향상된 통화 음질 제공 |

| | | | |
|-------|----------------------------|-------------------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 인체공학적 디자인을 통해 편안하고 안정감 있는 착용감 제공 · 전작 대비 15% 작아진 기기 사이즈와 개선된 통기홀 구조를 적용하여 착용감 개선 - Galaxy Device간 쉬운 연결을 통한 사용 경험 강화 · 오토 스위치 기능 제공을 끝, 태블릿, 위치에서 TV로 확장하고 쉽고 빠르게 기기 전환 |
| 네트워크 | 기지국 (2021.02.~2023.05.) | RAN S/W Package (2021.06.) | <input type="checkbox"/> SVR21B NR vDU SW Package (2021.06.) <ul style="list-style-type: none"> - TDD 기반 C-Band vDU · H/W 변경없이 유연한 기지국Upgrade 및 자원 할당 가능 * vDU(virtual DU): 5G 기지국 기능을 상용 서버 기반의 S/W 개발로 구현 |
| | | | <input type="checkbox"/> MMU Beam Forming SOC 개발 (2021.02.) <ul style="list-style-type: none"> - MMU 보드 내 Beam Forming FPGA가 수행하는 기능을 SOC로 구현 - 기존 소모 전력의30% 수준으로 감축(최대 소모전력40W 이하) <input type="checkbox"/> 미주 ORAN* RU 5종 개발 (2021.09.) <ul style="list-style-type: none"> - DU-RU간 표준 interface를 정의하여, DU에서 RU 벤더에 상관없이 연동가능 - AWS/PCS, 700/850 4T4R 40W 2종, 320W 2종, C-Band 8T8R 320W <input type="checkbox"/> 북미향 AWS/PCS Dual Band 16T16R FDD MMU (2021.10.) <ul style="list-style-type: none"> - 당사 최초16T16R FDD Dual Band MMU 상용 제품(자체 개발 Chip 적용) <input type="checkbox"/> 국내 3.5GHz NR 32T32R TDD MMU (2022.02.) <ul style="list-style-type: none"> - 당사 최초 Mechanical PSA(Phase Shift Antenna) 적용 * 안테나 기울기(Tilt 0~12°)를 MMU 내부에서 Motor로 자동 제어 <input type="checkbox"/> 고성능 RFIC + DFE 통합 Chip 개발 (2022.04) <ul style="list-style-type: none"> * RFIC(Radio Frequency Integrated Circuit): 무선통신에 적합한 고주파 집적 회로 * DFE(Digital Front End): 통신을 위한 Digital 신호처리의 마지막 단계 <input type="checkbox"/> Dish향 FDD RU 2종(Dual Band/Tri Band RU) (2022.09) <ul style="list-style-type: none"> - ORAN 표준을 준수하고 여러 주파수 대역을 동시에 지원하는 5G FDD RU 제품 개발 * RU 지원 주파수 : n71(600MHz), n29(700MHz), n66(AWS: 1.7GHz/2.1GHz), n70(AWS: 1.7GHz/1.9GHz) <input type="checkbox"/> Gen.3 Dual Band NR 2T2R AU (2022.10.) <ul style="list-style-type: none"> - 세계 최초 Dual Band(28GHz+39GHz) AU 개발 - 기존 2세대 AU 대비 동일 사이즈에 출력 2배 향상, 용량 2배 확대로 제품 성능 개선 <input type="checkbox"/> 국내 3.5GHz NR 64T64R MMU (2022.11.) <ul style="list-style-type: none"> - 국내향 최초 상용 64T64R Massive MIMO MMU 개발 - 기존 국내향 32T32R MMU(구형) 대비 Antenna Element 2배 증가, 출력 2.7배 증가 <input type="checkbox"/> 3.5GHz CBRS NR Strand Smallcell (2023.03.) <ul style="list-style-type: none"> - 당사 최초 상용 Strand Smallcell(전선 설치형 소형 기지국) 개발 - Digital Unit, Radio Unit, 안테나 기능을 하나의 form factor로 제공하는 기지국 - 당사가 자체 개발한 최신 2세대 5G 모뎀칩(5G Modem SoC) 탑재하여, 전선 위 설치 가능하도록 소형화 <input type="checkbox"/> 북미향 C-band NR 64T64R MMU (2023.05.) <ul style="list-style-type: none"> - 1세대 대비 고출력화, 소형화, 경량화, 저전력화 개발 |
| DS 부문 | 메모리 | 모바일용 DRAM (2021.11.~2022.10.) | <input type="checkbox"/> 업계 최초 LPDDR5X D램 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 제품 대비 속도 30% 이상, 소비전력 효율 약 20% 개선 - 업계 최선단 14나노 기반, 단일 패키지 용량 64GB까지 확대 가능하여 모바일 외, 서버/Automotive 등 고성능 저전력 메모리 적용 분야 확대 - 퀄컴 스냅드래곤 모바일 플랫폼에 8GB LPDDR5X D램 패키지 탑재해 업계 최고 동작 속도(8.5Gbps) 검증 |
| | | 서버용 DRAM (2021.03.~2023.05.) | <input type="checkbox"/> 업계 최초 HKMG 공정 적용 고용량 DDR5 메모리 개발 <ul style="list-style-type: none"> - High-K Metal Gate, 8단 TSV 적용으로 512GB DDR5 모듈 구현 - 기존 공정 대비 약 13% 전력소모 낮추고, 성능은 2배 이상 향상 - 차세대 컴퓨팅, 슈퍼컴퓨터, 대용량 데이터센터 등에 적용 예정 |

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| | | <input type="checkbox"/> 업계 최선단 12나노급 D램 양산('23.5월) <ul style="list-style-type: none"> - 14나노 D램 대비 생산성 향상 및 저전력 특성 개선으로 생산성 약 20% 향상, 소비전력 약 23% 감소로 차세대 컴퓨팅 최적화 - 고유전율 신소재 적용 커패시터 등 최신 기술 적용 최선단 공정 완성 - 대용량 컴퓨팅 시장 수요에 맞는 고성능, 고용량 D램 솔루션 제공 및 12나노급 D램 라인업 확대해, 다양한 응용처에 공급 예정 |
| | 그래픽 DRAM (2022.07.~2022.11.) | <input type="checkbox"/> 업계 최고 속도 GDDR6 D램 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 3세대 10나노급(1z) 공정 적용으로 업계 최초 24Gbps 구현 - 기존 제품 대비 성능 30% 이상 높여 초당 최대 1.1TB 데이터 처리, 1.1V 동작전압 지원, 전력 효율 20% 높여 다양한 고객 요구 충족 - 국제 반도체 표준화 기구 JEDEC의 표준규격 준수해 호환성 확보 - 차세대 그래픽카드, 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 응용처 확대 <input type="checkbox"/> 첨단 패키징 기술을 활용한 그래픽 메모리 GDDR6W 개발 <ul style="list-style-type: none"> - GDDR6W는 새로운 메모리 칩 다이(die)의 개발 없이 적층, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer level Package) 기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6와 동일한 크기의 패키지로 성능(대역폭) 2배와 용량 2배를 구현 |
| | HBM DRAM (2021.02.~2022.10.) | <input type="checkbox"/> 세계 최초로 AI 엔진을 탑재한 인공지능 HBM-PIM 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 HBM2 대비 성능 2배 이상 향상, 시스템 에너지 약 70% 이상 감소 - 반도체 분야 최고 권위 학회 ISSCC에서 논문 공개('21.2월) - 기존 메모리 인터페이스 사용으로 별도 시스템 변경없이 적용 가능 - 데이터센터, AI 고객들과 PIM 표준화, 에코 시스템 구축 협력 <input type="checkbox"/> 인공지능 탑재 메모리 제품군 확대 (HBM-PIM 성능 평가결과 및 AXDIMM/LPDDR5-PIM 개발) <ul style="list-style-type: none"> - 지난 2월 개발한 HBM-PIM 실제 시스템 적용 사례 공개 (자일링스 AI 가속시스템에 탑재시 성능 2.5배, 에너지사용 60% 이상 감소) - D램 모듈에 AI 기능 탑재한 AXDIMM은 기존 대비 성능 2배, 에너지사용 40% 감소 - 모바일 D램과 PIM 기술을 결합한 LPDDR5-PIM 공개 <input type="checkbox"/> HBM-PIM과 GPU를 함께 탑재한 AI용 가속기 구현 <ul style="list-style-type: none"> - AMD의 GPU 가속기 카드에 HBM-PIM 메모리를 탑재하여 HBM-PIM Cluster 구현 - HBM-PIM을 활용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 감소 - HBM-PIM 탑재한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 통합된 소프트웨어 환경에서 PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 |
| | NAND (2022.11.) | <input type="checkbox"/> '8세대 V낸드' 양산 <ul style="list-style-type: none"> - 세계 최고 용량의 '1Tb(테라비트) 8세대 V낸드' 양산 - 웨이퍼당 비트 집적도 대폭 향상, 업계 최고 수준 비트 밀도 확보 - 차세대 인터페이스 적용, 2.4Gbps 전송 속도 구현으로 기존대비 성능 1.2배 향상 - 차세대 서버시장 고용량화 주도, 고신뢰성 요구하는 전장 시장까지 사업 영역 확대 |
| | eStorage (2022.05.) | <input type="checkbox"/> 업계 최고 성능 UFS 4.0 개발 <ul style="list-style-type: none"> - UFS 3.1 제품 대비 읽기/쓰기 속도 약 2배로 개선 - 동일한 데이터 처리시, 전력효율 약 46% 향상되어 장시간 사용 가능 - 최신 보안 기술 적용하여 고객들의 중요 데이터를 읽고 저장하는 성능 개선 - 스마트폰, Automotive 및 VR/AR 등 컨슈머 기기로의 확대 예상 |
| | 서버용 SSD (2021.02.~2022.07.) | <input type="checkbox"/> 데이터센터 전용 고성능 OCP SSD 양산 <ul style="list-style-type: none"> - 6세대 V낸드로는 업계 최초로 OCP 규격의 SSD 양산 - 데이터센터 업계가 요구하는 성능, 전력효율, 신뢰성, 보안 모두 만족 - 업계 최고 전력효율 특성으로 비용 절감 및 탄소 저감 효과에 기여 |

| | | | |
|--|--------------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 업계 최고 성능 SAS 24Gbps 서버용 SSD 양산 <ul style="list-style-type: none"> - 이전 세대 SSD 대비 약 2배 향상된 속도 지원 - 6세대 V낸드 기반으로 800GB 부터 30.72TB까지 고용량 제공 - 전력효율 약40% 향상되어 서버 운영 비용 절감 및 탄소 저감 효과 기대 <input type="checkbox"/> 차세대 기업 서버용 ZNS SSD 업계 최초 양산 <ul style="list-style-type: none"> - 데이터 성격에 따라 구역(Zone)별로 분류하여 저장하는 ZNS 기술 적용 - 기존 SSD 대비 수명연장 및 SSD 용량 최대 활용 - AI, 빅데이터, IOT등 차세대 서버/스토리지 시스템 효율 제고에 기여 및 다양한 오픈소스 프로젝트 활동으로 ZNS SSD 저변 확대 <input type="checkbox"/> PCIe 5.0 기반 고성능 SSD PM1743 개발 <ul style="list-style-type: none"> - PCIe 4.0 기반 SSD 대비 읽기/쓰기 속도 약 2배 및 전력효율 약 30% 개선 - 듀얼포트 지원 및 최신 보안 기술 적용으로 서버 운영 안전성 보장 <input type="checkbox"/> 연산기능 강화한 '2세대 스마트SSD' 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 연산 성능 2배 향상, 처리시간 50% 이상, 에너지 70%, CPU 사용 97% - SSD 내에서 데이터 처리, 시스템 성능과 에너지 효율 동시에 향상 - 데이터베이스, 비디오 트랜스코딩 등 다양한 시장 요구에 적극 대응 - 컴퓨테이션 스토리지 표준화 주도, 차세대 스토리지 제품 개발 확대 |
| | Client SSD (2023.01.) | | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 5나노 기반 컨트롤러 탑재한 PC용 고성능 SSD 'PM9C1a' 양산 <ul style="list-style-type: none"> - 5나노 기반 신규 컨트롤러와 7세대 V낸드 탑재로 성능 향상 - 기존 대비 속도 최대 1.8배, 전력 효율 최대 70% 가량 향상 - DICE 표준 신규 적용 등 보안솔루션 강화로 디바이스 인증, 증명 기술 지원 |
| | 브랜드 SSD (2021.01.~2022.08.) | | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 소비자용 SATA SSD 870 EVO 글로벌 출시 <ul style="list-style-type: none"> - 최신 V낸드, 컨트롤러 탑재, 인텔리전트 터보라이트 기술 적용 - 업계 최고 수준 내구성 보유, 지속성능 30% 이상 향상 - 250GB~4TB까지 5개 모델로, 한국·미국·독일·중국 등 40여개국 순차 출시 <input type="checkbox"/> 성능과 경제성을 모두 만족한 고성능 NVMe SSD 980 출시 <ul style="list-style-type: none"> - 6세대 V낸드 탑재, SATA SSD 대비 최대 6배 빠른 성능 제공 - 비용을 고려한 DRAMless 설계와 컨트롤러, 펌웨어 최적화 기술 적용 - 하이엔드 제품에 적용되는 열 제어 기능 탑재 - 970 EVO 대비 전력효율 56% 향상, 소비자들 '착한 소비' 가능 <input type="checkbox"/> 성능과 내구성 모두 갖춘 전문가용 포터블 SSD 'T7 실드(Shield)' 출시 <ul style="list-style-type: none"> - 방수, 방진, 최대 3미터 낙하 보호 설계 - 고화질 영상 녹화, 편집 등의 성능 저하 없이 안정적으로 데이터 전송 <input type="checkbox"/> 게이밍에 최적화된 고성능 SSD '990 PRO' 공개 <ul style="list-style-type: none"> - 최신 V낸드 기술과 독자 컨트롤러로 업계 최고 수준 성능 구현 - 전작보다 속도 최대 55%, 전력 효율 최대 50% 향상 - 고성능 그래픽 게임, 4K/8K 고화질 비디오 등 초고속 데이터 처리 작업이 요구되는 환경에 최고 성능 제공 |
| | EUV (2021.10.) | | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 업계 최선단 14나노 EUV DDR5 D램 양산 <ul style="list-style-type: none"> - EUV 멀티레이어 적용 및 업계 최고 웨이퍼 집적도 구현으로 생산성 약 20% 향상 - DDR4 대비 속도 2배 및 이전 공정 대비 소비전력 약 20% 개선 |
| | CXL (2021.05.~2023.05.) | | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 업계 최초 CXL 기반 DRAM 메모리 기술 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 대용량 데이터센터가 요구하는 차세대 메모리 솔루션으로 DRAM 모듈의 물리적 한계 극복, 용량 대역폭의 획기적인 확장 가능 - CXL 컨트롤러를 통해 인터페이스 컨버팅, 예러 관리 등 지원 - 데이터센터, 서버, 칩셋 업체들과 협력으로 CXL DRAM 메모리에 최적화된 컨트롤러, 소프트웨어 기술 개발 <input type="checkbox"/> 업계 최초 CXL 메모리 오픈소스 소프트웨어 솔루션 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 메인 메모리와 CXL 메모리가 최적으로 동작할 수 있도록 지원하여 시스템 메모리의 성능/용량 확장 가능 |

| | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------|---|
| | | | <p><input type="checkbox"/> 업계 최초 고용량 512GB CXL D램 개발</p> <ul style="list-style-type: none"> - CXL D램 용량 4배 향상, 서버 한 대당 수십 테라바이트 이상 확장 가능 - CXL 전용 컨트롤러 탑재, 데이터 지연 시간 1/5로 감소 <p><input type="checkbox"/> 고용량 AI 모델을 위한 CXL 기반의 PNM 솔루션 개발</p> <ul style="list-style-type: none"> - PNM(Processing-near-Memory)은 연산기능을 메모리 옆에 위치시켜 CPU-메모리간 발생하는 병목현상을 줄이고 시스템 성능 개선 - 높은 메모리 대역폭을 요구하는 추천 시스템이나 인-메모리 데이터베이스 등의 응용에서 약 2배 이상 성능이 향상 <p><input type="checkbox"/> 업계 최초 'CXL 2.0 D램' 개발</p> <ul style="list-style-type: none"> - D램 모듈의 한계 극복, 대역폭과 용량 확장 가능 - CXL D램 영역을 분할 사용하는 '메모리 풀링' 지원으로 서버 운영비용 절감 - 데이터센터, 서버, 칩셋 기업과 지속 협력해 CXL 생태계 확장 및 차세대 컴퓨팅 시장 수요 적기 대응으로 시장 선도 |
| | 복합칩 (2021.06.) | | <p><input type="checkbox"/> 업계 최고 성능의 uMCP5(LPDDR5 + UFS3.1) 멀티칩 패키지 양산</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기존 LPDDR4X 대비 속도 1.5배, UFS2.2 대비 2배 향상 - 중저가 5G 스마트폰까지 탑재하여 5G 대중화 견인 |
| | 브랜드 Card (2021.09.~2022.05.) | | <p><input type="checkbox"/> 성능·안정성을 강화한 마이크로 SD카드 신제품 출시</p> <ul style="list-style-type: none"> - 'PRO Plus'는 이전세대 대비 읽기 속도 약 1.6배, 쓰기 속도 약 1.3배 - 'EVO Plus'는 이전세대 대비 읽기 속도 약 1.3배 - 강화된 성능과 외부 충격에 강한 디자인 설계로 일반 소비자 뿐만 아니라 4K UHD 영상과 같은 고사양의 콘텐츠를 제작, 고객까지 만족 기대 <p><input type="checkbox"/> 성능과 내구성을 강화한 메모리카드 'PRO Endurance' 출시</p> <ul style="list-style-type: none"> - 서버급 고품질 낸드 채용, 16년 연속 녹화 가능한 내구성 - CCTV, 블랙박스 등 고해상도(4K, 풀HD) 영상 녹화장치에 최적화 - 극한 환경에서도 안정적 녹화 성능을 유지, 6-proof 보호 적용 - 클래스 10, UHS 클래스 U3, 비디오 스피드 클래스 V30 속도 지원, 풀HD·4K 고해상도 영상 연속 촬영 |
| | Automotive (2021.12.) | | <p><input type="checkbox"/> Automotive용 메모리 토털 솔루션 양산</p> <ul style="list-style-type: none"> - IVI용 256GB SSD, 2GB DDR4/GDDR6 및 AD용 2GB GDDR6, 128GB UFS - 서버급에 탑재되는 고성능 SSD와 그래픽D램 공급 및 차량용 반도체 시장에서 요구하는 높은 안정성 확보(영하 40℃~영상 105℃ 동작보증구간 지원) |
| | System LSI | 이미지센서 (2021.01.~2023.03.) | <p><input type="checkbox"/> 1억8백만화소 프리미엄 이미지센서 '아이소셀 HM3' 출시 (HM3, 0.8um/108Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0.8um 크기 작은 픽셀 1억 8백만개를 '1/1.33인치'에 집적 - '스마트 ISO 프로'로 간상 최소화, 밝고 선명한 이미지 촬영 가능 - 자동초점 최적 렌즈 탑재 '슈퍼 PD 플러스' 적용... 초점 검출 능력 50% 향상 - 설계 최적화로 프리뷰 모드 동작 전력 기존 대비 약 6% 절감 <p><input type="checkbox"/> 사람 눈과 더욱 가까워진 이미지센서 '아이소셀 GN2' 출시 (GN2, 1.4um/50Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 업계 최초, 픽셀을 대각선 분할하는 '듀얼 픽셀 프로' 적용 - 1.4um 픽셀 구조, 보다 밝고 선명한 이미지 촬영 - 스테퍼드 HDR, 기존 제품 대비 동작 전력 약 24% 감소 <p><input type="checkbox"/> 업계 최초 0.64um 픽셀 적용 '아이소셀 JN1' 출시(JN1, 0.64um/50Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 초소형 픽셀 크기 양산, 고화소 모바일 카메라 슬림 디자인 적용 - 어두운 곳에서 촬영 감도 높이는 최첨단 이미지센서 기술 적용 - 카메라 렌즈 모듈사 협력, 1/2.8" 제품과 호환 가능한 생태계 구축 <p><input type="checkbox"/> 차량용 이미지센서 '아이소셀 오토 4AC' 본격 출시(4AC, 3.0um/1.2Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 서라운드 뷰 모니터, 후방 카메라에 적용 예정 - 극한 환경에서도 운전자 보조, 사각지대를 최소화하는 안전 솔루션 <p><input type="checkbox"/> 초격차 모바일 이미지센서 신기술 공개(HP1, 0.64um/200Mp 및 GN5, 1.0um/50Mp)</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - 업계 최초 '2억화소' 벽을 넘어선 '아이소셀 HP1' - 업계 최초 크기의 듀얼 픽셀 이미지셀 '아이소셀 GN5' <input type="checkbox"/> 업계 최초 픽셀 크기의 2억화소 이미지센서 공개(HP3, 0.56um/200Mp) - 기존 HP1(0.64um)보다 12% 작아진 픽셀 크기로 카메라 모듈 면적 최대 20% 감소 - '슈퍼 QPD' 기술로 2억개 픽셀 모두 자동 초점 기능 구현 - '테트라 스캐어드 픽셀' 기술 활용, 저조도 환경에서도 선명한 화질 <input type="checkbox"/> 초고화소 기술 집약된 2억화소 이미지센서 출시(HP2, 0.6um/200Mp) - 업계 최초 '듀얼 버티컬 트랜스퍼 게이트' 적용, 색 표현력 및 화질 개선 - '테트라 스캐어드 픽셀' 기술 활용, 저조도 환경에서도 선명한 화질 - '듀얼 슬로프 게인' 적용, 업계 최초 5천만화소에서 센서 자체로 HDR 구현 - '슈퍼 QPD' 적용, 전 화소 이용 위상차 자동 초점 지원 |
| | <p>엑시노스 (2021.01. ~2023.06.)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 5G 통합 프리미엄 모바일AP '엑시노스 2100' 출시(엑시노스 2100) <ul style="list-style-type: none"> - 최첨단 5나노 EUV 공정 · 최신 CPU/GPU 적용, 성능 대폭 향상 - 설계 최적화로 전작 대비 성능 CPU 30%, GPU 40% 이상 개선 - 온디바이스 AI 성능 강화, 초당 26조번 인공지능(AI) 연산 - 소비전력 최대 20% 감소, 자체 전력 관리 솔루션 'AMIGO'도 적용 - 초고주파 대역 5G 통신 지원, 최대 6개 이미지센서 처리 등 <input type="checkbox"/> EUV(Extreme UltraViolet, 극자외선) 공정 기반 웨어러블용 '엑시노스 W920' 출시 <ul style="list-style-type: none"> - 최신 5나노 EUV 공정 및 설계 기술 적용으로 성능과 전력효율 향상 - 최첨단 패키지 기술을 적용, 웨어러블용 초소형 패키지로 구현 - 최신 ARM 코어 적용, 전세대(Exynos 9110) 대비 CPU 성능 20%, 그래픽 성능 10배 향상 - 저전력 디스플레이용 코어 탑재, AOD(Always On Display) 모드에서 프로세서 전력소모 97% 개선 <input type="checkbox"/> 업계 최초 5G 통신 서비스 제공하는 차량용 통신칩 '엑시노스 오토 T5123' 출시 <ul style="list-style-type: none"> - 초당 5.1Gb 다운로드 지원, 주행 중에도 끊김없이 고용량 · 고화질 콘텐츠 이용 가능 - 최신 5G 기반 멀티모드 통신칩 내장돼 5G 단독망 및 LTE 혼합망 모두 지원 <input type="checkbox"/> 차량 인포테인먼트용 프로세서 '엑시노스 오토 V7' 출시 <ul style="list-style-type: none"> - 신경망처리장치(NPU), 카메라 센서의 불량화소 및 왜곡 보정 기술, 이미지 압축기술 등 최신 차량용 기술 적용 - 그래픽 장치는 디지털 계기판, 중앙 정보 디스플레이(CID, Center Information Display), 헤드업 디스플레이(HUD, Head Up Display) 등 독립된 4개 디스플레이 구동 및 최대 12개의 카메라 센서 지원 - 보안 프로세서 탑재해 차량 주요 정보를 안전하게 보관 및 물리적 복제 방지 기술 제공 <input type="checkbox"/> 프리미엄 모바일 AP '엑시노스 2200' 출시 <ul style="list-style-type: none"> - AMD와 공동 개발한 차세대 GPU '엑스클립스(Xclipse)' 탑재, 게임 성능 및 전력 효율 극대화 - 업계 최초 모바일 기기에서 하드웨어 기반 '광선 추적(Ray Tracing)' 기술 구현 - ARM 최신 CPU 아키텍처 'Armv9' 기반 코어 적용하여 성능 및 보안 강화 - NPU 연산 성능 이전 대비 두 배 이상 향상, 머신러닝 성능 대폭 향상 <input type="checkbox"/> 5G 기반 위성통신용 모뎀 국제 표준기술 확보(NTN: Non Terrestrial Network) <ul style="list-style-type: none"> - 이동통신 표준화 기술협력기구(3GPP)의 최신 표준(릴리즈-17) 반영 - 저궤도 위성 위치 예측, 주파수 오류 최소화 기술 적용 - 간단한 문자 메시지 외 영상 등 대용량 데이터 양방향 송수신 가능 <input type="checkbox"/> UWB기반 근거리 무선통신용 반도체 '엑시노스 커넥트 U100' 공개 <ul style="list-style-type: none"> - 수 센티미터 이내, 5도 이하 정밀 측위 가능 - 저전력 원칙으로 모바일, 전장, 각종 IoT 기기에 최적화 - 해킹 방지 STS(Scrambled Timestamp Sequence) 기능 및 보안 HW 암호화 엔진 적용 - UWB 표준 단체 'FIRa 컨소시엄' 국제 공인 인증 |
| | LSI | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DDR5 D램 모듈용 전략관리반도체(S2FPD01, S2FPD02, S2FPC01) |

| | | | |
|-------------------------------------|---------|---|---|
| | | (2021.01.~2023.03.) | <ul style="list-style-type: none"> - 차세대 기기 성능향상 및 전력절감에 핵심, 전력관리반도체 3종 - 전력 소비 및 발열 낮추는 자체 기술 적용, 동작 효율 최고 91%까지 향상 - 메모리용 전력관리반도체 라인업 지속확대 및 기술 리더십 강화 <input type="checkbox"/> 차량 인포테인먼트 프로세서용 전력공급반도체(S2VPS01) <ul style="list-style-type: none"> - 차량용 시스템 안전기준 '에이실-B' 인증 획득, 기능 안전성 강화 - 발열 차단 기능, 자가 진단 기능 등 시스템 안정성 강화 <input type="checkbox"/> 생체인증카드용 원칩 지문인증 IC 출시(S3B512C) <ul style="list-style-type: none"> - 하드웨어 보안칩(SE, Secure Element), 지문 센서, 보안 프로세서 기능을 하나의 IC로 통합 - 보안 국제 공통 평가 기준(CC, Common Criteria)의 EAL6+ 등급 획득, 글로벌 온라인 카드 결제 기술표준(EMVCo) 인증 및 마스터카드의 생체 인식 평가 통과로 보안성 입증 |
| | Foundry | 2.5D 반도체 패키지 기술 'I-Cube4' (2021.05.) | <input type="checkbox"/> 로직칩과 4개의 HBM칩을 한 패키지에 구현하여 하나의 반도체처럼 동작 <ul style="list-style-type: none"> - 실리콘 인터포저를 적용해 안정적 전력 공급 및 초미세 배선 구현 - 100마이크로미터 수준의 얇은 인터포저 변형을 막는 반도체 공정/제조 노하우 적용 <input type="checkbox"/> 열 방출 성능 우수한 독자 구조로 생산기간 단축 및 수율 향상 |
| 8나노 RF 공정 (2021.06.) | | <input type="checkbox"/> 서브 6GHz 및 밀리미터파까지 지원하는 5G 통신용 RF(Radio Frequency) 공정 <ul style="list-style-type: none"> - 멀티 채널, 멀티 안테나 지원 원칩 솔루션으로 소형, 저전력, 고품질 통신 제공 <input type="checkbox"/> 독자 개발 RF 전용 반도체 소자 'RFeFET(RF extremeFET)' 적용해 RF 성능 향상 <ul style="list-style-type: none"> - 전자의 이동 통로인 채널 주변부에 물리적 자극을 가해 전자 이동 특성 극대화 <input type="checkbox"/> 전 세대 14나노 RF 공정 대비 전력 효율 35% 증가, 아날로그 회로 면적 35% 감소 <ul style="list-style-type: none"> - RFeFET의 성능이 크게 향상되어 칩의 전체 트랜지스터 수 감소 | |
| 2.5D 반도체 패키지 기술 'H-Cube' (2021.11.) | | <input type="checkbox"/> 실리콘 인터포저 및 하이브리드 기판을 사용한 2.5D 솔루션 'Hybrid Cube' <ul style="list-style-type: none"> - 인터포저 위에 로직과 고대역폭 메모리(HBM)를 배치, 최대 6HBM 집적 구현 - 하이브리드 기판은 상단의 고사양 메인 기판이 로직/메모리 칩을 연결하고, 대면적 구현이 용이한 하단의 보조 기판이 시스템 보드 연결을 담당하는 이중 구조 - 두 기판을 전기적으로 연결하는 솔더볼(Solder ball) 간격을 35% 좁혀 기판 크기 감소 - 칩 분석기술 적용해 안정적으로 전원을 공급하고 신호의 왜곡 및 손실을 축소 - 고성능/대면적이 요구되는 데이터센터, AI, 네트워크 등 분야 반도체에 최적화 | |
| 세계 최초 GAA 기술 적용 3나노 공정 (2022.06.) | | <input type="checkbox"/> 세계 최초 Gate-All-Around(GAA) 트랜지스터 기술 적용한 3나노 공정 양산 <ul style="list-style-type: none"> - 나노시트 활용한 독자적 GAA 기술 'MBCFET' 적용해 전력효율 및 성능 극대화 - 3나노 1세대 공정은 5나노 대비 전력 45%↓, 성능 23%↑, 면적 16%↓ <input type="checkbox"/> GAA는 핀펫의 기술적 한계를 극복하여 공정 미세화 지속을 가능케 하는 기술 <ul style="list-style-type: none"> - 채널의 모든 면을 게이트가 감싸 전류제어 특성 향상, 동작전압 및 전력소모 감소 - 채널을 수직 적층한 구조로 단위 면적당 채널폭 및 전류량이 증가하며 성능 향상 - 채널 폭을 조절할 수 있어 설계 자유도 향상 <input type="checkbox"/> 에코시스템 파트너들과 검증된 3나노 설계 인프라 및 서비스 제공 중 <input type="checkbox"/> 고성능·저전력HPC용 시스템 반도체, 모바일SOC 등에 적용 확대 계획 | |
| SDC | DP | 갤럭시 S21용 저소비전력 OLED (2021.01.) | <input type="checkbox"/> 저소비전력, 고휘도 혁신 OLED 디스플레이 양산 <ul style="list-style-type: none"> - S21 시리즈: 6.24" · 6.67" · 6.81" QHD+(3,200×1,440) - 신규 유기재료 적용으로 발광효율 개선: 전작 대비 소비전력 16% 개선 - 휘도·명암비 향상으로 우수한 야외시인성 확보 (Max/HBM 420/800 →500/1100nit, Peak 1,785nit) → Sunlight Visibility 인증(UL, 글로벌 안정인증회사) |
| | | 갤럭시Z 폴드3용 폴더블 OLED개발 (2021.08.) | <input type="checkbox"/> 다양한 신기술의 폴더블 최초 적용 <ul style="list-style-type: none"> - 7.6" QXGA+7.55" (2,208×1,768) - 언더 패널 카메라(Under Panel Camera) 기술로 화면 사각지대 제거 - 에코스퀘어(Eco2) 기술로 전작 대비 배터리 소모 절감 |
| | | 55/65" QD-Display | <input type="checkbox"/> 세계 최초 TV향 QD-Display (55" UHD, 65" UHD) <ul style="list-style-type: none"> - BT2020 90% 업계 최고의 넓고 선명한 색 표현 |

| | | |
|--|---|--|
| | (2022.01.) | <ul style="list-style-type: none"> - 전방위 균일하게 빛을 발하는 QD 특성으로 어느 각도에서도 최고의 휘도와 색감 구현 - 뛰어난 HDR 성능, 깊고 디테일한 Black 표현 |
| | 34" QD-Display (2022.03.) | <input type="checkbox"/> 세계 최초 모니터형 QD-Display (34" QHD) <ul style="list-style-type: none"> - 175Hz, 0.1ms, 1800r, HDR True Black, G-Sync 지원으로 최고의 게이밍 경험 제공 - 뛰어난 색, 시야각, 명암비 특성 및 유해 블루라이트를 최소화 |
| | 갤럭시Z 폴드4용 폴더블 OLED개발 (2022.08.) | <input type="checkbox"/> 전작비 추가적인 개선 진행 <ul style="list-style-type: none"> - 카메라 성능을 유지하면서 Under Panel Camera 영역 시인성 크게 개선, 대화면 경험 강조 - 투과율이 개선된 에코스퀘어 플러스(Eco2 OLED Plus)로 에너지 효율 증가 - FRP(Fiber Reinforced Plastics)-Digitizer 일체형을 통한 원가 및 무게 저감 |
| | 3.36" 850ppi 초고해상도VR 개발 (2023.02.) | <input type="checkbox"/> 초고해상도 (850ppi) OLED 적용 VR <ul style="list-style-type: none"> - Screen Door Effect Free solution 으로 체감 해상도 1,100 ppi 달성 - 기존 Square 대비 Round Shape 적용으로 Set Design 자유도 향상 |
| | 갤럭시북3 프로용 14/16" OLED개발 (2023.02.) | <input type="checkbox"/> 세계최대 Size (16") OCTA 기술 최초 상품화 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 스마트폰에 적용했던 Touch 일체형 기술인 OCTA 기술을 중형 노트북용 OLED로 확대적용 - 신소재 및 공정기술 개발로 패널 Dead Space 최소화 - 48~120Hz 가변주사율 노트북 OLED 최초 적용으로 소비전력 감소 |
| | HP Elitebook용 16" OLED개발 (2023.04.) | <input type="checkbox"/> OLED 유기재료 성능개선으로 저소비전력, 장수명 달성 <ul style="list-style-type: none"> - 16" WQ+ (2,880 x 1,800, 16:10) - 48~120Hz, VRR (Variable Refresh Rate) 적용하여 AMD Freesync Premium Pro 인증, 최적 Game환경제 공 |

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

2. 전문가와의 이해관계